



# 億而得微電子股份有限公司

## Yield Microelectronics Corporation

### 公開說明書

(現金增資發行新股辦理上市前公開承銷暨股票初次上市用稿本)

- 一、 公司名稱：億而得微電子股份有限公司
- 二、 本公開說明書編印目的：現金增資發行新股辦理上市前公開承銷暨股票初次上市用稿本。
  - (一) 股票來源：現金增資發行新股。
  - (二) 種類：記名式普通股，每股面額新台幣壹拾元整。
  - (三) 股數：現金增資發行新股2,616,000 股。
  - (四) 金額：新台幣26,160,000元整。
  - (五) 發行條件：
    1. 本次現金增資發行新股2,616,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣26,160,000元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算數平均數之七成為上限，訂為每股新臺幣60.00元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標格認購，公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格每股新臺幣91.49元為之，惟均價高於最低承銷價格之1.25倍，故每股發行價格以新臺幣75.00元溢價發行。
    2. 本次現金增資依公司法267條規定，保留發行新股約10%，計262,000股由本公司員工認購，員工若有認購不足或放棄認購部分，則授權董事長洽特定人認購之，其餘 90%計2,354,000股全數委託證券承銷商對外辦理公開承銷。
    3. 本次現金增資發行新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
  - (六) 公開承銷比例：本次現金增資發行新股總數約90%，共計2,354,000股。
  - (七) 承銷及配售方式：採全數競價拍賣方式辦理承銷。
- 三、 本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：請參閱公開說明書第58頁至第65頁。
- 四、 本次發行之相關費用
  - (一) 承銷費用：包含輔導費及承銷手續費等費用，約新台幣500萬元整。
  - (二) 上市審查費：新台幣50萬元整。
  - (三) 其他費用：包括會計師、律師及印刷等費用，合計約新台幣350萬元整。
- 五、 有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
- 六、 本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。
- 七、 投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容，並應注意公司之風險事項：請參閱本公開說明書第3頁至第7頁。
- 八、 本公開說明書，適用於初次申請有價證券創板上市，並計劃以現金增資發行新股委託證券承銷商辦理創板上市前之公開銷售。
- 九、 本公司係創板上市公司，相關營運風險較高。
- 十、 本次現金增資所發行之股票，為因應證券市場價格之變動，證券承銷商必要時得依規定進行安定操作。
- 十一、 股票初次申請創板上市案件，掛牌後首五個交易日無漲跌幅之限制，投資人應注意交易之風險。
- 十二、 本公司係依上市審查準則第二十九條第一項之規定申請股票在創板上市之公司，並未被要求獲利之上市條件，且所營業務具有相當之風險性，僅限符合資格之合格投資人買賣，請投資人特別注意。
- 十三、 本公司於掛牌上市年度及其後三個會計年度內，繼續委任主辦證券承銷商協助本公司遵循中華民國證券法令、臺灣證券交易所章則暨公告事項及上市契約等規章規範；如上市掛牌期間發生與主辦證券承銷商終止委任關係時，應於終止委任生效日起一個月內委任其他證券承銷商繼任。
- 十四、 查詢本公開說明書之網址：公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>

億而得微電子股份有限公司 編製

中華民國 一 一 年 五 月 六 日 刊 印





# 發行人之產業、營運及其他重要風險

## 一、產業風險

### (一) 新製程開發驗證時間長

近年來由於半導體市場持續擴大，雖然市場有供應者很早即提出擁有邏輯製程嵌入式NVM SIP技術，但NVM SIP設計品質影響後續驗證流程(qualification flow)進度，當SIP Macro完成後，會進行testchip製作，並測試NVM SIP特性(characterization)是否符合要求，若未達規格要求，即需改版，此會影響NVM SIP上架時程。

#### 因應對策：

在研發活動上，持續積極尋找專業人才加入公司，縮短新製程之驗證時間，並持續開發技術難度高之NVM SIP，強化公司競爭力並積極建立行銷管道，拓展產品市場。本公司研發之NVM SIP面積小、光罩數少、功能強CP值高，在中容量市場以下具競爭力，且能滿足不同市場規格要求；本公司將透過強化公司產品技術創新之特色，提升國內外客戶對公司之專業形象。

## 二、營運風險

### (一) 公司規模、品牌知名度與影響力不足，導致可能價格制定與議價能力較弱

由於本公司營運規模較一般上市櫃同業小，本公司須考量開發進度與成敗所能承受之風險，若無法順利將研發成果轉變成自有產品銷售以挹注營業收入，將對公司未來之營運及獲利產生風險。由於半導體市場商機大，然而本公司營運規模較小，且在全球品牌知名度較低，故其面臨市場競爭壓力大。

#### 因應對策：

本公司將透過強化公司產品技術創新之特色，提升國內外客戶對公司之專業形象；並且透過晶圓代工廠或整合元件製造廠之推薦多數國際大型IC設計公司多是經由晶圓代工廠已合作的嵌入式NVM SIP解決方案來決定採用的對象，除非是供應商已累積相當知名度，不然仍然信任晶圓代工廠所推薦之方案。

### (二) NVM SIP設計專業人才培育不易

隨著智慧手機的成長，且眾多廠商開始布局車用及物聯網，以及人工智慧市場逐步發酵，也使得全球半導體設計產業產值不斷升高，因此NVM SIP設計專業人才需求增加，惟目前市場上NVM SIP設計專業人才尚不足。

#### 因應對策：

本公司已積極尋找專業人才加入公司，另本公司亦積極推通上市計畫，提高本公司知名度，以吸引或留住優秀的專業人才。

## 三、其他重要風險：

本公司其他重要風險及因應措施，請詳本公開說明書「壹、二、風險事項」之說明。

綜上所述，就本公司所面臨之產業、營運及其他風險三方面，分別予以評估其各項可能風險之因應措施，本公司已具備因應相關風險之能力，各項因應措施尚屬穩當，尚可有效降低相關之風險。

## 億而得微電子股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：新台幣 268,100 仟元		公司地址：新竹縣竹北市台元街 28 號 7 樓之 2		電話：(03)552-6035			
設立日期：民國 90 年 9 月 4 日			網址： <a href="http://www.ymc.com.tw">www.ymc.com.tw</a>				
上市日期：不適用		上櫃日期：不適用		公開發行日期：102.04.22			
管理股票日期：不適用		發言人姓名：陳香綺 職稱：協理					
負責人：董事長 黃文謙		代理發言人：賴盈君 職稱：協理					
總經理 黃文謙							
股票過戶機構： 元大證券股份有限公司服務代理部			電話：(02)2586-5859		網址： <a href="http://www.yuanta.com">www.yuanta.com</a>		
股票承銷機構			地址：台北市承德路三段 210 號 B1 樓				
			兆豐證券股份有限公司		電話：(02)2327-8988	網址： <a href="http://www.megasec.com.tw">www.megasec.com.tw</a>	
			地址：台北市中正區忠孝東路二段 95 號 9 樓			凱基證券股份有限公司	
			電話：(02)2181-8888		網址： <a href="http://www.kgi.com.tw">www.kgi.com.tw</a>		
			地址：台北市中山區明水路 700 號 3 樓			元富證券股份有限公司	
電話：(02) 2325-5818		網址： <a href="http://www.masterlink.com.tw">www.masterlink.com.tw</a>					
地址：台北市大安區敦化南路二段 97 號 22 樓			玉山綜合證券股份有限公司		電話：(02)5556-1313		
網址： <a href="http://www.esunsec.com">www.esunsec.com</a>							
地址：台北市松山區民生東路三段 158 號 6 樓			國泰綜合證券股份有限公司		電話：(02) 7712-3967		
網址： <a href="http://www.cathaysec.com.tw">www.cathaysec.com .tw</a>							
地址：台北市大安區敦化南路二段 333 號 20 樓			最近年度簽證會計師：勤業眾信聯合會計師事務所 林心彤會計師、蔡美貞會計師				
電話：(03)578-0899		網址： <a href="http://www.deloitte.com.tw">www.deloitte.com.tw</a>					
地址：新竹市科學工業園區展業一路 2 號 6 樓			複核律師：蔚中傑律師事務所 蔚中傑律師				
電話：(02)3322-5516		網址： <a href="http://www.ctlaw.com.tw">http:// www.ctlaw.com.tw</a>					
地址：台北市忠孝東路二段 118 號 6 樓			信用評等機構：不適用				
電話：不適用		網址：不適用	地址：不適用				
評等標的		發行公司：不適用		無■；有□，評等日期：評等等級：			
		本次發行公司債：不適用		無■；有□，評等日期：評等等級：			
董事選任日期：111.06.23，任期：3 年			全體董事持股比例：16.22%（113 年 4 月 30 日）				
董事及持股超過 10%股東及其持股比例：							
職 稱	姓 名	持 股 比 例	職 稱	姓 名	持 股 比 例		
董 事 長	黃文謙	3.81%	獨 立 董 事	潘燕民	0.00%		
董 事	陳永華	4.41%	獨 立 董 事	吳清沂	0.00%		
董 事	陳鴻文	3.39%	獨 立 董 事	林月霞	0.00%		
董 事	鄭玗姝	2.50%	獨 立 董 事	李展南	0.02%		
董 事	魏雅庵	2.09%					
工廠地址：無				電話：無			
主要產品：可複寫嵌入式非揮發性記憶體 IP 授權及技術服務			市場結構：內銷 25.46%；外銷 74.54%		參閱本文之頁次 第 43 頁		
風 險 事 項			請參閱本公開說明書公司概況之風險事項		參閱本文之頁次 第 3 頁~第 7 頁		
去（112）年度			營業收入：187,384 仟元 稅前純益：38,267 仟元 每股盈餘(稅後)：1.19 元		參閱本文之頁次 第 67 頁		
本次募集發行有價證券種類及金額			請參閱本公開說明書封面				
發行條件			請參閱本公開說明書封面				
募集資金用途及預計產生效益概述			請參閱本公開說明書：參、發行計畫及執行計畫				
推薦證券商執行過額配售及價格穩定之相關資訊			本公司已與主辦證券商簽訂過額配售協議書，並協調相關事宜。				
本次公開說明書刊印日期：113 年 05 月 06 日			刊印目的：現金增資發行新股辦理股票上市前公開承銷暨股票初次上市用				
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄。							

# 億而得微電子股份有限公司

## 公開說明書目錄

壹、公司概況 .....	1
一、公司簡介 .....	1
(一)設立日期 .....	1
(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話 .....	1
(三)公司沿革 .....	1
二、風險事項 .....	3
(一)風險因素 .....	3
(二)訴訟或非訴訟事件 .....	4
(三)公司董事、監察人、經理人及持股超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書列印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響 .....	5
(四)發行公司於最近一會計年度或申請上市會計年度內，其子公司符合會計師查核簽證財務報表規則第二條之一第二項及會計師受託查核簽證金融機構財務報表相關規定第五條規定之重要子公司標準之一者，應增列該子公司之風險事項說明 .....	5
(五)外國發行公司應增列敘明外國發行公司註冊地國及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、外匯管制、租稅及相關法令，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並說明所採行之因應措施 .....	5
(六)本國發行公司或外國發行人初次申請股票在創新板上市者，應增列敘明擁有之關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式，及因重大技術、產品、政策、經營模式變化、核心技術人員變動等可能導致之風險，並說明所採行之因應措施 .....	5
(七)其他重要事項 .....	7
三、公司組織 .....	8
(一)組織系統 .....	8
(二)關係企業圖 .....	10
(三)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 .....	11
(四)董事及獨立董事 .....	13
(五)發起人 .....	22
(六)最近年度(112 年度)支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 .....	23
(七)分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。 .....	27
(八)發行人之非董事，而實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營而實質指揮董事執行業務者，應增列敘明上開人士之姓名、經（學）歷、持有股份、目前兼任發行人及其他公司之職務、與發行人董事及監察人之關係及對發行人實質控制情形，另外國發行人並應敘明上開人士依註冊地國法令規定之法律責任 .....	28
(九)本國發行公司或外國發行人初次申請股票在創新板上市者，應增列敘明核心技術人員之資歷簡歷 .....	28
四、資本及股份 .....	29
(一)股份種類 .....	29
(二)股本形成經過 .....	29

(三)最近股權分散情形.....	30
(四)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料.....	32
(五)公司股利政策及執行狀況.....	33
(六)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響.....	33
(七)員工、董事及監察人酬勞.....	33
(八)公司買回本公司股份情形.....	34
五、公司債(含海外公司債)辦理情形.....	34
六、特別股辦理情形.....	34
七、參與發行海外存託憑證之辦理情形.....	34
八、員工認股權憑證辦理情形.....	34
九、限制員工權利新股辦理情形.....	34
十、併購辦理情形.....	34
十一、受讓其他公司股份發行新股尚在進行中者.....	34
<b>貳、營運概況.....</b>	<b>35</b>
一、公司之經營.....	35
(一)業務內容.....	35
(二)市場及產銷概況.....	43
(三)最近二年度及截至公開說明書刊印日止之從業員工人數.....	50
(四)環保支出資訊.....	50
(五)勞資關係.....	50
(六)資通安全管理：.....	51
(七)有無因應景氣變動之能力.....	52
(八)發行公司及其各子公司(包括母子公司間交易事項)之關係人間交易事項是否合理.....	52
(九)本國發行公司或外國發行人初次申請股票在創新板上市者，應增列下列事項.....	53
二、不動產、廠房及設備及其他不動產應記載事項.....	55
(一)自有資產.....	55
(二)使用權資產.....	55
(三)各生產工廠現況及最近二年度設備產能利用率：.....	55
三、轉投資事業.....	55
(一)轉投資事業概況.....	55
(二)綜合持股比例.....	55
(三)上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司財務績效及財務狀況之影響.....	56
(四)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，發生公司法第一百八十五條情事或有以部分營業、研發成果移轉子公司者，應揭露放棄子公司現金增資認購情形，認購相對人之名稱、及其與公司、董事、監察人及持股比例超過百分之十股東之關係及認購股數.....	56
四、重要契約.....	56
<b>參、發行計畫及執行情形.....</b>	<b>58</b>
一、前次現金增資、併購或受讓其他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計畫分析.....	58

二、本次現金增資、發行公司債、發行員工認股權憑證或限制員工權利新股計畫應記載事項.....	58
三、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項.....	65
四、本次併購發行新股應記載事項.....	65
<b>肆、財務概況.....</b>	<b>66</b>
一、最近五年度簡明財務資料.....	66
(一)簡明資產負債表及綜合損益表.....	66
(二)影響上述簡明財務報表作一致性比較之重要事項如會計變動、公司合併或營業部門停工等及其發生對當年度財務報告之影響.....	68
(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見.....	68
(四)財務分析.....	69
(五)會計項目重大變動說明.....	71
(六)本國發行人自公開發行後最近連續七年或外國發行人最近連續七年由相同會計師查核簽證者，應增列說明未更換之原因、目前簽證會計師之獨立性暨發行公司對強化會計師簽證獨立性之具體因應措施.....	71
(七)外國發行公司得僅列示最近三年度簡明財務資料.....	71
(八)外國發行公司列示之財務報表為最近兩年度及最近期經會計師查核或核閱之合併財務報告，如係申請創新板第一上市者，為最近一年度及最近期經會計師查核或核閱之合併財務報告.....	71
二、財務報告應記載事項.....	72
(一)發行人申報募集發行有價證券時之最近年度財務報告及會計師查核報告，並應加列最近一季依法公告申報之財務報告.....	72
(二)最近年度發行人經會計師查核簽證之年度個別財務報告。但不包括重要會計項目明細帳.....	72
(三)發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告，應併予揭露.....	72
三、財務概況其他重要事項.....	72
(一)公司及其關係企業最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對公司財務狀況之影響.....	72
(二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者，應揭露資訊.....	72
(三)期後事項.....	72
(四)其他.....	72
四、財務狀況及經營結果檢討分析.....	73
(一)財務狀況.....	73
(二)財務績效.....	74
(三)現金流量.....	74
(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	75
(五)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	75
(六)其他重要事項.....	75
<b>伍、特別記載事項.....</b>	<b>76</b>
一、內部控制制度執行狀況.....	76

二、委託經金融監督管理委員會核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露該信用評等機構所出具之評等報告.....	76
三、證券承銷商評估總結意見.....	76
四、法律意見書.....	76
五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見.....	76
六、前次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經本會通知應自行改進事項之改進情形.....	76
七、本次募集與發行有價證券於申報生效時經金融監督管理委員會通知應補充揭露之事項.....	76
八、公司初次上市、上櫃或前次及最近三年度申報(請)募集與發行有價證券時，於公開說明書中揭露之聲明書或承諾事項及其目前執行情形.....	76
九、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容.....	76
十、最近年度及截至公開說明書刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形.....	76
十一、證券承銷商、發行人及其董事、監察人、總經理、財務或會計主管以及與本次申報募集發行有價證券案件有關之經理人等人出具不得退還或收取承銷相關費用之聲明書.....	76
十二、發行人辦理現金增資或募集具股權性質之公司債，並採詢價圈購對外公開承銷之案件，證券承銷商及發行人等出具不得配售予關係人及內部人等對象之聲明書.....	76
十三、本國發行公司自行評估內部控制制度作成之內部控制聲明書及委託會計師進行專案審查取具之報告書.....	76
十四、發行公司之公司治理運作情形.....	77
十五、發行公司與同屬集團企業公司間有業務往來者，應各出具書面聲明或承諾無非常規交易情事；無業務往來者，應由申請公司出具承諾日後有往來時必無非常規交易.....	80
十六、發行公司於申請上市會計年度及其上一會計年度已辦理與辦理中之大量現金增資發行新股，及是否產生相當效益之評估.....	80
十七、發行公司是否有與其他公司共同使用申請貸款額度.....	80
十八、發行公司有無因非正當理由仍有大量資金貸與他人.....	80
十九、具有上市審查準則第六條之一所規定申請之公司者，應增列事項.....	80
二十、具有上市審查準則第十六條所規定之公司者，應增加揭露資訊.....	80
二十一、發行公司有上市審查準則補充規定第十條或第二十六條所列各款情事者，應將該非常規交易詳細內容及處理情形充分揭露，並提報股東會.....	80
二十二、本國發行公司為普通申請公司債上市者，應增列之事項.....	80
二十三、充分揭露發行公司與證券承銷商共同訂定承銷價格之依據及方式.....	80
二十四、發行公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至之員工認股權憑證採內含價值法，於申請公司股票上市後對財務報表可能之影響.....	80
二十五、依上市審查準則第四條第二項、第三項、第二十八條之一第五項、第六項、第二十九條第一項、第二項、或屬科技事業、文化創意事業申請股票初次上市，且委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，並保留一定比例採洽商銷售方式辦理配售者，應增列配售名單、協議認購股數、協議配售總股數、占公開銷售總股數之比例及配售股票之集保期間與賣出限制等事項.....	80
二十六、證券承銷商應就前款配售名單合理性、配售股數、占公開銷售總股數之比例、配售股票賣出限制、繳款資力及協議事項妥適性出具評估意見.....	80



二十七、本國發行公司或外國發行公司依第十三款規定委託證券承銷商辦理上市前公開銷售者，本國發行公司或外國發行人及證券承銷商應出具絕無以任何方式或名目，提供直接或間接利益予洽商銷售投資人或其指定人之聲明書。該洽商銷售投資人亦應出具絕無要求或收取發行公司或承銷商以任何方式或名目提供之直接或間接利益之聲明書.....	81
二十八、外國發行公司有上市審查準則第二十八條之七第一項第三款或三十四條第二項第二款情事者，應將有關股東權益保護之重要事項因與註冊地國法令之強制規定抵觸，致未能增訂於公司章程或組織文件之重大差異充分揭露.....	81
二十九、其他基於有關規定應出具之書面承諾或聲明.....	81
三十、發行人視所營事業性質，委請在技術、業務、財務等各方面具備專業知識及豐富經驗之專家，就發行人目前營運狀況及本次發行有價證券後之未來發展，進行比較分析並出具意見者，應揭露該等專家之評估意見.....	81
三十一、上市上櫃公司應就公司治理運作情形應記載事項.....	81
三十二、其他必要補充說明事項.....	101
<b>陸、重要決議、公司章程及相關法規.....</b>	<b>114</b>
一、重要決議應記載與本次發行有關之決議文（含章程新舊條文對照表及盈餘分配表）.....	114
二、未來股利發放政策.....	114
三、未來辦理增資計畫及其對獲利能力稀釋作用之影響事項.....	114
四、本國發行公司或外國發行人召開股東會討論股票初次申請上市暨辦理上市前現金增資新股公開銷售，並將保留該新股之一定比例採洽商銷售方式辦理配售，應於股東會召集事由列舉並說明相關事宜，並應完整揭露股東會決議內容.....	114
附件一：民國111年度個別財務報告書暨會計師查核報告	
附件二：民國112年度個別財務報告書暨會計師查核報告	
附件三：內部控制聲明書	
附件四：內部控制制度審查報告	
附件五：法律意見書	
附件六：誠信聲明書	
附件七：不得退還或收取承銷相關費用之聲明書	
附件八：不受理特定投標對象聲明書	
附件九：財務業務往來無非常規交易情事聲明書	
附件十：證券承銷商評估總結意見	
附件十一：承銷價格計算書	
附件十二：與本次發行有關之決議文	
附件十三：盈餘分配表	
附件十四：公司章程(含章程修正條文對照表)	
附件十五：股票初次申請創新板上市證券承銷商評估報告	
附件十六：創新板上市前現金增資發行新股證券承銷商評估報告	

## 壹、公司概況

### 一、公司簡介

#### (一) 設立日期

民國 90 年 9 月 4 日

#### (二) 總公司、分公司及工廠之地址及電話

公司地址：新竹縣竹北市台元街 28 號 7 樓之 2

電話：(03)5526035

#### (三) 公司沿革

年份	公司大事紀
90 年 09 月	公司正式成立
90 年 10 月	現金增資 47,000 仟元，實收資本額增至 52,000 仟元
93 年 11 月	現金增資 20,000 仟元，實收資本額增至 72,000 仟元
94 年 01 月	現金增資 19,120 仟元，實收資本額增至 91,120 仟元
95 年 11 月	現金增資 40,000 仟元，實收資本額增至 131,120 仟元
97 年 09 月	與聯電(UMC)簽署合約聯合開發 0.35 微米及 0.25 微米 YMC MTP 矽智財元件
97 年 10 月	與新唐科技(Nuvoton)簽署合約聯合開發 0.6 微米、0.5 微米及 0.35 微米 YMC MTP 矽智財元件
97 年 11 月	現金增資 20,000 仟元，實收資本額增至 151,120 仟元
97 年 12 月	旺宏電子宣佈與本公司合作，於 0.5 微米高壓(HV)製程成功開發 MTP SIP
98 年 03 月	宣佈於 0.35um 製程推出 1.5V 低電壓讀取 MTP SIP
98 年 03 月	與聯電(UMC)聯合開發合約增加 0.18 微米及 0.13 微米製程
98 年 11 月	現金增資 15,000 仟元，員工認股權憑證增資 6,940 仟元，實收資本額增至 173,060 仟元
99 年 01 月	與鉅晶電子(Maxchip)簽署合約聯合開發 0.18 微米、0.13 微米及 90 奈米 YMC MTP 矽智財元件
99 年 02 月	與世界先進(VIS)簽署合約聯合開發 0.5 微米、0.35 微米、0.25 微米及 0.18 微米 YMC MTP 矽智財元件
99 年 03 月	與日本沖電氣公司(OKI)簽署合約聯合開發 0.6 微米、0.5 微米及 0.35 微米 YMC MTP 矽智財元件
99 年 11 月	與馬來西亞 Silterra 簽署合約聯合開發 0.18 微米 YMC MTP 矽智財元件
99 年 11 月	現金增資 7,000 仟元，員工認股權憑證增資 7,810 仟元，實收資本額增至 187,870 仟元
100 年 07 月	與聯電(UMC)聯合開發合約增加至 40 奈米製程
100 年 09 月	聯電(UMC)宣佈與 YMC 成功合作開發專案，推出面積最小的 MTP SIP 解決方案，0.18 微米製程 100 年下半年進入量產
100 年 12 月	員工認股權憑證增資 11,230 仟元，實收資本額增至 199,100 仟元
101 年 01 月	與旺宏電子(MXIC)簽署合約聯合開發 0.5 微米、0.45 微米及 0.35 微米 YMC MTP 矽智財元件
101 年 03 月	推出多款 MTP SIP，切入 In cell touch 及 AMOLED driver 應用
101 年 03 月	推出高速、寬電壓、低光罩層數 1M bits MTP SIP
101 年 03 月	宣布於高壓製程 3.3V 及 5V 元件平台開發完成 0.18um、0.162um、0.13um、0.11um、90nm、55nm 製程技術 MTP SIP

年份	公司大事紀
101 年 05 月	與韓商美格納(MagnaChip)簽署合約聯合開發 0.35 微米及 0.18 微米 MTP 矽智財元件
101 年 07 月	員工認股權憑證增資 4,000 仟元，實收資本額增至 203,100 仟元
101 年 12 月	現金增資 10,000 仟元，實收資本額增至 213,100 仟元
101 年 12 月	與台積電(TSMC)簽訂 MTP 矽智財元件授權合約
102 年 04 月	完成補辦公開發行
102 年 11 月	與韓商美格納(MagnaChip)共同開發之 0.35 微米及 0.18 微米 MTP 矽智財元件，成功地導入量產平台
102 年 12 月	推出世界最小嵌入式邏輯製程 MTP IP，切入觸控芯片及 MCU 應用
103 年 05 月	與日本東芝(Toshiba)簽訂 MTP 矽智財元件授權合約
103 年 05 月	辦理現金增資 20,000 仟元，增資後實收資本額增至 233,100 仟元。
103 年 09 月	辦理現金增資 15,000 仟元，增資後實收資本額增至 248,100 仟元。
103 年 10 月	登錄興櫃
104 年 05 月	MTP IP 與 EEPROM IP 整合成功且共用線路
104 年 09 月	MTP IP 通過 150C 高溫測試，可提供車載市場
104 年 12 月	完成低電流寫入 MTP IP 設計，並進行驗證中，可提供 IOT 市場使用
105 年 03 月	與新加坡商 Globalfoundries 簽署合約開發 0.11 微米及 0.18 微米 MTP IP 矽智財元件
105 年 05 月	提出簡易操作低容量取代 Fuse IP
105 年 10 月	與世界先進積體電路股份有限公司簽訂專利授權契約
106 年 01 月	台積電(TSMC)自製 MTP(YMC cell)，客戶進入量產
106 年 01 月	Toshiba 自製 MTP(YMC cell)，完成開發
106 年 07 月	世界先進自製 MTP(YMC cell)，完成開發
106 年 07 月	辦理現金增資 20,000 仟元，增資後實收資本額增至 268,100 仟元。
106 年 10 月	與歐美重量級客戶聯手合作，宣布於 0.18um BCD 製程成功開發 Digital Trimming(數位調適)解決方案。
107 年 4 月	Nexchip 簽署合約開發 0.11 微米 MTP IP 矽智財元件
107 年 4 月	Nexchip 簽署合約開發 0.09 微米 MTP IP 矽智財元件
107 年 5 月	與新加坡商 Globalfoundries 開發 0.18 微米及 0.15 微米 G(IV)MTP IP 矽智財元件
107 年 11 月	與韓商 Hynix 簽署合約開發 0.11 微米及 MTP IP 矽智財元件
108 年 1 月	與廣州粵芯 Cansemi 簽署合約開發 0.18 微米 MTP IP 矽智財元件
108 年 1 月	與韓商 Hynix 簽署合約開發 0.18 微米 MTP IP 矽智財元件
108 年 2 月	與以色列商 Towerjazz 簽署合約開發 0.065 微米 MTP IP 矽智財元件
108 年 6 月	與韓商 Silicon Works 簽署合約開發 0.18 微米 MTP IP 矽智財元件
108 年 8 月	與工研院簽署合約開發射頻辨識讀取晶片
108 年 8 月	車規 Grade 0 MTP IP 矽智財元件完成開發
108 年 10 月	與韓商 TechwidU 簽署合約開發 0.18 微米 MTP IP 矽智財元件
108 年 12 月	韓商 Hynix 0.11 微米 MTP IP 矽智財元件完成開發
109 年 09 月	與上海華力微電子 HLMC 簽署合約開發 0.055 微米 MTP/OTP IP 矽智財元件
109 年 11 月	與矽創電子 Sitronix 簽署合約開發 0.11 微米 MTP IP 矽智財元件
110 年 2 月	與江西聯智 Celfras 簽署合約開發 0.18 微米 MTP IP 矽智財元件
110 年 8 月	與韓商 Hynix 簽署合約開發 0.11 微米 MTP IP 矽智財元件

年份	公司大事紀
111年1月	與中央大學簽署產學合作開發下一代矽智財元件
111年10月	與SK海力士系統集成電路(無錫)簽署合約開發0.18微米MTP IP矽智財元件
112年2月	與中央大學簽署產學合作開發新一代矽智財元件

## 二、風險事項

### (一)風險因素：

#### 1.利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

單位：新台幣仟元；%

項 目	111 年度	112 年度
利息收(支)淨額	1,433	3,139
兌換(損)益淨額	1,082	70
利息收(支)淨額占營收淨額比率	0.63%	1.68%
利息收(支)淨額占稅前淨利比率	1.76%	8.20%
兌換(損)益淨額占營收淨額比率	0.48%	0.04%
兌換(損)益淨額占稅前淨利比率	1.33%	0.18%

#### (1)利率變動

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止並無向金融機構借款之情形，故利率變動對本公司損益影響較低；但本公司仍定期注意銀行借款利率變動情形，並與銀行間保持良好關係，以取得較優惠利率，以降低利率變化對本公司損益產生之影響。

#### (2)匯率變動

本公司產品除內銷外，並外銷美國及亞洲各國，其外銷交易多以美元計價，由上表觀之，111年度產生兌換利益1,082仟元，112年度產生兌換利益70仟元，主係台幣升值所致。

本公司對外匯處理係以規避風險為原則，不以投機交易為目的，財務人員隨時注意金融資訊及外匯市場之變化，以充分掌握匯率走勢外，並加強建立與銀行間往來之關係，參酌外匯銀行建議，藉以使外匯避險操作更靈活。

#### (3)通貨膨脹變動

本公司未來將密切注意觀察物價指數變化，視通貨膨脹對本公司之影響，適時調整產品售價以反應成本上揚情形，減緩本公司承擔通貨膨脹之壓力。目前本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並未因通貨膨脹而產生重大影響。

#### 2.從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司專心本業，最近年度及截至公開說明書刊印日止並未從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之情形。本公司已制定「取得或處分資產處理準則」、「背書保證作業辦法」、「資金貸與他人作業程序」，並經股東會決議通過，未來本公司若有從事有關作業時，將依相關作業程序辦理並依法令規定即時且正確公告各項資訊。

#### 3.未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司未來研究發展計畫為因應客戶產品多元化需求，開發各式各樣應用領域SIP，如MCU應用、功率IC應用、觸控IC應用，建置客戶更完整MTP SIP資料庫的解決方案；與合作夥伴開發55、40奈米等製程技術，此類應用如通訊類相關產品，並專注於智慧電力，手機屏控制IC，手機屏驅動IC，物聯網(IOT)、MCU以及感應器市場的內建多次寫

入非揮發性記憶體SIP。

本公司的研發費用主要投入在產品的開發上，和當年度銷售金額不一定會有比例關係，本公司相信積極投入研發才能保有公司持續的競爭力，也才能維持現有的優勢，所以在各項研發經費的投入本公司不會因外在環境而有所影響，本公司110年度、111年度及112年度研發費用分別為89,596仟元、107,830仟元及108,127仟元，佔營業收入淨額比率分別為53.27%、47.00%及57.70%，本公司研發經費係依研發人力、新技術開發進度逐項編列，且持續投入研發資源，以符合市場之需求以及確保公司之競爭優勢。

4.國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司將持續注意國內外相關政策及法律變動，並即時因應變動所產生之影響；最近年度截至公開說明書刊印日止，並無國內外重要政策及法律變動對本公司財務業務產生重大影響之情形。

5.科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司一向重視研發人才之投入培養與產品技術之開發，亦持續注意國內外科技或產業變化，並著手評估新趨勢所產生之影響，經營階層已充分掌握未來市場方向或技術開發策略，若有影響將即時採取適當反應，故最近年度截至公開說明書刊印日止，科技改變及產業變化對公司財務業務並無重大不利影響。

6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司近年來不斷強化公司治理，以因應各種可能之企業危機，並針對各種危機迅速制定處理流程，即時回應，以保障公司之企業形象。最近年度截至公開說明書刊印日止，尚無因企業形象改變而對公司產生重大影響之情事。

7.進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並未有併購他公司之計畫。將來若有併購規畫，將秉持審慎評估之態度，充份考量合併之綜效，以確實保障股東權益。

8.擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司為研究、開發、銷售邏輯製程嵌入式 MTP 非揮發性記憶體 SIP 之公司，本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並未有擴廠之計畫。

9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1)在進貨集中方面

本公司為一家專業邏輯製程嵌入式 MTP 非揮發性記憶體 SIP 供應商，營運中並無進貨之情形，故不適用此項評估。

(2)在銷貨集中方面

本公司為一家專業邏輯製程嵌入式 MTP 非揮發性記憶體 SIP 供應商，營收對象主要為晶圓廠及 IC 設計公司，雖部分客戶銷貨收入有超過 10%之情形，惟所往來對象均為國內外知名之大廠，雖銷貨有集中之情形，但雙方往來關係維持良好，收款情形正常，故此類風險輕微。

10.董事、監察人或持股超過百分之十之大股東、股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，並無股權大量移轉之情事。

11.經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無經營權改變之情形。

12.其他重要風險及因應措施：無。

(二)訴訟或非訴訟事件：

1.公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非

訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其相關資料：無。

2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。

3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(三) 公司董事、監察人、經理人及持股超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響：

本公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，董事、監察人、經理及持股比例超過百分之十之大股東並未發生財務週轉困難或喪失債信情事，故無對本公司財務狀況發生影響之情事。

(四) 發行公司於最近一會計年度或申請上市會計年度內，其子公司符合會計師查核簽證財務報表規則第二條之一第二項及會計師受託查核簽證金融機構財務報表相關規定第五條規定之重要子公司標準之一者，應增列該子公司之風險事項說明：本公司無重要子公司，故不適用。

(五) 外國發行公司應增列敘明外國發行人註冊地國及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、外匯管制、租稅及相關法令，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並說明所採行之因應措施：不適用。

(六) 本國發行公司或外國發行人初次申請股票在創新板上市者，應增列敘明擁有之關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式，及因重大技術、產品、政策、經營模式變化、核心技術人員變動等可能導致之風險，並說明所採行之因應措施

#### 1. 關鍵核心技術

##### A. 獨特專利之 1T1C 核心技術

相較於其他記憶體 SIP 設計公司專注於僅能單次寫入且製程簡易之 OTP (One-Time Programming, 以下簡稱 OTP) 產品，本公司主要著墨於可多次讀寫且製程更為複雜之 MTP (Multi-Times Programming, 以下簡稱 MTP) 產品。藉由自行研發 1 電晶體 1 電容 (1 Transistor, 1 Capacitor, 以下簡稱 1T1C) 之存儲單元專利技術，成功開發出極具小面積優勢且可多次寫入之 MTP 產品。本公司 1T1C 存儲單元專利技術已發展至第七代，代表持續精進於面積的縮小與成本的降低，不但有利於增進客戶的競爭力，同時拓寬產品未來應用市場之廣度。

##### B. MTP SIP 技術領導公司

本公司之主要產品為 MTP SIP，相較於傳統製程便宜卻僅能一次性編程之 OTP SIP 或製程昂貴但可多次編程之 Flash SIP，MTP SIP 結合可多次編程且低成本兩者優勢，以其關鍵核心技術 1T1C 所研發之 MTP，具備毋需更改製程、不增加額外光罩層數及最小面積之優勢，且其第七代記憶體細胞，可將 MTP 面積降至小於競爭對手之 OTP 面積，藉此節省 IC 業者開發成本及提升設計彈性，為目前市場中最具競爭力之 MTP SIP。

#### 2. 創新能力

##### A. 多樣化寫入次數，提供客戶彈性選擇

鑑於市場應用亦有少量寫入次數需求，本公司憑藉早期成功開發寫入次數 100~10,000 次之 EEPROM（電子抹除式可複寫唯讀記憶體）產品之經驗，研發不同寫入規格之 SIP 產品，包含 100~10,000 次之 EEPROM、100~1,000 次之 MTP 及 1~100 次之 FTP，目前皆已量產，其中尤以 FTP 為當前市場獨有具備可量產之中低容量產品。本公司結合其獨特 1T1C 核心技術之小面積及低成本優勢，具有各式寫入次數、容量及面積之創新產品研發能力，滿足客戶多樣彈性應用 MTP SIP 之需求。

#### B.獨特設計架構，發展少量寫入次數之 OTP

本公司透過其創新設計架構—電子式抹除方式，搭配其核心技術 1T1C 之面積領先優勢，發展出在相同面積下，可電子式寫入 10 次之浮動閘極（Floating-gate）架構 OTP 產品；在單次寫入方面，更將面積縮小至同業之 80%，大幅提升產品競爭力，產品已獲客戶驗證，並於 0.18 $\mu\text{m}$ 、0.35 $\mu\text{m}$  等製程量產使用。

#### C.持續開發高階應用及研發特殊材料，突破既有框架

持續開發高階 SIP 設計方法與流程，發展可提供 100,000 寫入次數之 HEEPROM 產品，以符合工業控制、車用及電腦週邊等終端市場應用，目前已進入產品驗證階段；另由於現行 MTP 受寫入方式限制，無法成功應用於先進製程，本公司積極研發高精密度之非揮發性元件—高介電常數金屬閘極陣列（HKMG array），尋找適用於先進製程之 MTP 解決方案，目前進行產學合作初步量測且提出專利申請中。

### 3.因重大技術、產品、政策、經營模式變化、核心技術人員變動等可能導致之風險，並說明所採行之因應措施

#### (1)美中科技戰對半導體產業未來佈局之風險

近年來美中貿易戰已逐漸演變成半導體、人工智慧及 5G 通訊等領域之科技戰，各國政府陸續頒布半導體出口管制措施，限制先進製程設備及技術元件輸往中國大陸地區，以壓制其半導體技術之發展。惟中國大陸擁有全球最大之晶片市場，受到各國政府抵制政策之影響，將造成產業供應鏈移轉之風險，衝擊全球半導體產業發展，SIP 設計業者亦連帶受到波及，進而影響本公司之營收及獲利表現。

#### 因應措施：

依據美國頒布之出口管制條例，半導體禁令旨在限制中國大陸 10~20 奈米以下之先進製程發展技術，而針對 28 奈米以上之成熟製程則並非其主要管制目標。由於本公司 SIP 產品於中國大陸地區之佈局仍以 55 奈米及更成熟之製程節點為主，並未落於該管制條例之制裁名單中，故短期內對本公司營運狀況無產生直接之影響，未來本公司於中國市場亦持續朝往成熟製程方向發展，預期中國市場晶圓代工業者在先進製程技術受限下將積極擴充成熟製程產能，且在物聯網、電動車及工業等趨勢領域需求持續提升，將帶動電源管理、微控制器及 Wi-Fi 等晶片供不應求，有助於推升公司整體業績表現。

#### (2)主要產品市場占有率低對公司營運規模之風險

早期記憶體 SIP 產業由於技術發展受限，使得本公司主要產品 MTP SIP 雖可提供客戶多次讀寫之功能，惟因面積仍較 OTP SIP 為大而不具備相應之成本優勢，且下游 IC 設計業者多考量採以數顆面積較小之 OTP SIP 組合方案來取代其僅能一次性編寫之效能限制，進而與本公司產品產生排擠效應，故 MTP SIP 並非成為初期市場上主流採用之記憶體 SIP 技術，進而導致本公司營運規模不及同業競爭者之風險。

#### 因應措施：

本公司專注於 MTP 技術領域已累積多年開發經驗，透過自有記憶體細胞單元專利，已可將其 MTPSIP 面積縮小於同業之 OTPSIP，並完成晶圓廠功能及製程相關驗證且成功導入量產，論其產品效能及效益皆已優於同業競品。此外，考量 OTPSIP 仍占有較高之市占率，加上現有客戶對本公司 SIP 設計架構較為熟悉且亦提出 OTPSIP 產品相關需求，故本公司擬藉由新開發之創新技術，提供可電子式寫入十次或面積可縮小至現有供應商 SIP 之 80% 等產品競爭優勢，並透過合作客戶取得新製程平台投產機會，搶攻 OTPSIP 市場商機，目前本公司 OTPSIP 產品已獲客戶驗證採用，並用作 0.18 $\mu\text{m}$ 、0.35 $\mu\text{m}$  等製程量產使用。綜上所述，受惠於 IC 產品週期縮短及設計複雜度增加之產業趨勢，MTP SIP 市場需求及新應用領域將逐步浮現，另隨著半導體產業持續追求製程微縮技術發展，將帶動以 OTPSIP 應用為主之先進製程需求成長，本公司將逐步切入 OTPSIP 市場，並占有產業領先技術優勢，建置完整之記憶體 SIP 資料庫客製化解決方案，有效提升本公司產品競爭優勢及市占率。

#### (3) 專利權侵權之風險

矽智財(Silicon Intellectual Property ;SIP)在半導體供應鏈中屬於上游產業類別，本身就是一種智慧財產權的觀念，也是一種專利權行使的成果，專利權在 SIP 產業係為公司重要的無實體的財產權及資產，已受到法律認可和保護，其屬於公司整體之研發成果，未經本公司授權同意，不得任意抄襲使用，若有非法使用之情況，公司一定會循著法律途徑解決，以維護應有之權益。

#### 因應措施：

除了預防他人竊取本公司之專利外，本公司亦同時避免研發之技術與產品發生專利侵權之情事，公司長期對於市場上相關產業及競爭者之技術進行瞭解，且透過客戶與合作之晶圓廠代工廠商密切的訊息傳遞，加上可搜尋到之相關專利互相比對，力求減少專利侵權之發生。由於世界各國對專利權行使皆相當重視，也制定了相關規範，本公司持續將研發成果於相關國家進行專利申請，以綿密的專利保護傘，確保公司權益，維持競爭優勢。

#### (4) 新競爭者加入之風險

嵌入式非揮發性記憶體(NVM)SIP 為知識密集型產業，有別於其他矽智財產品，供應商通常由記憶體基本單元 bitcell(記憶胞)開始開發，直至 SIP Macro(SIP 區塊)完成，可供 IC 設計公司進行 SIP merge(合併)，其開發時程冗長，技術層次高，門檻相對困難，原本有意進入此一產業之競爭者就少，加上晶圓代工廠或整合元件製造廠自己使用為主或為了吸收更多客戶下單，其會自行開發盡量充實其 SIP 庫，包含 NVM SIP，免費提供客戶使用，以增加市佔率，故除非 NVM SIP 供應商產品技術之價值性高，否則很難藉由晶圓代工廠推廣至 IC 設計公司。

#### 因應措施：

科技技術進步常令人異想不到，必須隨時戰戰兢兢，本公司會將研發成果於相關國家進行專利申請，以專利保護傘，確保公司權益，同時要加快新技術腳步，建立產品差異化，盡量拉大與同業距離，與晶圓代工廠保持密切關係，進行策略結盟，於各個應用領域建構完整產品線，並提高產品創新和研發速度，成為 NVM SIP 產業領導供應商，提出業界領先的解決方案，如此則雖然有新競爭者加入，公司亦會有競爭力應付任何新的考驗。

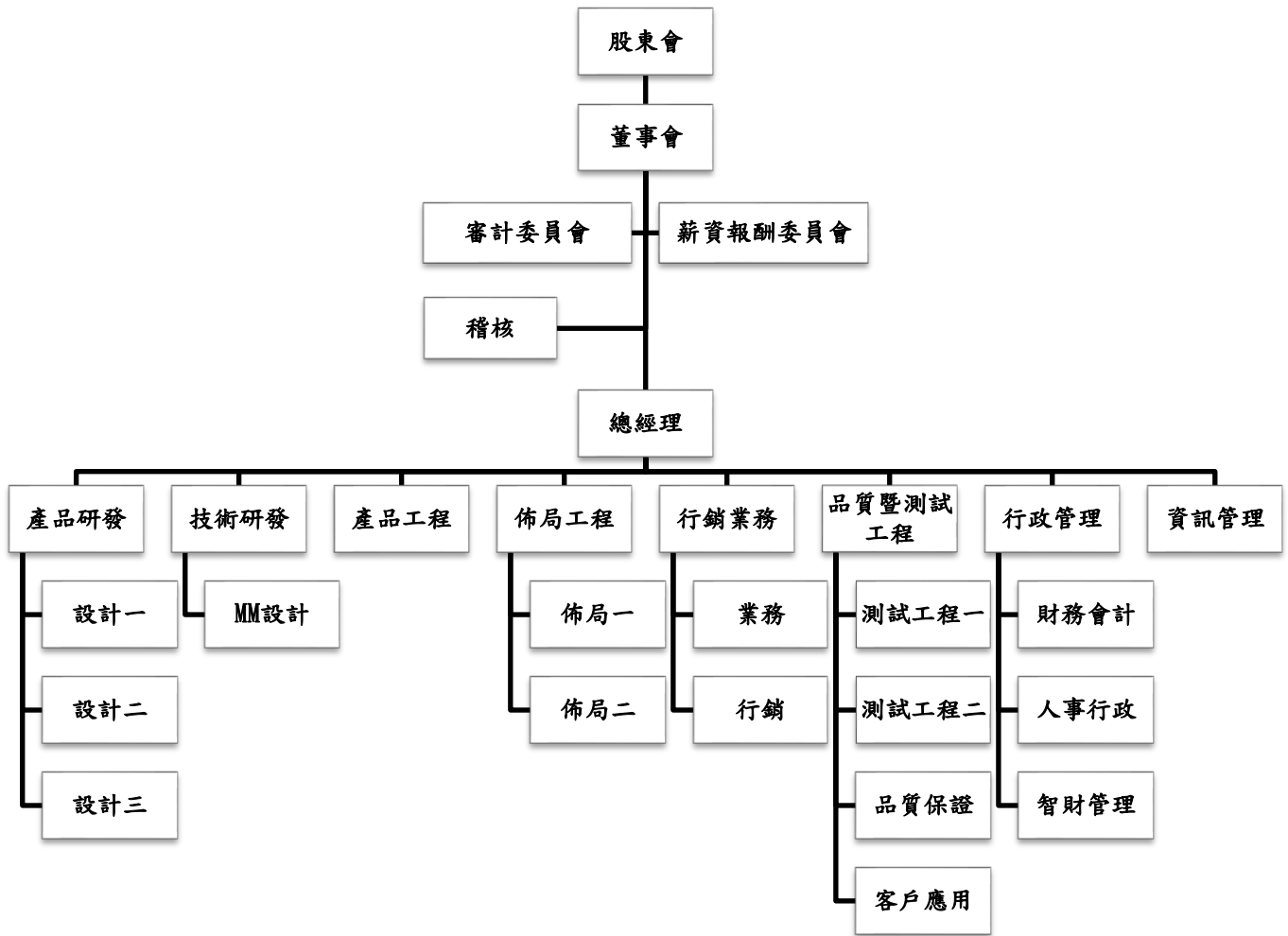
(七) 其他重要事項：無。



三、公司組織

(一)組織系統

1.組織結構



## 2. 各主要部門所營業務

單位		職掌概要
審計委員會		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。</li> <li>2.內部控制制度有效性之考核。</li> <li>3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</li> <li>4.涉及董事自身利害關係之事項。</li> <li>5.重大之資產或衍生性商品交易。</li> <li>6.重大之資金貸與、背書或提供保證。</li> <li>7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</li> <li>8.簽證會計師之委任、解任或報酬。</li> <li>9.財務、會計或內部稽核主管之任免。</li> <li>10.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。</li> <li>11.其他公司或主管機關規定之重大事項。</li> </ol>
薪資報酬委員會		以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
稽核室		協助董事會及經理人檢查、評估內部控制制度、管理規章及作業流程管理，並提供分析及建議，以確保內部控制制度得以持續有效運作。
總經理室		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.公司未來短、中、長程發展之營運目標及計畫之擬定及修訂。</li> <li>2.監督各部室執行營運計畫以達成公司營運目標、追求永續經營。</li> <li>3.對外公共關係之建立。</li> </ol>
產品研發	設計一、二、三	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.產品之技術開發與設計。</li> <li>2.整合公司資源，持續改進產品的性能及品質。</li> <li>3.協助客戶解決應用上問題。</li> <li>4.產品規格書製作。</li> <li>5.產品設計套件製作。</li> </ol>
技術研發	MM 設計	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.無線射頻之發射接收類比產品研究開發。</li> <li>2.數位產品的研究開發。</li> </ol>
產品工程	產品工程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.產品規格擬定。</li> <li>2.產品製作流程安排。</li> <li>3.產品特性驗證分析。</li> <li>4.產品特性改善建議。</li> <li>5.協助客戶使用產品。</li> <li>6.製程平台溝通窗口。</li> </ol>
佈局工程	佈局一、二	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.產品之電路佈局設計。</li> <li>2.協助客戶佈局嵌合併驗證。</li> </ol>
行銷業務	行銷、業務	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.年度銷售目標及營業計畫之擬定及執行，以達成年度行銷目標。</li> <li>2.新市場、新客戶之開發，以提升市場占有率。</li> <li>3.服務客戶各項需求及客戶訴怨受理與處理。</li> </ol>
品質暨測試工程	測試工程一	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.開發/維護產品相關之測試程式，使其能提供產品除錯/驗證工程之作業。</li> </ol>

單位		職掌概要
	測試工程二	2.提昇測試程式之偵錯能力，確保產品驗證之完整性，解決產品驗證相關之技術問題。 3.提供產品測試驗證結果相關資料。 4.提供產品相關量產測試流程。
	品質保證	1.提昇驗證效率，節省測試時間。 2.驗證完整產品特性，確認其結果是否符合規格。 3.協助產品 wafer die sort 及封裝收送貨事宜。 4.提供產品完整特性驗證結果報告。 5.不良原因的分析制度建立與執行。 6.產品可靠度測試與失效分析。 7.實驗室儀器校正管理。 8.協助提供客戶產品相關可靠度問題。 9.提供產品可靠度驗證結果報告。 10.撰寫維護 HTOL 相關測試程式。
	客戶應用	1.處理並回應客戶之應用問題。 2.客戶故障產品之分析。 3.產品應用狀況之掌握與回覆。 4.提供故障分析報告。
行政管理	財務會計	1.統籌公司的財務、會計、稅務及經營分析等事宜。 2.年度預算之編製、彙總及控制。 3.各項理財活動之調度及運用。 4.公司股東會、董事會及股務作業相關事宜。
	人事行政	1.負責公司有關人事、薪資、勞務、福利等管理制度之事項。 2.公司各項人力資源管理工作。 3.各項內部管理辦法制訂及後續執行追蹤。 4.其它有關人事、行政及總務作業。
	智財管理	1.文件及記錄管制作業。 2.產品及案件資料檢查與確認。 3.產品產出及銷售控管。 4.伺服器資料管理。
資訊管理	資訊管理	1.各項電腦化資訊系統軟體及硬體之規畫、維護與執行。 2.各項資訊系統及委外工程之協調與管理。 3.協助各部門之工作資訊科技化。 4.資安風險之分析與管控。

(二) 關係企業圖：無。

(三) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

113年4月30日;單位：股；%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人員取得工認股憑情形	備註
					股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)			職稱	姓名	關係		
總經理	中華民國	黃文謙	男	90.08.01	1,020,425	3.81	-	-	-	-	國立清華大學物理系學士 華邦電子(股)公司 行銷業務經理 凌巨科技(股)公司 行銷業務處長	1. 晶隼科技(股)公司 董事 2. 禹創半導體(深圳)有限公司 董事	-	-	-	-	註 1
技術研發副總經理	中華民國	吳政穎	男	108.09.11	45,234	0.17	52,924	0.20	-	-	國立交通大學電信工程所碩士 華邦電子(股)公司 資深工程師	-	-	-	-	-	
產品研發副總經理	中華民國	吳其沛	男	111.12.20	-	-	-	-	-	-	國立清華大學電子工程所碩士	-	-	-	-	-	
佈局工程協理	中華民國	陳英堂	男	108.09.11	219,712	0.82	-	-	-	-	國立中央大學環工所碩士 大內科技(股)公司 佈局工程師 新芯科技(股)公司 工程副理	-	-	-	-	-	
品質暨測試工程協理	中華民國	江政璋	男	108.09.11	-	-	-	-	-	-	國立聯合大學電子工程系學士 茂德科技(股)公司 測試工程師	-	-	-	-	-	

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人員取得工認憑情形	備註
					股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)			職稱	姓名	關係		
產品工程協理	中華民國	陳政揚	男	108.09.11	15,000	0.06	-	-	-	-	明新科技大學電子所碩士 漢磊科技(股)公司製程整合資深工程師	-	-	-	-	-	-
行銷業務協理	中華民國	陳香綺	女	111.12.20	3,000	0.01	-	-	-	-	靜宜大學西班牙語文學系學士 德勝科技業務開發經理	-	-	-	-	-	-
行政管理協理兼任財會主管、公司治理主管	中華民國	賴盈君	女	101.10.01	14,037	0.05	-	-	-	-	中華大學財務管理系學士 正文科技(股)公司資深管理師	-	-	-	-	-	-
稽核主管	中華民國	王承永	男	110.11.15	-	-	-	-	-	-	國立成功大學高階主管經營管理碩士 精英電腦股份有限公司稽核資深經理 豐達科技股份有限公司管理部經理 神達電腦科技股份有限公司稽核副理	-	-	-	-	-	-
資訊安全主管	中華民國	賴新格	男	112.08.02	-	-	1,402	0.01	-	-	交通大學管理學院科技管理所碩士 凌巨科技(股)公司資訊管理部副理	-	-	-	-	-	-

註1：本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力，同時隨時與各董事(包含獨立董事)就相關重大經營決策做討論與意見交換，並在董事會中充分討論，以落實公司治理，本公司已設置審計委員會，提升董事會職能及強化監督功能，且本公司有過半董事未兼任員工或經理人。

(四) 董事及獨立董事

1.姓名、性別、年齡、國籍或註冊地、經(學)歷、持有股份及性質(本公司已設置審計委員會，故不適用監察人制度)

113年4月30日;單位：股

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期(年)	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內其他主或管、董事或監察人			備註
							股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	黃文謙	男 61-70歲	111.06.23	3	93.03.29	980,425	3.66	1,020,425	3.81	-	-	-	-	國立清華大學物理系學士 華邦電子(股)公司行銷業務經理 凌巨科技(股)公司行銷業務處長	1.本公司總經理 2.晶隼科技(股)公司董事 3.禹創半導體(深圳)有限公司 董事	-	-	-	註1

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期(年)	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內其他主或管、董事或監察人			備註
							股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	陳鴻文	男 61-70歲	111.06.23	3	99.06.23	909,575	3.39	909,575	3.39	-	-	-	-	國立清華大學電機所碩士 台灣積體電路製造(股)公司工程師 太欣半導體(股)公司工程師	1.正文科技(股)公司董事長 2.正文投資(股)公司董事長 3.普羅通訊(股)公司董事長 4.先博通訊(股)公司董事長 5.Polaris Group 董事長 6.G-Technology Investment Co., Ltd 董事 7.Witek Investment Co.,Ltd 董事 8.Ampak International Holdings Ltd 董事 9.Primax Communication (B.V.I.)Inc. 董事 10.Free PPWorldwide Co.,Ltd 董事 11.鴻璟科技股份有限公司 法人董事代表人	-	-	-	-
董事	中華民國	陳永華	男 61-70歲	111.06.23	3	99.06.23	693,685	2.59	1,182,685	4.41	-	-	-	-	國立清華大學物理系學士 大同工學院事業經營研究所碩士 精強科技(股)公司總經理	1.晶彩科技(股)公司董事長 2.晶隼科技(股)公司董事長	-	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期(年)	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	配偶或二親等以內其他主或關係之管、董、監、察人			備註
							股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	魏雅庵	男 61-70歲	111.06.23	3	108.05.23	687,040	2.56	561,040	2.09	-	-	-	-	南亞技術學院土木工程系 中華民國工業區北部理事長聯誼會會長	1. 中華民國工業區廠商聯合總會 副理事長 2. 行政院 政務顧問 3. 內政部 歸化國籍之高級專業人才審查會 審查委員 4. 內政部 警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金管理會 委員 5. 勞動部 勞動基準諮詢委員會委員 6. 勞動部 跨國勞動力政策協商諮詢小組 委員 7. 勞動部 勞動力發展署桃竹苗分署 區域勞動力發展策進諮詢會 委員 8. 基隆市政府 市政顧問 9. 基隆市政府 都市計畫委員 10. 台灣智慧淨零建築產業聯盟 常務理事	-	-	-	-



職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期(年)	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	配偶或二親等以內其他主或關係之管、董、監、察人			備註
							股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	鄭珮姝	女 51-60歲	111.06.23	3	111.06.23	679,000	2.53	670,000	2.50	-	-	-	-	空中商專 台揚科技股份有限公司資深會計 億而得微電子股份有限公司經理	無	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	潘燕民	男 51-60歲	111.06.23	3	107.05.30	-	-	-	-	8,000	0.03	-	-	文化大學經濟研究所碩士 銖德科技股份有限公司投資部副總經理	1.銖德科技(股)公司副總經理 2.鈺德科技(股)公司法人董事代表人 3.銖寶科技(股)公司法人董事代表人 4.兆強科技(股)公司法人董事代表人 5.互力精密化學(股)公司監察人 6.銖洋(股)公司法人董事代表人 7.安可光電(股)公司法人董事代表人 8.博銖科技(股)公司法人董事代表人 9.厚聚能源開發(股)公司法人董事代表人 10.振專股份有限公司法人董事代表人 11.達振能源(股)公司監察人 12.來穎科技(股)公司監察人 13.銖工場(股)公司監	-	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期(年)	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內其他主或關係之管、董、監、察人			備註
							股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
																察人 14.力鍊光電科技(揚州)有限公司 法人董事長代表人暨總經理 15.昆山滬鍊光電科技股份有限公司 法人董事長代表人 16.安可光電揚州有限公司 法人董事代表人 17.太陽海科技(股)公司 監察人				
獨立董事	中華民國	吳清沂	男 61-70 歲	111.06.23	3	107.08.03	-	-	-	-	-	-	-	-	國立清華大學 電機工程研究所博士 嘉聯益科技股份有限公司 獨立董事	1.嘉聯益科技股份有限公司 獨立董事 2.長典生物科技股份有限公司 顧問	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	林月霞	女 51-60 歲	111.06.23	3	107.08.03	-	-	-	-	-	-	-	東海大學會計系學士 正大聯合會計師事務所 執業會計師	1.大中國際聯合會計師事務所 執業會計師	-	-	-	-	
獨立董事	中華民國	李展南	男 61-70 歲	112.10.23	3	112.10.23	5,000	0.02	5,000	0.02	-	-	-	-	國立中興大學企管所碩士 台灣證券交易所專員 台灣期貨交易所副組長	1.伍豐科技(股)公司 副總經理 2.水礦科技(股)公司 法人董事代表人	-	-	-	註 2

註 1：本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力，同時隨時與各董事(包含獨立董事)就相關重大經營決策做討論與意見交換，並在董事會中充分討論，以落實公司治理，本公司已設置審計委員會，提升董事會職能及強化監督功能，且本公司有過半董事未兼任員工或經理人。

註 2：李展南先生係於 112 年 10 月 23 日經 112 年第一次股東臨時會增選之獨立董事。

2.法人股東之主要股東：無

3.法人股東之主要股東屬法人者其主要股東：無

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長 黃文謙		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，曾任職於華邦與凌巨公司，目前擔任本公司董事長暨總經理及未有公司法第30條各款情事(註2)。	(1)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (2)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (3)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (4)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
董事 陳鴻文		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任正文科技(股)公司董事長及未有公司法第30條各款情事(註2)。	(1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非(1)所列之經理人。 (3)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (4)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (5)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (6)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	無

		(7)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	
董事 陳永華	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任晶彩科技、晶隼科技(股)公司董事長及未有公司法第30條各款情事(註2)。	(1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非(1)所列之經理人。 (3)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (4)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (5)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (6)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (7)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
董事 魏雅庵	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任中華民國工業區廠商聯合總會副理事長、基隆市大武崙工業區廠商協進會理事長及未有公司法第30條各款情事(註2)。	(1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非(1)所列之經理人。 (3)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (4)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (5)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (7)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取	無

		<p>得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。</p> <p>(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p> <p>(9)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。</p>	
<p>董 事 鄭 珮 妹</p>	<p>具有五年以上公司業務所需之工作經驗，曾任職於台揚公司，未有公司法第30條各款情事(註2)。</p>	<p>(1)非公司或其關係企業之受僱人。</p> <p>(2)非(1)所列之經理人。</p> <p>(3)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。</p> <p>(4)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。</p> <p>(5)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。</p> <p>(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。</p> <p>(7)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。</p> <p>(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p> <p>(9)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。</p>	<p>無</p>

獨立董事 潘燕氏	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，畢業於文化大學經濟研究所碩士，目前任職於鍊德科技擔任副總經理及未有公司法第30條各款情事(註2)。	(1)非本公司或其關係企業之受僱人。 (2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有本公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8)非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。 (9)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
獨立董事 吳清沂	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，畢業於國立清華大學電機工程研究所博士，目前擔任嘉聯益科技股份有限公司獨立董事及未有公司法第30條各款情事(註2)。		1
獨立董事 林月霞	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，曾任職於正大聯合會計師事務所會計師，目前任職於大中國際聯合會計師事務所執業會計師及未有公司法第30條各款情事(註2)。		無
獨立董事 李展南	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，畢業於國立中興大學企業管理研究所碩士，目前擔任伍豐科技股份有限公司副總經理及未有公司法第30條各款情事(註2)。		無

註1：依據上市審查準則及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項，本公司已取得個獨立董事獨立性聲明書，確認均符合法令規定之獨立性資格條件。

註2：有下列情事之一者，不得充任經理人，其已充任者，當然解任：

1. 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。
2. 曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
3. 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年者。
4. 受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權者。
5. 使用票據經拒絕往來尚未期滿者。
6. 無行為能力或限制行為能力者。
7. 受輔助宣告尚未撤銷。

## 5. 董事會多元化及獨立性：

### (1) 董事會多元化：

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當

之多元化方針，包括但不限於以下：

A.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。

B.專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

本公司現任董事會由9位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
獨立董事任期未逾 3 屆	達成
適足多元之專業知識與技能	達成

董事會成員多元化政策落實情形如下：

心 姓名	多元化核		基本組成				專業背景				專業知識與技能					
	國籍	性別	具員工身分	年齡		獨立董事任期年資	會計	產業	財務	科技	營運判斷能力	經營管理能力	領導決策能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀
				51-60歲	61-70歲											
董事	黃文謙	男	V		V			V		V	V	V	V	V	V	V
	陳鴻文	男			V			V	V	V	V	V	V	V	V	V
	陳永華	男			V			V		V	V	V	V	V	V	V
	魏雅庵	男			V			V		V	V	V	V	V	V	V
	鄭珮妹	女		V			V		V		V	V	V	V	V	V
獨立董事	潘燕民	男		V		3-6年		V	V	V	V	V	V	V	V	V
	吳清沂	男			V	3-6年		V		V	V	V	V	V	V	V
	林月霞	女		V		3-6年	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	李展南	男			V	0-3年		V	V	V	V	V	V	V	V	V

(2)董事會獨立性：

本公司現任董事會成員共 9 位，包含 5 位董事(其中 1 位具員工身份)及 4 位獨立董事(佔全體董事成員比例 55.56%及 44.44%)，獨立董事席次超過三分之一。截至 113 年 4 月止，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事，本公司董事會具獨立性(請參閱本公開說明書第 19-23 頁之董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)，各董事經學歷、性別及工作經驗(請參閱本本公開說明書第 13-18 頁之董事資料)。

(五) 發起人：不適用。

(六)最近年度(112年度)支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.董事(含獨立董事)之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

112年12月31日;單位:新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)		兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11)						
		報酬(A)(註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)				薪資、獎金及特支費等(E)(註5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註6)										
		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司		財務報告內所有公司(註7)		本公司	財務報告內所有公司(註7)							
董事長	黃文謙	-	-	-	-	1,557	1,557	114	114	1,671	1,671	5.22%	5.22%	3,453	3,453	-	-	258	-	258	-	5,382	5,382	16.81%	16.81%	無
董事	陳鴻文	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	陳永華	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	魏雅庵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	鄭玥姝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	潘燕氏	958	958	-	-	-	-	120	120	1,078	1,078	3.36%	3.36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	吳清沂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	林月霞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	李展南(註)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

本公司獨立董事係領取車馬費(業務執行費)及固定報酬，獨立董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得給付定額報酬，其報酬依本公司「董事及經理人薪資酬勞發放辦法」授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業水準議定之。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註：李展南先生係於112年10月23日經112年第一次股東臨時會增選之獨立董事。

■本公司之董事酬勞與員工酬勞分派案業經113年2月27日董事會決議通過。



酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註8)	財務報告內所有公司 (註9)H	本公司(註8)	財務報告內所有公司 (註9)I
低於 1,000,000 元	黃文謙、陳鴻文、陳永華、 魏雅庵、鄭玥姝、潘燕民、 吳清沂、林月霞、 李展南(註)	黃文謙、陳鴻文、陳永華、 魏雅庵、鄭玥姝、潘燕民、 吳清沂、林月霞 李展南(註)	陳鴻文、陳永華、魏雅庵、 鄭玥姝、潘燕民、吳清沂、 林月霞、李展南(註)	陳鴻文、陳永華、魏雅庵、 鄭玥姝、潘燕民、吳清沂、 林月霞、李展南(註)
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	黃文謙	黃文謙
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	9 人	9 人	9 人	9 人

註：李展南先生係於 112 年 10 月 23 日經 112 年第一次股東臨時會增選之獨立董事。

■本公司之董事酬勞與員工酬勞分派案業經 113 年 2 月 27 日董事會決議通過。

2.監察人酬金：不適用。

3.最近年度(112年度)總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

112年12月31日；單位:新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金 (B)		獎金及 特支費等等(C) (註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等四項 總額及占稅後純益之比 例(%) (註8)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註9)
		本公司	財務報告 內所有公 司 (註5)	本公 司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公 司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司		財務報告內所 有公司 (註5)		本公司	財務報告 內所有公 司(註5)	
								現金 金額	股票 金額	現金金 額	股票 金額			
總經理	黃文謙	8,322	8,322	-	-	1,429	1,429	694	-	694	-	10,445 32.62%	10,445 32.62%	無
副總經理	吳政穎													
副總經理	吳其沛													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註6)	財務報告內所有公司(註7)E
低於1,000,000元	-	-
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	-	-
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	吳政穎	吳政穎
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	黃文謙、吳其沛	黃文謙、吳其沛
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	-	-
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	-	-
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	-	-
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	-	-
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	-	-

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註6)	財務報告內所有公司(註7)E
100,000,000 元以上	-	-
總計	3 人	3 人

■本公司之員工酬勞分派案業經 113 年 2 月 27 日董事會決議通過。

4.最近年度(112年)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

112年12月31日；單位:新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	黃文謙	0	1,410	1,410	4.40%
	副總經理	吳政穎				
	副總經理	吳其沛				
	協理	陳英堂				
	協理	江政璋				
	協理	陳政揚				
	協理	陳香綺				
	協理	賴盈君				

■本公司之員工酬勞分派案業經113年2月27日董事會決議通過。

(七)分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

1.最近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

單位：新台幣仟元；%

	112年度		111年度	
	本公司	個別財報	本公司	個別財報
董事酬金	8.59%	8.59%	6.78%	6.78%
總經理及副總經理酬金	32.62%	32.62%	10.02%	10.02%

註：本公司107年成立審計委員會，故無監察人酬金。

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性

- (1)本公司董事之酬勞政策訂定於公司章程內，並經股東會同意通過；本公司董事執行本公司職務時，其報酬授權董事會參酌國內外業界之水準議定之。如公司年度決算有獲利時，依公司章程之規定分配酬勞。
- (2)本公司總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金及員工酬勞，本公司給付酬金之政策，係依其學歷、經歷，參考同業薪資水準，並評估於公司職務之權責、目標達成度及貢獻度，及該年度公司之經營成果，予以合理之報酬。
- (3)本公司設置薪資報酬委員會，董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會定期審核與評估，並視營運狀況及相關法令適時調整。112年度董事及經理人酬金分派金額，均由薪資報酬委員會審議後提董事會議定之。
- (4)本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金政策係考量營運績效、未來產業景氣波動、以及本公司未來經營可能面臨之營運風險、交易風險、財務風險等因素以訂定酬金。

(八)發行人之非董事，而實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營而實質指揮董事執行業務者，應增列敘明上開人士之姓名、經（學）歷、持有股份、目前兼任發行人及其他公司之職務、與發行人董事及監察人之關係及對發行人實質控制情形，另外國發行人並應敘明上開人士依註冊地國法令規定之法律責任：

本公司無此情形，故不適用。

(九)本國發行公司或外國發行人初次申請股票在創新板上市者，應增列敘明核心技術人員之資歷簡歷

姓名	職稱	最高學歷 (學校系所)	主要經歷	本業成就及專長
黃文謙	總經理	國立清華大學 物理系學士	華邦電子(股)公司行 銷業務經理 凌巨科技(股)公司行 銷業務處長	<ul style="list-style-type: none"> <li>●主導公司營運方針、經營目標及執行具產品開發經驗</li> <li>●瞭解半導體領域與發展趨勢</li> </ul>
吳政穎	副總經理	國立交通大學 電信工程所 碩士	華邦電子(股)公司 資深工程師	<ul style="list-style-type: none"> <li>●瞭解半導體領域與技術發展趨勢</li> </ul>
吳其沛	副總經理	國立清華大學 電子工程所 碩士	本公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>●瞭解半導體領域與產品開發</li> </ul>

四、資本及股份  
(一)股份種類

113年3月23日；單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份(註)	未 發 行 股 份	合 計	
記名普通股	26,810,000	3,190,000	30,000,000	本公司股票屬 興櫃公司股票

(二)股本形成經過

1.最近五年度及截至公開說明書刊印日止股本變動之情形

單位：新台幣仟元；仟股

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以 外之財產 抵充股款 者	其 他
101.07	10 元	30,000	300,000	20,310	203,100	員工認股權憑證轉換 4,000 仟元	無	註 1
101.12	30 元	30,000	300,000	21,310	213,100	現金增資 10,000 仟元	無	註 2
103.05	30 元	30,000	300,000	23,310	233,100	現金增資 20,000 仟元	無	註 3
103.09	50 元	30,000	300,000	24,810	248,100	現金增資 15,000 仟元	無	註 4
106.07	50 元	30,000	300,000	26,810	268,100	現金增資 20,000 仟元	無	註 5

註 1：業經中華民國 101 年 7 月 9 日 經授中字第 10132224900 號

註 2：業經中華民國 101 年 12 月 24 日 經授中字第 10132835580 號

註 3：業經中華民國 103 年 5 月 19 日 經授中字第 10333346610 號

註 4：業經中華民國 103 年 9 月 24 日 經授中字第 10333711550 號

註 5：業經中華民國 106 年 7 月 20 日 經授中字第 10633411570 號

2.最近三年度及截至公開說明書刊印日止，私募普通股辦理情形：無此情形。

3.公司採總括申報方式發行新股：不適用。

## (三)最近股權分散情形

## 1.股東結構

113年3月23日；單位：人；股

股東結構 數量	政府 機構	金融 機構	本國公司 法人	本國其他 法人團體	個人	外國機構 及外國人	合計
人 數	-	-	30	1	2,848	31	2,910
持 有 股 數	-	-	2,188,091	1,000	23,661,985	958,924	26,810,000
持 股 比 例(%)	-	-	8.16	0.00	88.26	3.58	100

## 2.股權分散情形

113年3月23日；單位：人；股

持股分級	股東人數	持有股數	持有比率(%)
1 - 999	598	120,212	0.45
1,000 - 5,000	1,744	3,367,339	12.55
5,001 - 10,000	258	2,045,052	7.63
10,001 - 15,000	80	1,023,597	3.82
15,001 - 20,000	44	788,289	2.94
20,001 - 30,000	51	1,302,211	4.86
30,001 - 40,000	39	1,381,970	5.15
40,001 - 50,000	17	763,905	2.85
50,001 - 100,000	41	3,053,070	11.39
100,001 - 200,000	18	2,626,392	9.80
200,001 - 400,000	10	2,627,252	9.80
400,001 - 600,000	3	1,388,240	5.18
600,001 - 800,000	3	2,070,765	7.72
800,001 - 1,000,000	1	909,575	3.39
1,000,001 以上	3	3,342,131	12.47
合計	2,910	26,810,000	100

## 3.主要股東名單：(持有股份達總額百分之五以上或股權比例占前十名股東)

113年3月23日；單位：股

主要股東名稱	股份	持 有 股 數	持 股 比 例(%)
陳永華		1,182,685	4.41
李語綺		1,139,021	4.25
黃文謙		1,020,425	3.81
陳鴻文		909,575	3.39
王子越		701,020	2.61
徐世佳		699,745	2.61
鄭玥姝		670,000	2.50
魏雅庵		561,040	2.09
凱基創業投資股份有限公司 代表人：黃幼玲		425,000	1.59
陳海源		402,200	1.50

- 4.最近二年度及當年度董事、監察人及持股比例超過百分之十之股東放棄現金增資認股之情形：無此情形。
- 5.最近二年度及截至公開說明書刊印日止，董事、監察人、經理人、現任技術股東及技術、研究發展人員及持股比例超過百分之五之股東股權移轉及股權質押變動情形

(1)股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	111 年度		112 年度		113 年度 截至刊印日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股 數 增 (減)數
董事長 兼總經理	黃文謙	40,000	-	-	-	-	-
董事	陳鴻文	-	-	-	-	-	-
董事	陳永華	481,000	-	8,000	-	-	-
董事	魏雅庵	-	-	(126,000)	-	-	-
董事	鄭玥姝	-	-	(9,000)	-	-	-
獨立董事	潘燕民	-	-	-	-	-	-
獨立董事	吳清沂	-	-	-	-	-	-
獨立董事	林月霞	-	-	-	-	-	-
獨立董事(註 1)	李展南	-	-	-	-	-	-
副總經理	吳政穎	-	-	-	-	-	-
協理	陳英堂	-	-	-	-	-	-
協理	吳其沛	-	-	-	-	-	-
協理	江政璋	-	-	-	-	-	-
協理	陳政揚	-	-	-	-	-	-
協理	陳香綺	-	-	-	-	-	-
協理 兼財會部主管	賴盈君	-	-	-	-	-	-

註 1：李展南先生於 112 年 10 月 23 日經 112 年第一次股東臨時會增選。

- (2)董事、監察人、經理人、現任技術股東及技術、研究發展人員及持股比例超過百分之五之股東股權移轉之相對人為關係人者之資訊：無。
- (3)董事、監察人、經理人、現任技術股東及技術、研究發展人員及持股比例超過百分之五之股東股權質押之相對人為關係人者之資訊：無。



6. 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

113年3月23日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數(股)	持股比例(%)	股數(股)	持股比例(%)	股數(股)	持股比例(%)	名稱(或姓名)	關係	
陳永華	1,182,685	4.41	-	-	-	-	-	-	-
李語綺	1,139,021	4.25	-	-	-	-	-	-	-
黃文謙	1,020,425	3.81	-	-	-	-	-	-	-
陳鴻文	909,575	3.39	-	-	-	-	-	-	-
王子越	701,020	2.61	-	-	-	-	-	-	-
徐世佳	699,745	2.61	-	-	-	-	-	-	-
鄭玥姝	670,000	2.50	-	-	-	-	-	-	-
魏雅庵	561,040	2.09	-	-	-	-	-	-	-
凱基創業投資股份有限公司 代表人：黃幼玲	425,000	1.59	-	-	-	-	-	-	-
陳海源	402,200	1.50	-	-	-	-	-	-	-

(四)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元/仟股

項目	年度		111年	112年(註1)
	每股市價(註2)	最高		未上市櫃(註2)
最低			未上市櫃(註2)	未上市櫃(註2)
平均			未上市櫃(註2)	未上市櫃(註2)
每股淨值	分配前		12.99	11.68
	分配後		10.49	10.68
每股盈餘	加權平均股數		26,810	26,810
	每股盈餘	追溯前	2.72	1.19
		追溯後	無	無
每股股利	現金股利		2.50	1.00
	無償配股	盈餘配股	無	無
		資本公積配股	無	無
	累積未付股利		無	無
投資報酬分析(註2)	本益比		未上市櫃(註2)	未上市櫃(註2)
	本利比		未上市櫃(註2)	未上市櫃(註2)
	現金股利殖利率		未上市櫃(註2)	未上市櫃(註2)

註1：包含113年2月27日董事會決議通過之民國112年度股利金額。

註2：本公司截至目前為止尚未上市(櫃)，無市價可供參考，故相關比例亦無法計算。

## (五)公司股利政策及執行狀況

### 1.公司章程所訂之股利政策

本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補以往虧損(包括調整未分配盈餘金額)，次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣後盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具分配案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部分，以發放現金方式為之，並報告股東會。

本公司授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將法定盈餘公積及資本公積之全部或一部分，以發放現金方式為之，並報告股東會。

### 2.本年度擬(已)議股利分派情形：

本公司113年2月27日董事會決議通過配發股東紅利每股新臺幣1.0元，將於民國113年5月21日股東常會提報。

(六)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

## (七)員工、董事及監察人酬勞

### 1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞(董事酬勞)前之利益)，應提撥：

(1)董事監察人酬勞，提撥比例不高於百分之五。

(2)員工酬勞，百分之五至百分之十五。

但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董監酬勞(董事酬勞)僅得以現金為之。

### 2.本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票股利之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：無此情形。

### 3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形：

A.本公司於113年2月27日第七屆第9次董事會通過112年度員工酬勞及一般董事酬勞分配案，其中員工酬勞為新台幣4,672,103元，董事酬勞為新台幣1,557,368元。

B.上開員工酬勞及董事酬勞之實際配發情形與民國112年度財務報表認列數並無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無此情形。

### 4.股東會報告分派酬勞情形及結果：

(1)依本公司章程第二十條規定，本公司如有獲利，應提撥不高於5%為董事酬勞及5%~15%為員工酬勞。

(2)本公司擬提撥董事酬勞3.5%，計新台幣1,557,368元；員工酬勞10.5%，計新台幣4,672,103元，均以現金方式發放。

### 5.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、

其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並敘明差異數、原因及處理情形：

本公司111年度董事及員工酬勞分配案，業經112年3月8日董事會決議配發董事酬勞3,874,801元及員工酬勞11,624,404元，並經112年6月6日股東會報告，均以現金方式發放。董事會通過之董事酬勞及員工酬勞與111年度財務報告估列金額相符。

(八)公司買回本公司股份情形：無。

五、公司債(含海外公司債)辦理情形：無。

六、特別股辦理情形：無。

七、參與發行海外存託憑證之辦理情形：無。

八、員工認股權憑證辦理情形：無。

九、限制員工權利新股辦理情形：無。

十、併購辦理情形：無。

十一、受讓他公司股份發行新股尚在進行中者：無。

## 貳、營運概況

### 一、公司之經營

#### (一) 業務內容

##### 1. 業務範圍

##### (1) 業務之主要內容

本公司為嵌入式非揮發性矽智財供應領導廠商，專門開發與邏輯製程相容並可單次或多次性寫入之嵌入式非揮發性記憶體，並以 NVM cell 及 array 為矽智財(IP) 核心技術，主要業務內容如下：

編號	代碼	營業項目說明
1	CC01080	電子零組件製造業
2	F119010	電子材料批發業
3	F219010	電子材料零售業
4	I501010	產品設計業
5	F401010	國際貿易業
6	F601010	智慧財產權業
7	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

##### (2) 營業比重

單位：仟元

主要產品種類	112 年度		111 年度	
	營業收入	營業比重%	營業收入	營業比重%
技術服務收入	48,082	25.66	58,821	25.64
技術權利金	139,302	74.34	170,599	74.36
總計	187,384	100.00	229,420	100.00

##### (3) 公司目前之商品 (服務) 項目

本公司成立於 90 年 9 月，為一家專業邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體 SIP (矽智財; Silicon Intellectual Property) 設計公司，產品之服務項目如下：

##### ① 技術服務費

包含授權金(License fee)、使用費(Usage fee)與產品設計開發費(Non-Recurring Engineering ; NRE)。

##### a. 授權金(License fee)：

本公司授權對象主要為晶圓代工廠，通常是針對基本記憶體單元及個別製程技術授權，晶圓代工廠可採用基本記憶體單元自行設計 NVM SIP 並提供予其 IC 設計客戶使用和後續的生產製造。雙方在簽訂合約時會設立階段性里程碑，當彼此開發進程達到特定階段里程碑時，即須支付一定比例之授權費。

##### b. 使用費(Usage fee)：

本公司已事先在晶圓代工廠及整合元件製造廠開發完成一系列標準型 SIP 區塊(macro)。使用費係指晶圓代工廠(Foundry)、整合元件製造廠(IDM)及 IC 設計公司若使用標準型 SIP 區塊，本公司會依客戶使用次數收取固定費用，亦即一個標準型 SIP 區塊，使用在一個產品上，需支付一次使用費，使用在二個產品上，則需支付二次使用費，依此類推。

c. 產品設計開發費(Non-Recurring Engineering ; NRE)：

產品設計開發費係指依據晶圓代工廠、整合元件製造廠及 IC 設計公司所要求之規格，客製化非標準型 SIP 區塊(macro)，且以規格複雜與難易程度所收取之費用。雙方在簽訂合約時會設立階段性里程碑，當彼此開發進程達到特定階段里程碑時，即須支付一定比例之產品設計開發費。

② 權利金(Royalty)

本公司已通過晶圓代工廠及整合元件製造廠驗證之 NVM SIP 產品，於客戶量產後，晶圓代工廠依據其售予客戶晶圓(wafer)價格或整合元件製造廠依據自行量產晶圓價格，由本公司收取一定比例權利金，一般約為 1%~5%。晶圓代工廠及整合元件製造廠需每季提供本公司其客戶產品之生產產量報表(quantity report)，計算出應收取權利金金額。

(4) 計畫開發之新商品（服務）項目

本公司致力於邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體 SIP 產品之研究開發、功能設計、市場應用與業務行銷，在超過十家以上的晶圓代工廠及整合元件製造廠晶圓生產線上，建置了 0.5 微米、0.4 微米、0.35 微米、0.3 微米、0.25 微米、0.18 微米、0.16 微米、0.15 微米、0.13 微米、0.11 微米、90 奈米、80 奈米、65 奈米等製程技術平台，提供客戶多樣化選擇。本公司 NVM SIP 已獲得多家知名 IC 設計公司使用，並在多種製程平台上完成產品的驗證，及進行客戶產品之量產動作。本公司開發之 NVM SIP 產品可使用於 TFT LCD driver IC、LED driver IC、Power IC、MCU IC、車用 IC、IOT IC 等應用領域，同時為配合客戶產品對先進製程需求，已擴大進行 55 奈米乃至 40 及 28 奈米製程開發。

新產品開發具體規劃如下：

- ① 開發更先進技術，除目前進行的 55 奈米及 40 奈米，會配合客戶對產品多元化之需求，往更先進製程開發。
- ② 建構更完整的製程技術平台，已建置的有 LG (Logic)、HV (High Voltage)、BCD，與 MM 製程，並積極開發 CIS 製程。
- ③ 為提供更完整的 SIP 產品線，會在目前製程平台上開發更高速及更高記憶容量(density size)之 NVM SIP 產品。
- ④ 為提供客戶更具競爭力 SIP 產品，已積極發展更小面積之 SIP 產品，IP 面積預估可在縮小，使其成為最具競爭力的 NVM IP，除了提高客戶設計彈性度，使客戶產品裸晶(die)面積更小，降低生產成本，更大幅擴大了 YMC NVM IP 的市場空間。
- ⑤ 為建構差異化產品，積極開發高速存取、更低操作電壓、更低消耗功率之高性能 NVM SIP 產品。
- ⑥ 開發多種類 IP，除了 MTP 之外，並增加 OTP 產品線，另外也在研發 low power IOT 相關的 IP。

2. 產業概況

(1) 產業之現況與發展

① 產業現況

本公司致力於邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體 SIP 產品的研發與銷售，為一家專業的 NVM SIP 設計公司與供應商。所謂矽智財(Silicon Intellectual Property SIP)其實就是一種智慧財產權的觀念，凡是加入 IC 晶片中可使 IC 晶片正常運作的功能區塊，即可稱為矽智財(SIP)元件，此智慧財產權因在半導體領域中被採用，通常會加上 silicon 成為 SIP 做為區分。此區塊是一種事先經過設計、驗證過並可重複使

用之功能性模組。有些矽智財(SIP)元件功能已固定，使用者無法修改；另有某些矽智財(SIP)元件允許使用者做限度的個別化修改。IC設計人員能使用這些矽智財(SIP)元件完成其設計中的部份功能，不需重新設計此功能區塊，可讓IC設計上更快、更有效率的完成，除縮短IC產品開發的時程，並可加速IC產品上市日期。

### ②產業未來成長性、發展趨勢

半導體產業已趨向專業分工，由設計階段所細分出來的矽智財(SIP)產業所扮演的角色也愈形重要，SIP 產業前景非常明確更值得期待，其產業發展可分三方面說明：

a.SIP 供應商需提供有差異化 SIP 產品，加強設計技術服務，吸引客戶使用：

國內 SIP 供應商數目眾多，但鮮少有可提供高附加價值及完善支援服務的供應商。在 SIP 產業，許多標準及架構都是由國際知名大廠所製定及主導，台灣 SIP 供應商往往只是跟隨者，在目前技術日新月異的時代，沒主導優勢就會失去初期市場商機，跟隨者只能獲取微薄利潤，不過，以國內現今 SIP 產業規模及週邊支援軟體配合的環境，要引領產業走向的能力還不成熟。

國內 SIP 供應商為走出跟隨者的窘境，不同類型的 SIP 供應商必須找到其相對應的利基市場，例如基本型 SIP 因進入門檻低，附加價值與利潤也較低，此類型的 SIP 供應商可與晶圓代工廠合作，利用晶圓代工廠新的或先進製程，開發新的 SIP 元件，即可區隔與競爭者差異。同樣的，標準型 SIP 供應商眾多，競爭相當激烈，價格必須保有優勢，此類 SIP 與產業標準有關，需注意領導廠商走向，也須與制定機構維持良好互動。SIP 供應商為了提供差異化產品，必須投資更多資源在研發及市場分析，其技術難度較高，開發時程長，不一定短時間內可以見到成效，不過此陣痛期若能熬過，即能提供客戶多樣化的解決方案，配合技術支援服務，將能確保公司最佳獲利。

b.IC 晶片採用 SIP 元件設計，縮短開發時程，已成業界走向：

隨著半導體製程精進，產品整合性提升，使得 IC 晶片設計愈趨複雜，如果晶片每個部份功能都是從頭開始開發設計，必定耗費公司可觀人力物力，若此時透過採購及授權的方式取得已經過驗證的 SIP，加以整合，可縮短產品開發時程，加速產品上市時間，故 IC 晶片採用 SIP 元件設計已成業界設計趨勢。

c.IC 設計服務公司經營內容愈趨多元化，自主開發 SIP 產品已成維繫公司競爭力重要因素：

IC 產品功能整合性提高，促使晶片設計愈趨複雜，IC 設計服務公司逐漸由設計後段配置、佈局、繞線進入設計前段 RTL，以提供設計前段的能力來製造服務的差異化。由於半導體往先進製程發展，IC 設計服務公司握有與晶圓代工廠合作經驗與緊密關係優勢，吸引 IC 設計公司或系統公司。

委托設計整合服務或客製化設計的合作，若 IC 設計服務公司能自主開發 SIP 產品提供客戶選擇，於競爭激烈環境中更具優勢。

### ③產業上、中、下游之關聯性

國內的兩兆雙星產業，起步最早的就是半導體產業，在半導體產業經過三十幾年發展，由於群聚效應促成產業興盛，並在政府協助與廠商努力下，已經建構出相當完整的產業架構和專業化的產業供應鏈、上游、中游、下游垂直分工，各自分工明確，彼此關係緊密且各有專精，相當具有產業發展的優勢。若依上、中、下游之專責領域，大致可區分成為：上游的晶圓製造業、光罩業、IC 設計業(design house)，中游的晶圓代工業(foundry)，下游的 IC 封裝、測試業(package and testing)及 IC 銷售通路。而由於整體半導體產業的基礎深厚，台灣半導體產業在全球半導體產業可說是具有舉足輕重的地位，以台灣半導體產業產值及產業中各業別表

現來分析，IC 設計業全球排名第二，晶圓代工業名列全球第一，而 IC 封裝及測試業全球排名也是第一，可見台灣半導體實力傲視全球。

半導體產業上游主要專責在晶圓製造、光罩及設計部份，可再細分成爲：

- a. 晶圓製造廠：長晶後經過研磨、拋光、切片即成晶圓，如國內的中美矽晶。
- b. 光罩公司：將電路圖形轉換成可重覆使用的光罩，如國內的台灣光罩公司。
- c. IC 設計公司：依據系統廠客戶之需求及市場 survey(調查)後訂定 IC 晶片規格，並且依照訂定的規格進行後續設計的流程，如國內的聯詠科技。
- d. SIP 供應商：提供 IC 設計公司所需之矽智財(SIP)元件，如本公司提供自行開發的邏輯製程嵌入式 MTP 非揮發性記憶體 SIP。
- e. IC 設計服務公司：提供系統公司、IC 設計公司在 IC 設計過程中部份或全部工作外包服務、設計整合服務、客製化特殊功能服務、Turnkey Service(統包服務)及矽智財(SIP)方案，如國內的智原科技。
- f. EDA 公司：提供 IC 設計公司、IC 設計服務公司所需之電子設計自動化工具軟體，如國內的思源科技。

台灣半導體產業上游、中游、下游架構非常完整，更是全球晶圓代工產業的重鎮所在，有著從上而下完整的產業供應鏈，垂直分工專業化，造就半導體產業蓬勃發展。若以本公司從事的 SIP 產業來說，由於晶圓代工業製程技術精進，帶動 IC 設計業快速發展，並在半導體產業的垂直分工體系出現更為精細的分工，SIP 供應商與 IC 設計服務公司的出現，使得半導體產業上游的垂直分工體系的專業分工架構更形完整，IC 設計公司在設計晶片時，可利用 SIP 業者所提供已經過驗證的矽智財，以加速 IC 設計的時程，減少人力、物力的耗費，提早產品上市時間，並提升產品競爭力，獲取公司最大的利益。尤其是 SoC 興起之後，SIP reuse 將是一大重點，SIP 供應商提供自行開發的 SIP 元件與技術支援，如本公司提供的邏輯製程嵌入式 MTP 非揮發性記憶體 SIP。

#### ④產品之各種發展趨勢

IC 晶片設計難度愈趨複雜化，晶片整合性的要求也就愈顯重要，這時若能善於使用矽智財(SIP)的優點，將可節省大量人力與物力的耗費，不用每個功能區塊都是從頭設計，IC 設計公司可使用已經過驗證可 reuse(重覆使用)的 SIP，與既有功能整合，在處處講求效率的科技產業，可加速開發時程，提早產品上市時間，增加產品競爭優勢，獲取公司最大利益。矽智財(SIP)的重要性與日俱增，在半導體產業的垂直分工體系出現更為精細的分工，可知 SIP 在 IC 產業的設計流程上扮演舉足輕重角色。

IC 設計服務公司提供自身 SIP 產品供選擇，服務展現多元化並逐漸擴大到設計前段專業的 SIP 供應商專責提供矽智財(SIP)產品，另外 IC 設計服務公司也為推展多元化服務，有業者推出自行開發的 SIP 產品，另有業者取得國際大廠 SIP 的授權，導入設計平台中。IC 設計服務公司早期著重於提供平面配置、佈局與繞線，但隨著 IC 設計集積度愈來愈高，晶圓代工廠需往更先進製程開發，趨使 IC 設計服務公司服務項目重心漸漸移往前段設計階段的 RTL 執行與發展、功能模擬、邏輯合成等，與晶圓代工廠關係則愈益緊密。

本公司致力於邏輯製程嵌入式 NVM(非揮發性記憶體) SIP 產品的研發與銷售，為一家專業的 NVM SIP 設計公司與供應商。對於嵌入式非揮發性記憶體 SIP 的市場而言，有分為於特殊製程上開發的嵌入式非揮發性記憶體 SIP，如 SST 公司的 Flash SIP；另一種則為於邏輯製程上開發的嵌入式非揮發性記憶體 SIP，如本公司開發的 NVM SIP。

### ⑤ 產品競爭情形

本公司 MTP SIP 抹除寫入次數(endurance) 10~100K 次，居業界領先地位，支援 in system programming 功能，使用 in system programming 功能時，不需額外的 RAM buffer，也不需經過抹除的動作，可以直接寫入，大大的增加了使用 in system programming 時的方便性，不但提升產品效能，更增加了客戶產品競爭優勢，此功能適合為參數與組態設定、系統程式碼(program code)儲存與紀錄、數位版權管理、安全辨識管理等提供最理想且經濟實惠的 NVM SIP 選擇。本公司 MTP SIP 產品技術較嵌入式 Flash SIP 擁有更佳成本優勢，嵌入式 Flash 因為製程複雜，還要增加額外的 7~11 層光罩，使得晶圓價格要比一般製程多出 30~50%，現在使用本公司 MTP SIP 可以同時兼顧，以一般製程的晶圓價格，得到比嵌入式 Flash 方便使用的效能。

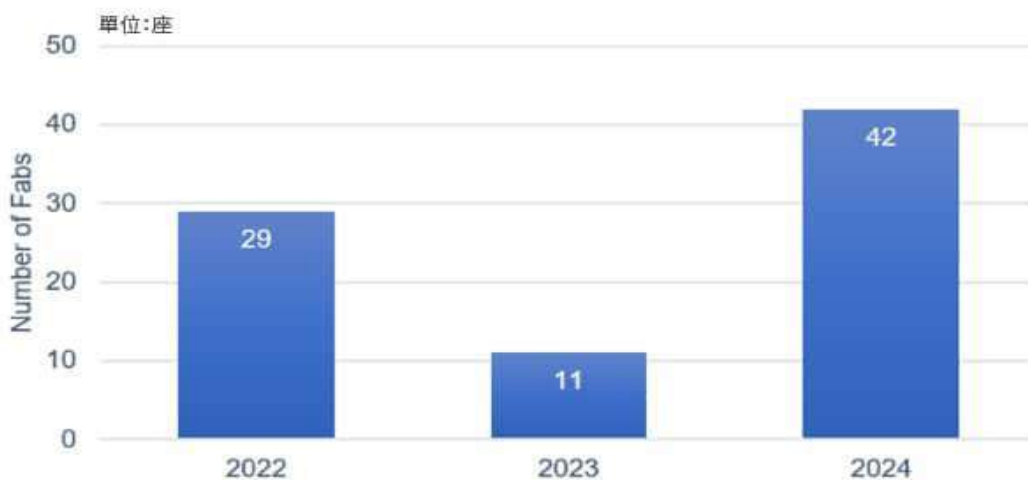
國際半導體產業協會(SEMI)近日公布最新一季全球晶圓廠預測報告(World Fab Forecast, WFF)，全球半導體產能繼 2023 年以 5.5%成長至每月 2,960 萬片晶圓(WPM, Wafers Per Month)之後，預計 2024 年將增速成長 6.4%，突破 3,000 萬片大關。

不同於 2023 年的產能擴張溫和主要受到市場需求走緩，半導體進入庫存調整期所致；2024 年包含生成式 AI 和高效能運算(HPC)等應用推動，以及晶片在終端需求的復甦，加速先進製程和晶圓代工產能擴增。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，全球市場需求走向復甦，加上各國政府獎勵措施，帶動主要晶片製造地區晶圓廠建設和設備投資大幅成長，此外，半導體策略牽動全球政經局勢影響性日益增加，也成為半導體產能成長關鍵催化劑，預計 2024 年全球產能將成長 6.4%。

最新一季全球晶圓廠預測報告顯示，2022 年至 2024 年預測期間，全球半導體產業計劃將有 82 座新設施投產，其中 2023 年及 2024 分別有 11 座及 42 座投產，涵蓋了 4 吋(100mm)到 12 吋(300mm)晶圓的生產線。

#### 2022~2024年新投入營運的晶圓廠家數



資料來源：SEMI(1/2024)

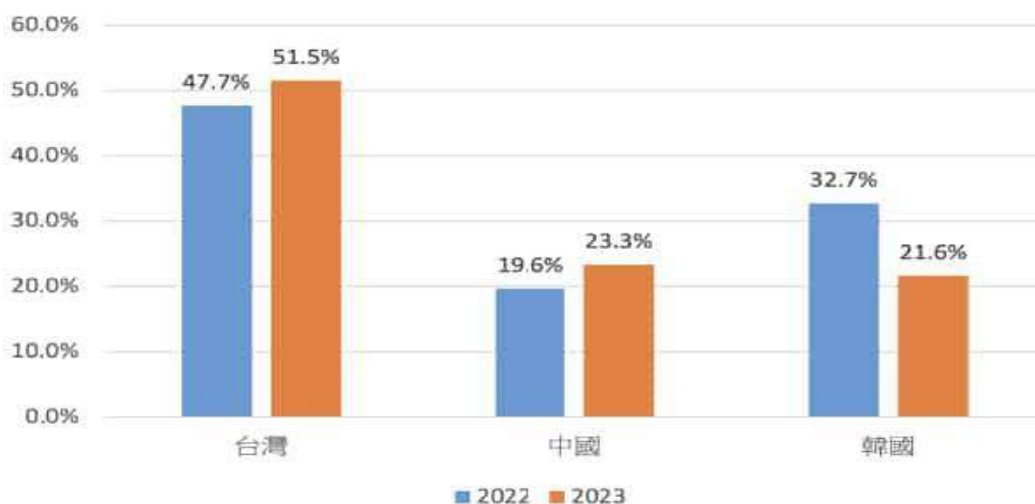
據 TrendForce 研究報告顯示，2023 年面板驅動晶片(DDIC)的價格多是持平或小幅下滑，2024 年在大尺寸應用如電視、電競液晶監視器、商務筆電換機等需



求增長的帶動，面板出貨將會有一定程度的成長，連同激勵 DDIC 的需求同步上升，但在面板價格仍有壓力的情況下，預期 2024 年 DDIC 價格仍會持續緩跌。

回顧 2023 年 DDIC 市場，TrendForce 表示，即便電視面板價格的回彈，對面板廠來說整體壓力並未解除，仍持續對上游端零組件端施壓降價。因此，DDIC 供應商不僅需要優化產品設計以降低成本，同時也要尋求更有效益的晶圓代工廠合作，成本下降才有空間讓利。

中日韓三國面板驅動IC市占率



資料來源：TrendForce(12/2023)

隨著資訊、家電及個人服務通訊時代的來臨，IC 設計業市場規模逐年擴大，未來 SIP 之需求亦會相對成長，其所衍生的市場與利潤也將是未來產業發展的重要指標，且 SIP 建立創新的授權營運模式，不直接產銷產品，而是以授權或收取權利金之方式行銷技術，使得 IP 業者成功開拓嶄新的利基市場。IP 產業由於固定成本低、毛利率高，優於半導體價值鏈中其他階段產業。本公司已在 MTP SIP 深耕多年，擁有最佳的優勢，目前本公司能提供客戶最多已建置完成製程平台的選擇方案，客戶可依自身需求選擇不同晶圓代工廠及製程技術。

### 3.技術及研發概況

#### (1)所營業務之技術層次及研究發展

本公司為一家專業邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體 SIP 供應商，專注於邏輯製程嵌入式可程式 NVM SIP 研究、開發與銷售，目前擁有多達十餘家國內外晶圓代工廠(foundry)及整合元件製造廠(IDM)合作夥伴，此 NVM SIP 已成功導入於合作夥伴之 0.5 微米、0.4 微米、0.35 微米、0.3 微米、0.25 微米、0.18 微米、0.16 微米、0.13 微米、0.11 微米、90 奈米、80 奈米、65 奈米製程技術，因應客戶不同應用之產品多元化需求，建置了邏輯製程(Logic)、混合信號製程(Mixed Mode)、高壓製程(High Voltage)、BCD 製程等平台。本公司目前提供 4bit~512kbit 容量 SIP 產品，已有眾多不同應用的客戶採用並設計、量產及出貨。本公司為嵌入式邏輯製程 MTP SIP 領域裡技術領導供應商，55 奈米、40 奈米製程也已導入合作夥伴開發中。本公司於 MTP SIP 技術層次的表現相當亮眼，早期邏輯製程嵌入式 OTP SIP 讓 IC 設計業者可以一次性參數寫入，但無法更改 ROM code，限制了產品的效能，此時若是有重複寫入的功能，將大幅提升客戶使用的方便性及產品的價值。公司為因應客戶產品應用多元化要求，除了與合作夥伴開發 55、40 奈米製程技術，且更在 MTP

SIP 產品本身投入大量研發經費，開發更低成本，效能更高，更符合客戶需求的產品。本公司研究發展方向如下：

## (2)研究發展概況

公司為因應客戶產品應用多元化要求，在 MTP SIP 產品本身投入大量研發經費，開發更低成本，效能更高，更符合客戶需求的產品。本公司研究發展概況如下：

### ①SIP 面積更小(size)

本公司持續開發 SIP 新架構，致力研發更小面積的記憶體基本單元(cell)，使 SIP 面積更小，讓客戶設計時能擁有更佳的靈活性與彈性度，更重要的是可降低客戶生產成本。

### ②讀取速度(Read Access Time)更快速

在 MCU 相關應用上，由於系統頻率愈來愈快速，對於儲存於 NVM SIP 資料要求更快的讀取速度。

### ③低消耗功率(Power)

消費性產品要求輕、薄、短、小已成趨勢，功率消耗為客戶規格上相當重要項目，甚至是決定客戶產品成功與否的指標，本公司 MTP SIP 致力提供更低消耗功率，提高客戶產品價值。

### ④更低讀取與寫入電壓

由於消費性產品輕、薄、短、小的趨勢，要求更低使用電壓，如此可加長消費性產品使用時間，更低使用電壓意謂消耗功率也會更少。

## (3)研究發展人員與其學經歷：

單位：人

年度	111 年度	112 年度	113 年 4 月底	
期初人數	45	47	46	
本期新進	7	2	1	
本期離職	5	3	0	
本期資遣	0	0	0	
本期退休	0	0	0	
期末人數	47	46	47	
平均服務年資	6.4	7	7	
離職率(%)	10%	6%	0%	
學歷分佈	博士	0	0	0
	碩士	22	21	22
	大學(專)	25	25	25
	高中(職)(含)以下	0	0	0
合計	47	46	47	

## (4)最近五年度每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度
項目					
A.研發費用	72,203	79,661	89,596	107,830	108,127

年度 項目	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度
B.營業收入	133,462	128,364	168,192	229,420	187,384
A/B	54.10%	62.06%	53.27%	47.00%	57.70%

(5)最近五年度開發成功之技術或產品

本公司自 2001 年成立至今，從非揮發性記憶體基本單元 bitcell(記憶胞)研發，乃至 SIP 產品形成，皆為自行研究開發，列舉最近五年重要的研發成果如下：

時間	重要成果
107 年 4 月	Nexchip 簽署合約開發 0.11 微米 MTP IP 矽智財元件
107 年 4 月	Nexchip 簽署合約開發 0.09 微米 MTP IP 矽智財元件
107 年 5 月	與新加坡商 Globalfoundries 開發 0.18 微米及 0.15 微米 G(IV)MTP IP 矽智財元件
107 年 11 月	與韓商 Hynix 簽署合約開發 0.11 微米及 MTP IP 矽智財元件
108 年 1 月	與廣州粵芯 Cansemi 簽署合約開發 0.18 微米 MTP IP 矽智財元件
108 年 1 月	與韓商 Hynix 簽署合約開發 0.18 微米 MTP IP 矽智財元件
108 年 2 月	與以色列商 Towerjazz 簽署合約開發 0.065 微米 MTP IP 矽智財元件
108 年 6 月	與韓商 Silicon Works 簽署合約開發 0.18 微米 MTP IP 矽智財元件
108 年 8 月	車規 Grade 0 MTP IP 矽智財元件完成開發
109 年 11 月	與矽創電子 Sitronix 簽署合約開發 0.11 微米 MTP IP 矽智財元件
110 年 2 月	與江西聯智 Celfras 簽署合約開發 0.18 微米 MTP IP 矽智財元件
111 年 10 月	與 SK 海力士系統集成電路(無錫) 簽署合約開發 0.18 微米 MTP IP 矽智財元件
112 年 2 月	與中央大學簽署產學合作開發新一代矽智財元件

4.長、短期業務發展計畫

為因應公司穩健且永續長久發展，特地就短期與長期公司業務發展進行規劃，因業務牽涉範圍廣泛，短期與長期業務發展計畫再各別細分成三項說明如下：

(1)短期業務發展計畫

①研究發展及製造計畫

- 因應客戶產品多元化需求，開發各式各樣應用領域 SIP，如 MCU 應用、功率 IC 應用、觸控 IC 應用，建置客戶更完整 NVM SIP 資料庫的解決方案。
- 與合作夥伴開發 55 奈米、40 奈米製程技術，提供客戶多元化使用平台環境。
- 與韓國、日本、大陸晶圓代工廠、整合元件製造廠簽署合作合約，提供客戶更多製程技術平台選擇。
- 改進 SIP 設計流程，加強研發能力，提高設計效率，以期適時推出產品上市。

②市場行銷計畫

- 本公司 SIP 產品已獲台灣地區客戶肯定及與本地晶圓代工廠、整合元件製造廠合作密切，短期計畫為積極拓展大陸市場，同時密切與大陸晶圓代工廠、整合元件製造廠合作。
- 除了既有應用領域外，拓展其他應用市場，並且擴大客戶群基礎。
- 對於既有及潛在客戶，改善服務項目、提升服務效率。
- 依區域建置全球行銷通路及管道，同時與晶圓代工廠、整合元件製造廠保持

密切合作關係。

③財務行政計畫

建立公司健全的財務環境及管理公司資金有效運用，並規劃公司股票上市上櫃。

(2)長期業務發展計畫

①研究發展及製造計畫

- a.因應客戶產品多樣化需求，與合作夥伴開發 55、40 奈米以內製程技術，此類應用如通訊類相關產品。
- b.IC 設計業為知識密集產業，應持續開發 NVM SIP 相關專利權，建立公司產品專利保護網，捍衛智慧財產權精神及保護本身權益。
- c.專注於智慧電力，手機屏控制 IC，手機屏驅動 IC，物聯網(IOT)、MCU 以及感應器市場的內建多次寫入非揮發性記憶體 SIP。

②市場行銷計畫

- a.積極拓展美國、韓國、日本、歐洲市場，同時與東南亞、歐洲晶圓代工廠、整合元件製造廠合作技術開發。
- b.配合公司全球化發展策略，增加 NVM SIP 市場佔有率，提升公司知名度，以成為國際級公司自許，期許公司發展成 NVM SIP 供應商第一品牌。
- c.建立國外行銷據點與通路，開發國際型客戶，維持穩定之年營收成長，提高公司的獲利能力。

③財務行政計畫

利用上市上櫃公開的資本市場，建構公司穩健長久的財務結構。

(二)市場及產銷概況

1.市場分析

(1)主要產品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

銷售區域	111 年	112 年
台灣	76,031	47,715
大陸(含香港)	84,992	78,560
新加坡	43,316	34,180
韓國	21,957	19,788
美國	2,645	3,745
其他	479	3,396
總計	229,420	187,384

(2)市場佔有率

本公司 2023 年營收 187,384 仟元，此營收全部來自於技術服務費和權利金，這與 IC 設計服務公司之營收中技術服務費和權利金所占的比例相當小有很大不同，台灣像本公司一樣以技術服務費、授權金、與權利金為主要營業收入的公司並不多，若再考慮同樣是致力於邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體 SIP 的供應商，除了本公司之外，僅有另一家供應商。隨著不同應用領域使用 YMC SIP 趨勢逐漸的形成，本公司於晶圓代工廠建置完成且經驗證成功的技術平台愈來愈多，客戶數目擴增，技術服務費與權利金營收將明顯快速成長，更可站穩 MTP 非揮發性記憶體 SIP 市場的領導地位。

本公司除自身持續研製新產品，也與晶圓代工廠建立緊密關係，了解晶圓代

工廠未來營運方向，不但能搶先挖掘潛在客戶並開發符合製程平台規格之產品，而在不斷更新規格、容量以符合各晶圓代工廠之製程平台或客戶產品需求時，本公司所上架之 IP 產品也持續增加，根據 Arsta Research Analysis 研究報告，本公司於 106 年~111 年之市場佔有率約為 2%，在整體 eNVM 市場中位居第四名。

**Table Global Embedded NVM (eNVM) IP Market Share by Companies (2017-2022)**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Microchip (SST)	46.27%	48.06%	47.78%	44.85%	43.47%	40.19%
eMemory	26.65%	24.27%	21.49%	23.87%	26.15%	26.87%
Synopsys	19.19%	18.38%	20.10%	19.49%	18.52%	20.41%
Yield Microelectronics Corp. (YMC)	2.25%	2.50%	2.62%	2.22%	2.40%	2.35%
NSCore, Inc.	0.49%	0.57%	0.68%	0.62%	0.61%	0.59%
Chengdu Analog Circuit Technology Inc. (Actt)	0.01%	0.05%	0.22%	0.82%	0.44%	0.97%
Others	5.13%	6.18%	7.11%	8.12%	8.41%	8.60%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Source: Arsta Research Analysis

### (3)市場未來之供需狀況與成長性

自從 1976 年工研院派出第一批菁英遠赴美國 RCA 取經並引進金屬氧化互補半導體(CMOS)技術，為我國半導體產業光榮史開啟了首部曲之後，至今已歷經 37 年，早在 2004 年時我國半導體產業即是第一個成為破兆元的產業，整體產業上、中、下游垂直分工專業、細緻，彼此有著非常緊密的關係，為台灣就業市場及經濟成長提供最穩定力量。其實半導體演進中，往往製程技術引領著半導體產業往前進步，摩爾定律(Moore's Law)揭曉：當價格不變時，積體電路(IC)上可容納的電晶體數目，約每隔 18 個月，便會增加一倍，效能也將提升一倍。雖然摩爾定律直至目前的 28 奈米、14 奈米製程技術，已開始受到考驗，不過其重要的意義在於長期而言，IC 製程技術是以一直線的方式向前推展，使得 IC 產品能持續降低成本，提升效能，增加功能。IC 製程技術的快速演進，加上近年 3C 產品要求輕、薄、短、小為目標的趨勢，促使系統單晶片(SoC; System-On-Chip)設計已經成為 IC 產業的顯學，普遍應用於各式各樣領域的 IC 產品上。

SoC 亦帶動 SIP(矽智財)產業快速崛起，為了因應 SoC 複雜的設計，使用 Reusable SIP 可降低設計人力的需求。IC 設計服務公司若採用已開發已定義且驗證完成的 SIP，可大幅縮短產品開發期，加速產品上市日期，提高競爭優勢，賺取最高利潤。半導體產業蓬勃發展除了造就 SIP 供應商龐大商機，對 IC 設計服務公司亦有不同需求服務應運而生。當 IC 設計服務公司業務由佈局、平面配置、繞線，轉往設計流程前端的 RTL 執行、邏輯合成、功能模擬，甚至由規格制定(Specification)就可幫客戶規畫，其與晶圓代工廠關係愈形緊密，客戶在先進製程開發新產品時，由於製程技術往往快過設計精進速度，晶片驗證所面臨問題可藉由與晶圓代工廠關係緊密之 IC 設計服務公司協助解決不同 SIP、不同製程相互整合的問題。

市場對 SIP 需求會隨著系統單晶片(SoC)複雜度增加而愈形重要，目前除了單顆 standalone 記憶體 IC (如 DRAM、NOR Flash、NAND Flash、SRAM)與部份功率晶片之外，其他各式各樣不同應用領域的 IC 產品，幾乎都有機會採用系統

單晶片(SoC)，由此可知系統單晶片(SoC)已深入每個應用領域，而系統單晶片又需要 Reusable SIP，在在顯示 SIP 需求的重要性，之前提過四種 SIP 類型：基本型 SIP、標準型 SIP、關鍵型 SIP、平台式 SIP，其中基本型 SIP 與製程相關性高，但價格較低；標準型 SIP 競爭激烈、應用範圍廣泛，但產品價格會隨著新產品的上市快速滑落；關鍵型 SIP 與平台式 SIP 擁有較高的附加價值，進入門檻高，競爭者少，這兩類型 SIP 主要還是以歐美大廠為主要供應商，而國內 IC 設計服務公司主要是提供 SoC 或 ASIC 的設計架構、設計服務、設計方法及 turnkey 服務，或者取得關鍵型 SIP 授權(如 ARM 與 MIPS 核心技術)以提供 SoC 設計平台。

整體半導體應用市場，隨著越來越多廠商投入在創新智慧載具，如：智慧機器人、無人機、智慧車輛等，從以往僅應用於特殊領域，近期正走向商用與消費型的市場，將帶動半導體應用新商機。

根據 Arsta Research Analysis 研究報告，112 年~117 年 eNVM 市場每年成長率皆高於 15%，其中 OTP 及 MTP 規模佔整體 eNVM 市場約 30%。



Source: Arsta Research Analysis

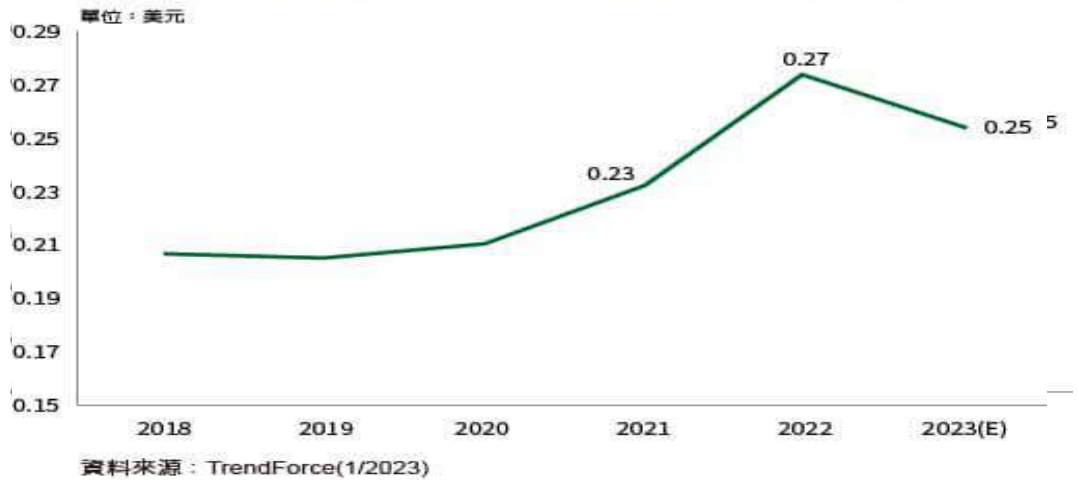
根據 TrendForce 指出，2023 上半年除了為傳統備貨淡季，且消費電子需求依舊疲軟，企業計劃性削減資本支出，然在電源管理晶片(PMIC)龍頭德儀(TI) RFAB2、LFAB 產能陸續開出情況之下，TrendForce 預估上半年全球電源管理晶片產能提升 4.7%，對消費性電子、網通、工控等應用產品將持續帶來降價壓力，預期上半年報價續降 5~10%。反觀，車規產品在燃油車轉電動車的進程推動下，需求穩定，即使景氣低迷讓整車市場雜音不斷，但車規產品受惠於買賣方長期建立的合作關係，價格不至於大幅鬆動，將成為整體電源管理晶片市場唯一穩定的銷售動能。

事實上，包括筆電、平板、電視、智慧型手機等產品使用的電源管理晶片，自 2022 年第三季起已開始降價，季減幅為 3~10%，至第四季除了相關應用的 AC-DC、DC-DC、LDO、Buck、Boost、PWM、Charger IC 再降 5~10%，網通裝置與工業領域需求也產生鬆動，目前僅剩少數工業(國防)與車用需求維持穩定，訂單排至 2023 年第二季無虞，較無降價求售情況產生。不過，由於工業與車用領域

的電源管理晶片有 83% 以上掌握在 IDM 大廠手上，IC 設計業者普遍仍較難切入，而這也是消費電子需求不振的當下，IC 設計業者急欲切入的市場，IC 送驗進度刻不容緩也持續進行。

據 TrendForce 調查目前電源管理晶片交期狀況，IC 設計業者的平均交期為 12~28 周，甚至部分型號產品因備有大量庫存，如面板端電源管理晶片，只要下訂即可立刻出貨；而 IDM 大廠的交期普遍仍較長，非車規交期為 20~40 周，而車規交期則超過 32 周，亦有少數製造、組裝與檢驗流程較為繁瑣的產品仍處於配貨狀態。

2018~2023年通用型PMIC平均銷售單價



#### (4) 競爭利基

本公司專注於邏輯製程嵌入式 NVM(非揮發性記憶體) SIP 開發與銷售，從基本記憶體單元 bitcell(記憶胞)乃至整個 SIP 功能區塊(macro)開發，都是本公司自主開發完成，至今本公司已取得數十項國內外相關的專利權，在知識密集的 SIP 產業，已建構出堅強的專利保護傘，用以保護本身權益。此邏輯製程嵌入式 MTP SIP 已成功導入於合作夥伴之 0.5 微米、0.4 微米、0.35 微米、0.3 微米、0.25 微米、0.18 微米、0.16 微米、0.15 微米、0.13 微米、0.11 微米、90 奈米、80 奈米、65 奈米製程技術，因應客戶不同應用之產品的多元化需求，建置了邏輯製程(Logic)、混合信號製程(Mixed Mode)、高壓製程(High Voltage)、BCD 製程等平台，同時為提供客戶多領域差異化需求，55 奈米、40 奈米製程也已導入合作夥伴開發中。由於本公司獨特的記憶體 SIP 技術使得原本採用嵌入式 OTP SIP 或嵌入式 Flash SIP 的客戶進而轉變改用本公司嵌入式 MTP SIP，客戶可以以一般製程的晶圓價格，得到比嵌入式 Flash 方便使用的效能，讓客戶設計更有彈性，產品更具競爭優勢。

與合作夥伴及客戶間緊密關係目前已有超過十家以上晶圓代工廠與整合元件製造廠與本公司有著緊密策略夥伴關係，本公司開發的 MTP SIP 於合作夥伴生產線上建置不同製程技術的平台，經合作夥伴嚴格的驗證流程，完成後即提供客戶採用，目前在各不同的應用領域，已有多家知名 IC 設計公司採用本公司 MTP SIP 產品。

員工為公司最大的資產，本公司研發團隊人員有相當比例已經在半導體產業服務超過十年，甚至有些已達二十、三十年，擁有豐富專業的技術能力，協助客戶設計出功能優異可靠的 MTP SIP 產品。為因應本公司未來業績持續成長需求，會不斷網羅優秀人才加入本公司行列。

## (5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

### ①發展遠景之有利因素

#### a.矽智財(SIP)產業在半導體市場已成為關鍵力量

國內半導體產業經過三十幾年演進與發展，已經形成上游、中游、下游垂直專業分工模式，且上、中、下游彼此關係密切，形成綿密網絡。SIP 產業位居上游的設計業中的一環，在晶片設計複雜度日益提高下，SIP 可減少設計人員的負擔，加速產品設計時程，提早產品上市時間，清楚顯示 SIP 產業於半導體市場產業鏈的重要性，此關鍵力量會加速更多廠商投入，讓市場更加成熟，有利 SIP 供應商往更先進製程發展並開拓不同應用的商機。

b.邏輯製程嵌入式 MTP 非揮發性記憶體 SIP 進入門檻高，競爭者少非揮發性記憶體 SIP 產業為一知識密集型產業，若要掌握關鍵技術免於同業競爭，必先自主開發基本單元(cell)並取得專利傘保護，才能領先競爭者，並獲取最大利益。非揮發性記憶體 SIP 產品開發流程相當冗長，由基本單元(cell)研發，至 SIP 功能區塊(macro)完成，SIP 產品還須經過晶圓代工廠、整合元件製造廠(IDM)驗證成功，才會放入 SIP 資料庫供客戶使用，若是客製化非揮發性記憶體 SIP 產品，必須由 SIP 規格(specification)制定開始，再經晶圓代工廠驗證完成，客戶才會採用，進行量產動作。除了開發耗費時間，非揮發性記憶體 SIP 必須建置於晶圓代工廠、整合元件製造廠(IDM)製程平台，以供 IC 設計公司量產出貨，所以必須與中游的晶圓代工廠、整合元件製造廠建立密切的策略夥伴關係，以利產品開發，順利導入量產流程，才能共創雙贏條件。由於如此漫長開發過程，故有意願投入者相當少，相對地也建立起相當高門檻，邏輯製程嵌入式 MTP 非揮發性記憶體 SIP 包括本公司在內，國內外目前僅三或四家公司投入且推廣此一領域開發。

c.應用面已逐漸改變，轉而採用邏輯製程嵌入式 MTP 非揮發性記憶體 SIP，邏輯製程嵌入式 MTP 非揮發性記憶體 SIP 已逐漸吸引 IC 設計公司目光，許多客戶開始捨棄傳統的嵌入式 OTP SIP 與嵌入式 Flash SIP，改採 MTP 非揮發性記憶體 SIP 解決方案，客戶可以以一般製程的晶圓價格，得到比嵌入式 Flash 方便使用的效能。嵌入式 OTP SIP 只能一次性使用，ROM code 無法改變，限制產品效能；而嵌入式 Flash SIP 因為製程複雜，還要增加額外的光罩，使得晶圓價格要比一般製程昂貴許多。本公司開發的邏輯製程嵌入式 MTP 非揮發性記憶體 SIP 已獲得許多知名 IC 設計公司採用，並有許多案件已開發完成並已量產出貨。MTP 非揮發性記憶體 SIP 解決方案應用領域遍佈於消費性產品 IC、資訊產品 IC、通訊類產品 IC、家電 IC 等等。

### ②發展遠景之不利因素及因應對策

#### a. NVM(非揮發性記憶體) SIP 領域人才尋找不易

國內開發記憶體(memory)IC 的時間可推移至早期的華邦電子、聯華電子、旺宏電子，由 Mask ROM，EPROM、SRAM，而後有 Flash、DRAM，目前則有力晶半導體開發 NAND Flash，不過國內整體 DRAM 規模還是遠大於 Flash，NVM(非揮發性記憶體) 領域人才比較於類比 IC、邏輯元件、微元件 IC 的人才更顯稀少。

因應對策：

<i>有經驗且專業人才難尋，本公司有計劃長期培訓經驗資淺的員工，除了公司內部專業訓練並於半導體專業機構或學校接受教育訓練。



<ii>申請半導體相關科系畢業之國防役學生，進行長期培訓。

<iii>申請股票公開發行及上市、上櫃，吸引員工，留住人才。

b.競爭者亦推出多次邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體 SIP

嵌入式 OTP SIP 市場逐漸式微，促使 OTP SIP 供應商加快在 MTP SIP 開發腳步，不過邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體 SIP 特性之優劣，與基本單元 (cell) 架構有直接關係，嵌入式 OTP SIP 開發的經驗值不一定可直接套用在嵌入式 MTP SIP 上，SIP 的功能區塊 (macro) 還需要晶圓代工廠驗證確認，並經客戶實際使用狀況而定。本公司目前已站穩領先優勢，仍會戰戰兢兢推廣 MTP SIP 產品，持續開發新 SIP，滿足客戶需求。

因應對策：

<i>持續開發先進製程 MTP SIP 產品。

<ii>建構多樣化不同應用 SIP 產品。

<iii>持續於不同晶圓代工廠、整合元件製造廠建置多樣化技術平台。

<iiii>架構專業技術服務系統，力求迅速回應客戶需求。

<iiiii>提高公司知名度，開發國際級客戶使用。

## 2. 主要產品之用途及產製過程

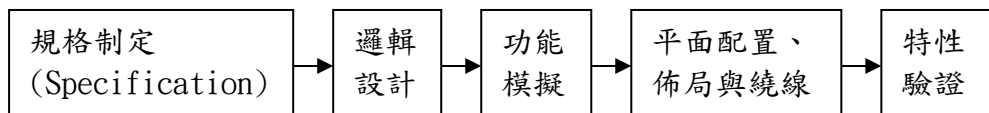
### (1) 主要產品之重要用途：

本公司致力於邏輯製程嵌入式 MTP 非揮發性記憶體 SIP 開發與銷售服務，本公司 SIP 產品應用範圍廣泛，可使用於消費性電子 IC、通訊類電子 IC、資訊電腦類 IC 等領域，應用產品類型如下：

- ① 功率 IC (Power Management IC)。
- ② 微控制器 (MCU / SoC)。
- ③ LED 驅動 IC (LED driver IC)。
- ④ TFT LCD 驅動 IC (TFT LCD Driver IC)。
- ⑤ 觸控控制器 (Touch controller)。
- ⑥ In Cell Touch controller。
- ⑦ AMOLED Driver IC。

### (2) 主要產品之產製過程

本公司專為邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體 SIP 之研究、開發與行銷，SIP 為矽智財產品，並非實體產品，本公司開發 SIP 產品流程如下：



## 3. 主要原料之供應狀況

本公司只有在業務交易方式為晶圓生產服務時，直接承接客戶晶圓產品訂單，再由本公司向晶圓代工廠下單，生產客戶所需有內含本公司 NVM SIP 之晶圓產品，交予客戶之產品為晶圓，此時本公司產品之原料為晶圓。至目前為止，本公司已無晶圓生產服務之業務提供。

4. 近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化之說明

單位：新台幣仟元

年度	111 年度	112 年度
營業收入	229,420	187,384
營業毛利	227,700	185,816
毛利率 (%)	99	99

資料來源：本公司各年度經會計師查核簽證之財務報告。

本公司 111 年度與 112 年度二年度毛利率並無差異，故不予分析。

5. 主要進銷貨客戶名單

- (1) 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例。

本公司為一家專業邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體 SIP (矽智財; Silicon Intellectual Property) 設計公司，本身並無從事生產與製造，故不適用此項評估。

- (2) 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例。

單位：新台幣仟元

年度	112 年度				111 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 (%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 (%)	與發行人之關係
1	客戶甲	33,194	17.71	無	客戶甲	43,317	18.88	無
2	客戶乙	25,285	13.49	無	客戶乙	33,951	14.80	無
3	客戶丙	19,788	10.56	無	-	-	-	-
4	客戶丁	18,929	10.10	無	客戶丁	23,808	10.38	無
5	其他	90,188	48.14	無	其他	128,344	55.94	無
	銷貨淨額	187,384	100.00		銷貨淨額	229,420	100.00	

增減變動說明：主要係受到 IC 設計公司調整庫存以及整體經濟較疲弱之因素。

6. 最近二年度生產量值

本公司為一家專業邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體 SIP (矽智財; Silicon Intellectual Property) 設計公司，本身並無從事生產與製造，故不適用此項評估。

## 7.最近二年度銷售量值

單位：新台幣仟元

銷 售 量 值  主要商品	年度		112 年度				111 年度			
			內銷		外銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值	量	值
技術服務收入	-	6,601	-	41,481	-	13,213	-	45,608	-	107,781
技術權利金	-	41,114	-	98,188	-	62,818	-	107,781	-	153,389
合計	-	47,715	-	139,669	-	76,031	-	153,389	-	153,389

註：本公司設計開發之產品，並不適用以數量計算。

### (三) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止之從業員工人數

單位：人

項目		年度	111 年度	112 年度	113 年度 截至 3 月 31 日止
員工 人數 (人)	經理人		7	8	8
	一般員工		14	14	13
	技術及研發人員		42	40	43
	合計		63	62	64
平均年歲(歲)			36	35.5	36.7
平均服務年資(年)			6.4	6.9	7.3
學歷分布 比率 (%)	博士		-	0	0
	碩士		41	28	27
	大專		59	34	37
	高中(含)以下		-	0	0

### (四) 環保支出資訊

- 1、依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：無此情形。
- 2、列示公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：不適用。
- 3、說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：無此情形。
- 4、說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)，處分之總額，並揭露其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：無此情形。
- 5、說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

### (五) 勞資關係

1. 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協

議與各項員工權益維護措施情形：

(1) 福利措施及實施狀況：

① 公司福利：

除以勞基法及相關法令辦理外，並特別規劃員工團體保險以補勞工保險之不足，亦嘉惠員工之眷屬使其保障福利更為完善，以及租借場地給于員工運動的時間等。

② 職工福利：

統籌辦理各項福利措施，包含年度國內外員工旅遊、特約商店、員工聚餐、年終尾牙、年節禮金、社團活動等，使同仁倍感公司關懷與照顧。

(2) 進修、訓練及實施狀況：

本公司為因應產業技術快速變遷及確保員工才能發展，本公司提供員工參加訓練之機會及經費，期使每位員工能吸收新知不斷自我成長，並能貢獻所學，精益求精，提昇工作品質與層次，創造公司整體利潤，並藉由工作與訓練使個人職涯規劃與公司整體利益能同時成長。

(3) 退休制度及實施狀況：

本公司依據勞工退休金條例（勞退新制），為員工按月提繳勞工退休金，儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。

(4) 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

為保障勞資權益，協調勞資關係，本公司致力加強勞資和諧，並定期召開勞資相關行政會議，作為公司與員工之溝通管道，因此，迄今勞資關係一向和諧，並無重大勞資糾紛情事發生。

本公司為關懷公司員工，以達到即時照顧員工保持員工意見反應管道之順暢，期能透過各項訪談機制與通暢的溝通管道，主動發掘問題並定期審視各項管理措施與可改善之空間，建立一個能使員工快樂工作的環境。

2. 說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：

本公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止尚無發生勞資糾紛而導致損失之情事。

(六) 資通安全管理：

1. 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

(1) 資通安全風險管理架構

A. 本公司成立跨部門資訊安全委員會由總經理擔任總召集人。

B. 已制定發行資訊安全管理目標及政策、個人資料管理政策，並定期檢討修訂。

C. 定期召開管理審查會議檢討資訊安全管理制度及個人資料管理制度執行情形。

(2) 資通安全政策

A. 根據內部控制制度，設置防火牆並定期檢視紀錄。

B. 個人電腦均安裝防毒軟體並且定期更新，並禁止使用未經授權的軟體。

C. 定期向員工宣達本公司之資訊安全政策及規定。

D. 定期覆核各項資安項目之 System Log，追蹤異常之情形。

E. 根據內部控制制度，定期備份重要資訊，採用異地備份。

F. 設置電腦機房，且實施門禁管制，人員進出須紀錄於「機房工作日誌」。

- G.所有操作伺服器及網路設備之動作均應確實記錄於「系統管理工作日誌」上。
- H.根據內部控制制度，硬體於已逾使用年限、損壞或不堪使用時，統一由資訊管理單位收集保管，由資訊管理單位負責填寫『財產報廢明細表』，經總經理同意後，於銷毀前填寫「資訊設備銷毀資安檢核表」，進行資料銷毀處理。
- I.根據內部控制制度，定期演練災害復原，防止公司因意外事故導致資訊軟硬體之毀損而影響到營業中斷的狀況發生。
- J.定期盤點資訊資產及個人資料清冊，依資訊安全及個人資料風險評鑑進行風險管理，落實各項管控措施。
- K.根據內部控制制度，要求同仁帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任並定期換置密碼。
- L.每年定期實施內部稽核，以確保資訊安全、個資保護管理制度之有效性。
- M.根據內部控制制度，系統開發與程式修改皆須經過審慎評估與權責主管簽核。
- N.機敏資料存取指定特定人員、指定特定機器，且需使用雙因子驗證來進行身分驗證。
- O.定期由第三方外部專家進行資訊安全風險評鑒，並針對弱點進行改善。

(3)具體管理方案及投入資通安全管理之資源

本公司格外重視資訊安全風險控制與保護，設有管制區，佈建多層次縱深防禦的資安管控防護網，實施嚴格的管控措施，例如資訊資產分類分級、資料對外傳輸的管制，必須經過申請核准、郵件系統防護、列影印傳真之資料輸出管制、網路異常查核、資訊設備進出必須遵照流程提出申請核准、禁止攜入私人儲存裝置、禁止私人設備進行拍照或錄影、加強出入管制與門禁，權限需定期進行重新審閱，並定期透過實體或線上課程給予全體同仁進行資安教育訓練，以及公告資安管控及重大資安事件進行意識宣導，資安管控依擬定之計畫升級。

近年來網路攻擊事件頻傳，勒索病毒尤為猖獗，影響層面廣泛，已對企業造成莫大的損害，不得掉以輕心，本公司針對國內外重大資安事件進行深入分析探討，加強內部及外部網路攻擊防護，教育訓練意識宣導，嚴格執行防火牆政策審核、主機端點防護、網路入侵偵測、防毒系統更新、主機及網路設備漏洞修補、電腦機房管理等，透過本公司資安維運的平台，定期進行系統查核與改善，為客戶及股東創造價值，善盡社會責任。

- 2.列明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。

本公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，並未遭受重大資通安全事件，且未有相關之損失及影響。

(七)有無因應景氣變動之能力

本公司經營團隊之專業能力，對產品市場的策略與定位有豐富經驗，隨時蒐集市場資訊及分析市場動向，且加強內部各項管理，以做好風險控管，使本公司營運能在景氣變化時有立即因應措施，將景氣變化對公司營運影響降至最低。

(八)發行公司及其各子公司(包括母子公司間交易事項)之關係人間交易事項是否合理

本公司與關係人間之交易均符合法令規範，並無非常規交易事項，相關交易說明請參閱本公司經會計師查核簽證之財務報告。

(九)本國發行公司或外國發行人初次申請股票在創新板上市者，應增列下列事項

1.市場及產銷部分，應增列產品核心技術分析暨持續發展之研究發展計畫

(1)產品生產開發技術之層次、來源、確保（專利權及所受法律保護狀況）與提升

本公司所有技術皆自行研發，其中以邏輯製程嵌入式少光罩多次寫入非揮發性記憶細胞為主要的核心技術，本公司所提供的每一個嵌入式NVM SIP產品，都是依據某家晶圓代工廠或整合元件製造廠之某製程技術所設計開發，當SIP產品開發後，就會進入此家晶圓代工廠或整合元件製造廠的可靠度驗證流程，一旦驗證完成之後，SIP即為上架產品，可供客戶晶片merge(合併)使用，同時也在合作夥伴生產線，建置了包括邏輯製程(Logic)、混合信號製程(Mixed Mode)、高壓製程(High Voltage)、BCD製程、CIS製程等技術平台，提供IC設計公司多樣和差異化的選擇。

本公司為技術創業企業具有獨特的創新技術，為確保技術在未來在市場上擁有法律上的保護，不被其他競爭對手輕易模仿抄襲，本公司積極布局智慧財產權領域，並註冊多項商標及專利，尤其各項產品均有申請專利保護，且專利布局領域橫跨美國、中國及台灣等地區。本公司不斷開發的創新產品，並持續推出面積更小、讀取速度更快的cell，以維持競爭優勢。

為持續提升公司技術之競爭力，公司持續參加相關之國際半導體展覽會，如台積電、Magnachip 等知名大廠在世界各地所舉辦的研討會，以了解國際技術及產品開發趨勢，並持續提昇整體研發能力並設計出可滿足客戶需求之嵌入式非揮發性記憶體SIP 技術。

(2)現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究發展計畫

A.競爭優勢

本公司邏輯製程嵌入式非揮發性記憶細胞可使用於少光罩製程約只需15層光罩而且可以多次寫入，邏輯製程記憶細胞也是同業中最小，目前中容量產品在MCU及智慧電源市場已佔有一席的地位。今年第四代及第五代cell所設計的MTP 及FTP IP，其推出可以爭取到更大容量客戶的需求，也因為面積的再度縮小將會取代部分OTP的市場。

B.生命週期及持續發展性

本公司邏輯製程嵌入式少光罩多次寫入非揮發性記憶細胞經過持續的改良與經驗的累積到目前已發展到第七代，其中第一代到第三代產品客戶仍持續量產中，嵌入式非揮發性記憶體產品在市場上已存在數十年，隨著物聯網及智慧電源的成長嵌入式非揮發性記憶體的需求也跟著成長，本公司生產的嵌入式少光罩多次寫入非揮發性記憶體矽智財在中容量的部分因為只需15層光罩，又具有面積小的優勢，不僅在成本上吸引客戶，也由於光罩層數少在生產周期也具吸引力。

在先進駕駛輔助系統(ADAS)、駕駛監控系統(DMS)等應用日益普及的情況下，汽車產業對相機模組與影像感測器等元件的需求，在未來幾年將維持高速成長。據Yole Group估計，2022年車用相機模組與車用影像感測器的銷售金額，各自比2021年成長了22.8%與35.3%。法規要求汽車必須搭載更先進的安全功能，以及晶片缺貨造成產品ASP上漲，是帶動此一市場能在2022年繳出如此亮眼成績的兩大因素。

長期來看，車用相機模組市場的規模，將在2028年成長到94億美元。2022~2028年間的複合年增率(CAGR)為9.7%。其中約有三分之一的營收由鏡頭組貢獻，影像感測器的營收貢獻度則接近四成。

值得注意的是，以應用別來看，雖然ADAS將是車用相機模組最重要的應用，但駕駛監控系統與智慧座艙等應用由於基期相對較低的關係，其成長速度將遠高於

ADAS。

## 2022~2028年車用相機模組市場規模預估



資料來源：Yole Group(7/2023)

市場上帶MCU的產品多數都會有嵌入式非揮發性記憶體的需求，而隨著MCU市場的成長，嵌入式非揮發性記憶體的需求也同步成長，另外LED驅動IC及PMIC IC也陸續導入可多次寫入的嵌入式非揮發性記憶體，增加使用者的方便性，因此嵌入式非揮發性記憶體尚無生命周期的風險。

### C. 新產品之研究開發計畫

本公司將持續投入研發資源，以開發新產品技術，目前係以自行開發為主，每年約投入90,000 仟元至100,000 仟元作為研究開發費用。本公司於現有嵌入式非揮發性記憶體矽智財之開發上，已陸續執行新產品開發計畫，未來研發計畫如下所列：

產品名稱	主要用途	預計完成時程
100k cycle EEPROM	工業控制，安全防護，車用	2024 年中完成驗證
Anti fuse OTP	手機、平板、電子紙、可攜式產品	2024 年底完成驗證
Flash IP	微控制器、電源管理應用	2024 年底完成產品開發
HKMG MTP	微控制器、電源管理應用	2024 年底完成工程驗證

2.如係屬生技醫療業者，應增列其核心產品之臨床實驗進度資訊：不適用。

3.最近二年度從業員工人數部分，增列經理人、技術及研究發展人員暨其他員工之流動情形：請參閱本公開說明書「貳、一、(三)最近二年度及截至公開說明書刊印日止從業員工人數」。

## 二、不動產、廠房及設備及其他不動產應記載事項

### (一)自有資產

- 1、列明取得成本達實收資本額百分之二十或三億元以上之不動產、廠房及設備名稱、數量、取得日期、取得成本、重估增值及未折減餘額，並揭露其使用及保險情形、設定擔保及權利受限制之其他情事。但公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，前開有關達實收資本額百分之二十部分改以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之：無。
- 2、列明閒置不動產及以投資為目的持有期間達五年以上之不動產名稱、面積、座落地點、取得日期、取得成本、重估增值、未折減餘額、公告現值或房屋評定價值、公允價值及預計未來處分或開發計畫：無。

### (二)使用權資產

列明金額達實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上之使用權資產租賃標的名稱、數量、租賃期間、出租人名稱、原始帳面金額、未折減餘額，並揭露其保險情形及租約之重要約定事項：無。

### (三)各生產工廠現況及最近二年度設備產能利用率：

本公司為一家專業邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體SIP (矽智財; Silicon Intellectual Property)設計公司，本身並無從事生產與製造，故不適用此項。

## 三、轉投資事業

### (一)轉投資事業概況

112年12月31日；單位：新台幣仟元；仟股

轉投資事業	主要營業	投資成本	帳面價值	投資股份		股權淨值	市價	會計處理方法	112年度投資報酬		持有公司股份總額
				股數	股權比例				投資損益	分配股利	
晶隼科技	RFID	29,350	0	2,350	13.30%	0.3	註	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	-	-	-

註：非上市櫃公司，故無市價。

### (二)綜合持股比例：

112年12月31日；單位：新台幣仟元；仟股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)
晶隼科技	2,350	13.30	3,878	21.94	6,228	35.24



(三)上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司財務績效及財務狀況之影響：不適用。

(四)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，發生公司法第一百八十五條情事或有以部分營業、研發成果移轉子公司者，應揭露放棄子公司現金增資認購情形，認購相對人之名稱、及其與公司、董事、監察人及持股比例超過百分之十股東之關係及認購股數：無。

#### 四、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
授權使用、合作開發	POWERCHIP	101.10.1~	技術授權合約	保密及遵守智慧財產權
授權使用、合作開發	Globalfoundries	105.3~	技術授權合約	保密及遵守智慧財產權
授權使用	無錫華潤矽科微電子	105.7.15~115.7.15	技術授權合約	保密及遵守智慧財產權
授權使用	世界先進 VIS	105.10.6~	技術授權合約	保密及遵守智慧財產權
授權使用	香港 SOUTHC	106.11.7~	技術授權合約	保密及遵守智慧財產權
授權使用	無錫中微愛芯電子	107.6.25~	技術授權合約	保密及遵守智慧財產權
授權使用	九齊科技	107.8.30~	技術授權合約	保密及遵守智慧財產權
專利專屬授權	晶隼科技(股)公司	108.1.21~	技術授權合約	保密及遵守智慧財產權
產品開發	SK Hynix	108.1.25~113.11.29	技術授權合約	保密及遵守智慧財產權
授權服務	和艦芯片製造(蘇州)	108.7.15~113.7.15	技術授權合約	保密及遵守智慧財產權
產品開發/技術移轉	合肥晶合集成電路	108.7.19~113.7.19	技術授權合約	保密及遵守智慧財產權
授權使用	合肥捷達電子(有)公司	108.7.20~	技術授權合約	保密及遵守智慧財產權
合作開發	上海華力微電子有限公司	109.9.20~119.9.20	IP 開發協議合約	保密及遵守智慧財產權
授權使用	矽創電子股份有限公司	109.11.24~	IP 開發暨授權合約	保密及遵守智慧財產權
授權使用	上海市海欒創科技股份有限公司	109.12.31~112.12.31	技術授權協議	保密及遵守智慧財產權
產品開發	江西聯智集成電路	110.2.23~	IP 開發暨授權合約	保密及遵守智慧財產權
授權使用	成都市易沖半導體	110.8.12	技術授權合約	保密及遵守

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
				智慧財產權
產品開發	SK Hynix(Wuxi)	111.10.13~	IP 開發暨授權合約	保密及遵守 智慧財產權
授權使用	成都水芯電子科技 有限公司	112.02.17- 115.02.17	授權使用合約書	保密及遵守 智慧財產權
授權使用	伏達半導體(合肥) 有限公司	112.03.28~	授權使用合約書	保密及遵守 智慧財產權
產品開發/ 技術移轉	合肥新品集成電路 有限公司	112.07.20- 117.07.20	產品開發-技術移轉 協議	保密及遵守 智慧財產權

## 參、發行計畫及執行情形

- 一、前次現金增資、併購或受讓其他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計畫分析：  
本公司並無辦理併購、受讓其他公司股份發行新股或發行公司債，而前各次現金增資計畫尚未完成及計畫實際完成日距申報時未逾三年者，茲就其計畫內容、執行情形及效益分析如下：不適用。
- 二、本次現金增資、發行公司債、發行員工認股權憑證或限制員工權利新股計畫應記載事項：

### (一) 資金來源

1. 本次計畫所需資金總額：新臺幣 235,021 仟元。
2. 資金來源：本次現金增資發行普通股 2,616 仟股，每股面額新臺幣 10 元，計新臺幣 26,160 仟元，競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之 30 個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新臺幣 60.00 元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，本次競價拍賣得標總金額為新臺幣 215,371 仟元；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格每股新臺幣 91.49 元為之，惟均價高於最低承銷價格之 1.25 倍，故每股發行價格以新臺幣 75.00 元溢價發行。另員工認購募集資金為新臺幣 19,650 仟元，募集總金額 235,021 仟元。

### 3. 計畫項目、預定資金運用進度

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成時間	所需資金總額	預計資金運用進度
			113年第二季
充實營運資金	113年第二季	235,021	235,021
合計		235,021	235,021

### 4. 預計可能產生效益

本次辦理現金增資發行資金總 235,021 仟元，考量申報主管機關審核、資金募集等相關作業時間，預計於 113 年第二季完成。本次現金增資完成後，現金流入預估可增加 235,021 仟元，除可提高自有資本比率及強化財務結構外，並可節省利息支出及提高公司整體競爭力，有助於公司未來中長期發展。

5. 本次募集之資金如有不足，其籌措方法及來源：本次計畫係現金增資發行普通股，如因募集股數或每股實際發行價格因市場變動而調整，致募集資金不足時，將減少充實營運資金之金額；惟若致募集資金增加時，將全數用以充實營運資金。

- (二) 本次發行公司債者，應參照公司法第二百四十八條之規定，揭露有關事項及其償債款項之籌集計畫與保管方法。如有委託經金管會核准或認可之信用評等機構評等者，並應揭露該機構名稱、評等日期及公司債信用評等結果。如附有轉換、交換或認股權利者，並應揭露發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形與對股東權益影響：不適用。
- (三) 本次發行特別股者，應揭露每股面額、發行價格、發行條件對特別股股東權益影響、股權可能稀釋情形、對股東權益影響及公司法第一百五十七條所規定之事項。

如 附有轉換權利或認股權利者，並應揭露發行及轉換辦法或認股辦法（含轉換前原特別股未分配之股息等權利義務於強制轉換後之歸屬）：不適用。

- (四)上市或上櫃公司發行未上市或未上櫃特別股者，應揭露發行目的、不擬上市或上櫃原因、對現有股東及潛在投資人權益之影響及未來有無申請上市或上櫃之計畫：不適用。
- (五)股票依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則 第五條規定核准在證券商營業處所買賣之公司發行新股者，應說明未來上市（櫃）計畫：不適用。
- (六)本次發行員工認股權憑證者，應揭露員工認股權憑證發行及認股辦法：不適用。
- (七)本次發行限制員工權利新股者，應揭露限制員工權利新股之發行辦法：不適用。
- (八)說明本次計畫之可行性、必要性及合理性，並應分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響。以低於票面金額發行股票者，應說明公司折價發行新股之必要性與合理性、未採用其他籌資方式之原因與其合理性及所沖減資本公積或保留盈餘之數額：

#### 1. 本次計畫之可行性評估

##### (1) 法定程序之可行性

本公司本次辦理創新板上市前現金增資發行普通股計畫，業經本公司 107 年 3 月 14 日董事會及 107 年 5 月 30 日股東常會決議通過辦理初次上市前現金增資提撥公開承銷案，並於 113 年 2 月 27 日董事會決議通過本次現金增資股票發行計畫，且授權董事長全權處理相關增資事宜。經核閱本公司本次計畫之相關內容，均符合「公司法」、「證券交易法」、「發行人募集與發行有價證券處理準則」、「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及其他相關法令之規定，另參閱蔚中傑律師事務所蔚中傑律師出具之法律意見書，本次計畫之相關內容符合相關法令之規定，故本次計畫於法定程序上應屬適法可行。

##### (2) 募集資金完成之可行性

本次計畫辦理現金增資發行普通股 2,616 仟股，每股面額新臺幣 10 元，總募集資金為新臺幣 235,021 仟元。本次現金增資依公司法第 267 條規定，保留增資發行新股之 10%，計 262 仟股由員工認購，其餘之 90% 計 2,354 仟股，則依「臺灣證券交易所股份有限公司上市審查準則」第 36 條及「臺灣證券交易所股份有限公司上市審查準則補充規定」第 17 條之 1 之規定，以現金增資發行新股方式委託證券商承銷商辦理上市前公開銷售，並按證券交易法第 28 條之 1 規定，於 117 年 5 月 30 日股東常會決議原股東放棄優先認購權利，排除公司法第 267 條第 3 項原股東優先認購之適用。本次辦理創新板初次上市前現金增資發行新股採全數競價拍賣方式辦理，其中員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理，應可確保資金募集完成，故本次計畫募集完成應具可行性。

##### (3) 資金運用計畫之可行性

本次現金增資計畫募集資金預計為新臺幣 235,021 仟元，資金運用計畫為充實營運資金，進而強化公司長期競爭力及健全財務結構，並可提升資金靈活調度之彈性，對企業經營具有正面助益，故本公司本次辦理現金增資充實營運資金之運用計畫應屬可行。

#### 2. 本次募集資金計畫之必要性

本次辦理現金增資發行新股係依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第 36 條規定，以現金增資發行新股方式，委託證券商承銷商辦理創

新板上市前公開承銷，另依「發行人募集與發行有價證券處理準則」，得不適用有關計畫必要性之規定。

3. 本次募集與發行有價證券資金運用計畫、預計進度及預計可能效益之合理性

(1) 資金運用計畫及預計進度之合理性

本公司本次辦理現金增資發行新股係作為辦理初次創新板上市前公開承銷之用，預計募得資金總額為新臺幣235,021仟元，經考量本次向主管機關申報、審查時間、公開承銷期間及繳款作業等因素，預計於113年第二季底前可收足股款，俟資金募集完成後，隨即將本次現金增資所籌措之款項用於充實營運資金，故其資金運用計畫及預計進度應屬合理。

(2) 預計可能產生效益之合理性

單位：新臺幣仟元

項目 / 年度		112年度	本次計畫執行完畢
財務結構	負債比率(%)	13.60	8.83
	流動比率(%)	714.20	1154.74
償債能力	速動比率(%)	708.99	1149.53

資料來源：本公司112年度經會計師查核之財務報告。

註：係按本公司本公司112年度經會計師查核之財務報告為基準，加計本次辦理現金增資發行新股募得資金予以設算。

本公司本次募集之資金將全數用於充實營運資金，提升中長期競爭力之外，對財務結構及償債能力改善，如上表所示，預估本次現金增資於113年第二季募集完成並挹注公司營運資金後，在財務結構方面，負債占資產比率可由增資前13.60%降至8.83%；就償債能力而言，流動比率及速動比率分別由增資前714.20%及708.99%，攀升至增資後之1154.74%及1149.53%，故對本公司整體營運發展及健全財務結構等面相均有正面助益，故本次募集計畫預計可能產生效益應屬合理。

4. 各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響

本公司本次募資計畫係依據發行人辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則63則」第六條第二項第三款規定，以現金增資發行新股辦理初次創新板上市前之公開銷售作業，故僅就發行新股對本年度每股盈餘稀釋情形進行評估。

本公司本次辦理創新板初次上市前現金增資發行新股2,616,000股，預計於113年第二季募集完成，以本公司現有股本26,810,000股估算，增資後已發行股份總額將增加至29,426,000股，本次辦理現金增資發行新股占本公司增資後股數之8.89%，本公司本次辦理現金增資用以充實營運資金，其將可強化財務結構及償債能力、增加資金靈活調度之彈性及維持公司競爭力，故本次辦理現金增資發行新股對本公司每股盈餘稀釋影響應屬有限，對現有股東權益亦尚無重大影響。

5. 以低於票面金額發行股票者，應說明公司折價發行新股之必要性與合理性、未採用其他籌資方式之原因與其合理性及所沖減資本公積或保留盈餘之數額：不適用。

(九) 說明本次發行價格、轉換價格、交換價格或認股價格之訂定方式

請參閱本公開說明書附件「承銷價格計算書」。

(十) 資金運用概算及可能產生之效益

1. 收購其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備者，應說明本次計畫完成後，預計可能增加之產銷量、值、成本結構（含總成本及單位成本）、獲利能力之變動情形、產品品質之改善情形及其他可能產生之效益：不適用。

2.轉投資其他公司者：不適用。

3.充實營運資金、償還債務者，應列明下列事項：

(1)公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形、目前營運資金狀況、所需之資金額度及預計運用情形，並列示所編製之申報年度及未來一年度各月份之現金收支預測表：

A.公司債務逐年到期，償還計畫及預計財務負擔減輕情形：本公司目前無流通在外之公司債，故不適用。

B.目前營運資金狀況：請參閱後附之現金收支預測表。

C.所需之資金額度及預計運用情形：

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成時間	所需資金總額	預計資金運用進度
			113年第二季
充實營運資金	113年第二季	235,021	235,021
合計		235,021	235,021

D.列示所編製之申報年度及未來一年度各月份之現金收支預測表如下：

申報年度(113年度)各月份之現金收支預測表

單位：新臺幣千元

項目	月份												合計
	1 月份	2 月份	3 月份	4 月份	5 月份	6 月份	7 月份	8 月份	9 月份	10 月份	11 月份	12 月份	
期初現金餘額(1)	294,821	299,674	286,750	279,660	242,888	488,904	489,920	494,607	518,604	510,514	515,307	522,651	294,821
加：非融資性收入(2)													0
應收帳款及票據收現	15,372	16,850	12,317	13,008	27,135	14,006	21,047	36,457	15,890	15,453	26,316	14,018	227,869
利息收入/退稅/其他	224	221	230	230	230	610	340	340	340	340	340	610	4,055
合計(2)	15,596	17,071	12,547	13,238	27,365	14,616	21,387	36,797	16,230	15,793	26,656	14,628	231,924
減：非融資性支出(3)													0
應付帳款付現	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
薪資(含獎金及員工酬勞)	5,330	11,416	10,628	5,800	5,800	8,600	5,800	6,000	9,000	6,000	6,000	6,000	86,374
各項費用	5,413	3,410	6,200	6,000	8,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	64,023
董事酬勞	0	0	1,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609
資本支出-軟體	0	2,569	0	0	0	0	5,900	1,800	4,600	0	8,312	0	23,181
資本支出-租賃改良	0	6,278	0	5,685	0	0	0	0	0	0	0	0	11,963
資本支出-辦公、消防設備	0	6,322	1,200	5,715	0	0	0	0	0	0	0	0	13,237
資本支出-儀器設備	0	0	0	0	2,570	0	0	0	2,570	0	0	0	5,140
所得稅	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150	0	0	0	3,150
非融資性支出合計(3)	10,743	29,995	19,637	23,200	16,370	13,600	16,700	12,800	24,320	11,000	19,312	11,000	208,677
要求最低現金餘額(4)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
所需資金總額(5)=(3)+(4)	25,743	44,995	34,637	38,200	31,370	28,600	31,700	27,800	39,320	26,000	34,312	26,000	223,677
融資前可供支用現金餘額(短絀)(6)=(1)+(2)-(5)	284,674	271,750	264,660	254,698	238,883	474,920	479,607	503,604	495,514	500,307	507,651	511,279	303,068
融資淨額(7)													0
現金增資					235,021								235,021
支付股利				(26,810)		0							(26,810)
融資淨額合計(7)	0	0	0	(26,810)	235,021	0	0	0	0	0	0	0	208,211
期末現金餘額(8)=(1)+(2)-(3)+(7)	299,674	286,750	279,660	242,888	488,904	489,920	494,607	518,604	510,514	515,307	522,651	526,279	526,279

未來一年度(114年度)各月份之現金收支預測表

單位：新臺幣千元

項目	月份												合計
	1 月份	2 月份	3 月份	4 月份	5 月份	6 月份	7 月份	8 月份	9 月份	10 月份	11 月份	12 月份	
期初現金餘額(1)	526,279	526,571	556,590	552,781	529,886	558,233	568,862	580,233	614,742	614,980	614,442	630,016	526,279
加：非融資性收入(2)													0
應收帳款及票據收現	17,252	43,579	20,195	31,904	42,007	21,519	30,231	48,569	20,848	15,022	37,046	21,416	349,588
利息收入/退稅/其他	340	340	340	340	340	610	340	340	340	340	340	610	4,620
合計(2)	17,592	43,919	20,535	32,244	42,347	22,129	30,571	48,909	21,188	15,362	37,386	22,026	354,208
減：非融資性支出(3)													0
應付帳款付現	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
薪資(含獎金及員工酬勞)	12,000	6,000	16,008	6,000	9,000	6,000	6,600	6,600	6,600	9,900	6,600	6,600	97,908
各項費用	5,300	5,000	5,000	5,000	5,000	5,500	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	66,800
董事酬勞	0	0	3,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,336
資本支出-軟體	0	2,900	0	0	0	0	6,600	1,800	4,600	0	9,212	0	25,112
資本支出-租賃改良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本支出-辦公、消防設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本支出-儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所得稅	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750	0	0	0	3,750
非融資性支出合計(3)	17,300	13,900	24,344	11,000	14,000	11,500	19,200	14,400	20,950	15,900	21,812	12,600	196,906
要求最低現金餘額(4)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
所需資金總額(5)=(3)+(4)	32,300	28,900	39,344	26,000	29,000	26,500	34,200	29,400	35,950	30,900	36,812	27,600	211,906
融資前可供支用現金餘額(短絀)(6)=(1)+(2)-(5)	511,571	541,590	537,781	559,025	543,233	553,862	565,233	599,742	599,980	599,442	615,016	624,442	668,581
融資淨額(7)													0
現金增資													0
支付股利				(44,139)									(44,139)
融資淨額合計(7)	0	0	0	(44,139)	0	0	0	0	0	0	0	0	(44,139)
期末現金餘額(8)=(1)+(2)-(3)+(7)	526,571	556,590	552,781	529,886	558,233	568,862	580,233	614,742	614,980	614,442	630,016	639,442	639,442



(2)就公司申報年度及預計未來一年度應收帳款收款與應付帳款付款政策、資本支出計畫、財務槓桿及負債比率（或自有資產與風險性資產比率），說明償債或充實營運資金之原因：

A.應收帳款及應付費用政策

應收帳款收款政策方面，係考量客戶之信用情形、財務狀況及過往交易之經驗等因素而予以不同之授信條件，對一般客戶之平均授信條件約為月結30~90天。本公司編製之現金收支預測表係以上述授信條件作為應收帳款收現天數之估計基礎，故其編製基礎應尚屬合理。

應付費用付款政策方面，係依據市場行情及與供應商過往交易之經驗等因素，其付款條件為月結30~60天左右。本公司編製之現金收支預測表係以上述付款條件作為應付費用付現天數之估計基礎，其編製基礎應尚屬合理。

綜上所述，本公司編製之113及114年度現金收支預測表中，應收帳款收現及應付費用付現金額係依據113年1~2月實際收付款情形為基礎，並考量未來與客戶及廠商之估計交易情形而編製，尚無重大異常之情事。

B.資本支出計畫

本公司預計113年度之資本支出金額預計為39,052仟元，主要係預計搬遷新辦公室及購置研發相關之軟體費用等支出，本公司資本支出計畫之擬定，主要係依目前經營策略、產業狀況、市場需求等因素所擬定，其資金來源預計以自有資金支應，經評估編製基礎尚屬合理。

C.財務槓桿及負債比率

單位：新臺幣仟元；%

項目	110年度	111年度	112年度
財務槓桿度	1.00	1.00	1.00
負債比率(%)	13.91%	15.92%	13.60%

財務槓桿係為衡量公司舉債經營之財務風險指標，評估利息費用變動對於營業利益之影響程度，財務槓桿度愈高表示利息費用占本公司營業利益比重越大，公司所承擔之財務風險愈大。本公司110~112年度之財務槓桿度皆為1.00倍，其數值維持相當且顯示其財務結構尚屬健全，預計未來隨營運規模穩定成長使營運資金之需求將隨之增加，本次現金增資用以償充實營運資金，可望降低營運風險，因此計畫經執行後對本公司之財務槓桿應無重大負面影響。

就負債比率而言，本公司110~112年度之負債比率分別為13.91%、15.92%及13.60%，預估本次現金增資用以充實營運資金，將可降低負債比率，進一步強化財務結構並增加資金靈活調度之彈性，故從財務槓桿及負債比率之影響，評估本次計畫應有其屬必要性及合理性。

(3)增資計畫如用於償債，應說明原借款用途及其效益達成情形。若原借款係用以購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程，應就預計自購置該營建用地至營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，說明原借款原因，並就認列損益之時點、金額說明預計可能產生效益及其達成情形：不適用。

(4)現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，應敘明其必要性、預計資金來源及效益：不適用。

4.購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程者，應詳列預計自購買土地至營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金

投入及工程進度，並就認列損益之時點、金額說明預計可能產生效益：不適用。  
5.購買未完工程並承受賣方未履行契約者，應列明買方轉讓理由、受讓價格決定依據及受讓過程對契約相對人權利義務之影響：不適用。

三、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：無。

四、本次併購發行新股應記載事項：無。

## 肆、財務概況

### 一、最近五年度簡明財務資料

#### (一) 簡明資產負債表及綜合損益表

##### 1. 簡明資產負債表-國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

項 目		最近五年度財務資料(註1)				
		108年	109年	110年	111年	112年
流動資產		232,395	249,840	300,332	360,529	318,075
不動產、廠房及設備		21,949	23,691	17,689	14,118	8,082
使用權資產		14,537	10,033	6,721	1,671	207
無形資產		14,075	9,133	21,886	31,980	30,248
其他資產		3,643	1,212	1,439	5,886	5,968
其他非流動資產		1,000	1,000	1,000	-	-
資產總額		287,599	294,909	349,067	414,184	362,580
流動負債	分配前	26,606	26,964	40,147	57,930	44,536
	分配後	26,606	26,964	66,957	124,955	71,346
非流動負債		14,451	5,554	8,406	7,989	4,790
負債總額	分配前	41,057	32,518	48,553	65,919	49,326
	分配後	41,057	32,518	75,363	132,944	76,136
歸屬於母公司業主之權益		246,542	262,391	300,514	348,265	313,254
股本		268,100	268,100	268,100	268,100	268,100
資本公積		-	-	-	-	-
保留盈餘	分配前	(21,558)	(5,709)	32,414	80,165	45,154
	分配後	(21,558)	(5,709)	5,604	13,140	18,344
其他權益		-	-	-	-	-
庫藏股票		-	-	-	-	-
非控制權益		-	-	-	-	-
股東權益總額	分配前	246,542	262,391	300,514	348,265	313,254
	分配後	246,542	262,391	273,704	281,240	286,444

註1：上開財務報表均經會計師查核簽證或核閱。

註2：民國112年度之盈餘分派案經董事會決議分配，於股東常會報告。

2. 簡明損益表-國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	最近五年度財務資料(註)				
	108年	109年8	110年	111年	112年
營業收入	133,462	128,364	168,192	229,420	187,384
營業毛利	132,191	127,518	166,869	227,700	185,816
營業損益	24,887	16,960	43,338	78,846	35,057
營業外收入及支出	(24)	3,027	(131)	2,525	3,210
稅前淨利	24,863	19,987	43,207	81,371	38,267
繼續營業單位 本期淨利	19,929	15,765	38,575	72,964	32,017
停業單位損失	-	-	-	-	-
本期淨利(損)	19,929	15,765	38,575	72,964	32,017
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	(247)	84	(452)	1,597	(3)
本期綜合損益總額	19,682	15,849	38,123	74,561	32,014
淨利歸屬於 母公司業主	19,929	15,765	38,575	72,964	32,017
淨利歸屬於非控制權益	-	-	-	-	-
綜合損益總額歸屬於 母公司業主	19,682	15,849	38,123	74,561	32,014
綜合損益總額歸屬於 非控制權益	-	-	-	-	-
每股盈餘	0.74	0.59	1.44	2.72	1.19

註：上開財務報表均經會計師查核簽證或核閱。

(二) 影響上述簡明財務報表作一致性比較之重要事項如會計變動、公司合併或營業部門停工等及其發生對當年度財務報告之影響：無。

(三) 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

1.最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見，除無表留意見之查核報告外，並應詳述其意見內容。

年 度	會計師事務所	會計師姓名	查 核 意 見
108	勤業眾信聯合會計師事務所	鍾鳴遠、蔡美貞	無保留意見
109	勤業眾信聯合會計師事務所	鍾鳴遠、蔡美貞	無保留意見
110	勤業眾信聯合會計師事務所	邱鏞銘、蔡美貞	無保留意見
111	勤業眾信聯合會計師事務所	林心彤、蔡美貞	無保留意見
112	勤業眾信聯合會計師事務所	林心彤、蔡美貞	無保留意見

2. 最近五年度如有更換會計師之情事者，應列示公司、前任及繼任會計師對更換原因之說明：

110 年度以及 111 年度更換會計師係會計師事務所內部調整。

(四) 財務分析

1.最近五年度財務分析-採用國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

分析項目		最近五年度財務分析(註2)				
		108年	109年	110年	111年	112年
財務結構(%)	負債占資產比率	14.28	11.03	13.91	15.92	13.60
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	1189.09	1131.03	1746.38	2523.48	3935.29
償債能力	流動比率%	873.47	926.58	748.08	622.35	714.20
	速動比率%	859.90	920.51	741.47	620.26	708.99
	利息保障倍數	294.81	99.25	210.81	767.34	741.18
經營能力	應收款項週轉率(次)	12.08	14.94	12.06	10.41	9.19
	平均收現日數	30.21	24.43	30.28	35.06	39.71
	存貨週轉率(次)	註1	註1	註1	註1	註1
	應付款項週轉率(次)	-	-	-	-	-
	平均銷貨日數	註1	註1	註1	註1	註1
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	7.39	5.63	8.13	14.43	16.88
	總資產週轉率(次)	0.50	0.44	0.52	0.60	0.48
獲利能力	資產報酬率(%)	7.53	5.47	12.03	19.14	8.25
	權益報酬率(%)	8.42	6.20	13.71	22.49	9.68
	稅前純益占實收資本比率(%)	9.27	7.46	16.12	30.35	14.27
	純益率(%)	14.93	12.28	22.94	31.80	17.09
	每股盈餘(元)	0.74	0.59	1.44	2.72	1.19
現金流量	現金流量比率(%)	143.29	136.16	138.70	187.83	129.61
	現金流量允當比率(%)	304.51	366.91	501.94	429	242
	現金再投資比率(%)	14.81	13.07	17.40	22.20	(2.73)
槓桿度	營運槓桿度	1.62	2.01	1.47	1.35	1.84
	財務槓桿度	1	1	1	1	1

請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達20%者可免分析)

- 1.長期資金占固定資產比率增加：主要係因本年度度營收減少導致股東權益淨額下降所致。
- 2.資產報酬率、股東權益報酬率、稅前純益佔實收資本比率及純益率減少：主係因本年度稅後淨利減少所致。
- 3.每股盈餘減少：主係因本年度稅後淨利減少所致。
- 4.現金流量比率減少：主要係因本年度營業活動淨現金流量較上期減少所致。
- 5.現金流量允當比率及現金流量允當比率減少：主要係因本年度發放之現金股利增加所致。
- 6.營運槓桿度增加：主要係因本年度營業利益減少所致。

註1：係無存貨金額，故未列示。

註2：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

註3：報本表末端，應列示如下之計算公式：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。（註4）

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。（註5）

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益(註6)。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

(五) 會計項目重大變動說明：

比較最近二年度資產負債表及綜合損益表之會計項目，其金額變動達百分之十以上，且金額達當年度資產總額百分之一者，應詳予分析其變動原因如下表：

會計科目	111 年度		112 年度		增減變動		差異數說明
	金額	% (註 1)	金額	% (註 1)	金額	% (註 2)	
現金及約當現金	334,922	80.86	294,821	81.31	(40,101)	(0.12)	係 112 年營收減少所致。
應收帳款	24,304	5.87	16,486	4.55	(7,818)	(0.32)	係 112 年營收減少所致。
使用權資產	1,671	0.40	207	0.06	(1,464)	(0.88)	係 112 年度持續提列折舊導致使用權資產減少。
其他無形資產	31,980	7.72	30,248	8.34	(1,732)	(0.05)	係 112 年度攤提軟體導致減少。
應付員工及董事酬勞	15,499	3.74	6,229	1.72	(9,270)	(0.60)	係 112 年獲利減少導致提撥金額減少所致。
其他流動負債	39,266	10.48	37,313	10.29	(1,953)	(0.05)	係 112 年應付軟體費用減少所致。
未分配盈餘	76,924	17.57	34,457	9.50	(42,467)	(0.55)	係 112 年度營收衰退，本期淨利減少所致。
營業收入	229,420	100.00	187,384	100.00	(42,036)	(0.18)	係 112 年度營收衰退所致。
營業毛利	227,700	99.25	185,816	99.16	(41,884)	(0.18)	係 112 年度營業收入減少所致。
營業費用	148,854	64.88	150,759	80.45	1,905	0.01	係 112 年軟體攤銷費用增加所致。
營業淨利	78,846	34.37	35,057	18.71	(43,789)	(0.56)	係 112 年度營業收入減少所致。
稅前淨利	81,371	35.47	38,267	20.42	(43,104)	(0.53)	係 112 年度營業收入減少所致。
本年度淨利	72,964	31.80	32,017	17.09	(40,947)	(0.56)	係 112 年度營業收入減少所致。
本年度綜合損益總額	74,561	32.50	32,014	17.08	(42,547)	(0.57)	係 112 年度營業收入減少所致。

註 1：指該科目於各相關報表之同型比率。

註 2：指以前一年為 100% 所計算出之變動比率。

(六) 本國發行人自公開發行後最近連續七年或外國發行人最近連續七年由相同會計師查核簽證者，應增列說明未更換之原因、目前簽證會計師之獨立性暨發行公司對強化會計師簽證獨立性之具體因應措施：無此情形。

(七) 外國發行公司得僅列示最近三年度簡明財務資料：不適用。

(八) 外國發行公司列示之財務報表為最近兩年度及最近期經會計師查核或核閱之合併財務報告，如係申請創新板第一上市者，為最近一年度及最近期經會計師查核或



核閱之合併財務報告：不適用。

## 二、財務報告應記載事項

(一)發行人申報募集發行有價證券時之最近年度財務報告及會計師查核報告，並應加列最近一季依法公告申報之財務報告：

- 1.民國112年度個別財務報告及會計師查核報告：請參閱附件一。
- 2.民國111年度個別財務報告暨會計師核閱報告：請參閱附件二。

(二)最近年度發行人經會計師查核簽證之年度個別財務報告。但不包括重要會計項目明細帳。

本公司因無子公司，無需編製合併財務報告，故個體財務報告與上述(一)之財務報告相同。

(三)發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告，應併予揭露：無。

## 三、財務概況其他重要事項

(一)公司及其關係企業最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。

(二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者，應揭露資訊：無。

(三)期後事項：無。

(四)其他：無。

#### 四、財務狀況及經營結果檢討分析

(一)財務狀況：最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫：

##### 財務狀況比較分析

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	112 年度	111 年度	差異		變動說明
				金額	%	
流動資產		318,075	360,529	(42,454)	(11.78)	-
不動產、廠房及設備		8,082	14,118	(6,036)	(42.75)	-
使用權資產		207	1,671	(1,464)	(87.61)	-
其他無形資產		30,248	31,980	(1,732)	(5.42)	-
其他資產		5,968	5,886	82	1.39	-
資產總額		362,580	414,184	(51,604)	(12.46)	-
流動負債		44,536	57,930	(13,394)	(23.12)	註 1
非流動負債		4,790	7,989	(3,199)	(40.04)	-
負債總額		49,326	65,919	(16,593)	(25.17)	註 1
股 本		268,100	268,100	-	-	-
法定盈餘公積		10,697	3,241	(35,011)	(43.67)	-
保留盈餘		34,457	76,924	(35,011)	(10.05)	註 2
權益總額		313,254	348,265	(42,454)	(11.78)	-
變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者之主要原因及其影響分析說明如下： 註 1.流動負債及負債總額減少：主要係因發放 111 年度股東現金紅利所致。 註 2.保留盈餘減少：主要係因 112 年淨利減少所致。						

## (二)財務績效

### 1.最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位：新台幣仟元

年度 項目	年度		增(減)金額	變動比例(%)	變動說明
	112 年度	111 年度			
營業收入淨額	187,384	229,420	(42,036)	(18.32)	-
營業成本	1,568	1,720	(152)	(8.84)	-
營業毛利	185,816	227,700	(41,884)	(18.39)	-
營業費用	150,759	148,854	1,905	1.28	-
營業淨利(損)	35,057	78,846	(43,789)	(55.54)	註 1
營業外收入及支出	3,210	2,525	685	27.13	-
稅前淨利(損)	38,267	81,371	(43,104)	(52.97)	註 1
所得稅利益(費用)	6,250	8,407	(2,157)	(25.66)	-
本期淨利(損)	32,017	72,964	(40,947)	(56.12)	註 1
本期綜合損益總額	32,014	74,561	(42,547)	(57.06)	註 1

變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元之分析說明：  
註 1.係因 112 年度營業收入減少所致。

### 2.預期未來一年度銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司為一家專業邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體SIP (矽智財; Silicon Intellectual Property)設計公司，產品不適用以數量計算，而本公司依據產業環境、客戶產品需求、市場供需及各產業預測資料等，預期未來一年在銷售方面較前一年度能保持穩定之成長幅度，此對公司未來財務有正面之幫助。

## (三)現金流量

### 1.最近年度現金流量變動情形分析：

單位：新台幣仟元

項目	年度		增(減)金額
	112年度	111年度	
營業活動	57,721	108,810	(51,089)
投資活動	(24,516)	(18,075)	(6,441)
籌資活動	(72,555)	(32,140)	(40,415)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(751)	(1,404)	653

現金流量變動情形分析：

- 營業活動之淨現金流入減少：係112年度稅前淨利減少所致。
- 投資活動之淨現金流出增加：主要係用於購置增購研發用測試設備、軟體。
- 籌資活動之淨現金流出增加：係112年發放111年度現金股利所致。
- 匯率變動對現金及約當現金之影響：主要因台幣兌美元貶值，重新評價外幣現金所致。

### 2.流動性不足之改善計畫：無現金不足之情形。

### 3.未來一年(113年)現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	預計全年來自 營業活動淨現 金流量	預計全年現金 投資活動淨現 金流量	預計全年籌 資活動淨現 金流量	現金剩餘 數額	現金不足額之補救措施	
					投資計畫	理財計畫
294,821	53,377	(64,075)	161,002	445,125	—	—
1.未來一年現金流量變動情形分析： (1)營業活動之淨現金流入：主要係源自113年營收。 (2)投資活動之淨現金流出：主要係預計購置辦公設備、研發用測試設備及軟體。 (3)籌資活動之淨現金流入：主要係預計辦理創新板初次上市前現金增資。 2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。						

(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

(五)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：無。

(六)其他重要事項：無。

## 伍、特別記載事項

### 一、內部控制制度執行狀況

(一)最近三年度會計師提出之內部控制改進建議：無。

(二)內部稽核發現重大缺失之改善情形：無。

(三)內部控制聲明書：請參閱附件三。

(四)委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形：會計師專案審查報告請參閱附件四。

二、委託經金融監督管理委員會核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露該信用評等機構所出具之評等報告：不適用。

三、證券承銷商評估總結意見：請參閱附件十。

四、法律意見書：請參閱附件五。

五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見：不適用。

六、前次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經本會通知應自行改進事項之改進情形：無。

七、本次募集與發行有價證券於申報生效時經金融監督管理委員會通知應補充揭露之事項：不適用。

八、公司初次上市、上櫃或前次及最近三年度申報(請)募集與發行有價證券時，於公開說明書中揭露之聲明書或承諾事項及其目前執行情形：不適用。

九、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

十、最近年度及截至公開說明書刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

十一、證券承銷商、發行人及其董事、監察人、總經理、財務或會計主管以及與本次申報募集發行有價證券案件有關之經理人等人出具不得退還或收取承銷相關費用之聲明書：請參閱附件六。

十二、發行人辦理現金增資或募集具股權性質之公司債，並採詢價圈購對外公開承銷之案件，證券承銷商及發行人等出具不得配售予關係人及內部人等對象之聲明書：不適用。

十三、本國發行公司自行評估內部控制制度作成之內部控制聲明書及委託會計師進行專案審查取具之報告書：請參閱附件三及附件四。

十四、發行公司之公司治理運作情形：請參閱本公開說明書「伍、三十二、上市上櫃公司應就公司治理運作情形應記載事項」說明。

項目	是否已執行	簡述執行情形	未執行之原因	改善計畫或因應措施	備註
<b>一、公司治理架構及規則</b>					
(一) 公司是否建置公司治理制度並涵蓋主要治理原則	是	本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」並經董事會決議通過。	-	-	-
(二) 公司是否建立完備之內部控制制度並有效執行	是	本公司考量本身之營運活動，依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，設計並確實執行內部控制制度，且隨時檢討改進，稽核單位並依照年度稽核計畫執行內部稽核工作，以確保內控制度之設計及執行持續有效。	-	-	-
<b>二、公司股權結構及股東權益</b>					
(一) 公司是否訂有股東會議事規則	是	本公司已訂定「股東會議事規則」並經股東會決議通過，其內容與「股東會議事規則參考範例」無重大差異。	-	-	-
(二) 公司是否設有專責人員處理股東建議或糾紛等問題	是	本公司已於公開資訊觀測站及官網揭露發言人、代理發言人及股務單位聯繫窗口及聯繫方式，以處理股東建議、疑義或糾紛等事宜。	-	-	-
(三) 公司是否隨時掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單	是	本公司充分掌握主要股東及最終控制者名單，股務代理機構隨時更新相關資訊。	-	-	-
(四) 公司是否揭露主要股東有關質押、增加或減少公司股份等重要事項	是	本公司已依相關法令規定，申報董事、經理人及大股東之持股、轉讓及質押情形。	-	-	-
(五) 公司與關係企業是否建立適當風險控管機制及防火牆	是	本公司已訂定「關係人及集團企業交易作業辦法」之內部控制制度，並依規定程序	-	-	-

		執行。			
三、董事會結構及獨立性					
(一) 公司是否設置二席以上獨立董事	是	本公司設有九席董事，其中有四席為獨立董事。	-	-	-
(二) 公司董事會是否設審計委員會	是	本公司設有審計委員會，由四位獨立董事組成。	-	-	-
(三) 公司董事長、總經理是否由不同人擔任，或是否無配偶或一等親之關係	是	本公司之董事長與總理由同一人擔任，並增加一席獨立董事。	-	-	-
(四) 董事對於有利害關係議案之迴避是否確實執行	是	本公司董事會議事規範中載明董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，不得代理其他董事行使其表決權，董事對於董事會議案有利害關係者，已確實執行利益迴避。	-	-	-
四、董事會及經理人之職責					
(一) 公司是否訂有董事會議事規則	是	本公司已訂定「董事會議事規範」並落實相關規範。	-	-	-
(二) 公司是否訂定各專門委員會行使職權規章	是	本公司已設置薪資報酬委員會及審計委員會，並分別訂定「薪資報酬委員會組織章程」、「審計委員會組織章程」以資遵循。	-	-	-
(三) 公司董事會是否定期評估簽證會計師之獨立性	是	本公司現已由審計委員會及董事會每年一次評估簽證會計師獨立性，且於審計委員會及董事會審議並通過簽證會計師之獨立性。	-	-	-
(四) 公司是否有為董事購買責任保險	是	本公司已為董事購買責任險，以降低及分散董事因錯誤或疏失而造成公司股東重大損害之風險。	-	-	-
(五) 公司是否訂有董事進修制度	是	本公司係依據「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」辦理董事進修事宜。	-	-	-

(六) 公司是否訂定風險管理政策及風險衡量標準並落實執行	是	本公司依法訂定各種內部規章、制度，進行各種風險管理及評估，對公司財務及業務面所面臨之風險明訂適當風險限額及監控機制，內部稽核亦持續對政策之遵循進行覆核，以確認相關作業已依規定辦理。	-	-	-
五、監察人之組成、職責及獨立性					
(一) 公司是否設置一席以上獨立監察人	不適用	本公司已設置審計委員會取代監察人。	-	-	-
(二) 監察人與公司之員工、股東及利害關係人是否建立溝通管道	不適用	本公司已設置審計委員會取代監察人。	-	-	-
(三) 公司是否成立監察人會或訂定議事規則	不適用	本公司已設置審計委員會取代監察人。	-	-	-
(四) 公司是否有為監察人購買責任保險	不適用	本公司已設置審計委員會取代監察人。	-	-	-
(五) 公司是否訂有監察人進修制度	不適用	本公司已設置審計委員會取代監察人。	-	-	-
六、利害關係人之權利及關係					
(一) 公司是否建立與利害關係人之溝通管道	是	本公司已於官網建立利害關係人專區，設有聯絡人及電子郵件之溝通管道，以妥善處理對於利害關係人所關切之重要議題。	-	-	-
(二) 公司是否重視公司之社會責任	是	本公司已訂定「永續發展實務守則」並落實相關規範，以實踐社會責任，提升永續競爭力。	-	-	-
(三) 公司是否訂定保護消費者或客戶之政策並定期考核其執行情形	是	本公司已於官網建立利害關係人專區，設有聯絡人及電子郵件之溝通管道，以妥善處理對於利害關係人所關切之議題，並由業務單位與售後服務單位妥善處理消費者或客戶意見。	-	-	-
七、資訊公開					
(一) 公司是否指定專人	是	本公司依循主管機關有關資	-	-	-



負責公司資訊蒐集及揭露工作		訊公開之規定，由專人負責揭露資訊公布於公司網站及公開資訊觀測站。			
(二) 公司是否建立發言人制度	是	本公司設有發言人制度處理投資人相關事宜。	-	-	-
(三) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊	是	本公司已架設公司網站定期揭露公司財務業務及公司治理相關資訊並指派專人維護更新。	-	-	-
八、其他應揭露事項：無。					

十五、發行公司與同屬集團企業公司間有業務往來者，應各出具書面聲明或承諾無非常規交易情事；無業務往來者，應由申請公司出具承諾日後有往來時必無非常規交易：請參閱附件七。

十六、發行公司於申請上市會計年度及其上一會計年度已辦理與辦理中之大量現金增資發行新股，及是否產生相當效益之評估：無。

十七、發行公司是否有與其他公司共同使用申請貸款額度：無。

十八、發行公司有無因非正當理由仍有大量資金貸與他人：無。

十九、具有上市審查準則第六條之一所規定申請之公司者，應增列事項：不適用。

二十、具有上市審查準則第十六條所規定之公司者，應增加揭露資訊：不適用。

二十一、發行公司有上市審查準則補充規定第十條或第二十六條所列各款情事者，應將該非常規交易詳細內容及處理情形充分揭露，並提報股東會：無。

二十二、本國發行公司為普通申請公司債上市者，應增列之事項：不適用。

二十三、充分揭露發行公司與證券承銷商共同訂定承銷價格之依據及方式：請參閱附件十一。

二十四、發行公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至之員工認股權憑證採內含價值法，於申請公司股票上市後對財務報表可能之影響：不適用。

二十五、依上市審查準則第四條第二項、第三項、第二十八條之一第五項、第六項、第二十九條第一項、第二項、或屬科技事業、文化創意事業申請股票初次上市，且委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，並保留一定比例採洽商銷售方式辦理配售者，應增列配售名單、協議認購股數、協議配售總股數、占公開銷售總股數之比例及配售股票之集保期間與賣出限制等事項：不適用。

二十六、證券承銷商應就前款配售名單合理性、配售股數、占公開銷售總股數之比例、配售股票賣出限制、繳款資力及協議事項妥適性出具評估意見：不適用。

二十七、本國發行公司或外國發行公司依第十三款規定委託證券承銷商辦理上市前公開銷售者，本國發行公司或外國發行人及證券承銷商應出具絕無以任何方式或名目，提供直接或間接利益予洽商銷售投資人或其指定人之聲明書。該洽商銷售投資人亦應出具絕無要求或收取發行公司或承銷商以任何方式或名目提供之直接或間接利益之聲明書：不適用。

二十八、外國發行公司有上市審查準則第二十八條之七第一項第三款或三十四條第二項第二款情事者，應將有關股東權益保護之重要事項因與註冊地國法令之強制規定抵觸，致未能增訂於公司章程或組織文件之重大差異充分揭露：不適用。

二十九、其他基於有關規定應出具之書面承諾或聲明：無。

三十、發行人視所營事業性質，委請在技術、業務、財務等各方面具備專業知識及豐富經驗之專家，就發行人目前營運狀況及本次發行有價證券後之未來發展，進行比較分析並出具意見者，應揭露該等專家之評估意見：無。

三十一、上市上櫃公司應就公司治理運作情形應記載事項：

(一)董事會運作情形

本公司最近年度及申請年度截至公開說明書刊印日止，董事會共開會 6(A)次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	黃文謙	6	0	100%	連任，111年6月23日改選。
董事	陳鴻文	3	2	50%	連任，111年6月23日改選。
董事	陳永華	5	0	83%	連任，111年6月23日改選。
董事	魏雅庵	4	2	67%	連任，111年6月23日改選。
董事	鄭珮姝	6	0	100%	新任，111年6月23日改選。
獨立董事	潘燕民	6	0	100%	連任，111年6月23日改選。
獨立董事	吳清沂	6	0	100%	連任，111年6月23日改選。
獨立董事	林月霞	6	0	100%	連任，111年6月23日改選。
獨立董事	李展南	3	0	100%	新任，112年10月23日增選。

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：不適用，本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，相關資料請參閱年報之審計委員會

運作情形。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

1. 112年03月08日第七屆第4次董事會

(1)本公司董事及經理人酬勞分配案。

應利益迴避原因：黃文謙董事長同時兼任本公司之總經理。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之黃文謙董事長外，由代理主席陳永華董事徵詢其他出席之董事無異議照案通過。

2. 112年08月02日第七屆第6次董事會

(1)本公司經理人112年度調薪案。

應利益迴避原因：黃文謙董事長同時兼任本公司之總經理。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之黃文謙董事長外，由代理主席陳永華董事徵詢其他出席之董事無異議照案通過。

3. 112年12月28日第七屆第8次董事會

(1)本公司經理人112年度年終獎金案。

應利益迴避原因：黃文謙董事長同時兼任本公司之總經理。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之黃文謙董事長外，由代理主席陳永華董事徵詢其他出席之董事無異議照案通過。

4. 113年02月27日第七屆第9次董事會

(1)本公司董事及經理人酬勞分配案。

應利益迴避原因：黃文謙董事長同時兼任本公司之總經理。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之黃文謙董事長外，由代理主席陳永華董事徵詢其他出席之董事無異議照案通過。

(2)本公司董事及經理人認股案。

應利益迴避原因：黃文謙董事長同時兼任本公司之總經理。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之黃文謙董事長外，由代理主席陳永華董事徵詢其他出席之董事無異議照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年	112/1/1~ 112/12/31	董事會	內部自評	董事會績效評估項目共分5大面向45項目： 包括對公司營運之參與程度、提升決策品質、組成與結構、董事選任及持續進修、內部控制等
		審計委員會 薪資報酬委員會	內部自評	功能性委員會績效評估共分5大面向，依不同委員會分別有19-22項目：包括對

				公司營運之參與程度、職責認知、提升決策品質、組成及成員選任、內部控制等。
		董事會成員	成員自評	個別董事成員績效評估共分6大面向 23 項目：包括公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業及持續進修、內部控制等。
<p>評估方式及結果摘述：</p> <p>評估由公司之董事會議事單位負責執行，於年度結束時，採用內部問卷方式進公司，依董事會運作、董事參與度、審計委員會運作、薪資報酬委員會運作等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、審計委員對委員會運作評估、薪資報酬委員對委員會運作評估。</p> <p>評估採 5 個等級方式，5 分相當於優異，4 分為良好，3 分為中等，2 分為尚可，1 分為欠佳。評分標準以量化方式進行評估，依各衡量項目採比重加權方式計分，並以平均得分做為評估結果之基準。上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。</p> <p>每年初問卷悉數回收後，本公司之公司治理主管依前開辦法分析，將結果提報董事會，並就董事之建議提出可加強改善之作法。</p> <p>本公司於113年2月完成董事會、董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會績效評估，並於最近期召開之董事會，將評鑑結果及持續強化之方式進公司提報。本年度評量結果尚屬良好。</p> <p>1.董事會 董事會績效考核自評問卷衡量項目含括5大面向，45個項目。 董事會與經營團隊互動良好，定期檢視管理績效，就重要會計財務事項視情況邀請會計師列席說明，達到充份的溝通與交流。 評量結果：優異。</p> <p>2.審計委員會 功能性委員會績效考核自評問卷，審計委員會部份衡量項目含括5大面向，22個項目。 委員對於該委員會之運作效率及效果皆有正面評價，能盡到善良管理人之責任，後續將持續精進運作效能。 評量結果：優異。</p> <p>3.薪資報酬委員會 功能性委員會績效考核自評問卷，薪資報酬委員會部份衡量項目含括5大面向，19個項目。 委員對於經營團隊與該委員會之溝通方式尚屬良好，參考同業水準，並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性，協助董事會檢視董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。</p>				

評量結果：優異。

#### 4.董事成員

董事成員績效考核自評問卷衡量項目含括6大面向，23個項目。

董事皆具備金融機構所需之專業能力，積極參與公司營運，關切公司策略發展方向，充分發揮職能，皆給予肯定的評價。

評量結果：優異。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估。

1.提升資訊透明度：本公司營運透明並注重股東權益，於董事會後即時將重大議案於公開資訊網站公告。

2.本公司已設置薪資報酬委員會、審計委員會，健全監督董事會功能及強化董事會管理機能。

註：本公司第七屆董事會於111年6月23日股東會選任，任期自111年6月23日至114年6月22日。

#### (二) 審計委員會運作情形

1.最近年度及申請年度截至公開說明書刊印日止，審計委員會共開會6(A)次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%)(B/A) (註)	備註
獨立董事	潘燕民	6	0	100.00%	連任，111年6月23日改選。
獨立董事	吳清沂	6	0	100.00%	連任，111年6月23日改選。
獨立董事	林月霞	6	0	100.00%	連任，111年6月23日改選。
獨立董事	李展南	3	0	100.00%	新任，112年10月23日增選。

為強化公司治理，本公司於107年成立審計委員會，本公司審計委員會由4名獨立董事組成，並推舉獨立董事潘燕民先生擔任召集人。審計委員會負責審核公司財務報表之允當性表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性，公司內部控制制度之有效實施、公司遵循相關法令規則及存在或潛在風險之控管等。

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第14條之5所列事項：請詳註1。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、

業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)。

(一) 內部稽核主管與審計委員會之溝通：

1. 定期性：於審計委員會報告稽核發現及異常事項改善進度，回覆獨立董事所提出的問題，並依其指示加強稽核工作內容，確保內控制度的有效。
2. 非定期性：平時利用電話、電子郵件或當面方式，溝通稽核發現內容及如何不斷提升稽核價值，若發現有重大違規情事，立即通知獨立董事。
3. 主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通內容	溝通情形
112.03.08	1.111年度「內部控制制度聲明書」 2.111年10-12月稽核計劃執行情形	本公司獨立董事對於公司111年度內部控制自評結果與稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。
112.06.27	112年1-3月稽核計劃執行情形	本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。
112.08.02	112年4-6月稽核計劃執行情形	本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。
112.11.08	112年7-9月稽核計劃執行情形	本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。
112.12.28	訂定本公司民國113年內部稽核計畫案	本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。
113.02.27	1.112年度「內部控制制度聲明書」 2.112年10-12月稽核計劃執行情形	本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。

(二) 會計師與審計委員會之溝通：

1. 定期性：會計師於核閱季報及查核年報前後期間，就查核(核閱)計劃、執行情形及結果與審計委員會進行溝通。
2. 非定期性：如有其他營運方面或內控等相關個案需即時進行溝通討論，則視情況安排會議。
3. 主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通內容	溝通情形
112.03.08	審核111年度財務報表	本公司獨立董事對於財務報表查核情形，溝通情形良好。
112.08.02	核閱第112年第2季財務報表	本公司獨立董事對於財務報表核閱情形，溝通情形良好。
112.11.08	核閱第112年第3季財務報表	本公司獨立董事對於財務報表核閱情形，溝通情形良好。
113.02.27	審核第112年度財務報表	本公司獨立董事對於財務報表查核情形，溝通情形良好。

註1：證券交易法第14條之5所列事項，如下：

審計委員會日期及期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
112.03.08 第三屆第3次	(1)通過審查111年第4季內部稽核計畫執行情形。 (2)通過本公司民國111年度營業報告書及財務報	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提請第七屆第4次董事會決議並依照董事會決議辦理

	<p>表案。</p> <p>(3)通過本公司民國111年度盈餘分配案。</p> <p>(4)通過112年度會計師公費審核及簽證會計師獨立性及適任性評估案。</p> <p>(5)通過本公司111年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。</p> <p>(6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>(7)通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。</p> <p>(8)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。</p> <p>(9)通過修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」部分條文案。</p>			
112.06.27 第三屆第4次	<p>(1)通過審查112年第1季內部稽核計畫執行情形。</p> <p>(2)通過訂定本公司「企業風險管理政策與程序」案。</p> <p>(3)通過修訂本公司「股務作業」之作業程序案。</p>	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提請第七屆第5次董事會決議並依照董事會決議辦理
112.08.02 第三屆第5次	<p>(1)通過審查112年第2季內部稽核計畫執行情形。</p> <p>(2)通過審查本公司112年第2季財務報告案。</p> <p>(3)(2)通過訂定本公司「內部控制制度自行評估作業程序」案。</p> <p>(4)通過訂定本公司「內部稽核實施細則」案。</p> <p>(5)通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。</p> <p>(6)通過修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」部分條文案</p>	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提請第七屆第6次董事會決議並依照董事會決議辦理
112.11.08 第三屆第6次	<p>(1)通過審查112年第3季內部稽核計畫執行情形。</p> <p>(2)通過本公司民國112年第3季財務報告案。</p> <p>(2)通過因應申請創新板需要，擬出具『內部控制制度聲明書』案。</p>	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提請第七屆第7次董事會決議並依照董事會決議辦理

	<p>(4)通過因應申請創新板需要，擬出具審查期間之財務預測資訊案。</p> <p>(5)通過授權本公司審閱稽核報告之董事案。</p> <p>(6)通過修訂本公司「銷貨及收款循環」之相關作業程序案。</p> <p>(7)通過修訂本公司「電子計算機循環」之相關作業程序案。</p> <p>(8)通過修訂本公司「資訊系統管理辦法」之部分條文案。</p> <p>(9)通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序辦法」之部分條文案。</p>			
112.12.28 第三屆第7次	<p>(1)通過訂定本公司民國113年預算案。</p> <p>(2)通過訂定本公司民國113年內部稽核計畫案。</p> <p>(3)通過修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞發放辦法」部分條文案。</p>	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提請第七屆第8次董事會決議並依照董事會決議辦理
113.02.27 第三屆第8次	<p>(1)通過審查112年第4季內部稽核計畫執行情形。</p> <p>(2)通過本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(3)通過本公司民國112年度盈餘分配案。</p> <p>(4)通過113年度會計師公費審核及簽證會計師獨立性及適任性評估案。</p> <p>(5)通過本公司112年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。</p> <p>(6)通過修訂本公司「申請暫停交易及恢復交易作業程序」案。</p> <p>(7)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。</p> <p>(8)通過修訂本公司「審計委員會行使職權辦法」部分條文案。</p> <p>(9)通過修訂本公司「股東</p>	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提請第七屆第9次董事會決議並依照董事會決議辦理



	<p>會議事規則」部分條文案。</p> <p>(10)通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。</p> <p>(11)通過擬辦理現金增資發行新股供初次申請創板上市前公開承銷案。</p> <p>(12)通過自民國113年第1季起更換簽證會計師案。</p>			
--	---	--	--	--

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定，唯尚未揭露公司治理實務守則。	無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一) 本公司為維護股東權益，設有發言人及代理發言人代表公司對外發言，協助處理股東建議或糾紛等問題。	無重大差異。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二) 本公司主要股東大多為本公司董事及經營團隊，每月依法規定期向公司申報持股異動情形。	
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 已訂定「與特定公司、集團企業及關係人之交易作業程序」及「對子公司監督與管理制度」並執行之。	
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四) 已訂定「防範內線交易之管理制度」從中規範公司內部人不得利用未公開資訊賺取利益。	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？</p> <p>(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p> <p>(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p> <p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	V	V	<p>(一)本公司為健全公司治理及提升董事會運作效能，已設立三席獨立董事。</p> <p>(二)本公司目前依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，未來將視實際需要及法令規定，設置其他功能性委員會。</p> <p>(三)本公司已訂定相關辦法並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。</p> <p>(四)本公司選任信譽卓越之會計師事務所簽證，其與本公司無任何利害關係，並嚴守獨立性，並定期評估簽證會計師之獨立性。</p>	無重大差異。
<p>四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？</p>	V		<p>本公司於112年08月02日董事會委任通過行政管理部門協理負責公司治理相關事務之最高主管，推動公司治理並有效發揮董事會職能，職權範圍及當年度業務執行重點如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。</li> <li>2.製作董事會及股東會議事錄。</li> <li>3.協助董事持續進修。</li> <li>4.提供董事執行業務所需之資料。</li> <li>5.協助董事遵循法令。</li> </ol>	無重大差異。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要永續發展議題？	V		本公司發言人為與利害關係人聯繫溝通之窗口，並於公司網站設置利害關係人聯繫資訊。	無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委由元大證券股務代理部辦理股東會事務。	無重大差異。
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		(一)本公司已架設網站，且持續著手增加其相關內容，另有關本公司之財務業務及公司治理相關訊息均依規定於公開資訊觀測站揭露。	無重大差異。
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V		(二)本公司指定專人負責定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項財務業務資訊，並遵循資訊公開之規定。並依規定設置發言人，落實發言人制度。	無重大差異。
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		V	(三)本公司為興櫃公司，因此尚未有提前申報年度財務報告及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運之情形。	未來將視主管機關規範，調整年度財務報告公告申報時限。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	V	<p>(一)本公司一向重視勞資關係，並以誠信對待員工，依勞基法保障員工合法權益。</p> <p>(二)透過員工福利制度及良好的教育訓練制度與員工建立互信互賴之良好關係。</p> <p>(三)本公司設置發言系統，與投資者保持暢通管道，與投資者均保持適當及良好的關係。</p> <p>(四)本公司與供應商一向維持良好關係。</p> <p>(五)利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。</p> <p>(六)本公司董事均具備相關專業知識並將定期參與進修。</p> <p>(七)本公司一向以穩健的原則進行相關之風險管理，訂有嚴密的內部控制制度以防範各項風險，並由內部稽核單位定期及不定期的查核內部控制制度的落實程度外，亦投保財產保險。</p> <p>(八)本公司與客戶維持穩定良好關係並秉持客戶至上之政策，以創造公司利潤。</p> <p>(九)本公司已為董事及經理人購買責任保險。</p> <p>(十)本公司已訂有誠信經營守則，將依相關辦法加強落實公司治理。</p>	無重大差異。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)本公司未列入受評公司，故無需填列。			

(四) 薪資報酬委員會運作情形資訊：

- 1.本公司薪資報酬委員會成員計 4 人，皆由獨立董事組成，成員資料可參閱「三、公司組織(四)董事及獨立董事」資料。
- 2.本屆委員任期：111 年 6 月 23 日至 114 年 6 月 22 日，最近年度及申請年度截至公開說明書刊印日止薪資報酬委員會開會 4(A)次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
召集人	潘燕民	4	0	100.00%	連任，111年6月23日委任。
委員	吳清沂	4	0	100.00%	連任，111年6月23日委任。
委員	林月霞	4	0	100.00%	連任，111年6月23日委任。
委員	李展南	4	0	0.00%	新任，112年11月8日委任。
<p>其他應記載事項：</p> <p>一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。</p> <p>二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。</p> <p>三、薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權：</p> <p>1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。</p> <p>2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。</p>					

3.提名委員會成員資料及運作情形資訊：不適用。

(五) 推動永續發展情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？		V	本公司尚未設置推動永續發展專職單位，但本公司訂有永續發展實務守則及公司誠信經營守則供全體員工及董事、經理人共同遵循。	未來將視公司發展需要及法令規定辦理。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註3)	V		本公司秉持「誠信、品質、服務、創新」經營理念及重大性原則，在追求企業永續經營與獲利之同時，履行永續發展，重視利害關係人之權益，注重環境、社會與公司治理之議題，並將其納入公司管理方針與營運活動，以達永續經營之目標。	無重大差異。
三、環境議題				
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一)本公司未設立環境管理制度，但本公司主要業務為非揮發性記憶體智財權授權，並無污染產生及環保相關問題。	無重大差異。
(二) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二)本公司致力於各項資源回收及再利用，如影印紙設回專區回收，並要求員工多利用電子郵件往來等減少用紙來降低環境衝擊。	無重大差異。
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？		V	(三)本公司主要業務為非揮發性記憶體智財權授權，目前氣候變遷對本公司尚無重大影響，但本公司持續關注有關氣候變遷之相關議題。	未來將視公司發展需要及法令規定辦理。
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？		V	(四)本公司主要業務為非揮發性記憶體智財權授權，雖沒有統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量等資料，但本公司致力於實施節能減碳，如提倡電子化系統，減少紙張使用量，並多加利用再生紙以及資源回收再利用等。	未來將視公司發展需要及法令規定辦理。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	V		(一) 本公司遵循各項勞動法令之規定並致力於職工福利的提昇，在人性化、合理化的管理下，員工意見皆能得到充分的重視與改善。	無重大差異。
<p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p>	V		(二) 本公司訂有工作規則及相關人事管理規章，內容涵蓋本公司聘僱勞工之基本工資、工時、休假、退休金給付、勞健保給付、職業災害補償等均符合勞動基準法相關規定。設立職工福利委員會透過員工選舉產生之福利委員會運作，辦理各項福利事項；本公司酬金政策，係依據個人能力，對公司的貢獻度，績效表現，與經營績效之關聯性成正相關。	無重大差異。
<p>(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？</p>	V		(三) 本公司提供員工安全與健康之工作環境，確保員工健康及工作環境安全；並有設置職業安全衛生人員，並制定相關工作守則，防止職業災害；定期辦理全體員工健康檢查，本公司亦依法辦理勞工保險、全民健康保險及團體保險，藉以保障員工權益，全方位支持員工身心靈均衡發展。	無重大差異。
<p>(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p>	V		(四) 本公司以長期人才培育為要，會依組織需求、部門需求及員工個人需求，規劃安排各項內外部培訓計畫，提升與更新員工的知識技能。	無重大差異。
			(五) 本公司與客戶間保持良好之溝通管道，並對產品與服務提	



評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(五) 對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	V		供透明且有效之客訴處理程序，對客戶之隱私均遵守保密協定及個人資料保護法，並設有客服單位及利害關係人專區保護消費者權益政策及提供申訴管道。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？		V	(六)本公司主要業務為非揮發性記憶體智財權授權，目前並無訂定供應商管理政策，但本公司會要求有合作的供應商應符合環保、安全及衛生相關法規。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續發展報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	本公司尚未設置推動永續發展專職單位以及編製永續發展報告書，未來將視公司發展需要及法令規定辦理。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司訂有「永續發展實務守則」運作大致如「上市上櫃公司永續發展實務守則」辦理，並適時修訂相關法規，惟尚未設置推動永續發展專職單位，未來將視公司發展需要及法令規定辦理。			
七、其他有助於瞭解永續發展運作情形之重要資訊： 本公司員工不論其種族、性別、年齡皆享有同等的工作權利，亦提供個人自由表達及發展之機會。			

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	V	V	<p>(一) 本公司本著廉潔、透明及負責之經營理念，建立良好之公司治理及風險控管機制，並以遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為本公司落實誠信經營之基本精神，並已訂定誠信經營守則，於內部管理及外部商業活動中確實執行。</p> <p>(二) 本公司所訂定「公司誠信經營守則」中已詳細規範禁止本公司董事、經理人及所有員工從事任何於「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，以防範不誠信行為發生。</p> <p>(三) 本公司已訂有誠信經營守則，明定防範方案範圍及權責單位。</p>	無重大差異。
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p>	V	V	<p>(一) 本公司已訂有誠信經營守則，明定相關規範。</p> <p>(三) 本公司尚未設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，由各部門依其職務所及範疇內落實誠信經營之政策，且本公司設有稽核單位，定期進行內控稽核，如有異常將向董事會進行報告。</p> <p>(三) 本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」及「董事會議事規範」明定防止利益衝突及迴避相關規範以利遵循。</p>	<p>無重大差異。</p> <p>未來將視公司發展需要及法令規定辦理。</p> <p>無重大差異。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以定期查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		(四) 本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，並設有專責之稽核單位，定期進行內控查核，並向董事會報告。	無重大差異。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五) 本公司適時對董事、獨立董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。	無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一) 本公司誠信經營守則已規範檢舉管道；對於已發生之不誠信行為，責成相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。本公司專責單位應將不誠信行為、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。	無重大差異。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		(二) 本公司誠信經營守則已有相關作業處理規範。	
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(三) 本公司採專人受理檢舉事項，以善盡保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。	
四、加強資訊揭露				
(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		(一) 本公司適時透過公開資訊觀測站、年報等揭露誠信經營相關資訊，未來將強化公司網站之投資人關係內容，以利資訊充份揭露及查詢。	無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：				
無重大差異。				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） 無。				

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

本公司已訂定公司治理相關規章：公司道德行為準則、公司誠信經營守則、公司永續發展實務守則、公司審計委員會組織規程、公司薪資報酬委員會組織規程等，可於公開資訊觀測站中查詢相關內容。

(八)最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。

(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

1.本公司 112 年度及截至公開說明書刊印日止，董事進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	黃文謙	112/8/9	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「內控處理準則修正」與「資訊安全」法遵防弊實務	6
		112/9/28		最新「ESG 永續」與「財報自編」相關政策發展與內控管理實務	6
董事	陳鴻文	112/11/7、112/11/8	台灣董事學會	企業雙軸轉型的發展趨勢、人工智慧的趨勢與風險管理	6
董事	陳永華	112/8/15	台灣科學工業園區科學工業同業公會	公司治理3.0、資本市場藍圖與綠色融資	3
		112/11/29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
董事	魏雅庵	112/7/31	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「ESG 永續」與「財報自編」相關政策發展與內控管理實務	6
		112/9/14		企業「勞動法令遵循」實務與案例解析	6
董事	鄭玥姝	112/9/14	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業「勞動法令遵循」實務與案例解析	6
獨立董事	潘燕民	112/9/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業併購後整合議題探討與管理機制建立	3
				國際碳關稅最新發展趨勢與因應作法	3

		112/10/20		112年度防範內線交易宣導會	3
獨立董事	吳清沂	112/9/4	金融監督管理委員會	第十四屆臺北公司治理論壇	6
獨立董事	林月霞	112/8/30	財團法人中華民國會計研究發展基金會	以「風險管理」推動企業永續發展	6
獨立董事	李展南	112/11/10	財團法人中華民國會計研究發展基金會	永續金融及投資ESG化趨勢	3

三十二、其他必要補充說明事項：

依臺灣證券交易所股份有限公司 113 年 2 月 26 日臺證上二字第 1131700766 號函，應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項：

(一)最近二年度與截至最近期業績變化之合理性

【公司說明】

本公司僅編制個別財務報告，茲就本公司最近二年度及 2023 年前三季之業績變化合理性說明如下：

單位：新臺幣千元

項目	2021 年度		2022 年度		2022 年前三季		2023 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入(淨額)	168,192	100.00	229,420	100.00	168,127	100.00	144,732	100.00
營業成本	1,323	0.79	1,720	0.75	813	0.48	1,061	0.73
營業毛利	166,869	99.21	227,700	99.25	167,314	99.52	143,671	99.27
營業費用	123,531	73.44	148,854	64.88	107,773	64.10	112,272	77.57
營業利益	43,338	25.77	78,846	34.37	59,541	35.41	31,399	21.69
營業外收入及支出	(131)	(0.08)	2,525	1.10	3,145	1.87	2,977	2.06
稅前淨利	43,207	25.69	81,371	35.47	62,686	37.28	34,376	23.75
所得稅費用	4,632	2.75	8,407	3.66	4,635	2.76	5,302	3.66
本期淨利	38,575	22.94	72,964	31.10	58,051	34.53	29,074	20.09
基本每股盈餘	1.44		2.72		2.17		1.08	

資料來源：各期經會計師查核簽證或核閱之個別財務報告。

1.營業收入

本公司2021年至2022年度及2023年前三季之營業收入分別為168,192千元、229,420千元及144,732千元，營業收入成長率分別為36.40%及(13.92)%。本公司營業項目分為技術服務及技術權利金二大類，前者主係提供標準/客製化矽智財服務，以收取使用費(Usage)或產品設計開發費(NRE)，而後者為經驗證之矽智財於晶圓代工廠投入量產，按產量收取一定比例之權利金。

本公司2022年度營業收入較2021年度增加61,228千元，主係2022年度全球晶片缺貨潮持續延燒，使 IC 設計公司紛紛提高備貨水位，而晶圓代工廠出貨量增加，致2022年度本公司技術權利金收入較2021年度增加59,836千元，使2022年度營業收入大幅成長36.40%；2023年前三季較2022年同期減少23,395千元，主係受到全球高通膨影響，消費者購買力下滑，致 IC 設計公司庫存去化速度放緩、晶圓代工廠出貨量下滑，進而影響本公司2023年前三季技術權利金收入減少，使2023年前三季營業收入相較2022年同期呈現衰退情形。

## 2.營業成本及營業毛利

本公司2021年至2022年度及2023年前三季之營業成本分別為1,323千元、1,720千元及1,061千元；本公司2021年至2022年度及2023年前三季之營業毛利分別為166,869千元、227,700千元及143,671千元，營業毛利成長率分別為36.45%及(14.13)%。有鑑於矽智財營運模式及產業特性，投入之成本多於研究開發當期即予認列為營業費用，僅部分產品設計開發(NRE)可明確歸屬至專案者，將相關費用認列為營業成本。2022年度營業毛利較2021年度增加60,831千元，主係本公司技術權利金收入為早先開發之SIP量產而衍生之後續收入，故研發相關費用多數以認列為當期之研究發展費用，故技術權利金收入並無產生相關營業成本，而2022年度技術權利金收入大幅成長，致營業毛利同時增長；2023年前三季較2022年同期減少22,643千元，主係2023年度晶圓代工廠出貨量下滑，營業收入減少致2023年前三季營業毛利相較2022年同期呈現衰退情形。

## 3.營業利益

本公司2021年至2022年度及2023年前三季之營業利益分別為43,338千元、78,846千元及31,399千元，營業利益成長率分別為81.93%及(47.26)%。2022年度營業利益較2021年度增加35,508千元，主係2022年度全球晶片缺貨情形持續延燒，IC設計公司紛紛提高庫存準備，晶圓出貨量大增，使技術權利金收入及毛利大幅成長，又本公司營業費用管控得宜，致2022年度營業利益大幅成長；2023年前三季較2022年同期減少28,142千元，主係受到全球高通膨影響，消費者購買力下滑，致IC設計公司庫存去化速度放緩、晶圓代工廠出貨量下滑，連帶本公司營收及毛利下滑，惟為維持穩定之研發量能，致研究發展費用較2022年同期增長，致2023年前三季營業利益相較2022年同期呈現衰退情形。

## 4.營業外收入及支出

本公司2021年至2022年度及2023年前三季之營業外收入及支出分別為(131)千元、2,525千元及2,977千元，營業外收入及支出成長率分別為2,027.48%及(5.34)%。2022年度營業外收入及支出較2021年增加2,656千元，主係本公司營業收入以美元為主要幣別，2022年度全球通膨壓力升高，美國聯準會決議啟動升息循環，致美元對新臺幣匯率強勢升值，使本公司2022年度產生兌換利益；2023年前三季較2022年同期減少168千元，亦受美元升值影響，惟2023年前三季營業收入減少，連帶產生之兌換利益減少。

## 5.稅前淨利及及每股稅後損益

本公司2021年至2022年度及2023年前三季之稅前淨利分別為43,207千元、81,371千元及34,376千元；每股盈餘則分別為1.44元、2.72元及1.08元。2022年度稅前淨利及每股盈餘分別較2021年增加38,164千元及1.28元，主係2022年度全球晶片缺貨潮持續延燒，使IC設計公司紛紛提高備貨水位，而

晶圓代工廠出貨量增加，2022年度本公司權利金收入增加，致整體稅前淨利及每股盈餘較2021年度上升；2023年前三季稅前淨利及本期淨利分別較2022年同期減少28,310千元及28,977千元，主係受消費性電子產品終端需求疲弱，消費性電子產業客戶存貨尚在去化，營業收入下滑，加上研發支出增加，致稅前淨利及本期淨利較2022年同期減少。

綜上分析，本公司整體獲利情形受終端消費性電子需求變動而影響，2021~2022年度及2023年前3季之業績變化情形尚屬合理。

## 【承銷商說明】

### (一) 公司所屬行業之產業概況

所謂嵌入式非揮發性記憶體(以下簡稱 eNVM)，有別於常見的動態隨機存取記憶體(DRAM)和靜態隨機存取記憶體(SRAM)，eNVM 係指當電流關掉後，所儲存的資料不會消失的資料儲存裝置，其中依記憶體內的資料是否能在使用系統時隨時改寫為標準，又可分為光罩式唯讀記憶體(Mask ROM)、單次寫入唯讀記憶體(One-Time Programming，以下簡稱 OTP)、多次寫入記憶體(Multi-Times Programming，以下簡稱 MTP)及快閃記憶體(Flash)等四種不同性質之記憶體模組，該公司主要產品為以邏輯製程開發之 MTP 為主，OTP 為輔，並提供客戶具備不同記憶體容量、燒寫次數、操作溫度與操作電壓的產品規格，其所發展之 SIP 產品可應用範圍廣泛，諸如電源管理 IC、微控制器 IC、車用 IC 及智慧聯網 AIoT 等應用領域。

根據調研機構 Arsta Research Analysis 於 2022 年 7 月出具之報告指出，eNVM SIP 市場產值將從 2022 年的 3.1 億美元，成長至 2028 年 8.1 億美元之水準，預估年均複合成長率將達到 14.7%，而該公司產品 OTP 及 MTP SIP，其市場產值更將從 2022 年的 0.9 億美元，成長至 2028 年 2.5 億美元，預估年均複合成長率達到 15.0%，顯示隨著系統單晶片(SoC)的發展，eNVM SIP 的儲存優勢也逐漸顯現，未來成長潛力可觀。若以各領域應用類別來看，Arsta Research Analysis 預估，eNVM SIP 金額最大市場仍以消費性電子產品為主，由 2022 年的 1.3 億美元成長至 2028 年的 3.3 億美元。車用領域將成為一匹黑馬，由 2022 年約 0.8 億美元的市場成長至 2028 年 2 億美元，另外，通訊領域也有顯著成長，由 2022 年約 0.4 億美元的市場成長至 2028 年 1.1 億美元。

消費性電子產品近年來受到消費性晶片供給過剩而導致的衝擊，加上國際局勢緊張、高通膨等影響，導致經濟成長停滯，市場需求降溫，消費者也將節約支出，限制了消費性電子產品成長。然而儘管手機及個人電腦市場存在短期困境，消費性電子產品仍是各應用類別中最大之市場，在此同時，智慧家庭、智慧生活以及聚焦在健康性質的消費性電子產品將承載著最多的機會，另外在微軟、輝達等公司致力發展 AI 的情況下，可預見人工智慧科技未來將應用於各領域之消費性電子產品，並改變人們的生活模式，消費性電子產業的長期前景仍屬樂觀。



在車用領域中，舉凡螢幕顯示、雨刷及天窗等，都含有電子控制單元(ECU)，根據統計，現在一台汽車上已有上百個 ECU 在其中進行運作，不單是 ECU，其內部組成零件也包含了 MCU、電源元件以及車內通訊電路等，每個晶片都必須各司其職，才能讓汽車內部對指令的溝通與傳輸更加順暢，此外，無論是燃油車或是電動車，現行車款導入先進駕駛輔助系統(ADAS)已成為標準配備，此部分應用都必須仰賴如大腦般的 AI 運算晶片，藉此有效並快速分析資訊，而隨著全球加快推動「綠色低碳發展」及 2050 年淨零碳排目標的確立，無形中加速了電動車的普及速度，而車用晶片在電動車中的需求大過於傳統汽車，因此電動車銷售成長，晶片需求也跟著增加。

而在通訊領域中，近幾年來歐美國家維持去中化原則，巨額投資新世代高速基礎網路，刺激更多新技術與產品的問市，新一代 5G 網路、Wi-Fi 7 路由器等設備陸續推出，美國更於 2023 年 6 月宣布將向全美各州投入 420 億美元經費，用於寬頻網路基礎建設，以便達成高速寬頻網路普及，故未來通訊市場發展可期。

## (二) 依主要產品別說明最近二年度及申請年度業績變化合理性

### 1. 最近二年度及申請年度主要產品別之營業收入變動表

單位：新臺幣千元

產品別 \ 年度	2021 年度		2022 年度		2022 年前三季		2023 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
技術服務	57,429	34.14	58,821	25.64	40,003	23.79	37,339	25.80
技術權利金	110,763	65.86	170,599	74.36	128,124	76.21	107,393	74.20
總計	168,192	100.00	229,420	100.00	168,127	100.00	144,732	100.00

資料來源：該公司提供

### 2. 最近二年度及申請年度主要產品別之營業成本變動表

單位：新臺幣千元

產品別 \ 年度	2021 年度		2022 年度		2022 年前三季		2023 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
技術服務	1,323	100.00	1,720	100.00	813	100.00	1,061	100.00
技術權利金	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	1,323	100.00	1,720	100.00	813	100.00	1,061	100.00

資料來源：該公司提供。

### 3. 最近二年度及申請年度主要產品別之營業毛利變動表

單位：新臺幣千元

產品別 \ 年度	2021 年度		2022 年度		2022 年前三季		2023 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
技術服務	56,106	33.62	57,101	25.08	39,190	23.42	36,278	25.25
技術權利金	110,763	66.38	170,599	74.92	128,124	76.58	107,393	74.75
總計	166,869	100.00	227,700	100.00	167,314	100.00	143,671	100.00

資料來源：該公司提供。

#### 4.最近二年度及申請年度主要產品別之營業收入、營業成本及營業毛利之變化說明

##### (1) 技術服務收入

本公司技術服務收入可依服務性質區分為委託設計開發收入(NRE)及使用收入(Usage)，NRE 係指該公司根據客戶所要求之規格製作 SIP 區塊，並於開發過程中達到特定階段里程碑時收取開發設計費用；Usage 係針對客戶使用已開發且驗證完成 SIP 或已於晶圓代工廠上架之既有 SIP，依其使用於自身產品次數收取固定費用。2021 年至 2022 年度及 2023 年前三季技術服務收入分別為 57,429 千元、58,821 千元及 37,339 千元，占營收淨額比重分別為 34.14%、25.64% 及 25.80%。

該公司 2022 年度技術服務收入金額較 2021 年度增加 1,392 千元，成長率為 2.42%，主要係受到 2021 年半導體產業過熱延燒，全球晶圓代工廠產能利用率皆達到歷年來新高點，IC 設計公司為確保既有產品出貨時程，放緩開發速度，導致該公司使用收入大幅下滑；而在委託設計開發收入方面，晶圓代工廠新建置之製程技術平台，已達成可靠度、特性及品質驗證里程碑並認列收入，使委託設計開發收入成長，致該公司 2022 年技術服務收入微幅增加。2023 年前三季銷售金額較 2022 年前三季減少 2,664 千元，衰退率為 6.66%。自 2022 年下半年開始，全球面臨高通膨、各國升息政策及地緣政治等負面影響，使得小型家電、個人電腦及顯示器等終端市場需求迅速滑落，IC 設計公司隨即面臨庫存過高、存貨去化速度緩慢等問題，在調整庫存之際，IC 設計公司持續減緩開發新案之速度，導致該公司使用收入減少；惟受到美國發佈對中國之晶片禁令，中國大陸全力扶植國內半導體產業，興建晶圓代工廠並加強發展 IC 設計公司，多數已達成開案或投片里程碑，使委託設計開發收入小幅成長，整體而言，該公司 2023 年前三季技術服務收入僅呈現微幅減少之態勢。

##### (2) 技術權利金

2022 年度技術權利金收入金額較 2021 年度增加 59,836 千元，成長率為 54.02%。該公司 SIP 多數應用於 MCU、電源管理 IC、顯示器之驅動 IC、指紋辨識 IC 等，終端產品分散於消費性電子、車用、通訊、IOT 及智慧家電等應用領域，受惠於近幾年疫情之影響改變生活習慣，帶動遠距辦公及數位學習等新模式需求崛起，使個人電腦、電腦伺服器及車用電子等消費市場需求大幅增長，又因各國封城工廠停工，使半導體供應鏈受到嚴重衝擊而爆發晶片缺貨潮，2022 年晶片缺貨現象延燒，全球晶圓代工廠產能利用率皆達到歷年新高點，而各家 IC 設計公司為避免延宕產品出貨時程，紛紛提高庫存準備，同時客戶通過投片驗證之產品也進入量產階段，SIP 開發基數、晶圓出貨量及價格增加帶動 2022 年度該公司技術權利金收入增加。2023 年第三季技術權利金收入金額較 2022 年第三季減少 20,731 千元，衰退率為 16.18%，主係自 2022 年下半年開始，國際通貨膨脹使各國央行逐步調升利率，全球總經濟成長疲軟，消費性

電子市場需求急速跌落，晶片供貨量趨於穩定，IC 設計公司隨即面臨高庫存壓力致晶圓出貨量大幅下滑，進而影響該公司技術權利金收入減少。

2023 年前三季受全球通膨壓力影響，消費者購買力下滑，導致消費性電子市場之需求減少，致該公司最近二個會計年度及 2023 年前三季之營業收入及毛利呈現衰退情形，參酌採樣同業力旺電子(股)公司（以下簡稱力旺）、晶心科技(股)公司（以下簡稱晶心科）及 M31 科技(股)公司（以下簡稱 M31），與該公司營收收入組成較為相似之採樣同業力旺相比較，2023 年前三季同樣受消費性電子產業需求疲弱影響，致營業收入及毛利較去年同期呈現衰退情形。

單位：新臺幣千元；%

分析項目	年度 公司 名稱	2021 年	2022 年		2022 年 前三季	2023 年前三季	
		金額	金額	成長率	金額	金額	成長率
營業收入	億而得	168,192	229,420	36.40%	168,127	144,732	(13.92)%
	力旺	2,363,824	3,216,711	36.08%	2,314,007	2,151,467	(7.02)%
	晶心科	819,778	931,821	13.67%	623,304	651,831	4.58%
	M31	1,011,879	1,360,165	34.42%	870,930	1,093,248	25.53%
營業毛利	億而得	166,869	227,700	36.45%	167,314	143,671	(14.13)%
	力旺	2,363,824	3,216,711	36.08%	2,314,007	2,151,467	(7.02)%
	晶心科	818,307	931,090	13.78%	621,699	650,240	4.59%
	M31	1,011,879	1,360,165	34.42%	870,930	1,093,248	25.53%

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告

#### 5. 營業費用及營業利益變化原因及其合理性分析

單位：新臺幣千元

產品別	年度	2021 年度		2022 年度		2022 年前三季		2023 年前三季	
		金額	占營收淨額%	金額	占營收淨額%	金額	占營收淨額%	金額	占營收淨額%
推銷費用		12,031	7.15	11,538	5.03	8,326	4.95	9,355	6.46
管理費用		21,904	13.02	29,486	12.85	20,758	12.35	22,212	15.35
研究發展費用		89,596	53.27	107,830	47.00	78,689	46.80	80,705	55.76
營業費用合計		123,531	73.44	148,854	64.88	107,773	64.10	112,272	77.57
營業利益		43,338	25.77	78,846	34.37	59,541	35.41	31,399	21.69

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

##### (1) 營業費用

該公司 2021 年至 2022 年度及 2023 年前三季之營業費用分別為 123,531 千元、148,854 千元及 112,272 千元，營業費用率分別為 73.44%、64.88% 及 77.57%，主要包括推銷費用、管理費用及研究發展費用。

##### ① 推銷費用

在推銷費用方面，該公司 2021 年至 2022 年度及 2023 年前三季分別為 12,031 千元、11,538 千元及 9,355 千元，占各期營業收入比重分別為 7.15%、5.03%及 6.46%，主要係業務單位人員之薪資支出、佣金支出、折舊費用及運雜費用等項目。

2022 年度推銷費用較 2021 年減少 493 千元，減幅為 4.10%，主要係業務副總經理辭任，致薪資相關費用減少所致；2023 年前三季推銷費用較 2022 年同期增加 1,029 千元，增幅為 12.36%，主要係透過中介之技術服務收入開案致佣金支出增加、參展及拜訪客戶致旅費及廣告費增加。

## ② 管理費用

在管理費用方面，該公司 2021 年至 2022 年度及 2023 年前三季分別為 21,904 千元、29,486 千元及 22,212 千元，占各期營業收入比重分別為 13.02%、12.85%及 15.35%，主要係管理單位人員之薪資支出、獎金、折舊費用、各項攤提、勞務費、董事酬勞及員工酬勞等項目。

2022 年度管理費用較 2021 年增加 7,582 千元，增幅為 34.61%，主要係 2022 年度本期淨利較 2021 年成長，員工酬勞及董事酬勞增加，且調薪及增聘人員使薪資相關費用增加；2023 年前三季管理費用較 2022 年同期增加 1,454 千元，增幅為 7.00%，主要係委託會計師出具內控專審報告致勞務費增加所致。

## ③ 研究發展費用

在研究發展費用方面，該公司 2021 年至 2022 年度及 2023 年前三季分別為 89,596 千元、107,830 千元及 80,705 千元，占各期營業收入比重分別為 53.27%、47.00%及 55.76%，主要係研發單位人員之薪資支出、獎金、折舊及攤提等項目。

2022 年度研究發展費用較 2021 年增加 18,234 千元，增幅為 20.35%，主要係調薪及增聘人員使薪資相關費用增加，另購置軟體使各項攤提增加所致；2023 年前三季研究發展費用較 2022 年同期增加 2,016 千元，增幅為 2.56%，主要係調薪及增聘人員使薪資相關費用增加、參展及拜訪客戶使旅費增加所致。

## (2) 營業利益

該公司於 2021 年至 2022 年度及 2023 年前三季之營業利益分別為 43,338 千元、78,846 千元及 31,399 千元，營業利益率分別為 25.77%、34.37%及 21.69%。2022 年度營業利益較 2021 年度成長 81.93%，主係該公司技術權利金收入大幅成長，且營業費用管控得宜，致 2022 年度營業利益較 2021 年度提升；2023 年第三季營業利益較 2022 年第三季減少，係晶圓出貨量受到半導體產業景氣影響而下滑，使得技術權利金收入減少，且 2022 年度獲利大幅成長，故估列員工酬勞及董事酬勞增加，同時

為維持穩定研發量能，使得研究發展費用增加，致營業利益較 2022 年第三季減少(47.26)%。

綜上所述，該公司 2021 年至 2022 年度及 2023 年前三季之營業費用及營業利益之變化情形，尚屬合理。

#### 6.營業外收入及支出變化原因及其合理性分析

單位：新臺幣千元

年度		2021 年度		2022 年度		2022 年前三季		2023 年前三季	
		金額	占營收淨額%	金額	占營收淨額%	金額	占營收淨額%	金額	占營收淨額%
產品別	銀行存款利息	677	0.40	1,511	0.66	861	0.51	2,260	1.56
	其他	9	-	28	0.01	-	-	-	-
	小計	686	0.40	1,539	0.67	861	0.51	2,260	1.56
其他收入		29	0.02	10	-	10	-	-	-
其他利益及損失	淨外幣兌換(損失)利益	(640)	(0.38)	1,082	0.47	2,366	1.41	764	0.53
財務成本		(206)	(0.12)	(106)	(0.04)	(92)	(0.05)	(47)	(0.03)
合計		(131)	(0.08)	2,525	1.10	3,145	1.87	2,977	2.06

資料來源：該公司各期間經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

##### (1) 利息收入

該公司 2021 年至 2022 年度及 2023 年前三季之利息收入分別為 677 千元、1,511 千元及 2,260 千元，主要係 2022 年央行升息使金融機構之定存利息收入所致。

##### (2) 其他收入

該公司 2021 年至 2022 年度及 2023 年前三季之其他收入分別為 29 千元、10 千元及 0 千元。2021 年主要係出售測試 IC 板收入；2022 年度主要係退稅及補助收入，而 2023 年無此情形。

##### (3) 其他利益及損失

該公司 2021 年至 2022 年度及 2023 年前三季之兌換利益(損失)分別為(640)千元、1,082 千元及 764 千元。該公司營業收入多以美金為計價幣別，2021 年度因受到美國聯準會為抑制經濟大幅衰退，維持自疫情期間以來實施之寬鬆貨幣政策，使美元對新臺幣匯率持續走貶，致該公司 2021 年度產生兌換損失 640 千元；2022 年度由於俄羅斯與烏克蘭軍事衝突擴大，造成全球通膨壓力升高，致使美國聯準會決議啟動升息循環，截至 2022 年底美國聯準會共升息 4.25%，使得美元對新臺幣強勢升值，致該公司 2022 年度產生兌換利益 1,082 千元；2023 年截至前三季因美國通貨膨脹情形尚未緩解，美國聯準會持續升息予以因應，致美元兌新臺幣匯率升值，使得該公司 2023 年前三季產生兌換利益 764 千元。

##### (4) 財務成本

該公司 2021 年至 2022 年度及 2023 年前三季之財務成本分別為 206 千元、106 千元及 47 千元，主係為租賃負債所認列之財務成本，並受到租賃負債期間產生變動。

#### 7. 稅前淨利及每股盈餘變化及其合理性分析

單位：新臺幣千元

產品別	2021 年度		2022 年度		2022 年前三季		2023 年前三季	
	金額	占營收淨額%	金額	占營收淨額%	金額	占營收淨額%	金額	占營收淨額%
稅前淨利	43,207	25.69	81,371	35.47	62,686	37.28	34,376	23.75
本期淨利	38,575	22.94	72,964	31.80	58,051	34.53	29,074	20.09
基本每股盈餘(元)	1.44		2.72		2.17		1.08	

資料來源：該公司各期間經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司 2021 年至 2022 年度及 2023 年前三季之稅前淨利分別為 43,207 千元、81,371 千元及 34,376 千元；每股盈餘分別為 1.44 元、2.72 元及 1.08 元，該公司之稅前淨利及每股盈餘與營業毛利呈相同變動趨勢。該公司 2022 年度受惠於晶圓量增價揚及晶圓代工廠產能利用率提升，致 2022 年度整體獲利能力逐季上升，加上營業費用控制得宜，使得稅前淨利及每股盈餘增加；2023 年前三季相較 2022 年同期減少，主要係受消費性電子產品終端需求疲弱且 IC 設計公司存貨尚在去化，致營業收入下滑，營業毛利較去年同期下降所致。

整體而言，該公司 2021 年至 2022 年度及 2023 年前三季之業績變化情形尚屬合理。

#### 【會計師說明】

就億而得公司最近 2 年度及最近期（2023 年前 3 季）業績變化之合理性評估說明如下：

單位：新臺幣千元

項目	2021 年度		2022 年度		2022 年前三季		2023 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入(淨額)	168,192	100.00	229,420	100.00	168,127	100.00	144,732	100.00
營業毛利	166,869	99.21	227,700	99.25	167,314	99.52	143,671	99.27
營業利益	43,338	25.77	78,846	34.37	59,541	35.41	31,399	21.69
稅前淨利	43,207	25.69	81,371	35.47	62,686	37.28	34,376	23.75

資料來源：各期經會計師查核簽證或核閱之個別財務報告。

就以下指標作業績變化之合理性分析：

##### 1. 營業收入

2021~2022 年受惠全球晶片需求增加，台灣主要為半導體出口大國，全球晶片需求加上億而得公司過去幾年的研發產品陸續驗證完成並進入量產，帶動億而得公司使用費收入與權利金收入成長；2023 年因市場庫存去化

速度未如原先預期，終端應用市場需求疲弱，2023年台灣半導體業產值出現衰退，晶圓代工出貨量下滑，進而影響億而得公司權利金收入下滑，使2023年前三季營收呈現微幅衰退情形。

## 2.營業毛利

億而得公司收入類別中，以權利金收入為主要收入來源，約占營收七成。權利金收入為早先開發之 SIP 量產而衍生之後續收入，故研發相關費用多數以認列為當期之研究發展費用，故各期認列之權利金收入並無產生相關營業成本。經本會計師經評估，最近2年度及最近期毛利率尚屬合理，未發現重大異常情事。

## 3.營業利益

億而得公司營業淨利各年之影響，主要係來自營收之影響。

## 4.稅前淨利

億而得公司稅前淨利各年之影響，主要係來自營收之影響，另2022及2023年度美元匯率貶值，美元兌新臺幣匯率升值使億而得公司產生較多兌換利益。

綜上分析，億而得公司整體獲利情形受終端消費性電子需求變動而影響，最近二年度與截至最近期財務報表業績變化尚屬合理。

## 8.

(二)公司規模小於國內外主要同業，且以成熟製程及終端消費性產品應用為主，公司之產業定位、面臨先進製程及新興記憶體研發之潛在營運風險及因應措施。

### 【公司說明】

#### 1.產業排名

本公司致力於邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體(eNVM) SIP 之研究開發、功能設計、市場應用與業務行銷，目前主要競爭對手國外以美國 Microchip、Synopsys 及國內力旺公司，三者囊括全球高達八成之市占率，本公司專注於 MTP 技術領域，早期 MTP 雖可提供多次讀寫之功能，仍因面積較 OTP 為大而不具備相應之成本優勢，致公司規模相較於其他競爭者小，2022年度全球市占率僅約2.35%，與競爭對手有顯著差距，惟本公司憑藉獨有之1T1C 關鍵核心技術，開發出極具小面積優勢且可多次寫入之 MTP 產品，已成為業界少數擁有 MTP 之技術領導公司，故全球排名位居第四。

#### 2.產業定位及競爭利基

本公司開發之 eNVM SIP 產品，在非特殊製程及無內建升壓電路之情況下，其面積已小於競爭者在相同容量及類似製程所推出之 OTP，提供具競爭力之記憶體規格與面積，降低 IC 業者開發成本及提升設計彈性，至今已取得數十項國內外發明專利，藉此拉開與同業之市場區隔，隨著 IC 產品生命週期縮短、晶片設計複雜度日益提升，需搭載 MTP 使用之晶片需求逐

漸成長，本公司提前佈局推出各式寫入次數、容量及面積之創新產品，提供 IC 設計業者多樣化和差異化的選擇，產品主要應用於電源管理、電源供應、驅動器 IC 及微處理器市場，並於超過十家以上晶圓代工廠之晶圓生產線上，建置多樣化技術平台，已獲得多家知名 IC 設計公司採用，在多種製程平台上完成驗證並進行產品量產，本公司為客戶量身打造 MTP 並提供完美解決方案，提升競爭力以成為 MTP 領導廠商。

本公司考量現今 OTP 仍有較高之市占率，且長期合作客戶陸續提出在熟悉設計架構下使用 OTP 產品之需求，加上同業成熟製程設計之 OTP 已量產多年，又應用製程眾多維護不易，在寫入功能上及面積上已逐漸不符市場需求，故藉由 MTP 競爭優勢開發 OTP，提供相同面積下，可進行10次的寫入次數之產品，或是僅有單次寫入功能而面積縮小20%之產品，大幅降低客戶成本及提高便利性，且成功創造出與同業產品差異化，已獲得許多客戶採用並且量產中，主要應用於低階微控制器、電子標籤及平板電腦、電子錶驅動器等市場。

在成功導入 OTP 市場後，本公司持續強化現有產品之效能，研發低成本、之 MTP 產品外，透過與合作夥伴取得開案機會，掌握終端需求，開發佈局朝向32位元微控制器、網通、車用電源管理、手機面板驅動等應用市場，以提升產品競爭力並擴大應用領域，藉由陸續發展出多樣化之 SIP 新品，預計2026年本公司全球市占率將可達到4.5%。

### 3.潛在風險及因應措施

非揮發性記憶體技術不斷演進，現今發展之新興記憶體雖然皆具有非揮發性功能，但受限於特殊製程要求、面積較大或材料特性等因素，目前僅有少數晶圓代工廠具備開發元件與製程之能力，使得新興記憶體技術僅局限於部份領域應用，且其開發時間及製造成本相對於 MTP 與 OTP 皆高出許多，更不易跟上製程研發的演進，故仍未被市場廣泛採用，因此具備低研發費用、研發時間短之 MTP 及 OTP 市場將持續存在，不易有被新興記憶體取代之風險。本公司也將持續佈局先進製程之開發，並拓展開發新興記憶體產品，惟 MTP 受限於技術及材料限制，在先進製程研發又更為艱難，目前以 HKMG 研製適用於先進製程之 MTP，產品尚在測試階段，預期未來成功進入量產，將可在先進製程實現不改製程之 MTP 方案，對產業之貢獻及本公司業績將有極大的助益；同時，本公司以自身 1T1C 關鍵技術，拓展開發次世代之記憶體產品，例如 HKMG、RRAM 元件與 RRAM 之控制線路等，並延續與晶圓代工廠合作研發方式，由晶圓代工廠提供 RRAM 元件，本公司負責開發設計服務等模式，提升技術層次與產品應用。本公司為除了透過產學交流外，更積極參加國際半導體展覽會，進而了解國際技術及產品開發趨勢，以持續提升技術之競爭力並設計出可滿足客戶需求之 SIP 產品。



綜上所述，本公司專注於 MTP 技術領域已累積多年開發經驗，受惠於 IC 產品週期縮短及設計複雜度增加之產業趨勢，MTP 市場需求及新應用領域將逐步浮現；另隨著半導體產業持續追求製程微縮技術發展，也將帶動以 OTP 應用為主之先進製程需求成長，本公司擁有 MTP 領先技術優勢，建置完整之記憶體 SIP 資料庫客製化解決方案，開發多項產品做出市場差異化，有效提升本公司市占率及產品競爭優勢。

## 【承銷商說明】

### 1. 產業排名、產業定位及競爭利基

該公司採用自行研發之 1T1C 核心技術，提供可多次編程、面積小、高效能及高穩定度之 MTP 客製化解決方案，大幅提升客戶產銷彈性及產品競爭力。惟受到早期記憶體 SIP 產業之技術發展受限之影響，導致 MTP 未成為市場上主流採用之技術，致品牌知名度相較同業為低，進而使得該公司企業規模尚不及已上市櫃之競爭同業，而該公司係全球第四大 eNVM 供應商，顯見該公司規模小仍於該產業中取得一席之地，已成為業界少數擁有 MTP 之技術領導公司。

該公司 MTP 產品結合高寫入次數及低成本之優勢，有效降低產品讀寫電壓提升客戶產品效能，並持續發展出相較同業更小面積之記憶體 SIP，擴大產品規格領先優勢及應用市場，以此區隔同業競爭市場。該公司以此關鍵技術之優勢，持續延伸佈局先進製程相關利基型應用並逐步切入 OTP 市場，透過現有合作客戶取得新製程平台投產機會，目前該公司已成功開發出相較競爭同業更多次寫入或面積更小之 OTP 產品，近年來 AI、電動車、物聯網及 5G 等應用持續推升半導體終端產品輕、薄、短、小及晶片整合度之需求，此核心技術將作為該公司未來積極朝向高壓先進製程之面板驅動 IC 及車用電子等應用領域發展，於市場上競爭之一大利基，藉以擴大該公司產品應用領域，並提升市場占有率。

半導體製程技術日益精進，消費性電子市場面臨少量多樣之需求挑戰，該公司多次讀寫之功能及各式容量之產品特性，提供客戶在相同硬體產品設計中，可靈活變更不同版本之韌體，快速反應不同終端產品應用需求，將大幅縮減產品開發時程，提升產品市場競爭力。該公司因應終端產品應用功能日益擴增且符合市場發展趨勢，未來將持續投入新產品及新技術之研究發展計畫，結合關鍵技術競爭優勢，開發如 32 位元微控制器、電源管理及面板驅動等各式 IC 應用領域，聚焦於車用電子、智慧電力及物聯網等利基市場，建置更完整資料庫之解決方案，藉以助客戶縮短產品設計週期、降低製造成本及提升市場競爭力。該公司累積逾 20 多年之開發經驗，成功跨入 OTP 市場，並占有 MTP 領先技術專利優勢，經評估該公司之產業定位及競爭利基尚屬合理。

### 2. 潛在風險及因應措施

近年來由於電子產品外型短小輕薄、功能多樣化等需求，促使晶片設計複雜度日益提高，矽智財產業作為半導體產業鏈的重要關鍵技術，可大幅縮短產品開發時程及加速產品上市週期，有效提升客戶產品競爭力。而終端應用領域日益廣泛，使非揮發性記憶體技術不斷演進，惟目前新興記憶體技術仍受限於特殊製程，而綜觀該公司 SIP 終端應用市場多於成熟製程，新興記憶體並非為客戶首選，近年來隨著物聯網技術蓬勃發展，將為汽車電子、穿戴式裝置、智慧家庭及無線充電等終端應用領域帶來絕佳之發展前景，MCU 終端應用日漸廣泛，帶動 eNVM 的需求也將持續增加，在 MTP 技術已被市場廣泛認可和應用之下，該公司未來將憑藉其研發團隊開發之技術，持續以技術領先思維，提升產品寫入次數、容量規格與讀寫速度，提供客戶更為優異之產品效能及性價比方案，將有助於提升整體競爭力並擴大公司規模，經評估該公司潛在風險及因應策略，應尚屬合理。

## 陸、重要決議、公司章程及相關法規

- 一、重要決議應記載與本次發行有關之決議文：（含章程新舊條文對照表及盈餘分配表）
  - （一）董事會議紀錄：請參閱本公開說明書附件十二。
  - （二）公司章程及章程新舊條文對照表：請參閱本公開說明書附件十四。
  - （三）盈餘分配表：請參閱本公開說明書附件十三。

### 二、未來股利發放政策

本公司章程第六章第 20 條：

本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥：

一、董事酬勞不高於百分之五。

二、員工酬勞百分之五至百分之十五。

但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議之，並報告股東會。

本公司章程第六章第 20 條之 1 中所訂之股利政策如下：

本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補以往虧損(包括調整未分配盈餘金額)，次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣後盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具分配案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部分，以發放現金方式為之，並報告股東會。

本公司授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將法定盈餘公積及資本公積之全部或一部分，以發放現金方式為之，並報告股東會。

本公司章程第六章第 20 條之 2：

授權董事會於可供分配盈餘 0%至 100%之額度範圍內，視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分配案，提報股東會。每年發放現金股利之比例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十。

### 三、未來辦理增資計畫及其對獲利能力稀釋作用之影響事項

本公司預計申請創新板上市待主管機關核准後，由本公司與證券承銷商視當時市場狀況及最近期之營運情形，再經董事會決議未來何時辦理現金增資，未來現金增資發行價格之訂定，主要係考量產業前景、公司競爭利基、未來營運狀況及發行市場環境等因素後，與證券承銷商協商後共同訂定承銷價格，而實際發行價格，則待主管機關核准之，再由本公司與證券承銷商視當時市場之狀況及最近期之營運情形，並經董事會議定之。惟本公司對未來營收及獲利狀況尚屬可期，故未來本公司辦理現金增資對每股獲利能力之稀釋程度應尚屬有限。

- 四、本國發行公司或外國發行人召開股東會討論股票初次申請上市暨辦理上市前現金增資新股公開銷售，並將保留該新股之一定比例採洽商銷售方式辦理配售，應於股東會召集事由列舉並說明相關事宜，並應完整揭露股東會決議內容：不適用。

附件一、111 年度個別財務報告  
暨會計師查核報告

億而得微電子股份有限公司

財務報告暨會計師查核報告

民國 111 及 110 年度

地址：新竹縣竹北市台元街28號7樓之2

電話：(03)552-6035

## § 目 錄 §

項	目 頁	次	財 務 報 告 附 註 編 號
一、封 面	1		-
二、目 錄	2		-
三、會計師查核報告	3~6		
四、資產負債表	7		-
五、綜合損益表	8		-
六、權益變動表	9		-
七、現金流量表	10		-
八、財務報告附註			
(一) 公司沿革	11		一
(二) 通過財務報告之日期及程序	11		二
(三) 新發布及修訂準則及解釋之適用	11~12		三
(四) 重大會計政策之彙總說明	12~20		四
(五) 重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	20		五
(六) 重要會計項目之說明	20~37		六~二十
(七) 關係人交易	37		二一
(八) 質抵押之資產	-		-
(九) 重大或有負債及未認列之合約承諾	-		-
(十) 重大之災害損失	-		-
(十一) 重大之期後事項	-		-
(十二) 具重大影響之外幣資產及負債資訊	37		二二
(十三) 附註揭露事項			
1. 重大交易事項相關資訊	38		二三
2. 轉投資事業相關資訊	-		-
3. 大陸投資資訊	-		-
(十四) 部門資訊	38~39		二四
八、重要會計項目明細表	40~47		-

### 會計師查核報告

億而得微電子股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

億而得微電子股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達億而得微電子股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報告規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與億而得微電子股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對億而得微電子股份有限公司民國 111 年度財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對億而得微電子股份有限公司民國 111 年度財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

#### 銷貨收入之認列

億而得微電子股份有限公司之營業收入主要為技術服務收入及權利金收入，於民國 111 年度分別為 58,821 仟元及 170,599 仟元，與收入認列相關之會計政策及資訊請詳財務報告附註四及十五。本會計師評估億而得微電子股份有限公司本年度技術服務收入中新增之客戶有收入認列真實性之風險，因此本會計師將其列為本年度之關鍵查核事項，並對該等客戶因應上述風險，執行查核程序如下：

1. 瞭解億而得微電子股份有限公司收入流程之主要內部控制設計，並執行相關控制測試。
2. 選樣抽核營業收入相關憑證與收款情形，以驗證銷貨之真實發生，且核對銷貨對象與收款對象是否存有異常情形。

#### **管理階層與治理單位對財務報告之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報告，且維持與財務報告編製有關之必要內部控制，以確保財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報告時，管理階層之責任亦包括評估億而得微電子股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算億而得微電子股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

億而得微電子股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核財務報告之責任**

本會計師查核財務報告之目的，係對財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。



本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對億而得微電子股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使億而得微電子股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報告使用者注意財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致億而得微電子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報告是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對億而得微電子股份有限公司民國 111 年度財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 心 彤

林 心 彤



會計師 蔡 美 貞

蔡 美 貞



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1110348898 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 8 日

億而得微電子股份有限公司

資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註四、六及二十)	\$ 334,922	81	\$ 277,731	79	2206	應付員工及董事酬勞(附註十六)	\$ 15,499	4	\$ 5,292	2
1170	應收帳款(附註四、七及二十)	24,304	6	19,758	6	2230	本期所得稅負債(附註四及十七)	1,811	-	824	-
1200	其他應收款(附註四、七及二十)	58	-	-	-	2280	租賃負債—流動(附註四、九及二十)	1,354	-	5,175	2
1470	預付款項及其他流動資產(附註十一)	1,245	-	2,843	1	2300	其他流動負債(附註十二及二十)	39,266	10	28,856	8
11XX	流動資產總計	360,529	87	300,332	86	21XX	流動負債總計	57,930	14	40,147	12
	非流動資產						非流動負債				
1600	不動產、廠房及設備(附註四及八)	14,118	4	17,689	5	2580	租賃負債—非流動(附註四、九及二十)	-	-	1,302	-
1755	使用權資產(附註四及九)	1,671	-	6,721	2	2640	淨確定福利負債(附註四及十三)	-	-	392	-
1780	其他無形資產(附註四及十)	31,980	8	21,886	6	2670	其他非流動負債(附註十二及二十)	7,989	2	6,712	2
1920	存出保證金(附註四及二十)	4,518	1	1,439	1	25XX	非流動負債總計	7,989	2	8,406	2
1975	淨確定福利資產(附註四及十三)	1,368	-	-	-	2XXX	負債總計	65,919	16	48,553	14
1990	其他非流動資產(附註十一)	-	-	1,000	-		權益(附註十四)				
15XX	非流動資產總計	53,655	13	48,735	14	3110	普通股股本	268,100	65	268,100	77
						3310	法定盈餘公積	3,241	1	-	-
						3350	未分配盈餘	76,924	18	32,414	9
						3XXX	權益總計	348,265	84	300,514	86
1XXX	資 產 總 計	\$ 414,184	100	\$ 349,067	100		負 債 及 權 益 總 計	\$ 414,184	100	\$ 349,067	100

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：黃文謙



經理人：黃文謙



會計主管：賴盈君



億而得微電子股份有限公司

綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及十五）	\$ 229,420	100	\$ 168,192	100
5000	營業成本（附註十六）	1,720	1	1,323	1
5900	營業毛利	227,700	99	166,869	99
	營業費用（附註十六）				
6100	推銷費用	11,538	5	12,031	7
6200	管理費用	29,486	13	21,904	13
6300	研究發展費用	107,830	47	89,596	53
6000	營業費用合計	148,854	65	123,531	73
6900	營業淨利	78,846	34	43,338	26
	營業外收入及支出（附註四及十六）				
7100	利息收入	1,539	1	686	-
7010	其他收入	10	-	29	-
7020	其他利益及損失	1,082	-	( 640)	-
7050	財務成本	( 106)	-	( 206)	-
7000	營業外收入及支出合計	2,525	1	( 131)	-
7900	稅前淨利	81,371	35	43,207	26
7950	所得稅費用（附註四及十七）	8,407	4	4,632	3
8200	本年度淨利	72,964	31	38,575	23
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數（附註四及十三）	1,597	1	( 452)	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 74,561	32	\$ 38,123	23
	每股盈餘（附註十八）				
9750	基 本	\$ 2.72		\$ 1.44	
9850	稀 釋	\$ 2.71		\$ 1.44	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：黃文謙



經理人：黃文謙



會計主管：賴盈君



億而得微電子股份有限公司

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼		普 通 股 股 本	未 分 配 盈 餘	權 益 總 計
		股 數 ( 仟 股 ) 金 額	法 定 盈 餘 公 積 未 分 配 盈 餘	
A1	110 年 1 月 1 日 餘 額	26,810 \$ 268,100	\$ - (\$ 5,709)	\$ 262,391
D1	110 年 度 淨 利	- -	- 38,575	38,575
D3	110 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	- -	- ( 452)	( 452)
D5	110 年 度 綜 合 損 益 總 額	- -	- 38,123	38,123
Z1	110 年 12 月 31 日 餘 額	26,810 268,100	- 32,414	300,514
	110 年 度 盈 餘 分 配			
B1	法定盈餘公積	- -	3,241 ( 3,241)	-
B5	本公司股東現金股利—每股 1 元	- -	- ( 26,810)	( 26,810)
D1	111 年 度 淨 利	- -	- 72,964	72,964
D3	111 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	- -	- 1,597	1,597
D5	111 年 度 綜 合 損 益 總 額	- -	- 74,561	74,561
Z1	111 年 12 月 31 日 餘 額	26,810 \$ 268,100	\$ 3,241 \$ 76,924	\$ 348,265

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：黃文謙



經理人：黃文謙



會計主管：賴盈君



億而得微電子股份有限公司

現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111 年度	110 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 81,371	\$ 43,207
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	12,887	12,706
A20200	攤銷費用	14,731	7,490
A20900	財務成本	106	206
A21200	利息收入	( 1,539)	( 686)
A24100	外幣兌換淨損(利)	30	( 20)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	( 4,562)	( 11,642)
A31180	其他應收款	( 58)	3
A31240	預付款項及其他流動資產	1,598	( 1,209)
A32230	其他流動負債	10,396	9,123
A32240	淨確定福利負債	( 163)	( 165)
A33000	營運產生之淨現金流入	114,797	59,013
A33100	收取之利息	1,539	686
A33300	支付之利息	( 106)	( 206)
A33500	支付之所得稅	( 7,420)	( 3,808)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>108,810</u>	<u>55,685</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 2,516)	( 2,182)
B03700	存出保證金增加	( 3,084)	( 233)
B03800	存出保證金減少	5	6
B04500	購置其他無形資產	( 12,480)	( 11,186)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 18,075)</u>	<u>( 13,595)</u>
	籌資活動之現金流量		
C04020	租賃負債本金償還	( 5,330)	( 4,466)
C04500	支付現金股利	( 26,810)	-
CCCC	籌資活動之現金流出	<u>( 32,140)</u>	<u>( 4,466)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( 1,404)	49
EEEE	現金及約當現金淨增加數	57,191	37,673
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>277,731</u>	<u>240,058</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 334,922</u>	<u>\$ 277,731</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：黃文謙



經理人：黃文謙



會計主管：賴盈君



億而得微電子股份有限公司

財務報告附註

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(除另註明外，金額以新台幣仟元為單位)

一、公司沿革

億而得微電子股份有限公司(以下稱「本公司」)於 90 年 9 月 4 日經經濟部核准設立。主要從事於電子產品設計、研發、製造、批發及零售、國際貿易及智慧財產權等業務。

本公司自 103 年 10 月 23 日起經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，於該中心之興櫃股票櫃檯買賣。

本財務報告係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。

二、通過財務報告之日期及程序

本財務報告於 112 年 3 月 8 日經董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一) 首次適用金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)認可並發布生效之國際財務報導準則(IFRS)、國際會計準則(IAS)、解釋(IFRIC)及解釋公告(SIC)(以下稱「IFRSs」)

適用修正後之金管會認可並發布生效之 IFRSs 將不致造成本公司會計政策之重大變動。

(二) 112 年適用之金管會認可之 IFRSs

<u>新發布 / 修正 / 修訂準則及解釋</u>	<u>國際會計準則理事會 (IASB) 發布之生效日</u>
IAS 1 之修正「會計政策之揭露」	2023 年 1 月 1 日(註 1)
IAS 8 之修正「會計估計值之定義」	2023 年 1 月 1 日(註 2)
IAS 12 之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」	2023 年 1 月 1 日(註 3)

註 1：於 2023 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間適用此項修正。

註 2：於 2023 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間所發生之會計估計值變動及會計政策變動適用此項修正。

註 3：除於 2022 年 1 月 1 日就租賃及除役義務之暫時性差異認列遞延所得稅外，該修正係適用於 2022 年 1 月 1 日以後所發生之交易。

截至本財務報告通過發布日止，本公司評估上述準則、解釋之修正將不致對財務狀況與財務績效造成重大影響。

(三) IASB 已發布但尚未經金管會認可並發布生效之 IFRSs

<u>新發布 / 修正 / 修訂準則及解釋</u>	<u>IASB 發布之生效日(註 1)</u>
IFRS 10 及 IAS 28 之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未 定
IFRS 16 之修正「售後租回中之租賃負債」	2024 年 1 月 1 日 (註 2)
IFRS 17「保險合約」	2023 年 1 月 1 日
IFRS 17 之修正	2023 年 1 月 1 日
IFRS 17 之修正「初次適用 IFRS 17 及 IFRS 9—比較資訊」	2023 年 1 月 1 日
IAS 1 之修正「負債分類為流動或非流動」	2024 年 1 月 1 日
IAS 1 之修正「具合約條款之非流動負債」	2024 年 1 月 1 日

註 1：除另註明外，上述新發布 / 修正 / 修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度報導期間生效。

註 2：賣方兼承租人應對初次適用 IFRS 16 日後簽訂之售後租回交易追溯適用 IFRS 16 之修正。

截至本財務報告通過發布日止，本公司仍持續評估上述準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之 IFRSs 編製。

(二) 編製基礎

除按公允價值衡量之金融工具及按確定福利義務現值減除計畫負債公允價值認列之淨確定福利負債外，本財務報告係依歷史成本基礎編製。



公允價值衡量依照相關輸入值之可觀察程度及重要性分為第 1 等級至第 3 等級：

1. 第 1 等級輸入值：係指於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價（未經調整）。
2. 第 2 等級輸入值：係指除第 1 等級之報價外，資產或負債直接（亦即價格）或間接（亦即由價格推導而得）之可觀察輸入值。
3. 第 3 等級輸入值：係指資產或負債之不可觀察之輸入值。

(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括：

1. 主要為交易目的而持有之資產；
2. 預期於資產負債表日後 12 個月內實現之資產；及
3. 現金及約當現金（但不包括於資產負債表日後逾 12 個月用以交換或清償負債而受到限制者）。

流動負債包括：

1. 主要為交易目的而持有之負債；
2. 於資產負債表日後 12 個月內到期清償之負債；以及
3. 不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少 12 個月之負債。

非屬上述流動資產或流動負債者，係分類為非流動資產或非流動負債。

(四) 外 幣

本公司編製財務報告時，以本公司功能性貨幣以外之貨幣（外幣）交易者，依交易日匯率換算為功能性貨幣記錄。

外幣貨幣性項目於每一資產負債表日以收盤匯率換算，因交割貨幣性項目或換算貨幣性項目產生之兌換差額，於發生當年度認列於損益。

以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算，不再重新換算。

#### (五) 不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備係以成本認列，後續以成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量。

不動產、廠房及設備於耐用年限內按直線基礎，對每一重大部分單獨提列折舊。本公司至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及折舊方法進行檢視，並推延適用會計估計變動之影響。

不動產、廠房及設備除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於損益。

#### (六) 無形資產

##### 1. 單獨取得

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量，後續係以成本減除累計攤銷及累計減損損失後之金額衡量。無形資產於耐用年限內按直線基礎進行攤銷，本公司至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及攤銷方法進行檢視，並推延適用會計估計變動之影響。

##### 2. 內部產生－研究及發展支出

研究之支出於發生時認列為費用。

##### 3. 除 列

無形資產除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於當年度損益。

#### (七) 不動產、廠房及設備、使用權資產及無形資產之減損

本公司於每一資產負債表日評估是否有任何跡象顯示不動產、廠房及設備、使用權資產及無形資產可能已減損。若有任一減損跡象存在，則估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額，本公司估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。

可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值之較高者。個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於其帳面金額時，將該資產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額，減損損失係認列於損益。

當減損損失於後續迴轉時，該資產或現金產生單位之帳面金額調增至修訂後之可回收金額，惟增加後之帳面金額以不超過該資產或現金產生單位若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額（減除攤銷或折舊）。減損損失之迴轉係認列於損益。

## (八) 金融工具

金融資產與金融負債於本公司成為該工具合約條款之一方時認列於資產負債表。

原始認列金融資產與金融負債時，若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者，係按公允價值加計直接可歸屬於取得或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或發行透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債之交易成本，則立即認列為損益。

### 1. 金融資產

金融資產之慣例交易係採交易日會計認列及除列。

#### (1) 衡量種類

本公司所持有之金融資產種類為透過損益按公允價值衡量之金融資產及按攤銷後成本衡量之金融資產。

##### A. 透過損益按公允價值衡量之金融資產

透過損益按公允價值衡量之金融資產包括強制透過損益按公允價值衡量及指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產。強制透過損益按公允價值衡量之金融資產包括未指定透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資。

透過損益按公允價值衡量之金融資產係按公允價值衡量，其再衡量產生之利益或損失（包含該金融資產所產生之任何股利或利息）係認列於損益。

## B. 按攤銷後成本衡量之金融資產

本公司投資金融資產若同時符合下列兩條件，則分類為按攤銷後成本衡量之金融資產：

- a. 係於某經營模式下持有，該模式之目的係持有金融資產以收取合約現金流量；及
- b. 合約條款產生特定日期之現金流量，該等現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

按攤銷後成本衡量之金融資產（包括現金及約當現金、按攤銷後成本衡量之應收帳款、其他應收款及存出保證金）於原始認列後，係以有效利息法決定之總帳面金額減除任何減損損失之攤銷後成本衡量，任何外幣兌換損益則認列於損益。

利息收入係以有效利率乘以金融資產總帳面金額計算。

約當現金包括自取得日起 3 個月內、高度流動性、可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之定期存款，係用於滿足短期現金承諾。

### (2) 金融資產之減損

本公司於每一資產負債表日按預期信用損失評估按攤銷後成本衡量之金融資產（含應收帳款）之減損損失。

應收帳款均按存續期間預期信用損失認列備抵損失。

預期信用損失係以發生違約之風險作為權重之加權平均信用損失。存續期間預期信用損失代表金融工具於預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。

所有金融資產之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額。

### (3) 金融資產之除列

本公司僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

按攤銷後成本衡量之金融資產整體除列時，其帳面金額與所收取對價間之差額係認列於損益。

## 2. 權益工具

本公司發行之權益工具係以取得之價款扣除直接發行成本後之金額認列。

再取回本公司本身之權益工具係於權益項下認列與減除。購買、出售、發行或註銷本公司本身之權益工具不認列於損益。

## 3. 金融負債

### (1) 後續衡量

本公司所有金融負債係以有效利息法按攤銷後成本衡量。

### (2) 金融負債之除列

除列金融負債時，其帳面金額與所支付對價（包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債）間之差額認列為損益。

## (九) 收入認列

本公司於客戶合約辨認履約義務後，將交易價格分攤至各履約義務，並於滿足各履約義務時認列收入。

移轉商品或勞務與收取對價之時間間隔在 1 年以內之合約，其重大財務組成部分不予調整交易價格。

### 1. 技術服務收入

依協議所提供之技術服務，並滿足履約義務時認列收入。

### 2. 權利金收入

授權不更新或無技術支援之情況下仍可維持運作之智慧財產所收取之收入即為權利金收入，客戶使用該智慧財產於晶圓代工廠量產時，依照生產量、銷售額或其他衡量方式決定權利金價款並依協議條款認列收入。

## (十) 租賃

本公司於合約成立日評估合約是否係屬（或包含）租賃。

## 本公司為承租人

除適用認列豁免之低價值標的資產租賃及短期租賃之租賃給付係按直線基礎於租賃期間內認列為費用，其他租賃皆於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債。

使用權資產原始按成本（包含租賃負債之原始衡量金額、租賃開始日前支付之租賃給付減除收取之租賃誘因、原始直接成本及復原標的資產之估計成本）衡量，後續按成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量，並調整租賃負債之再衡量數。使用權資產係單獨表達於資產負債表。

使用權資產採直線基礎自租賃開始日起至耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者提列折舊。

租賃負債原始按租賃給付（包含固定給付）之現值衡量。若租賃隱含利率容易確定，租賃給付使用該利率折現。若該利率並非容易確定，則使用承租人增額借款利率。

後續，租賃負債採有效利息法按攤銷後成本基礎衡量，且利息費用係於租賃期間分攤。若租賃期間變動導致未來租賃給付有變動，本公司再衡量租賃負債，並相對調整使用權資產，惟若使用權資產之帳面金額已減至零，則剩餘之再衡量金額認列於損益中。租賃負債係單獨表達於資產負債表。

### (十一) 員工福利

#### 1. 短期員工福利

短期員工福利相關負債係以換取員工服務而預期支付之非折現金額衡量。

#### 2. 退職後福利

確定提撥退休計畫之退休金係於員工提供服務期間將應提撥之退休金數額認列為費用。

確定福利退休計畫之確定福利成本（含服務成本、淨利息及再衡量數）係採預計單位福利法精算。當年度服務成本及淨確定福利負債淨利息於發生時認列為員工福利費用。再衡量數

(含精算損益及扣除利息後之計畫資產報酬)於發生時認列於其他綜合損益並列入保留盈餘，後續期間不重分類至損益。

淨確定福利負債(資產)係確定福利退休計畫之提撥短絀(剩餘)。淨確定福利資產不得超過從該計畫退還提撥金或可減少未來提撥金之現值。

## (十二) 所得稅

所得稅費用係當年度所得稅及遞延所得稅之總和。

### 1. 當年度所得稅

依中華民國所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵所得稅，係於股東會決議年度認列。

以前年度應付所得稅之調整，列入當年度所得稅。

### 2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。

遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列，而遞延所得稅資產則於很有可能具有課稅所得以供可減除暫時性差異或虧損扣抵所產生之所得稅抵減使用時認列。

遞延所得稅資產之帳面金額於每一資產負債表日予以重新檢視，並針對已不再很有可能具有足夠之課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調減帳面金額。原未認列為遞延所得稅資產者，亦於每一資產負債表日予以重新檢視，並在未來很有可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調增帳面金額。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當年度之稅率衡量，該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映本公司於資產負債表日預期回收或清償其資產及負債帳面金額之方式所產生之租稅後果。

### 3. 當年度及遞延所得稅

當年度及遞延所得稅係認列於損益，惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當年度及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。

## 五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本公司於採用會計政策時，對於不易自其他來源取得相關資訊者，管理階層必須基於歷史經驗及其他攸關之因素作出相關之判斷、估計及假設。實際結果可能與估計有所不同。

本公司將新型冠狀病毒肺炎疫情近期之發展及對經濟環境可能之影響，納入重大會計估計之考量，管理階層將持續檢視估計與基本假設。若估計之修正僅影響當期，則於修正當期認列；若會計估計之修正同時影響當期及未來期間，則於修正當期及未來期間認列。

## 六、現金及約當現金

	111年12月31日	110年12月31日
庫存現金	\$ 65	\$ 49
銀行活期存款	101,257	74,082
約當現金		
原始到期日在3個月以內之		
銀行定期存款	<u>233,600</u>	<u>203,600</u>
	<u>\$334,922</u>	<u>\$277,731</u>

銀行存款於資產負債表日之利率區間如下：

	111年12月31日	110年12月31日
銀行存款	0.05%~1.05%	0.010%~0.405%

## 七、應收帳款及其他應收款

	111年12月31日	110年12月31日
<u>應收帳款</u>		
按攤銷後成本衡量		
總帳面金額	\$ 24,304	\$ 19,758
減：備抵損失	-	-
	<u>\$ 24,304</u>	<u>\$ 19,758</u>
<u>其他應收款</u>		
應收退稅款	<u>\$ 58</u>	<u>\$ -</u>



本公司對勞務收入之平均授信期間為 30 天至 60 天，對應收帳款不予計息。為減輕信用風險，本公司已訂定授信及應收帳款管理辦法以確保逾期應收款項之回收已採取適當行動。此外，本公司於資產負債表日會逐一複核應收款項之可回收金額以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。據此，本公司管理階層認為本公司之信用風險已顯著減少。

本公司按存續期間預期信用損失認列應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況、產業經濟情勢，並同時考量產業展望。因本公司之信用損失歷史經驗顯示，不同客戶群之損失型態並無顯著差異，因此準備矩陣未進一步區分客戶群，僅以應收帳款逾期天數訂定預期信用損失率。

若有證據顯示交易對方面臨嚴重財務困難且本公司無法合理預期可回收金額，本公司直接沖銷相關應收帳款，惟仍會持續追索活動，因追索回收之金額則認列於損益。

本公司依準備矩陣衡量應收帳款之備抵損失如下：

111 年 12 月 31 日

	未逾期	逾期 1~30 天	逾期 31~60 天	逾期 61~90 天	逾期 超過 90 天	合計
總帳面金額	\$ 21,390	\$ 2,914	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,304
備抵損失 (存續期間 預期信用損失)	-	-	-	-	-	-
攤銷後成本	<u>\$ 21,390</u>	<u>\$ 2,914</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 24,304</u>

110 年 12 月 31 日

	未逾期	逾期 1~30 天	逾期 31~60 天	逾期 61~90 天	逾期 超過 90 天	合計
總帳面金額	\$ 18,122	\$ 1,636	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,758
備抵損失 (存續期間 預期信用損失)	-	-	-	-	-	-
攤銷後成本	<u>\$ 18,122</u>	<u>\$ 1,636</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 19,758</u>

## 八、不動產、廠房及設備

### (一) 自用

	研 發 設 備	租 賃 改 良	生 財 器 具	合 計
<u>成 本</u>				
111年1月1日餘額	\$ 50,574	\$ 119	\$ 6,753	\$ 57,446
增 添	1,389	621	2,049	4,059
處 分	( 214)	-	( 440)	( 654)
111年12月31日餘額	<u>\$ 51,749</u>	<u>\$ 740</u>	<u>\$ 8,362</u>	<u>\$ 60,851</u>
<u>累計折舊</u>				
111年1月1日餘額	\$ 36,371	\$ 80	\$ 3,306	\$ 39,757
折舊費用	6,294	195	1,141	7,630
處 分	( 214)	-	( 440)	( 654)
111年12月31日餘額	<u>\$ 42,451</u>	<u>\$ 275</u>	<u>\$ 4,007</u>	<u>\$ 46,733</u>
111年12月31日淨額	<u>\$ 9,298</u>	<u>\$ 465</u>	<u>\$ 4,355</u>	<u>\$ 14,118</u>
<u>成 本</u>				
110年1月1日餘額	\$ 50,457	\$ 119	\$ 5,150	\$ 55,726
增 添	460	-	1,722	2,182
處 分	( 343)	-	( 119)	( 462)
110年12月31日餘額	<u>\$ 50,574</u>	<u>\$ 119</u>	<u>\$ 6,753</u>	<u>\$ 57,446</u>
<u>累計折舊</u>				
110年1月1日餘額	\$ 29,303	\$ 40	\$ 2,692	\$ 32,035
折舊費用	7,411	40	733	8,184
處 分	( 343)	-	( 119)	( 462)
110年12月31日餘額	<u>\$ 36,371</u>	<u>\$ 80</u>	<u>\$ 3,306</u>	<u>\$ 39,757</u>
110年12月31日淨額	<u>\$ 14,203</u>	<u>\$ 39</u>	<u>\$ 3,447</u>	<u>\$ 17,689</u>

折舊費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

研發設備	3~5年
租賃改良	3年
生財器具	5年

## 九、租賃協議

### (一) 使用權資產

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
使用權資產帳面金額		
建築物	<u>\$ 1,671</u>	<u>\$ 6,721</u>

	111年度	110年度
使用權資產之添增	<u>\$ 207</u>	<u>\$ 1,210</u>
使用權資產之折舊費用	<u>\$ 5,257</u>	<u>\$ 4,522</u>

(二) 租賃負債

	111年12月31日	110年12月31日
租賃負債帳面金額		
流動	<u>\$ 1,354</u>	<u>\$ 5,175</u>
非流動	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,302</u>

租賃負債之折現率區間如下：

	111年12月31日	110年12月31日
建築物	2.37%~2.62%	2.37%~2.62%

(三) 重要承租活動及條款

本公司承租建築物做為辦公室及停車位使用，租賃期間 3 年。於租賃期間終止時，本公司對所租賃之建築物並無優惠承購權，並約定未經出租人同意，本公司不得將租賃標的之全部或一部轉租或轉讓。

(四) 其他租賃資訊

	111年度	110年度
短期租賃費用	<u>\$ 240</u>	<u>\$ 148</u>
租賃之現金流出總額	<u>\$ 5,676</u>	<u>\$ 4,820</u>

十、其他無形資產

	<u>電 腦 軟 體 專 利 權 合 計</u>		
<u>成 本</u>			
111年1月1日餘額	\$ 53,428	\$ 2,857	\$ 56,285
增 添	24,825	-	24,825
處 分	( 13,119)	-	( 13,119)
111年12月31日餘額	<u>\$ 65,134</u>	<u>\$ 2,857</u>	<u>\$ 67,991</u>

(接次頁)

(承前頁)

	電 腦 軟 體	專 利 權	合 計
<u>累計攤銷</u>			
111年1月1日餘額	\$ 32,828	\$ 1,571	\$ 34,399
攤銷費用	14,160	571	14,731
處 分	( <u>13,119</u> )	<u>-</u>	( <u>13,119</u> )
111年12月31日餘額	<u>\$ 33,869</u>	<u>\$ 2,142</u>	<u>\$ 36,011</u>
111年12月31日淨額	<u>\$ 31,265</u>	<u>\$ 715</u>	<u>\$ 31,980</u>
<u>成 本</u>			
110年1月1日餘額	\$ 33,185	\$ 2,857	\$ 36,042
增 添	<u>20,243</u>	<u>-</u>	<u>20,243</u>
110年12月31日餘額	<u>\$ 53,428</u>	<u>\$ 2,857</u>	<u>\$ 56,285</u>
<u>累計攤銷</u>			
110年1月1日餘額	\$ 25,909	\$ 1,000	\$ 26,909
攤銷費用	<u>6,919</u>	<u>571</u>	<u>7,490</u>
110年12月31日餘額	<u>\$ 32,828</u>	<u>\$ 1,571</u>	<u>\$ 34,399</u>
110年12月31日淨額	<u>\$ 20,600</u>	<u>\$ 1,286</u>	<u>\$ 21,886</u>

攤銷費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

電腦軟體	3年
專利權	5年

#### 十一、其他資產

	111年12月31日	110年12月31日
<u>流 動</u>		
預付測試材料費	\$ 587	\$ 2,302
預付軟體費	285	83
預付保險費	190	166
留抵稅額	-	156
其 他	<u>183</u>	<u>136</u>
	<u>\$ 1,245</u>	<u>\$ 2,843</u>
<u>非 流 動</u>		
預付專利費	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,000</u>

## 十二、其他負債

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
<u>流動</u>		
應付軟體費	\$ 15,390	\$ 6,712
應付薪資及獎金	10,814	9,927
未休假獎金	4,828	4,542
應付保險費	1,170	1,108
應付技術服務費	1,730	964
應付勞務費	1,450	1,496
其他	<u>3,884</u>	<u>4,107</u>
	<u>\$ 39,266</u>	<u>\$ 28,856</u>
<u>非流動</u>		
應付軟體費	<u>\$ 7,989</u>	<u>\$ 6,712</u>

## 十三、退職後福利計畫

### (一) 確定提撥計畫

本公司所適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，依員工每月薪資 6% 提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。

### (二) 確定福利計畫

本公司依我國「勞動基準法」辦理之退休金制度係屬政府管理之確定福利退休計畫。員工退休金之支付，係根據服務年資及核准退休日前 6 個月平均工資計算。本公司按員工每月薪資總額 2% 提撥退休金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶。年度終了前，若估算專戶餘額不足給付次一年度內預估達到退休條件之勞工，次年度 3 月底前將一次提撥其差額。該專戶係委託勞動部勞動基金運用局管理，本公司並無影響投資管理策略之權利。

列入資產負債表之確定福利計畫金額列示如下：

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
確定福利義務現值	\$ 1,150	\$ 3,327
計畫資產公允價值	( <u>2,518</u> )	( <u>2,935</u> )
淨確定福利(資產)負債	<u>( \$ 1,368 )</u>	<u>\$ 392</u>

淨確定福利（資產）負債變動如下：

	確 定 福 利 義 務 現 值	計 畫 資 產 公 允 價 值	淨 確 定 福 利 ( 資 產 ) 負 債
110年1月1日	\$ 2,827	(\$ 2,722)	\$ 105
利息費用（收入）	10	( 10)	-
認列於損益	10	( 10)	-
再衡量數			
計畫資產報酬（除 包含於淨利息之 金額外）	-	( 38)	( 38)
精算損失—人口統 計假設變動	176	-	176
精算利益—財務假 設變動	( 119)	-	( 119)
精算損失—經驗調 整	433	-	433
認列於其他綜合損益	490	( 38)	452
雇主提撥	-	( 165)	( 165)
110年12月31日	3,327	( 2,935)	392
利息費用（收入）	22	( 20)	2
認列於損益	22	( 20)	2
再衡量數			
計畫資產報酬（除 包含於淨利息之 金額外）	-	( 219)	( 219)
精算利益—財務假 設變動	( 52)	-	( 52)
精算利益—經驗調 整	( 1,326)	-	( 1,326)
認列於其他綜合損益	( 1,378)	( 219)	( 1,597)
雇主提撥	-	( 165)	( 165)
福利支付	( 821)	821	-
111年12月31日	\$ 1,150	(\$ 2,518)	(\$ 1,368)

本公司因「勞動基準法」之退休金制度暴露於下列風險：

1. 投資風險：勞動部勞動基金運用局透過自行運用及委託經營方式，將勞工退休基金分別投資於國內（外）權益證券與債務證券及銀行存款等標的，惟本公司之計畫資產得分配金額係以不低於當地銀行2年定期存款利率計算而得之收益。

2. 利率風險：政府公債之利率下降將使確定福利義務現值增加，惟計畫資產之債務投資報酬亦會隨之增加，兩者對淨確定福利負債之影響具有部分抵銷之效果。
3. 薪資風險：確定福利義務現值之計算係參考計畫成員之未來薪資。因此計畫成員薪資之增加將使確定福利義務現值增加。

本公司之確定福利義務現值係由合格精算師進行精算，衡量日之重大假設如下：

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
折現率	1.40%	0.75%
薪資預期增加率	3.50%	3.50%

若重大精算假設分別發生合理可能之變動，在所有其他假設維持不變之情況下，將使確定福利義務現值增加（減少）之金額如下：

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
折現率		
增加 0.25%	(\$ 21)	(\$ 76)
減少 0.25%	<u>\$ 21</u>	<u>\$ 78</u>
薪資預期增加率		
增加 0.25%	<u>\$ 20</u>	<u>\$ 74</u>
減少 0.25%	(\$ 20)	(\$ 72)

由於精算假設可能彼此相關，僅單一假設變動之可能性不大，故上述敏感度分析可能無法反映確定福利義務現值實際變動情形。

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
預期 1 年內提撥金額	<u>\$ 165</u>	<u>\$ 165</u>
確定福利義務平均到期期間	9 年	10 年

#### 十四、權益

##### (一) 普通股股本

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
額定股數（仟股）	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>
額定股本	<u>\$300,000</u>	<u>\$300,000</u>
已發行且已收足股款之股數 （仟股）	<u>26,810</u>	<u>26,810</u>
已發行股本	<u>\$268,100</u>	<u>\$268,100</u>

## (二) 保留盈餘及股利政策

依本公司章程之盈餘分派政策規定，年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補以往虧損（包括調整未分配盈餘金額），次提列 10% 為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣後盈餘，連同期初未分配盈餘（包括調整未分配盈餘金額），由董事會擬具分配案，提請股東會決議分派股東股息紅利。本公司章程規定之員工及董事酬勞分派政策，參閱附註十六(七)員工酬勞及董事酬勞。

授權董事會於可供分配盈餘 0% 至 100% 之額度範圍內，視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分配案，提報股東會。每年發放現金股利之比例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數的 10%。

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時，法定盈餘公積超過實收股本總額 25% 之部分除得撥充股本外，尚得以現金分配。

本公司於 111 年 6 月 23 日及 110 年 8 月 25 日舉行股東常會，分別決議通過 110 年度盈餘分配案及 109 年度盈虧撥補案，110 年度盈餘分配案及每股股利如下：

	110 年度
法定盈餘公積	<u>\$ 3,241</u>
現金股利	<u>\$ 26,810</u>
每股現金股利（元）	\$ 1.00

本公司 112 年 3 月 8 日董事會擬議 111 年度盈餘分配案及每股股利如下：

	111 年度
法定盈餘公積	<u>\$ 7,456</u>
現金股利	<u>\$ 67,025</u>
每股現金股利（元）	\$ 2.50



有關 111 年度之盈餘分配案尚待預計於 112 年 6 月 6 日召開之股東常會決議。

## 十五、營業收入

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
客戶合約收入		
技術服務收入	\$ 58,821	\$ 57,429
權利金收入	<u>170,599</u>	<u>110,763</u>
	<u>\$229,420</u>	<u>\$168,192</u>

### (一) 客戶合約之說明

#### 1. 技術服務收入

技術服務收入係提供客戶積體電路矽智財設計服務，於提供客戶服務或積體電路矽智財後認列收入。

#### 2. 權利金收入

權利金收入係本公司將標準化積體電路矽智財授權予客戶，於客戶使用該授權積體電路矽智財量產後，依據合約收取權利金。

### (二) 合約餘額

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>	<u>110年1月1日</u>
應收帳款（附註七）	<u>\$ 24,304</u>	<u>\$ 19,758</u>	<u>\$ 8,145</u>

### (三) 客戶合約收入之細分

<u>主 要 地 區 市 場</u>	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
中國大陸（含香港）	\$ 84,992	\$ 45,612
台 灣	76,031	61,962
新 加 坡	43,316	31,438
韓 國	21,957	19,746
美 國	2,645	7,265
其 他	<u>479</u>	<u>2,169</u>
	<u>\$229,420</u>	<u>\$168,192</u>

## 十六、淨 利

### (一) 利息收入

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
銀行存款	\$ 1,511	\$ 677
其 他	<u>28</u>	<u>9</u>
	<u>\$ 1,539</u>	<u>\$ 686</u>

(二) 其他收入

	111年度	110年度
其他	<u>\$ 10</u>	<u>\$ 29</u>

(三) 其他利益及損失

	111年度	110年度
淨外幣兌換利益(損失)	<u>\$ 1,082</u>	<u>(\$ 640)</u>

(四) 財務成本

	111年度	110年度
租賃負債之利息	<u>\$ 106</u>	<u>\$ 206</u>

(五) 折舊及攤銷

	111年度	110年度
折舊費用依功能別彙總 營業費用	<u>\$ 12,887</u>	<u>\$ 12,706</u>
攤銷費用依功能別彙總 營業費用	<u>\$ 14,731</u>	<u>\$ 7,490</u>

(六) 員工福利費用

	111年度	110年度
短期員工福利	<u>\$ 96,841</u>	<u>\$ 82,100</u>
退職後福利		
確定提撥計畫	3,436	3,245
確定福利計畫(附註十 三)	<u>2</u>	<u>-</u>
員工福利費用合計	<u>\$100,279</u>	<u>\$ 85,345</u>
依功能別彙總		
營業成本	\$ 624	\$ 393
營業費用	<u>99,655</u>	<u>84,952</u>
	<u>\$100,279</u>	<u>\$ 85,345</u>

(七) 員工酬勞及董事酬勞

本公司依章程規定係按當年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前利益分別以 5%~15% 及不高於 5% 提撥員工酬勞及董事酬勞。111 及 110 年度員工酬勞及董事酬勞分別於 112 年 3 月 8 日及 111 年 3 月 31 日經董事會決議如下：

估列比例

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
員工酬勞	12%	10%
董事酬勞	4%	2.5%

金 額

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
員工酬勞	\$ 11,624	\$ 4,234
董事酬勞	3,875	1,058

年度財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

110 年度員工酬勞及董事酬勞之實際配發金額與 110 年度財務報告之認列金額並無差異。

有關本公司董事會決議之員工酬勞及董事酬勞資訊，請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

十七、所得稅

(一) 認列於損益之所得稅

所得稅費用之主要組成項目如下：

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
當期所得稅		
本年度產生者	<u>\$ 8,407</u>	<u>\$ 4,632</u>
認列於損益之所得稅費用	<u>\$ 8,407</u>	<u>\$ 4,632</u>

會計所得與所得稅費用之調節如下：

	111年度	110年度
稅前淨利	<u>\$ 81,371</u>	<u>\$ 43,207</u>
稅前淨利按法定稅率計算之		
所得稅費用	\$ 16,274	\$ 8,641
暫時性差異之產生及迴轉	572	( 8)
國外來源所得可扣抵稅額	( 8,331)	-
使用未認列之虧損扣抵／可		
減除暫時性差異	( 8,515)	( 8,633)
國外所得稅	<u>8,407</u>	<u>4,632</u>
認列於損益之所得稅費用	<u>\$ 8,407</u>	<u>\$ 4,632</u>

(二) 未於資產負債表中認列遞延所得稅資產之可減除暫時性差異及未使用虧損扣抵金額

	111年12月31日	110年12月31日
虧損扣抵		
111年度到期	\$ -	\$ 21,954
113年度到期	19,308	33,108
114年度到期	<u>13,079</u>	<u>13,079</u>
	<u>\$ 32,387</u>	<u>\$ 68,141</u>
可減除暫時性差異	<u>\$ 28,402</u>	<u>\$ 25,543</u>

(三) 所得稅核定情形

本公司截至 109 年度止之營利事業所得稅申報案件，業經稅捐稽徵機關核定。

#### 十八、每股盈餘

單位：每股元

	111年度	110年度
基本每股盈餘	<u>\$ 2.72</u>	<u>\$ 1.44</u>
稀釋每股盈餘	<u>\$ 2.71</u>	<u>\$ 1.44</u>

用以計算每股盈餘之本年度淨利及普通股加權平均股數如下：

#### 本年度淨利

	111年度	110年度
本年度淨利	<u>\$ 72,964</u>	<u>\$ 38,575</u>
用以計算基本及稀釋每股盈餘之淨利	<u>\$ 72,964</u>	<u>\$ 38,575</u>

股 數	單位：仟股	
	111年度	110年度
用以計算基本每股盈餘之普通股加權平均股數	26,810	26,810
具稀釋作用潛在普通股之影響：		
員工酬勞	150	31
用以計算稀釋每股盈餘之普通股加權平均股數	26,960	26,841

若本公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞，則計算稀釋每股盈餘時，假設員工酬勞將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。於次年度決議員工酬勞發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

#### 十九、資本風險管理

本公司進行資本管理以確保能夠於繼續經營之前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，以使股東報酬極大化。本公司之整體策略並無變化。

本公司資本結構係由權益（即股本及保留盈餘）組成。

本公司不須遵守其他外部資本規定。

本公司主要管理階層定期重新檢視本公司資本結構，其檢視內容包括考量各類資本之成本及相關風險。本公司依據主要管理階層之建議，將藉由支付股利、發行新股、買回股份及發行新債或償付舊債等方式平衡其整體資本結構。

#### 二十、金融工具

##### (一) 公允價值之資訊－非按公允價值衡量之金融工具

本公司管理階層認為非按公允價值衡量之金融資產及金融負債之帳面金額趨近其公允價值。

## (二) 金融工具之種類

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
<u>金融資產</u>		
按攤銷後成本衡量之金融資產 (註1)	\$363,802	\$298,928
<u>金融負債</u>		
按攤銷後成本衡量之金融負債 (註2)	23,624	14,387

註1：餘額係包含現金及約當現金、應收帳款、其他應收款及存出保證金等按攤銷後成本衡量之金融資產。

註2：餘額係其他負債，但不包含應付薪資及獎金、未休假獎金等按攤銷後成本衡量之金融負債。

## (三) 財務風險管理目的與政策

本公司主要金融工具包括權益投資及應收帳款。本公司之財務管理部門係為各業務單位提供服務，統籌協調進入國內與國際金融市場操作，藉由依照風險程度與廣度分析暴險之內部風險報告監督及管理本公司營運有關之財務風險。該等風險包括市場風險（包含匯率風險及利率風險）、信用風險及流動性風險。

### 1. 市場風險

本公司之營運活動使本公司承擔之主要財務風險為外幣匯率變動風險（參閱下述(1)）以及利率變動風險（參閱下述(2)）。

本公司有關金融工具市場風險之暴險及其對該等暴險之管理與衡量方式並無改變。

#### (1) 匯率風險

本公司從事外幣計價之交易，因而使本公司產生匯率變動暴險。

本公司於資產負債表日非功能性貨幣計價之貨幣性資產與貨幣性負債帳面金額，參閱附註二二。

### 敏感度分析

本公司主要受到美元匯率波動之影響。

下表詳細說明當新台幣（功能性貨幣）對各攸關外幣之匯率增加及減少1%時，本公司之敏感度分析。1%係為本公司內部向主要管理階層報告匯率風險時所使用之敏感度比率，亦代表管理階層對外幣匯率之合理可能變動範圍之評估。敏感度分析僅包括流通在外之外幣貨幣性項目，並將其年底之換算以匯率變動1%予以調整。下表之正數係表示當新台幣相對於各相關貨幣貶值1%時，將使稅前淨利增加之金額；當新台幣相對於各相關外幣升值1%時，其對稅前淨利之影響將為同金額之負數。

	美 金 之 影 響	
	111年度	110年度
損 益	\$ 316	\$ 432

本公司於本年度對匯率敏感度下降，主係因美元計價之淨資產減少所致。

### (2) 利率風險

本公司於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下：

	111年12月31日	110年12月31日
具公允價值利率風險		
— 金融資產	\$128,600	\$133,600
— 金融負債	1,354	6,477
具現金流量利率風險		
— 金融資產	206,257	144,082

### 敏感度分析

下列敏感度分析係依非衍生工具於資產負債表日之利率暴險而決定。對於浮動利率資產，其分析方式係假設資產負債表日流通在外之資產金額於報導期間皆流通在外。

若年利率增加 1%，在所有其他變數維持不變之情況下，本公司 111 及 110 年度之稅前淨利將分別增加 2,063 仟元及 1,441 仟元。

本公司於本年度對利率之敏感度上升，主係因變動利率金融資產增加所致。

## 2. 信用風險

信用風險係指交易對方拖欠合約義務而造成本公司財務損失之風險。截至資產負債表日，本公司可能因交易對方未履行義務造成財務損失之最大信用風險暴險主要係來自於資產負債表所認列之金融資產帳面金額。

應收帳款之對象涵蓋眾多客戶，分散於不同產業及地理區域。本公司持續地針對應收帳款客戶之財務狀況進行評估。

除了本公司最大的客戶外，本公司並無對任何單一交易對方或任何一組具相似特性之交易對方有重大的信用暴險。於 111 及 110 年度內，應收帳款總額來自前述客戶之比率分別為 40% 及 46%。

## 3. 流動性風險

本公司係透過管理及維持足夠部位之現金及約當現金以支應營運並減輕現金流量波動之影響。

非衍生金融負債到期分析係依照約定之還款日編製。

### 111 年 12 月 31 日

	要求即付或 短於 1 個月	1 至 3 個月	3 個 月 至 1 年	1 年 以 上	合 計
非衍生金融負債					
無附息負債	\$ 13,953	\$ 4,957	\$ 18,813	\$ 7,989	\$ 45,712
租賃負債	<u>453</u>	<u>906</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,359</u>
	<u>\$ 14,406</u>	<u>\$ 5,863</u>	<u>\$ 18,813</u>	<u>\$ 7,989</u>	<u>\$ 47,071</u>

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	短於 1 年	1 ~ 5 年	5 ~ 10 年	10 ~ 15 年	15 ~ 20 年	20 年 以 上
租賃負債	<u>\$ 1,359</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>



110年12月31日

非衍生金融負債	要求即付或	3個月			合計
	短於1個月	1至3個月	至1年	1年以上	
無附息負債	\$ 14,186	\$ 1,555	\$ 13,115	\$ 6,712	\$ 35,568
租賃負債	<u>453</u>	<u>905</u>	<u>3,921</u>	<u>1,307</u>	<u>6,586</u>
	<u>\$ 14,639</u>	<u>\$ 2,460</u>	<u>\$ 17,036</u>	<u>\$ 8,019</u>	<u>\$ 42,154</u>

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

租賃負債	短於1年	1~5年	5~10年	10~15年	15~20年	20年以上
		<u>\$ 5,279</u>	<u>\$ 1,307</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

二一、關係人交易

主要管理階層薪酬

	111年度	110年度
短期員工福利	<u>\$ 12,254</u>	<u>\$ 9,310</u>

董事及其他主要管理階層之薪酬係由薪酬委員會依照個人績效及市場趨勢決定。

二二、具重大影響之外幣資產及負債資訊

以下資訊係按本公司功能性貨幣以外之外幣彙總表達，所揭露之匯率係指該等外幣換算至功能性貨幣之匯率。具重大影響之外幣資產及負債資訊如下：

單位：各外幣仟元

	111年12月31日		110年12月31日	
	外幣匯率	匯率	外幣匯率	匯率
<u>外幣資產</u>				
<u>貨幣性項目</u>				
美元	<u>\$ 1,813</u>	30.71	<u>\$ 1,561</u>	27.680
<u>外幣負債</u>				
<u>貨幣性項目</u>				
美元	<u>\$ 783</u>	30.71	<u>\$ -</u>	27.680

具重大影響之外幣兌換損益（已實現及未實現）如下：

外幣	111年度		110年度	
	匯率	淨兌換利益	匯率	淨兌換損失
美元	29.805(美元:新台幣)	<u>\$ 1,082</u>	28.009(美元:新台幣)	<u>(\$ 640)</u>

### 二三、附註揭露事項

本公司除下列項目外，並無其他重大交易事項、轉投資事業及大陸投資資訊等應揭露者。

期末持有有價證券情形：

持有之公司	有價證券種類	有價證券名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期				備註
					股數(仟)	帳面金額	持股比例(%)	股權淨值/市價/帳面價值	
本公司	股票	晶準科技股份有限公司	本公司董事長為該公司之董事	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	2,350	\$ -	13	\$ -	註

註：上列有價證券於111年12月底，並無提供擔保、質押借款或其他依約定而受限制者。

### 二四、部門資訊

本公司之營運決策者用以分配資源及評量部門績效係以不同監理環境為基礎，所有符合營運部門定義皆具有相類似之經濟特性，故本公司彙總為單一營運部門報導。另本公司提供給營運決策者複核之部門資訊，其衡量基礎與財務報告相同，故111及110年度應報導之部門收入及營運結果可參照111及110年度之綜合損益表；111年及110年12月31日應報導之部門資產可參照111年及110年12月31日之資產負債表。

(一) 主要產品及勞務之收入：請參閱附註十五。

(二) 地區別資訊：

本公司來自外部客戶之繼續營業單位收入依營運地點區分與非流動資產按資產所在地區分之資訊列示如下：

	來自外部客戶之收入		非流動資產	
	111年度	110年度	111年12月31日	110年12月31日
中國大陸(含香港)	\$ 84,992	\$ 45,612	\$ -	\$ -
台灣	76,031	61,962	47,769	47,296
新加坡	43,316	31,438	-	-
韓國	21,957	19,746	-	-
美國	2,645	7,265	-	-
其他	479	2,169	-	-
	<u>\$ 229,420</u>	<u>\$ 168,192</u>	<u>\$ 47,769</u>	<u>\$ 47,296</u>

非流動資產不包括金融工具、存出保證金及淨確定福利資產。

(三) 主要客戶資訊

來自單一客戶之收入達本公司收入總額之 10% 以上者如下：

客 戶 名 稱	111年度	110年度
甲 客 戶	\$ 43,317	\$ 30,654
乙 客 戶	33,951	25,449
丙 客 戶	23,808	-

## §重要會計項目明細表目錄§

項	目	編 號 / 索 引
資產、負債及權益項目明細表		
現金及約當現金明細表		明細表一
應收帳款明細表		明細表二
其他資產明細表		附註十一
使用權資產成本及使用權資產累計折舊變動明細表		明細表三
不動產、廠房及設備變動明細表		附註八
其他無形資產變動明細表		附註十
租賃負債明細表		明細表四
其他流動負債明細表		附註十二
損益項目明細表		
營業收入明細表		附註十五
營業費用明細表		明細表五
其他收益及費損淨額明細表		附註十六
本期發生之員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表		明細表六

億而得微電子股份有限公司  
現金及約當現金明細表  
民國 111 年 12 月 31 日

明細表一

單位：除另予註明者外  
，係新台幣仟元

項 目	摘 要	金 額
銀行存款		
活期存款		\$ 66,640
外幣存款	美元 1,022 仟元及人民幣 736 仟元 (兌換率為 US\$1 : NT\$30.71 及 CNY\$1 : NT\$4.408)	34,617
定期存款	利率 0.85%~1.03%，112 年 3 月底 前陸續到期	233,600
庫存現金		65
		\$334,922

億而得微電子股份有限公司

應收帳款明細表

民國 111 年 12 月 31 日

明細表二

單位：新台幣仟元

<u>客</u> <u>戶</u> <u>名</u> <u>稱</u>	<u>金</u> <u>額</u>
A 公 司	\$ 9,623
B 公 司	6,234
C 公 司	2,916
D 公 司	2,472
其他（註一）	<u>3,059</u>
合 計	<u>\$ 24,304</u>

註一：各戶餘額皆未超過本科目餘額之 5%。

註二：未有逾期 1 年以上者。

億而得微電子股份有限公司  
 使用權資產成本及使用權資產累計折舊變動明細表  
 民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

明細表三

單位：新台幣仟元

名 稱	房 屋 及 建 築
成 本	
111 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 19,906
增 添	<u>207</u>
111 年 12 月 31 日 餘 額	<u>20,113</u>
累 計 折 舊	
111 年 1 月 1 日 餘 額	13,185
折 舊	<u>5,257</u>
111 年 12 月 31 日 餘 額	<u>18,442</u>
111 年 12 月 31 日 淨 額	<u>\$ 1,671</u>

億而得微電子股份有限公司

租賃負債明細表

民國 111 年 12 月 31 日

明細表四

單位：除另予註明者外  
，係新台幣仟元

名 稱	租 賃 期 間	折 現 率	金 額
建築物	109.04~112.03	2.37%~2.62%	\$ 1,354
減：租賃負債—流動			( <u>1,354</u> )
租賃負債—非流動			<u>\$ -</u>



億而得微電子股份有限公司

營業費用明細表

民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

明細表五

單位：新台幣仟元

項	目	推 銷 費 用	管 理 費 用	研 究 發 展 費 用
薪資費用		\$ 6,850	\$ 20,708	\$ 60,177
折舊費用		1,314	2,493	9,080
攤銷費用		-	204	14,527
技術服務費		-	-	8,419
保險費		574	1,295	4,525
勞務費		-	1,350	74
佣金支出		967	-	-
其他(註)		<u>1,833</u>	<u>3,436</u>	<u>11,028</u>
		<u>\$ 11,538</u>	<u>\$ 29,486</u>	<u>\$ 107,830</u>

註：各項目金額皆未超過各科目金額之 5%。

億而得微電子股份有限公司

本期發生之員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

明細表六

單位：新台幣仟元

	111 年度			110 年度		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	\$ 624	\$ 82,792	\$ 83,416	\$ 393	\$ 71,679	\$ 72,072
員工保險費用	-	6,300	6,300	-	5,924	5,924
退休金費用	-	3,438	3,438	-	3,245	3,245
董事酬金	-	4,943	4,943	-	2,096	2,096
其他員工福利費用	-	<u>2,182</u>	<u>2,182</u>	-	<u>2,008</u>	<u>2,008</u>
合 計	<u>\$ 624</u>	<u>\$ 99,655</u>	<u>\$ 100,279</u>	<u>\$ 393</u>	<u>\$ 84,952</u>	<u>\$ 85,345</u>
折舊費用	<u>\$ -</u>	<u>\$ 12,887</u>	<u>\$ 12,887</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 12,706</u>	<u>\$ 12,706</u>
攤銷費用	<u>\$ -</u>	<u>\$ 14,731</u>	<u>\$ 14,731</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 7,490</u>	<u>\$ 7,490</u>

註 1：111 及 110 年度之每月底平均員工人數分別為 71 人及 70 人，其中未兼任員工之董事人數分別為 7 人及 6 人。

註 2：股票已在證券交易所上市或於證券櫃檯買賣中心上櫃買賣之公司，應增加揭露以下資訊：

(1) 111 年度平均員工福利費用 1,490 仟元(『111 年度員工福利費用合計數—董事酬金合計數』／『111 年度員工人數—未兼任員工之董事人數』)。

110 年度平均員工福利費用 1,301 仟元(『110 年度員工福利費用合計數—董事酬金合計數』／『110 年度員工人數—未兼任員工之董事人數』)。

(2) 111 年度平均員工薪資費用 1,303 仟元 (111 年度薪資費用合計數／『111 年度員工人數—未兼任員工之董事人數』)。

110 年度平均員工薪資費用 1,126 仟元 (110 年度薪資費用合計數／『110 年度員工人數—未兼任員工之董事人數』)。

(3) 平均員工薪資費用調整變動情形 15.72% (『111 年度平均員工薪資費用—110 年度平均員工薪資費用』／110 年度平均員工薪資費用)。

註 3：本公司已無監察人，並已依法條規定由審計委員會取代監察人之職權。

註 4：本公司薪資報酬政策 (包括董事、經理人及員工)：

(1) 董事：本公司依照公司章程第二十條之規定，年度如有獲利 (所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥：董事酬勞不高於 5%，員工酬勞 5%~15%。但公司尚有累積虧損 (包括調整未分配盈餘金額) 時，應預先保留彌補數額，前述提撥之比率，由董事會決議之，並報告股東會。另依據本公司「董事會績效評估辦法」作為董事酬勞核定之參考。

(接次頁)

(承前頁)

- (2) 經理人：本公司經理人之薪酬水準須具有同業競爭力，以吸引外部優秀人才、穩定內部優秀人才。經理人個人薪酬水準依職責及績效差異化，以鼓勵經理人承擔職責及達成績效。經理人為經營績效負責，激勵應兼顧公司之長短期績效。
- (2) 員工：本公司員工整體薪酬以兼顧內部公平性及外部競爭力為原則，本公司員工酬勞總額依公司章程規定，本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥 5%~15% 為員工酬勞；員工個人薪酬依工作職責與專業技能核給，獎金及員工酬勞為綜合個人工作績效表現及貢獻度予以獎勵。

台灣省會計師公會會員印鑑證明書

台省財證字第 1120044 號

會員姓名：  
(1) 林心彤

(2) 蔡美貞

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

事務所地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

事務所電話：27259988



事務所統一編號：94998251

會員證書字號：  
(1) 台省會證字第 4876 號

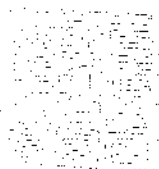
(2) 台省會證字第 3970 號

委託人統一編號：12894399

印鑑證明書用途：辦理億而得微電子股份有限公司 111 年度（自民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日）財務報表之查核簽證。

簽名式 (一)	林心彤	存會印鑑 (一)	
簽名式 (二)	蔡美貞	存會印鑑 (二)	

理事長：



核對人：



中華民國 112 年 1 月 12 日

台省財證字第

1120

號

附件二、112 年度個別財務報告  
暨會計師查核報告

億而得微電子股份有限公司

財務報告暨會計師查核報告

民國 112 及 111 年度

地址：新竹縣竹北市台元街28號7樓之2

電話：(03)552-6035

## § 目 錄 §

項	目 頁	次	財 務 報 告 附 註 編 號
一、封 面	1		-
二、目 錄	2		-
三、會計師查核報告	3~6		
四、資產負債表	7		-
五、綜合損益表	8		-
六、權益變動表	9		-
七、現金流量表	10		-
八、財務報表附註			
(一) 公司沿革	11		一
(二) 通過財務報告之日期及程序	11		二
(三) 新發布及修訂準則及解釋之適用	11~12		三
(四) 重大會計政策之彙總說明	12~20		四
(五) 重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	20		五
(六) 重要會計項目之說明	20~37		六~二十
(七) 關係人交易	37		二一
(八) 質抵押之資產	-		-
(九) 重大或有負債及未認列之合約承諾	-		-
(十) 重大之災害損失	-		-
(十一) 重大之期後事項	-		-
(十二) 具重大影響之外幣資產及負債資訊	37~38		二二
(十三) 附註揭露事項			
1. 重大交易事項相關資訊	38		二三
2. 轉投資事業相關資訊	-		-
3. 大陸投資資訊	-		-
4. 主要股東資訊	-		-
(十四) 部門資訊	38~39		二四
九、重要會計項目明細表	40~47		-

### 會計師查核報告

億而得微電子股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

億而得微電子股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達億而得微電子股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與億而得微電子股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對億而得微電子股份有限公司民國 112 年度財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。



茲對億而得微電子股份有限公司民國 112 年度財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

#### 銷貨收入之認列

億而得微電子股份有限公司之營業收入主要為技術服務收入及權利金收入，於民國 112 年度分別為 48,082 仟元及 139,302 仟元，與收入認列相關之會計政策及資訊請詳財務報告附註四及十五。本會計師評估億而得微電子股份有限公司本年度技術服務收入中特定顯著成長之客戶有收入認列真實性之風險，因此本會計師將其列為本年度之關鍵查核事項，並對該等客戶因應上述風險，執行查核程序如下：

1. 瞭解億而得微電子股份有限公司收入流程之主要內部控制設計，並執行相關控制測試。
2. 選樣抽核營業收入相關憑證與收款情形，以驗證銷貨之真實發生，且核對銷貨對象與收款對象是否存有異常情形。

#### **管理階層與治理單位對財務報告之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報告，且維持與財務報告編製有關之必要內部控制，以確保財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估億而得微電子股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算億而得微電子股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

億而得微電子股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核財務報告之責任**

本會計師查核財務報告之目的，係對財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報告存有之重大

不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對億而得微電子股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使億而得微電子股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致億而得微電子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對億而得微電子股份有限公司民國 112 年度財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 心 彤

林 心 彤



會計師 蔡 美 貞

蔡 美 貞



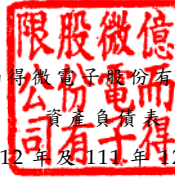
金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1110348898 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 113 年 2 月 27 日



億而得電子股份有限公司

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日		代碼	負 債 及 權 益	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註四、六及二十)	\$ 294,821	81	\$ 334,922	81	2206	應付員工及董事酬勞(附註十六)	\$ 6,229	2	\$ 15,499	4
1170	應收帳款(附註四、七及二十)	16,486	5	24,304	6	2230	本期所得稅負債(附註四及十七)	785	-	1,811	-
1200	其他應收款(附註四、七及二十)	4,395	1	58	-	2280	租賃負債—流動(附註四、九及二十)	209	-	1,354	-
1470	預付款項及其他流動資產(附註十一)	2,373	1	1,245	-	2300	其他流動負債(附註十二及二十)	37,313	10	39,266	10
11XX	流動資產總計	318,075	88	360,529	87	21XX	流動負債總計	44,536	12	57,930	14
	非流動資產						非流動負債				
1600	不動產、廠房及設備(附註四及八)	8,082	2	14,118	4	2670	其他非流動負債(附註十二及二十)	4,790	2	7,989	2
1755	使用權資產(附註四及九)	207	-	1,671	-	2XXX	負債總計	49,326	14	65,919	16
1780	其他無形資產(附註四及十)	30,248	8	31,980	8		權益(附註十四)				
1920	存出保證金(附註四及二十)	4,555	1	4,518	1	3110	普通股股本	268,100	74	268,100	65
1975	淨確定福利資產(附註四及十三)	1,413	1	1,368	-	3310	法定盈餘公積	10,697	3	3,241	1
15XX	非流動資產總計	44,505	12	53,655	13	3350	未分配盈餘	34,457	9	76,924	18
1XXX	資 產 總 計	\$ 362,580	100	\$ 414,184	100	3XXX	權益總計	313,254	86	348,265	84
							負債及權益總計	\$ 362,580	100	\$ 414,184	100

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：黃文謙



經理人：黃文謙



會計主管：賴盈君



億而得微電子股份有限公司

綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及十五）	\$ 187,384	100	\$ 229,420	100
5000	營業成本（附註十六）	1,568	1	1,720	1
5900	營業毛利	185,816	99	227,700	99
	營業費用（附註十六）				
6100	推銷費用	12,056	7	11,538	5
6200	管理費用	30,576	16	29,486	13
6300	研究發展費用	108,127	58	107,830	47
6000	營業費用合計	150,759	81	148,854	65
6900	營業淨利	35,057	18	78,846	34
	營業外收入及支出（附註四及十六）				
7100	利息收入	3,190	2	1,539	1
7010	其他收入	1	-	10	-
7020	其他利益及損失	70	-	1,082	-
7050	財務成本	(51)	-	(106)	-
7000	營業外收入及支出合計	3,210	2	2,525	1
7900	稅前淨利	38,267	20	81,371	35
7950	所得稅費用（附註四及十七）	6,250	3	8,407	4
8200	本年度淨利	32,017	17	72,964	31
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數（附註四及十三）	(3)	-	1,597	1
8500	本年度綜合損益總額	\$ 32,014	17	\$ 74,561	32
	每股盈餘（附註十八）				
9750	基 本	\$ 1.19		\$ 2.72	
9850	稀 釋	\$ 1.19		\$ 2.71	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：黃文謙



經理人：黃文謙



會計主管：賴盈君



億而得微電子股份有限公司



民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼		普 通 股 股 本	未 分 配 盈 餘	權 益 總 計
		股 數 ( 仟 股 ) 金 額	法 定 盈 餘 公 積 未 分 配 盈 餘	
A1	111 年 1 月 1 日 餘 額	26,810 \$ 268,100	\$ - \$ 32,414	\$ 300,514
B1	110 年度 盈 餘 分 配			
B5	法定盈餘公積	-	3,241 ( 3,241)	-
B5	本公司股東現金股利—每股 1 元	-	- ( 26,810)	( 26,810)
D1	111 年度 淨 利	-	- 72,964	72,964
D3	111 年度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	- 1,597	1,597
D5	111 年度 綜 合 損 益 總 額	-	- 74,561	74,561
Z1	111 年 12 月 31 日 餘 額	26,810 268,100	3,241 76,924	348,265
B1	111 年度 盈 餘 分 配			
B5	法定盈餘公積	-	7,456 ( 7,456)	-
B5	本公司股東現金股利—每股 2.5 元	-	- ( 67,025)	( 67,025)
D1	112 年度 淨 利	-	- 32,017	32,017
D3	112 年度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	- ( 3)	( 3)
D5	112 年度 綜 合 損 益 總 額	-	- 32,014	32,014
Z1	112 年 12 月 31 日 餘 額	26,810 \$ 268,100	\$ 10,697 \$ 34,457	\$ 313,254

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：黃文謙



經理人：黃文謙



會計主管：賴盈君



億而得微電子股份有限公司

現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112 年度	111 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 38,267	\$ 81,371
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	12,421	12,887
A20200	攤銷費用	16,953	14,731
A20900	財務成本	51	106
A21200	利息收入	( 3,190)	( 1,539)
A24100	外幣兌換淨損失	2,623	30
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	7,480	( 4,562)
A31180	其他應收款	( 4,337)	( 58)
A31240	預付款項及其他流動資產	( 1,128)	1,598
A32230	其他流動負債	( 7,234)	10,396
A32240	淨確定福利負債	( 48)	( 163)
A33000	營運產生之淨現金流入	61,858	114,797
A33100	收取之利息	3,190	1,539
A33300	支付之利息	( 51)	( 106)
A33500	支付之所得稅	( 7,276)	( 7,420)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>57,721</u>	<u>108,810</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 1,912)	( 2,516)
B03700	存出保證金增加	( 37)	( 3,084)
B03800	存出保證金減少	-	5
B04500	購置其他無形資產	( 22,567)	( 12,480)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 24,516)</u>	<u>( 18,075)</u>
	籌資活動之現金流量		
C04020	租賃負債本金償還	( 5,530)	( 5,330)
C04500	支付現金股利	( 67,025)	( 26,810)
CCCC	籌資活動之現金流出	<u>( 72,555)</u>	<u>( 32,140)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( 751)	( 1,404)
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加數	( 40,101)	57,191
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>334,922</u>	<u>277,731</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 294,821</u>	<u>\$ 334,922</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：黃文謙



經理人：黃文謙



會計主管：賴盈君



億而得微電子股份有限公司

財務報表附註

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(除另註明外，金額以新台幣仟元為單位)

一、公司沿革

億而得微電子股份有限公司(以下稱「本公司」)於 90 年 9 月 4 日經經濟部核准設立。主要從事於電子產品設計、研發、製造、批發及零售、國際貿易及智慧財產權等業務。

本公司自 103 年 10 月 23 日起經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，於該中心之興櫃股票櫃檯買賣。

本財務報告係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。

二、通過財務報告之日期及程序

本財務報告於 113 年 2 月 27 日經董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一) 首次適用金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)認可並發布生效之國際財務報導準則(IFRS)、國際會計準則(IAS)、解釋(IFRIC)及解釋公告(SIC)(以下稱「IFRS 會計準則」)

適用修正後之金管會認可並發布生效之 IFRS 會計準則將不致造成本公司會計政策之重大變動。

(二) 113 年適用之金管會認可之 IFRS 會計準則

<u>新發布 / 修正 / 修訂準則及解釋</u>	<u>國際會計準則理事會 (IASB) 發布之生效日 (註 1)</u>
IFRS 16 之修正「售後租回中之租賃負債」	2024 年 1 月 1 日 (註 2)
IAS 1 之修正「負債分類為流動或非流動」	2024 年 1 月 1 日
IAS 1 之修正「具合約條款之非流動負債」	2024 年 1 月 1 日
IAS 7 及 IFRS 7 之修正「供應商融資安排」	2024 年 1 月 1 日 (註 3)

註 1：除另註明外，上述新發布 / 修正 / 修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度報導期間生效。

註 2：賣方兼承租人應對初次適用 IFRS 16 日後簽訂之售後租回交易追溯適用 IFRS 16 之修正。



註 3：第一次適用本修正時，豁免部分揭露規定。

截至本財務報告通過發布日止，本公司評估上述準則、解釋之修正將不致對財務狀況與財務績效造成重大影響。

(三) IASB 已發布但尚未經金管會認可並發布生效之 IFRS 會計準則

新發布 / 修正 / 修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日(註1)
IFRS 10 及 IAS 28 之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未 定
IFRS 17「保險合約」	2023 年 1 月 1 日
IFRS 17 之修正	2023 年 1 月 1 日
IFRS 17 之修正「初次適用 IFRS 17 及 IFRS 9—比較資訊」	2023 年 1 月 1 日
IAS 21 之修正「缺乏可兌換性」	2025 年 1 月 1 日 (註2)

註 1：除另註明外，上述新發布 / 修正 / 修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度報導期間生效。

註 2：適用於 2025 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間。首次適用該修正時，將影響數認列於首次適用日之保留盈餘。當本公司以非功能性貨幣作為表達貨幣時，將影響數調整首次適用日權益項下之國外營運機構兌換差額。

截至本財務報告通過發布日止，本公司仍持續評估上述準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之 IFRS 會計準則編製。

(二) 編製基礎

除按公允價值衡量之金融工具及按確定福利義務現值減除計畫資產公允價值認列之淨確定福利資產外，本財務報告係依歷史成本基礎編製。

公允價值衡量依照相關輸入值之可觀察程度及重要性分為第 1 等級至第 3 等級：

1. 第 1 等級輸入值：係指於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價（未經調整）。
2. 第 2 等級輸入值：係指除第 1 等級之報價外，資產或負債直接（亦即價格）或間接（亦即由價格推導而得）之可觀察輸入值。
3. 第 3 等級輸入值：係指資產或負債之不可觀察之輸入值。

### (三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括：

1. 主要為交易目的而持有之資產；
2. 預期於資產負債表日後 12 個月內實現之資產；及
3. 現金及約當現金（但不包括於資產負債表日後逾 12 個月用以交換或清償負債而受到限制者）。

流動負債包括：

1. 主要為交易目的而持有之負債；
2. 於資產負債表日後 12 個月內到期清償之負債，以及
3. 不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少 12 個月之負債。

非屬上述流動資產或流動負債者，係分類為非流動資產或非流動負債。

### (四) 外 幣

本公司編製財務報告時，以本公司功能性貨幣以外之貨幣（外幣）交易者，依交易日匯率換算為功能性貨幣記錄。

外幣貨幣性項目於每一資產負債表日以收盤匯率換算，因交割貨幣性項目或換算貨幣性項目產生之兌換差額，於發生當年度認列於損益。

以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算，不再重新換算。

#### (五) 不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備係以成本認列，後續以成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量。

不動產、廠房及設備於耐用年限內按直線基礎，對每一重大部分單獨提列折舊。本公司至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及折舊方法進行檢視，並推延適用會計估計值變動之影響。

不動產、廠房及設備除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於損益。

#### (六) 無形資產

##### 1. 單獨取得

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量，後續係以成本減除累計攤銷及累計減損損失後之金額衡量。無形資產於耐用年限內按直線基礎進行攤銷，本公司至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及攤銷方法進行檢視，並推延適用會計估計值變動之影響。

##### 2. 內部產生－研究及發展支出

研究之支出於發生時認列為費用。

##### 3. 除 列

無形資產除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於當年度損益。

#### (七) 不動產、廠房及設備、使用權資產及無形資產之減損

本公司於每一資產負債表日評估是否有任何跡象顯示不動產、廠房及設備、使用權資產及無形資產可能已減損。若有任一減損跡象存在，則估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額，本公司估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。

可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值之較高者。個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於其帳面金額時，將該資產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額，減損損失係認列於損益。

當減損損失於後續迴轉時，該資產或現金產生單位之帳面金額調增至修訂後之可回收金額，惟增加後之帳面金額以不超過該資產或現金產生單位若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額（減除攤銷或折舊）。減損損失之迴轉係認列於損益。

## (八) 金融工具

金融資產與金融負債於本公司成為該工具合約條款之一方時認列於資產負債表。

原始認列金融資產與金融負債時，若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者，係按公允價值加計直接可歸屬於取得或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或發行透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債之交易成本，則立即認列為損益。

### 1. 金融資產

金融資產之慣例交易係採交易日會計認列及除列。

#### (1) 衡量種類

本公司所持有之金融資產種類為透過損益按公允價值衡量之金融資產及按攤銷後成本衡量之金融資產。

##### A. 透過損益按公允價值衡量之金融資產

透過損益按公允價值衡量之金融資產包括強制透過損益按公允價值衡量及指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產。強制透過損益按公允價值衡量之金融資產包括未指定透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資。

透過損益按公允價值衡量之金融資產係按公允價值衡量，其再衡量產生之利益或損失（包含該金融資產所產生之任何股利或利息）係認列於損益。

## B. 按攤銷後成本衡量之金融資產

本公司投資金融資產若同時符合下列兩條件，則分類為按攤銷後成本衡量之金融資產：

- a. 係於某經營模式下持有，該模式之目的係持有金融資產以收取合約現金流量；及
- b. 合約條款產生特定日期之現金流量，該等現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

按攤銷後成本衡量之金融資產（包括現金及約當現金、按攤銷後成本衡量之應收帳款、其他應收款及存出保證金）於原始認列後，係以有效利息法決定之總帳面金額減除任何減損損失之攤銷後成本衡量，任何外幣兌換損益則認列於損益。

利息收入係以有效利率乘以金融資產總帳面金額計算。

約當現金包括自取得日起 3 個月內、高度流動性、可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之定期存款，係用於滿足短期現金承諾。

### (2) 金融資產之減損

本公司於每一資產負債表日按預期信用損失評估按攤銷後成本衡量之金融資產（含應收帳款）之減損損失。

應收帳款均按存續期間預期信用損失認列備抵損失。

預期信用損失係以發生違約之風險作為權重之加權平均信用損失。存續期間預期信用損失代表金融工具於預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。

所有金融資產之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額。

### (3) 金融資產之除列

本公司僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

按攤銷後成本衡量之金融資產整體除列時，其帳面金額與所收取對價間之差額係認列於損益。

## 2. 權益工具

本公司發行之權益工具係以取得之價款扣除直接發行成本後之金額認列。

再取回本公司本身之權益工具係於權益項下認列與減除。購買、出售、發行或註銷本公司本身之權益工具不認列於損益。

## 3. 金融負債

### (1) 後續衡量

本公司所有金融負債係以有效利息法按攤銷後成本衡量。

### (2) 金融負債之除列

除列金融負債時，其帳面金額與所支付對價（包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債）間之差額認列為損益。

## (九) 收入認列

本公司於客戶合約辨認履約義務後，將交易價格分攤至各履約義務，並於滿足各履約義務時認列收入。

移轉商品或勞務與收取對價之時間間隔在 1 年以內之合約，其重大財務組成部分不予調整交易價格。

### 1. 技術服務收入

依協議所提供之技術服務，並滿足履約義務時認列收入。

### 2. 權利金收入

授權不更新或無技術支援之情況下仍可維持運作之智慧財產所收取之收入即為權利金收入，客戶使用該智慧財產於晶圓代工廠量產時，依照生產量、銷售額或其他衡量方式決定權利金價款並依協議條款認列收入。

## (十) 租賃

本公司於合約成立日評估合約是否係屬（或包含）租賃。

## 本公司為承租人

除適用認列豁免之低價值標的資產租賃及短期租賃之租賃給付係按直線基礎於租賃期間內認列為費用，其他租賃皆於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債。

使用權資產原始按成本（包含租賃負債之原始衡量金額、租賃開始日前支付之租賃給付減除收取之租賃誘因、原始直接成本及復原標的資產之估計成本）衡量，後續按成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量，並調整租賃負債之再衡量數。使用權資產係單獨表達於資產負債表。

使用權資產採直線基礎自租賃開始日起至耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者提列折舊。

租賃負債原始按租賃給付（包含固定給付）之現值衡量。若租賃隱含利率容易確定，租賃給付使用該利率折現。若該利率並非容易確定，則使用承租人增額借款利率。

後續，租賃負債採有效利息法按攤銷後成本基礎衡量，且利息費用係於租賃期間分攤。若租賃期間變動導致未來租賃給付有變動，本公司再衡量租賃負債，並相對調整使用權資產，惟若使用權資產之帳面金額已減至零，則剩餘之再衡量金額認列於損益中。租賃負債係單獨表達於資產負債表。

### (十一) 員工福利

#### 1. 短期員工福利

短期員工福利相關負債係以換取員工服務而預期支付之非折現金額衡量。

#### 2. 退職後福利

確定提撥退休計畫之退休金係於員工提供服務期間將應提撥之退休金數額認列為費用。

確定福利退休計畫之確定福利成本（含服務成本、淨利息及再衡量數）係採預計單位福利法精算。當年度服務成本及淨確定福利資產淨利息於發生時認列為員工福利費用。再衡量數

(含精算損益及扣除利息後之計畫資產報酬)於發生時認列於其他綜合損益並列入保留盈餘，後續期間不重分類至損益。

淨確定福利負債(資產)係確定福利退休計畫之提撥短絀(剩餘)。淨確定福利資產不得超過從該計畫退還提撥金或可減少未來提撥金之現值。

## (十二) 所得稅

所得稅費用係當年度所得稅及遞延所得稅之總和。

### 1. 當年度所得稅

依中華民國所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵所得稅，係於股東會決議年度認列。

以前年度應付所得稅之調整，列入當年度所得稅。

### 2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。

遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列，而遞延所得稅資產則於很有可能具有課稅所得以供可減除暫時性差異或虧損扣抵所產生之所得稅抵減使用時認列。

遞延所得稅資產之帳面金額於每一資產負債表日予以重新檢視，並針對已不再很有可能具有足夠之課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調減帳面金額。原未認列為遞延所得稅資產者，亦於每一資產負債表日予以重新檢視，並在未來很有可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調增帳面金額。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當年度之稅率衡量，該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映本公司於資產負債表日預期回收或清償其資產及負債帳面金額之方式所產生之租稅後果。



### 3. 當年度及遞延所得稅

當年度及遞延所得稅係認列於損益，惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當年度及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。

### 五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本公司於採用會計政策時，對於不易自其他來源取得相關資訊者，管理階層必須基於歷史經驗及其他攸關之因素作出相關之判斷、估計及假設。實際結果可能與估計有所不同。

管理階層將持續檢視估計與基本假設。若估計之修正僅影響當年度，則於修正當年度認列；若會計估計之修正同時影響當年度及未來年度，則於修正當年度及未來年度認列。

### 六、現金及約當現金

	112年12月31日	111年12月31日
庫存現金	\$ 33	\$ 65
銀行活期存款	54,388	101,257
約當現金		
原始到期日在3個月以內之		
銀行定期存款	240,400	233,600
	<u>\$294,821</u>	<u>\$334,922</u>

銀行存款於資產負債表日之利率區間如下：

	112年12月31日	111年12月31日
銀行存款	0%~1.45%	0%~1.05%

### 七、應收帳款及其他應收款

	112年12月31日	111年12月31日
<u>應收帳款</u>		
按攤銷後成本衡量		
總帳面金額	\$ 16,486	\$ 24,304
減：備抵損失	-	-
	<u>\$ 16,486</u>	<u>\$ 24,304</u>
<u>其他應收款</u>		
應收退稅款	\$ 4,395	\$ 58

本公司對勞務收入之平均授信期間為 30 天至 60 天，對應收帳款不予計息。為減輕信用風險，本公司已訂定授信及應收帳款管理辦法以確保逾期應收款項之回收已採取適當行動。此外，本公司於資產負債表日會逐一複核應收款項之可回收金額以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。據此，本公司管理階層認為本公司之信用風險已顯著減少。

本公司按存續期間預期信用損失認列應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況、產業經濟情勢，並同時考量產業展望。因本公司之信用損失歷史經驗顯示，不同客戶群之損失型態並無顯著差異，因此準備矩陣未進一步區分客戶群，僅以應收帳款逾期天數訂定預期信用損失率。

若有證據顯示交易對方面臨嚴重財務困難且本公司無法合理預期可回收金額，本公司直接沖銷相關應收帳款，惟仍會持續追索活動，因追索回收之金額則認列於損益。

本公司依準備矩陣衡量應收帳款之備抵損失如下：

112 年 12 月 31 日

	未逾期	逾期 1~30天	逾期 31~60天	逾期 61~90天	逾期超過 90天	合計
總帳面金額	\$ 12,789	\$ 1,855	\$ -	\$ 1,842	\$ -	\$ 16,486
備抵損失(存續期間 預期信用損失)	-	-	-	-	-	-
攤銷後成本	<u>\$ 12,789</u>	<u>\$ 1,855</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,842</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 16,486</u>

111 年 12 月 31 日

	未逾期	逾期 1~30天	逾期 31~60天	逾期 61~90天	逾期超過 90天	合計
總帳面金額	\$ 21,390	\$ 2,914	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,304
備抵損失(存續期間 預期信用損失)	-	-	-	-	-	-
攤銷後成本	<u>\$ 21,390</u>	<u>\$ 2,914</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 24,304</u>

## 八、不動產、廠房及設備

### 自 用

	研 發 設 備	租 賃 改 良	生 財 器 具	合 計
<u>成 本</u>				
112年1月1日餘額	\$ 51,749	\$ 740	\$ 8,362	\$ 60,851
增 添	38	-	498	536
處 分	( 62)	-	( 158)	( 220)
112年12月31日餘額	<u>\$ 51,725</u>	<u>\$ 740</u>	<u>\$ 8,702</u>	<u>\$ 61,167</u>
<u>累計折舊</u>				
112年1月1日餘額	\$ 42,451	\$ 275	\$ 4,007	\$ 46,733
折舊費用	5,030	207	1,335	6,572
處 分	( 62)	-	( 158)	( 220)
112年12月31日餘額	<u>\$ 47,419</u>	<u>\$ 482</u>	<u>\$ 5,184</u>	<u>\$ 53,085</u>
112年12月31日淨額	<u>\$ 4,306</u>	<u>\$ 258</u>	<u>\$ 3,518</u>	<u>\$ 8,082</u>
<u>成 本</u>				
111年1月1日餘額	\$ 50,574	\$ 119	\$ 6,753	\$ 57,446
增 添	1,389	621	2,049	4,059
處 分	( 214)	-	( 440)	( 654)
111年12月31日餘額	<u>\$ 51,749</u>	<u>\$ 740</u>	<u>\$ 8,362</u>	<u>\$ 60,851</u>
<u>累計折舊</u>				
111年1月1日餘額	\$ 36,371	\$ 80	\$ 3,306	\$ 39,757
折舊費用	6,294	195	1,141	7,630
處 分	( 214)	-	( 440)	( 654)
111年12月31日餘額	<u>\$ 42,451</u>	<u>\$ 275</u>	<u>\$ 4,007</u>	<u>\$ 46,733</u>
111年12月31日淨額	<u>\$ 9,298</u>	<u>\$ 465</u>	<u>\$ 4,355</u>	<u>\$ 14,118</u>

折舊費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

研發設備	3~5年
租賃改良	3年
生財器具	5年

## 九、租賃協議

### (一) 使用權資產

	112年12月31日	111年12月31日
使用權資產帳面金額		
建築物	<u>\$ 207</u>	<u>\$ 1,671</u>

	112年度	111年度
使用權資產之添增	<u>\$ 4,385</u>	<u>\$ 207</u>
使用權資產之折舊費用	<u>\$ 5,849</u>	<u>\$ 5,257</u>

(二) 租賃負債

	112年12月31日	111年12月31日
租賃負債帳面金額	<u>\$ 209</u>	<u>\$ 1,354</u>
流動		

租賃負債之折現率區間如下：

	112年12月31日	111年12月31日
建築物	2.99%	2.37%~2.62%

(三) 重要承租活動及條款

本公司承租建築物做為辦公室及停車位使用，租賃期間 1~3 年。於租賃期間終止時，本公司對所租賃之建築物並無優惠承購權，並約定未經出租人同意，本公司不得將租賃標的之全部或一部轉租或轉讓。

(四) 其他租賃資訊

	112年度	111年度
短期租賃費用	<u>\$ 279</u>	<u>\$ 240</u>
租賃之現金流出總額	<u>\$ 5,860</u>	<u>\$ 5,676</u>

租賃期間於資產負債表日後開始之所有承租承諾如下：

	112年12月31日	111年12月31日
承租承諾	<u>\$ 26,161</u>	<u>\$ -</u>

十、其他無形資產

	電	腦	軟	體	專	利	權	合	計
成本									
112年1月1日餘額	\$	65,134	\$	2,857	\$	67,991			
增添		15,221		-		15,221			
處分	(	7,431)	-	-	(	7,431)			
112年12月31日餘額	\$	<u>72,924</u>	\$	<u>2,857</u>	\$	<u>75,781</u>			

(接次頁)

(承前頁)

	電 腦 軟 體	專 利 權	合 計
<u>累計攤銷</u>			
112年1月1日餘額	\$ 33,869	\$ 2,142	\$ 36,011
攤銷費用	16,381	572	16,953
處分	( <u>7,431</u> )	<u>-</u>	( <u>7,431</u> )
112年12月31日餘額	<u>\$ 42,819</u>	<u>\$ 2,714</u>	<u>\$ 45,533</u>
112年12月31日淨額	<u>\$ 30,105</u>	<u>\$ 143</u>	<u>\$ 30,248</u>
<u>成 本</u>			
111年1月1日餘額	\$ 53,428	\$ 2,857	\$ 56,285
增 添	24,825	-	24,825
處分	( <u>13,119</u> )	<u>-</u>	( <u>13,119</u> )
111年12月31日餘額	<u>\$ 65,134</u>	<u>\$ 2,857</u>	<u>\$ 67,991</u>
<u>累計攤銷</u>			
111年1月1日餘額	\$ 32,828	\$ 1,571	\$ 34,399
攤銷費用	14,160	571	14,731
處分	( <u>13,119</u> )	<u>-</u>	( <u>13,119</u> )
111年12月31日餘額	<u>\$ 33,869</u>	<u>\$ 2,142</u>	<u>\$ 36,011</u>
111年12月31日淨額	<u>\$ 31,265</u>	<u>\$ 715</u>	<u>\$ 31,980</u>

攤銷費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

電腦軟體	3年
專利權	5年

依功能別彙總攤銷費用：

	112年度	111年度
管理費用	\$ 140	\$ 204
研發費用	<u>16,813</u>	<u>14,527</u>
	<u>\$ 16,953</u>	<u>\$ 14,731</u>

#### 十一、其他資產

	112年12月31日	111年12月31日
<u>流 動</u>		
預付技術服務費	\$ 970	\$ -
預付軟體費	547	285
預付測試材料費	215	587

(接次頁)

(承前頁)

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
預付保險費	\$ 199	\$ 190
其他	<u>442</u>	<u>183</u>
	<u>\$ 2,373</u>	<u>\$ 1,245</u>

## 十二、其他負債

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
<u>流動</u>		
應付軟體費	\$ 12,777	\$ 15,390
應付薪資及獎金	11,509	10,814
未休假獎金	5,758	4,828
應付勞務費	2,747	1,450
應付設備款	167	1,543
應付保險費	1,262	1,170
應付技術服務費	1,073	1,730
其他	<u>2,020</u>	<u>2,341</u>
	<u>\$ 37,313</u>	<u>\$ 39,266</u>
<u>非流動</u>		
應付軟體費	<u>\$ 4,790</u>	<u>\$ 7,989</u>

## 十三、退職後福利計畫

### (一) 確定提撥計畫

本公司所適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，依員工每月薪資 6% 提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。

### (二) 確定福利計畫

本公司依我國「勞動基準法」辦理之退休金制度係屬政府管理之確定福利退休計畫。員工退休金之支付，係根據服務年資及核准退休日前 6 個月平均工資計算。本公司按員工每月薪資總額 2% 提撥退休金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶。年度終了前，若估算專戶餘額不足給付次一年度內預估達到退休條件之勞工，次年度 3 月底前將一次提撥其差額。該專戶係委託勞動部勞動基金運用局管理，本公司並無影響投資管理策略之權利。

列入資產負債表之確定福利計畫金額列示如下：

	112年12月31日	111年12月31日
確定福利義務現值	\$ 1,189	\$ 1,150
計畫資產公允價值	( 2,602)	( 2,518)
淨確定福利資產	( \$ 1,413)	( \$ 1,368)

淨確定福利資產變動如下：

	確 定 福 利 義 務 現 值	計 畫 資 產 公 允 價 值	淨 確 定 福 利 ( 資 產 ) 負 債
112年1月1日	\$ 1,150	( \$ 2,518)	( \$ 1,368)
利息費用(收入)	16	( 36)	( 20)
認列於損益	16	( 36)	( 20)
再衡量數			
計畫資產報酬(除 包含於淨利息之 金額外)	-	( 20)	( 20)
精算損失—財務假 設變動	8	-	8
精算損失—經驗調 整	15	-	15
認列於其他綜合損益	23	( 20)	3
雇主提撥	-	( 28)	( 28)
福利支付	-	-	-
112年12月31日	\$ 1,189	( \$ 2,602)	( \$ 1,413)
111年1月1日	\$ 3,327	( \$ 2,935)	\$ 392
利息費用(收入)	22	( 20)	2
認列於損益	22	( 20)	2
再衡量數			
計畫資產報酬(除 包含於淨利息之 金額外)	-	( 219)	( 219)
精算利益—財務假 設變動	( 52)	-	( 52)
精算利益—經驗調 整	( 1,326)	-	( 1,326)
認列於其他綜合損益	( 1,378)	( 219)	( 1,597)
雇主提撥	-	( 165)	( 165)
福利支付	( 821)	821	-
111年12月31日	\$ 1,150	( \$ 2,518)	( \$ 1,368)

本公司因「勞動基準法」之退休金制度暴露於下列風險：

1. 投資風險：勞動部勞動基金運用局透過自行運用及委託經營方式，將勞工退休基金分別投資於國內（外）權益證券與債務證券及銀行存款等標的，惟本公司之計畫資產得分配金額係以不低於當地銀行 2 年定期存款利率計算而得之收益。
2. 利率風險：政府公債之利率下降將使確定福利義務現值增加，惟計畫資產之債務投資報酬亦會隨之增加，兩者對淨確定福利負債之影響具有部分抵銷之效果。
3. 薪資風險：確定福利義務現值之計算係參考計畫成員之未來薪資。因此計畫成員薪資之增加將使確定福利義務現值增加。

本公司之確定福利義務現值係由合格精算師進行精算，衡量日之重大假設如下：

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
折現率	1.30%	1.40%
薪資預期增加率	3.50%	3.50%

若重大精算假設分別發生合理可能之變動，在所有其他假設維持不變之情況下，將使確定福利義務現值增加（減少）之金額如下：

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
折現率		
增加 0.25%	(\$ <u>21</u> )	(\$ <u>21</u> )
減少 0.25%	\$ <u>21</u>	\$ <u>21</u>
薪資預期增加率		
增加 0.25%	\$ <u>20</u>	\$ <u>20</u>
減少 0.25%	(\$ <u>20</u> )	(\$ <u>20</u> )

由於精算假設可能彼此相關，僅單一假設變動之可能性不大，故上述敏感度分析可能無法反映確定福利義務現值實際變動情形。

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
預期 1 年內提撥金額	\$ <u>-</u>	\$ <u>165</u>
確定福利義務平均到期期間	8 年	9 年



#### 十四、權 益

##### (一) 普通股股本

	112年12月31日	111年12月31日
額定股數(仟股)	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>
額定股本	<u>\$300,000</u>	<u>\$300,000</u>
已發行且已收足股款之股數 (仟股)	<u>26,810</u>	<u>26,810</u>
已發行股本	<u>\$268,100</u>	<u>\$268,100</u>

##### (二) 保留盈餘及股利政策

本公司已於 112 年 6 月 6 日股東會決議通過修正章程，依本公司修正後章程之盈餘分派政策規定，年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補以往虧損（包括調整未分配盈餘金額），次提列 10% 為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣後盈餘，連同期初未分配盈餘（包括調整未分配盈餘金額），由董事會擬具分配案，提請股東會決議分派股東股息紅利。另本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部分如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

依本公司修正前章程之盈餘分派政策規定，年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補以往虧損（包括調整未分配盈餘金額），次提列 10% 為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣後盈餘，連同期初未分配盈餘（包括調整未分配盈餘金額），由董事會擬具分配案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司章程規定之員工及董事酬勞分派政策，參閱附註十六(七)員工酬勞及董事酬勞。

授權董事會於可供分配盈餘 0% 至 100% 之額度範圍內，視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法

由董事會擬具分配案，提報股東會。每年發放現金股利之比例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數的 10%。

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時，法定盈餘公積超過實收股本總額 25% 之部分除得撥充股本外，尚得以現金分配。

本公司於 112 年 6 月 6 日及 111 年 6 月 23 日舉行股東常會，分別決議通過 111 及 110 年度盈餘分配案及每股股利如下：

	<u>111 年度</u>	<u>110 年度</u>
法定盈餘公積	<u>\$ 7,456</u>	<u>\$ 3,241</u>
現金股利	<u>\$ 67,025</u>	<u>\$ 26,810</u>
每股現金股利（元）	\$ 2.50	\$ 1.00

本公司 113 年 2 月 27 日董事會決議 112 年度盈餘分配案及每股股利如下：

	<u>112 年度</u>
法定盈餘公積	<u>\$ 3,201</u>
現金股利	<u>\$ 26,810</u>
每股現金股利（元）	\$ 1.00

有關 112 年法定盈餘公積金額尚待預計於 113 年 5 月 21 日召開之股東常會決議。

#### 十五、營業收入

	<u>112 年度</u>	<u>111 年度</u>
客戶合約收入		
技術服務收入	\$ 48,082	\$ 58,821
權利金收入	<u>139,302</u>	<u>170,599</u>
	<u>\$187,384</u>	<u>\$229,420</u>

#### (一) 客戶合約之說明

##### 1. 技術服務收入

技術服務收入係提供客戶積體電路矽智財設計服務，於提供客戶服務或積體電路矽智財後認列收入。

## 2. 權利金收入

權利金收入係本公司將標準化積體電路矽智財授權予客戶，於客戶使用該授權積體電路矽智財量產後，依據合約收取權利金。

### (二) 合約餘額

	112年12月31日	111年12月31日	111年1月1日
應收帳款(附註七)	<u>\$ 16,486</u>	<u>\$ 24,304</u>	<u>\$ 19,758</u>

### (三) 客戶合約收入之細分

主要地區市場	112年度	111年度
中國大陸(含香港)	\$ 78,560	\$ 84,992
台灣	47,715	76,031
新加坡	34,180	43,316
韓國	19,788	21,957
美國	3,745	2,645
其他	<u>3,396</u>	<u>479</u>
	<u>\$187,384</u>	<u>\$229,420</u>

## 十六、淨利

### (一) 利息收入

	112年度	111年度
銀行存款	\$ 3,126	\$ 1,511
其他	<u>64</u>	<u>28</u>
	<u>\$ 3,190</u>	<u>\$ 1,539</u>

### (二) 其他收入

	112年度	111年度
其他	<u>\$ 1</u>	<u>\$ 10</u>

### (三) 其他利益及損失

	112年度	111年度
淨外幣兌換利益	<u>\$ 70</u>	<u>\$ 1,082</u>

### (四) 財務成本

	112年度	111年度
租賃負債之利息	<u>\$ 51</u>	<u>\$ 106</u>

(五) 折舊及攤銷

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
折舊費用依功能別彙總		
營業費用	<u>\$ 12,421</u>	<u>\$ 12,887</u>
攤銷費用依功能別彙總		
營業費用	<u>\$ 16,953</u>	<u>\$ 14,731</u>

無形資產攤銷費用分攤至各單行項目資訊，請參閱附註十。

(六) 員工福利費用

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
短期員工福利	\$ 96,345	\$ 96,841
退職後福利		
確定提撥計畫	3,737	3,436
確定福利計畫（附註十三）	( 20 )	2
員工福利費用合計	<u>\$100,062</u>	<u>\$100,279</u>
依功能別彙總		
營業成本	\$ 1,153	\$ 624
營業費用	<u>98,909</u>	<u>99,655</u>
	<u>\$100,062</u>	<u>\$100,279</u>

(七) 員工酬勞及董事酬勞

本公司依章程規定係按當年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前利益分別以 5%~15% 及不高於 5% 提撥員工酬勞及董事酬勞。112 及 111 年度員工酬勞及董事酬勞分別於 113 年 2 月 27 日及 112 年 3 月 8 日經董事會決議如下：

估列比例

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
員工酬勞	10.5%	12%
董事酬勞	3.5%	4%

金 額

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
員工酬勞	\$ 4,672	\$ 11,624
董事酬勞	1,557	3,875

年度財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計值變動處理，於次一年度調整入帳。

111 及 110 年度員工酬勞及董事酬勞之實際配發金額與 111 及 110 年度財務報告之認列金額並無差異。

有關本公司董事會決議之員工酬勞及董事酬勞資訊，請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

(八) 外幣兌換（損）益

	112年度	111年度
外幣兌換利益總額	\$ 2,488	\$ 5,908
外幣兌換（損失）總額	( 2,418)	( 4,826)
淨外幣兌換利益	<u>\$ 70</u>	<u>\$ 1,082</u>

十七、所得稅

(一) 認列於損益之所得稅

所得稅費用之主要組成項目如下：

	112年度	111年度
當期所得稅		
本年度產生者	\$ 6,250	\$ 8,407
認列於損益之所得稅費用	<u>\$ 6,250</u>	<u>\$ 8,407</u>

會計所得與所得稅費用之調節如下：

	112年度	111年度
稅前淨利	<u>\$ 38,267</u>	<u>\$ 81,371</u>
稅前淨利按法定稅率計算之		
所得稅費用	\$ 7,653	\$ 16,274
暫時性差異之產生及迴轉	( 370)	572
國外來源所得可扣抵稅額	( 6,211)	( 8,331)
使用未認列之虧損扣抵／可		
減除暫時性差異	( 1,072)	( 8,515)
國外所得稅	<u>6,250</u>	<u>8,407</u>
認列於損益之所得稅費用	<u>\$ 6,250</u>	<u>\$ 8,407</u>

(二) 未於資產負債表中認列遞延所得稅資產之可減除暫時性差異及未使用虧損扣抵金額

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
虧損扣抵		
113年度到期	\$ 13,410	\$ 19,308
114年度到期	<u>13,079</u>	<u>13,079</u>
	<u>\$ 26,489</u>	<u>\$ 32,387</u>
可減除暫時性差異	<u>\$ 26,553</u>	<u>\$ 28,402</u>

(三) 所得稅核定情形

本公司截至 110 年度止之營利事業所得稅申報案件，業經稅捐稽徵機關核定。

#### 十八、每股盈餘

單位：每股元

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
基本每股盈餘	<u>\$ 1.19</u>	<u>\$ 2.72</u>
稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.19</u>	<u>\$ 2.71</u>

用以計算每股盈餘之本年度淨利及普通股加權平均股數如下：

#### 本年度淨利

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
本年度淨利	<u>\$ 32,017</u>	<u>\$ 72,964</u>
用以計算基本及稀釋每股盈餘之淨利	<u>\$ 32,017</u>	<u>\$ 72,964</u>

#### 股    數

單位：仟股

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
用以計算基本每股盈餘之普通股加權平均股數	26,810	26,810
具稀釋作用潛在普通股之影響：		
員工酬勞	<u>55</u>	<u>150</u>
用以計算稀釋每股盈餘之普通股加權平均股數	<u>26,865</u>	<u>26,960</u>

若本公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞，則計算稀釋每股盈餘時，假設員工酬勞將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋

作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。於次年度決議員工酬勞發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

## 十九、資本風險管理

本公司進行資本管理以確保能夠於繼續經營之前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，以使股東報酬極大化。本公司之整體策略並無變化。

本公司資本結構係由權益（即股本及保留盈餘）組成。

本公司不須遵守其他外部資本規定。

本公司主要管理階層定期重新檢視本公司資本結構，其檢視內容包括考量各類資本之成本及相關風險。本公司依據主要管理階層之建議，將藉由支付股利、發行新股、買回股份及發行新債或償付舊債等方式平衡其整體資本結構。

## 二十、金融工具

### (一) 公允價值之資訊－非按公允價值衡量之金融工具

本公司管理階層認為非按公允價值衡量之金融資產及金融負債之帳面金額趨近其公允價值。

### (二) 金融工具之種類

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
<u>金融資產</u>		
按攤銷後成本衡量之金融資產(註1)	\$320,257	\$363,802
<u>金融負債</u>		
按攤銷後成本衡量之金融負債(註2)	24,836	31,613

註1：餘額係包含現金及約當現金、應收帳款、其他應收款及存出保證金等按攤銷後成本衡量之金融資產。

註2：餘額係其他負債，但不包含應付薪資及獎金、未休假獎金等按攤銷後成本衡量之金融負債。

### (三) 財務風險管理目的與政策

本公司主要金融工具包括權益投資及應收帳款。本公司之財務管理部門係為各業務單位提供服務，統籌協調進入國內與國際金融市場操作，藉由依照風險程度與廣度分析暴險之內部風險報告監督及管理本公司營運有關之財務風險。該等風險包括市場風險（包含匯率風險及利率風險）、信用風險及流動性風險。

#### 1. 市場風險

本公司之營運活動使本公司承擔之主要財務風險為外幣匯率變動風險（參閱下述(1)）以及利率變動風險（參閱下述(2)）。

本公司有關金融工具市場風險之暴險及其對該等暴險之管理與衡量方式並無改變。

##### (1) 匯率風險

本公司從事外幣計價之交易，因而使本公司產生匯率變動暴險。

本公司於資產負債表日非功能性貨幣計價之貨幣性資產與貨幣性負債帳面金額，參閱附註二二。

##### 敏感度分析

本公司主要受到美元匯率波動之影響。

下表詳細說明當新台幣（功能性貨幣）對各攸關外幣之匯率增加及減少1%時，本公司之敏感度分析。1%係為本公司內部向主要管理階層報告匯率風險時所使用之敏感度比率，亦代表管理階層對外幣匯率之合理可能變動範圍之評估。敏感度分析僅包括流通在外之外幣貨幣性項目，並將其年底之換算以匯率變動1%予以調整。下表之正數係表示當新台幣相對於各相關貨幣貶值1%時，將使稅前淨利增加之金額；當新台幣相對於各相關外幣升值1%時，其對稅前淨利之影響將為同金額之負數。

	美	金	之	影	響
	112年度			111年度	
損	\$ 215			\$ 316	
益					



本公司於本年度對匯率敏感度下降，主係因美元計價之淨資產減少所致。

## (2) 利率風險

本公司於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下：

	112年12月31日	111年12月31日
具公允價值利率風險		
—金融資產	\$135,400	\$128,600
—金融負債	209	1,354
具現金流量利率風險		
—金融資產	159,388	206,257

### 敏感度分析

下列敏感度分析係依非衍生工具於資產負債表日之利率暴險而決定。對於浮動利率資產，其分析方式係假設資產負債表日流通在外之資產金額於報導期間皆流通在外。

若年利率增加 1%，在所有其他變數維持不變之情況下，本公司 112 及 111 年度之稅前淨利將分別增加 1,594 仟元及 2,063 仟元。

本公司於本年度對利率之敏感度下降，主係因變動利率金融資產減少所致。

## 2. 信用風險

信用風險係指交易對方拖欠合約義務而造成本公司財務損失之風險。截至資產負債表日，本公司可能因交易對方未履行義務造成財務損失之最大信用風險暴險主要係來自於資產負債表所認列之金融資產帳面金額。

應收帳款之對象涵蓋眾多客戶，分散於不同產業及地理區域。本公司持續地針對應收帳款客戶之財務狀況進行評估。

本公司之信用風險主要係集中於前 5 大客戶，截至 112 年及 111 年 12 月 31 日止，應收帳款總額來自前述客戶之比率分別為 52% 及 75%。

### 3. 流動性風險

本公司係透過管理及維持足夠部位之現金及約當現金以支應營運並減輕現金流量波動之影響。

非衍生金融負債到期分析係依照約定之還款日編製。

#### 112年12月31日

	要求即付或 短於1個月	1至3個月	3個月 至1年	1年以上	合計
非衍生金融負債					
無附息負債	\$ 10,252	\$ 11,477	\$ 15,584	\$ 4,790	\$ 42,103
租賃負債	<u>70</u>	<u>140</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>210</u>
	<u>\$ 10,322</u>	<u>\$ 11,617</u>	<u>\$ 15,584</u>	<u>\$ 4,790</u>	<u>\$ 42,313</u>

#### 111年12月31日

	要求即付或 短於1個月	1至3個月	3個月 至1年	1年以上	合計
非衍生金融負債					
無附息負債	\$ 14,236	\$ 6,217	\$ 18,813	\$ 7,989	\$ 47,255
租賃負債	<u>453</u>	<u>906</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,359</u>
	<u>\$ 14,406</u>	<u>\$ 5,863</u>	<u>\$ 18,813</u>	<u>\$ 7,989</u>	<u>\$ 47,071</u>

### 二一、關係人交易

#### 主要管理階層薪酬

	112年度	111年度
短期員工福利	<u>\$ 13,194</u>	<u>\$ 12,254</u>

董事及其他主要管理階層之薪酬係由薪酬委員會依照個人績效及市場趨勢決定。

### 二二、具重大影響之外幣資產及負債資訊

以下資訊係按本公司功能性貨幣以外之外幣彙總表達，所揭露之匯率係指該等外幣換算至功能性貨幣之匯率。具重大影響之外幣資產及負債資訊如下：

單位：各外幣仟元

	112年12月31日		111年12月31日	
	外幣	匯率	外幣	匯率
外幣資產				
貨幣性項目				
美元	<u>\$ 1,271</u>	30.705	<u>\$ 1,813</u>	30.71

(接次頁)

(承前頁)

外幣負債	112年12月31日		111年12月31日	
	外幣	匯率	外幣	匯率
貨幣性項目				
美元	\$ 572	30.705	\$ 783	30.71

具重大影響之外幣兌換損益（已實現及未實現）如下：

外幣	112年度		111年度	
	匯率	淨兌換利益	匯率	淨兌換損失
美元	31.155(美元:新台幣)	\$ 70	29.805(美元:新台幣)	\$ 1,082

### 二三、附註揭露事項

本公司除下列項目外，並無其他重大交易事項、轉投資事業及大陸投資資訊等應揭露者。

期末持有有價證券情形：

持有之公司	有價證券種類	有價證券名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期				備註
					股數(仟)	帳面金額	持股比例(%)	股權淨值/市價/帳面價值	
本公司	股票	晶隼科技股份有限公司	本公司董事長為該公司之董事	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	2,350	\$ -	13	\$ -	註

註：上列有價證券於112年12月底，並無提供擔保、質押借款或其他依約定而受限制者。

### 二四、部門資訊

本公司之營運決策者用以分配資源及評量部門績效係以不同監理環境為基礎，所有符合營運部門定義皆具有相類似之經濟特性，故本公司彙總為單一營運部門報導。另本公司提供給營運決策者複核之部門資訊，其衡量基礎與財務報告相同，故112及111年度應報導之部門收入及營運結果可參照112及111年度之綜合損益表；112年及111年12月31日應報導之部門資產可參照112年及111年12月31日之資產負債表。

(一) 主要產品及勞務之收入：請參閱附註十五。

(二) 地區別資訊：

本公司來自外部客戶之繼續營業單位收入依營運地點區分與非流動資產按資產所在地區分之資訊列示如下：

	來自外部客戶之收入		非流動資產	
	112年度	111年度	112年12月31日	111年12月31日
中國大陸(含香港)	\$ 78,560	\$ 84,992	\$ -	\$ -
台灣	47,715	76,031	38,537	47,769
新加坡	34,180	43,316	-	-
韓國	19,788	21,957	-	-
美國	3,745	2,645	-	-
其他	3,396	479	-	-
	<u>\$ 187,384</u>	<u>\$ 229,420</u>	<u>\$ 38,537</u>	<u>\$ 47,769</u>

非流動資產不包括金融工具、存出保證金及淨確定福利資產。

(三) 主要客戶資訊

來自單一客戶之收入達本公司收入總額之10%以上者如下：

關係人名稱	112年度		111年度	
	金額	所佔比例%	金額	所佔比例%
甲客戶	\$ 33,194	18	\$ 43,317	19
乙客戶	25,285	13	33,951	15
丙客戶	19,788	11	NA(註)	-
丁客戶	18,929	10	23,808	10

註：收入金額未達本公司收入總額之10%。

## §重要會計項目明細表目錄§

項	目	編 號 / 索 引
資產、負債及權益項目明細表		
現金及約當現金明細表		明細表一
應收帳款明細表		明細表二
其他資產明細表		附註十一
使用權資產成本及使用權資產累計折舊變動明細表		明細表三
不動產、廠房及設備變動明細表		附註八
其他無形資產變動明細表		附註十
租賃負債明細表		明細表四
其他流動負債明細表		附註十二
損益項目明細表		
營業收入明細表		附註十五
營業費用明細表		明細表五
其他收益及費損淨額明細表		附註十六
本期發生之員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表		明細表六

億而得微電子股份有限公司  
現金及約當現金明細表  
民國 112 年 12 月 31 日

明細表一

單位：除另予註明者外  
，係新台幣仟元

項	目	摘	要	金	額
銀行存款					
	活期存款			\$	31,340
	外幣存款	美元 734 仟元及人民幣 119 仟元(兌 換率為 US\$1 : NT\$30.705 及 CNY\$1 : NT\$4.327)			23,048
	定期存款	利率 1.1%~1.25%，113 年 3 月底前 陸續到期			240,400
庫存現金					
					33
					\$294,821

億而得微電子股份有限公司

應收帳款明細表

民國 112 年 12 月 31 日

明細表二

單位：新台幣仟元

客 戶 名 稱	金 額
A 公 司	\$ 5,458
B 公 司	1,842
C 公 司	1,535
D 公 司	1,535
E 公 司	1,290
F 公 司	1,161
其他（註一）	<u>3,665</u>
合 計	<u>\$ 16,486</u>

註一：各戶餘額皆未超過本科目餘額之 5%。

註二：未有逾期 1 年以上者。

億而得微電子股份有限公司  
 使用權資產成本及使用權資產累計折舊變動明細表  
 民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

明細表三

單位：新台幣仟元

名 稱	房 屋 及 建 築
成 本	
112 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 20,113
增 添	<u>4,385</u>
112 年 12 月 31 日 餘 額	<u>24,498</u>
累 計 折 舊	
112 年 1 月 1 日 餘 額	18,442
折 舊	<u>5,849</u>
112 年 12 月 31 日 餘 額	<u>24,291</u>
112 年 12 月 31 日 淨 額	<u>\$ 207</u>



億而得微電子股份有限公司

租賃負債明細表

民國 112 年 12 月 31 日

明細表四

單位：除另予註明者外  
，係新台幣仟元

名 稱	租 賃 期 間	折 現 率	金 額
建築物	109.04~113.03	2.99%	\$ 209
減：租賃負債—流動			( 209)
租賃負債—非流動			\$ -

億而得微電子股份有限公司

營業費用明細表

民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

明細表五

單位：新台幣仟元

項	目	推 銷 費 用	管 理 費 用	研 究 發 展 費 用
薪資費用		\$ 6,042	\$ 18,009	\$ 61,834
折舊費用		1,462	2,898	8,061
攤銷費用		-	140	16,813
技術服務費		-	-	5,794
旅 費		982	40	194
保 險 費		525	1,386	5,265
勞 務 費		-	3,547	137
其他（註）		<u>3,045</u>	<u>4,556</u>	<u>10,029</u>
		<u>\$ 12,056</u>	<u>\$ 30,576</u>	<u>\$ 108,127</u>

註：各項目金額皆未超過各科目金額之 5%。

億而得微電子股份有限公司

本期發生之員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

明細表六

單位：新台幣仟元

	112 年度			111 年度		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	\$ 1,153	\$ 83,136	\$ 84,289	\$ 624	\$ 82,792	\$ 83,416
員工保險費用	-	7,055	7,055	-	6,300	6,300
退休金費用	-	3,717	3,717	-	3,438	3,438
董事酬金	-	2,749	2,749	-	4,943	4,943
其他員工福利費用	-	<u>2,252</u>	<u>2,252</u>	-	<u>2,182</u>	<u>2,182</u>
合 計	<u>\$ 1,153</u>	<u>\$ 98,909</u>	<u>\$ 100,062</u>	<u>\$ 624</u>	<u>\$ 99,655</u>	<u>\$ 100,279</u>
折舊費用	<u>\$ -</u>	<u>\$ 12,421</u>	<u>\$ 12,421</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 12,887</u>	<u>\$ 12,887</u>
攤銷費用	<u>\$ -</u>	<u>\$ 16,953</u>	<u>\$ 16,953</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 14,731</u>	<u>\$ 14,731</u>

註 1：112 及 111 年度之每月底平均員工人數分別為 72 人及 71 人，其中未兼任員工之董事人數均為 7 人。

註 2：股票已在證券交易所上市或於證券櫃檯買賣中心上櫃買賣之公司，應增加揭露以下資訊：

(1) 112 年度平均員工福利費用 1,497 仟元(『112 年度員工福利費用合計數—董事酬金合計數』／『112 年度員工人數—未兼任員工之董事人數』)。

111 年度平均員工福利費用 1,490 仟元(『111 年度員工福利費用合計數—董事酬金合計數』／『111 年度員工人數—未兼任員工之董事人數』)。

(2) 112 年度平均員工薪資費用 1,297 仟元 (112 年度薪資費用合計數／『112 年度員工人數—未兼任員工之董事人數』)。

111 年度平均員工薪資費用 1,303 仟元 (111 年度薪資費用合計數／『111 年度員工人數—未兼任員工之董事人數』)。

(3) 平均員工薪資費用調整變動情形(0.46)% (『112 年度平均員工薪資費用—111 年度平均員工薪資費用』／111 年度平均員工薪資費用)。

註 3：本公司已無監察人，並已依法條規定由審計委員會取代監察人之職權。

註 4：本公司薪資報酬政策 (包括董事、經理人及員工)：

(1) 董事：本公司依照公司章程第二十條之規定，年度如有獲利 (所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥：董事酬勞不高於 5%，員工酬勞 5%~15%。但公司尚有累積虧損 (包括調整未分配盈餘金額) 時，應預先保留彌補數額，前述提撥之比率，由董事會決議之，並報告股東會。另依據本公司「董事會績效評估辦法」作為董事酬勞核定之參考。

(接次頁)

(承前頁)

- (2) 經理人：本公司經理人之薪酬水準須具有同業競爭力，以吸引外部優秀人才、穩定內部優秀人才。經理人個人薪酬水準依職責及績效差異化，以鼓勵經理人承擔職責及達成績效。經理人為經營績效負責，激勵應兼顧公司之長短期績效。
- (2) 員工：本公司員工整體薪酬以兼顧內部公平性及外部競爭力為原則，本公司員工酬勞總額依公司章程規定，本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥 5%~15% 為員工酬勞；員工個人薪酬依工作職責與專業技能核給，獎金及員工酬勞為綜合個人工作績效表現及貢獻度予以獎勵。

# 社團法人臺灣省會計師公會會員印鑑證明書

臺省財證字第 1130066 號

會員姓名： (1) 林心彤  
(2) 蔡美貞

事務所名稱： 勤業眾信聯合會計師事務所

事務所地址： 新竹市科學工業園區展業一路2號6樓

事務所統一編號： 94998251


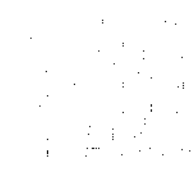
事務所電話： (03)5780899

委託人統一編號： 12894399

會員書字號： (1) 臺省會證字第 4876 號  
(2) 臺省會證字第 3970 號

印鑑證明書用途： 辦理 億而得微電子股份有限公司

112 年 01 月 01 日 至  
112 年度 (自民國 112 年 12 月 31 日 ) 財務報表之查核簽證。

簽名式 (一)	林 心 彤	存會印鑑 (一)	
簽名式 (二)	蔡 美 貞	存會印鑑 (二)	

理事長：



核對人：



中 華 民 國 113 年 01 月 16 日

附件三、內部控制聲明書

# 億而得微電子股份有限公司

## 內部控制制度聲明書

日期：112年11月8日

本公司民國 112 年 4 月 1 日至 112 年 9 月 30 日之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及 5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 112 年 9 月 30 日之內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、為申請股票上市之需要，本公司依據「處理準則」第六條之規定，委託會計師專案審查上開期間與外部財務報導之可靠性及與保障資產安全(使資產不致在未經授權之情況下取得、使用或處分)有關的內部控制制度，如前項所述，其設計及執行係屬有效，並無影響財務資訊之記錄、處理、彙總及報告可靠性之重大缺失，亦無影響保障資產安全，使資產在未經授權之情況下逕行取得、使用或處分之重大缺失。
- 七、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 八、本聲明書業經本公司民國 112 年 11 月 8 日董事會通過，出席董事 9 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

億而得微電子股份有限公司

董事長暨總經理



# 億而得微電子股份有限公司

## 內部控制制度聲明書

日期：一一三年二月二十七日

本公司民國一一二年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國一一二年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一三年二月二十七日董事會通過，出席董事九人中，有○人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

億而得微電子股份有限公司



董事長暨總經理：



簽章



附件四、內部控制制度審查報告

### 內部控制制度審查 會計師合理確信報告

億而得微電子股份有限公司 公鑒：

億而得微電子股份有限公司與外部財務報導和保障資產安全有關之內部控制制度民國 112 年 9 月 30 日之設計及執行情形及於民國 112 年 11 月 8 日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國 112 年 9 月 30 日係有效設計及執行之聲明書，其中億而得微電子股份有限公司重大營運循環及管理程序之內部控制制度，包括「銷售及收款循環」及「電腦資訊系統循環」業經本會計師執行必要程序竣事。

#### 確信標的、確信標的資訊與適用基準

本確信案件之標的及標的資訊分別為億而得微電子股份有限公司與外部財務報導和保障資產安全有關之重大營運循環及管理程序之內部控制制度，包括「銷售及收款循環」及「電腦資訊系統循環」於民國 112 年 9 月 30 日之設計及執行情形，及億而得微電子股份有限公司於民國 112 年 11 月 8 日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國 112 年 9 月 30 日係有效設計及執行之聲明書，詳附件。

用以衡量或評估上開確信標的及標的資訊之適用基準係「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目。

#### 先天限制

由於任何內部控制制度均有其先天上之限制，故億而得微電子股份有限公司上述內部控制制度仍可能未能預防或偵測出業已發生之錯誤或舞弊。此外，未來之環境可能變遷，遵循內部控制制度之程度亦可能降低，故在本期有效之內部控制制度，並不表示在未來亦必有效。

#### 管理階層之責任

管理階層之責任係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關法令規章建立內部控制制度，且隨時檢討，以維持內部控制制度之設計及執行持續有效，並於評估其有效性後，據以出具內部控制制度聲明書。

## 會計師之責任

本會計師之責任係依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及確信準則 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」對確信標的及標的資訊執行必要程序以取得合理確信，並對確信標的及標的資訊在所有重大方面是否遵循適用基準及是否允當表達作成結論。

## 獨立性及品質管理規範

本會計師及所隸屬會計師事務所已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性及其他道德規範之規定，該規範之基本原則為正直、公正客觀、專業能力及專業上應有之注意、保密及專業行為。此外，本會計師所隸屬會計師事務所遵循品質管理準則 1 號「會計師事務所之品質管理」，該品質管理準則規定會計師事務所設計、付諸實行及執行品質管理制度，包含與遵循職業道德規範、專業準則及適用之法令規範相關之政策或程序。

## 所執行程序之彙總說明

本會計師係基於專業判斷規劃及執行必要程序，以獲取相關標的及標的資訊之證據。所執行之程序包括瞭解公司內部控制制度、評估管理階層評估整體內部控制制度有效性之過程、測試及評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度設計及執行之有效性，以及本會計師認為必要之其他確信程序。

## 確信結論

依本會計師意見，億而得微電子股份有限公司與外部財務報導和保障資產安全有關之重大營運循環及管理程序之內部控制制度，包括「銷售及收款循環」及「電腦資訊系統循環」於民國 112 年 9 月 30 日之設計及執行，在所有重大方面已遵循「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目可維持有效性；億而得微電子股份有限公司於民國 112 年 11 月 8 日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度係有效設計及執行之聲明書，在所有重大方面係屬允當表達。

## 勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 心



會計師 蔡 美



中 華 民 國 112 年 12 月 4 日

附件五、律師法律意見書

## 律師法律意見書

億而得微電子股份有限公司本次為申請股票創新板上市，向臺灣證券交易所股份有限公司提出申請股票創新板上市交易。經本律師採取必要審核程序，包括實地瞭解，與公司相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料，並參酌相關專家之意見等。特依臺灣證券交易所股份有限公司「有價證券上市審查準則」、「有價證券上市審查準則補充規定」、「有價證券上市作業程序」、「初次申請有價證券上市公開說明書應行記載事項準則」及「公司募集與發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」等規定，出具本律師法律意見書。

依本律師意見，億而得微電子股份有限公司本次向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票創新板上市，並未發現有違反法令致影響股票上市之情事。

此致

億而得微電子股份有限公司

律師事務所：蔚中傑律師事務所



律師：蔚中傑



中華民國 112 年 12 月 11 日

## 律師法律意見書

億而得微電子股份有限公司（以下簡稱該公司或億而得）本次為辦理現金增資募集與發行普通股 2,616 仟股，每股面額 10 元，發行總面額新臺幣 26,160 仟元整，向臺灣證券交易所股份有限公司提出申報。經本律師採取必要審核程序，包括實地瞭解，與公司董事、經理人及相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料，並參酌相關專家之意見等。特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本律師法律意見書。

依本律師意見，該公司本次向臺灣證券交易所股份有限公司提出之法律事項檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響有價證券募集與發行之情事。

此致

億而得微電子股份有限公司

蔚中傑律師事務所



蔚中傑律師



中 華 民 國 1 1 3 年 三 月 廿 五 日

註：總括申報發行新股案件應就首次發行或各次追補發行之股數、面額及總金額進行填列。

附件六、誠信聲明書

## 聲 明 書

本公司茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、以及與本公司申請創新板上市案有關之經理人、受僱人，或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

申請人：億而得微電子股份



代表人：黃文謙



中 華 民 國 一 一 二 年 十 二 月 十 一 日



## 聲 明 書

本人為億而得微電子股份有限公司之董事長暨總經理，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予億而得公司及其董事，以及與億而得公司申請創新板上市案有關之經理人、受僱人，或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

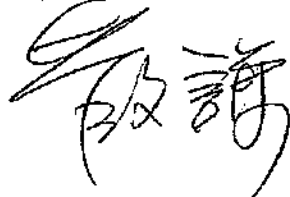
二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：黃文謙



中 華 民 國 一 一 二 年 十 二 月 十 一 日

## 聲 明 書

本人為億而得微電子股份有限公司之董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。


- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予億而得公司及其董事，以及與億而得公司申請創新板上市案有關之經理人、受僱人，或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：陳鴻文



中 華 民 國 一 一 二 年 十 二 月 十 一 日

## 聲 明 書

本人為億而得微電子股份有限公司之董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

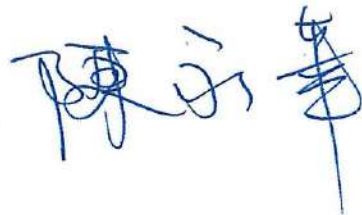
- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予億而得公司及其董事，以及與億而得公司申請創新板上市案有關之經理人、受僱人，或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：陳永華



中 華 民 國 一 一 二 年 十 二 月 十 一 日

## 聲 明 書

本人為億而得微電子股份有限公司之董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。


- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予億而得公司及其董事，以及與億而得公司申請創新板上市案有關之經理人、受僱人，或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：魏雅庵



中 華 民 國 一 一 二 年 十 二 月 十 一 日

## 聲 明 書

本人為億而得微電子股份有限公司之董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予億而得公司及其董事，以及與億而得公司申請創新板上市案有關之經理人、受僱人，或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：鄭玥姝



中 華 民 國 一 一 二 年 十 二 月 十 一 日

## 聲 明 書

本人為億而得微電子股份有限公司之獨立董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

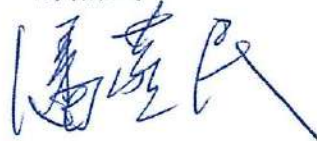
- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予億而得公司及其董事，以及與億而得公司申請創新板上市案有關之經理人、受僱人，或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：潘燕民



中 華 民 國 一 一 二 年 十 二 月 十 一 日

## 聲 明 書

本人為億而得微電子股份有限公司之獨立董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予億而得公司及其董事，以及與億而得公司申請創新板上市案有關之經理人、受僱人，或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：吳清沂



中 華 民 國 一 一 二 年 十 二 月 十 一 日

## 聲 明 書

本人為億而得微電子股份有限公司之獨立董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予億而得公司及其董事，以及與億而得公司申請創新板上市案有關之經理人、受僱人，或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

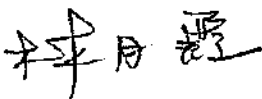
二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：林月霞



中 華 民 國 一 一 二 年 十 二 月 十 一 日



## 聲 明 書

本人為億而得微電子股份有限公司之獨立董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予億而得公司及其董事，以及與億而得公司申請創新板上市案有關之經理人、受僱人，或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：李展南



中 華 民 國 一 一 二 年 十 二 月 十 一 日

## 聲 明 書








本人為億而得微電子股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予億而得公司及其董事，以及與億而得公司申請創新板上市案有關之經理人、受僱人，或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：吳政穎		經理人：吳其沛	
經理人：陳英堂		經理人：江政璋	
經理人：陳政揚		經理人：陳香綺	
		經理人：賴盈君	

中 華 民 國 一 一 二 年 十 二 月 十 一 日

## 聲 明 書

本人為億而得微電子股份有限公司之受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予億而得公司及其董事，以及與億而得公司申請創新板上市案有關之經理人、受僱人，或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

受僱人：王承永



中 華 民 國 一 一 二 年 十 二 月 十 一 日

## 聲 明 書

本公司及本公司相關人員輔導並承銷億而得微電子股份有限公司申請有價證券於創新板上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、 本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、 知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

主辦證券承銷商：兆豐證券股份有限公司



負責人：陳佩君



中 華 民 國 112 年 12 月 11 日

# 聲 明 書

本公司及本公司相關人員輔導並承銷億而得微電子股份有限公司申請有價證券於創新板上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、 本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、 知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：凱基證券股份有限公司



負責人：方維昌



中 華 民 國 112 年 12 月 11 日

## 聲 明 書

本公司及本公司相關人員輔導並承銷億而得微電子股份有限公司申請有價證券於創新板上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

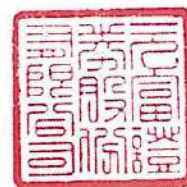
- 一、 本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、 知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：元富證券股份有限公司



董 事 長：陳俊宏



中 華 民 國 112 年 12 月 11 日

## 聲 明 書

本公司及本公司相關人員輔導並承銷億而得微電子股份有限公司申請有價證券於創新板上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、 本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、 知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：玉山綜合證券股份有限公司



負責人：林晉輝



中 華 民 國 112 年 12 月 11 日

# 聲 明 書

本公司及本公司相關人員輔導並承銷億而得微電子股份有限公司申請有價證券於創新板上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

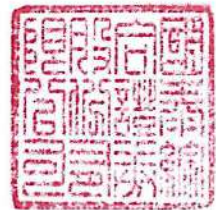
- 一、 本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、 知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：國泰綜合證券股份有限公司



負責人：莊順裕



中 華 民 國 112 年 12 月 11 日



# 聲 明 書

本律師承辦億而得微電子股份有限公司申請有價證券於創新板上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

- 一、 絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。
- 二、 知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

律師事務所：蔚中傑律師事務所



律師：蔚中傑



中 華 民 國 112 年 12 月 11 日

## 聲 明 書

本律師承辦億而得微電子股份有限公司申請有價證券於創新板上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

- 一、 絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。
- 二、 知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

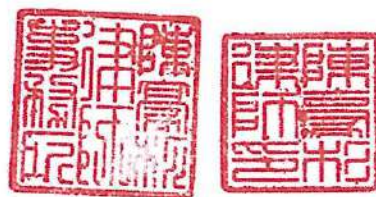
特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

律師事務所：陳豪杉律師事務所

律師：陳豪杉



中 華 民 國 112 年 12 月 11 日

## 聲 明 書

本會計師承辦億而得微電子股份有限公司申請有價證券於創新板上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

- 一、 絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。
- 二、 知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

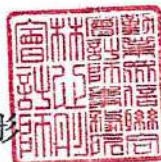
特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

會計師事務所：勤業眾信聯合會計師事務所

會計師：林 心 彤



會計師：蔡 美 貞



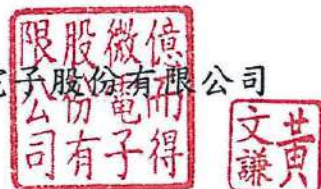
中 華 民 國 112 年 12 月 11 日

附件七、不得退還或收取承銷相關費用之聲明書

# 聲 明 書

本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十二條、第二十二條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

發行人：億而得微電子股份有限公司



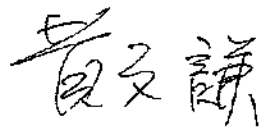
負責人：黃文謙

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 廿 五 日

# 聲 明 書

本人擔任億而得微電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之董事長暨總經理，就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

董事長暨總經理：黃文謙



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 五 日

# 聲 明 書

本人擔任億而得微電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之董事,就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案,絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為,且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等,絕無虛偽或隱匿之情事,如有上開情事者,涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定,應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

董事：陳永華



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 廿 五 日

# 聲 明 書

本人擔任億而得微電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之董事，就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

董事：陳鴻文



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十五 日



# 聲 明 書

本人擔任億而得微電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之董事，就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

董事：魏雅庵

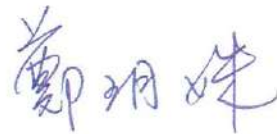


中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 五 日

# 聲 明 書

本人擔任億而得微電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之董事,就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案,絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為,且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等,絕無虛偽或隱匿之情事,如有上開情事者,涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定,應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

董事：鄭玥姝

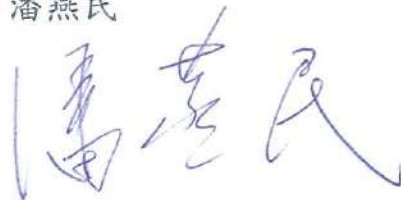


中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 五 日

# 聲 明 書

本人擔任億而得微電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之獨立董事，就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

獨立董事：潘燕民



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 伍 日

# 聲 明 書

本人擔任億而得微電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之獨立董事,就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案,絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為,且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等,絕無虛偽或隱匿之情事,如有上開情事者,涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定,應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

獨立董事：吳清沂

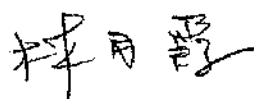


中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 廿 日

# 聲 明 書

本人擔任億而得微電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之獨立董事，就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

獨立董事：林月霞



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 恆 日

# 聲 明 書

本人擔任億而得微電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之獨立董事,就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案,絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為,且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等,絕無虛偽或隱匿之情事,如有上開情事者,涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定,應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

獨立董事：李展南



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 五 日

# 聲 明 書

本人擔任億而得微電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之財務暨會計主管，就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

財務暨會計主管：賴盈君




中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 五 日

# 聲 明 書

本人擔任億而得微電子股份有限公司(以下簡稱該公司)之經理人/受僱人，就該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及該公司於創新板上市前現金增資發行新股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：吳政穎 

經理人：吳其沛 

經理人：陳英堂 

經理人：江政璋 

經理人：陳政揚 

經理人：陳香綺 

受僱人：王承永 

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 五 日



## 聲明書

本公司受億而得微電子股份有限公司（下稱億而得公司）委託，擔任億而得公司募集與發行創新板上市前現金增資發行新股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、億而得公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

主辦證券承銷商：兆豐證券股份有限公司

負責人：陳佩君



日期：中華民國一一年三月十五日

## 聲明書

本公司受億而得微電子股份有限公司（下稱億而得公司）委託，擔任億而得公司募集與發行創新板上市前現金增資發行新股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、億而得公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。



協辦證券承銷商：凱基證券股份有限公司

負責人：方維昌



日期：中華民國一三年三月廿五日

## 聲明書

本公司受億而得微電子股份有限公司（下稱億而得公司）委託，擔任億而得公司募集與發行創新板上市前現金增資發行新股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、億而得公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

協辦證券承銷商：元富證券股份有限公司

董 事 長：陳俊宏



日 期：中華民國一一年 三 月 伍 日

## 聲明書

本公司受億而得微電子股份有限公司（下稱億而得公司）委託，擔任億而得公司募集與發行創新版上市前現金增資發行新股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、億而得公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

協辦證券承銷商：玉山綜合證券股份有限公司

代表人：林晉輝

日期：中華民國一一三年 三 月 伍 日



## 聲明書

本公司受億而得微電子股份有限公司（下稱億而得公司）委託，擔任億而得公司募集與發行創新板上市前現金增資發行新股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、億而得公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

協辦證券承銷商：國泰綜合證券股份有限公司

負責人：莊 順 裕



日期：中華民國一一年三月廿五日

附件八、不受理特定投標對象聲明書

## 聲 明 書

茲聲明本公司辦理創新板上市現金增資發行新股案件，將不受理下列對象之投標單：

- 一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
- 四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
- 八、承銷團各證券商。
- 九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。
- 十、股票申請創新板初次上市案件未具第四十三條之一第二項所訂合格投資人資格者。
- 十一、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：億而得微電子股份有限公司

負責人：黃文謙



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 五 日

## 聲 明 書

茲聲明本公司主辦億而得微電子股份有限公司創新版上市現金增資發行新股案件，將不受理下列對象之投標單：

- 一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
- 四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
- 八、承銷團各證券商。
- 九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。
- 十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：兆豐證券股份有限公司

負責人：陳佩君



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 廿 五 日



## 聲 明 書

茲聲明本公司協辦億而得微電子股份有限公司創新板上市現金增資發行新股案件，將不受理下列對象之投標單：

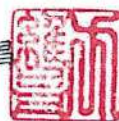
- 一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
- 四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
- 八、承銷團各證券商。
- 九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。
- 十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：凱基證券股份有限公司

負責人：方 維 昌



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 五 日

## 聲 明 書

茲聲明本公司協辦億而得微電子股份有限公司創新板上市現金增資發行新股案件，如發現競價拍賣投標之對象有下列各款之人應募時，應拒絕之：

- 一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
- 四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
- 八、承銷團各證券商。
- 九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。
- 十、股票申請創新板初次上市案件未具第四十三條之一第二項所訂合格投資人資格者。
- 十一、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：元富證券股份有限公司

董事長：陳俊宏



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 五 日

## 聲 明 書

茲聲明本公司協辦億而得微電子股份有限公司創新板上市現金增資發行新股案件，將不受理下列對象之投標單：

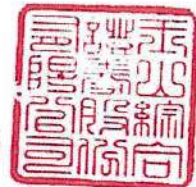
- 一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
- 四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
- 八、承銷團各證券商。
- 九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。
- 十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：玉山綜合證券股份有限公司

代表人：林 晉 輝



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 五 日

## 聲 明 書

茲聲明本公司協辦億而得微電子股份有限公司創新板上市現金增資發行新股案件，將不受理下列對象之投標單：

- 一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者、
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，  
或具有配偶關係者、
- 四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管、
- 六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶、
- 七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶、
- 八、承銷團各證券商、
- 九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。
- 十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：國泰綜合證券股份有限公司

負責人：莊 順 裕



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 五 日

附件九、無非常規交易聲明書

# 聲 明 書

本公司目前未有集團企業，未來若有集團企業，並配合營運而有財務、業務往來之情形者，將依本公司所訂之相關作業規章辦理，而無非常規交易之情事。

特此聲明

立書人：億而得微電子股份有限公司



代表人：黃文謙



中 華 民 國 一 一 二 年 十 二 月 十 一 日

附件十、證券承銷商評估總結意見

## 承銷商總結意見

億而得微電子股份有限公司本次為辦理創新板上市前現金增資發行普通股 2,616 千股，每股面額新台幣壹拾元整，合計發行總金額為新台幣 26,160 千元，依法向臺灣證券交易所股份有限公司提出申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序，包括實地了解億而得微電子股份有限公司之營運狀況，與公司董事、經理人、及其他相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證及比較分析相關資料等，予以審慎評估。特依金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，億而得微電子股份有限公司本次募集與發行有價證券符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

兆豐證券股份有限公司



負責人：陳佩君



承銷部門主管：郝振邦



中華民國一一年三月十五日



附件十一、承銷價格計算書

# 億而得微電子股份有限公司

## 承銷價格計算書

### 一、承銷總股數說明

#### (一)已發行股份總數

億而得微電子股份有限公司(以下簡稱「億而得」或「該公司」)申請股票於創新板上市時之實收資本額為新臺幣(以下同)268,100,000 元，每股面額新臺幣 10 元整，已發行股數為 26,810,000 股。該公司擬於初次申請股票於創新板上市案經主管機關審查通過後，辦理現金增資發行新股 2,354,000 股作為股票公開承銷作業之用，預計股票上市掛牌時已發行股數為 29,426,000 股及實收資本額為 294,260,000 元。

#### (二)承銷股數來源

依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第 36 條及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第 17-1 條之規定，本國發行公司初次申請普通股在創新板上市，應至少提出擬上市股份總額 5%之股份，且不得低於八十萬股，並以募集發行之普通股股票為限，全數以現金增資發行新股之方式，於扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購之股數及應提出主辦證券承銷商認購之股數後，依證券交易法第 71 條第 1 項包銷有價證券規定，全數委託證券承銷商辦理上市前公開銷售。

#### (三)過額配售

依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」第二條第一項第一款規定，本承銷商已與該公司簽訂「股票初次上市穩定承銷價格機制協議書」供證券承銷商辦理過額配售，並經 112 年 11 月 8 日董事會決議通過，由該公司協調股東提出對外公開承銷股數之 15%額度內，供證券承銷商辦理過額配售。屆時證券承銷商與該公司得依市場需求決定實際過額配售數量。

#### (四)股權分散

該公司截至 113 年 3 月 22 日止，記名股東人數共 2,910 人，公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東為 2,896 人，其所持有股份合計為 22,103,368 股，占目前已發行股份總額之 82.44%，已符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第二十九條有關股權分散之標準。

#### (五)綜上所述

該公司依擬上市股份總額之百分之八計算應提出公開承銷之股數，全數以現金增資發行新股之方式，委託本證券承銷商辦理上市前公開銷售，該現金增資案依據

「證券交易法」第 28-1 條之規定，業經 107 年 5 月 30 日股東常會通過，原股東全數放棄認購以辦理上市前公開承銷。該公司辦理現金增資發行新股 2,616,000 股，扣除依公司法第 267 條規定保留 10% 予員工優先認購之 262,000 股後，其餘 2,354,000 股全數提撥對外公開承銷。另本證券承銷商已與該公司簽訂過額配售協議，由該公司協調其股東提出對外公開銷售股數之 15% 為上限，提供已發行普通股股票供本證券承銷商辦理過額配售，屆時本證券承銷商與該公司再依市場需求決定實際過額配售數量。

## 二、承銷價格

(一)承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式及與適用國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。

### 1.承銷價格訂定所採用之方法、原則或計算方式

股票價值評估方法相當多元，各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，目前市場上常用之股票評價方法包括市場法如本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)、股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)，主係透過已公開資訊與整個市場、產業性質相近之同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業價值之依據，再根據被評量公司本身異於採樣公司之部分做折溢價之調整；成本法係以帳面之歷史成本資料作為公司價值評定基礎之淨值法為主，未考慮公司的未來獲利能力與現金流量，因此由此法所計算得出之價格尚須經過調整；此外，尚有以採用未來現金流量作為公司價值評定基礎之收益法，但此方法受限於公司未來現金流量之預估是否精確以及各項評價因子之選取是否適當，故其參考價值之高低係建立在各項參數是否精確之基礎上。茲將各類股票價值評估方法之計算方式、優缺點及適用時機，表列如下：

方法	計算方式	優點	缺點	適用時機
市場法—本益比法	依據公司之財務資料計算每股盈餘並擇取上市櫃公司或產業性質相近之同業平均本益比估算股價，最後進行溢折價調整，以允當反應受評公司與同業公司間之差異。	1.最具經濟效益與時效性，為一般投資人投資股票最常用之參考依據，具有相當之參考價值。 2.所評價之價值與市場的股價較接近。 3.較能反映市場研判多空氣氛及投資價值認定。 4.市場價格資料容易取得。	1.盈餘品質受會計方法之選擇所影響。 2.即使身處同一產業，不同公司間之本質上仍有相當差異。 3.企業虧損時不適用。	適用評估風險溢酬、成長率及股利政策穩定之公司。
市場法—股價淨值	依據公司之財務資料，計算每股淨值，	1.淨值係長期且穩定之指標。	1.帳面價值受會計方法之選擇所影響	適用於評價產業成熟型

方法	計算方式	優點	缺點	適用時機
比法	並擇取上市櫃公司或產業性質相近之同業平均股價淨值比估算股價，最後再進行溢折價調整，以允當反應受評公司與同業公司間之差異。	2.當評價公司為虧損時之替代評估方法。 3.市場價格資料容易取得。	。 2.即使身處同一產業，不同公司間之本質上仍有相當差異。	及穩定型之公司。
成本法—淨值法	以帳面之歷史成本資料為公司價值之評估基礎，即以資料負債表之帳上資產總額減去負債總額。最後，再考量資產及負債之市場價格進行帳面價值之調整，以允當反應受評公司之價值。	1.資料容易取得。 2.使用財務報表資料，較客觀公正。	1.資產帳面價值與市場價值差距甚大。 2.未考量公司經營成效之優劣。 3.不同種類資產須使用不同分析方法，且部分資產價值計算較困難。	適合用於評估如傳統產業類股或公營事業。
收益法—現金流量折現法	根據公司預估之未來年度現金流量，並佐以風險等級相稱之折現率，進行折現加總，據以評估受評公司之公司價值。	1.符合學理上對價值的推論，能依不同關鍵變數的預期來評價公司。 2.較不受會計原則或會計政策不同影響。 3.反映企業之永續經營價值，並考量企業之成長性及風險。	1.使用程序繁瑣，需估計大量變數，花費成本大且不確定性高。 2.對於投資者，現金流量觀念不易瞭解。 3.預測期間較長。	1.當可取得公司詳確的現金流量與資金成本的預測時。 2.企業經營穩定且無鉅額資本支出。

## 2.適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

### (1)採樣同業之選擇

該公司係為嵌入式非揮發性記憶體矽智財開發商，為非揮發性記憶體與數位類比功能在單一晶片之整合提供關鍵性之解決方案，綜觀目前國內上市櫃公司中，經考量比較公司之業務內容、營運模式及產品性質應用領域較為相近之上市櫃公司，選擇之採樣同業包括上櫃公司力旺電子股份有限公司(以下簡稱：力旺，股票代號：3529)，其專注於邏輯嵌入式非揮發性記憶體矽智財開發，產品涵蓋 OTP、MTP 及快閃記憶體等 SIP、上市公司晶心科技股份有限公司(以下簡稱：晶心科，股票代號：6533)，主要提供嵌入式微處理器核心 SIP 及相關軟體發展平台等，為提供第五代精簡指令集(RISC-V)處理器核心產品軟體解決方案之主要供應商之一，以及上櫃公司円星科技股份有限公司(以下簡稱：M31，股票代號：6643)，主要提供基礎元件 SIP(包含標準資料庫及記憶體編譯器)及高速介面 SIP(包含多種高速之接口 SIP)之設計開發及授權服務。上述三家公司除力旺以外，晶心科與 M31 主要產品應用之領域與產業或有不

同，惟其皆係以提供矽智財設計服務為主之公司，故選擇作為採樣同業，並進行以下分析：

## (2)市場法

- ①此法假設被評價公司之價值與同一產業類似公司間存在密切關係，因此以同一產業類似公司作為評價比較的標準，通常以已上市、櫃同業股票之本益比或股價淨值比乘上目標公司之每股稅後純益或每股淨值，計算評價目標公司之合理市價。其評價模式為：

$$\text{目標公司參考價值} = \left( \frac{V_b}{X_b} \right) \times X_a$$

$X_a$  = 目標公司之財務變數，如盈餘、帳面價值及銷售金額等

$$\left( \frac{V_b}{X_b} \right) = \text{採樣公司之市場乘數(多以本益比或股價淨值比為主)}$$

- ②以市場法計算之承銷參考價格如下：

### A.本益比法

茲就採樣同業、上市半導體類股及上市大盤最近五個月(112年11月~113年3月)之本益比區間列示如下：

單位：倍

項目 月份	上市		採樣同業		
	大盤平均	半導體業	力旺 (3529)	晶心科 (6533)	M31 (6643)
112年11月	20.48	18.27	119.57	註	69.85
112年12月	21.12	18.94	125.3	註	75.14
113年01月	21.17	19.54	129.98	註	97.41
113年02月	22.96	22.74	145.35	註	128.39
113年03月	23.53	24.90	134.52	註	119.65
平均	21.85	20.88	130.94	註	98.09

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及臺灣證券交易所網站。

註：採樣同業最近四季財報之稅後淨利為負數，故不予計算。

參酌上市大盤、上市半導體業類股及採樣公司最近五個月之平均本益比區間介於 20.88~130.94 倍之間，惟因上市大盤及半導體業類股之組成多樣，故經考量比較性後予以排除，擬選取採樣同業之本益比進行本案之價值評估，然排除最近四季財報之稅後淨利為負數之採樣同業晶心科之平均本益比後，採樣同業最近五個月之平均本益比區間約為 98.09~130.94 倍。另以該公司最近四季經會計師查核簽證之財務報告之稅後淨利 32,017 千元，及依擬上市掛牌股數 29,426 千股為基礎追溯調整計算，每股盈餘約為 1.09

元。

按上述本益比區間，並考量該公司初次上市掛牌初期之成交量及流動性風險等因素，給予 30%折價作為流動性風險貼水，計算每股參考價格區間約為 74.84~99.91 元，而證券承銷商與該公司共同議定之暫定承銷價格為 75 元，介於前述設算價格區間，應尚屬合理。

#### B.股價淨值比法

茲就採樣同業、上市半導體類股及上市大盤最近五個月(112 年 11 月~113 年 3 月)之股價淨值比區間列示如下：

單位：倍

項目 月份	上市		採樣同業		
	大盤平均	半導體業	力旺 (3529)	晶心科 (6533)	M31 (6643)
112 年 11 月	1.95	3.58	72.07	4.21	15.42
112 年 12 月	2.12	3.93	70.40	4.81	18.40
113 年 01 月	2.12	4.05	73.04	4.94	23.86
113 年 02 月	2.24	4.35	77.72	5.25	30.74
113 年 03 月	2.35	4.76	65.63	4.67	25.47
平均	2.18	4.18	70.79	4.95	23.11

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及臺灣證券交易所網站。

參酌上市大盤、上市半導體業類股及採樣公司最近五個月之平均股價淨值比，剔除偏高屬極端值之力旺後，最近五個月之平均股價淨值比約為 2.18~23.11 倍，若以該公司 112 年底經會計師查核之財務報告淨值 313,254 千元及依擬上市掛牌股數 29,426 千股計算之每股淨值 10.65 元予以估算，其價格區間約為 23.22~246.12 元，惟股價淨值比法係以歷史成本為計算依據，限制及影響因素較多，易受經營期間長短及盈餘分配政策、股東權益內容結構等非獲利性之影響，且並未考量未來成長機會，對於成長型公司較不具參考性，故證券承銷商不擬採用此方法。

#### (3)成本法

- ① 係依照國際財務報導準則將目標公司之資產價值扣除公司之負債，以獲得目標公司之價值，實務慣用衡量資產價值之方法為帳面價值法，依此法公司之價值即資產負債表之帳面淨值。其評價模式為：

$$\text{目標公司參考價格} = \frac{A_n - D_n}{S}$$

$A_n$  = 目標公司總資產帳面價值

$D_n$  = 目標公司總負債帳面價值

$S$  = 目標公司流通在外普通股總數

②以成本法計算之承銷參考價格如下：

$$P = \frac{A_n - D_n}{S}$$

$$P = (362,580 \text{ 千元} - 49,326 \text{ 千元}) / 26,810 \text{ 千股}$$

$$= 11.68 \text{ 元/股}$$

依該公司 112 年度經會計師查核之財務報表淨值 313,254 千元及上市掛牌前流通在外股數 26,810 千股計算之。

此種評價方式係以歷史成本為計算依據，無法表達資產實際經濟價值亦未考慮公司的未來獲利能力，較不具參考性，且在評定資產總額及負債總額時，尚需考慮到資產及負債之真正市價，一般而言不容易取得市價資訊，故證券承銷商與該公司未以此方法列入承銷價格議定之依據。

#### (4) 收益法-現金流量折現法

此法主要假設目標企業之價值為未來各期創造之現金流量折現值，基於對於公司之未來現金流量較難精確掌握，且部分評價因子亦較難取得適切之數據故可能無法評估公司應有價值。茲將收益法之基本假設及評估參數分述如下：

##### ① 模型介紹

現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method)係認為企業價值應為未來營運可能創造淨現金流量之現值總和，其中又以自由現金流量折現模式(Free Cash Flow Model)最能反映合理之報酬率，其計算公式如下：

$$P_0 = VE / N = (V_0 - VD) / \text{Shares}$$

$$V_0 = \sum_{t=1}^n \frac{FCFF_t}{(1+K_1)^t} + \sum_{t=n+1}^m \frac{FCFF_t}{(1+K_1)^n \times (1+K_2)^{t-n}} + \frac{FCFF_{m+1}}{(1+K_1)^n \times (1+K_2)^{m-n} (K_3 - G)}$$

$$FCFF_t = EBIT_t \times (1 - \text{tax rate}_t) + \text{Dep\&Amo}_t - \text{Capital Exp}_t - \Delta \text{NWC}_t$$

$$K_i = \frac{D}{D+E} \times K_d \times (1 - \text{tax rate}) + \frac{E}{D+E} \times K_e$$

$$K_e = R_f + \beta_j \times (R_m - R_f)$$

$P_0$  = 每股價值

$V_0$  = 企業總體價值 =  $V_E + V_D$  = 股東權益價值 + 負債價值  
(不含計入營業活動現金流量之負債)

$N$  = 擬上市(最大)股數 29,426 千股

$FCFF_t$  = 第 t 期之自由現金流量

$K_i$  = 加權平均資金成本  $i=1,2,3$

$G$	= 營業收入淨額成長率
$n$	= 5 第一階段之經營年限：112 年度~116 年度
$m$	= 10 第二階段之經營年限：117 年度~121 年度
$EBIT_t$	= 第 $t$ 期之息前稅前淨利
$tax\ rate_t$	= 第 $t$ 期之稅率
$Dep\&\ Amo_t$	= 第 $t$ 期之折舊與折耗費用
$Capital\ Exp_t$	= 第 $t$ 期之資本支出 = 第 $t$ 期之購置固定資產支出+新增長期投資支出
$\Delta\ NWC_t$	= 第 $t$ 期之淨營運資金變動需求-第 $t-1$ 期之淨營運資金 = (第 $t$ 期之流動資產-不付息流動負債)-(第 $t-1$ 期之流動資產-不付息流動負債)
$D/D+E$	= 付息負債占付息負債及權益比
$E/D+E$	= 權益占付息負債及權益比 = 1- $D/D+E$
$K_d$	= 付息負債資金成本率
$K_e$	= 權益資金成本率
$R_f$	= 無風險利率
$R_m$	= 市場平均報酬率
$\beta_j$	= 系統風險；衡量公司風險相對於市場風險之指標

② 加權平均資金成本及自由現金流量之參數設定及計算結果

項目	期間I	期間II	期間III	基本假設說明
$t$	$t \leq n, n=5$	$n+1 \leq t \leq m, m=10$	$t \geq m+1$	依據該公司狀況分為三期間： 期間 I：112~116 年 期間 II：117~121 年 期間 III：122 年後(永續經營期)
$D/(D+E)$	0.00%	0.36%	0.72%	期間 I：依該公司最近三年度之付息負債占比(付息負債+權益)平均比率計算。 期間 II：採用期間 I 及期間 III 之平均數。 期間 III：進入永續經營期後，估計對資本市場與運用應與同業相近，以採樣同業力旺、晶心科及 M31 最近期之付息負債占比(付息負債+權益)平均比率計算之平均數。
$E/(D+E)$	100.00%	99.64%	98.28%	



項目	期間I	期間II	期間III	基本假設說明
<i>Kd</i>	0.00%	0.98%	1.95%	<p>期間 I：該公司目前尚無借款之情事，預期期間I借款利率為 0%。</p> <p>期間II：採用期間 I 及期間III之平均數。</p> <p>期間III：係採用最近十年本國銀行之各季借款平均利率計算之。</p>
<i>tax rate</i>	20.00%	20.00%	20.00%	依財政部新制營利事業所得稅率 20% 估算。
<i>Rf</i>	1.507%	1.507%	1.507%	113 年 3 月 6 日證券櫃檯買賣中心公告台灣十年期以上政府公債加權平均殖利率。
<i>Rm</i>	6.266%	6.266%	6.266%	係採用 103~112 年度股票集中市場之幾何平均投資報酬率。
<i>βj</i>	1.652	1.326	1	<p>期間 I：係採用 TEJ 資料庫計算之採樣同業(力旺、晶心科及 M31)最近五年股價對集中交易市場大盤指數之風險係數，並取其平均值。</p> <p>期間II：採用期間I及期間III之平均數。</p> <p>期間III：預期永續經營期之系統風險將逐步貼近市場之系統風險，故假設為 1。</p>
<i>Ke</i>	9.37%	7.82%	6.27%	$Ke = Rf + \beta_j \times (Rm - Rf)$ 。 其中， <i>Rf</i> ：無風險報酬率； <i>Bj</i> ：類股與大盤走勢之相關係數； <i>Rm</i> ：市場風險報酬率
<i>Ki</i>	9.37%	7.79%	6.23%	加權平均資金成本 $Ki = E/(D+E) * Ke + D/(D+E) * Kd (1 - tax rate)$
G (保守)	4.93%	3.100%	0.000%	<p>期間 I：係根據國際數據資料報告預估 111-115 年全球半導體市場之複合年增長率為 4.93% 估算。</p> <p>期間II：係以國際貨幣基金預測 118 年之全球經濟成長率 3.1% 估計。</p> <p>期間III：考量永續經營，尚無法合理</p>

項目	期間I	期間II	期間III	基本假設說明
				預估成長率，故假設成長率為0。
G (樂觀)	16.37%	3.100%	3.100%	期間I：係以該公司過去三年(110~112年度)之平均營收成長率16.37%估計。 期間II：係以國際貨幣基金預測117年之全球經濟成長率3.1%估計。 期間III：係以國際貨幣基金預測117年之全球經濟成長率3.1%估計。

#### A. 保守情境

$$\begin{aligned}
 P0 &= (V0 - VD) / \text{Shares} \\
 &= \{293,442 \text{ 千元} - 0 \text{ 千元}\} / 29,426 \text{ 千股} \\
 &= 9.97 \text{ 元/股}
 \end{aligned}$$

#### B. 樂觀情境

$$\begin{aligned}
 P0 &= (V0 - VD) / \text{Shares} \\
 &= \{502,086 \text{ 千元} - 0 \text{ 千元}\} / 29,426 \text{ 千股} \\
 &= 17.06 \text{ 元/股}
 \end{aligned}$$

依據上述假設及公式，該公司依收益法(現金流量折現法)之參考價格區間為9.97元~17.06元。由於此法係以未來各期所創造現金流量之折現值合計數認定為股東權益價值，然因未來之現金流量無法精確掌握，且評價使用之相關參數亦無一致標準。在股價評價方法選擇上，考量收益法下如現金流量折現法因需推估公司未來數年之盈餘及現金流量作為評價之基礎，然而預測期間長，推估營收資料之困難度提高，不確定性風險相對高，亦不能合理評估公司應有之價值，故不擬採用此法評估。

### (二) 該公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形

#### 1. 該公司與採樣同業力旺、晶心科及M31之財務狀況

分析項目		公司名稱	110年度	111年度	112年度
財務結構	負債占資產比率(%)	億而得	13.91	15.92	13.60
		力旺	20.85	20.65	18.73
		晶心科	5.13	8.12	9.84
		M31	18.23	21.54	13.93
		同業	32.40	29.20	(註)

分析項目	公司名稱	110 年度	111 年度	112 年度
長期資金占 不動產、廠 房及設備比 率(%)	億而得	1,746.38	2,523.48	3,935.21
	力旺	553.44	675.20	648.01
	晶心科	19,787.47	6,814.61	5,117.80
	M31	247.17	326.14	368.60
	同業	425.53	561.80	(註)

資料來源：公開資訊觀測站各公司年報及經會計師查核簽證之財務報告。

註：截至評估報告出具日止，該期間之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」，尚未出具。

#### (1) 負債占資產比率

該公司 110~112 年之負債占資產比率分別為 13.91%、15.92% 及 13.60%，111 年該公司隨著獲利成長，估列之應付員工及董事酬勞增加，另因營運需求，添購新的電腦軟體等無形資產，致應付軟體費增加，111 年負債占資產比率較 110 年上升；112 年度負債占資產比率較 111 年度下降，主係該公司 112 年度營收下滑，估列之員工紅利及董事酬勞等流動負債減少所致。

與採樣公司及同業比較，該公司 110~112 年之負債占資產比率均介於採樣同業及同業平均之間，經評估尚無重大異常。

#### (2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司 110~112 年之長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為 1,746.38%、2,523.48% 及 3,935.21%，111 年長期資金占不動產、廠房及設備比率較 110 年度增加，主係該公司隨著獲利成長，股東權益也隨之增加，加上該公司未有新增重大之不動產、廠房及設備，致該比率上升；112 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率較 111 年度上升，主係該公司 112 年度未有新增重大之不動產、廠房及設備，原有資產折舊後使不動產、廠房及設備淨額進一步減少所致。

與採樣公司及同業比較，該公司 110~112 長期資金占不動產、廠房及設備比率均優於力旺、M31 及同業平均，低於晶心科。整體而言，該公司 110~112 年長期資金占不動產、廠房及設備比率皆達 100% 以上，顯示該公司長期資金尚足以支應不動產、廠房及設備之支出，經評估尚無重大異常。

整體而言，該公司最近三個會計年度之財務結構尚屬穩健。

#### 2. 該公司與採樣同業力旺、晶心科及 M31 之獲利情形

分析項目	公司名稱	110 年度	111 年度	112 年度	
獲利 能力	資產報酬率 (%)	億而得	12.03	19.14	8.25
		力旺	38.61	45.28	38.22
		晶心科	5.07	6.84	(1.86)
		M31	13.76	17.63	18.28

分析項目	公司名稱	110 年度	111 年度	112 年度
	同業	13.90	6.80	(註 2)
權益報酬率 (%)	億而得	13.71	22.49	9.68
	力旺	49.25	58.24	48.47
	晶心科	5.42	7.29	(2.08)
	M31	16.34	22.04	22.20
	同業	19.80	9.60	(註 2)
	營業利益占 實收資本額 比率(%)	億而得	16.16	29.41
力旺		166.68	243.28	226.76
晶心科		31.33	(13.66)	(53.01)
M31		99.00	116.08	128.06
同業		(註 1)	(註 1)	(註 1)
稅前純益占 實收資本額 比率(%)	億而得	16.12	30.35	14.27
	力旺	168.55	250.57	234.58
	晶心科	34.97	75.76	(19.56)
	M31	92.88	139.80	147.30
	同業	(註 1)	(註 1)	(註 1)
純益率(%)	億而得	22.94	31.80	17.09
	力旺	46.27	49.87	47.95
	晶心科	19.72	38.20	(9.62)
	M31	24.97	27.88	26.99
	同業	16.00	9.80	(註 2)
每股盈餘(元)	億而得	1.44	2.72	1.19
	力旺	14.78	21.61	19.76
	晶心科	3.59	7.03	(2.01)
	M31	8.12	12.16	12.60
	同業	(註 1)	(註 1)	(註 1)

資料來源：公開資訊觀測站各公司年報及經會計師查核簽證之財務報告

註 1：「中華民國台灣地區主要行業財務比率」未揭露該項比率。

註 2：截至評估報告出具日止，該期間之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」尚未出具。

#### (1) 資產報酬率及權益報酬率

該公司 110~112 年度資產報酬率為 12.03%、19.14%及 8.25%，權益報酬率則分別 13.71%、22.49%及 9.68%。111 年度資產報酬率及權益報酬率均較 110 年度大幅提升，主係 111 年度受惠於半導體產業成長，帶動該公司權利金收入增加，使得稅後淨利較 110 年度成長 189.15%，致 111 年度資產報酬率及

權益報酬率均較 110 年度增加；112 年度資產報酬率及權益報酬率均較 111 年度下降，主係該公司受到下游廠商調整庫存等影響，致權利金收入較 111 年度下降，使稅前損益減少所致。

與採樣公司及同業比較，110 年度資產報酬率高於晶心科、低於力旺、M31 及同業平均；111 年度高於晶心科、M31 及同業平均、低於力旺；112 年度高於晶心科、低於力旺及 M31。110 年度權益報酬率高於晶心科、低於力旺、M31 及同業平均；111 年度高於晶心科、M31 及同業平均、低於力旺；112 年度高於晶心科、低於力旺及 M31，經評估並無重大異常情事。

#### (2)營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率

該公司 110~112 年度營業利益占實收資本額為 16.16%、29.41% 及 13.08%，稅前純益占實收資本額比率則分別為 16.12%、30.35% 及 14.27%，111 年度營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率均較 110 年度上升，主係營業利益及稅前純益隨營收增加而成長所致；而 112 年度受下游廠商調整庫存之影響，該公司營收較 111 年度減少，致營業利益及稅前純益占實收資本額比率皆較 111 年度下滑。

與採樣公司及同業比較，該公司 110 年度之營業利益占實收資本額比率均低於採樣同業；111~112 年度皆高於晶心科、低於力旺、M31。而 110~111 年度之稅前純益占實收資本額比率均低於採樣同業；112 年度則高於晶心科、低於力旺、M31，經評估並無重大異常情事。

#### (3)純益率及每股盈餘

該公司 110~112 年度純益率為 22.94%、31.80% 及 17.09%，每股盈餘分別為 1.44 元、2.72 元及 1.19 元。111 年度純益率及每股盈餘均較 110 年度成長，主係營收成長，稅後淨利增加，稅後淨利成長幅度大於營收成長幅度所致；而 112 年度純益率較 111 年度下降，主係受下游廠商庫存去化之影響，使該公司收取之權利金減少，致純益率下降。

與採樣公司及同業比較，110 年度純益率高於晶心科及同業平均、低於力旺及 M31，111 年度高於 M31 及同業平均、低於力旺及晶心科，112 年度則高於晶心科、低於力旺及 M31；另在每股盈餘方面，110 及 111 年度均低於所有採樣公司，112 年度則高於晶心科、低於力旺及 M31，主係該公司整體規模尚較採樣同業小，經評估尚無重大異常。

整體而言，該公司最近三個會計年度之獲利能力應無重大異常。

#### (4)本益比

請詳本價格計算書「二、(一)、2、(2)、A.本益比法」之評估說明。

(三)議定之承銷價格參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告者，應說明專家意見或鑑價報告內容及結論

證券承銷商與該公司共同議定之承銷價格，並未委請財務專家出具意見或鑑價機構提供鑑價報告，故不適用。

(四)該公司於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價及成交量資料

該公司於興櫃市場掛牌最近一個月之平均股價及成交量資料彙總列示如下：

單位：元、股

月份	平均股價(元)	累積成交量(股)
113年3月20日~113年5月3日	120.49	5,029,525

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站。

該公司於 103 年 10 月 23 日於興櫃市場掛牌，最近一個月(113 年 3 月 20 日至 113 年 5 月 3 日)之月平均股價為 120.49 元，總成交量為 5,029,525 股。另最近一個月每日成交均價介於 116.67 元至 125.95 元，每日最高及最低成交均價差異 7.95%，尚無價格波動過大之情事。經查詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「興櫃一般板公布注意股票資訊」、「興櫃一般板處置股票資訊」及「興櫃交易時間內股價異常波動達暫停交易標準之股票查詢」，該公司非為「興櫃股票公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第 4 條規定公告為「興櫃公布注意股票」，且無「興櫃股票買賣辦法」第 11 條之 1 規定暫停交易(啟動興櫃股票市場冷卻機制)之情事，尚無發現有重大異常之情事。

(五)證券承銷商與該公司共同議定承銷價格合理性之評估意見

綜上所述，本證券承銷商經參酌國際慣用之本益比法評量，承銷價之參考價格區間為 74.84 至 99.91 元，另參酌該公司最近一個月興櫃市場之成交均價為 120.49 元。該公司初次上市前現金增資案之對外募資金額以競價拍賣之方式承銷，故依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 8 條規定，應以申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之 30 個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為最低承銷價格之上限，故暫以 113 年 3 月 11 日至 113 年 4 月 23 日興櫃有成交之 30 個營業日成交均價簡單算術平均數(120.84)之七成為上限，訂定最低承銷價格(競價拍賣底標)為 60 元，依投標價格高者優先得標，每一投標人應依其得標價格認購；另依同辦法第 16 條規定，承銷價格以競價拍賣各得標單之價格及其數量加權平均所得價格新臺幣 91.49 元為之，惟該均價高於本證券承銷商與該公司議定最低承銷價格之 1.25 倍，故每股承銷價格定以新臺幣 75 元溢價發行，尚屬合理。

發行公司：億而得微電子股份有



負責人：黃文謙



地址：新竹縣竹北市台元二街 12 號 11 樓之 2

中 華 民 國 一 一 三 年 五 月 六 日

( 僅 供 億 而 得 微 電 子 股 份 有 限 公 司 承 銷 價 格 算 書 使 用 )

主辦證券承銷商：兆豐證券股份有限公司



負責人：陳佩君



地址：台北市忠孝東路二段 95 號 3 樓

中華民國一 一 三 年 五 月 六 日

( 僅 供 億 而 得 微 電 子 股 份 有 限 公 司 承 銷 價 格 計 算 書 使 用 )



協辦證券承銷商：元富證券股份有限公司



董 事 長：陳俊宏



地 址：臺北市敦化南路二段 97 號 22 樓

中 華 民 國 一 一 三 年 五 月 六 日

( 僅 供 億 而 得 微 電 子 股 份 有 限 公 司 承 銷 價 格 計 算 書 使 用 )

協辦證券承銷商：凱基證券股份有限公司



負 責 人：總經理 方維昌

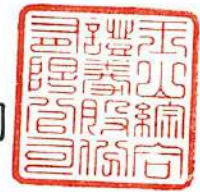


地 址：臺北市中山區明水路 700 號 3 樓

中 華 民 國 一 一 三 年 五 月 六 日

( 僅 供 億 而 得 微 電 子 股 份 有 限 公 司 承 銷 價 格 計 算 書 使 用 )

協辦證券承銷商：玉山綜合證券股份有限公司



負 責 人：陳烜台

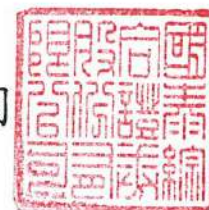


地 址：臺北市松山區民生東路三段 158 號 6 樓

中 華 民 國 一 一 三 年 五 月 六 日

(僅供億而得微電子股份有限公司承銷價格計算書使用)

協辦證券承銷商：國泰綜合證券股份有限公司



負 責 人：莊順裕



地 址：臺北市大安區敦化南路二段 333 號 20 樓

中 華 民 國 一 一 三 年 五 月 六 日

( 僅 供 億 而 得 微 電 子 股 份 有 限 公 司 承 銷 價 格 計 算 書 使 用 )

附件十二、與本次發行有關之決議文

億而得微電子股份有限公司

一〇七年第一次董事會會議記錄(節錄)

開會時間：中華民國 107 年 03 月 14 日下午 1 時 59 分

開會地點：新竹縣竹北市台元街 28 號 7 樓之 2 (本公司會議室)

出席人員：黃文謙董事長、林信章董事、陳永華董事(委託黃文謙出席)、黃定維獨立董事、黃偉能獨立董事。

列席人員：許詩佳(稽核主管)、許景揚(元富承銷輔導人員)。

請假人員：

主 席： 黃文謙



記錄：賴盈君



壹、宣布開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：略。

肆、討論事項：

- 一、上次會議保留之討論事項：無。
- 二、本次會議預定承認、討論事項

第一案~第十七案：略。

第十八案、案由：本公司擬向主管機關申請股票上市/櫃交易案，謹提請 討論。

- 說明：1.為因應未來業務發展需要、提升競爭力並吸引優秀人才，擬於適當時機向主管機關申請股票上市/櫃。
- 2.有關申請送件日期及申請送件之相關事務，授權董事長全權處理。
  - 3.謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事全數無異議照案通過。

第十九案、案由：為配合本公司申請股票上市/櫃依規定辦理現金增資發行新股作為股票初次上市/櫃公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權，並於最近期股東會提請決議，謹提請 討論。

- 說明：1.是為配合本公司申請上市/櫃時依法令規定強制以發行新股供公開承銷案，擬於主管機關規定之額度內辦理現金增資發行普通股，發行價格將依公開承銷之承銷價而定，除依公司法第 267 條規定，保留發行新股總額之 10%~15%，由本公司員工承購外，其餘發行新股總額之 85%~90%由原股東認購之股數擬請原股東放棄並全數提撥公開承銷之用；本次員工若有認購不足或放棄認購，則授權董事長洽特定人認購之。

2. 本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同，每股面額為新台幣 10 元整。
3. 本次增資發行新股案提請股東會決議通過後，授權董事長全權處理本次增資相關事宜。
4. 本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境需予以修正變更時，擬提請股東會授權董事長全權處理。
5. 依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關規定，本公司上市/櫃擬採何種承銷方式，擬提請股東會授權董事長視市場狀況決定之。
6. 謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事全數無異議照案通過。

第二十案~第二十五案：略。

伍、臨時動議：主席徵詢全數出席董監無臨時動議。

陸、散會。

會議結束時間：下午 2 時 23 分

億而得微電子股份有限公司  
一〇七年股東常會事錄節錄

時間：中華民國一〇七年五月三十日(星期三)上午9時正

地點：新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計15,994,176股，佔本公司發行總股數26,810,000股之59.65%。

主席：黃文謙



記錄：賴盈君



壹、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：略。

肆、承認事項：

第一案~第六案：略。

第七案 案由、本公司擬向主管機關申請股票上市/櫃交易案，謹提請討論。【董事會提】

說明：1. 為因應未來業務發展需要、提升競爭力並吸引優秀人才，擬於適當時機向主管機關申請股票上市/櫃。

2. 有關申請送件日期及申請送件之相關事務，授權董事長全權處理。

3. 謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第八案 案由、為配合本公司申請股票上市/櫃依規定辦理現金增資發行新股作為股票初次上市/櫃公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權案，謹提請討論。【董事會提】

說明：1. 是為配合本公司申請上市/櫃時依法令規定強制以發行新股供公開



承銷案，擬於主管機關規定之額度內辦理現金增資發行普通股，發行價格將依公開承銷之承銷價而定，除依公司法第 267 條規定，保留發行新股總額之百分之十至十五，由本公司員工承購外，其餘發行新股總額之百分之八十五至九十由原股東認購之股數擬請原股東放棄並全數提撥公開承銷之用；本次員工若有認購不足或放棄認購，則授權董事長洽特定人認購之。

2. 本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同，每股面額為新台幣 10 元整。
3. 本次增資發行新股案提請股東會決議通過後，授權董事長全權處理本次增資相關事宜。
4. 本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境需予以修正變更時，擬請股東會授權董事長全權處理。
5. 依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關規定，本公司上市/櫃擬採何種承銷方式，擬提請股東會授權董事長視市場狀況決定之。
6. 謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、選舉事項：略。

柒、討論事項二：略。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。(同日上午九點四十六分)

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要點；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準)

  
億而得微電子股份有限公司  
一一三年第一次董事會議紀錄節錄  
(第七屆第9次)

開會時間：中華民國 113 年 02 月 27 日，下午 3 時 43 分

開會地點：新竹縣竹北市台元街 28 號 7 樓之 2 (本公司會議室)。

出席人員：黃文謙董事長、陳鴻文董事(視訊)、陳永華董事、魏雅庵董事(委託出席)、鄭玗姝董事、潘燕民獨立董事、吳清沂獨立董事、林月霞獨立董事、李展南獨立董事。

列席人員：勤業林心彤會計師、蘇莉卿人事行政主管、王承永稽核主管、兆豐證券輔導人員。

請假人員：

主 席： 黃文謙



記錄：賴盈君



壹、主席宣布開會。

貳、報告事項：略。

參、討論(承認)事項：

一、上次會議保留之討論事項：無。

二、本次會議預定討論(承認)事項

第一案~第十一案：略。

第十二案、案由：擬辦理現金增資發行新股供初次申請創新版上市前公開承銷案，提請討論。【審計委員會提】

說明：1.為配合公司股票初次上市前辦理股票公開承銷之需要，業經臺灣證券交易所股份有限公司 113 年 2 月 20 日董事會通過，待本公司取得創新版上市核准函後，將辦理現金增資發行新股供創新版上市前公開承銷。

2.本次現金增資擬發行新股 2,616,000 股，每股面額新台幣 10 元整，均為普通股，暫定發行價格為每股新台幣 75 元，預計可募集金額為新台幣 196,200,000 元；惟實際上市之承銷價格，將視辦理公開承銷前股票市場狀況及向投資人競價拍賣結果，授權董事長依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

3.本次現金增資依公司法第 267 條規定，保留發行股份之 10% 計 262,000 股由員工認購，員工若認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。其餘 90% 現金增資發行新股計 2,354,000 股，依證券交易法第 28 條之 1 規定與本公司 107 年 5 月 30 日股東會之決議，現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，並由原股東放棄優先認購之權利，不受公司法第 267 條原股東按原有股份比例優先認購規定之限制，全數委託證券承銷商辦理上市前之公開承銷。另對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

4.本次辦理現金增資之資金用途為充實營運資金，現金增資資金運用計

畫、預計資金運用進度及預計可能產生效益，請參閱附件。

5. 本次現金增資發行新股之實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額及其他相關事宜，如因法令規定或因應主管機關之核定內容，及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時暨本案其他未盡事宜，擬提請董事會授權董事長全權處理之。
6. 本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
7. 本案俟董事會決議通過，向主管機關申報生效後發行之，並授權董事長辦理訂定繳款期間、增資基準日及認股發放日等與發行新股相關事宜。
8. 提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

第十三案~第十七案：略。

肆、臨時動議：主席徵詢全數出席董事無臨時動議提出。

伍、主席宣布散會。

會議結束時間：下午 4 時 9 分

附件十三、112 年度盈餘分配表

億而得微電  
子股份有限  
公司

盈餘分配表

民國112年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	2,442,761
確定福利計畫精算之再衡量數	(3,353)
112 年度淨利	32,016,629
提列法定盈餘公積 10%	(3,201,328)
本年可供分配盈餘小計	31,254,709
股東股利 - 現金 1.00 元 (26,810,000 股*1.00)	(26,810,000)
期末未分配盈餘	4,444,709
附註：	
* 配發員工酬勞 - 現金	4,672,103
* 配發董事酬勞 - 現金	1,557,368

- \* 本次優先分派 111 年度盈餘。
- \* 本案提請股東會通過後，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- \* 本次現金股利配發至元為止(元以下無條件全捨)，其分配不足一元之畸零款合計數，擬列入公司其他收入項下。

董事長：黃文謙



經理人：黃文謙



主辦會計：賴盈君



附件十四、最新公司章程及新舊條文對照表

# 億而得微電子股份有限公司



## 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為億而得微電子股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

一、CC01080 電子零組件製造業。

二、F119010 電子材料批發業。

三、F219010 電子材料零售業。

四、I501010 產品設計業。

五、F401010 國際貿易業。

六、F601010 智慧財產權業。

七、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司得為對外保證業務，有關背書保證事項均依「背書保證作業程序」之規定施行之，該程序若有未盡事宜，將依相關法令規定辦理。

第三條：本公司設總公司於新竹縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第三條之一：本公司得對外投資，且投資總額得不受公司法第十三條不得逾實收股本百分之四十之限制，投資金額授權董事會決定。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

## 第二章 股 份

第五條：本公司資本額定為新台幣肆億元整，分為肆仟萬股。

每股金額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。前項資本額保留

肆仟伍佰萬元整發行員工認股權憑證，分為肆佰伍拾萬股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。

第六條：刪除。

第七條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司股票經辦理公開發行後，依法得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前一個月內，股東臨時開會前十五日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。本公司公開發行股票後辦理第一項股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，不得為之。

第八條之一：本公司發行認股價格不受「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十三條規定限制之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。

本公司依公司法發行員工認股權憑證，其發給對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定。

本公司依公司法發行限制員工權利新股之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定。

第八條之二：本公司收買股份時，得經董事會決議依法令規定為之。

本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於市價（每股淨值）之認股價格發行之員工認股權憑證，應送請股東會同意且應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。

本公司依法收買股份轉讓於員工，其轉讓之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定。

### 第三章 股東會

第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。

第九條之一：股東常會之召集應於三十日前，股東臨時會之召集應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東並公告之。股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。

第九條之二：本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。本公司股票公開發行後，股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十一條：除相關法令另有規定者外，本公司股東每股有一表決權。

第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表以發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決全過半數之同意行之。

依主管機關規定，本公司應將電子方式列為股東會行使表決權的管道之一，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第十二條之一：本公司股票公開發行後，擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於上市(上櫃、興櫃)期間，均不變動此條文。

### 第四章 董事及審計委員會

第十三條：本公司設有董事七至十一人，董事人數授權由董事會議定之。董事之選舉採候選人提名制度，任期為三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。本公司董事之選舉採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事，該方法有修正之必要時，除應依公司法第172條等規定辦理外，應於召集事由中列舉並說明其主要內容。

候選人提名方式依公司法第192條之1規定辦理。

第十三條之一：本公司公開發行股票後，配合證券交易法第14-2條之規定，本公司上述董



事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一；採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項依證券主管機關之相關規定。

第十三條之二：本公司得於董事任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第十三條之三：董事缺額達三分之一、獨立董事均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。除董事全面改選之情況外，其任期以補原任之期限為限。

第十三條之四：本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成，其職權行使及相關事項悉依相關法令辦理。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。董事會得以視訊畫面為之，董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

本公司召集董事會時，應載明開會時間、地點、召集事由、出席及列席人員，於開會七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集通知得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真文件方式為之。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十五條之一：董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得依公司法第二百零五條規定出具委託書委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。

第十六條：全體董事之報酬由股東會議定之，不論營業盈虧得參酌同業通常水準支給之。

## 第五章 經理人

第十七條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條辦理。

## 第六章 會計

第十八條：本公司之會計年度自每年元月一日起至十二月三十一日止。每一會計年度終了，董事會應編造下列表冊依法定程序提交股東常會，請求承認。

- (一) 營業報告書
- (二) 財務報表
- (三) 盈餘分派或虧損撥補之議案

第十九條：刪除。

第二十條：本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥：

- 一、董事酬勞不高於百分之五。
- 二、員工酬勞百分之五至百分之十五。

但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議之，並報告股東會。

第二十條之一：本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補以往虧損(包括調整未分配盈餘金額)，次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣後盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具分配案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部分，以發放現金方式為之，並報告股東會。

本公司授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將法定盈餘公積及資本公積之全部或一部分，以發放現金方式為之，並報告股東會。

第二十條之二：授權董事會於可供分配盈餘0%至100%之額度範圍內，視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分配案，提報股東會。每年發放現金股利之比例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十。

## 第七章 附 則

第二十一條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第二十二條：本章程訂立於民國九十年八月二十四日。

第一次修正於民國九十年十一月二十三日。

第二次修正於民國九十一年六月二十六日。

第三次修正於民國九十三年六月二十八日。

第四次修正於民國九十三年七月九日。

第五次修正於民國九十三年十二月三日。

第六次修正於民國九十五年六月二十二日。

第七次修正於民國九十六年六月二十二日。

第八次修正於民國九十七年六月二十日。

第九次修正於民國九十九年六月二十三日。

第十次修正於民國一〇一年十二月十日。

第十一次修正於民國一〇二年七月二十三日。

第十二次修正於民國一〇四年六月九日。

第十三次修正於民國一〇五年六月十四日。

第十四次修正於民國一〇六年六月八日。

第十五次修正於民國一〇七年五月三十日。

第十六次修正於民國一〇七年十二月二十日。

第十七次修正於民國一一一年六月二十三日。

第十八次修正於民國一一二年六月六日。

億而得微電子股份有限公司



董事長：黃文謙

億而得微電子股份有限公司  
章程修訂條文對照表

	修訂後條文	原條文	修正說明
第十二條	<p>股東會之決議除公司法另有規定外應有代表以發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決全過半數之同意行之。</p> <p>依主管機關規定，本公司應將電子方式列為股東會行使表決權的管道之一，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。</p>	<p>股東會之決議除公司法另有規定外應有代表以發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決全過半數之同意行之。議案，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。</p> <p>依主管機關規定，本公司上市(櫃)後，電子方式為本公司股東會行使表決權的管道之一，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。</p>	<p>依主管機關將現行上市(櫃)公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，擴大至興櫃公司投票亦須包括電子方式，並自 112 年起實施。</p>
第二十條之	<p>本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補以往虧損(包括調整未分配盈餘金額)，次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣後盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具分配案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</p> <p><u>本公司授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部分，以發放現金方式為之，並報告股東會。</u></p> <p><u>本公司授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將法定盈餘公積及資本公積之全部或一部分，以發放現金方式為之，並報告股東會。</u></p>	<p>本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補以往虧損(包括調整未分配盈餘金額)，次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣後盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具分配案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</p>	<p>修訂盈餘採年度分配時之決議程序。</p>
第二十二條	<p>本章程訂立於民國九十年八月二十四日。</p> <p>(略)</p> <p>第十六次修正於民國一〇七年十二月二十日。</p> <p>第十七次修正於民國一一一年六月二十三日。</p> <p>第十八次修正於民國一一二年六月六日。</p>	<p>本章程訂立於民國九十年八月二十四日。</p> <p>(略)</p> <p>第十六次修正於民國一〇七年十二月二十日。</p> <p>第十七次修正於民國一一一年六月二十三日。</p>	<p>新增修訂日期。</p>

附件十五、股票初次申請創新板上市證券承銷商評估報告

# 億而得微電子股份有限公司

## 股票初次申請創新板上市 證券承銷商評估報告 (稿本)

主辦推薦承銷商：兆豐證券股份有限公司



協辦推薦承銷商：元富證券股份有限公司



凱基證券股份有限公司



玉山綜合證券股份有限公司



國泰綜合證券股份有限公司



中華民國 一 一 二 年 十 二 月 十 一 日

## 發行人之產業、營運及其他重要風險

### 一、產業風險：產業前景看好，競爭者推出競品

由於晶片設計複雜度伴隨終端產品新型應用與日俱增，嵌入式 MTP SIP 技術具備可多次編寫之特性及成本競爭優勢，將吸引許多記憶體 SIP 設計服務供應商加快於 MTP SIP 市場開發腳步，進而推出競爭品項，未來矽智財產業之競爭亦將更顯激烈。

#### 因應對策：

考量邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體 SIP 之優劣特性，與基本單元(cell)架構有直接關係，且嵌入式 OTP SIP 開發經驗值並非可直接套用於嵌入式 MTP SIP 上，該公司目前已站穩 MTP SIP 研發經驗及技術領先優勢，未來將持續開發適用各項製程之 MTP SIP 產品，並持續縮小非揮發性元件面積，擴大產品規格領先優勢及應用市場，以滿足客戶需求並區隔競爭市場。

### 二、營運風險

#### (一)非揮發性記憶體 SIP 領域人才尋找不易

矽智財設計產業為典型之知識經濟，隨著 IC 設計產業蓬勃發展，種類繁多之非揮發性記憶體於市場中相繼出現，惟目前在此領域資深且專業之人才難覓，如何培養優秀之研發技術人員及減低人才流失之風險將會是 SIP 設計公司成就與否之關鍵因素，亦為永續經營之必要條件。

#### 因應對策：

該公司透過計劃性長期培訓公司員工，提供公司內部專業訓練並於半導體專業機構或學校接受教育訓練，透過產學合作學習知識培養專業人才，並透過辦理現金增資供員工認購，使員工成為股東，分享公司成果，藉此吸引員工及留住人才並增強向心力。

#### (二)外幣計價比率高，匯率波動影響獲利

該公司係提供嵌入式非揮發性記憶體技術之 SIP 技術授權與設計服務，銷售地區主要為臺灣、中國大陸、新加坡及韓國，惟應客戶要求多以美金為計價幣別，因此美金匯率變動將對該公司之營收及獲利造成影響。

#### 因應對策：

該公司之財務單位與各銀行之外匯部門保持密切聯繫，並隨時蒐集市場匯率變化之相關資訊，充分掌握國內外匯率走勢及變化資訊，以降低匯率變動所產生之負面影響。該公司之業務單位進行報價前，會先行對未來之匯率走勢及影響匯率之因素做綜合考量及評估，以決定適當且合理之報價，降低

因交易而產生之匯兌風險，以保障公司之合理利潤。

### 三、其他重要風險

請詳證券承銷商評估報告「貳、二、發行公司營運風險」說明。

綜上所述，就該公司所面臨之產業風險、營運風險及其他重要風險及其因應對策予以評估，該公司已具備降低風險之能力，其因應對策尚屬穩當。

# 億而得微電子股份有限公司

## 評估報告目錄

<b>壹、評估報告總評</b> .....	<b>1</b>
一、承銷總股數說明 .....	1
二、承銷價格 .....	2
三、承銷風險因素 .....	10
四、總結.....	12
<b>貳、產業狀況及營運風險</b> .....	<b>15</b>
一、發行公司所屬行業營運風險.....	15
二、發行公司營運風險.....	23
<b>參、業務狀況</b> .....	<b>51</b>
一、營業概況 .....	51
二、存貨概況 .....	65
三、最近期及最近二個會計年度之業績概況 .....	66
四、併購他公司尚未屆滿一個完整會計年度者，評估併購之目的、效益、交易合理性等因素.....	72
<b>肆、財務狀況</b> .....	<b>72</b>
一、列表並說明最近期及最近二個會計年度財務比率之分析，與同類別上市公司及未上市同業財務比率之比較分析，應包括財務結構、償債能力、經營能力及獲利能力.....	72
二、發行公司及其各子公司(包括母子公司間交易事項)之最近期及最近二個會計年度背書保證、重大承諾及資金貸與他人、衍生性商品交易及重大資產交易之情形，並評估其對發行公司財務狀況之影響.....	86
三、申請公司申請年度截至最近期之擴廠計畫及資金來源、工作進度、預計效益，並評估其可行性.....	87
四、發行公司及其各子公司(包括母子公司間交易事項)之轉投資事業.....	87
五、承銷商依臺灣證券交易所股份有限公司「證券承銷商辦理股票初次申請上市案之評估查核程序」第六條規定實地輔導發行公司之重要子公司者，應列示是否有重大營運風險或其他重大異常情事之評估意見.....	88
六、評估發行公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至之員工認股權憑證採內含價值法，於發行公司股票上市後對財務報表可能之影響 .....	88



七、公營事業申請股票上市時，其檢送之財務報告有未經會計師簽證者，應洽會計師就如適用一般公認會計原則與審計機關審定數之差異，及其對財務報告之影響表示意見.....	88
八、金融事業申請股票上市，應列明其備抵提列情形，並評估其是否足額 .....	88
九、承銷商應評估外國發行公司依註冊地國法令規定發行之員工認股權憑證及其股權性質有價證券之發行辦法合理性暨對股東權益之影響 .....	88
伍、承銷商得視發行公司所營事業性質，委請在技術、業務，財務等各方面具備專業知識及豐富經驗之專家，就發行公司目前營運狀況及未來發展，進行比較分析，並本獨立公正立場出具審查意見，俾利評估 .....	88
陸、法令之遵循及對本國發行公司營運影響由承銷商洽律師對本國發行公司、現任董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責最近三年內就下列事項出具意見後，依據其意見承銷商評估對本國發行公司營運影響及因應之道，並說明影響此次承銷之因素 .....	88
一、發行公司是否違反相關法令規章.....	89
二、董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人等相關人員是否違反相關法令，致使有違誠信原則或影響職務之行使.....	89
三、是否違反著作權、專利權、商標權或其他智慧財產權.....	89
四、繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件.....	89
五、重大勞資糾紛或污染環境事件.....	90
柒、列明本國發行公司有無「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第九條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見；或外國發行公司或其從屬公司有無同準則第二十八條之八各款所列不宜上市情事之評估意見；或申請創板上市之發行公司有無同準則第三十一條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見。評估有無同準則第九條第一項第十一款第二目、第二十八條之八第七款第二目或第三十一條第一項第十款第二目規定情事。列明發行公司設置之獨立董事及薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦理之評估意見。 .....	90
一、列明依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第三十一條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見.....	90
二、列明發行公司設置之獨立董事及薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦理之評估意見 .....	90
捌、評估是否符合特定行業或組織型態公司之上市規定 .....	92
一、評估是否符合集團企業申請股票上市之規定 .....	92

二、評估是否符合「臺灣證券交易所股份有限公司上市審查準則」第十六條規定之公司申請股票上市.....	96
三、評估是否符合控股公司、金融控股公司、或其他特定組織型態公司申請上市之有關規定.....	96
玖、評估發行公司是否依本公司「初次申請有價證券上市公開說明書應行記載事項準則」規定，於其公開說明書允當表達其推動永續發展執行情形。評估發行公司公司治理評鑑自評報告是否允當表達其公司治理運作情形.....	96
拾、對上列各項目有關證券承銷商評估報告完成日起，截至股票上市契約生效日之前一日止之期後事項，應隨時加以更新說明與評估；於股票上市用公開說明書刊印日前，如有重大期後事項，亦應加以更新說明與評估.....	98
拾壹、以投資控股公司或金融控股公司申請股票上市者，承銷商應就被控股公司或其子公司之所營事業性質，依第四、五、六、八、九、十一及十二條等規定進行評估，出具各被控股公司或子公司之審查意見，再憑以出具綜合彙總意見....	98
拾貳、本國上市(櫃)公司之海外子公司申請其股票第一上市者，承銷商應評估本國上市(櫃)公司決策過程之適法性、對其營運及財務狀況是否有重大不利之影響，及擬採行之因應措施.....	98
拾參、其他補充揭露事項.....	98
附件一、「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第三十一條第一項各款所列不宜上市情事之承銷商審查意見.....	99

## 壹、評估報告總評

### 一、承銷總股數說明

#### (一)承銷前後流通在外股數

億而得微電子股份有限公司(以下簡稱「億而得」或「該公司」)申請股票於創新板上市時之實收資本額為新臺幣(以下同)268,100,000 元，每股面額新臺幣 10 元整，已發行股數為 26,810,000 股。該公司擬於初次申請股票於創新板上市案經主管機關審查通過後，辦理現金增資發行新股 1,676,000 股作為股票公開承銷作業之用，預計股票上市掛牌時已發行股數為 28,486,000 股及實收資本額為 284,860,000 元。

#### (二)公開承銷股數來源

##### 1.現金增資發行新股

依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第 36 條及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第 17-1 條之規定，本國發行公司初次申請普通股在創新板上市，應至少提出擬上市股份總額 5%之股份，且不得低於八十萬股，並以募集發行之普通股股票為限，全數以現金增資發行新股之方式，於扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購之股數及應提出主辦證券承銷商認購之股數後，依證券交易法第 71 條第 1 項包銷有價證券規定，全數委託證券承銷商辦理上市前公開銷售。依上述規定，該公司預計辦理現金增資發行新股 1,676,000 股，占擬上市股份總額 28,486,000 股之 5.88%，並依公司法第 267 條之規定，保留發行股份之 10~15%，計 168,000~251,000 股供員工認購，其餘 1,425,000 股~1,508,000 股則依證券交易法第 28-1 條之規定，業經 107 年 5 月 30 日股東常會決議通過由原股東全數放棄認購以辦理上市前公開承銷作業，排除公司法第 267 條第 3 項原股東優先認購之適用，全數委託證券承銷商辦理上市前公開銷售。

##### 2.過額配售

本承銷商已與該公司簽訂「股票初次上市穩定承銷價格機制協議書」供證券承銷商辦理過額配售，並經 112 年 11 月 8 日董事會決議通過，由該公司協調股東提出對外公開承銷股數之 15%額度內，供本證券承銷商辦理過額配售。屆時本證券承銷商與該公司得依市場需求決定實際過額配售數量。

### (三)股權分散標準

該公司截至 112 年 9 月 24 日止，記名股東人數共 2,548 人，公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東為 2,535 人，其所持有股份合計為 22,108,368 股，占目前已發行股份總額之 82.46%，已符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第二十九條有關股權分散之標準。

## 二、承銷價格

### (一)承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式及與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

#### 1.承銷價格訂定所採用之方法、原則或計算方式

股票價值評估方法相當多元，各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，目前市場上常用之股票評價方法包括市場法如本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)、股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)，主係透過已公開資訊與整個市場、產業性質相近之同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業價值之依據，再根據被評量公司本身異於採樣公司之部分做折溢價之調整；成本法係以帳面之歷史成本資料作為公司價值評定基礎之淨值法為主，未考慮公司的未來獲利能力與現金流量，因此由此法所計算得出之價格尚須經過調整；此外，尚有以採用未來現金流量作為公司價值評定基礎之收益法，但此方法受限於公司未來現金流量之預估是否精確以及各項評價因子之選取是否適當，故其參考價值之高低係建立在各項參數是否精確之基礎上。茲將各類股票價值評估方法之計算方式、優缺點及適用時機，表列如下：

方法	計算方式	優點	缺點	適用時機
市場法 — 本益比法	依據公司之財務資料計算每股盈餘並擇取上市櫃公司或產業性質相近之同業平均本益比估算股價，最後進行溢折價調整，以允當反應受評公司與同業公司間之差異。	1. 最具經濟效益與時效性，為一般投資人投資股票最常用之參考依據，具有相當之參考價值。 2. 所評價之價值與市場的股價較接近。 3. 較能反映市場研判多空氣氛及投資價值認定。 4. 市場價格資料	1. 盈餘品質受會計方法之選擇所影響。 2. 即使身處同一產業，不同公司間之本質上仍有相當差異。 3. 企業虧損時不適用。	適用評估風險溢酬、成長率及股利政策穩定之公司。

方法	計算方式	優點	缺點	適用時機
		容易取得。		
市場法 — 股價淨 值比法	依據公司之財務資料，計算每股淨值，並擇取上市櫃公司或產業性質相近之同業平均股價淨值比估算股價，最後再進行溢折價調整，以允當反應受評公司與同業公司間之差異。	1. 淨值係長期且穩定之指標。 2. 當評價公司為虧損時之替代評估方法。 3. 市場價格資料容易取得。	1. 帳面價值受會計方法之選擇所影響。 2. 即使身處同一產業，不同公司間之本質上仍有相當差異。	適用於評價產業成熟型及穩定型之公司。
成本法 — 淨值法	以帳面之歷史成本資料為公司價值之評估基礎，即以資料負債表之帳上資產總額減去負債總額。最後，再考量資產及負債之市場價格進行帳面價值之調整，以允當反應受評公司之價值。	1. 資料容易取得。 2. 使用財務報表資料，較客觀公正。	1. 資產帳面價值與市場價值差距甚大。 2. 未考量公司經營成效之優劣。 3. 不同種類資產須使用不同分析方法，且部分資產價值計算較困難。	適合用於評估如傳統產業類股或公營事業。
收益法 — 現金流 折現法	根據公司預估之未來年度現金流量，並佐以風險等級相稱之折現率，進行折現加總，據以評估受評公司之公司價值。	1. 符合學理上對價值的推論，能依不同關鍵變數的預期來評價公司。 2. 較不受會計原則或會計政策不同影響。 3. 反映企業之永續經營價值，並考量企業之成長性及風險。	1. 使用程序繁瑣，需估計大量變數，花費成本大且不確定性高。 2. 對於投資者，現金流量觀念不易瞭解。 3. 預測期間較長。	1. 當可取得公司的詳確的現金流量與資金成本的預測時。 2. 企業經營穩定且無鉅額資本支出。

該公司主要從事嵌入式非揮發性記憶體矽智財技術之研發及授權服務，近年伴隨智慧物聯技術及電動車等趨勢題材帶動下，該公司以創新技術為出發點，提供客戶高性價比及客製化之最佳嵌入式記憶體矽智財解決方案，積極朝往智慧電力及車用電子等利基型領域發展。該公司目前 MTP 技術主要應用於家電、通訊設備、車規及消費性電子等產品，隨著製程設計平台陸續驗證完成，產品功能、品質、成本為客戶所認同，產品陸續量產將致權利金收入增長，屬成長型類股，故在評估該公司股價時，由於「股價淨值比法」及「淨值法」係採用歷史性財務資料作為評量企業價值之依據，並不足以反應成長性股票未來之獲利狀況；同時，因收益法須對公司未來盈

餘及現金流量能精確估計且預測期間較長，惟產業快速變化之特性使對未來之預估更具不確定性，較無法合理評估公司應有之價值，故在相關參數之參考價值相對較低下，國內實務上較少採用，故本證券承銷商不擬採用上述評價方法。考量各評價方法之優缺點、市場慣用方式及投資者之認同度，本證券承銷商主係參考市場法之本益比法所推算之承銷價格，復參酌該公司所屬產業未來前景、發行市場環境及同業之市場狀況等，採用多項因素以綜合考量該公司承銷參考價格之訂定依據，實際承銷價格將於辦理股票上市前公開承銷時，視當時整體經濟環境、產業前景、市場供需變化、公司營運狀況及其最近期財務報告等資訊，依採行之承銷方式發現市場合理價格後，由本證券承銷商與該公司另行議定合理之承銷價格。

## 2. 適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

### (1) 採樣同業之選擇

該公司係為嵌入式非揮發性記憶體矽智財開發商，為非揮發性記憶體與數位類比功能在單一晶片之整合提供關鍵性之解決方案，綜觀目前國內上市櫃公司中，經考量比較公司之業務內容、營運模式及產品性質應用領域較為相近之上市櫃公司，選擇之採樣同業包括上櫃公司力旺電子股份有限公司(以下簡稱：力旺，股票代號：3529)，其專注於邏輯嵌入式非揮發性記憶體矽智財開發，產品涵蓋 OTP、MTP 及快閃記憶體等 SIP、上市公司晶心科技股份有限公司(以下簡稱：晶心科，股票代號：6533)，主要提供嵌入式微處理器核心 SIP 及相關軟體發展平台等，為提供第五代精簡指令集(RISC-V)處理器核心產品軟硬體解決方案之主要供應商之一，以及上櫃公司円星科技股份有限公司(以下簡稱：M31，股票代號：6643)，主要提供基礎元件 SIP(包含標準資料庫及記憶體編譯器)及高速介面 SIP(包含多種高速之接口 SIP)之設計開發及授權服務。上述三家公司除力旺以外，晶心科與 M31 主要產品應用之領域與產業或有不同，惟其皆係以提供矽智財設計服務為主之公司，故選擇作為採樣同業，並進行以下分析：

### (2) 市場法

- ① 此法假設被評價公司之價值與同一產業類似公司間存在密切關係，因此以同一產業類似公司作為評價比較的標準，通常以已上市、櫃同業股票之本益比或股價淨值比乘上目標公司之每股稅後純益或每股淨值，計算評價目標公司之合理市價。其評價模式為：

$$\text{目標公司參考價值} = \left( \frac{V_b}{X_b} \right) \times X_a$$

$X_a$  = 目標公司之財務變數，如盈餘、帳面價值及銷售金額等

$$\left(\frac{V_b}{X_b}\right) = \text{採樣公司之市場乘數(多以本益比或股價淨值比為主)}$$

②以市場法計算之承銷參考價格如下：

A.本益比法

單位：倍

月份 \ 項目	上市		採樣同業		
	大盤平均	半導體業	力旺 (3529)	晶心科 (6533)	M31 (6643)
112年9月	17.79	14.61	101.61	註	63.60
112年10月	17.53	15.08	112.28	註	64.80
112年11月	20.48	18.27	119.57	註	69.85
平均	18.60	15.99	111.15	註	66.08

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及臺灣證券交易所網站。

註：採樣同業最近四季財報之稅後淨利為負數，故不予計算。

參酌上市大盤、上市半導體業類股及採樣公司最近三個月之平均本益比區間介於 15.99~111.15 倍之間，惟因上市大盤及半導體業類股之組成多樣，故經考量比較性後予以排除，擬選取採樣同業之本益比進行本案之價值評估，然排除最近四季財報之稅後淨利為負數之採樣同業晶心科之平均本益比後，採樣同業最近三個月之平均本益比區間約為 66.08~111.15 倍。另以該公司最近四季(111年第四季~112年前三季)經會計師查核簽證或核閱之財務報告之稅後淨利 43,987 千元，及依擬上市掛牌股數 28,486 千股為基礎追溯調整計算，每股盈餘約為 1.54 元。

按上述本益比區間，並考量該公司初次上市掛牌初期之成交量及流動性風險等因素，給予 20%折價作為流動性風險貼水，計算每股參考價格區間約為 81.41~136.94 元，而本證券承銷商與該公司共同議定之暫定承銷價格為 100 元，介於前述設算價格區間，尚屬合理。

B.股價淨值比法

單位：倍

月份 \ 項目	上市		採樣同業		
	大盤平均	半導體業	力旺 (3529)	晶心科 (6533)	M31 (6643)
112年9月	2.00	3.53	67.82	4.30	15.14
112年10月	1.95	3.58	72.07	4.21	15.42
112年11月	2.05	3.79	67.18	5.07	17.09
平均	2.00	3.63	69.02	4.53	15.88

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及臺灣證券交易所網站。

參酌上市大盤、上市半導體業類股及採樣公司最近三個月之平均股價淨值比，剔除偏高屬極端值之力旺後，最近三個月之平均股價淨值比約為 2.00~15.88 倍，若以該公司 112 年 9 月底經會計師核閱之財務報告淨值 310,314 千元及依擬上市掛牌股數 28,486 千股計算之每股淨值 10.89 元予以估算，其價格區間約為 21.78~172.93 元，惟股價淨值比法係以歷史成本為計算依據，限制及影響因素較多，易受經營期間長短及盈餘分配政策、股東權益內容結構等非獲利性之影響，且並未考量未來成長機會，對於成長型公司較不具參考性，故本證券承銷商不擬採用此方法。

### (3)成本法

- ①係依照國際財務報導準則將目標公司之資產價值扣除公司之負債，以獲得目標公司之價值，實務慣用衡量資產價值之方法為帳面價值法，依此法公司之價值即資產負債表之帳面淨值。其評價模式為：

$$\text{目標公司參考價格} = \frac{A_n - D_n}{S}$$

$A_n$  = 目標公司總資產帳面價值

$D_n$  = 目標公司總負債帳面價值

$S$  = 目標公司流通在外普通股總數

- ②以成本法計算之承銷參考價格如下：

$$P = \frac{A_n - D_n}{S}$$

$$\begin{aligned} P &= (370,966 \text{ 千元} - 60,652 \text{ 千元}) / 28,486 \text{ 千股} \\ &= 10.89 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

依該公司 112 年前三季經會計師核閱之財務報告每股淨值為 10.89 元，即為依成本法計算之參考價格，惟由於此法未考慮公司未來獲利能力與現金流量，因此由此法所計算得出之價格尚需經過調整，故較不具有參考性。

### (4)收益法-現金流量折現法

收益法係同時考慮實質現金及貨幣之時間價值來進行估算，此法主要假設目標企業之價值為未來各期創造之現金流量的折現值，以其加權平均資金成本作為折現率，將目標企業未來各期預期產生的現金流量予以折現後，即可得到目標企業之總體價值。基於未來現金流量及加權平均資金成



本無法精確掌握，且適切的評價因子難求，在相關參數之參考價值相對較低下，故未採用此方法列入承銷價格議定之依據。

①模型介紹

收益法之理論依據，係認為企業價值應等於未來營運可能創造淨現金流量之現值總和，在多種理論模型中，以自由現金流量折現模式(Free Cash Flow Model)最能反映投資人之報酬率，其計算公式如下：

$$P_0 = V_E / N = (V_0 - V_D) / \text{Shares}$$

$$V_0 = \sum_{t=1}^n \frac{FCFF_t}{(1+K_1)^t} + \sum_{t=n+1}^m \frac{FCFF_t}{(1+K_1)^n \times (1+K_2)^{t-n}} + \frac{FCFF_{m+1}}{(1+K_1)^n \times (1+K_2)^{m-n} (K_3 - G)}$$

$$FCFF_t = EBIT_t \times (1 - \text{tax rate}_t) + \text{Dep\&Amo}_t - \text{Capital Exp}_t - \Delta NWC_t$$

$$K_i = \frac{D}{D+E} \times K_d \times (1 - \text{tax rate}) + \frac{E}{D+E} \times K_e$$

$$K_e = R_f + \beta_j \times (R_m - R_f)$$

$P_0$	=	每股價值
$V_0$	=	企業總體價值 = $V_E + V_D$ = 股東權益價值 + 負債價值
$N$	=	擬上市股數 28,486 千股
$FCFF_t$	=	第 t 期之自由現金流量
$K_i$	=	加權平均資金成本 $i=1,2,3$
$G$	=	營業收入淨額成長率
$n$	=	5 第一階段之經營年限：112 年度~116 年度
$m$	=	10 第二階段之經營年限：117 年度~121 年度
$EBIT_t$	=	第 t 期之息前稅前淨利
$\text{tax rate}_t$	=	第 t 期之稅率
$\text{Dept\&Amo}_t$	=	第 t 期之折舊與攤銷費用
$\text{Capital Exp}_t$	=	第 t 期之資本支出
	=	第 t 期之購置固定資產支出
$\Delta NWC_t$	=	第 t 期之淨營運資金變動數 - 第 t-1 期之淨營運資金
	=	(第 t 期之流動資產 - 不付息流動負債) - (第 t-1 期之流動資
$D/(D+E)$	=	付息負債占付息負債及權益比
$E/(D+E)$	=	權益資產比 = $1 - D/(D+E)$
$K_d$	=	負債資金成本率
$K_e$	=	權益資金成本率
$R_f$	=	無風險利率
$R_m$	=	市場平均報酬率
$\beta_j$	=	系統風險；衡量公司風險相對於市場風險之指標

②加權平均資金成本及自由現金流量之參數設定及計算結果

項目	期間I	期間II	期間III	基本假設說明
$t$	$t \leq n, n=5$	$n+1 \leq t \leq m, m=10$	$t \geq m+1$	依據該公司狀況分為三期間： 期間 I：112~116 度 期間 II：117~121 年度 期間 III：122 年度後(永續經營期)
$D/(D+E)$	0.00%	0.36%	0.72%	期間 I：依該公司最近三年度及最近期之付息負債占比(付息負債+權益)平均比率計算。 期間 II：採用期間 I 及期間 III 之平均數。 期間 III：進入永續經營期後，估計對資本市場與運用應與同業相近，以採樣同業力旺、晶心科及円星最近期之付息負債占比(付息負債+權益)平均比率計算之平均數。
$E/(D+E)$	100.00%	99.64%	98.28%	
$Kd$	0.00%	0.98%	1.95%	期間 I：該公司目前尚無借款之情事，預期期間 I 借款利率為 0%。 期間 II：採用期間 I 及期間 III 之平均數。 期間 III：係採用最近十年本國銀行之各季借款平均利率計算之。
$tax\ rate$	20.00%	20.00%	20.00%	依財政部新制營利事業所得稅率 20% 估算。
$Rf$	1.507%	1.507%	1.507%	112 年 11 月 22 日證券櫃檯買賣中心公告台灣十年期以上政府公債加權平均殖利率。
$Rm$	6.266%	6.266%	6.266%	係採用 102~111 年度股票集中市場之幾何平均投資報酬率。
$\beta_j$	1.652	1.326	1	期間 I：係採用 TEJ 資料庫計算之採樣同業(力旺、晶心科及 M31)最近五年股價對集中交易市場大盤指數之風險係數，並取其平均值。 期間 II：採用期間 I 及期間 III 之平均數。 期間 III：預期永續經營期之系統風險將逐步貼近市場之系統風險，故假設為 1。
$Ke$	9.37%	7.82%	6.27%	$Ke = Rf + \beta_j \times (Rm - Rf)$ 。其中， $Rf$ ：無風險報酬率； $\beta_j$ ：類股與大盤走勢之相關係數； $Rm$ ：市場風險報酬率
$Ki$	9.37%	7.79%	6.23%	加權平均資金成本 $Ki = E/(D+E) * Ke + D/(D+E) * Kd (1 - tax\ rate)$
G (保守)	4.93%	3.100%	0.000%	期間 I：係根據國際數據資料報告預估 2022-2026 年全球半導體市場之複合年增長率為 4.93% 估算。 期間 II：係以國際貨幣基金預測 118 年之全球經濟成長率 3.1% 估計。 期間 III：考量永續經營，尚無法合理預估成長率，故假設成長率為 0。
G (樂觀)	21.20%	3.100%	3.100%	期間 I：係以該公司過去三年(109~111 年度)之平均營收成長率 21.20% 估計。 期間 II：係以國際貨幣基金預測 118 年之全球經濟成長率 3.1% 估計。 期間 III：係以國際貨幣基金預測 118 年之全球經濟成長率 3.1% 估計。

A. 保守情境

$$\begin{aligned} P0 &= (V0 - VD) / \text{Shares} \\ &= \{278,571 \text{ 千元} - 0 \text{ 千元}\} / 28,486 \text{ 千股} \\ &= 9.78 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

B. 樂觀情境

$$\begin{aligned} P0 &= (V0 - VD) / \text{Shares} \\ &= \{666,262 \text{ 千元} - 0 \text{ 千元}\} / 28,486 \text{ 千股} \\ &= 23.39 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

依據上述假設及公式，該公司依收益法(現金流量折現法)之參考價格區間為 9.78 元~23.39 元。由於此法係以未來各期所創造現金流量之折現值合計數認定為股東權益價值，然因未來之現金流量無法精確掌握，且評價使用之相關參數亦無一致標準。在股價評價方法選擇上，考量收益法下如現金流量折現法因需推估公司未來數年之盈餘及現金流量作為評價之基礎，然而預測期間長，推估營收資料之困難度提高，不確定性風險相對高，亦不能合理評估公司應有之價值，故不擬採用此法評估。

(二)發行公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形

1.申請公司與已上市、櫃同業財務狀況及獲利情形

(1)該公司與採樣同業力旺、晶心科及 M31 之財務狀況、獲利情形

該公司最近二個會計年度與上市櫃採樣同業財務狀況及獲利情形請詳本評估報告「肆、財務狀況」。

(2)本益比

請詳本評估報告「壹、二、(一)、2、(2)、②、A.本益比法」之評估說明。

(三)所議定之承銷價若參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告者，應說明該專家意見或鑑價報告內容及結論

本證券承銷商與該公司共同議定之承銷價格，並未委請財務專家出具意見或鑑價機構提供鑑價報告，故不適用。

(四)發行公司於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價及成交量資料

該公司於興櫃市場掛牌最近一個月之平均股價及成交量資料彙總列示如下：

單位：元、股

月份	平均股價(元)	累積成交量(股)
112年11月份	118.10	10,452,099

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站。

(五)證券承銷商就其與發行公司所共同議定承銷價格合理性之評估意見

綜上所述，本證券承銷商與該公司議定之暫訂承銷價格，係依一般市場承銷價格訂定方式，經考量大盤及採樣同業之平均本益比以及該公司最近一個月(112年11月)興櫃市場之平均成交價等方式，以推算合理之承銷價格，復參酌該公司獲利情形、未來產業前景、技術創造營收能力、發行市場環境狀況等條件後，由本證券承銷商與該公司共同議定之。綜上考量，本證券承銷商經參酌國際慣用之市場法下之本益比評量，與該公司共同議定承銷價格暫訂為每股新臺幣100元，尚屬合理。俟未來該公司申請股票初次創新板上市案奉主管機關核准後，於辦理公開承銷前，視當時整體經濟環境、產業前景、公司營運狀況及最近期財務報告等資訊，依採行之承銷方式發現市場價格後，再行與該公司另行議定合理之承銷價格。

三、承銷風險因素

茲依股價變化過鉅、穩定價格策略、本次承銷之相關費用及承銷手續費率及新股承銷導致股本膨脹稀釋獲利等因素分別說明本次承銷相關風險如下：

(一)股價變化過鉅

該公司此次暫定之承銷價格，已考量該公司未來經營績效、同業狀況及發行市場現況等因素後予以調整，因此，此次暫定承銷價格應尚能合理反映該公司之市場價值，且辦理公開銷售時，將針對市場對案件承銷價格的接受條件及認購情形進行調查，作為調整承銷價格之參考依據。另本證券承銷商亦已依「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」規定，擬定穩定價格策略，辦理過額配售並視市場狀況執行穩定價格操作，期能降低該公司未來股價變化過鉅之風險。

(二)穩定價格策略

1.過額配售機制

依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，本證券承銷商已與該公司簽訂「穩定承銷價

格機制協議書」，由該公司協調其股東提出對外公開銷售股數之百分之十五以內，提供已發行普通股股票供本證券承銷商辦理過額配售，並將過額配售取得之款項做為執行穩定掛牌後價格操作之資金，於創新板上市買賣日起五個交易日採無升降幅度限制時，若股價跌破承銷價，本證券承銷商得運用此資金買進該公司股票，執行穩定價格操作。

## 2. 特定股東集保

該公司除依規定應提出強制集保股份外，本證券承銷商已與該公司協議，取得該公司董事、持股達百分之十股東等之配偶及其二親等親屬、該公司經理人本人及其配偶、二親等親屬以及其他股東，就其所持有之已發行普通股股票，於掛牌日起三個月，自願送存臺灣集中保管結算所股份有限公司集保，並承諾不得賣出，以維持承銷價格穩定。

### (三) 本次承銷之相關費用及承銷手續費率

該公司本次承銷之相關費用主要包括公開說明書印製費用、報紙公告、相關承銷書件印製費用、會計師與律師之勞務費以及承銷手續費等；而承銷手續費將參考未來辦理公開銷售時之市場行情議定，惟依國際財務報導準則實務指引(IFRS Manual of Accounting)及參酌 IAS32 第 37 段之說明，企業於發行或取得本身之權益工具時，通常會發生各種成本，此權益交易之交易成本應按扣除所有相關所得稅利益後之淨額作權益之減項處理，但以直接可歸屬該權益交易之可避免增額成本為限，而本次承銷手續費係可直接歸屬於該權益交易之可避免增額成本，故對該公司之獲利狀況並無重大影響。

### (四) 新股承銷導致股本膨脹稀釋獲利

該公司本次預估辦理現金增資發行新股 1,676,000 股，與該公司擬掛牌之股份總額 28,486,000 股相較，新股承銷導致股本膨脹對每股盈餘稀釋比率為 5.88%，惟本證券承銷商與該公司議定承銷價格時業已考量本次發行新股之稀釋效果，故對本次承銷風險之影響尚屬有限。

綜上分析，該公司已依法令規定計算應提出公開承銷股數，並全數以現金增資發行新股之方式，於扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購之股數後，委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，經評估本次新股承銷之相關費用對其獲利之稀釋程度有限，股本膨脹對該公司獲利之稀釋效果亦已於本次議定承銷價格時納入考量，另本證券承銷商已針對承銷價格擬定穩定價格策略，整體而言，其承銷風險應屬有限。

#### 四、總結

(一)本證券承銷商經評估該公司之財務及業務等狀況後，綜合說明該公司之營運風險、財務風險及潛在風險等如下：

##### 1.營運風險

###### (1)非揮發性記憶體(NVM) SIP 領域人才尋找不易

矽智財設計產業為典型之知識經濟，隨著 IC 設計產業蓬勃發展，種類繁多之非揮發性記憶體於市場中相繼出現，惟目前在此領域資深且專業之人才難覓，如何培養優秀之研發技術人員及減低人才流失之風險將會是 SIP 設計公司成就與否之關鍵因素，亦為永續經營之必要條件。

###### 因應措施

- ① 計劃性長期培訓公司員工，提供公司內部專業訓練並於半導體專業機構或學校接受教育訓練，透過產學合作學習知識培養專業人才。
- ② 申請半導體相關科系畢業之研發替代役學生進行長期培訓。
- ③ 辦理現金增資供員工認購，使員工成為股東，分享公司成果，藉此吸引員工及留住人才並增強向心力。

###### (2)產業前景看好，競爭者推出競品

由於晶片設計複雜度伴隨終端產品新型應用與日俱增，嵌入式 MTP SIP 技術具備可多次編寫之特性及成本競爭優勢，將吸引許多記憶體 SIP 設計服務供應商加快於 MTP SIP 市場開發腳步，進而推出競爭品項，未來矽智財產業之競爭亦將更顯激烈。

###### 因應措施

- ① 考量邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體 SIP 之優劣特性，與基本單元 (cell) 架構有直接關係，且嵌入式 OTP SIP 開發經驗值並非可直接套用於嵌入式 MTP SIP 上，該公司目前已站穩 MTP SIP 研發經驗及技術領先優勢，未來將持續開發適用各項製程之 MTP SIP 產品，並持續縮小非揮發性元件面積，擴大產品規格領先優勢及應用市場，以滿足客戶需求並區隔競爭市場。
- ② 持續於不同晶圓代工廠、整合元件製造廠建置多樣化技術平台，進而提高嵌入式非揮發性記憶體技術 SIP 在晶圓廠、IC 設計公司及 IC 產品間之滲透率，以挹注業績之成長暨擴大市場占有率。
- ③ 架構專業技術服務系統，力求迅速反應客戶多元化需求，提供客戶完整的嵌入式記憶體 SIP 佈局並降低客戶開發成本，提升客戶服務滿意度暨穩固客供關係。

④ 提高公司知名度，開發國際級客戶使用該公司 SIP 技術。

## 2.財務風險

### (1)匯率風險

由於該公司銷貨多以美元作為交易計價幣別，故市場匯率波動對該公司營收及獲利將有一定程度之影響。

#### 因應措施

- ① 與主要往來銀行開立外匯存款帳戶，客戶匯入之貨款則視實際資金需求及匯率可能變動趨勢，適時決定外幣兌換或存入外匯存款帳戶。
- ② 公司財務單位與各銀行之外匯部門保持密切聯繫，並隨時蒐集市場匯率變化之相關資訊，充分掌握國內外匯率走勢及變化資訊，以降低匯率變動所產生之負面影響。
- ③ 公司業務單位進行報價前，會先行對未來之匯率走勢及影響匯率之因素做綜合考量及評估，以決定適當且合理之報價，降低因交易而產生之匯兌風險，以保障公司之合理利潤。

## 3.潛在風險

### (1)美中科技戰對半導體產業未來佈局之風險

近年來美中貿易戰已逐漸演變成半導體、人工智慧及 5G 通訊等領域之科技戰，各國政府陸續頒布半導體出口管制措施，限制先進製程設備及技術元件輸往中國大陸地區，以壓制其半導體技術之發展。惟中國大陸擁有全球最大之晶片市場，受到各國政府抵制政策之影響，將造成產業供應鏈移轉之風險，衝擊全球半導體產業發展，SIP 設計業者亦連帶受到波及，進而影響該公司之營收及獲利表現。

#### 因應措施

依據美國頒布之出口管制條例，半導體禁令旨在限制中國大陸 10~20 奈米以下之先進製程發展技術，而針對 28 奈米以上之成熟製程則並非其主要管制目標。由於該公司 SIP 產品於中國大陸地區之佈局仍以 55 奈米及更成熟之製程節點為主，並未落於該管制條例之制裁名單中，故短期內對該公司營運狀況無產生直接之影響，未來該公司於中國市場亦持續朝往成熟製程方向發展，預期中國市場晶圓代工業者在先進製程技術受限下將積極擴充成熟製程產能，且在物聯網、電動車及工業等趨勢領域需求持續提升，將帶動電源管理、微控制器及 Wi-Fi 等晶片供不應求，有助於推升公司整體業績表現。

(2)主要產品市場占有率低對公司營運規模之風險

早期記憶體 SIP 產業由於技術發展受限，使得該公司主要產品 MTP SIP 雖可提供客戶多次讀寫之功能，惟因面積仍較 OTP SIP 為大而不具備相應之成本優勢，且下游 IC 設計業者多考量採以數顆面積較小之 OTP SIP 組合方案來取代其僅能一次性編寫之效能限制，進而與該公司產品產生排擠效應，故 MTP SIP 並非成為初期市場上主流採用之記憶體 SIP 技術，進而導致該公司營運規模不及同業競爭者之風險。

**因應措施**

該公司專注於 MTP 技術領域已累積多年開發經驗，透過自有記憶體細胞單元專利，已可將其 MTP SIP 面積縮小於同業之 OTP SIP，並完成晶圓廠功能及製程相關驗證且成功導入量產，論其產品效能及效益皆已優於同業競品。此外，考量 OTP SIP 仍占有較高之市占率，加上現有客戶對該公司 SIP 設計架構較為熟悉且亦提出 OTP SIP 產品相關需求，故該公司擬藉由新開發之創新技術，提供可電子式寫入十次或面積可縮小至現有供應商 SIP 之 80%等產品競爭優勢，並透過合作客戶取得新製程平台投產機會，搶攻 OTP SIP 市場商機，目前該公司 OTP SIP 產品已獲客戶驗證採用，並用作 0.18 $\mu$ m、0.35 $\mu$ m 等製程量產使用。綜上所述，受惠於 IC 產品週期縮短及設計複雜度增加之產業趨勢，MTP SIP 市場需求及新應用領域將逐步浮現，另隨著半導體產業持續追求製程微縮技術發展，將帶動以 OTP SIP 應用為主之先進製程需求成長，該公司將逐步切入 OTP SIP 市場，並占有產業領先技術優勢，建置完整之記憶體 SIP 資料庫客製化解決方案，有效提升該公司產品競爭優勢及市占率。

(二)承銷商就外國申請公司應列示說明其註冊地國及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、相關法令、外匯管制及租稅，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並評估外國申請公司所採行相關因應措施之適當性

該公司為本國發行公司申請股票創新板上市案件，故不適用本項評估。

(三)依據對發行公司整體評估之結果，作為是否推薦發行公司上市之依據。

本證券承銷商基於輔導期間對億而得之產業狀況、營運風險、業務及財務狀況綜合評估，並就不宜上市標準進行查核，認為該公司已符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」所規定之上市標準，且其產業未來前景尚屬樂觀，故本證券承銷商推薦該公司申請股票上市。



## 貳、產業狀況及營運風險

### 一、發行公司所屬行業營運風險

該公司成立於民國 90 年 9 月，為一專業嵌入式非揮發性記憶體矽智財 (Embedded Non-Volatile Memory SIP，以下簡稱 eNVM SIP) 之設計服務供應商，致力於 eNVM SIP 產品之研究開發、功能設計、業務行銷及授權服務。

矽智財(Silicon Intellectual Property，以下簡稱 SIP)係積體電路設計當中所涉及之智慧財產，屬半導體產業的上游，其晶片具有特定功能的積體電路設計技術，是可以經過事前設計、定義及驗證重複使用的功能區塊，且有模組化的特性，通常被用來滿足特定的規格，其有效性經過驗證並可重複使用。隨著電子產品「智慧化」需求愈來愈大，舉凡 AI、電動車、物聯網、5G 等都持續推升半導體需求與複雜度，隨著先進製程不斷開發、製程節點保持穩健升級，晶片的設計結構與功能也變得愈來愈複雜，而 SIP 授權將能有效使 IC 設計的過程簡化、減少開發成本及週期，並提升晶片性能，故對於 SIP 的依賴性也愈來愈高。茲就該公司所屬之產業概況及其產品應用市場相關之行業營運風險說明如下：

#### (一) 產業概況

##### (1) 半導體產業概況



資料來源：WSTS(2023/06)，兆豐證券整理

根據全球半導體貿易統計組織(World Semiconductor Trade Statistics, WSTS) 112 年 6 月發布之半導體預測報告顯示，由於全球性通貨膨脹等原因，致智慧型手機、PC 需求疲弱，個人消費市場低迷，因此將 112 年全球半導體銷售額預估值自前次(111 年 11 月)預估的年減 4.1%大幅下修至年減

10.3%，為自 109 年以來首度陷入萎縮，全球半導體銷售金額將降至 5,150 億美元，而 113 年則預估將呈現強勁反彈，全球半導體銷售額將達 5,760 億美元，成長 11.8%，有望創下歷史新高紀錄。WSTS 也指出，112 年並非所有半導體需求皆低迷，像是電動車、再生能源等相關用途的需求持續強勁，而需求急劇攀升的生成式 AI 也推升部分邏輯晶片需求。

### 臺灣半導體產業產值概況

億新臺幣↕	2019↕	2019↓ 成長率↕	2020↕	2020↓ 成長率↕	2021↕	2021↓ 成長率↕	2022↕	2022↓ 成長率↕	2023 (e)↕	2023 (e)↓ 成長率↕
IC 產業產值↕	26,656	1.7%	32,222	20.9%	40,820	26.7%	48,370	18.5%	42,496	-12.1%
IC 設計業↕	6,928	8.0%	8,529	23.1%	12,147	42.4%	12,320	1.4%	10,760	-12.7%
IC 製造業↕	14,721	-0.9%	18,203	23.7%	22,289	22.4%	29,203	31.0%	26,060	-10.8%
晶圓代工	13,125	2.1%	16,297	2.1%	19,410	19.1%	26,847	38.3%	24,380	-9.2%
記憶體與其他製造	1,596	-20.4%	1,906	19.4%	2,879	51.0%	2,356	-18.2%	1,680	-28.7%
IC 封裝業↕	3,463	0.5%	3,775	9.0%	4,354	15.3%	4,660	7.0%	3,771	-19.1%
IC 測試業↕	1,544	4.0%	1,715	11.1%	2,030	18.4%	2,187	7.7%	1,905	-12.9%
IC 產品產值↕	8,524	1.3%	10,435	22.4%	15,026	44.0%	14,676	-2.3%	12,440	-15.2%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	4,123 ↕	-12.0%↕	4,404 ↕	6.8%↕	5,559 ↕	26.2%↕	5,741 ↕	3.3%↕	5,508 ↕	-4.1%↕

資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2023/05)

依臺灣半導體產業協會預估，就臺灣半導體產業來看，112 年臺灣半導體產業產值為新臺幣 4.25 兆元，較 111 年 4.84 兆元衰退約 12.1%，整體而言，半導體景氣最終還是取決於電子終端需求，112 年持續受通膨、升息等負面因素影響，消費市場買氣不佳、拉貨力道疲軟，IC 設計業者面臨客戶砍單、殺價及庫存水位過高的問題，因此調降對晶圓代工廠的投片量或採取延遲出貨措施，晶圓代工廠的產能利用率將逐季下修，而晶圓廠產量下滑、訂單能見度低，也連帶影響 IC 封測業稼動率持續鬆動。若以半導體細項產業表現來說，均陷入衰退走勢，其中記憶體與其他製造業的跌幅最高，產值年減率由 111 年的(18.2)%擴大為(28.7)%，主係 DRAM、Flash 等產品供過於求，造成價格大跳水；而次要跌幅的則是 IC 設計業，產值年增率由 1.4%轉為(12.7)%，主係手機、平板等消費性電子領域的需求表現不佳，影響相關晶片的需求與價格；半導體封測業、晶圓代工業也均呈現由正轉負，其中 111 年大幅成長 38.3%的晶圓代工業，也將轉為(9.2)%，主係二線晶圓代工廠面臨成熟製程的價格戰，代工報價預期有鬆動情況。

儘管市場需求以及全球經濟的週期性變化導致了半導體市場銷售額波動，致使短期內國內外半導體業似乎將陷入衰退局面，然而晶片係構築人類社會數位化轉型的底層基礎，在使世界更智慧、更高效等方面發揮越來越重要的作用，故中長期來說，國內外半導體市場的長期需求仍然是相

當強勁，未來成長依舊可知；例如 Apple 革命性的 MR 設備將引領新一輪的全球消費電子創新週期，以及 ChatGPT 帶動 AI 熱潮，預計可順勢拉抬半導體供應鏈題材，或是新能源汽車和智慧化汽車滲透率上升，將進一步提升將對於車用半導體供應鏈的需求。

## (2) 嵌入式非揮發性記憶體 SIP 產業概況

所謂嵌入式非揮發性記憶體(以下簡稱 eNVM)，有別於常見的動態隨機存取記憶體(DRAM)和靜態隨機存取記憶體(SRAM)，eNVM 係指當電流關掉後，所儲存的資料不會消失的資料儲存裝置，其中依記憶體內的資料是否能在使用系統時隨時改寫為標準，又可分為光罩式唯讀記憶體(Mask ROM)、單次寫入唯讀記憶體(One-Time Programming，以下簡稱 OTP)、多次寫入記憶體(Multi-Times Programming，以下簡稱 MTP)及快閃記憶體(Flash)等四種不同性質之記憶體模組，該公司主要產品為以邏輯製程開發之 MTP 為主，OTP 為輔，並提供客戶具備不同記憶體容量、燒寫次數、操作溫度與操作電壓的產品規格，其所發展之 SIP 產品可應用範圍廣泛，諸如電源管理 IC、微控制器 IC、車用 IC 及智慧聯網 AIoT 等應用領域。

根據調研機構 Arsta Research Analysis 於 111 年 7 月出具之報告指出，eNVM SIP 市場產值將從 111 年的 3.1 億美元，成長至 117 年 8.1 億美元之水準，預估年均複合成長率將達到 14.7%，而該公司產品 OTP 及 MTP SIP，其市場產值更將從 111 年的 0.9 億美元，成長至 117 年 2.5 億美元，預估年均複合成長率達到 15.0%，顯示隨著系統單晶片(SoC)的發展，eNVM SIP 的儲存優勢也逐漸顯現，未來成長潛力可觀。

### eNVM SIP 市場規模預測

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
eFlash	162.32	195.23	228.25	269.60	313.06	365.23	419.82
eE2PROM	38.14	46.11	54.28	64.97	74.34	87.45	99.97
eOTP/eMTP	94.30	113.88	133.99	159.74	184.73	217.42	250.98
Others	16.56	20.00	23.36	27.55	31.77	37.43	43.31
<b>Total</b>	<b>311.31</b>	<b>375.22</b>	<b>439.87</b>	<b>521.86</b>	<b>603.90</b>	<b>707.53</b>	<b>814.09</b>

Source: Arsta Research Analysis

資料來源：Arsta Research Analysis(2022/07)

若以各領域應用類別來看，Arsta Research Analysis 預估，eNVM SIP 金額最大市場仍以消費性電子產品為主，由 111 年的 1.3 億美元成長至 117 年的 3.3 億美元。車用領域將成為一匹黑馬，由 111 年約 0.8 億美元的市場

成長至 117 年 2 億美元，另外，通訊領域也有顯著成長，由 111 年約 0.4 億美元的市場成長至 117 年 1.1 億美元。

消費性電子產品近年來受到消費性晶片供給過剩而導致的衝擊，加上國際局勢緊張、高通膨等影響，導致經濟成長停滯，市場需求降溫，消費者也將節約支出，限制了消費性電子產品成長。然而儘管手機及個人電腦市場存在短期困境，消費性電子產品仍是各應用類別中最大之市場，在此同時，智慧家庭、智慧生活以及聚焦在健康性質的消費性電子產品將承載著最多的機會，另外在微軟、輝達等公司致力發展 AI 的情況下，可預見人工智慧科技未來將應用於各領域之消費性電子產品，並改變人們的生活模式，消費性電子產業的長期前景仍屬樂觀。

在車用領域中，舉凡螢幕顯示、雨刷及天窗等，都含有電子控制單元 (ECU)，根據統計，現在一台汽車上已有上百個 ECU 在其中進行運作，不單是 ECU，其內部組成零件也包含了 MCU、電源元件以及車內通訊電路等，每個晶片都必須各司其職，才能讓汽車內部對指令的溝通與傳輸更加順暢，此外，無論是燃油車或是電動車，現行車款導入先進駕駛輔助系統 (ADAS) 已成為標準配備，此部分應用都必須仰賴如大腦般的 AI 運算晶片，藉此有效並快速分析資訊，而隨著全球加快推動「綠色低碳發展」及 2050 年淨零碳排目標的確立，無形中加速了電動車的普及速度，而車用晶片在電動車中的需求大過於傳統汽車，因此電動車銷售成長，晶片需求也跟著增加。

而在通訊領域中，近幾年來歐美國家維持去中化原則，巨額投資新世代高速基礎網路，刺激更多新技術與產品的問市，新一代 5G 網路、Wi-Fi 7 路由器等設備陸續推出，美國更於 112 年 6 月宣布將向全美各州投入 420 億美元經費，用於寬頻網路基礎建設，以便達成高速寬頻網路普及，故未來通訊市場發展可期。

### eNVM SIP 市場應用類別預測

**Table Global Embedded NVM (eNVM) IP Revenue (M USD) Forecast by Application (2022-2028)**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Consumer Electronics	126.80	152.38	178.41	212.35	246.81	288.81	332.07
Communication	42.74	51.33	60.00	71.60	82.37	97.50	111.61
Automotive	76.83	92.98	109.57	129.63	149.34	174.34	201.49
Home Appliance	29.73	36.06	42.58	50.31	57.85	67.57	77.42
Industrial	21.01	25.21	29.16	34.34	40.04	47.05	54.30
Others	14.20	17.26	20.15	23.64	27.48	32.26	37.20
<b>Total</b>	<b>311.31</b>	<b>375.22</b>	<b>439.87</b>	<b>521.86</b>	<b>603.90</b>	<b>707.53</b>	<b>814.09</b>

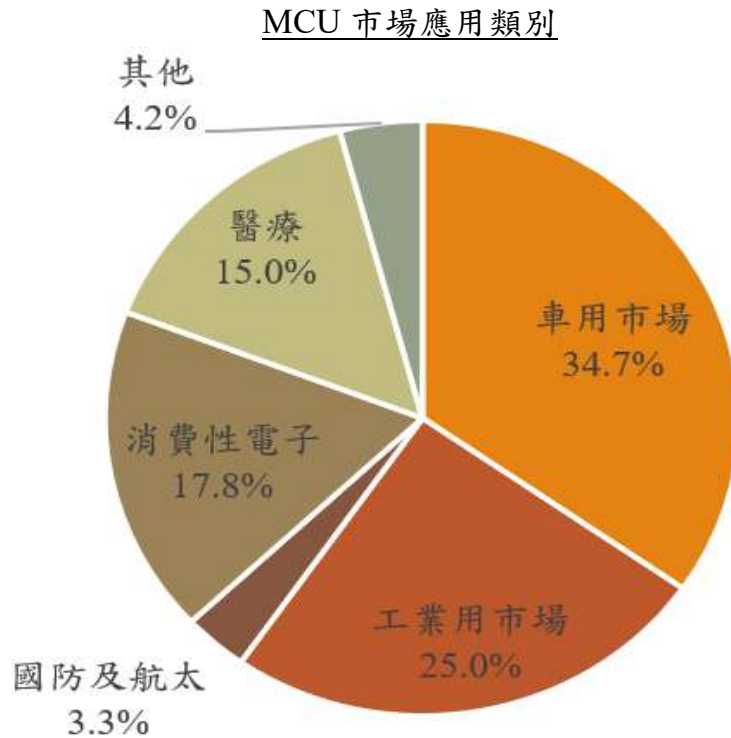
Source: Arsta Research Analysis

### (3)微控制器產業概況

微控制器為該公司 eNVM SIP 主要應用產品，微控制器 (Microcontroller Unit，以下簡稱 MCU)，係將中央處理器、記憶體、輸入/輸出介面等各式零組件整合在一塊 IC 上，因此 MCU 有「微型電腦」一稱，可以負責做少量、簡單的資料運算與處理，其小體積、低耗能和低成本特性，讓它被廣泛應用在許多不需大量運算應用的設備中，依等級可分 4 位元、8 位元、16 位元與 32 位元，從發展趨勢觀察，4 位元與 16 位元 MCU 晶片使用案例愈來愈少，目前市場上較活躍的是 8 位元及 32 位元 MCU 晶片。使用者在選擇 MCU 單晶片時一般會將系統規模、產品大小、成本、可獲取性、延遲性、RAM 效率、控制及處理能力等因素納入考量。8 位元 MCU 單晶片可執行簡單的邏輯運算，如加、減、乘、除，相較於 32 位元 MCU 單晶片，8 位元儲存空間較小，計算能力較弱，多應用於簡單、小型的系統，優點是可支援老式程式語言；32 位元單晶片具有可獲取性，可應用於複雜系統，同時具有較佳的控制和處理能力，而且能控制較多模組及設備，以 Cortex-M 架構為例，由於支援 C++ 資料庫，開發人員可以輕鬆地在其中編寫韌體。若以效率而言，8 位元 MCU 單晶片在處理簡單的運算工作時效率較高，32 位元 MCU 單晶片則是在處理複雜度高的運算工作時效率較高。近年來，洗衣機、洗碗機、爐具、電冰箱、空調、微波爐等白色家電逐漸朝物聯網靠攏，智能化需求促使不少產品的內部晶片全面升級，如按鍵式操作鈕轉換為內建觸控螢幕操作模式，這類升級需求加上車用、網通及工控需求，推升 32 位元 MCU 單晶片需求，逐漸成為主流產品。

根據 Global Market Insights 之調查報告指出，MCU 終端應用大致可分為消費性市場及非消費性市場，其中消費性市場應用為消費性電子、醫療及其他，非消費性市場應用則包括車用市場、工業用市場、國防及航太，而全球 MCU 市場又以非消費性應用為大宗，約占總市場 63% 份額。消費性 MCU 由於技術門檻不高，加上中國近年致力推動晶片國產化，祭出了半導體產業相關減稅補助，目前已屬紅海市場，估計未來數年消費性市場將維持低價競爭的情形。而非消費性 MCU 則屬於技術門檻較高的市場，以工業、車用兩大應用為主，由於工控、車用等非消費性 MCU 注重產品的穩定性及客製化，通常客戶採用後會有一定黏著度，不會輕易更換供應商，加上智慧化工廠的建置及 ADAS 持續升級和電動車的電動動力系統發展等因素影響下，使非消費性 MCU 的整體未來展望較消費性 MCU 亮

眼許多。



資料來源：Global Market Insights (2022/07)，兆豐證券整理

## (二)所屬行業之營運風險

茲就該公司產品所屬之行業，分別說明景氣循環、行業上下游變化、行業未來發展趨勢及產品可替代性等對其之營運風險如下：

### (1)景氣循環風險

該公司主要產品係以 eNVM SIP 之授權及設計服務，其主要客戶為全球各大半導體廠商及 IC 設計公司，客戶群遍及臺灣、美國、中國、日本及韓國等地區，如同一般 IC 設計產業所面臨之共同風險，其營運仍會受整體半導體市場景氣之波動及下游終端產品之產業景氣而產生影響，然因該公司客戶端之應用涵蓋範圍相當廣泛，下游應用以微控制器、電源管理 IC、物聯網、中小尺寸面板驅動 IC 為主，終端應用產品則包含資訊設備、車用電子、智慧家電、通訊及消費性電子，皆屬於該公司產品可應用範圍，因此該公司營運上無明顯因特定產業波動之現象，較不易受特定需求循環或季節性需求影響。

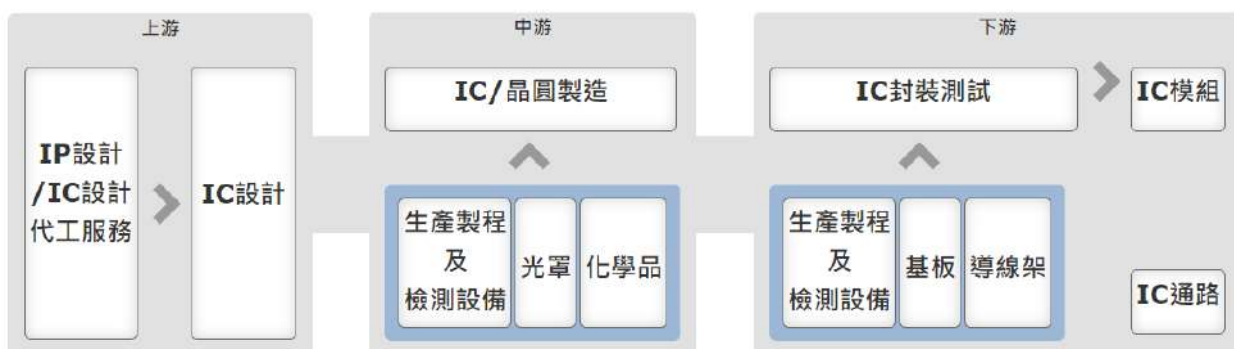
### (2)行業上下游變化

該公司係屬於半導體業上游之 SIP 設計服務公司，屬於高知識密集產業，主要業務為自行研發設計 SIP 模組架構並授權下游客戶，或接受客戶

委託開發產品等設計服務，而 SIP 為 IC 設計的智慧財產權，SIP 開發流程包含 SIP 設計與 SIP 驗證，在 IC 設計中，SIP 核心再利用可以有效縮短產品開發週期並降低成本，現今 IC 設計大幅增加了許多功能，因此必須運用既有的驗證有效 SIP 元件，以滿足上市前置時間的要求。

當 IC 設計產品完成設計開發後，再委託中游之 IC 製造公司，即專業晶圓代工廠，以自身擁有之複雜製程技術與精密機器設備，同時搭配 SIP 設計公司提供特定性能之 SIP，方能協助 IC 設計公司將其所設計之電路生產製造成 IC 晶片，最後送至下游之 IC 封裝及測試廠，將製造完成之晶圓半成品先經專業封裝廠完成切割及封裝，後由專業測試廠進行晶圓電路測試，而完成測試之 IC 成品最終售予各系統廠商，各系統廠商再裝配生產成各式應用之系統產品，因此半導體產業每一生產環節皆有專門技術之個別廠商投入，形成設計、製造、封裝、測試垂直整合一條龍之產業鏈，使半導體業上中下游均具有高度專業水平分工體系，茲將 IC 產業上、中、下游產業關聯圖列示如下：

IC 產業鏈之分工圖



資料來源：產業價值鏈資訊平台

### (3) 行業未來發展趨勢

#### ① 嵌入式系統晶片應用多元化

隨著科技不斷進步，新電子產品不斷推陳出新，消費性產品不僅要求輕薄短小，更要提高其效能，使得晶片的設計也朝高效能、小面積發展，採用嵌入式系統晶片設計成為縮小面積並提高效能的最佳方案，舉凡日常生活用的智能家電、穿戴裝置到工業應用的物聯網、車聯網等各種電子裝置，均屬於嵌入式系統應用的範疇，也因此嵌入式晶片已成為晶片設計業者的兵家必爭之地。然而隨著嵌入式晶片設計的複雜度提高，相關的驗證工序也變得繁瑣與複雜，該公司憑藉其於 eNVM SIP 深耕多年之經驗及技術，可針對客戶產品所需之記憶體提供多元化解

決方案，並縮短產品驗證時間，滿足客戶降低成本及提高產品價值與競爭力之需求。

### ②與晶圓代工廠策略結盟發展先進製程

SIP 公司發展與晶圓代工廠息息相關，SIP 開發對於先進製程的需求越來越高，不僅需晶圓代工廠提供驗證方面之協助，若成功開發新產品後，也需要委由擁有先進製程及高良率之晶圓代工廠投片量產，故與晶圓代工廠保持密切合作關係不僅能加強研發能力並提高設計效率，還能建構更完整之製程技術平台，提供客戶多元化的產品線，並藉由晶圓代工廠的推廣，帶來更多新客戶，使權利金收入進一步的成長，創造雙贏的局面。該公司除了與原合作夥伴加強其製程技術，發展高速多次寫入、減少光罩層數及低電壓低電流寫入讀取之 eNVM，也拓展不同地區晶圓廠與之合作，不僅加強自身產品的深度及廣度，更能提供客戶多元化製程技術平台選擇。

### ③具備 AI 應用潛力

隨著 AI 技術的發展，智慧化的需求開始湧現在各個產品應用，對運算效能的需求也倍速增加，其所使用的記憶體將比以往更加吃重，除了儲存所擷取的資訊外，也需要大量儲存空間用以學習演算法、演算結果及大數據分析等，因此除了具備足夠的記憶體儲存容量外，長期讀寫的可靠度、高速讀寫的能力、在不同環境下仍具備穩定的性能，未來將尋求效能更好的記憶體解決方案，以達成 AI 的需求。而目前新一代的嵌入式記憶體技術與次世代非揮發性記憶體的結合，已成為主要半導體業者研發重點，如 RRAM、MRAM 及 FRAM 等，除具有上述特性，並可以滿足龐大運算需求，帶動前瞻記憶體研發能量。

### (4)產品可替代性

該公司主要經營授權 eNVM SIP 及提供相關技術服務，相較於外掛式的記憶體，eNVM 具有低成本、低功耗及易於整合等優勢，目前已大量用於電子產品，尤其可攜帶性產品之中。而該公司主力產品 MTP 在 eNVM 中結合了 OTP 的低製造成本及 Flash 的高效能等特點，並能根據客戶要求之容量、寫入次數和導入成本等，量身打造最適之 MTP 產品，對於需要多次程式編寫之晶片提供完美解決方案。採用 MTP 產品不僅不需特殊元件便能進行開發，建置週期較短，且與採用多個 OTP 組成之產品價格相當，其面積更能大幅縮小。近年來隨著物聯網的應用持續普及和電動車需求的持續增加，MCU 使用 eNVM 的需求也持續增加，MTP 技術已被市場



廣泛認可和應用。綜上所述，MTP 結合 Flash 寫入次數較高及 OTP 成本較低之兩大優點，短期間難有新產品可替代，故整體而言，不論就該公司產品本身或終端應用發展上觀察，該公司所屬產業短期內尚無明顯之替代風險。

## 二、發行公司營運風險

### (一)業務之營運風險

#### 1.市場未來供需變化情形

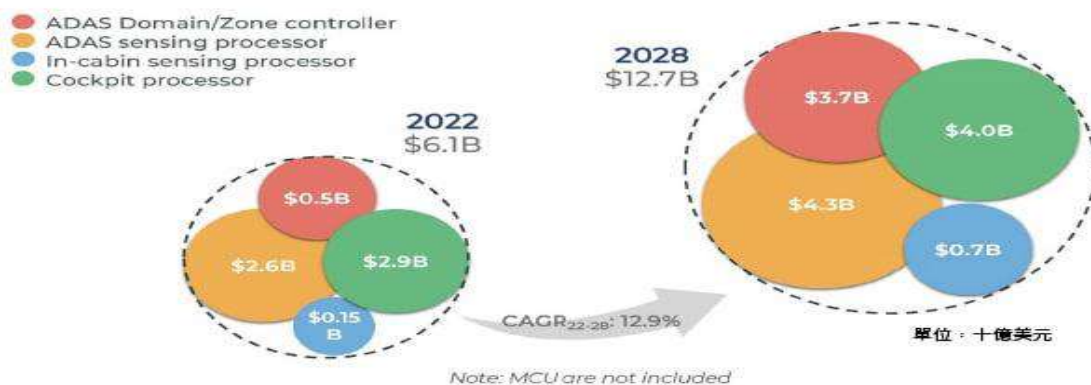
##### (1)供給面

半導體產業為一高技術密集型產業，專業化之產業供應鏈使得產業上、中、下游廠商彼此分工且關係緊密，該公司位於供應鏈最上游之矽智財設計服務產業，除了專業領域人才之培育外，下游晶圓廠產能對於市場供給面亦有重要之影響力，近年來全球半導體市場隨著疫後宅經濟效應消退及高通膨經濟環境影響，使得消費性電子市場需求疲軟，且在疫情期間因晶片短缺促使半導體供應商擴充產能之情況下，進而造成 2023 年上半年各類晶片處於供過於求之情事，連帶使得晶圓代工廠產能利用率逐步衰退，惟考量半導體仍是市場剛性需求，未來隨著終端市場庫存去化調整，加上在 AI、物聯網及車用電子等利基型應用不斷推陳出新，預計仍將帶動晶圓產能利用率逐步回升。

##### (2)需求面

近年來 5G、AI、車用電子等新興應用逐步浮現，全球 IC 業者對於矽智財元件在各式製程上之需求逐漸受到重視。以該公司矽智財產品應用面觀察未來市場需求，隨著 5G、AI、物聯網時代來臨，持續催生各類網通、穿戴式裝置及智能家電等應用商機，且在中國政府頒布「十四五」政策之推波助瀾下，加快既有住宅設施數位化及新建社區增設智慧系統，預期中國消費性電子內需市場將持續擴大；在車用電子市場方面，伴隨電動車及自駕車市場滲透率逐漸提升，先進駕駛輔助系統(ADAS)與智慧座艙(Cockpit)兩類應用所使用之車用處理器市場需求，預期將出現可觀之成長，根據研究機構 Yole Group 最新發表之報告指出，2022~2028 年間 ADAS 處理器之年複合成長率將達到 18%，Cockpit 處理器之年複合成長率則有 5%。綜上所述，預期未來在智慧應用、車用電子及穿戴式裝置等利基應用持續擴張，將帶動相關應用晶片及矽智財需求持續成長。

## 2022~2028年汽車ADAS與座艙處理器市場規模預估



資料來源：Yole Group(3/2023)

### 2.該公司在同業間之地位及市場占有率

該公司產品主係以嵌入式非揮發性記憶體矽智財(Embedded-Non-Volatile Memory SIP,以下簡稱：eNVM SIP)為主，致力於 eNVM SIP 產品之技術開發、功能設計、市場應用與業務行銷。

就產業方面而言，若以我國 IC 設計產業作為產值計算基礎，根據工研院 IEK 研究資料統計，2022 年度我國整體 IC 設計產業產值為 1 兆 2,320 億元，而 2022 年度該公司之營業收入為 229,420 千元，占整體 IC 設計業總產值 0.02%。就產品方面而言，根據 Arsta Research Analysis 研究報告顯示，2022 年全球 eNVM SIP 市場規模為美金 3 億 1,131 萬元，換算該公司在全球 eNVM SIP 市場市占率為 2.35%。

eNVM 產品依其可編程次數多寡，由少至多可概分為光罩式唯讀記憶體(Mask Read-Only Memory; 以下簡稱：Mask ROM)、一次可程式(One-Time Programmable, 以下簡稱：OTP)、多次可程式(Multi-Times Programmable, 以下簡稱：MTP)及快閃記憶體(Flash)等不同性質之記憶體模組。該公司之產品則主要聚焦於 MTP，其雖結合 Flash 高寫入次數及 OTP 低成本之產品優勢，然因終端應用需求及成本考量，致現今記憶體 SIP 市場仍以採用 OTP 產品為大宗，故使得該公司市占率相較同業為低。然該公司現有 MTP 之產品效能及矽智財面積皆已位居業界技術領先地位，未來將持續增強其 MTP 產品市場競爭力，瞄準家電及車用市場商機，另該公司擬藉由 MTP 領域領先技術切入 OTP 市場，搶攻未來高成長之高壓先進製程之面板驅動 IC 及車用市場。綜上所述，該公司未來將持續優化現有成熟製程技術並積極佈局先進製程，研發高精密度之非揮發性元件，另與全球各大晶圓代工廠及 IC 設計公司建立密切合作關係，以挹注業績之成長暨擴大市場占有率，經評估該公司未來仍有相當大之成長空間。

**Table Global Embedded NVM(eNVM) SIP Market Share by Companies(2017-2022)**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Microchip (微晶片科技)	46.27%	48.06%	47.78%	44.85%	43.47%	40.19%
eMemory(力旺電子)	26.65%	24.27%	21.49%	23.87%	26.15%	26.87%
Synopsys(新思科技)	19.19%	18.38%	20.10%	19.49%	18.52%	20.41%
Yield Microelectronics Corp.(億而得微電子)	2.25%	2.50%	2.62%	2.22%	2.40%	2.35%
NSCore,Inc.	0.49%	0.57%	0.68%	0.62%	0.61%	0.59%
Chengdu Analog Circuit Technology Inc.(成都模擬電路技術)	0.01%	0.05%	0.22%	0.82%	0.44%	0.97%
Others	5.13%	6.18%	7.11%	8.12%	8.41%	8.60%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Source:Astra Research Analysis (2022/2)

### 3.影響該公司未來發展之有利與不利因素及其所採行相關因應措施

#### (1)有利因素

##### ① 矽智財產業已成為半導體供應鏈重要關鍵板塊

近年來由於電子產品外型短小輕薄、功能多樣化等需求，促使晶片設計複雜度日益提高，矽智財產業作為半導體產業鏈的重要關鍵技術，可大幅縮短產品開發時程及加速產品上市週期，有效提升客戶產品競爭力。此項關鍵技術亦將促使未來更多終端客戶快速投入市場，有利矽智財供應商開拓不同應用領域之商機。

##### ② 技術進入門檻高

eNVM SIP 產業為一高技術密集型產業，SIP 設計服務供應商須先具備自主開發基本單元(cell)之能力並取得專利權保護智慧財產，才得以掌握關鍵技術提升與同業之競爭力。eNVM SIP 產品整體開發流程亦相當冗長，從基本單元研發，至 SIP 功能區塊建置完成，SIP 產品還須經過晶圓代工廠、整合元件製造廠驗證成功，並建置於其製程平台，才得以被客戶採用進行量產，此外，與中游廠商建立緊密之策略夥伴關係，將更有利於產品之開發且順利導入量產流程。由於如此漫長開發過程且高技術之進入門檻，故競爭投入者相對稀少。

##### ③ 擁有多項 MTP 技術專利及開發經驗

由於 IC 產品功能設計複雜度日趨增加，許多 IC 設計公司開始捨棄只能一次性使用之 OTP SIP 與成本較高的 Flash SIP，改採成本適中且可多次燒寫之 MTP SIP 解決方案。該公司自從進入矽智財產業，即致力於邏輯製程嵌入式 MTP 非揮發性記憶體 SIP 之開發，已累積豐富之 MTP SIP 技術開發經驗，至今已取得數十項

國內外相關專利技術，並成功導入合作夥伴之 0.4 $\mu$ m、0.3 $\mu$ m 等直到 90nm 製程技術，因應客戶不同產品之多元化需求，該公司在各大晶圓代工廠建置技術平台，且有許多案件已開發完成並量產出貨，並與 IC 設計公司、晶圓代工廠、整合元件製造廠建立起緊密合作關係。

## (2)不利因素

### ① 非揮發性記憶體(NVM) SIP 領域人才尋找不易

矽智財設計產業為典型之知識經濟，隨著 IC 設計產業蓬勃發展，種類繁多之非揮發性記憶體於市場中相繼出現，惟目前在此領域資深且專業之人才難覓，如何培養優秀之研發技術人員及減低人才流失之風險將會是 SIP 設計公司成就與否之關鍵因素，亦為永續經營之必要條件。

#### 因應對策：

- A. 計劃性長期培訓公司員工，提供公司內部專業訓練並於半導體專業機構或學校接受教育訓練，透過產學合作學習知識培養專業人才。
- B. 申請半導體相關科系畢業之研發替代役學生進行長期培訓。
- C. 辦理現金增資供員工認購，使員工成為股東，分享公司成果，藉此吸引員工及留住人才並增強向心力。

### ② 產業前景看好，競爭者推出競品

由於晶片設計複雜度伴隨終端產品新型應用與日俱增，嵌入式 MTP SIP 技術具備可多次編寫之特性及成本競爭優勢，將吸引許多記憶體 SIP 設計服務供應商加快於 MTP SIP 市場開發腳步，進而推出競爭品項，未來矽智財產業之競爭亦將更顯激烈。

#### 因應對策：

- A. 考量邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體 SIP 之優劣特性，與基本單元(cell)架構有直接關係，且嵌入式 OTP SIP 開發經驗值並非可直接套用於嵌入式 MTP SIP 上，該公司目前已站穩 MTP SIP 研發經驗及技術領先優勢，未來將持續開發適用各項製程之 MTP SIP 產品，並持續縮小非揮發性元件面積，擴大產品規格領先優勢及應用市場，以滿足客戶需求並區隔競爭市場。
- B. 持續於不同晶圓代工廠、整合元件製造廠建置多樣化技術平台，進而提高嵌入式非揮發性記憶體技術 SIP 在晶圓廠、IC 設計公

公司及 IC 產品間之滲透率，以挹注業績之成長暨擴大市場占有率。

C. 架構專業技術服務系統，力求迅速反應客戶多元化需求，提供客戶完整的嵌入式記憶體 SIP 佈局並降低客戶開發成本，提升客戶服務滿意度暨穩固客供關係。

D. 提高公司知名度，開發國際級客戶使用該公司 SIP 技術。

#### 4. 公司競爭利基

##### (1) 市場先行者優勢

eNVM SIP 市場包含種類多樣之記憶體元件，其中，該公司成立初期選擇以高門檻、技術含量高之 MTP SIP 作為進入矽智財設計產業之發展主軸，惟早期由於此技術仍處開發中階段，MTP 之面積仍較 OTP 為大，且因其製程所需光罩次數較多而不具備產品成本優勢，故此技術方向在業界尚未被廣泛接受。然該公司憑藉在 MTP SIP 領域累積逾 20 年之技術開發經驗，已搶先取得多項 MTP SIP 專利技術。隨著 IC 產品生命週期縮短、晶片設計複雜度日益提升，需搭載 MTP SIP 使用之晶片需求逐漸成長，該公司藉由營運策略提前佈局，現已成為業界少數擁有 MTP SIP 之技術領導公司，成為市場競爭之一大利基。

##### (2) 獨特專利技術

近幾年 IC 產業在 AI 高效能運算潮流帶動下，全球 IC 業者對於先進製程之需求逐漸成長，以致晶片整合度之提升及對終端產品輕、薄、短、小之需求，逐漸成為 IC 技術發展主流趨勢。該公司藉由採用其自行研發 1 電晶體 1 電容 (1 Transistor, 1 Capacitor, 以下簡稱：1T1C) 之存儲單元專利技術，成功開發出極具小面積優勢之記憶體細胞，將此獨特專利技術套用於該公司之 MTP SIP，在非特殊製程及無內建升壓電路之情況下，可將 64kb(千位元)容量之 MTP SIP 面積縮小至 0.12mm<sup>2</sup>(平方毫米)，其面積已小於競爭者在相同容量及類似製程所推出之 OTP SIP(面積約為 0.169mm<sup>2</sup>)，並已進入製程量產階段。藉由低成本、小面積又可多次燒寫之產品優勢，除了進一步提升市場競爭力，亦可擴大產品適用範圍，提升市占率。

#### (二) 技術能力、研發及專利權之營運風險

##### 1. 取得專家之評估意見佐證

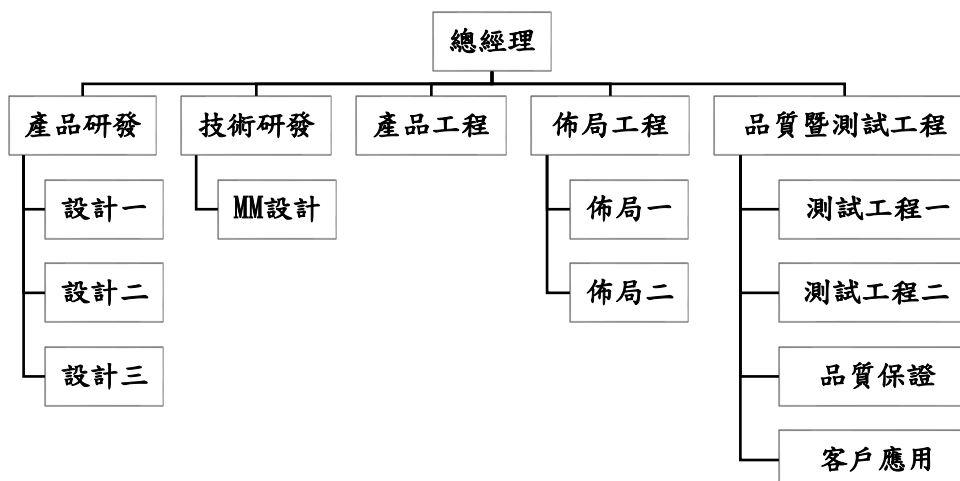
本證券承銷商與該公司並未委請技術專家就該公司之研發技術能力出具意見或報告，故不適用。

##### 2. 取得發行公司研究發展部門之沿革、組織、人員、學經歷、研究成果及未

來計畫等資料，以了解主要技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額，暨研發工作未來發展方向，並分析最近期及最近二個會計年度研發部門人員之人數、平均年資、流動情形及離職率等資料，評估研發人員離職對發行公司之營運風險

### (1)研發部門之沿革及組織

該公司係專業矽智財開發商，自民國 90 年成立以來積極建構堅實的研發技術與服務團隊，網羅來自國內、外產業界具有豐富實務經驗之人才，專注於邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體 SIP 開發與銷售領域。該公司為因應客戶需求多元化發展，研發出多樣化之創新矽智財，以協助客戶縮短產品設計週期、降低製造成本、提升產品競爭力並搶占市場先機為目標，因此相當重視公司研發設計能力之建置及培植。112 年截至 11 月底，該公司研發人員共計 48 人，其研發組織圖及各研發單位之職掌概述如下：



研發單位		工作內容
產品研發	設計一	1.產品之技術開發與設計。 2.整合公司資源，持續改進產品的性能及品質。 3.協助客戶解決應用上問題。 4.產品規格書製作。 5.產品設計套件製作。
	設計二	
	設計三	
技術研發	單晶微波電路(MM)設計	1.無線射頻之發射接收類比產品研究開發。 2.數位產品的研究開發。
產品工程處		1.產品規格擬定。 2.產品製作流程安排。 3.產品特性驗證分析。 4.產品特性改善建議。 5.協助客戶使用產品。 6.製程平台溝通窗口。
佈局工程	佈局一	1.產品之電路佈局設計。

	佈局二	2.協助客戶佈局嵌入合併驗證。
品質暨設計工程處	測試工程一	1.開發/維護產品相關之測試程式，使其能提供產品除錯/驗證工程之作業。 2.提昇測試程式之偵錯能力，確保產品驗證之完整性，解決產品驗證相關之技術問題。 3.提供產品測試驗證結果相關資料。 4.提供產品相關量產測試流程。
	測試工程二	
	品質保證	1.提昇驗證效率，節省測試時間。 2.驗證完整產品特性，確認其結果是否符合規格。 3.協助產品晶圓晶粒挑揀及封裝收送貨事宜。 4.提供產品完整特性驗證結果報告。 5.不良原因的分析制度建立與執行。 6.產品可靠度測試與失效分析。 7.實驗室儀器校正管理。 8.協助提供客戶產品相關可靠度問題。 9.提供產品可靠度驗證結果報告。 10.撰寫維護高溫工作壽命相關測試程式。
	客戶應用	1.處理並回應客戶之應用問題。 2.客戶故障產品之分析。 3.產品應用狀況之掌握與回覆。 4.提供故障分析報告。

資料來源：該公司提供。

(2)最近期及最近二個會計年度研發部門人員之人數、平均年資、學歷、流動情形及離職率

單位：人；年；%

項目		年度	110 年度	111 年度	112 年 11 月底
		員工人數	期初人數	43	45
	新進人數	12	7	4	
	離職人員	9	5	3	
	資遣及退休人數	1	—	—	
	期末人數	45	47	48	
平均服務年資(年)		5.6	6.4	6.6	
離職率(%)		18.18	9.62	5.88	
學歷分佈	博士	—	—	—	
	碩士	22	22	22	
	大學(專)	23	25	26	
	高中/高職	—	—	—	

資料來源：該公司提供。

註：離職率＝本期離職人數/(本期期末人數＋本期離職人數、資遣及退休人員)

該公司最近二年度及 112 年截至 11 月底，研發部門人數分別為 45 人、47 人及 48 人，所聘任人員以大學(專)及碩士以上學歷為主，顯示該公司相當重視研發人員素質。該公司 110~111 度及 112 年截

至 11 月底研發部門離職率分別為 18.18%、9.62 %及 5.88%，除 110 年度有一位研發部門人員因績效考核結果不如預期予以資遣外，其餘離職員工主係因其個人生涯規劃或家庭因素等而離職，未有研發人員集體離職之情形。該公司已訂定相關研發循環及資通安全管控辦法，嚴格控管及歸檔於研發過程之書面及電子檔紀錄並列為機密文件，此外，該公司與研發人員皆有簽署保密合約，以確保公司之智慧財產權，離職員工皆依公司規定完成工作交接，以避免人員流動所造成研發中斷之風險。整體而言，研發人員之流動對於該公司之研發部門運作及公司營運尚不致產生重大之影響。

(3)最近期及最近二個會計年度研發費用占營業收入之情形

單位：新臺幣千元；%

項目 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年 第三季
研發費用	89,596	107,830	80,705
營業收入淨額	168,192	229,420	144,732
研發費用/營業收入淨額(%)	53.27	47.00	55.76

資料來源：該公司經會計師查核簽證及核閱之財務報告。

該公司 110~111 年度及 112 年第三季研發費用分別為 89,596 千元、107,830 千元及 80,705 千元，占營收比重為 53.27%、47.00%及 55.76%。該公司研發費用主要投入於產品之開發上，性質主係研發人員薪資費用及研發設備所需攤提之各項費用。110~111 年度之研發費用占營業收入淨額比重下滑，主係因該公司過去年度所研發之產品已陸續完成驗證並進入量產階段，帶動 111 年度權利金收入大幅成長，間接使得研發費用占比相對下滑；另因 112 年度持續受到全球高通膨經濟環境之影響，導致終端消費性電子市場需求疲弱，使得 112 年第三季換算全年之權利金收入相較 111 年度下滑，惟該公司為持續維持一定之研發量能，故 112 年第三季換算全年之研發費用相較 111 年度差異微小，進而使得 112 年第三季研發費用占營業收入淨額比重相較去年同期上升。

該公司自成立以來，即積極從事新技術之開發與創新，持續擴編研發團隊並延攬產業優秀人才，且為精進整體研發實力亦持續投入相關研發經費，使研發費用呈逐年成長之趨勢。綜上所述，該公司研發費用及其占營收淨額比重之變動情形尚屬合理，尚無重大異常情事。



(4)重要研發成果

年度	開發技術或產品名稱	研發成果說明
109	Gen3 MTP 電源管理應用技術在 180 奈米 BCD 製程完成開發並導入量產，提供電源管理應用。	億而得所開發之 Gen3 cell 較 Gen2 cell 縮減約 30% 面積，加上 FTP SIP 及 MTP SIP 相較 eFlash SIP 所需之製程層數更少，故在中高容量 (128kb~512kb) 記憶體 SIP 市場中更具成本優勢。
	Gen3 FTP 技術在 110 奈米高壓製程完成開發並導入量產，提供電子紙應用。(原 OTP 應用市場)	
	Gen3 MTP 技術在 110 奈米邏輯製程完成開發並導入量產，提供微處理器應用。	
	Gen3 MTP 技術在 65 奈米 BCD 製程完成開發並導入量產，提供微處理器應用。	
110	Gen3 FTP 指紋 IC 應用技術在 180 奈米邏輯製程完成開發並導入量產。(原 OTP 應用市場)	Gen3 cell 已能逐漸取代部分 OTP 應用市場，搭配有著可多次編寫之優點特性，在少量多樣之應用市場，具產品推廣及驗證之方便性。
	Gen3 MTP 技術在 110 奈米高壓製程完成開發並導入量產，提供車用市場應用。	
	Gen2 FTP 技術在 90 奈米高壓製程完成開發並導入量產，提供平板、手機應用。(原 OTP 應用市場)	
	反熔絲 Gen1 OTP cell 取得美國專利。	
111	Gen5 FTP 技術在 180 奈米邏輯製程完成開發並導入量產，提供微處理器應用。	億而得開發之 Gen5 cell 成功將記憶體 SIP 面積相較 Gen3 cell 縮小約 30%，面積已幾乎相近於 OTP，成本相近且具備產品推廣及驗證方便性，使產品受到更多應用市場採用。此外，當年度推出 Gen1 Trim SIP 可多次寫入亦吸引客戶使用，客
	Gen1 Trim SIP 在 180 奈米 BCD 製程完成開發並導入量產，提供電源管理應用。	
	Gen5 FTP 技術在 110 奈米及 150 奈米邏輯製程完成開發並導入量產，提供微處理器應用。	

年度	開發技術或產品名稱	研發成果說明
		戶可以在封裝後修改設定，增加產品賣點。
112	Gen2 OTP SIP 在 180 奈米邏輯製程完成開發。	Gen5 cell 除了在微處理器應用已開始量產，亦開始導入在電源管理之應用，鑒於面積有絕對之優勢因此市場反應良好
	Gen5 FTP 技術在 90 奈米 BCD 製程完成開發並導入量產，提供電源管理應用。	
	Gen3 FTP 在 90 奈米高壓製程完成開發，提供電子紙應用(原 OTP 應用市場)	

資料來源：該公司提供。

### 3.說明主要技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額

該公司自投入嵌入式記憶體矽智財之設計以來，即不斷從事研發工作，並積極培育研發人才，其主要技術來源係來自該公司研發部門自行開發，惟為持續強化研發能力及拓展產品應用範圍，該公司部分技術係以支付授權金方式取得，其技術授權合約主要內容如下表所示：

合作對象	契約名稱	契約期間	內容摘要	技術報酬金或權利金
晶隼科技股份有限公司	專利專屬授權契約書	108.01.21 ~各該專利期間屆滿為止	特定專利授權	依約定分期支付金
國立中央大學	產學合作暨授權契約書	112.02.01~113.01.31	基於先進半導體之邏輯技術，先導式百萬元阻式記憶體製作計畫	依約定分期支付金

資料來源：該公司提供。

### 4.研發工作未來發展方向

嵌入式非揮發性記憶體 SIP 市場在未來幾年仍將持續蓬勃發展，該公司研發團隊以研發創新為主軸，持續提昇研發技術能力並設計出可滿足客戶需求之嵌入式非揮發性記憶體 SIP 技術，並擴大應用市場。茲就該公司短、長期未來之研發方向列示如下：

### (1)短期研發計畫

- ① 因應產品多元化需求，研發各式應用領域矽智財，如微控制 IC、功率 IC、觸控 IC 應用，建置更完整的 MTP SIP 資料庫解決方案，提供即時且更完善的客戶服務。
- ② 與韓國、日本、大陸晶圓代工廠、整合元件製造廠簽署合作契約，並提供給客戶更多製程平台技術作選擇，建立該公司、IC 設計公司及晶圓廠三方穩固策略夥伴關係，進而提升市場競爭力。
- ③ 開發先進製程所需非揮發性記憶體元件，透過產學、客戶合作以及招募高階技術相關人才，以加速研發速度及增加研發機會，與策略夥伴合作開發 55、40 奈米先進製程技術，並以持續縮小非揮發性記憶體元件面積為目標，擴大利基應用範圍。
- ④ 持續研發改進高階 SIP 之設計方法與流程，以降低成本和縮短產品上市時程為目標。

### (2)長期研發計畫

- ① 因應產品多樣化需求，持續研發新型記憶體技術，如 55、40 奈米以下先進製程技術元件開發，應用如通訊類相關產品。
- ② 專攻於智慧電力市場商機，持續精進研發旗下擁有面積小、低功耗、高效能同時具備成本競爭力之 MTP SIP，可廣泛支援物聯網、手機屏控、手機屏驅動、微控制器及感應器應用市場。
- ③ 藉由關鍵 SIP 的開發與佈局，包含單次(OTP)、多次(MTP)可程式非揮發性記憶體矽智財，建立完整的 SIP 平台，依產品應用需求，提供更具彈性的 OTP 與 MTP 整合方案，並架設公司產品專利保護網，確保該公司 SIP 在市場上的競爭優勢。

5. 目前已登記或已取得之專利權、商標權及著作權有無涉及違反專利權、商標權及著作權之情事，暨因應措施是否合理有效

截至評估報告出具日為止，該公司並無涉及違反專利權、商標權及著作權之情事，茲將該公司之專利權、商標權及著作權列示如下：

#### (1)專利權

##### ① 已取得

專利名稱	專利證號碼	註冊國家	申請日期	類型	有效期間 (起~迄)	
非揮發性記憶體及其操作方法	I231039	中華民國	2005/4/11	發明	2005/4/11	2024/4/29

專利名稱	專利證號碼	註冊國家	申請日期	類型	有效期間 (起~迄)	
單閘極之非揮發性記憶體的抹除方法	I281163	中華民國	2005/9/9	發明	2007/5/11	2025/9/8
單閘極之非揮發性記憶體及其操作方法	I319189	中華民國	2006/3/17	發明	2010/1/1	2026/3/16
低干擾性之單閘極非揮發性記憶體及其操作方法	I307161	中華民國	2006/7/11	發明	2009/3/1	2026/7/10
參考電壓產生裝置	I359343	中華民國	2008/02/13	發明	2012/3/1	2028/2/12
非揮發性記憶體的低壓快速抹除方法	I419166	中華民國	2010/01/08	發明	2013/12/11	2030/1/7
低電壓操作之電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列	I440034	中華民國	2010/07/16	發明	2014/6/1	2030/7/15
低成本電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列	I449045	中華民國	2010/07/16	發明	2014/8/11	2030/7/15
小面積電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列	I415251	中華民國	2010/07/30	發明	2013/11/11	2030/7/29
單閘源極共線之非揮發性記憶體及其操作方法	I559506	中華民國	2014/06/10	發明	2016/11/21	2034/6/9
低成本電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	I533310	中華民國	2014/11/21	發明	2016/5/11	2034/11/20
小面積電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	I530955	中華民國	2014/11/25	發明	2016/4/21	2034/11/24
降低電壓差之電子寫入抹除式可複寫唯讀記憶體及其操作方法	I563508	中華民國	2015/04/14	發明	2016/12/21	2035/4/13
單閘極多次寫入非揮發性記憶體的操作方法	I624034	中華民國	2016/11/21	發明	2018/5/11	2036/11/20
低電壓差之電子寫入抹除式可複寫唯讀記憶體及其操作方法	I640084	中華民國	2017/08/16	發明	2018/11/1	2037/8/15
單閘極之非揮發性記憶體的抹除方法	I635496	中華民國	2017/10/12	發明	2018/9/11	2037/10/11
低電流電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	I653631	中華民國	2018/08/17	發明	2019/3/11	2038/8/16
電子寫入抹除式可複寫唯讀記憶體的低壓快速抹除方法	I695489	中華民國	2019/03/07	發明	2020/6/1	2039/3/6
低電流電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的快速抹除方法	I678700	中華民國	2019/03/07	發明	2019/12/1	2039/3/6
單閘極多次寫入非揮發性記憶體及其操作方法	I690061	中華民國	2019/04/02	發明	2020/4/1	2039/4/1
單閘極多次寫入非揮發性記憶體陣列及其操作方法	I707344	中華民國	2019/10/08	發明	2020/10/11	2039/10/7
低電流電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操	I693602	中華民國	2019/11/13	發明	2020/5/11	2039/11/12

專利名稱	專利證號碼	註冊國家	申請日期	類型	有效期間 (起~迄)	
作方法						
電子寫入抹除式可複寫唯讀記憶體的操作方法	I710113	中華民國	2019/11/29	發明	2020/11/11	2039/11/28
低電壓反熔絲元件	I718861	中華民國	2020/02/04	發明	2021/2/11	2040/2/3
小面積低電壓反熔絲元件與陣列	I747528	中華民國	2020/09/28	發明	2021/11/21	2040/9/27
低成本低電壓反熔絲陣列	I744130	中華民國	2020/12/09	發明	2021/10/21	2040/12/8
高寫入效率的反熔絲陣列	I769095	中華民國	2021/10/08	發明	2022/6/21	2041/01/07
小面積側邊電容唯讀記憶體元件及其陣列與操作方法	I805189	中華民國	2022/01/14	發明	2023/6/11	2042/1/13
非揮發性記憶體及其操作方法	US7,099,192B2	美國	2004/06/07	發明	2004/6/7	2024/6/7
單閘極之非揮發性記憶體及其操作方法	US7,423,903B2	美國	2006/04/14	發明	2006/4/14	2026/12/23
非揮發性記憶體的低壓快速抹除方法	US8,218,369B2	美國	2010/01/25	發明	2010/1/25	2031/1/8
低成本電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列	US8,300,469B2	美國	2010/08/11	發明	2010/8/11	2031/12/9
低電壓操作之電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列	US8,305,808B2	美國	2010/08/12	發明	2010/8/12	2031/1/28
小面積電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列	US8,300,461B2	美國	2010/08/24	發明	2010/8/24	2024/4/30
單閘源極共線之非揮發性記憶體及其操作方法	US9,281,312B2	美國	2014/07/08	發明	2014/7/8	2034/8/7
低成本電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	US9,240,242B1	美國	2014/12/10	發明	2014/12/10	2034/12/10
小面積電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	US9,318,208B1	美國	2014/12/17	發明	2014/12/17	2034/12/17
降低電壓差之電子寫入抹除式可複寫唯讀記憶體及其操作方法	US9,601,202B2	美國	2016/09/08	發明	2016/9/8	2036/9/8
低電壓差之電子寫入抹除式可複寫唯讀記憶體及其操作方法	US10,242,741B1	美國	2017/09/19	發明	2017/9/19	2037/11/17
單閘極之非揮發性記憶體的抹除方法	US10,141,057B1	美國	2017/11/21	發明	2017/11/21	2037/11/21
低電流電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	US10,643,708B1	美國	2018/10/12	發明	2018/10/12	2038/10/12
低電流電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的快速抹除方法	US10,685,716B1	美國	2019/04/11	發明	2019/4/11	2039/4/11
電子寫入抹除式可複寫唯讀記憶體的操作方法	US11,004,857B1	美國	2020/01/21	發明	2020/1/21	2040/2/2

專利名稱	專利證號碼	註冊國家	申請日期	類型	有效期間 (起~迄)	
低電流電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	US10,854,297B 1	美國	2020/01/10	發明	2020/1/10	2040/1/10
低電壓反熔絲元件	US11,380,694B 2	美國	2020/03/04	發明	2020/3/4	2040/7/25
小面積低電壓反熔絲元件與陣列	US11,424,252B 2	美國	2020/10/29	發明	2020/11/23	2041/1/30
低成本低電壓反熔絲陣列	US11,502,090B 2	美國	2021/02/05	發明	2021/2/5	2041/7/24
單閘極的非揮發性內存及其操作方法	514050	中國大陸	2006/04/03	發明	2006/4/3	2026/4/2
低成本電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列	1270240	中國大陸	2010/08/05	發明	2013/9/11	2030/8/4
小面積電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列	1249787	中國大陸	2010/08/11	發明	2013/8/7	2033/8/10
低成本電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	3511238	中國大陸	2014/11/25	發明	2019/8/30	2034/11/24
小面積電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	3510467	中國大陸	2014/12/09	發明	2019/8/30	2034/12/8
降低電壓差的EEPROM及其操作方法(原：降低電壓差之電子寫入抹除式可複寫唯讀記憶體及其操作方法)	3510507	中國大陸	2015/04/15	發明	2019/8/30	2035/4/14
單閘極多次寫入非揮發性記憶體的操作方法	3690474	中國大陸	2016/11/29	發明	2020/2/14	2036/11/28
低電壓差的電子寫入抹除式可複寫唯讀記憶體及操作方法	3948652	中國大陸	2017/08/25	發明	2020/8/21	2037/8/24
低電流電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	4615038	中國大陸	2018/09/06	發明	2021/8/13	2038/9/5

資料來源：該公司提供。

## ② 申請中

專利名稱	專利申請號碼	註冊國家	申請日期	類型
單閘極多次寫入非揮發性記憶體陣列及其操作方法	201911024481.9	中國大陸	2019/10/25	發明
低電流電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	201911214012.3	中國大陸	2019/12/2	發明
帶電可擦除可程式設計唯讀記憶體的操作方法	201911415784.3	中國大陸	2019/12/31	發明
低電壓反熔絲元件	202010086112.9	中國大陸	2020/2/11	發明
小面積低電壓反熔絲元件與	202011178949.2	中國大陸	2020/10/29	發明

陣列				
低成本低電壓反熔絲陣列	202011528284.3	中國大陸	2020/12/22	發明
高寫入效率的反熔絲陣列	202111229153.X	中國大陸	2021/10/21	發明
高寫入效率的反熔絲陣列	17/455,546	美國	2021/11/18	發明
小面積側邊電容只讀存儲器元件及其陣列與操作方法	202210187660.X	中國大陸	2022/2/28	發明
小面積側邊電容唯讀記憶體元件及其陣列與操作方法	17/698,175	美國	2022/3/18	發明
小面積高效率唯讀記憶體陣列及其操作方法	112103524	中華民國	2023/2/1	發明
小面積高效率只讀存儲器陣列及其操作方法	202310101501.8	中國大陸	2023/2/10	發明
小面積高效率唯讀記憶體陣列及其操作方法	18/186,278	美國	2023/3/20	發明

資料來源：該公司提供。

## (2)商標權

商標名稱	商標註冊號數	註冊國家	有效期間 (起~迄)	
億而得微電子股份有限公司標章圖	01026524	中華民國	2012/12/16	2032/12/15
yntp	01704649	中華民國	2015/5/1	2025/4/30
yntp	01711125	中華民國	2015/6/1	2025/5/31
ymc 及標章圖	02163559	中華民國	2021/8/16	2031/8/15

資料來源：該公司提供。

## (3)著作權：無。

### 6.重要技術合作契約對該公司營運之風險

經評估上述簽訂之技術授權合約對該公司有強化技術能力及發展產生應用範疇效益，故對該公司營運應有正面幫助，經檢視其契約內容並未有重大不利限制條款，故對該公司營運應尚無不利之影響。

### 7.以科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市者，就其產品生產開發技術之層次、來源、確保與提升，暨現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究開發計劃，預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性及研究發展之內部控制暨保全措施

該公司並非以科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市，故不適用此評估事項。

8.以科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市者，其參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東、以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷（工作經驗、教育背景及職位年資）、持股比例、最近三個會計年度及申請年度內股權移轉變化情形暨該技術股東與經理人實際投入經營之時間與情形，並評估該等人員未來若未能繼續參與經營對發行公司財務業務之影響及其因應之措施

該公司並非以科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市，故不適用此評估事項。

9.以創新板上市者，就其創新特點及營運模式，因重大技術、產品、政策、經營模式變化等可能導致之風險暨所採行之因應措施

#### (1)創新特點及營運模式

在創新特點方面，就該公司所屬矽智財產業之 eNVM 市場來看，有別於其他記憶體 SIP 設計公司主要專注於僅能單次寫入且製程簡易之 OTP 產品，該公司則主要著墨於可多次讀寫且製程更為複雜之 MTP 產品，所需之研發技術亦更為艱難。近年來該公司採用自行研發之 1T1C 關鍵核心技術，成功開發出極具小面積優勢之第七代記憶體細胞，可將其中、高容量之 MTP SIP 面積縮小於競爭對手之 OTP SIP，藉此降低 IC 業者開發成本及提升設計彈性，為目前市場中最具競爭力之 MTP SIP。此外，該公司更透過創新材料及作法搭配於各類型 SIP 產品進行研發，持續突破既有框架技術，開創出記憶體市場中獨特之 SIP 設計架構，以滿足客戶對各式容量、寫入次數及面積大小等更具彈性應用之矽智財需求，並已取得多項發明專利，以掌握市場先機並加大競爭對手之技術門檻，顯見該公司已掌握產業關鍵研發技術且極具創新能力。該公司目前產品主要應用於微控制器 IC、電源管理 IC、指紋辨識 IC 及 AMOLED 顯示驅動 IC 等，未來將瞄準車用市場商機，研製先進製程之車用電子產品。

在營運模式方面，該公司為半導體產業體系中最上游之矽智慧財產權設計公司，專注於開發邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體矽智財，提供下游 IC 設計服務公司晶片開發所使用，故其主係以收取技術服務費及權利金為主。於新專案開發階段，依照客戶所要求之產品規格及其規格難易度，協助設計可應用之記憶體 SIP 或提供技術專利授權服務，於達成特定里程碑時階段性向客戶收取技術服務費，隨著該公司所開發之各式 SIP 經過晶圓代工廠及整合元件製造廠之



驗證及可靠度測試以後，即可被客戶採用並進入量產階段，再依據晶圓出廠片數及出廠價格等衡量方式訂定權利金比率，穩定收取權利金收入。矽智財產業建立起創新之授權營運模式，因無產銷實體產品，故具備「零庫存」之成本優勢，有效減少積壓庫存之風險及生產相關資本支出，使其擁有更具彈性之營運模式。

(2)因重大技術、產品、政策、經營模式變化等可能導致之風險暨所採行之因應措施

茲就該公司因重大技術、產品、政策、經營模式變化等可能導致之風險暨所採行之因應措施，說明如下：

①美中科技戰對半導體產業未來佈局之風險

近年來美中貿易戰已逐漸演變成半導體、人工智慧及 5G 通訊等領域之科技戰，各國政府陸續頒布半導體出口管制措施，限制先進製程設備及技術元件輸往中國大陸地區，以壓制其半導體技術之發展。惟中國大陸擁有全球最大之晶片市場，受到各國政府抵制政策之影響，將造成產業供應鏈移轉之風險，衝擊全球半導體產業發展，SIP 設計業者亦連帶受到波及，進而影響該公司之營收及獲利表現。

**因應措施**

依據美國頒布之出口管制條例，半導體禁令旨在限制中國大陸 10~20 奈米以下之先進製程發展技術，而針對 28 奈米以上之成熟製程則並非其主要管制目標。由於該公司 SIP 產品於中國大陸地區之佈局仍以 55 奈米及更成熟之製程節點為主，並未落於該管制條例之制裁名單中，故短期內對該公司營運狀況無產生直接之影響，未來該公司於中國市場亦持續朝往成熟製程方向發展，預期中國市場晶圓代工業者在先進製程技術受限下將積極擴充成熟製程產能，且在物聯網、電動車及工業等趨勢領域需求持續提升，將帶動電源管理、微控制器及 Wi-Fi 等晶片供不應求，有助於推升公司整體業績表現。

②主要產品市場占有率低對公司營運規模之風險

早期記憶體 SIP 產業由於技術發展受限，使得該公司主要產品 MTPSIP 雖可提供客戶多次讀寫之功能，惟因面積仍較 OTPSIP 為大而不具備相應之成本優勢，且下游 IC 設計業者多考量採以數顆面積較小之 OTP SIP 組合方案來取代其僅能一次性編寫之效能限制，進而與該公司產品產生排擠效應，故 MTPSIP 並非成為初期市

場上主流採用之記憶體 SIP 技術，進而導致該公司營運規模不及同業競爭者之風險。

### **因應措施**

該公司專注於 MTP 技術領域已累積多年開發經驗，透過自有記憶體細胞單元專利，已可將其 MTP SIP 面積縮小於同業之 OTP SIP，並完成晶圓廠功能及製程相關驗證且成功導入量產，論其產品效能及效益皆已優於同業競品。此外，考量 OTP SIP 仍占有較高之市占率，加上現有客戶對該公司 SIP 設計架構較為熟悉且亦提出 OTP SIP 產品相關需求，故該公司擬藉由新開發之創新技術，提供可電子式寫入十次或面積可縮小至現有供應商 SIP 之 80% 等產品競爭優勢，並透過合作客戶取得新製程平台投產機會，搶攻 OTP SIP 市場商機，目前該公司 OTP SIP 產品已獲客戶驗證採用，並用作 0.18 $\mu\text{m}$ 、0.35 $\mu\text{m}$  等製程量產使用。綜上所述，受惠於 IC 產品週期縮短及設計複雜度增加之產業趨勢，MTP SIP 市場需求及新應用領域將逐步浮現，另隨著半導體產業持續追求製程微縮技術發展，將帶動以 OTP SIP 應用為主之先進製程需求成長，該公司將逐步切入 OTP SIP 市場，並占有產業領先技術優勢，建置完整之記憶體 SIP 資料庫客製化解決方案，有效提升該公司產品競爭優勢及市占率。

10. 以創新板上市者，就其產品生產開發技術之層次、來源、確保與提升，暨現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究開發計劃，預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性及研究發展之內部控制暨保全措施

#### **(1) 產品生產開發技術之層次、來源、確保與提升**

該公司所屬半導體市場最上游之矽智財設計產業，主要提供「邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體」矽智財授權及技術開發服務，相較於一般傳統的唯一讀記憶體(Read-Only Memory，以下簡稱：ROM)元件，其技術層次有著顯著之差異，在傳統的 ROM 製程技術中，起初即會將特定程式碼以光罩方式寫入記憶體元件中，且寫入後即無法再做任何修改，限制了產品設計之彈性及生產研發效率，而採用該公司自行研發之記憶單元技術，另搭載不同邏輯控制線路所設計之 OTP SIP(單次寫入)、MTP SIP(多次寫入)及 EEPROM SIP(電子抹除式寫入)等矽智財產品，可根據客戶不同產品及製程特性需求，提供可編程、面積小、高效能及高穩定度之嵌入式記憶體矽智財客製化解決方案，大幅提升客戶產銷彈性及產品競爭力。

該公司之主要技術來源為研發部門自行開發為主，其可提供具競爭力之記憶體規格與面積，與邏輯製程相容之技術更使其可靈活應用於各技術平台如邏輯(logic)、高壓(high-voltage)、混合信號(mixed-mode)、BCD (bipolar-CMOS-DMOS)等製程，提供客戶高性價比及特殊需求之最佳嵌入式記憶體矽智財解決方案。

該公司經驗豐富之技術研發團隊，除藉由公司內部專業訓練之外，亦透過特定外部課程深耕技術層次，必要時亦會與大專院校或研究機構進行產學合作計畫，另為保護公司研發成果及智慧財產權，該公司已於內部控制制度中之研發循環訂定技術文件管理相關作業程序，嚴格把關各階段之研發資料皆受有系統性安全控管，並將新技術之研發成果申請專利權保護，直接或間接提升及確保公司整體技術能力。

## (2)現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性

### ① 主要產品之競爭優勢

該公司之主要產品係屬嵌入式 MTP 非揮發性記憶體 SIP，相較於傳統製程便宜卻僅能一次性編程之嵌入式 OTP SIP 以及製程昂貴但可多次編程之嵌入式 Flash SIP，嵌入式 MTP SIP 結合兩者優勢，提供客戶以一般製程之晶圓價格，得到多達 10~100K 次擦寫次數之使用效能，此技術特色適合為參數與組態設定、系統程式編碼儲存與紀錄及安全辨識管理等應用，提供最適用且經濟實惠 eNVM SIP 之解決方案。此外，該公司 MTP SIP 之設計採用自行研發之 1T1C 記憶細胞及記憶陣列核心技術專利，大幅縮小嵌入式 MTP SIP 產品面積，不僅有效降低產品讀寫電壓提升客戶產品效能，並提升極具競爭力之成本效益。

### ② 主要產品之生命週期

相較於一般記憶體 SIP 設計公司係以專用製程設計服務為主，SIP 產品僅需依規格要求範圍內完成相關功能及特性驗證即可使用，製程驗證項目較少，產品可量產性也較低，而該公司 MTP SIP 所需之技術層級高，多應用於穩定性高及可量產性之非專用製程，需遵照晶圓廠提供之超規格製程規範，額外通過高低溫寫入次數、讀取能力及製程可靠度測試等各項功能驗證，故 MTP SIP 從開發至完成驗證一般需要 2 年的時間才可進入量產階段。然該公司主要產品由於並非終端產品，其生命週期應依各式 MTP SIP 終端應用而定，而目前客戶終端產品多應用於對產品耐用性及穩定性要

求甚高之家用電器及車用電子市場，其產品生命週期可長達 5~10 年之久，隨著客戶 SIP 累積使用量逐年增加，將帶動該公司權利金收入持續成長。

### ③ 主要產品之持續發展性

隨著半導體製程技術日益精進，消費性電子市場面臨少量多樣之需求挑戰，促使系統單晶片(System on Chip；以下簡稱：SoC)設計已成為 IC 產業發展顯學，進而使得晶片整合趨勢快速提升。該公司嵌入式非揮發性記憶體技術涵蓋多次反覆讀寫之功能及各式記憶體容量之產品特性，提供客戶在相同硬體產品設計中，可靈活變更不同版本之韌體，快速反應不同終端產品應用需求，將大幅縮減產品開發時程，提升產品市場競爭力。顯見隨著 5G、AI、物聯網及車用市場等利基型應用領域快速崛起，IC 設計產業規模逐年擴大，SIP 產品之運用將扮演 IC 產業重要關鍵之角色。該公司未來將持續投入新產品及新技術之研究發展計畫，結合掌握產業關鍵技術競爭優勢，開發如微控制器、電源管理、OLED 面板驅動及無線充電等各式 IC 應用領域，聚焦於車用電子、智慧電力及物聯網等利基市場，建置更完整 MTP SIP 資料庫之解決方案，希冀成為嵌入式 MTP 非揮發性記憶體 SIP 之領導廠商。

### (3)新產品之研究開發計畫，預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性

#### ① 新產品之研究開發計畫、預計生產時程及成本

產品項目	計畫研發之新產品	預計時程
100K cycle EEPROM	研發第 1 代 HEEPROM 記憶胞架構，提供高讀寫次數至 100K 次之嵌入式 EEPROM，可應用於 DDR5 電源管理、車用及工控監測產品	預計 2024 年中完成驗證
Anti-fuse OTP (反熔絲 OTP)	研發第 2 代 OTP 記憶胞架構，提供相較競爭者產品縮小約 30%之面積優勢，可應用於 OLED 面板驅動 IC 及車用電子市場	預計 2024 年底完成驗證
MTP/Flash SIP	研發第 7 代多次寫入記憶胞，可應用於 MTP 及 Flash SIP，將面積持續縮小於 0.5 $\mu\text{m}^2$ ，讀取速度達 25ns(奈秒)，強化產品效能及擴大應用範圍	預計 2024 年底完成產品開發

產品項目	計畫研發之新產品	預計時程
HKMG MTP	研發第 1 代 HKMG(高介電常數金屬閘極)記憶胞架構，將 HKMG 材料與 MTP 技術之結合，擴大 MTP 技術於先進製程之應用範疇	預計 2024 年底完成工程驗證

資料來源：該公司提供。

#### ② 新產品之市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性

該公司未來產品開發計畫係以目前現有之技術持續延伸，除了強化現有產品之效能外，為因應終端產品應用功能日益擴增且符合市場發展趨勢，透過採用創新材料及作法研發新型記憶胞架構，陸續開發出多樣化之 SIP 新品，以提升產品競爭力並擴大應用領域。該公司目前已針對其開發之核心技術申請專利保護，其新產品之市場定位將鎖定下一代主量趨勢產品，如：OLED 面板驅動 IC、車載 IC、電源管理 IC、物聯網 IC 及微控制器 IC 之產品需求，以主要應用市場及先進製程技術平台作為該公司新產品發展之主要目標。根據研究機構 Gartner 之估計，2021 年全球物聯網終端電子市場規模為 4,100 億美金，預估 2021 年至 2031 年整體市場規模之年複合成長率將達 8.8%，隨著聯網技術蓬勃發展，將為汽車電子、穿戴式裝置、智慧家庭及無線充電等終端應用領域帶來絕佳之發展前景，該公司未來將憑藉其研發團隊開發之技術，持續以技術領先思維，提升產品寫入次數、容量規格與讀寫速度，提供客戶更為優異之產品效能及性價比。綜上所述，由於該公司所處相關應用市場持續成長，加上新產品推出使公司產品線更加完整，適用於更多終端產品，因此，隨著新產品授權客戶增加及權利金之貢獻成長，未來營收之成長係可預期，故未來營收效益應可順利達成。

#### (4) 研究發展之內部控制暨保全措施

該公司為強化資訊安全管理，確保所屬之研發資產之機密性及完整性，於公司內部建置資通安全風險管理架構，成立智財管理部門及跨部門資訊安全委員會並由總經理擔任總召集人，予以制定資訊安全及個人資料管理目標及政策，另亦設置資訊安全主管，負責推動並具體落實資訊安全措施。

該公司所屬高技術密集之矽智財產業，相當重視資安風險控制與保護，其佈建多層次資安管控防護網，實施嚴格之管控措施，如研發部門採用經防火牆控管之專用封閉式網路作業，無法連線至外

部網路並禁止使用未經授權之軟體、重要研發資料定期執行異地備份，且異地備份每周更換一次備份媒體，以此確保資料存儲之安全性、資訊設備進出必須遵照流程提出申請核准，禁止攜入私人儲存裝置及設備進行拍照或錄影、電腦機房實施門禁管制，人員進出須詳實紀錄於機房工作日誌，且權限需定期進行重新審閱等，此外，該公司亦定期透過實體或線上課程給予全體同仁進行資安教育訓練，建構完善之資安管控及防護意識。

11.以創新板上市者，其參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東、以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷（工作經驗、教育背景及職位年資）、持股比例、最近二個會計年度及申請年度內股權移轉變化情形暨該技術股東與經理人實際投入經營之時間與情形，並評估該等人員未來若未能繼續參與經營對發行公司財務業務之影響及其因應措施

(1)參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東、以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等資歷、持股比例、實際投入經營之時間與情形

112年11月30日；單位：年；%

職稱	姓名	主要學(經)歷	產業年資	公司服務年資	持股比例
董事長兼總經理	黃文謙	國立清華大學物理系學士 華邦電子(股)公司行銷業務經理 凌巨科技(股)公司行銷業務處長	36.5	22	3.81
董事	陳鴻文	國立清華大學電機所碩士 台灣積體電路製造(股)公司工程師 太欣半導體(股)公司工程師	36	13	3.39
董事	陳永華	國立清華大學物理系學士 大同工學院事業經營研究所碩士 精強科技(股)公司總經理	36	13	4.41
董事	魏雅庵	南亞技術學院土木工程系 中華民國工業區北部理事長聯誼會會長	35	4	2.09
董事	鄭玗姝	空中商專 台揚科技資深會計 億而得微電子股份有限公司經理	31	22	2.50
獨立董事	潘燕民	文化大學經濟研究所碩士 鍊德科技股份有限公司投資部副總經理	30	5	—

獨立董事	吳清沂	國立清華大學電機所博士 嘉聯益科技股份有限公司獨立董事	36	5	—
獨立董事	林月霞	東海大學會計系學士 正大聯合會計師事務所執業會計師	32	5	—
獨立董事	李展南	國立中興大學企研所碩士 臺灣證券交易所專員 臺灣期貨交易所副組長	33	5	0.02
副總經理	吳政穎	國立交通大學電信工程所碩士 華邦電子(股)公司資深工程師	28.3	19	0.17
副總經理	吳其沛	國立清華大學電子工程所碩士	15	15	—

資料來源：該公司提供。

(2)參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東、以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等，最近二個會計年度及申請年度內股權移轉變化情形

單位：股

職稱	姓名	109 年度	110 年度		111 年度		112 年度 截至 11 月 30 日	
		期末 股數	增(減) 股數	期末 股數	增(減) 股數	期末 股數	增(減) 股數	期末 股數
董事長 兼總經理	黃文謙	1,025,425	(45,000)	980,425	40,000	1,020,425	—	1,020,425
董事	陳鴻文	909,575	—	909,575	—	909,575	—	909,575
董事	陳永華	722,685	(29,000)	693,685	481,000	1,174,685	8,000	1,182,685
董事	魏雅庵	699,040	(12,000)	687,040	—	687,040	(126,000)	561,040
董事	鄭玥姝	700,000	(18,000)	682,000	(3,000)	679,000	(9,000)	670,000
獨立董事	潘燕民	—	—	—	—	—	—	—
獨立董事	吳清沂	—	—	—	—	—	—	—
獨立董事	林月霞	—	—	—	—	—	—	—
獨立董事	李展南	10,000	—	10,000	(5,000)	5,000	—	5,000
副總經理	吳政穎	51,234	(6,000)	45,234	—	45,234	—	45,234
副總經理	吳其沛	—	—	—	—	—	—	—

資料來源：該公司提供。

110~111 年度及截至 112 年 11 月 30 日止，該公司參與經營決策之董事及掌握生產技術與技術開發經理人之股權變動，主係策略投資規劃及自身理財因素致持股異動，並未發現有重大異常情形之股權移轉或轉讓之情事。

(3)參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東、以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等，未來若未

能繼續參與經營對發行公司財務業務之影響及其因應之措施

該公司參與經營決策之董事及掌握技術開發之經理人均具備營運及業務發展所需之產業相關經驗，其營運策略方向主係透過董事在董事會提供營運及經營策略之適當建議，並無單一董事或集團控制該公司經營或日常運作之情事；而該公司因無以專門技術出資之股東，關鍵核心技術均掌握於其研發團隊中，智慧財產擁有權亦歸屬於億而得，並非由單一個人能完全掌握且無技術集中於特定人士或組織之情事。綜上所述，即便上述董事或經理人未來不繼續參與公司之經營，然因公司重大決策與營運方針係由董事會決議，致使公司之治理仍可有效實施，此外，該公司建立完善之研發循環內部控制制度及相關作業辦法，使得研發成果得以保留於公司內部，作為後續研發團隊改善及追蹤之依據，並能在智慧資產及經驗傳承中保持完整性，致該等人員之異動尚不致對該公司產生重大影響。

12.以創新板上市者，屬生技醫療業者，應就其核心產品之臨床試驗進度加以評估

該公司非屬生技醫療業者以創新板上市者，故不適用此項評估。

(三)人力資源之營運風險

1.員工總人數、離職人員、資遣或退休人數、直接或間接人工數、平均年齡及平均服務年資等資料，以評估離職率之變化情形及對發行公司營運之風險

(1)最近二年度及申請年度截至最近期止員工總人數、離職人員、資遣或退休人數、直接或間接人工數、平均年齡及平均服務年資

單位：人；%

年度		110 年度	111 年度	112 年 11 月底
		人數		
期初人數		57	64	63
新進人數		22	10	6
減少 人數	離職人數	14	10	4
	資遣人數	1	—	—
	退休人數	—	1	—
期末人數		64	63	65
平均年齡(歲)		35	36	35
平均服務年資(年)		6.3	6.4	7.0
學歷分布 比率(%)	博士	—	—	—
	碩士	42.19	41.27	41.54



年度 人數		110 年度	111 年度	112 年 11 月底
		大學(專)	57.81	58.73
	高中(職)	—	—	—

資料來源：該公司提供。

(2)最近二年度及申請年度截至最近期止員工離職率之變化情形

單位：人；%

年度 人數	110 年度			111 年度			112 年 11 月底		
	離職 人數	期末 人數	離職率	離職 人數	期末 人數	離職率	離職 人數	期末 人數	離職率
經理人	—	8	—	1	7	12.50%	—	8	—
一般 職員	15	56	21.13%	10	56	15.15%	4	57	6.56%
合計	15	64	18.99%	11	63	14.86%	4	65	5.80%

資料來源：該公司提供。

註 1：離職率＝本期離職人數/(本期期末人數+本期離職人數)。

註 2：本期離職人數包含資遣及退休人數。

該公司最近二年度及申請年度截至最近期止，期末人數分別為 64 人、63 人及 65 人，其員工人數變化微小，主係隨公司營運規模變化而調整人力所致。在員工平均年齡及服務年資方面，該公司員工平均年齡為 35 歲至 36 歲，平均服務年資為 6.3 年至 7.0 年，顯示該公司員工主要為青壯年人口且呈現增加之趨勢，對公司營運之穩定及成長將有所助益。該公司目前員工學歷組成以大學及專科(含)以上為主，顯見該公司對人力素質之重視，未來將持續招募高度學術涵養及專業素養之人才，以強化公司技術實力及市場競爭力，經評估尚無重大異常情事。

在離職率方面，110~111 年度及 112 年截至 11 月底之離職(含一般離職、資遣及退休)人數分別為 15 人、11 人及 4 人，離職率分別為 18.99%、14.86%及 5.80%，離職員工除一名經理人外，其餘皆為一般職員，離職原因主係為個人生涯規劃及家庭因素等；另 110 年度有一名資遣員工，主係因工作不適任而予以資遣，針對前述資遣員工，該公司業已依法向主管機關通報，並依規定給予資遣費，並無損及資遣員工權益之情事。

該公司針對員工相關作業辦法已建有完整書面管理制度，並備有職務代理制度，故人力增補後可順利銜接。整體而言，該公司各

年度之人員異動情形尚屬合理，尚無因人員異動而對公司營運造成重大不利之影響。

#### (四)各主要產品之成本分析

- 1.最近二年度及申請年度截至最近期止主要產品之原料、人工及製造費用資料，並分析各成本要素比率變化對發行公司營運之風險

該公司係提供嵌入式非揮發性記憶體技術之 SIP 技術授權與設計服務，因此無實體貨品產出，亦無投入直接原料、直接人工及製造費用，故不適用此項評估。

- 2.符合「有價證券上市審查準則」第十六條規定之公司申請股票上市者，取得當(鄰)地行情報導、同業資料及政府機關提供之房地價格比例(如評定現值及公告現值比例或房屋造價及地價比例等)，以評估合建分售、合建分屋或合建分成者，發行公司與地主之分配比率是否合理

該公司非屬「有價證券上市審查準則」第十六條規定之建設公司申請上市者，故不適用本項評估。

#### (五)匯率變動情形

- 1.最近二年度及申請年度截至最近期止內外銷、內外購之金額與比例

該公司係提供嵌入式非揮發性記憶體技術之 SIP 技術授權與設計服務，因此無實體貨品產出，未有採購原料之情事，故僅以最近二年度及申請年度至最近期止內外銷之金額與比率評估。

##### (1)最近二年度及申請年度截至最近期止內外銷之金額與比例

單位：千元

項目	年度	110 年度		111 年度		112 年第三季	
		金額	%	金額	%	金額	%
內銷	新臺幣	30,422	18.09	34,074	14.85	18,514	12.79
	美金	31,541	18.75	41,956	18.29	16,475	11.39
	小計	61,963	36.84	76,030	33.14	34,989	24.18
外銷	美金	105,279	62.59	151,756	66.15	108,472	74.94
	人民幣	950	0.57	1,634	0.71	1,271	0.88
	小計	106,229	63.16	153,390	66.86	109,743	75.82
銷貨合計		168,192	100.00	229,420	100.00	144,732	100.00

資料來源：該公司提供。

該公司 110~111 年度及 112 年第三季美金銷售占整體營收之比率分別為 81.34%、84.44%及 86.33%，銷售地區主要為臺灣、中國大陸、新加坡及韓國，惟應客戶要求多以美金為計價幣別，因此美金匯率變動將對該公司之營收及獲利造成影響。

## 2.最近二年度及申請年度截至最近期止兌換損益占營收淨額及營業利益之情形

單位：新臺幣千元；%

項目	年度	110 年度	111 年度	112 年 第三季
兌換利(損)益		(640)	1,082	764
營業收入淨額		168,192	229,420	144,732
營業利益		43,338	78,846	31,399
兌換利(損)益/營業收入		(0.38)	0.47	0.53
兌換利(損)益/營業利益		(1.48)	1.37	2.43

資料來源：該公司 110~111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司 110~111 年度及 112 年第三季兌換利(損)益占營收淨額比率分別為 (0.38)%、0.47%及 0.53%；兌換利(損)益占營業利益比率則分別為 (1.48)%、1.37%及 2.43%。110 年度因受到美國聯準會為抑制經濟大幅衰退，維持自疫情期間以來實施之寬鬆貨幣政策，使美元對新臺幣匯率持續走貶，致該公司 110 年度產生兌換損失 640 千元；111 年度由於俄羅斯與烏克蘭軍事衝突擴大，造成全球通膨壓力升高，致使美國聯準會決議啟動升息循環，截至 111 年底美國聯準會共升息 4.25%，使得美元對新臺幣強勢升值，致該公司 111 年度產生兌換利益 1,082 千元；112 年截至第三季因美國通貨膨脹情形尚未緩解，美國聯準會持續升息予以因應，致美元兌新臺幣匯率升值，使得該公司 112 年第三季產生兌換利益 764 千元。

該公司及 110~111 年度及 112 年第三季之兌換利(損)益占營業收入比例分別為(0.38)%、0.47%及 0.53%，占營業利益比例分別為(1.48)%、1.37%及 2.43%，顯見該公司兌換利(損)益占各年度營業收入及營業利益比重甚微，且其兌換損益之變化情形與匯率變動趨勢尚屬合理，尚不致因匯率變動而對其營運產生重大風險，惟該公司亦將適時採取必要之避險措施，以防止兌換損失侵蝕獲利水準之風險。

## 3.申請公司之避險措施

該公司對於匯率變動風險之因應係以規避風險為原則，不以投機交易為目的，所採取之具體因應措施如下：

(1)與主要往來銀行開立外匯存款帳戶，客戶匯入之貨款則視實際資金需

求及匯率可能變動趨勢，適時決定外幣兌換或存入外匯存款帳戶。

(2)公司財務單位與各銀行之外匯部門保持密切聯繫，並隨時蒐集市場匯率變化之相關資訊，充分掌握國內外匯率走勢及變化資訊，以降低匯率變動所產生之負面影響。

(3)公司業務單位進行報價前，會先行對未來之匯率走勢及影響匯率之因素做綜合考量及評估，以決定適當且合理之報價，降低因交易而產生之匯兌風險，以保障公司之合理利潤。

經評估該公司最近二年度及申請年度兌換損益情形及因應匯率變動之具體措施應屬允當。

## 參、業務狀況

### 一、營業概況

(一)最近期及最近二個會計年度主要銷售對象及供應商(年度前十名或占年度營業收入淨額或進貨淨額 5%以上者)之變化分析

1.最近期及最近二個會計年度主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例，主要銷售對象變化情形之原因並分析是否合理，是否有銷售集中之風險，並簡述發行公司之銷售政策

(1)最近期及最近二個會計年度主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例

單位：新臺幣千元

年 度 排 名	110 年度				111 年度				112 年前三季			
	名稱	金額	佔全年度 銷貨淨額 比率(%)	與發行 人之關 係	名稱	金額	佔全年度 銷貨淨額 比率(%)	與發行 人之關 係	名稱	金額	佔全年度 銷貨淨額 比率(%)	與發行 人之關 係
1	A公司	30,654	18.23%	無	A公司	43,317	18.88%	無	A公司	27,601	19.07%	無
2	B公司	25,449	15.13%	無	B公司	33,951	14.80%	無	B公司	18,440	12.74%	無
3	C公司	14,113	8.39%	無	K公司	23,808	10.38%	無	K公司	17,364	12.00%	無
4	D公司	9,961	5.92%	無	C公司	21,936	9.56%	無	C公司	14,583	10.08%	無
5	E公司	9,356	5.56%	無	F公司	10,067	4.39%	無	I公司	8,463	5.85%	無
6	F公司	7,988	4.75%	無	E公司	9,717	4.23%	無	N公司	6,969	4.81%	無
7	G公司	7,923	4.71%	無	G公司	9,563	4.17%	無	F公司	6,056	4.18%	無
8	H公司	7,265	4.32%	無	L公司	7,847	3.42%	無	E公司	3,820	2.64%	無
9	I公司	4,976	2.96%	無	D公司	7,339	3.20%	無	O公司	3,585	2.48%	無
10	J公司	4,415	2.63%	無	M公司	6,725	2.93%	無	H公司	3,154	2.18%	無
	其他	46,092	27.40%	—	其他	55,150	24.04%	—	其他	34,697	23.97%	—
	營業淨額	168,192	100.00%	—	營業淨額	229,420	100.00%	—	營業淨額	144,732	100.00%	—

資料來源：該公司提供。

## (2)主要銷售對象變化情形之原因並分析是否合理

該公司主要從事嵌入式非揮發性記憶體矽智慧財產權(以下簡稱 eNVM SIP)技術之研究開發、功能設計及授權服務等業務，依交易模式不同，該公司收入來源可分為技術服務收入及技術權利金收入，其主要銷售客戶為臺灣、新加坡、中國及韓國等晶圓代工廠及 IC 設計公司。該公司 110~111 年度及 112 年第三季之銷售對象及金額受到市場需求、客戶營運政策改變等因素影響，致各年度間主要銷售客戶有所變動，茲就主要銷售對象變化情形說明如下：

### ① A 公司

A 公司成立於民國 98 年，總部位於美國加利福尼亞州聖克拉拉，為美國 NASDAQ 上市公司，資本額為 80.3 億美元，為全球第四大晶圓代工製造廠商，該公司於 104 年與 A 公司簽訂授權合約至今，主要係授權使用於 0.18、0.15 微米製程之 MTP SIP，並應用於 MCU 及電源管理 IC 等終端產品。

該公司 110~111 年度及 112 年第三季對 A 公司之銷售金額分別為 30,654 千元、43,317 千元及 27,601 千元，占營收淨額比重分別為 18.23%、18.88%及 19.07%。111 年度銷售金額較 110 年度增加，主係受到 110 年晶片缺貨影響延續，市場擔心供應鏈中斷，使 IC 設計公司積極備貨並提高庫存準備，並與晶圓代工廠簽訂長約以確保順利取得產能，根據 EPS News 報導 A 公司 111 年產能使用率達 90%，晶圓出貨量大增帶動該公司技術權利金收入大幅成長，111 年第三季及 112 年第三季對 A 公司銷售金額分別為 33,622 千元及 27,601 千元，占營收淨額比重分別為 20.00%及 19.07%，112 年第三季銷售金額相較 111 年同期減少，係因 112 年全球經濟持續面臨高通膨壓力、地緣政治風險及各國央行接連升息等因素，導致經濟成長動能明顯減緩，終端消費市場購買力道衰弱，供應鏈備貨心態趨於謹慎，IC 設計公司庫存居高不下，面臨調整庫存去化階段，整體半導體產業進入淡季，而晶圓出貨量下滑致該公司收取之技術權利金減少；惟在合作開發設計 SIP 產品方面，受到終端需求冷卻晶圓代工廠釋出產能，進而加速產品開發之各項驗證時程，A 公司委託該公司設計於 1.8V、6V 等不同電壓製程應用之 MTP 產品，多於 112 年前三季達成特性及品質驗證之里程碑，使技術服務收入成長，故最近二年度及 112 年第三季 A 公司皆為該公司第一大銷售客戶。

## ② B 公司

B 公司成立於民國 83 年，為我國上櫃公司，實收資本額為新臺幣 16,389,823 千元，為全球第八大晶圓代工製造廠商，該公司於 98 年與 B 公司簽訂授權合約至今，期間雙方配合良好，該公司已有多項 SIP 上架至其製程設計平台，供終端客戶選擇使用，主要係 0.18~0.5 微米製程，並應用於 MCU、電源管理 IC 及顯示器驅動 IC 等產品。

該公司 110~111 年度及 112 年第三季對 B 公司之銷售金額分別為 25,449 千元、33,951 千元及 18,440 千元，占營收淨額比重分別為 15.13%、14.80%及 12.74%。111 年度銷售金額較 110 年度增加，主係 B 公司委託該公司設計開發使用於 BCD 製程之專案，於 111 年分別達到各項里程碑，致技術服務收入增加；又受到 110 年晶片缺貨影響，使 IC 設計公司提高庫存準備，同時帶動 111 年度技術權利金收入成長。111 年第三季及 112 年第三季對 B 公司銷售金額分別為 23,463 千元及 18,440 千元，占營收淨額比重分別為 13.96%及 12.74%，112 年第三季銷售金額相較 111 年同期減少，主係 112 年半導體產業進入庫存調整階段且終端消費性電子市場購買力道減緩，晶圓出貨量下滑致該公司收取之技術權利金減少，而 B 公司委託設計之 BCD 專案仍持續達成品質驗證里程碑，使 B 公司於最近二年度及 112 年第三季皆為該公司第二大銷售客戶。

## ③ C 公司

C 公司為位於韓國專注生產電源管理 IC、驅動面板 IC 及 MCU 之 8 吋晶圓代工廠，隸屬於全球前三大記憶體供應商旗下之晶圓代工事業體。該公司於 101 年與 C 公司簽訂授權合約，主要係授權 0.16 及 0.18 微米製程之 MTP SIP，並應用於 MCU 及電源管理 IC 等產品。

該公司 110~111 年度及 112 年第三季對 C 公司之銷售金額分別為 14,113 千元、21,936 千元及 14,583 千元，占營收淨額比重分別為 8.39%、9.56%及 10.08%。111 年度銷售金額較 110 年度增加，主係受到 110 年晶片缺貨影響，IC 設計公司提高庫存準備，使晶圓出貨量增加，且新使用該公司 SIP 之終端客戶已於 C 公司投片完成進入量產階段，帶動 111 年技術權利金收入成長，惟 C 公司相較於其他晶圓代工大廠成長幅度較小，使其原於 110 年度為該公司第三大銷售客戶，至 111 年度退居於第四大銷售客戶。111 年第三季及 112 年第三季對 C 公司銷售金額分別為 14,289 千元及 14,583 千元，占營收淨額比重分別為 8.50%及 10.08%。雖 112 年半導體產業面臨庫存調整使整體產業進入

淡季，在智慧聯網(AIoT)及電動車應用之相關軟硬體技術日趨成熟之下，應用於伺服器之電源管理 IC，市場需求持續成長，使終端客戶仍維持投片量，致該公司 112 年第三季授權金收入相較 111 年同期呈現微幅增加趨勢。

#### ④ D 公司

D 公司成立於民國 83 年，為我國上市公司，實收資本額為新臺幣 40,692,493 千元，為全球第七大晶圓代工製造廠商，該公司於 98 年與 D 公司簽訂授權合約，主要係授權 0.09、0.13、0.18 微米製程之 MTP SIP，應用於顯示器之驅動 IC 等產品。

該公司 110~111 年度及 112 年第三季對 D 公司之銷售金額分別為 9,961 千元、7,339 千元及 1,364 千元，占營收淨額比重分別為 5.92%、3.20%及 0.94%。111 年度銷售金額較 110 年度減少，主係 111 年下半年開始手機及電腦等消費性電子市場需求快速滑落，使面板驅動 IC 終端客戶投片量下滑，致該公司收取之技術權利金下降，D 公司由該公司第四大銷售客戶退為第九大銷售客戶。111 年第三季及 112 年第三季對 D 公司銷售金額分別為 6,389 千元及 1,364 千元，占營收淨額比重分別為 8.50%及 0.94%。112 年半導體生產鏈庫存水位過高，又全球景氣衰退致終端市場需求疲弱，消費者購買力持續低迷，D 公司晶圓代工訂單受到明顯衝擊，客戶出貨量大幅減少牽動該公司技術權利金收入下滑，致 112 年第三季 D 公司退出該公司前十大銷售客戶排行之列。

#### ⑤ E 公司

E 公司成立於民國 69 年，為我國上市公司，實收資本額為新臺幣 125,031,392 千元，為全球第三大晶圓代工製造廠商，該公司於 100 年與 E 公司簽訂授權合約，係授權 0.25、0.35 微米製程之 MTP SIP，主要應用於顯示器之驅動 IC 等產品。

該公司 110~111 年度及 112 年第三季對 E 公司之銷售金額分別為 9,356 千元、9,717 千元及 3,820 千元，占營收淨額比重分別為 5.56%、4.24%及 2.64%。111 年度銷售金額較 110 年度增加，主係受到 110 年晶片缺貨影響延續，IC 設計公司提高庫存準備，使晶圓出貨量增加，惟 111 年下半年開始手機及電腦等消費性電子市場需求快速滑落，使面板驅動 IC 終端客戶投片量下滑，致該公司 111 年度相較 110 年度收取之技術權利金僅微幅成長。111 年第三季及 112 年第三季對 E 公司



銷售金額分別為 7,606 千元及 3,820 千元，占營收淨額比重分別為 4.52%及 2.64%，112 年第三季銷售金額相較 111 年同期減少，主係 112 年半導體產業進入庫存調整階段，同時受到全球經濟成長趨緩影響，手機及電腦等消費性電子市場疲弱、購買力持續低迷，晶圓出貨量下滑致該公司收取之技術權利金減少，使 E 公司於 112 年第三季由該公司第六大銷售客戶退為第八大銷售客戶。

#### ⑥ G 公司

G 公司成立於民國 97 年，為我國第一上市公司，實收資本額為新臺幣 959,320 千元，主要從事電源管理 IC 之研發、設計與銷售業務，產品廣泛應用消費性電子、工業、資訊通信及汽車電子等領域，為全球少數生產小封裝、高壓大電流之 IC 設計公司，該公司於 104 年與 G 公司簽訂授權合約，主要係授權 0.35 微米製程之 MTPSIP，主要應用於固態硬碟及通訊電子等終端產品。

該公司 110~111 年度及 112 年第三季對 G 公司之銷售金額分別為 7,923 千元、9,563 千元及 1,723 千元，占營收淨額比重分別為 4.71%、4.17%及 1.19%。111 年度銷售金額較 110 年度增加，主係受到 110 年晶片缺貨影響延續，終端市場需求強勁，使 G 公司提高庫存準備，而晶圓出貨量增加，帶動該公司收取之技術權利金成長，惟 G 公司成長幅度較其他晶圓代工大廠小，使其 111 年度由第六大銷售客戶下降為第七大銷售客戶。111 年第三季及 112 年第三季對 G 公司銷售金額分別為 4,989 千元及 1,723 千元，占營收淨額比重分別為 2.97%及 1.19%。112 年半導體產業進入庫存調整階段且終端消費性電子市場購買力道減緩，晶圓出貨量下滑致該公司收取之技術權利金減少，且 G 公司委託該公司設計開發適用於 0.35 及 0.162 微米製程平台之 MTP 項目，已於 111 年度達成最終階段里程碑，又新委託設計產品尚在洽談階段未達成開案里程碑，故無產生技術服務收入，使 G 公司於 112 年第三季退出該公司銷售前十大客戶之列。

## ⑦ H 公司

H 公司成立於民國 86 年，美國紐約證券交易所掛牌上市公司，資本額為 16.7 億美元，總部位於華盛頓州柯克蘭，為一專業 IC 設計公司，其主要於工業應用、電信基礎設施、雲端計算、車用、消費性電子等應用領域提供電源解決方案。H 公司使用該公司上架於 0.16 及 0.18 微米製程平台之 MTP SIP，應用於伺服器之電源管理 IC 產品。

該公司 110~111 年度及 112 年第三季對 H 公司之銷售金額分別為 7,265 千元、1,144 千元及 3,154 千元，占營收淨額比重分別為 4.32%、0.50%及 2.18%。受到 110 年晶片缺貨延續，111 年晶圓代工廠產能滿載，進而壓縮其他製程平台之技術開發空間，減緩 H 公司之 IC 各項可靠度測試進度，且驗證完成之 IC 已陸續進入量產階段，使 111 年收取之技術服務收入大幅減少，並退出該公司前十大銷售客戶之列。111 年第三季及 112 年第三季對 H 公司銷售金額分別為 1,144 千元及 3,154 千元，占營收淨額比重分別為 0.50%及 2.18%。112 年第三季銷售金額相較 111 年同期增加，主係 112 年半導體產業進入庫存調整階段，晶圓代工廠產能降溫，H 公司使用該公司 SIP 開發新電源管理 IC 進入投片階段，致 112 年第三季收取之技術服務收入成長，使 H 公司於 112 年第三季成為該公司銷售第十大客戶。

## ⑧ F 公司

F 公司為全球前三大記憶體供應商於民國 107 年切割成立之專業晶圓代工事業體，111 年該集團調整整體營運模式，將位於南韓清州之 8 吋晶圓廠遷移至中國無錫，該公司主要係授權 0.11 微米製程之 MTP SIP，並應用於電源管理 IC 等產品，尚有多項 SIP 產品技術合作計劃，隨著達成階段性驗證里程碑，而收取不同階段之技術服務收入。

該公司 110~111 年度及 112 年第三季對 F 公司之銷售金額分別為 7,988 千元、10,067 千元及 6,056 千元，占營收淨額比重分別為 4.75%、4.39%及 4.18%，銷售金額呈逐年成長趨勢。111 年度銷售金額較 110 年度增加，主係受惠於 F 公司將 8 吋晶圓廠遷至中國無錫，設備移轉同時增開產線，故委託該公司設計應用於不同製程平台之 MTP 專案，分別達成開發、特性及可靠度驗證里程碑，使技術服務收入大幅成長，致 F 公司由 110 年度之第六大銷售客戶上升至 111 年度之第五大銷售客戶。111 年第三季及 112 年第三季對 F 公司銷售金額分別為 3,555 千元及 6,056 千元，占營收淨額比重分別為 2.11%及 4.18%，112 年第三季銷售金額相較 111 年同期成長，主係 112 年 F 公司委託該公司設計

專案達功能性里程碑，致收取之技術服務收入增加，惟 112 年半導體整體產業成長趨緩，晶圓出貨量減少致技術權利金收入大幅下滑，使 F 公司於 112 年第三季退為該公司第七大銷售客戶。

#### ⑨ I 公司

I 公司成立於 105 年，資本額為人民幣 120,000 千元，總部位於中國大陸成都市，為一專業 IC 設計公司，在中國上海、深圳、西安、香港，以及韓國和美國均設有分部，主要從事無線充電 IC、電源管理 IC 等晶片設計與銷售業務，該公司於 109 年與 I 公司簽訂授權合約，主要係授權 0.18 微米 BCD 製程之 MTP SIP，並應用於電源管理 IC 等產品。

該公司 110~111 年度及 112 年第三季對 I 公司之銷售金額分別為 4,976 千元、5,766 千元及 8,463 千元，占營收淨額比重分別為 2.96%、2.51%及 5.85%，銷售金額呈逐年成長趨勢。111 年度銷售金額較 110 年度增加，主係 I 公司新開發 IC 增加使用該公司 MTP SIP，且委託設計 SIP 已測試完成達到流片里程碑，致技術服務收入成長，惟其成長幅度較小，使 111 年 I 公司退出該公司前十大銷售客戶之列。111 年第三季及 112 年第三季對 I 公司銷售金額分別為 3,903 千元及 8,463 千元，占營收淨額比重分別為 2.32%及 5.85%，112 年第三季銷售金額相較 111 年同期增加，主係近年來 I 公司委託該公司設計產品已進入量產階段，且電源管理晶片應用日漸廣泛，致其終端產品市場需求增加，帶動該公司 112 年技術權利金收入大幅成長，使 I 公司於 112 年第三季成為該公司第五大銷售客戶。

#### ⑩ J 公司

J 公司前身為我國上市公司之邏輯 IC 部門，於民國 97 年分割成立，現為我國上市公司，實收資本額為新臺幣 4,197,653 千元，主要提供 MCU、影音及 PC 等 IC 設計及晶圓代工服務，該公司主要係授權 0.35 微米製程之 MTP SIP，應用於 MCU 等產品。

該公司 110~111 年度及 112 年第三季對 J 公司之銷售金額分別為 4,415 千元、4,888 千元及 2,331 千元，占營收淨額比重分別為 2.63%、2.13%及 1.61%。111 年度銷售金額較 110 年度增加，主係受到 110 年晶片缺貨影響延續，IC 設計公司紛紛提高庫存準備，致晶圓出貨量增加，惟 111 年下半年開始消費性電子及個人電腦等市場需求快速滑落，終端客戶投片量下滑，致該公司 111 年技術權利金僅微幅成長，使 J 公

司於 111 年退出該公司前十大銷售客戶之列。

⑪ K 公司

K 公司成立於民國 104 年，為上海證券交易所科創板掛牌公司，實收資本額為人民幣 1,504,601 千元，主要提供顯示器驅動 IC、CMOS 影像感測器、MCU、電源管理等應用領域之晶圓代工服務，111 年為全球第十大晶圓代工製造廠商。該公司於 106 年與 K 公司簽訂授權合約至今，係授權 0.11、0.09 微米製程之 MTP SIP，主要應用於微控制器之 IC 及顯示器之驅動 IC 等產品。

該公司 110~111 年度及 112 年第三季對 K 公司之銷售金額分別為 2,203 千元、23,808 千元及 17,364 千元，占營收淨額比重分別為 1.31%、10.38%及 12.00%。111 年度銷售金額較 110 年度大幅增加，主係因多數 IC 產品於 111 年驗證完成進入量產階段，又受到晶片缺貨影響延續，使 IC 設計公司紛紛提高庫存準備，並與晶圓代工廠簽訂長約以確保產能，故帶動 111 年技術權利金收入大幅成長，且 K 公司委託該公司設計開發之專案，已分別達成第三階段及第四階段里程碑，同時推升技術服務收入增加，使 111 年 K 公司一舉躍上成為該公司第三大銷售客戶。111 年第三季及 112 年第三季對 K 公司銷售金額分別為 23,808 千元及 17,364 千元，占營收淨額比重分別為 14.16%及 12.00%，112 年第三季銷售金額相較 111 年同期減少，主係 112 年半導體產業進入庫存調整階段且終端消費性電子市場購買力道減緩，晶圓出貨量下滑致該公司收取之技術權利金減少所致。

## ⑫ L 公司

L 公司成立於民國 76 年，實收資本額為新臺幣 259,320,710 千元，為我國上市公司，係全球第一大晶圓代工製造廠商，該公司於 101 年授權專利元件予 L 公司，供其自行開發設計符合 0.25 及 0.18 高壓製程之 SIP，隨著製程平台驗證完成，該公司依晶圓生產數量收取技術權利金。

該公司 111 年度及 112 年第三季對 L 公司之銷售金額分別為 3,460 千元、7,847 千元及 2,909 千元，占營收淨額比重為 2.06%、3.42% 及 2.01%。111 年度銷售金額較 110 年度增加，主係受到 110 年晶片缺貨影響延續，市場擔心供應鏈中斷，IC 設計公司積極備貨，晶圓出貨量增加帶動技術權利金收入成長，使 111 年 L 公司成為該公司銷售第八大客戶。111 年第三季及 112 年第三季對 L 公司銷售金額分別為 6,532 千元及 2,909 千元，占營收淨額比重分別為 3.89% 及 2.01%，112 年第三季銷售金額相較 111 年同期減少，主係 112 年半導體產業進入庫存調整階段且終端消費性電子市場購買力道減緩，晶圓出貨量下滑致該公司收取之技術權利金減少，使 112 年第三季 L 公司退出該公司銷售前十大客戶之列。

## ⑬ M 公司

M 公司為我國上市公司於民國 92 年成立之子公司，資本額為美金 879 千元，主要於中國大陸地區提供代理銷售半導體、光電及電子材料等產品及技術服務。IC 設計公司自身營運規模將影響晶圓代工廠產能安排，故營運規模較小之 IC 設計公司常委託 M 公司投片下單至晶圓代工廠生產，並由 M 公司進行代收付之交易模式，而該公司主要係授權 0.18 微米製程之 MTPSIP，並按照授權合約依晶圓出貨數量收取技術權利金。

該公司 111 年度及 112 年第三季對 M 公司之銷售金額分別為 6,725 千元及 693 千元，占營收淨額比重為 2.93% 及 0.48%。111 年終端 IC 設計客戶與晶圓代工廠間交易模式改變，轉由委託 M 公司代向晶圓代工廠採購晶圓，並受到 110 年晶片缺貨影響延續，IC 設計公司提高庫存準備以免供應鏈中斷，晶圓出貨量增加使 111 年度技術權利金收入大幅成長，致 111 年度 M 公司成為該公司第九大銷售客戶，惟 112 年崇越集團調整代理銷售營運模式，改由崇越科技直接向臺灣晶圓代工廠採購晶圓，且又受到半導體整體產業面臨庫存調整階段，致 112 年第三季技術權利金收入減少，M 公司退出該公司銷售前十大客

戶之列。

⑭ N 公司

N 公司成立於 103 年，資本額為人民幣 36,000 千元，總部位於中國大陸合肥市，於中國上海、北京、杭州、深圳，以及美國、馬來西亞、韓國均設有分部，主要從事無線充電、有線快充等電源管理 IC 設計及研發，終端應用橫跨消費性電子、汽車電子、工業及醫療等領域，目前為多家手機品牌及手機配件廠商之供應商。該公司於 110 年與 N 公司簽訂授權合約至今，主要授權應用於電源管理 IC 之 0.18 微米高壓製程，並按照授權合約依晶圓出貨數量收取技術權利金。

該公司 111 年第三季及 112 年第三季對 N 公司之銷售金額分別為 1,139 千元及 6,969 千元，占營收淨額比重分別為 0.68% 及 4.81%，112 年第三季銷售金額相較 111 年同期增加。主係中國大陸地區手機品牌市場競爭激烈，無線充電系統成熟應用加速終端消費市場成長，整體呈現供不應求之情形，N 公司積極取得客戶訂單跨足車用電子市場，112 年終端品牌產品進入量產，帶動該公司技術權利金收入大幅成長，而 N 公司委託該公司設計之 SIP 晶片已進入流片階段達成里程碑，致技術服務收入同時增長，使 N 公司於 112 年第三季成為該公司第六大銷售客戶。

⑮ O 公司

O 公司成立於民國 99 年，資本額為人民幣 405,556 千元，為上海證券交易所科創板掛牌上市公司，係我國上市公司之子公司，主要提供面板驅動及電源管理之 IC 設計服務。O 公司主要委託該公司設計應用於 0.11 微米製程之 MTP SIP，並依照合約內容達成階段性里程碑後收取技術服務收入。

該公司 111 年第三季及 112 年第三季對 O 公司之銷售金額分別為 376 千元及 3,585 千元，占營收淨額比重分別為 0.22% 及 2.48%，112 年第三季銷售金額相較 111 年同期增加，主係 112 年 O 公司委託該公司設計之 SIP 產品晶片已進入流片階段達成里程碑，同時 O 公司使用該公司多項 SIP 產品開發電子標籤、電子紙等驅動 IC，故技術服務收入成長，致 O 公司於 112 年第三季成為該公司第九大銷售客戶。

(3) 是否有銷貨集中之風險

該公司主要營業項目係從事嵌入式非揮發記憶體 SIP 授權及技術服務。該公司 110~111 年度及 112 年第三季前十大銷售客戶占各該年度營業

收入比重分別為 72.60%、75.96%及 76.03%，並無單一銷售客戶占整體營收比率逾 20%以上，經評估尚無銷貨集中之風險。

#### (4)發行公司之銷售政策

臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，該公司憑藉著小面積大容量之 MTP 關鍵核心技術，成為臺灣 IC 設計公司、整合元件公司及晶圓代工廠重要合作之 eNVM 矽智財廠商。未來公司發展策略聚焦於研發小面積單次或少量寫入次數之 SIP 產品，提前佈局先進製程應用，在 MTP 產品方面，該公司針對各種容量、面積大小及寫入次數等提供多樣化規格，擴展產品寬度增強客戶使用彈性以提高黏著度，並且持續研發第六代 MTP，專注於縮小面積提高產品深度，以關鍵技術打造護城河維持自身核心競爭力。

該公司 MTP 產品擁有業界中相同寫入次數中最小面積之技術優勢，既有客戶忠誠度高，且單一 IC 中通常會使用各種類型之 eNVM SIP，在同一設計架構下，客戶轉換使用 OTP 成本降低，將可逐步帶動新產品成長同時鞏固現有客戶，也透過既有客戶推廣 SIP 產品，以增加公司 SIP 流片量，後續將帶動技術服務收入及技術權利金收入成長，產品進入量產後將可形成一細水長流之營運模式。該公司深耕於產業 20 餘年，與各大晶圓代工廠保持良好互動關係，增加取得晶圓代工廠建置製程設計平台之開案機會，並且透過晶圓代工廠推廣 SIP 產品，觸及不同應用領域之終端客戶，再藉由參展及官網等行銷推廣通路，進而提升公司知名度及產品市占率。

- 2.最近期及最近二個會計年度各主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額，並分析最近期及最近二個會計年度主要之變化情形：不適用

(二)最近期及最近二個會計年度，發行公司之財務報告及個體財務報告應收款項變動之合理性、備抵損失提列之適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估。

該公司無須編制合併財務報告，故僅評估最近二年度及申請年度截至最近期止個體財務報告應收款項變動合理性、備抵損失提列適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估。

#### 1.最近二年度及申請年度截至最近期止個體及合併應收款項變動合理性評估

單位：新臺幣千元

項目	年度	個體財務報表		
		110 年度	111 年度	112 年第三季
營業收入淨額		168,192	229,420	144,732
應收款項總額(A)		19,758	24,304	32,660
減：備抵呆帳總額(B)		-	-	-
應收款項淨額(A)-(B)		19,758	24,304	32,660
備抵呆帳(B)占應收款項總額(A)比例(%)		-	-	-
應收款項週轉率(次)		12.06	10.41	6.78
應收款項收款天數(天)		30	35	54
授信條件	該公司主要係依據銷售客戶之財務狀況、營運規模、信用狀況及過往交易紀錄等因素，分別訂定不同之授信條件，授信天數主要介於 30 至 60 天。			

資料來源：該公司 110~111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

#### (1) 110 年度及 111 年度之合理性說明

該公司 110 及 111 年度應收款項總額分別為 19,758 千元及 24,304 千元。111 年度較 110 年度增加 4,546 千元，變動比率為 23.01%，主係自新冠疫情爆發，各國為控制疫情封城，促使遠端作業成為必然之趨勢，個人電腦及消費性電子市場需求迅速提升，於 110 年度晶圓代工廠拉高產能並加速投資，供給仍明顯不足以應付終端需求急速增加，IC 設計公司為避免未來出貨受到影響，紛紛與晶圓代工廠簽訂長期供貨合約以確保產能穩定，而該公司受惠於晶圓出貨量遽增，致使 111 年度營業收入較 110 年度增加 61,228 千元，應收款項總額隨營收成長而增加。

應收款項週轉率及應收款項收現天數，該公司 110 及 111 年度之應收款項週轉率分別 12.06 次及 10.41 次，應收款項收款天數分別為 30 天及 35 天。111 年度應收款項週轉率較 110 年度下降及收款天數上升，主係營收成長使得應收款項增加所致。



## (2) 111 年度及 112 年 9 月底之合理性說明

該公司 112 年 9 月底之應收款項總額為 32,660 千元，較 111 年度應收款項總額 24,304 千元增加 8,356 千元，變動比率為 34.38%，主係因銷售客戶內部作業不及延遲付款之款項增加，致使 112 年 9 月底應收款項金額較 111 年度上升，惟該延遲付款之款項已於 112 年 10 月初收回。

應收款項週轉率及應收款項收現天數，該公司 111 年度及 112 年第三季之應收款項週轉率分別為 10.41 次及 6.78 次，應收款項收款天數分別為 35 天及 54 天；112 年第三季應收款項週轉率下降及應收款項收現天數上升，主係因半導體產業整體面臨產能過剩並進入庫存調整期，致晶圓出貨量下滑，使得 112 年該公司技術權利金收入減少，以致 112 年第三季之年化營收相較 111 年度減少，以及應收款項因銷售客戶內部作業不及延遲付款之款項增加，致使應收帳款週轉率下滑，惟該延遲付款之款項已於 112 年 10 月初收回。整體而言，該公司之應收款項及週轉率之變動情形，尚屬合理。

## 2. 應收款項備抵損失提列之適足性評估

### (1) 備抵損失之政策

該公司應收款項備抵損失提列政策係按存續期間預期信用損失認列應收款項之備抵損失，存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況、產業經濟情勢，並同時考量產業展望，依信用損失歷史經驗顯示，不同客戶群之損失型態並無顯著差異，因此準備矩陣未進一步區分客戶群，僅以應收款項逾期天數訂定預期信用損失率。

### (2) 備抵損失提列之適足性

該公司 110~111 年度及 112 年第三季皆無提列備抵呆帳。該公司備抵呆帳提列政策係參酌過去之經營經驗並考量客戶信用品質，訂定備抵呆帳提列政策據以提列備抵呆帳，其提列金額已依政策執行，應足以涵蓋該公司應收款項可能發生壞帳之風險，且依照歷史經驗，尚無實際發生重大呆帳無法收回之情事，經評估其提列情形尚無重大異常。

### 3. 應收款項收回可能性評估

單位：新臺幣千元；%

項目	112.9.30 金額	截至 112.11.30 收回情形		截至 112.11.30 止 未收回情形	
		金額	%	金額	%
應收票據	-	-	-	-	-
應收帳款	32,660	30,337	92.89	2,323	7.11
合計	32,660	30,337	92.89	2,323	7.11

資料來源：該公司提供。

該公司 112 年 9 月底應收帳款總額為 32,660 千元，截至 112 年 11 月 30 日止已收回 30,337 千元，回收比率為 92.89%，未收回部分 2,323 千元，未收回比率為 7.11%，其中已逾期之款項金額 2,323 千元主係因銷售客戶內部作業不及延遲付款，該等逾期款項預計於 12 月初收回。經評估該公司 112 年 9 月底之應收款項餘額，截至 112 年 11 月底之收回情形，尚無發現重大異常之情形。

### 4. 與同業比較評估

單位：新臺幣千元；%

項目 \ 年度		110 年度	111 年度	112 年第三季
營業收入淨額	億而得	168,192	229,420	144,732
	力旺	2,363,824	3,216,711	2,151,467
	晶心科	819,778	931,821	651,831
	M31	1,011,879	1,360,165	1,093,248
應收款項總額 (A)	億而得	19,758	24,304	32,660
	力旺	104,104	239,478	367,818
	晶心科	161,077	116,518	111,779
	M31	327,537	333,346	331,287
備抵呆帳(B)	億而得	-	-	-
	力旺	1,435	97	66
	晶心科	6,556	5,200	6,007
	M31	8,465	8,129	12,381
備抵呆帳占應 收款項總額比 例(B)/(A)	億而得	-	-	-
	力旺	1.38%	0.04%	0.02%
	晶心科	4.07%	4.46%	5.37%
	M31	2.58%	2.44%	3.74%
應收款項週轉 率(次)	億而得	12.06	10.41	6.78
	力旺	20.25	18.56	9.40
	晶心科	5.19	6.17	8.01
	M31	3.45	4.12	4.53
應收款項收款 天數(天)	億而得	30	35	54
	力旺	18	20	39
	晶心科	70	54	46
	M31	106	89	81

資料來源：各公司 110~111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司 110、111 年度及 112 年第三季之應收款項週轉率分別為 12.06 次、10.41 次及 6.78 次，應收款項週轉天數分別為 30 天、35 天及 54 天，其差異變化主係隨營收變動而略為增減，且應收帳款週轉天數均落於該公司對銷售客戶授信條件 30 至 60 天區間內，經評估，尚無重大異常之情事。

該公司由於收款情形良好，110、111 年度及 112 年第三季均無產生備抵呆帳，故備抵損失占應收款項總額比率均優於採樣同業，該公司係參酌過去之經營經驗並考量客戶信用品質，基於保守穩健之原則，訂定備抵損失提列政策據以提列備抵損失。經檢視該公司過去客戶往來經驗及收款情形，尚無發生呆帳無法收回之情事。

綜上所述，經評估該公司 110、111 年度及 112 年第三季，應收款項變動之合理性及應收款項期後收回情形尚無重大異常之情事。依據該公司過去客戶往來經驗及收款情形，尚無發生呆帳無法收回之情事，此外，該公司已根據財務準則公報、過去之經營情形、考量個別客戶應收帳款收回可能性，並參考以往年度收款情形，擬訂備抵呆帳提列政策並據以提列，經評估其提列金額之合理性及適足性，尚屬合理。

## 二、存貨概況

(一)最近期及最近二個會計年度，發行公司之財務報告及個體財務報告存貨淨額變動之合理性、備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估，並與同業比較評估

該公司為一專業邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體 SIP 設計公司，係以收取技術服務費及權利金為主要營運模式，並無供應原物料等之供應商，故不適用本項評估。

### 三、最近期及最近二個會計年度之業績概況

#### (一)列表並說明發行公司最近期及最近二個會計年度營業收入、營業毛利及營業利益與同業比較之情形

單位：新臺幣千元

分析項目	年度 公司	110 年度	111 年度		111 年 第三季	112 年 第三季	
		金額	金額	成長率	金額	金額	成長率
營業收入	億而得	168,192	229,420	36.40%	168,127	144,732	(13.92)%
	力旺	2,363,824	3,216,711	36.08%	2,314,007	2,151,467	(7.02)%
	晶心科	819,778	931,821	13.67%	622,304	651,831	4.74%
	M31	1,011,879	1,360,165	34.42%	870,930	1,093,248	25.53%
營業毛利	億而得	166,869	227,700	36.45%	167,314	143,671	(14.13)%
	力旺	2,363,824	3,216,711	36.08%	2,314,007	2,151,467	(7.02)%
	晶心科	818,307	931,090	13.78%	621,699	650,240	4.59%
	M31	1,011,879	1,360,165	34.42%	870,930	1,093,248	25.53%
營業利益	億而得	43,338	78,846	81.93%	59,541	31,399	(47.26)%
	力旺	1,268,812	1,853,418	46.08%	1,318,804	1,153,072	(12.57)%
	晶心科	158,664	(69,168)	(143.59)%	(38,304)	(259,185)	576.65%
	M31	312,894	367,950	17.60%	161,896	277,937	71.68%

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司主係從事嵌入式非揮發性記憶體矽智財(簡稱 eNVM SIP)技術之研究開發、功能設計及授權服務等業務，產品涵蓋 MTP(Multi-Time Programming, 簡稱 MTP)、FTP(Few-Time Programming, 簡稱 FTP)、EEPROM(Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory, 簡稱 EEPROM)、Flash Memory 及 OTP(One-Time Programming, 簡稱 OTP)等不同性質之記憶體模組，主要係提供自有專利 SIP 授權及 SIP 設計服務，綜觀目前國內上市櫃公司中，經考量比較公司之業務內容、營收獲利比重、應用產業、實收資本額及營收規模等，選擇營運模式以矽智財相關業務、產品性質應用領域較為相近之上櫃公司力旺(股票代號：3529)、上市公司晶心科(股票代號：6533)及上櫃公司 M31(股票代號：6643)。力旺專注於邏輯嵌入式非揮發性記憶體矽智財開發，其產品以 OTP 為主；晶心科主要提供嵌入式微處理器核心 SIP 及相關軟體發展平台等，為提供 RISC-V 處理器核心產品軟硬體解決方案的供應商；M31 主要從事基礎元件及高速傳輸 SIP 設計與記憶體設計。上述三家公司除力旺與該公司相同皆致力於開發 eNVM SIP 產品外，M31 與晶心科主要產品應用之領域與產業或有不同，惟主要皆為開發矽智財之公司，故選擇作為採樣公司。以下就該公司與採樣公司 110~111 年度及 112 年第三季之營業收入、營業毛利及營業利益變化情形進行說明：

## 1.營業收入

該公司 110~111 年度及 112 年第三季營業收入分別為 168,192 千元、229,420 千元及 144,732 千元。111 年度營業收入較 110 年度成長 36.40%，該公司 MTP 產品結合寫入次數較 OTP 高及成本較 Flash 低兩大優點，且其專利技術使 MTP 擁有同業中最小面積之優勢，陸續取得銷貨客戶認證，產品量產後客戶認同度逐漸提高，目前應用於消費性電子、車用電子及無線通訊領域等終端市場。

自新冠疫情爆發各國為控制疫情封城，促使遠端作業成為必然之趨勢，個人電腦及消費性電子市場需求迅速提升，110 年晶圓代工廠拉高產能並加速投資，供給仍明顯不足以應付終端需求急速增加，IC 設計公司為避免未來出貨受到影響，紛紛與晶圓代工廠簽訂長期供貨合約以確保產能穩定，該公司受惠於晶圓出貨量遽增，使 111 年技術權利金收入大幅成長；112 年第三季較 111 年第三季減少 23,395 千元，減少幅度達 13.92%，111 年下半年開始，全球面臨高通膨、各國升息政策及地緣政治等負面影響，使得小型家電、個人電腦及顯示器等終端市場需求迅速滑落，半導體產業整體面臨產能過剩並進入庫存調整期，致晶圓出貨量下滑，使得 112 年該公司技術權利金收入減少，而該公司技術服務收入受到客戶使用已開發完成之 SIP 次數或客戶訂定合約之開發里程碑影響，致 112 年第三季該公司營業收入較 111 年同期減少。

與同業相較，該公司營運規模相較採樣同業小，故以營收成長率進行比較。該公司 111 年度營業收入成長率皆優於採樣同業，而 112 年第三季營業收入成長率則低於採樣同業，主係因該公司股本及營收規模與採樣同業有所差異，受到整體產業影響致營收波動較為劇烈，其中採樣同業力旺營收收入組成與該公司較為相似，技術權利金占比亦超過 7 成，故同樣受到半導體產業影響，營業收入呈現負成長；而採樣同業 M31 及晶心科營收來源以階段性之技術服務收入為主，主要係依合約簽訂之里程碑開發進度認列營業收入。整體而言，該公司受限於目前營運規模較小，在經營策略有效佈局之下，持續維持研發量能以拓展產品應用範圍，已開發完成之技術服務產品逐漸發酵，後續收取之技術權利金將逐年成長，致客戶依存度提高，持續推升產品量產數量以擴大營運規模，其 110~111 年及 112 年第三季之營業收入變化趨勢與同業相較，應無重大異常情事。

## 2. 營業毛利

年度 公司	110 年度	111 年度		111 年 第三季	112 年 第三季	
	比率	比率	成長率	比率	比率	成長率
億而得	99.21%	99.25%	0.04%	99.52%	99.27%	(0.25)%
力旺	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
晶心科	99.82%	99.92%	0.10%	99.74%	99.76%	0.01%
M31	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%

資料來源: 各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司 110~111 年度及 112 年第三季營業毛利分別為 166,869 千元、227,700 千元及 143,671 千元，毛利率分別為 99.21%、99.25%及 99.27%，該公司營業收入組成可分為技術權利金及技術服務收入，由於授權 SIP 毋須進貨，且 SIP 產品的投入研發存有量產成功的不確定性，故研發人員薪資及開發支出等相關費用多數列入當年度之研究發展費用，惟委託設計專案係屬客製化服務，尚可歸屬部分研發費用，致技術服務收入產生少量營業成本，毛利率接近 100%，該公司 110~111 年度及 112 年第三季，毛利率皆低於採樣同業，主係因採樣同業力旺、M31 皆將 SIP 開發費用認列為當年度之研究發展費用，惟採樣同業晶心科尚有印刷電路板進貨等需求，致毛利率有所變動，該公司 110~111 年及 112 年第三季之毛利率均維持於 99%以上，與採樣同業晶心科相同，其營業毛利率之變化趨勢與同業相較，應無重大異常情事。

## 3. 營業利益

年度 公司	110 年度	111 年度		111 年 第三季	112 年 第三季	
	比率	比率	成長率	比率	比率	成長率
億而得	25.77%	34.37%	33.38%	35.41%	21.69%	(38.74)%
力旺	53.68%	57.62%	7.34%	56.99%	53.59%	(5.96)%
晶心科	19.35%	(7.42)%	(138.35)%	(6.16)%	(39.76)%	546.00%
M31	30.92%	27.05%	(12.52)%	18.59%	25.42%	36.76%

資料來源: 各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司 110~111 年度及 112 年第三季營業利益分別為 43,338 千元、78,846 千元及 31,399 千元，營業利益率分別為 25.77%、34.37%及 21.69%，111 年度營業利益及營業利益率較 110 年度分別成長 81.93%及 33.38%，主係因該公司技術權利金收入大幅成長，且營業費用管控得宜，致 111 年營業利益較 110 年度提升。112 年第三季營業利益較 111 年第三季減少，係晶圓出貨量受到半導體產業景氣影響而下滑，使得技術權利金收入減少，且 111 年獲利大幅成長，故估列員工酬勞及董事酬勞增加，同時為維持穩定研發量能，使

得研究發展費用增加，致營業利益及營業利益率較 111 年第三季減少 (47.26)%及(38.74)%。

與同業相較，該公司 110~111 年度及 112 年第三季營業利益成長率，111 年度優於採樣同業，而 112 年第三季則為負成長，主係該公司持續研發並積極拓展業務，尚處於營運規模擴張階段，而與營收收入組成與該公司較為相似之採樣同業力旺相比，112 年第三季營業利益同樣受到半導體整體產業影響，皆呈現衰退情形，惟該公司營業利益率皆保持在 20%以上，其 110~111 年及 112 年第三季之營業利益之變化趨勢，應無重大異常情事。

綜上所述，該公司 110~111 年度及 112 年第三季之營業收入、營業毛利及營業利益變動情形及與同業比較，尚無重大異常情事。

(二)列表並說明最近期及最近二個會計年度以「部門別」或「主要產品別」之營業收入、營業成本及營業毛利之變化情形是否合理

### 1.產品別營業收入變動表

單位：新臺幣千元

年度 產品別	110 年度		111 年度		111 年第三季		112 年第三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
技術服務	57,429	34.14	58,821	25.64	40,003	23.79	37,339	25.80
技術權利金	110,763	65.86	170,599	74.36	128,124	76.21	107,393	74.20
總計	168,192	100.00	229,420	100.00	168,127	100.00	144,732	100.00

資料來源：該公司提供。

### 2.產品別營業成本變動表

單位：新臺幣千元

年度 產品別	110 年度		111 年度		111 年第三季		112 年第三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
技術服務	1,323	100.00	1,720	100.00	813	100.00	1,061	100.00
技術權利金	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	1,323	100.00	1,720	100.00	813	100.00	1,061	100.00

資料來源：該公司提供。

### 3.產品別營業毛利變動表

單位：新臺幣千元

年度 產品別	110 年度		111 年度		111 年第三季		112 年第三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
技術服務	56,106	33.62	57,101	25.08	39,190	23.42	36,278	25.25
技術權利金	110,763	66.38	170,599	74.92	128,124	76.58	107,393	74.75
總計	166,869	100.00	227,700	100.00	167,314	100.00	143,671	100.00

資料來源：該公司提供。

4.該公司最近期及最近二個會計年度主要產品別之營業收入、營業成本及營業毛利變動情形說明如下：

該公司 eNVM SIP 主要應用於 MCU、電源管理、無線電充、顯示器及電子紙等晶片，終端產品涵蓋消費性電子、車用電子、及無線通訊領域等應用市場。根據授權服務內容及交易模式不同，該公司營業收入組成可分為技術服務收入及技術權利金收入，茲將各類別之營業收入、營業成本及營業毛利等變化情形說明如下：

(1)技術服務收入

該公司技術服務收入可依服務性質區分為委託設計開發收入(NRE)及使用收入(Usage)，NRE 係指該公司根據客戶所要求之規格製作 SIP 區塊，並於開發過程中達到特定階段里程碑時收取開發設計費用；Usage 係針對客戶使用已開發且驗證完成 SIP 或已於晶圓代工廠上架之既有 SIP，依其使用於自身產品次數收取固定費用。110~111 年度及 112 年第三季技術服務收入金額分別為 57,429 千元、58,821 千元及 37,339 千元，占營收淨額比重分別為 34.14%、25.64%及 25.80%。該公司 111 年度技術服務收入金額較 110 年度增加 1,392 千元，成長率為 2.42%，主要係受到 110 年半導體產業過熱延燒，全球晶圓代工廠產能利用率皆達到歷年來新高點，IC 設計公司為確保既有產品出貨時程，放緩開發速度，導致該公司使用收入大幅下滑；而在委託設計開發收入方面，晶圓代工廠新建置之製程技術平台，已達成可靠度、特性及品質驗證里程碑並認列收入，使委託設計開發收入成長，致該公司 111 年技術服務收入微幅增加。112 年第三季銷售金額較 111 年第三季減少 2,664 千元，衰退率為 6.66%，主係自 111 年下半年開始，全球面臨高通膨、各國升息政策及地緣政治等負面影響，使得小型家電、個人電腦及顯示器等終端市場需求迅速滑落，IC 設計公司隨即面臨庫存過高、存貨去化速度緩慢等問題，在調整庫存之際，IC 設計公司持續減緩開發新案之速度，導致該公司使用收入減少；惟受到美國發佈對中國之晶片禁令，中國大陸全力扶植國內半導體產業，興建晶圓代工廠並加強發展 IC 設計公司，多數已達成開案或投片里程碑，使委託設計開發收入小幅成長，整體而言，該公司 112 年第三季技術服務收入僅呈現微幅減少之態勢。

該公司 110~111 年度及 112 年第三季技術服務收入之營業成本分別為 1,323 千元、1,720 千元及 1,061 千元，營業毛利分別為 56,106 千元、57,101 千元及 36,278 千元，各期營業毛利率分別為 97.69%、97.08%及 97.16%。在營業成本及營業毛利方面，根據產業特性，矽智財的研究需經



由長時間開發，且存有量產成功的不確定性，故以投入研發時將相關成本予以費用化，惟委託開發設計偏向客製化服務，尚可歸屬部分開發費用，故產生少量之技術服務成本，且最近期及最近二年度該公司毛利率均維持於 99% 以上，其變動差異不大，應無重大異常之情形。

## (2) 技術權利金收入

技術權利金係該公司經晶圓代工廠驗證之 SIP 產品，於客戶採用並量產時，依據晶圓代工廠之晶圓價格或 IC 設計公司依其自行量產晶圓價格，由該公司收取一定比例權利金，並於每季出具生產產量報表，以計算權利金金額。110~111 年度及 112 年第三季技術權利金收入金額分別為 110,763 千元、170,599 千元及 107,393 千元，占營收淨額比重分別為 65.86%、74.36% 及 74.20%，111 年度技術權利金收入金額較 110 年度增加 59,836 千元，成長率為 54.02%。該公司 SIP 多數應用於 MCU、電源管理 IC、顯示器之驅動 IC、指紋辨識 IC 等，終端產品分散於消費性電子、車用、通訊、AIoT 及智慧家電等應用領域，受惠於近幾年疫情之影響改變生活習慣，帶動遠距辦公及數位學習等新模式需求崛起，使個人電腦、電腦伺服器及車用電子等消費市場需求大幅增長，又因各國封城工廠停工，使半導體供應鏈受到嚴重衝擊而爆發晶片缺貨潮，111 年晶片缺貨現象延燒，全球晶圓代工廠產能利用率皆達到歷年新高點，而各家 IC 設計公司為避免延宕產品出貨時程，紛紛提高庫存準備，同時客戶通過投片驗證之產品也進入量產階段，SIP 開發基數、晶圓出貨量及價格增加帶動 111 年度該公司技術權利金收入增加。而 112 年第三季技術權利金收入金額較 111 年第三季減少 20,731 千元，衰退率為 16.18%，主係自 111 年下半年開始，國際通貨膨脹使各國央行逐步調升利率，全球總經濟成長疲軟，消費性電子市場需求急速跌落，晶片供貨量趨於穩定，IC 設計公司隨即面臨高庫存壓力致晶圓出貨量大幅下滑，進而影響該公司技術權利金收入減少。在營業成本及營業毛利方面，技術權利金收入並無銷貨成本，係源自於已開發完成之既有技術或技術服務授權衍生之後續相關收入，且在研發時程中開發人員相關費用均列為當年度研發費用，使技術權利金之毛利率均為 100%。

綜上評估，該公司最近期及最近二個會計年度主要產品項目之營業收入、營業成本及營業毛利隨著授權 SIP 數量、市場需求及客戶量產投片情況而產生變動，分析其營業收入、營業成本及營業毛利之變化原因尚無重大異常。

(三)最近期及最近二個會計年度營業收入或毛利率變動達百分之二十以上者，應做價量分析變動之原因，並敘明是否合理

單位：新臺幣千元

年度 項目	110 年度	111 年度		111 年 第三季	112 年 第三季	
	金額	金額	變動率	金額	金額	變動率
營業收入	168,192	229,420	36.40%	168,127	144,732	(13.92)%
毛利率	99.21%	99.25%	0.04%	99.52%	99.27%	(0.25)%

資料來源：各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

由上表可得知，該公司最近二年度及 112 年度第三季之營業收入變動率分別為 36.40%及(13.92)%，毛利率變動率分別為 0.04%及(0.25)%。111 年度之營業收入變動有達 20%以上之情事。因該公司營業收入來源，主要係客戶委託開發設計 SIP 或客戶使用該公司既有 SIP 收取之技術服務收入，以及與客戶開發完成之 SIP，依據客戶出貨量收取之技術權利金，各項授權簽約金受到授權範圍、SIP 數量、晶圓價格、客戶量產投片數量等情形有所不同，故不具價量關係，僅針對該公司於 111 年度之營業收入變動原因說明如下：

該公司於 111 年度之營業收入變動率為 36.40%，變動達 20%以上，惟其變動原因請詳前述「三、(一)、1.營業收入」之分析。

四、併購他公司尚未屆滿一個完整會計年度者，評估併購之目的、效益、交易合理性等因素

該公司最近一年度及申請年度截至評估報告出具日止，並無併購他公司之情形，故不適用本項評估。

#### 肆、財務狀況

一、列表並說明最近期及最近二個會計年度財務比率之分析，與同類別上市公司及未上市同業財務比率之比較分析，應包括財務結構、償債能力、經營能力及獲利能力

(一)選擇採樣公司之說明

該公司主要從事 eNVM SIP 之技術開發、設計及授權。經檢視其相關產業及同業資料，以目前國內上市及上櫃公司中從事 SIP 相關業務之廠商為選樣標準，故選取上櫃公司力旺(股票代碼：3529)，主要從事 eNVM 技術開發與 SIP 授權業務，產品涵蓋 OTP、MTP 與快閃記憶體等，為全球首創邏輯製程 eNVM SIP 廠，其邏輯製程 SIP 技術市佔為全球第一；上市公司晶心科(股票代碼：6533)，其主要專注於嵌入式處理器矽智財及相關技術的研發與服務，

致力於提供低功耗高效能處理器及周邊平台 SIP，與必要之開發工具及軟體，產品應用範圍包含消費、網通、車用、工業及醫療等電子產品；上櫃公司 M31(股票代碼：6643)，主係為專業之積體電路矽智財技術研發及授權服務廠商，其主要技術與產品可應用於基礎元件及高速介面等領域；同業平均資料則選用財團法人金融聯合徵信中心出版之「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」中之「專業、科學及技術服務業」資料，作為同業平均之比較數據。

(二)最近期及最近二個會計年度財務比率分析及與同業比較分析

分析項目		年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
		公司名稱			
財務 結構	負債占資產比率 (%)	億而得	13.91	15.92	16.35
		力旺	20.85	20.65	19.50
		晶心科	5.13	8.12	8.51
		M31	18.23	21.54	13.42
		同業	32.40	29.20	註 3
	長期資金占不動 產、廠房及設備比 率(%)	億而得	1,746.38	2,523.48	3,321.08
		力旺	553.44	675.20	581.00
		晶心科	19,787.47	6,814.61	5,293.14
		M31	247.17	326.14	345.34
		同業	425.53	561.80	註 3
償債 能力	流動比率(%)	億而得	748.08	622.35	570.23
		力旺	409.80	423.72	434.32
		晶心科	2,566.59	1,377.56	1,213.68
		M31	419.92	328.50	530.36
		同業	285.60	330.20	註 3
	速動比率(%)	億而得	741.47	620.26	567.43
		力旺	404.11	420.51	419.91
		晶心科	2,539.78	1,356.14	1,946.07
		M31	407.90	317.23	299.68
		同業	218.30	237.30	註 3
	利息保障倍數(倍)	億而得	210.81	767.34	737.93
		力旺	11,772.54	13,257.42	7,037.60
		晶心科	100.35	222.82	15.05
		M31	153.42	1,745.60	7,829.78
		同業	9,999.90	5,211.30	註 3
經營	應收款項週轉率 (次)	億而得	12.06	10.41	6.78
		力旺	20.25	18.56	9.40

分析項目	公司名稱	年度			
		110 年度	111 年度	112 年 前三季	
能力	晶心科	5.19	6.71	8.01	
		M31	3.45	4.12	4.53
		同業	7.60	6.90	註 3
	應收款項收款天數 (天)	億而得	30	35	54
		力旺	18	20	39
		晶心科	70	54	46
		M31	106	89	81
		同業	48	53	註 3
	存貨週轉率(次)	億而得	-	-	-
		力旺	-	-	-
		晶心科	0.75	0.34	1.11
		M31	-	-	-
		同業	-	-	註 3
	平均售貨天數(天)	億而得	-	-	-
		力旺	-	-	-
		晶心科	486.66	1,073.52	328.83
		M31	-	-	-
		同業	-	-	註 3
	不動產、廠房及設 備週轉率(次)	億而得	8.13	14.43	16.36
		力旺	5.10	6.98	6.64
		晶心科	34.65	18.75	14.31
		M31	2.38	2.18	2.55
		同業	4.90	3.80	註 3
	總資產週轉率(次)	億而得	0.52	0.60	0.49
		力旺	0.83	0.91	0.80
		晶心科	0.25	0.18	0.16
M31		0.55	0.63	0.63	
同業		0.80	0.60	註 3	
資產報酬率(%)	億而得	12.03	19.14	7.42	
	力旺	38.61	45.28	29.57	
	晶心科	5.07	6.84	0.14	
	M31	13.76	17.63	13.94	
	同業	13.90	6.80	註 3	
權益報酬率(%)	億而得	13.71	22.49	8.83	
	力旺	49.25	58.24	37.01	

分析項目		年度			
		公司名稱	110 年度	111 年度	112 年 前三季
獲利能力		晶心科	5.42	7.29	0.15
		M31	16.34	22.04	16.91
		同業	19.80	9.60	註 3
	營業利益占實收資本額比率(%)	億而得	16.16	29.41	11.71
		力旺	166.68	243.28	151.34
		晶心科	31.33	(13.66)	(51.17)
		M31	99.00	116.08	79.72
	稅前純益占實收資本額比率(%)	同業	註 1	註 1	註 3
		億而得	16.12	30.35	12.82
		力旺	168.55	250.57	167.17
		晶心科	34.97	75.76	3.80
		M31	92.88	139.80	110.02
	純益率(%)	同業	註 1	註 1	註 3
		億而得	22.94	31.80	20.09
		力旺	46.27	49.87	49.41
		晶心科	19.72	38.20	1.16
		M31	24.97	27.88	29.47
	每股盈餘(元)	同業	16.00	9.80	註 3
		億而得	1.44	2.72	1.08
		力旺	14.78	21.61	14.35
晶心科		3.59	7.03	0.15	
M31		8.12	12.16	9.34	
現金流量	現金流量比率(%)	同業	註 1	註 1	註 3
		億而得	138.70	187.83	53.21
		力旺	210.61	213.76	124.27
		晶心科	177.75	223.71	33.81
		M31	83.27	128.99	23.62
	淨現金流量允當比率(%)	同業	35.40	(9.70)	註 3
		億而得	501.94	429.00	219.00
		力旺	134.79	142.40	註 2
		晶心科	63.57	87.94	註 2
		M31	83.11	106.45	註 2
	現金再投資比率(%)	同業	註 1	註 1	註 3
		億而得	17.40	29.46	註 4
	力旺	24.91	19.45	註 2	

分析項目	年度			
	公司名稱	110 年度	111 年度	112 年 前三季
	晶心科	6.36	13.02	註 2
	M31	(1.37)	19.77	註 2
	同業	11.30	(2.40)	註 3

資料來源：1.各公司 110~111 年度及 112 年前三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告；各公司公開資訊觀測站揭露之財務分析資料；及兆豐證券計算之財務分析資料。

2.同業資料係摘自財團法人金融聯合徵信中心出版之「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」。

註 1：「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」並未揭露該資訊。

註 2：截至評估報告刊印日止，採樣同業尚未於公開資訊觀測站公告 112 年前三季財務資訊。

註 3：截至評估報告刊印日止，該期間之「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」尚未出具。

註 4：現金再投資比率因營業活動淨現金流量扣除現金股利後為負數，故未予列示。

註 5：財務分析之計算公式說明：

#### 1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額/資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額。

#### 2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產/流動負債。

(2)速動比率＝(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

#### 3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)淨額。

(2)應收款項收款天數＝365/應收款項(含應收票據)週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本/平均存貨總額。

(4)平均售貨天數＝365/存貨週轉率

(5)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

(6)總資產週轉率＝銷貨淨額/平均資產總額。

#### 4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益/平均權益淨額。

(3)營業利益占實收資本額比率＝營業利益/實收資本額。

(4)稅前利益占實收資本額比率＝稅前利益/實收資本額。

(5)純益率＝稅後損益/銷貨淨額。

(6)每股盈餘＝(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數。

#### 5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量/流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)。

## 1. 財務結構

### (1) 負債占資產比率

該公司 110~111 年度及 112 年前三季之負債占資產比率分別為 13.91%、15.92%及 16.35%，111 年度負債占資產比率較 110 年度上升，主係該公司隨著獲利成長，估列之應付員工及董事酬勞增加，另因營運需求，添購新的電腦軟體等無形資產，致應付軟體費增加，使負債占資產比率上升；112 年前三季負債占資產比率較 111 年度上升，主係該公司發放 111 年度之現金股利，致現金水位淨流出約 50,000 千元，故負債占資產比率較 111 年度上升。

與採樣公司及同業比較，該公司 110~111 年度及 112 年前三季之負債占資產比率均介於採樣同業及同業平均之間，經評估尚無重大異常。

### (2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司 110~111 年度及 112 年前三季之長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為 1,746.38%、2,523.48%及 3,321.08%，111 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率較 110 年度增加，主係該公司隨著獲利成長，股東權益也隨之增加，加上該公司未有新增重大之不動產、廠房及設備，致該比率上升；112 年前三季長期資金占不動產、廠房及設備比率較 111 年度上升，主係該公司 112 年前三季未有新增重大之不動產、廠房及設備，原有資產折舊後使不動產、廠房及設備淨額進一步減少所致。

與採樣公司及同業比較，該公司 110~111 年度及 112 年前三季長期資金占不動產、廠房及設備比率均優於力旺、M31 及同業平均，低於晶心科。整體而言，該公司 110~111 年度及 112 年前三季長期資金占不動產、廠房及設備比率皆達 100%以上，顯示該公司長期資金尚足以支應不動產、廠房及設備之支出，經評估尚無重大異常。

整體而言，該公司之財務結構良好，且長期資金支應不動產、廠房及設備能力尚屬健全，其變化情形尚無重大異常情事。

## 2. 償債能力

### (1) 流動比率及速動比率

該公司 110~111 年度及 112 年前三季之流動比率為 748.08%、622.35%、及 570.23%，速動比率為 741.47%、620.26%及 567.43%。111 年度該公司流動比率及速動比率均較 110 年度下降，主係該公司雖營運持續獲利，使現金部位及應收帳款增加，惟估列之應付員工及董事酬勞等流動負債增加之比率較流動資產高，致流動比率及速動比率皆較 110 年度降低；112 年前三季則因發放現金股利使該公司現金水位下降，致該公司流動比率及速動比率皆較 111 年度下降。

該公司 110~111 年度及 112 年前三季流動比率及速動比率介於採樣公司及同業平均間，且均高於 100%，顯示該公司流動性尚屬良好，經評估尚未發現重大異常情事。

### (2) 利息保障倍數

該公司 110~111 年度及 112 年前三季之利息保障倍數分別為 210.81 倍、767.34 倍及 737.93 倍。該公司之利息費用組成項目為租賃負債之利息，111 年度利息保障倍數較 110 年度大幅上升，主係該公司營運成長，使稅前息前淨利較 110 年度增加 87.7%，致利息保障倍數上升；而 112 年前三季雖因營收下滑，致稅前息前淨利較 111 年同期減少，然該公司 112 年前三季租賃負債之利息也較 111 年同期減少約 50%，故使 112 年前三季利息保障倍數仍與 111 年度相當。

與採樣公司及同業相較，該公司 110 年度利息保障倍數高於晶心科及 M31、低於力旺及同業平均；111 年度高於晶心科、低於力旺、M31 及同業平均；112 年前三季則高於晶心科、低於力旺及 M31，經評估尚無重大異常情事。

整體而言，該公司 110~111 年度及 112 年前三季之流動比率、速動比率及利息保障倍數等指標變化尚屬健全，顯示該公司償債能力尚屬允當。

## 3. 經營能力

### (1) 應收款項週轉率及應收款項收現天數

該公司 110~111 年度及 112 年前三季應收款項週轉率分別為 12.06 次、10.41 次及 6.78 次，應收款項收款天數分別為 30 天、35 天及 54 天。該公司 111 年度應收款項週轉率較 110 年度下降，主係該公司營收成長



使得應收款項增加，且 111 年度營收成長之主要客戶授信期間有調整增加天數，故 111 年度應收款項週轉率下降，應收款項收款天數由 30 天上升至 35 天；而 112 年前三季營業收入較 111 年同期減少，設算全年後仍較 111 年度減少，加上應收帳款因銷售客戶延遲付款之款項增加，使 112 年前三季平均應收帳款較 111 年度增加，故應收款項週轉率下降、應收款項收款天數至 54 天。

與採樣公司及同業比較，該公司 110 及 111 年度應收款項週轉率高於晶心科、M31 及同業平均、低於力旺；112 年前三季高於 M31、低於力旺及晶心科。整體而言，該公司 110~111 年度及 112 年第一季平均收現天數均落於其對銷售客戶主要授信期間 30 至 60 天區間內，經評估尚無重大異常之情事。

#### (2) 存貨週轉率及平均售貨天數

該公司 110~111 年度及 112 年前三季均無存貨，故存貨週轉率及存貨週轉天數不適用。

#### (3) 不動產、廠房及設備週轉率

該公司 110~111 年度及 112 年前三季之不動產、廠房及設備週轉率分別為 8.13 次、14.43 次及 16.36 次，111 年度不動產、廠房及設備週轉率較 110 年度上升，主係該公司 111 年度營收成長約 36%，加上未有增添重大資產，期末不動產、廠房及設備淨額較 110 年度減少，致不動產、廠房及設備週轉率上升；而 112 年前三季營業收入雖較 111 年度下滑，惟不動產、廠房及設備淨額減少比率仍較營業收入減少比率高，致不動產、廠房及設備週轉率較 111 年度上升。

與採樣公司及同業比較，110 及 111 年度高於力旺、M31 及同業平均、低於晶心科；112 年前三季則高於所有採樣同業，經評估尚無重大異常之情事。

#### (4) 總資產週轉率

該公司 110~111 年度及 112 年前三季之總資產週轉率分別為 0.52 次、0.60 次及 0.49 次。111 年度該公司總資產週轉率較 110 年度上升，主係該公司因營收成長，且其成長幅度高於資產規模增加所致；而 112 年前三季營業收入較 111 年同期減少，經設算全年後仍較 111 年度減少，致總資產週轉率下滑。

與採樣公司及同業比較，110~111 年度及 112 年前三季皆高於晶心

科，低於力旺、M31 及採樣同業，經評估尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司 110~111 年度及 112 年前三季各項經營能力指標變化情形尚屬健全，與採樣公司及同業比較，尚無重大異常之情事。

#### 4. 獲利能力

##### (1) 資產報酬率及權益報酬率

該公司 110~111 年度及 112 年前三季資產報酬率為 12.03%、19.14% 及 7.42%，權益報酬率則分別 13.71%、22.49% 及 8.83%。111 年度資產報酬率及權益報酬率均較 110 年度大幅提升，主係 111 年度受惠於半導體產業成長，帶動該公司權利金收入增加，使得稅後淨利較 110 年度成長 189.15%，致 111 年度資產報酬率及權益報酬率均較 110 年度增加；112 年前三季資產報酬率及權益報酬率均較 111 年度下降，主係該公司受到下游廠商調整庫存等影響，致權利金收入較 111 年同期減少，使年化稅後淨利較 111 年度下降所致。

與採樣公司及同業比較，110 年度資產報酬率高於晶心科、低於力旺、M31 及同業平均；111 年度資產報酬率高於晶心科、M31 及同業平均、低於力旺；112 年前三季資產報酬率高於晶心科、低於力旺及 M31。110 年度權益報酬率高於晶心科、低於力旺、M31 及同業平均；111 年度高於晶心科、M31 及同業平均、低於力旺；112 年前三季權益報酬率高於晶心科、低於力旺及 M31，經評估並無重大異常情事。

##### (2) 營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率

該公司 110~111 年度及 112 年前三季營業利益占實收資本額為 16.16%、29.41% 及 11.71%，稅前純益占實收資本額比率則分別為 16.12%、30.35% 及 12.82%，111 年度營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率均較 110 年度上升，主係營業利益及稅前純益隨營收增加而成長所致；而 112 年度前三季受下游廠商調整庫存之影響，該公司營收較 111 年同期減少，致營業利益及稅前純益占實收資本額比率皆較 111 年度下滑。

與採樣公司及同業比較，該公司 110 年度之營業利益占實收資本額比率均低於採樣同業；111 年度及 112 年前三季則高於晶心科、低於力旺、M31。而 110~111 年度之稅前純益占實收資本額比率均低於採樣同業；112 年前三季高於晶心科、低於力旺、M31，經評估並無重大異常情事。

### (3) 純益率及每股盈餘

該公司 110~111 年度及 112 年前三季純益率為 22.94%、31.80%及 20.09%，每股盈餘分別為 1.44 元、2.72 元及 1.08 元。111 年度純益率及每股盈餘均較 110 年度成長，主係營收成長，稅後淨利增加，稅後淨利成長幅度大於營收成長幅度所致；而 112 年前三季純益率較 111 年度下降，主係受下游廠商庫存去化之影響，使該公司收取之權利金減少，致純益率下降。

與採樣公司及同業比較，110 年度純益率高於晶心科及同業平均、低於力旺及 M31，111 年度高於 M31 及同業平均、低於力旺及晶心科，112 年前三季高於晶心科、低於力旺及 M31；另在每股盈餘方面，110 及 111 年度均低於所有採樣公司，112 年前三季則高於晶心科、低於力旺及 M31，主係該公司整體規模尚較採樣同業小，經評估尚無重大異常。

整體而言，該公司 110~111 年度及 112 年前三季獲利能力等各項指標變化尚屬合理，未發現重大異常之情事。

## 5. 現金流量

### (1) 現金流量比率

該公司 110~111 年度及 112 年前三季之現金流量比率為 138.70%、187.83%及 53.21%，111 年度現金流量比率較 110 年度上升，係因業績成長，稅前淨利大幅增加，致 111 年度營業活動之淨現金流入增加；112 年前三季現金流量比率較 111 年度下降，主係 112 年前三季稅前淨利較 111 年同期減少約 45%，致 112 年前三季現金流量比率較 111 年度減少。

與採樣公司及同業比較，該公司 110 及 111 年度之現金流量比率高於 M31 及同業平均、低於力旺及晶心科；112 年前三季則高於晶心科及 M31、低於力旺，經評估後，尚無發現重大異常。

### (2) 淨現金流量允當比率

該公司 110~111 年度及 112 年前三季之淨現金流量允當比率為 501.94%、429.00%及 219.00%，111 年度淨現金流量允當比率較 110 年度下降，主係因該公司於 109 年度轉虧為盈，並於 111 年度首次發放所屬 110 年度之現金股利，致 111 年度淨現金流量允當比率略微下滑；112 年前三季淨現金流量允當比率較 111 年度下降，主係 111 年度營運良好，並於 112 年前三季發放 111 年度之現金股利，加上 112 年前三季營收較 111 年同期減少，致 112 年前三季淨現金流量允當比率下降。

與採樣公司及同業比較，110~111 年度均高於所有採樣公司；112 年前三季因採樣同業未揭露，尚無從比較，經評估尚無發現重大異常。

### (3) 現金再投資比率

該公司 110 及 111 年度之現金再投資比率為 17.40%及 29.46%，111 年度現金再投資比率較 110 年度上升，主係因業績成長，稅前淨利大幅增加，致 111 年度營業活動之淨現金流入增加；112 年前三季之現金再投資比率因該公司營業活動淨現金流量扣除現金股利後為負數，故不予列式。

與採樣公司及同業比較，該公司 110 年度之現金再投資比率高於晶心科、M31 及同業平均、低於力旺；111 年度均高於所有採樣公司；112 年前三季因採樣同業未揭露，尚無從比較，經評估尚無發現重大異常。

整體而言，該公司 110~111 年度及 112 年前三季現金流量相關比率之變化尚屬合理，經評估應無重大異常之情形。

(三)依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第四條第二項或第三項或第二十八條之一第五項或第六項或科技事業或文化創意事業申請股票上市者，應另列明其最近一個會計年度及最近期財務報告歸屬於母公司業主之權益，暨評估其申請上市年度及未來一年度歸屬於母公司業主之權益繼續達實收資本額三分之二以上之可能性。無面額或每股面額非屬新臺幣十元之發行人，應評估未來一年度歸屬於母公司業主之權益低於股本加計資本公積－發行溢價之合計數三分之二之可能性

該公司非以「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第 4 條第 2 項或第 3 項或第 28 條之 1 第 5 項或第 6 項或科技事業或文化創意事業申請股票上市，故不適用。

(四)若屬申請創新板上市者，取得其申請上市月份至預計掛牌後十二個月之各月份現金收支預測表，評估其是否符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第二十九條第一項第三款之規定

該公司申請上市時股數為 268,100 千股，每股暫訂承銷價為 100 元，推估申請創新板上市時之市值已達新臺幣 26.81 億元，已符合市值達新臺幣 10 億元以上之規定；另最近四季營業收入為金額為 206,025 千元，亦符合營業收入不低於新臺幣一億元之規定；此外，經檢視該公司自 113 年 6 月(預計掛牌次月)至 114 年 5 月(掛牌後十二個月)之現金收支預測表，該公司預計於掛牌後十二個月內之非融資性收入及支出分別為 302,744 仟元及 175,262

仟元，其編製原則主係以依過往狀況，並考量未來規劃預估之用人費用、營運支出及資本支出等款項所需支付資金，進行評估編製而成，經檢視其編製底稿，尚屬合理。該公司預計 113 年 5 月掛牌，掛牌當月期初之現金及約當現金為 408,507 仟元，掛牌後 12 個月 (113/6~114/5) 之非融資性收入為 302,744 仟元、融資淨支出為 32,172 仟元，合計金額為 270,572 仟元，占掛牌後 12 個月之非融資性支出 175,262 仟元的 154.38%。經評估，該公司已符合法規規定，未有重大異常之情事。

該公司申請上市月份至預計掛牌月份之各月現金收支預測表

單位：新臺幣千元

項目 年/ 月	112/12 (申請時)	113/1	113/2	113/3	113/4	113/5 (掛牌時)
<b>期初現金餘額(1)</b>	289,300	281,722	286,160	293,936	273,332	408,507
<b>加：非融資性收入</b>						
應收帳款及票據收現	10,082	15,308	27,546	12,723	15,215	27,135
利息收入/退稅/其他	500	230	230	230	230	230
<b>合計(2)</b>	10,582	15,538	27,776	12,953	15,445	27,365
<b>減：非融資性支出</b>						
薪資(含獎金及員工酬勞)	5,600	5,800	11,400	10,628	5,800	5,800
各項費用	5,000	5,300	6,000	6,200	6,000	8,000
董事酬勞	-	-	-	1,609	-	-
資本支出-軟體	-	-	2,600	-	-	-
資本支出-租賃改良(裝潢)	4,410	-	-	8,820	1,470	-
資本支出-辦公、消防設備	3,150	-	-	6,300	1,050	-
<b>非融資性支出合計(3)</b>	18,160	11,100	20,000	33,557	14,320	13,800
<b>融資淨額</b>						
現金增資	-	-	-	-	134,050	-
<b>融資淨額合計(4)</b>	-	-	-	-	134,050	-
<b>期末現金餘額(5)=(1)+(2)-(3)+(4)</b>	281,722	286,160	293,936	273,332	408,507	422,072

資料來源：該公司提供

## 該公司預計掛牌後 12 個月之各月現金收支預測表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年/月	113/6	113/7	113/8	113/9	113/10	113/11	113/12	114/1	114/2	114/3	114/4	114/5
<b>期初現金餘額(1)</b>	422,072	423,088	427,775	421,400	415,880	420,673	428,017	431,645	431,937	462,255	467,790	489,035
<b>加：非融資性收入</b>												
應收帳款及票據收現	14,006	21,047	36,457	15,890	15,453	26,316	14,018	17,252	43,579	20,195	31,904	42,007
利息收入/退稅/其他	610	340	340	340	340	340	610	340	340	340	340	340
<b>合計(2)</b>	14,616	21,387	36,797	16,230	15,793	26,656	14,628	17,592	43,919	20,535	32,244	42,347
<b>減：非融資性支出</b>												
薪資(含獎金及員工酬勞)	8,600	5,800	6,000	9,000	6,000	6,000	6,000	12,000	6,000	6,000	6,000	9,000
各項費用	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,300	5,000	5,000	5,000	5,000
董事酬勞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-
資本支出-軟體	-	5,900	-	4,600	-	8,312	-	-	2,600	-	-	-
所得稅	-	-	-	3,150	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>非融資性支出合計(3)</b>	13,600	16,700	11,000	21,750	11,000	19,312	11,000	17,300	13,600	15,000	11,000	14,000
<b>融資淨額</b>												
支付股利	-	-	(32,172)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>融資淨額合計(4)</b>	-	-	(32,172)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>期末現金餘額 (5)=(1)+(2)-(3)+(4)</b>	423,088	427,775	421,400	415,880	420,673	428,017	431,645	431,937	462,255	467,790	489,035	517,382

資料來源：該公司提供

二、發行公司及其各子公司(包括母子公司間交易事項)之最近期及最近二個會計年度背書保證、重大承諾及資金貸與他人、衍生性商品交易及重大資產交易之情形，並評估其對發行公司財務狀況之影響

(一)背書保證情形

該公司已訂定「背書保證作業程序」，並經董事會及股東會決議通過後實施，以作為辦理背書保證作業之依據。經查閱該公司 110~111 年度及 112 年截至最近期止經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會議事錄及背書保證備查簿等，該公司最近二年度及申請年度截至最近期止未有為他人背書保證之情形。

(二)重大承諾事項

該公司已訂定「負債承諾及或有事項管理辦法」，並經董事會決議通過後實施，作為該公司從事相關交易之依據。經查閱該公司 110~111 年度及 112 年截至最近期止經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會及股東會議事錄，尚無發現該公司有任何重大承諾事項。

(三)資金貸與他人情形

該公司已訂定「資金貸與他人作業程序」並經董事會及股東會決議通過後實施，以作為資金貸與他人之依據。經查閱該公司 110~111 年度及 112 年截至最近期止經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會議事錄及資金貸與他人備查簿等，該公司最近二年度及申請年度截至最近期止未有資金貸與他人之情形。

(四)衍生性商品交易

該公司已訂定「取得或處分資產處理準則」，並經董事會及股東會決議通過後實施，作為該公司從事衍生性商品交易之依據。經查閱該公司 110~111 年度及 112 年截至最近期止經會計師查核簽證或核閱之財務報告及董事會議事錄，該公司最近二年度及申請年度截至最近期止並無從事衍生性商品交易之情形。

(五)重大資產交易

該公司已訂定「取得或處分資產處理準則」，並經董事會及股東會決議通過後實施，作為該公司從事重大資產交易之依據。經查閱該公司 110~111 年度及 112 年截至最近期止經會計師查核簽證或核閱之財務報告及董事會議



事錄，該公司最近二年度及申請年度截至最近期止並無從事重大資產交易之情形。

綜上所述，該公司最近二年度及 112 年前三季並無從事背書保證、重大承諾、資金貸與他人、衍生性商品交易及重大資產交易之情形，尚不致對該公司財務狀況造成重大不利影響。

### 三、申請公司申請年度截至最近期之擴廠計畫及資金來源、工作進度、預計效益，並評估其可行性

該公司截至評估報告出具日止，尚無預計執行之擴廠計畫，故不適用本項評估。

### 四、發行公司及其各子公司(包括母子公司間交易事項)之轉投資事業

(一)列明申請年度截至最近期財務報告止概況並評估重要轉投資事業(持股比例達百分之二十以上或帳面金額或原始投資金額達新臺幣五千萬元以上)最近期及最近一個會計年度之營運及獲利情形、最近期及最近二個會計年度認列採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額、股利分配情形(海外轉投資事業一併列明獲利匯回金額)，若有利用發行公司資源及技術之情形，其給付對價或技術報酬金之合理性，若截至最近一期，轉投資事業發生營運或財務週轉困難情事，並應評估對發行公司之影響

該公司申請年度截至最近期財務報告日止，並無轉投資事業持股比例達百分之二十以上或帳面金額或原始投資金額達新臺幣五千萬元以上，故不適用本項評估。

(二)已赴或擬赴大陸地區從事投資者，應敘明其投資情況與最近期及最近二個會計年度認列採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額、獲利匯回金額，並評估其對發行人財務狀況之影響

截至評估報告出具日止，該公司並無已赴或擬赴大陸地區從事投資之情事，故不適用本項評估。

(三)申請年度截至最近期財務報告止尚未完成之投資案，其預估總投資金額占最近一個會計年度實收資本額百分之二十以上，或逾新臺幣五億元者，應就下列事項詳加評估說明；無面額或每股面額非屬新臺幣十元之發行人，前開有關實收資本額百分之二十之計算應以歸屬於母公司業主之權益百分之十替代之

截至最近期財務報告止，該公司並無尚未完成之投資案，其預估總投資金額占最近一年度財務報告所列示實收資本額百分之二十以上，或逾新臺幣五億元者，故不適用本項評估項目。

五、承銷商依臺灣證券交易所股份有限公司「證券承銷商辦理股票初次申請上市案之評估查核程序」第六條規定實地輔導發行公司之重要子公司者，應列示是否有重大營運風險或其他重大異常情事之評估意見

該公司申請年度截至評估報告出具日止並無重要子公司，故不適用本項評估。

六、評估發行公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至之員工認股權憑證採內含價值法，於發行公司股票上市後對財務報表可能之影響

該公司截至評估報告出具日止，並無已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至之員工認股權憑證採內含價值法之情事，故不適用本項之評估。

七、公營事業申請股票上市時，其檢送之財務報告有未經會計師簽證者，應洽會計師就如適用一般公認會計原則與審計機關審定數之差異，及其對財務報告之影響表示意見

該公司非以公營事業申請股票上市，故不適用本項評估。

八、金融事業申請股票上市，應列明其備抵提列情形，並評估其是否足額

該公司非以金融事業申請股票上市，故不適用本項評估。

九、承銷商應評估外國發行公司依註冊地國法令規定發行之員工認股權憑證及具股權性質有價證券之發行辦法合理性暨對股東權益之影響

該公司非屬外國申請公司申請股票上市，故不適用本項評估

伍、承銷商得視發行公司所營事業性質，委請在技術、業務，財務等各方面具備專業知識及豐富經驗之專家，就發行公司目前營運狀況及未來發展，進行比較分析，並本獨立公正立場出具審查意見，俾利評估

本證券承銷商並無委請專家出具審查意見書之情事，故不適用本項評估。

陸、法令之遵循及對本國發行公司營運影響由承銷商洽律師對本國發行公司、現任董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責最近三年內就下列事項出具意見後，依據其意見承銷商評估對本國發行公司營運影響及因應之道，並說明影響此次承銷之因素

## 一、發行公司是否違反相關法令規章

### (一)發行公司所屬行業之目的事業中央主管機關及影響該行業之重要法律與相關規章

經查閱該公司董事會議事錄、股東會議事錄及收發文紀錄等有關文件資料，核閱該公司與主管機關往來函文，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，該公司尚無違反目的事業中央主管機關及影響該行業之重要法律與相關規章而屬情節重大之情事。

### (二)發行公司依公開發行公司資訊公開相關法令應公開之資訊，評估是否依其法令辦理

經核閱該公司與主管機關往來函文，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，及查閱公開資訊觀測站該公司所揭露之資訊，該公司最近三年內均依照主管機關規定之「公開發行公司應公告或向本會申報事項一覽表」定期或不定期辦理應公告申報事項，尚無發現有未依公開發行公司資訊公開相關法令規定辦理之情事。

### (三)其他法令規章

經參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，並檢視與主管機關往來函文、簽訂之重大契約及取得該公司所出具之聲明書，該公司最近三年內尚無發生重大違反其他法令規章之情事。

## 二、董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人等相關人員是否違反相關法令，致使有違誠信原則或影響職務之行使

經參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，並取得上述人員之聲明書、財團法人金融聯合徵信中心綜合信用報告、第一類票據信用資料查覆單等資料，截至目前，該公司之董事、持股超過股份總額百分之十之股東、總經理及實質負責人並無違反相關法令，致有違誠信原則或影響職務行使之情事。

## 三、是否違反著作權、專利權、商標權或其他智慧財產權

經查詢司法院網站法學資料檢索系統及相關資料，並取得該公司之聲明書及參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，該公司尚無違反著作權、專利權、商標權或其他智慧財產權之情事。

## 四、繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件

經查閱該公司最近三年度及申請年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告、截至評估報告出具日止之董事會議事錄、股東會議事錄及該公司與其董事、總經理出具之聲明書及搜尋法源法律網所設立各法院裁判書查詢系統，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，該公司及其上

述人等尚無繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟之事件。

#### 五、重大勞資糾紛或污染環境事件

(一)經函詢勞動部勞工保險局、衛生福利部中央健康保險署及參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，並取具該公司之聲明書，截至評估報告日為止，尚無其他重大勞資糾紛案件。

(二)經函詢新竹縣政府環境保護局、行政院環保署及參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，並取具該公司之聲明書，截至評估報告日為止，該公司並無重大污染環境之情事。

柒、列明本國發行公司有無「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第九條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見；或外國發行公司或其從屬公司有無同準則第二十八條之八各款所列不宜上市情事之評估意見；或申請創新板上市之發行公司有無同準則第三十一條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見。評估有無同準則第九條第一項第十一款第二目、第二十八條之八第七款第二目或第三十一條第一項第十款第二目規定情事。列明發行公司設置之獨立董事及薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦理之評估意見。

一、列明依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第三十一條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見

該公司並無「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第三十一條第一項各款所列不宜上市之情事，請詳附件一。

二、列明發行公司設置之獨立董事及薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦理之評估意見

該公司於 111 年 6 月 23 日股東常會全面改選董事，選任潘燕民、吳清沂及林月霞擔任獨立董事，同日董事會決議委任上述三席獨立董事為第四屆薪資報酬委員會委員；該公司於 112 年 10 月 23 日股東臨時會選舉增選李展南為獨立董事，並於 112 年 11 月 8 日董事會決議增選李展南為薪資報酬委員會委員。茲就該公司本屆獨立董事及薪資報酬委員會成員之專業資格、職權行使及相關事項評估如下：

#### (一)獨立董事

經檢視該公司四席獨立董事之學經歷資料，其資格條件均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 2 條及第 3 條規定，茲就四席獨立董事之資格條件評估說明如下：

1. 獨立董事潘燕民為文化大學經濟研究所碩士，目前任職於鍊德科技股份有限公司擔任投資部副總經理，任職期間自 86 年 9 月迄今，具備 5 年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
2. 獨立董事吳清沂為國立清華大學電機工程研究所博士，曾任職於光寶科技股份有限公司擔任顧問，任職期間自 107 年 3 月至 112 年 3 月，具備 5 年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
3. 獨立董事林月霞為東海大學會計系學士，目前任職於大中國際聯合會計師事務所執業會計師，任職期間自 90 年 6 月迄今，具備 5 年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
4. 獨立董事李展南為國立中興大學企業管理研究所碩士，目前任職於伍豐科技股份有限公司擔任副總經理，任職期間自 96 年 12 月迄今，具備 5 年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

另經查閱該公司董事會議事錄並實地列席參與該公司董事會運作，獨立董事亦依其各自專業領域及經驗提供董事會客觀之建議，尚無重大異常之情事，其職權行使等相關事項皆已依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及相關法令規定辦理。

## (二) 薪資報酬委員會

該公司於 111 年 6 月 23 日股東常會全面改選董事選任潘燕民、吳清沂及林月霞擔任獨立董事，並於同日董事會決議委任上述三席獨立董事為第四屆薪資報酬委員會委員，另於 112 年 10 月 23 日股東臨時會選舉增選李展南為獨立董事，並於 112 年 11 月 8 日董事會決議增選李展南為薪資報酬委員會委員。經檢視該公司薪資報酬委員會成員之學經歷資料，其資格條件均符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第 5 條及第 6 條相關規定。

經查閱該公司薪資報酬委員會之會議事錄，其討論並提交董事會之建議事項均依相關程序及法令進行，尚無重大異常之情事，且其職權行使等相關事項皆已依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」及相關法令規定辦理。

綜上所述，該公司設置之獨立董事及薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項均依我國證券法令規定辦理。

## 捌、評估是否符合特定行業或組織型態公司之上市規定

### 一、評估是否符合集團企業申請股票上市之規定

(一)依據臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定第六條之規定，「集團企業」係指於申請上市會計年度及其最近一個會計年度內，與申請公司彼此間具有控制或從屬關係之企業整體。其具體認定標準及逐項評估如下：

1.具有下列各款情事之一者，即認為其彼此間具有控制或從屬關係

集團企業認定標準	符合認定公司	說明
1.屬於母公司及其所有子公司關係者。	該公司並無符合本項標準之情事。	1.經參閱該公司最近期之股東名冊，並檢視 111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司並未有持股超過 50% 之法人股東，或對該公司具有重大控制力之公司，故該公司尚無母公司。 2.經參閱該公司 111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司申請上市會計年度及其最近一個會計年度內並未有直接及間接持股達 50% 以上之子公司。
2.申請公司直接或間接控制他公司之人事、財務或業務經營者；或他公司直接或間接控制申請公司之人事、財務或業務經營者。所稱直接或間接控制其人事、財務或業務經營係指符合下列情事之一者：		
A.取得對方過半數之董事席位者。	該公司並無符合本項標準之情事。	1.取得該公司最近期經濟部變更登記表，並查閱該公司 111 年度及 112 年截至目前為止之董事名單，並無他公司取得該公司過半數董事席位。 2.經查閱該公司 111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財

集團企業認定標準	符合認定公司	說明
		務報告，該公司並無取得他公司過半數董事席次之情事。
B.指派人員獲聘為對方總經理者。	該公司並無符合本項標準之情事。	經檢視該公司 111 年度及 112 年截至目前為止董事會議事錄，其總經理係由該公司董事會委任，非為他公司指派之情事；該公司亦未指派他人擔任對方總經理之情事。
C.依合資經營契約規定擁有對方經營權者。	該公司並無符合本項標準之情事。	經檢視該公司 111 年度及 112 年截至目前為止之董事會議事錄及重要合約內容，尚無發現該公司有依合資經營契約而擁有對方經營權或他公司擁有該公司之情事。
D.為對方資金融通金額達對方總資產之三分之一以上者。	該公司並無符合本項標準之情事。	經檢視該公司 111 年度及 112 年截至目前為止之董事會議事錄、111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，尚無發現該公司有資金融通金額達對方總資產三分之一以上之情事；另亦無他公司為該公司資金融通金額達到該公司總資產三分之一以上之情事。
E.為對方背書保證金額達對方總資產之三分之一以上者。	該公司並無符合本項標準之情事。	經檢視該公司 111 年度及 112 年截至目前為止之董事會議事錄、111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並未發現有為對方背書保證金額達對方總資產之三分之一以上之情事。另並未有他公司為該公司背書保證金額達到該公司總資產三分之一以上之情事。
3.申請公司與他公司相互投資各達對方有表決權之股份總數或資本總額三分之一以上者，並互可直接或間接控制對方之人事、財務或業務經營者。	該公司並無符合本項標準之情事。	經核閱該公司最近期之股東名冊及 111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司並無與他公司相互投資各達對方有表決權股份總數或資本總額三分之一以上，並互可直接或間接控制對方之人事、財務或業務經營之情事。

2.申請公司與他公司間有下列各款情事之一者，即認為其彼此間具有控制或從屬關係。但申請公司檢具相關事證，證明無控制或從屬關係者，不在此限：

集團企業認定標準	符合認定公司	說明
1.申請公司與他公司之董事、監察人及總經理合計有半數以上相同者。其計算方式係包括該等人員之配偶、子女及具二親等以內之親屬關係者在內。	該公司並無符合本項標準之情事。	該公司共有九席董事(含四位獨立董事)及董事長兼總經理，經取得該公司之董事及總經理二親等親屬名單轉投資聲明書，並無發現與他公司有半數以上之董事、監察人及總經理與該公司相同之情事。
2.申請公司與他公司之已發行有表決權之股份總數或資本總額，均有半數以上為相同之股東持有或出資者。	該公司並無符合本項標準之情事。	經查閱該公司最近期之股東名冊及董事之轉投資事業明細表，並無發現該公司與他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額，均有半數以上為相同之股東持有或出資者。
3.對申請公司採權益法評價之他投資公司與其之關係人總計持有申請公司超過半數之已發行有表決權股份者；或申請公司與其關係人總計持有申請公司採權益法評價之他投資公司超過半數之已發行有表決權股份者。	該公司並無符合本項標準之情事。	經查閱該公司 111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，及最近期之股東名冊，並無發現對申請公司採權益法評價之他投資公司與其之關係人總計持有申請公司超過半數之已發行有表決權股份之情事；另該公司 111 年度及 112 年截至目前為止，並未有申請公司與其關係人總計持有申請公司採權益法評價之他投資公司超過半數之已發行有表決權股份者。

綜上所述，該公司無符合集團企業認定標準之公司。

## (二)集團企業中之本國發行公司申請股票上市者不宜上市認定標準

依據臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則第三十二條之規定，集團企業中之發行公司申請股票上市，除公營事業外，雖合於上市審查準則有關規定，但不能符合下列各款情事者，應不同意其股票上市：

1.申請公司與同屬集團企業公司之主要業務或主要商品，無相互競爭之情形。但申請公司具獨立經營決策能力者，不在此限。



該公司並無集團企業公司，故不適用。

- 2.申請公司與同屬集團企業公司間有財務業務往來或交易者，除各應就相互間之財務業務相關作業規章訂定具體書面制度，並經董事會通過外，應各出具書面聲明或承諾無非常規交易情事；無業務往來者，應由申請公司出具書面，承諾日後有往來時必無非常規交易之情事。

該公司已訂定「集團企業特定公司關係人交易往來辦法」，以規範與集團企業間財務暨業務往來事宜，並經董事會決議通過。此外，該公司截至評估報告出具日止並無集團企業，故無與集團企業交易往來之情事。爾後該公司與集團企業間有財務、業務往來者，將依「集團企業、特定公司關係人交易往來辦法」相關規定辦理，以避免非常規交易之情事。

- 3.其財務業務狀況及前述之作業辦法應無重大異常情事。

前述該公司之「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「集團企業、特定公司關係人交易往來辦法」係依據主管機關相關規定及該公司之營運狀況訂定，尚無發現有重大異常情事。

- 4.其對於銷售予集團企業公司之產品，應具有獨立行銷之開發潛力。

該公司無集團企業，故不適用本項評估。

- 5.申請上市時，最近期及最近一個會計年度來自集團企業公司之進貨金額未超過百分之七十。但基於行業特性、市場供需狀況、政府政策或其他合理原因者，得不適用之。

該公司無集團企業，故不適用本項評估。

- 6.申請上市時，最近期及最近一個會計年度來自集團企業公司之營業收入或營業利益金額未超過百分之五十；或利用集團企業公司提供之關鍵性技術或資產所生營業收入金額未超過百分之五十。但基於行業特性、市場供需狀況、政府政策或其他合理原因者，得不適用之。

該公司無集團企業，故不適用本項評估。

綜上所述，該公司尚無違反「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則及補充規定」中有關集團企業申請上市之規定。

(三)申請時屬於母子公司關係之子公司申請其股票上市，除公營事業外，雖合於「臺灣證券交易所股份有限公司上市審查準則」有關規定，但不能符合下列各款情事者，應不同意其股票上市：

該公司非屬於母子公司關係之子公司申請其股票上市，故不適用本項評估。

#### (四)集團企業評估結論

依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」，所列各項具體認定標準逐項評估後，該公司應無違反集團企業申請股票上市規定之情事。

二、評估是否符合「臺灣證券交易所股份有限公司上市審查準則」第十六條規定之公司申請股票上市

該公司非屬建設公司，故不適用本項之評估。

三、評估是否符合控股公司、金融控股公司、或其他特定組織型態公司申請上市之有關規定

該公司非屬控股公司、金融控股公司、或其他特定組織型態公司，故不適用本項之評估。

玖、評估發行公司是否依本公司「初次申請有價證券上市公開說明書應行記載事項準則」規定，於其公開說明書允當表達其推動永續發展執行情形。評估發行公司公司治理評鑑自評報告是否允當表達其公司治理運作情形

##### 一、永續發展執行情形

經檢視該公司出具之初次申請有價證券上市公開說明書，已依照臺灣證券交易所股份有限公司「初次申請有價證券上市公開說明書應行記載事項準則」規定，於其公開說明書允當表達其推動永續發展執行情形。

##### 二、公司治理運作情形

經檢視該公司出具之公司治理自評報告，公司已確實依照其「公司治理評鑑指標」自評各項評鑑指標，包含維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及推動永續發展等項目，進行逐項之評估，自我評量公司治理執行狀況，茲就該公司之公司治理運作情形說明如下：

(1)維護股東權益及平等對待股東

該公司重視股東權益，業已依照公司法及相關法令之規定制定完備之議事規則，定期召集股東會，並確實依照召集程序之規定於開會通知書上載明召集事由，及於開會前上傳年報與議事手冊至公開資訊觀測站，以確保股東對公司重大事項享有充分知悉權利。股東會之召開係依「股東會議事規則」進行，對於報告及討論事項均給予股東適當發言及充分討論之機會，並於公司章程中明定將電子表決列為股東表決權行使管道之一。此外，該公司已建置對外專屬網站，提供投資人瞭解該公司產業及其他資訊，並設置發言人及代理人制度，可妥善解答股東之疑慮及建議，保障該公司股東之權益。

## (2)強化董事會結構與運作

該公司目前設有九席董事，其中包含四席獨立董事，並有二席為女性董事，董事間超過半數之席次不具有配偶或二親等以內之親屬關係。董事選任程序已依公司法第一百九十二條之一規定係採候選人提名制度，符合上市上櫃公司治理實務守則之規定。該公司在遴選獨立董事時除考量獨立性外，並充分核閱獨立董事學經歷背景，以期發揮獨立董事應有之功能。該公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」制訂完備之董事會議事規則，作為議事有效運作之依據。每一季度該公司至少召開一次董事會，遇有緊急情事時則隨之召集，開會過程全程錄音，相關會議記錄皆依規定辦理及保存。

該公司亦依相關法令訂定「審計委員會組織規程」並設置審計委員會，審計委員會成員係由全體獨立董事組成，符合審查準則暨相關法令之規定。此外，為健全該公司董事及經理人薪資報酬制度，該公司亦已依相關法令訂定「薪資報酬委員會組織規程」並設置薪資報酬委員會，以規範各功能性委員會成員職責範疇。另，該公司業已設置公司治理主管，由財務主管兼任，負責公司治理相關事務。

## (3)提升資訊透明度

該公司重視資訊透明公開之責任，已依主管機關之規定，建置公開資訊之網路申報作業系統，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，且均於證券相關法規所定之期限內公告並申報財務報告等資訊，資訊即時公開，此外，該公司亦已於公司網站建置投資人專區，使股東及利害關係人能及時與充分瞭解公司財務業務狀況及實施公司治理之情形。另該公司過去一年未有因違反資訊揭露相關法規而受主管機關處分之情事發生，且並未有重編財務報告之情事。

#### (4)推動永續發展

該公司已訂定「關係人、特定公司及集團企業財務業務作業程序」並經董事會通過，作為該公司與關係企業間財務與業務往來之依據。該公司已訂有「員工手冊」作為勞資雙方權利義務之規範。該公司亦訂有經董事會通過之「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「防範內線交易管理作業程序辦法」及「永續發展實務守則」等相關辦法，落實誠信經營之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行誠信經營政策，並積極推動永續發展，在追求獲利的同時，作為公司實踐社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步。

綜上所述，經本證券承銷商逐條核閱該公司各評鑑指標之自我評估結果，該公司之公司治理自評報告已敘明目前實際運作情形，尚能依照上市上櫃公司治理實務守則之規範允當表達其公司治理運作之情形。

**拾、對上列各項目有關證券承銷商評估報告完成日起，截至股票上市契約生效日之前一日止之期後事項，應隨時加以更新說明與評估；於股票上市用公開說明書刊印日前，如有重大期後事項，亦應加以更新說明與評估**

該公司截至評估報告出具日止尚無重大期後事項。

**拾壹、以投資控股公司或金融控股公司申請股票上市者，承銷商應就被控股公司或其子公司之所營事業性質，依第四、五、六、八、九、十一及十二條等規定進行評估，出具各被控股公司或子公司之審查意見，再憑以出具綜合彙總意見**

該公司非以投資控股公司或金融控股公司申請股票上市，故不適用。

**拾貳、本國上市(櫃)公司之海外子公司申請其股票第一上市者，承銷商應評估本國上市(櫃)公司決策過程之適法性、對其營運及財務狀況是否有重大不利之影響，及擬採行之因應措施**

該公司非本國上市(櫃)公司之海外子公司申請其股票第一上市，故不適用。

**拾參、其他補充揭露事項**

無。

附件一、「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第三十一條第一項各款所列不宜上市情事之承銷商審查意見

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
<p>一、遇有證券交易法第一百五十六條第一項第一款、第二款所列情事，或其行為有虛偽不實或違法情事，足以影響其上市後之證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。</p> <p>(一)發行該有價證券之公司遇有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產。</p> <p>(二)發行該有價證券之公司，遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計畫之重要內容或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大之變更，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。</p> <p>(三)發行該有價證券之公司之行為有虛偽不實或違法情事，足以影響其上市後之證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。</p>	<p>(一)經查閱該公司最近二年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，最近二年度及 112 年截至目前為止之董事會議事錄、股東會議事錄、勞務費明細帳、收發文紀錄、取得該公司聲明書、查詢司法院法學資料檢索系統及參閱陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，並未發現該公司有訴訟或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。</p> <p>(二)經查閱該公司最近二年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，最近二年度及 112 年截至目前為止之董事會議事錄、股東會議事錄、存續之重要契約，向財團法人金融聯合徵信中心查詢該公司之企業綜合信用資訊、第一類票據信用資料查覆單及取得該公司所出具之聲明書，並參閱陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，截至評估報告出具日止，該公司並無遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計畫之重要內容或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大之變更，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。</p> <p>(三)經查閱該公司最近二年度及 112 年截至目前為止董事會議事錄、股東會議事錄、主管機關往來函文及經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並取得該公司所出具之聲明書及陳豪杉律師出具之法律意見書，並未發現該公司有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。</p> <p>綜上所述，該公司最近二年度及 112 年截至目前為止並無證券交易法第一百五十六條第一項第一款、第二款所列情事，或其行為</p>	<p>是</p>	

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
	有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。		
<p>二、財務或業務未能與他人獨立劃分者。</p> <p>(一) 資金來源過度集中於非金融機構者。</p> <p>(二) 申請公司與他人簽訂對其營運有重大限制或顯不合理之契約，致生不利影響之虞者。</p> <p>(三) 與他人共同使用貸款額度而無法明確劃分者。但母子公司間共用貸款額度，不在此限。</p> <p>(四) 申請上市時，最近期或最近一個會計年度來自非屬集團企業公司之關係人之進貨金額超過百分之七十。但基於行業特性、市場供需狀況、政府政策或其他合理原因所造成者，得不適用之。</p> <p>(五) 申請上市時，最近期或最近一個會計年度來自非屬集團企業公司之關係人之營業收入或營業利益金額超過百分之五十；或利用前揭關係人提供之關鍵性技術或資產所生營業收入金額超過百分之五十。但基於行業特性、市場供需狀況、政府政策或其他合理原因所造成，且前開比率未超過百分之七十者，得不適用之。</p>	<p>(一) 經查閱該公司 110~111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、該公司 110~111 年及 112 年截至送件日止之非銀行借款之負債科目明細帳，該公司並無「股東往來」及「同業往來」科目，另「暫估應付費用」、「其他應付費用」、「代收款」及「暫收款」等明細帳均為正常營運之交易性質，並無重大異常，該公司並無向非金融機構、股東或關係企業間有資金融通之情事。</p> <p>(二) 經查閱該公司提供尚在存續中之合約彙總表及抽核重要合約，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，該公司並未與他人簽訂對其營運有重大限制或顯不合理之契約，致生不利影響之虞者。</p> <p>(三) 經查閱該公司 110~111 年度及 112 年截至評估日止之董事會議紀錄、該公司 110~111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及該公司之聲明書，該公司尚無與他人共同使用貸款額度之情事。</p> <p>(四) 經查閱該公司 111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司並無來自非屬集團企業公司之關係人之進貨金額超過百分之七十之情事。</p> <p>(五) 經查閱該公司 111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及前十大銷貨客戶明細表，該公司並無來自非屬集團企業公司之關係人之營業收入或營業利益金額超過百分之五十；或利用前揭關係人提供之關鍵性技術或資產所生營業收入金額超過百分之五十之情事。</p> <p>綜上評估，該公司並無財務或業務未能與他人獨立劃分之情事。</p>	是	

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
<p>三、有足以影響公司財務業務正常營運之重大勞資糾紛或污染環境情事，尚未改善者。</p> <p>(一)所規定「足以影響公司財務業務正常營運之重大勞資糾紛」，係指下列情事之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 發生重大勞資爭議者。</li> <li>2. 因安全衛生設施不良而發生重大職業災害；或違反職業安全衛生法被處以部分或全部停工者；或設置危險性機械、設備未檢查合格者。但經申請由檢查機構複查合格者，不在此限。</li> <li>3. 積欠勞工保險保費及滯納金，經依法追訴仍未繳納者。</li> </ol> <p>(二)所規定「足以影響財務業務正常營運之重大污染環境」，係指公司或其事業活動相關場廠有下列情事之一：</p>	<p>(一)重大勞資糾紛之相關評估結果如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.經訪談該公司主要管理階層人員，並查閱 110~111 年度及 112 年截至目前為止之收發文記錄、勞資會議紀錄、工作規則、營業外支出明細帳、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、該公司之聲明書，函詢新竹縣勞工局及北區職業安全衛生署，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書等，該公司最近二年度及申請上市年度並無發生重大勞資爭議且足以影響公司財務業務正常營運之情事。</li> <li>2. 經查閱該公司 110~111 年度及 112 年截至目前為止之收發文記錄、營業外支出明細帳、經會計師查核簽證或核閱之財務報告及取得公司聲明書，函詢北區職業安全衛生署，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書等，該公司 110~111 年度及 112 年截至目前為止尚無因安全衛生設施不良而發生重大職業災害；或違反職業安全衛生法被處以部分或全部停工；或設置危險性機械、設備未檢查合格之情事。</li> <li>3. 經查閱該公司 110~111 年度及 112 年截至目前為止之收發文記錄、相關會計科目明細帳及經會計師查核簽證或核閱之財務報告，抽核該公司勞健保費用之繳納情形及取得公司聲明書，並函詢勞工保險局及衛生福利部中央健康保險署，該公司並無積欠勞工保險費、健保費及滯納金之情事。</li> </ol> <p>(二)重大環境污染情事之相關評估結果如下：</p>	是	

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
<p>1.依法令應取得污染設置、操作或排放許可證而未取得者。</p> <p>2.曾因環境污染，於申請上市會計年度或最近二會計年度，各該年度經環保機關按日連續處罰者或經限期改善，而未完成改善者。</p> <p>3.有公害糾紛事件而無有效污染設備，或未能提供污染防治設備之正常運轉及定期檢修紀錄者。</p> <p>4.有環境污染情事，經有關機關命令停工、停業、歇業或撤銷污染相關許可證者。</p> <p>5.廢棄物任意棄置或未依相關規定貯存、清除、處理或於處理過程中造成環境重大污染，因而致人於死或致重傷或危害人體健康導致疾病者。</p> <p>6.經中央主管機關指定公告之事業，其土地因污染土壤或地下水而被公告為控制場</p>	<p>1.該公司主要從事邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體係智慧財產權技術、授權及技術開發設計服務業務，其營運過程中並無產生汙染環境之情事，故無需取得污染防治相關規定之許可證，亦無工業用水汙染及空氣汙染相關問題，且該公司取得環境保護局之無違反環保法令回函，尚無發現該公司有須依法令應取得污染設置、操作或排放許可證而未取得之情事。</p> <p>2.經查閱該公司 110~111 年度及 112 年截至目前為止之收發文記錄、營業外支出明細帳、函詢主管機關及取得該公司出具之聲明書，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書等，尚無發現該公司有因環境污染而經環保機關按日連續處罰或經限期改善，而未完成改善之情事。</p> <p>3.經查閱該公司 110~111 年度及 112 年截至目前為止之收發文記錄、該公司出具之聲明書，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，且函詢新竹縣政府環境保護局，尚無發現該公司有公害糾紛事件而無有效污染設備，或未能提供污染防治設備之正常運轉及定期檢修紀錄之情事。</p> <p>4.經查閱該公司 110~111 年度及 112 年截至目前為止之收發文記錄、該公司出具之聲明書，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，且函詢新竹縣政府環境保護局，尚無發現該公司有環境污染情事，而經有關機關命令停工、停業、歇業或撤銷污染相關許可證之情事。</p> <p>5.經查閱該公司 110~111 年度及 112 年截至目前為止之收發文記錄、該公司出具之聲明書，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，且函詢新竹縣政府環境保護局，該公司並未有因廢棄物任意棄置或未依相關規定貯存、清除、處理或於處理過程中造成環境重大污染，因而致人於死或致重傷或危害人體健康導致疾病之情事。</p> <p>6.經查閱該公司 110~111 年度及 112 年截至目前為止之收發文記錄、該公司出具之聲明書，並參酌陳豪杉律師事務所陳</p>		



項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
<p>址或整治場址者。</p> <p>7. 法人有製造、加工或輸入偽禁環境用藥情事，其負責人經判刑確定者。</p> <p>(三)所規定「尚未改善者」，係指在本公司受理其股票上市申請案之日以後仍有上開情事者。</p> <p>(四)但前(二)第 2 款之重大環境污染情事，以其已委託經環保機關認可之檢測機構，進行檢測及提出檢測結果報告書，並據以向環保機關申報污染改善完成報告書，於申報後三個月內未再續遭處罰者，作為是否改善之認定標準。</p>	<p>豪杉律師出具之法律意見書，且函詢新竹縣政府環境保護局，尚未發現該公司有經中央主管機關指定公告之事業，其土地因污染土壤或地下水而被公告為控制場址或整治場址之情事。</p> <p>7. 經查閱該公司 110~111 年度及 112 年截至目前為止之收發文記錄、該公司出具之聲明書，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，且函詢新竹縣政府環境保護局，尚未發現該公司有因製造、加工或輸入偽禁環境用藥情事，其負責人經判刑確定之情事。</p> <p>綜上所述，該公司並無足以影響財務業務正常營運之重大環境污染而尚未改善之情事。</p>		
<p>四、經發現有重大非常規交易，尚未改善者。</p> <p>(一)所規定「重大非常規交易」，係指申請公司有下列各款情事之一者，但公營事業依審計法規辦理者，不在此限：</p> <p>1. 進銷貨交易之目的、價格及條件，或其交易之發生，或其交易之實質與形式，或其交易之處理程序，與一般正常交易顯不相當或顯欠合理者。</p> <p>2. 依主管機關訂頒「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，應行公告及申報之取得或處分資產交易行為，未能合理證明其內部決定過程之合法性，或其交易之必要性，或其有關報表揭露之充分性，暨價格與款項收付情形之合理性者。</p>	<p>(一)重大非常規交易：</p> <p>1. 經查閱該公司 110~111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並抽核該公司與前十大銷貨對象之交易及收付款情形，尚無發現該公司交易之目的、價格及條件，或其交易之發生，或其交易之實質與形式，或其交易之處理程序，與一般正常交易顯不相當或顯欠合理者。</p> <p>2. 取得或處分資產處理之評估</p> <p>(1)該公司業依證期局「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，訂定該公司之「取得或處分資產處理程序」，並經董事會決議通過後，提報股東會同意，其作業內容及程序符合相關法令之規定。</p> <p>(2)經查閱該公司 110~111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會議事錄、股東會議事錄、財產</p>	是	

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
<p>3. 以簽約日為計算基準，其最近五年內買賣不動產有下列情形之一者：</p> <p>(1) 向關係人購買不動產，其按主管機關所訂頒「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條所列方法，評估不動產成本結果，均較實際交易價格為低，且未符合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十七條規定者。</p> <p>(2) 出售不動產予關係人，其按主管機關所訂頒「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條所列方法，評估不動產成本結果，均較實際交易價格為高者。</p> <p>(3) 向關係人買賣不動產，收付款條件明顯異於一般交易，而未有適當理由者。</p> <p>(4) 申請公司所買賣土地與關係人於相近時期買賣鄰近土地，價格有明顯差異而未有適當理由者。</p> <p>(5) 最近五個會計年度末一季銷貨或租賃不動產予關係人所產生之營業收入，逾年度營業收入百分之二十，而未有適當理由者。</p> <p>(6) 向非關係人買賣不動產，有其他資料顯示買賣不動產交易明顯異於一般交易而無適當理由者。</p> <p>4. 非因公司間業務交易行為有融通資金之必要，將大量資金貸與他人者。</p>	<p>目錄、公告資訊及抽核相關文件等，該公司尚無達到須依公開發行公司取得或處分資產處理準則辦理公告申報之情事。</p> <p>3. 經查閱該公司最近五年度及 112 年度第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會議事錄、財產目錄及重大契約等，該公司最近五年度未有取得或處分不動產之交易；另該公司非屬建設業或以買賣或租賃不動產為主要業務，亦無年度末一季銷貨或租賃不動產予關係人所產生之營業收入逾年度營業收入 20% 之情事。</p> <p>4. 經查閱該公司 110~111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及相關明細帳，並查詢公開資訊觀測站，該公司並無非因公司間業務交易行為有融通資金之必要，將大量資金貸與他人之情事。</p>		

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
<p>5. 前項第三款關於向關係人買賣不動產之規定，對於最近五年內其交易對象之前手或前前手有關係人身分時，亦應比照適用之。但買賣不動產之交易，其交易對象簽約取得時間，至本次交易簽約日止超過五年者，可免適用之。</p> <p>6. 申請公司有第一項所定情事，致獲得利益者，經將所獲得利益予以扣除設算後，其獲利能力仍應符合上市條件。</p> <p>(二)所規定「尚未改善」，其改善之認定，係指符合下列各款情事之一者：</p> <p>1. 因非常規交易而致申請公司以外之人獲得利益者，該獲得利益之人已將所得利益歸還應得之人者。</p> <p>2. 該非常規交易行為經檢調或司法單位確定無犯罪情事。</p> <p>3. 該非常規交易已恢復原狀者。</p>	<p>5. 經查閱該公司董事會議事錄、財產目錄、明細帳等帳冊及該公司最近五年度及申請年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司最近五年內，未有向關係人買賣不動產之情事。</p> <p>6. 該公司並無重大非常規交易，故不適用。</p> <p>(二)該公司並無重大非常規交易尚未改善，故不適用。</p> <p>綜上評估，該公司並無重大非常規交易迄申請時尚未改善之情事。</p>		
<p>五、有迄未有效執行書面會計制度、內部控制制度、內部稽核制度，或不依有關法令及國際財務報告準則編製財務報告等情事，情節重大者。</p> <p>(一)所規定「不依有關法令及國際財務報告準則編製財務報告」，係指有下列情事之一者：</p> <p>1. 財務報告未依有關法令及國際財務報告準則編製，經會計師出具否定意見或無法表示意見之查核報告書者，或經會計師出具保留意見之查核報告書而影響財務報告之允當表達者。</p> <p>2. 財務報告經主管機關函示應改進而未改進者。</p>	<p>(一)有無「不依有關法令及國際財務報告準則編製財務報告」之評估：</p> <p>1.經查閱該公司 110~111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司財務報告均依有關法令及國際財務報告準則編製，並無經會計師出具否定意見或無法表示意見之查核報告書者，或經會計師出具保留意見之查核報告書而影響財務報告之允當表達之情事。</p> <p>2.經查閱該公司 110~111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及收發文紀錄，該公司之財務報告並無經主管機關函示應改進而未改進</p>	是	
	之情事。		

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
<p>3. 簽證會計師查核工作底稿，經臺灣證券交易所股份有限公司調閱後，發現有重大缺失，致無法確認財務報告是否允當表達者。</p> <p>(二)所規定「迄未有效執行書面會計制度、內部控制制度、內部稽核制度」，指有下列情事之一者：</p> <p>1. 在申請上市年度未依主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則或內部控制相關法令規定，建立健全書面會計制度、內部控制制度、內部稽核制度。</p> <p>2. 經臺灣證券交易所股份有限公司實地查核，發現未依書面會計制度、內部控制制度、內部稽核制度合理運作者。</p>	<p>3. 經借閱 110~111 年度及 112 年第三季會計師查核或核閱之工作底稿，並未發現有經臺灣證券交易所股份有限公司調閱後，發現有重大缺失，致無法確認財務報告是否允當表達之情事。</p> <p>1. 經核閱該公司之書面會計制度、內部控制制度及內部稽核制度，該公司已依「證券發行人財務報告編製準則」建立其書面會計制度，另其內部控制制度及內部稽核制度亦已依該公司管理及業務發展所需制定，並經該公司董事會通過。</p> <p>2. 該公司已依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，建立書面內部控制制度及內部稽核制度，且經查閱該公司 110~111 年度經會計師出具之內部控制建議書，尚未發現有重大缺失之情形。另該公司業依規定委請會計師就其內部控制制度之設計與實際運作情形進行專案審查，並於 112 年 12 月 4 日取得會計師出具無保留意見之內部控制制度專案審查，其表示該公司於 112 年 4 月 1 日至 112 年 9 月 30 日之內部控制制度及內部稽核制度應已健全並有效執行。</p> <p>綜上所述，該公司並無未有效執行書面會計制度、內部控制制度、內部稽核制度，或不依有關法令及國際財務報告準則編制財務報告等情節重大之情事。</p>		
<p>六、所營事業嚴重衰退者</p> <p>(一)所規定「嚴重衰退」，係指有下列情事之一者，但申請股票上市公司最近一個會計年度之營業利益及稅前淨利占股本比率不低於百分之十二者，不適用之：</p> <p>1. 最近一個會計年度或申請上市會計年度之營業收入及營業利益與同業比較，顯有重大衰退者。</p> <p>2. 最近一個會計年度或申請上市會計年度之稅前淨利與同業比較，顯有重大衰退者。</p> <p>3. 最近三個會計年度之營業</p>	<p>(一)經查閱該公司 111 年度經會計師查核簽證之個別財務報告之營業利益及稅前淨利，分別為 78,846 仟元及 81,371 仟元，占 111 年底之股本 268,100 仟元之比重分別為 29.41%及 30.35%，已超過 12%以上，故不適用所營事業嚴重衰退之評估。</p>	是	

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
<p>收入及營業利益，均連續呈現負成長情形者。</p> <p>4. 最近三個會計年度之稅前淨利，連續呈現負成長情形者。</p> <p>5. 產品或技術已過時，而未有改善計畫者。</p> <p>(二)前項規定，對於最近一個會計年度之營業利益及稅前淨利占股本比率不低於百分之十二者，不適用之。</p> <p>(三)第一項第一、二款所規定「同業比較」，證券承銷商應評估說明所採樣同業之合理性。</p> <p>(四)第一項第三、四款之規定，對於已有具體改善計畫並產生效益者，不適用之。</p> <p>(五)依據臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定第三十二條第三項：經申請有價證券在創新板上市、創新板第一上市者提出合理性說明後，得不準用之。</p>			
<p>七、申請公司或其現任董事、總經理或實質負責人於最近三年內有違反誠信原則之行為者。</p> <p>(一)公司部分：</p> <p>1. 所開立之支票存款戶經票據交換所公告為拒絕往來戶，或因簽發支票或以金融業為擔當付款人之票據，發生存款不足退票列入紀錄未經清償贖回註記者。</p> <p>2. 向金融機構貸款有逾期還款之情形者。但還款完畢已逾三年者，不在此限。</p> <p>3. 違反勞動基準法被處以刑罰確定者，但最近二年內經檢查機構複查已改善者，不在此限。</p> <p>4. 違反稅捐稽徵法經判決有罪確定者。</p>	<p>(一)公司部分：</p> <p>1. 經檢視票據交換所第一類票據查詢資料及財團法人金融聯合徵信中心信用報告，該公司最近三年內並未被列為拒絕往來戶及因存款不足退票列入記錄未經註銷之情形。</p> <p>2. 該公司最近三年度及申請年度截至最近期止未有借款之情事，並經檢視財團法人金融聯合徵信中心信用報告，該公司並無向金融機構貸款有逾期還款之情事。</p> <p>3. 經檢視 109~111 年度及 112 年度截至目前為止主管機關往來函文及勞工主管機關之回函內容，該公司並未有違反勞基法經判決有罪確定之情事。</p> <p>4. 經檢視 109~111 年度及 112 年度截至目前為止主管機關往來函文及所屬地區稅捐稽徵機關與國稅局之回函內容，該公司最近三年內並未有逾期欠稅之情事及違反稅捐稽徵法經判決有罪確定之情</p>	是	

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
<p>5. 違反申請上市時所出具聲明書之聲明事項者。</p> <p>6. 有其他重大虛偽不實、違反法令或喪失公司債信情事，而有損害公司利益、股東權益或公眾利益者。</p> <p>(二)董事、總經理或實質負責人部分：</p> <p>1. 同前款第(一)之 1、2、3、4 及 5 目。但屬向金融機構貸款逾期還款者，倘逾期還款情節非屬重大或有合理事由者，不在此限。</p> <p>2. 犯公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、證券交易法、期貨交易法、商業會計法、票券金融管理法等商事法規規定之罪，或犯貪污、瀆職、詐欺、背信、侵占等罪，經法院判決有期徒刑以上之罪者。</p> <p>3. 有經營其他公司涉及惡性倒閉或重大違反公司治理原則等不良行為者。</p> <p>4. 有其他重大違反法令或誠實信用原則之行為者。</p>	<p>事。</p> <p>5. 經檢視陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書及該公司出具之聲明書，該公司最近三年度並無違反申請上市時出具聲明書之聲明事項。</p> <p>6. 經查閱該公司與主管機關往來函文、取得該公司出具之聲明書及查詢司法法院法學資料檢索系統，並參酌陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，該公司並未有其他重大虛偽不實、違反法令或喪失公司債信情事，而有損害公司利益、股東權益或公眾利益者。</p> <p>(二)董事、總經理或實質負責人部分：</p> <p>1. 經檢視該公司董事、總經理或實質負責人經財團法人聯合徵信中心出具之綜合信用報告、台灣票據交換所之第一類票據信用資料查覆單、財政部國稅局及稅捐稽徵機關出具之納稅義務人違章欠稅查復表、陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書並取得該等人員出具之聲明書，該公司董事、總經理或實質負責人最近三年內尚無前開(一)第 1 至 5 目所列之情事。</p> <p>2. 經取得該公司董事、總經理或實質負責人所出具之聲明書，檢視陳豪杉律師事務所陳豪杉律師出具之法律意見書，該公司之董事、總經理或實質負責人尚無犯公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、證券交易法、期貨交易法、商業會計法、票券金融管理法等商事法規規定之罪，或犯貪污、瀆職、詐欺、背信、侵占等罪，經法院判決有期徒刑以上之罪者。</p> <p>3. 經取得該公司董事、總經理或實質負責人所出具之聲明書、檢視陳豪杉律師事務所陳豪杉律師所出具之法律意見書，該公司董事、總經理或實質負責人並無經營其他公司涉及惡性倒閉或重大違反公司治理原則等不良行為之情事。</p> <p>4. 經取得該公司董事、總經理或實質負責人出具之聲明書及檢視陳豪杉律師事務所陳豪杉律師所出具之法律意見書，該等人員並無其他重大違反法令或誠實信用原則之行為。</p> <p>綜上評估，該公司及其現任董事、總經理或實質負責人於最近三年內並無違反誠信原則之行為。</p>		
<p>八、申請公司之董事會成員少於五人或為單一性別，獨立董事人數少於三</p>	<p>經檢視該公司最近期變更登記核准函及變更事項登記表，該公司目前設有九席董事(其中包括四席獨立董事)，已符合董事成員</p>	是	

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
<p>人或至少董事席次三分之一；其董事會有無法獨立執行其職務；或未依證券交易法第十四條之六及其相關規定設置薪資報酬委員會者。另所選任獨立董事其中至少一人須為會計或財務專業人士。但本國發行公司申請股票上市前，其股票未登錄為興櫃股票櫃檯買賣者，經承諾至遲於股票上市買賣前完成獨立董事之選任及功能性委員會之設置者，不在此限。</p> <p>(一) 擔任申請公司獨立董事，有不合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂之要件者：</p> <p>1. 擔任申請公司之獨立董事，應取得下列專業資格條件之一，並具備五年以上工作經驗：</p> <p>(1) 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公立大專院校講師以上。</p> <p>(2) 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。</p> <p>(3) 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。</p> <p>2. 有下列情事之一者，不得充任獨立董事，其已充任者，當然解任：</p> <p>(1) 有公司法第三十條各款情事之一。</p> <p>(2) 依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。</p> <p>(3) 違反本辦法所定獨立董事之資格。</p>	<p>不少於五人，獨立董事人數不少於三人或不少於董事席次五分之一之規定；該公司九席董事彼此間並無席次具有配偶、二親等以內親屬及同一法人之代表人之關係，故該公司並未有董事無法獨立執行其職務之情事；另該公司業已依證券交易法第十四條之六及其相關規定設置薪資報酬委員會，並經董事會決議委任四名獨立董事擔任薪資報酬委員會委員。所選獨立董事林月霞為會計或財務專業人士，符合獨立董事至少一人應具備會計或財務專業人士之規定。</p> <p>經取得該公司獨立董事學歷、經歷證明及聲明書，評估該公司獨立董事已符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂之資格要件，茲說明如下：</p> <p>(1) 獨立董事潘燕民畢業於私立中國文化大學經濟研究所碩士，目前擔任銖德科技(股)公司副總經理暨公司治理主管，任職期間自 86 年 9 月迄今。</p> <p>(2) 獨立董事吳清沂畢業於國立清華大學電機工程研究所博士，曾任光寶科技(股)公司顧問，任職期間自 107 年 3 月至 112 年 3 月，並為現任嘉聯益科技(股)公司獨立董事</p> <p>(3) 獨立董事林月霞畢業於東海大學會計系學士，現為大中國國際聯合會計師事務所執業會計師，任職期間自 90 年 6 月迄今。</p> <p>(4) 獨立董事李展南畢業於中興大學企業管理研究所碩士，現為伍豐科技股份有限公司副總經理，任職期間自 96 年 12 月迄今。</p> <p>該公司四位獨立董事均符合專業資格條件，具備五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。</p> <p>2. 經查閱該公司最近期之變更登記事項卡、查詢司法院法學資料檢索系統，並取得該公司獨立董事出具之聲明書、財團法人金融聯合徵信中心之信用報告、第一類票據信用資料查覆單，該公司四席獨立董事並無公司法第三十條各款情事之一，亦非以公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選，或違反「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所定獨立董事資格之情事。</p>		

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
<p>3. 申請公司之獨立董事應於選任前二年及任職期間無下列情事之一：</p> <p>(1) 公司或其關係企業之受僱人。</p> <p>(2) 公司或其關係企業之董事、監察人。</p> <p>(3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。</p> <p>(4) 第一款之經理人或前二款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。</p> <p>(5) 直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。</p> <p>(6) 公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人。</p> <p>(7) 公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，</p>	<p>3. 獨立性資格之判斷：</p> <p>(1) 經核對獨立董事之任職資料，並取具獨立董事之聲明書、學經歷聲明書，且經查閱該公司員工名冊，該公司獨立董事選任前二年及任職期間非為該公司或其關係企業之受僱人。</p> <p>(2) 經核對獨立董事之任職資料，並取具獨立董事之聲明書、學經歷聲明書，該公司獨立董事選任前二年及任職期間非為該公司或其關係企業之董事或監察人。</p> <p>(3) 經核閱該公司之股東名冊，並取具獨立董事出具之聲明書、親屬表及轉投資明細表，該公司獨立董事選任前二年及任職期間並無本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。</p> <p>(4) 經取得獨立董事出具之聲明書、親屬表、轉投資明細表、該公司股東名冊及董事名單，該公司之獨立董事並無左列情事。</p> <p>(5) 經取得獨立董事出具之聲明書、工作經歷相關資料及轉投資明細表，並經檢視該公司股東名冊，未有直接持有該公司已發行股份總數百分之五以上之法人股東，並取得持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東董監名單，該公司獨立董事於選任前二年及任職期間非為直接持有該公司已發行股份總數百分之五、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。</p> <p>(6) 經取得該公司股東名冊、董事名單、獨立董事出具之聲明書及轉投資明細表，該公司並無董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之情事。</p> <p>(7) 經查閱該公司之董事長、總經理或相當職務者兼任其他公司情形，檢視該等兼任公司於經濟部商業司登記之董監事</p>		



項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
<p>他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。</p> <p>(8)與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。</p> <p>(9)為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依本法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。</p> <p>4. 申請公司之獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家。</p>	<p>名單，該公司之董事長兼任晶隼科技股份有限公司之董事，經核對獨立董事任職之任職資料及其所出具之聲明書，該公司之獨立董事於委任前二年及任職期間非為他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。</p> <p>(8)經檢視獨立董事轉投資聲明書、學經歷證明文件及獨立性聲明書，該公司獨立董事於選任前二年及任職期間非為與該公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。該公司之特定公司或機構評估如下：</p> <p>A.經檢視該公司股東名冊，並無持有該公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%之特定公司。</p> <p>B.經檢核該公司股東名冊，並無他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總額百分之十之股東總計持有該公司已發行股份總額百分之三十以上之情事。</p> <p>C.經取得該公司最近二年度及申請年度前 10 大銷售客戶對象，尚無發現該公司有營業收入來自他公司及其集團公司達百分之三十以上之情事。</p> <p>D.該公司因行業特性無進貨廠商，故無主要產品原料或主要商品，其數量或總進貨金額來自他公司及其集團公司達百分之五十以上。</p> <p>(9)經取具獨立董事之學經歷聲明書、任職資料及聲明書，並檢視該公司之勞務費明細帳，該公司獨立董事選任前二年及任職期間，除經 111 年 6 月 23 日及 112 年 11 月 8 日董事會委任為薪資報酬委員會成員外，非為該公司或其關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。</p> <p>4. 經取得該公司獨立董事出具之聲明書、轉投資明細表及工作經歷相關資料，該公司獨立董事並無兼任其他公開發行公司獨立</p>		

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
<p>5. 申請公司之獨立董事選舉，應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，並載明於章程，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。</p> <p>(二) 擔任申請公司獨立董事者，未於該公司輔導期間進修法律、財務或會計專業知識每年達三小時以上且取得「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」第六條第一、二、四款訂定之進修體系所出具之相關證明文件。</p> <p>(三) 申請公司之董事彼此間有超過半數之席次，具有下列關係之一： 1. 配偶。 2. 二親等以內之親屬。 3. 同一法人之代表人。 前項(三)之規定，對於政府或法人為股東，以政府或法人身分當選為董事，而指派代表行使職務之自然人；暨由其代表人當選為董事之代表人，亦適用之。 董事間有超過半數之席次具有(三)3.之關係，經目的事業主管機關核准者，不適用之。</p>	<p>董事逾三家之情事。</p> <p>5. 經檢視該公司之公司章程及股東會議紀錄，已載明獨立董事之選舉採候選人提名制，且該公司四名獨立董事分別於 111 年 3 月 31 日及 112 年 8 月 2 日董事會提名通過，並經 111 年 6 月 23 日股東常會及 112 年 10 月 23 日股東臨時會依候選人提名制度選任之。</p> <p>(二) 經取得該公司獨立董事參加法律、財務或會計專業知識之進修證明，該公司之獨立董事已於該公司輔導期間進修法律、財務或會計專業知識達三小時，符合獨立董事每年應就法律、財務或會計專業知識進修三小時以上之規定。</p> <p>(三) 經取得該公司董事出具之聲明書及其二等親屬表，尚無發現該公司之董事彼此間具有配偶、二親等以內之親屬及同一法人之代表人，故其董事之獨立性尚符合審查認定標準。</p> <p>綜上評估，該公司未有董事會無法獨立執行其職務之情事。</p>		
<p>九、申請公司於申請上市會計年度及其最近一個會計年度已登錄為證券商營業處所買賣興櫃股票，於掛牌日起，其現任董事及持股超過其發行股份總額百分之十之股東有未於興櫃股票市場而買賣申請公司發行之股票情事者。但因辦理本準則第十一條之承銷事宜或有其他正當事由者，不在此限。</p>	<p>經取得該公司申請上市會計年度及其最近一個會計年度之內部人股權轉讓明細表，並查詢公開資訊觀測站董事股權異動資料，尚無發現其現任董事及持股超過百分之十之股東，有未於興櫃股票市場買賣該公司股票之情事。</p>	是	
<p>十、申請公司之股份為上市(櫃)公司持有且合於下列條件之一者，該上市(櫃)公司最近三年內為降低對申請公司之持股比例所進行之股權移轉，未採公司原有股東優先認購或其他不損害公司股東權益方式：</p>	<p>該公司非屬上市(櫃)公司進行分割後受讓營業或財產之既存或新設公司，故不適用本項評估。</p>	是	

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	備註
<p>(一)申請公司係屬上市(櫃)公司進行分割後受讓營業或財產之既存或新設公司。</p> <p>(二)申請公司係屬上市(櫃)公司子公司,於申請上市前三年內,上市(櫃)公司降低對申請公司直接或間接持股比例累積達百分之二十以上。</p>			
<p>十一、其他因事業範圍、性質或特殊情況,而不宜上市之情事。</p>	<p>該公司尚無其他因事業範圍、性質或特殊情況,而有不宜上市之情事。</p>	<p>是</p>	


主辦證券承銷商：兆豐證券股份有限公司



評估人簽章：潘子瑜 

阮傳烜 

楊復穎 

林暉喬 

單位主管簽章：王基昂 

負責人簽章：陳佩君 

中華民國 一 一 二 年 十 二 月 十 一 日

(本用印頁僅限於億而得微電子股份有限公司股票申請於創新板上市證券承銷商評估報告使用)

協辦證券承銷商：元富證券股份有限公司



評估人簽章：李顯章



單位主管簽章：顏榮嗣



董事長簽章：陳俊宏



中華民國 一 一 二 年 十 二 月 十 一 日

(本用印頁僅限於億而得微電子股份有限公司股票申請於創新板上市證券承銷商評估報告使用)

協辦證券承銷商：凱基證券股份有限公司



評估人簽章：方彥博



單位主管簽章：林能顯



負責人簽章：方維昌



中華民國一一二年十二月十一日

(本用印頁僅限於億而得微電子股份有限公司股票申請於創新板上市證券承銷商評估報告使用)

協辦證券承銷商：玉山綜合證券股份有限公司



評估人簽章：莊英鈞



單位主管簽章：黃美霞



負責人簽章：林晉輝



中華民國 一 一 二 年 十 二 月 十 一 日

(本用印頁僅限於億而得微電子股份有限公司股票申請於創新板上市證券承銷商評估報告使用)

協辦證券承銷商：國泰綜合證券股份有限公司



評估人簽章：陳俊文



單位主管簽章：林聖斌



負責人簽章：莊順裕



中華民國 一 一 二 年 十 二 月 十 一 日

(本用印頁僅限於億而得微電子股份有限公司股票申請於創新板上市證券承銷商評估報告使用)



附件十六、創板上市前現金增資發行新股證券承銷商評估報告

# 億而得微電子股份有限公司

一一三年度現金增資發行新股

證券承銷商評估報告

主辦證券承銷商：兆豐證券股份有限公司



中華民國 113 年 3 月 15 日 編 製

## 評估報告目錄

壹、承銷商總結意見.....	1
貳、評估報告內容摘要.....	2
一、產業概況.....	2
二、發行人之競爭地位.....	8
三、營運風險.....	12
四、最近期及最近二個會計年度募集與發行有價證券籌資效益.....	41
參、業務財務狀況.....	41
一、業務狀況.....	41
二、財務狀況.....	59
肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及 私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....	75
一、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募 有價證券計畫尚未完成者之執行狀況，如執行進度未達預計目標者，應 再具體評估其落後原因之合理性、對股東權益之影響及是否有具體改善 計畫.....	75
二、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募 有價證券計畫如經重大變更且尚未完成者，應說明其變更計畫內容、資 金之來源與運用、變更原因及變更前後效益.....	75
三、計畫實際完成日距申報時未逾三年之前各次現金增資、併購或受讓他公 司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫已完成者之原預計效 益是否顯現，如執行效益未達預計目標者，應具體評估其原因之合理性 及對股東權益之影響.....	75
四、曾發行公司債或舉借長期債務者，是否均如期還本付息，其契約對公司 目前財務、業務或其他事項之重大限制條款，並說明最近期及最近二個 會計年度有無財務週轉困難情事.....	75
五、是否確實依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理資訊公 開.....	75
伍、就本次募集與發行有價證券之適法性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結 論.....	77
一、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款 所列之情事，如有，則應就其事項性質依附表九之一中所列事項詳與評 估對發行人財務狀況之影響及是否影響本次有價證券募集及發行.....	77
二、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條及第八條所列之 情事.....	77
二之一、總括申報發行新股案件者，是否符合「發行人募集與發行有價證券處 理準則」第十九條之一及十九之二所列情事.....	90
三、是否符合中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與 發行有價證券自律規則」規定.....	90
四、法令之遵循及對公司營運影響.....	106

五、說明發行人委請填報其案件檢查表並出具法律意見書之律師，於最近一年內是否曾受法務部律師懲戒委員會懲戒，且是否與發行公司、最近期財務報告簽證會計師及主辦證券承銷商間具有財務會計準則公報第六號規定之關係人關係或其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者 .....	111
<b>陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....</b>	<b>113</b>
一、本次募集與發行有價證券資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益是否具有合理性 .....	113
一之一、總括申報發行新股案件者，應另就下列事項提供評估說明.....	115
二、分析比較各種資金調度來源對發行人當年度每股盈餘稀釋、財務負擔、股權之可能稀釋情形及對現有股東權益之影響。發行人如辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款規定之案件，得僅就發行新股對當年度每股盈餘稀釋情形進行評估 .....	115
三、本次募集與發行有價證券資金計畫如用於轉投資、償債、充實營運資金、購買營建用地、支付營建工程款、購買未完工程並承受賣方未履行契約者，其必要性及合理性 .....	116
三之一、本次增資計畫如非以現金出資時，其出資金額之合理性及取得資產之必要性 .....	122
四、本次增資計畫如併同減資計畫辦理者，應評估其可行性與合理性 .....	122
五、以低於票面金額辦理現金發行新股者，應評估未採用其他籌資方式之原因及其合理性、發行價格訂定方式及對股東權益之影響 .....	122
六、發行人向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報募集與發行有價證券，發行辦法依規定採彈性訂定方式者，應評估事項 .....	122
七、發行人申報發行人民幣債券者，應審慎評估到期償債資金來源計畫之可行性、必要性及合理性 .....	124
<b>陸之一、是否確實依規定於公開說明書揭露推動永續發展相關事項.....</b>	<b>124</b>
<b>柒、就本次附認股權特別股、分離型附認股權特別股分離後之特別股及認股權憑證發行及認股辦法之下列各款之合理性及對原股東及附認股權特別股持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....</b>	<b>124</b>
<b>捌、就本次公司債發行(及轉換)辦法之合理性及對原股東及轉換公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....</b>	<b>124</b>
<b>玖、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債分離後之公司債及認股權憑證發行及認股辦法之合理性及對原股東及附認股權公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....</b>	<b>124</b>
<b>拾、就本次發行公司債債權確保情形(列明有無擔保、擔保品種類與價值等)蒐集資料，說明其查核程序及其實際情形，如為經信用評等機構評等者，取得其相關項目及評等結果.....</b>	<b>124</b>
<b>拾壹、就本次轉換公司債設算理論價值之各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....</b>	<b>124</b>

拾貳、就本次附認股權公司債、分離型認股權公司債射算理論價值之各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....	124
拾參、就發行人其他必要補充說明事項蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論 .	125
拾肆、於公開說明書刊印日期，如有重大期後事項，亦應查明本要點各相關事項並加以更新說明與評估.....	125

## 壹、承銷商總結意見

億而得微電子股份有限公司本次為辦理創新板上市前現金增資發行普通股 2,616 千股，每股面額新台幣壹拾元整，合計發行總金額為新台幣 26,160 千元，依法向臺灣證券交易所股份有限公司提出申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序，包括實地了解億而得微電子股份有限公司之營運狀況，與公司董事、經理人、及其他相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證及比較分析相關資料等，予以審慎評估。特依金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，億而得微電子股份有限公司本次募集與發行有價證券符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

兆豐證券股份有限公司



負責人：陳佩君



承銷部門主管：郝振邦



中華民國 113 年 4 月 24 日

## 貳、評估報告內容摘要

該公司成立於民國 90 年 9 月，為一專業嵌入式非揮發性記憶體矽智財 (Embedded Non-Volatile Memory SIP，以下簡稱 eNVM SIP) 之設計服務供應商，致力於 eNVM SIP 產品之研究開發、功能設計、業務行銷及授權服務。

矽智財 (Silicon Intellectual Property，以下簡稱 SIP) 係積體電路設計當中所涉及之智慧財產，屬半導體產業的上游，其晶片具有特定功能的積體電路設計技術，是可以經過事前設計、定義及驗證重複使用的功能區塊，且有模組化的特性，通常被用來滿足特定的規格，其有效性經過驗證並可重複使用。隨著電子產品「智慧化」需求愈來愈大，舉凡 AI、電動車、物聯網、5G 等都持續推升半導體需求與複雜度，隨著先進製程不斷開發、製程節點保持穩健升級，晶片的設計結構與功能也變得愈來愈複雜，而 SIP 授權將能有效使 IC 設計的過程簡化、減少開發成本及週期，並提升晶片性能，故對於 SIP 的依賴性也愈來愈高。

本承銷商依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定，蒐集發行人所屬行業之產業報導等資料，並了解公司之財務業務狀況，說明其產業概況、發行人之競爭地位及營運風險、最近期及最近二個會計年度募集與發行有價證券籌資效益如下：

### 一、產業概況

#### (一) 產業現況

##### 1. 半導體產業概況



資料來源：WSTS(2023/06)，兆豐證券整理

根據全球半導體貿易統計組織(World Semiconductor Trade Statistics,

WSTS) 112 年 6 月發布之半導體預測報告顯示，由於全球性通貨膨脹等原因，致智慧型手機、PC 需求疲弱，個人消費市場低迷，因此將 112 年全球半導體銷售額預估值自前次(111 年 11 月)預估的年減 4.1%大幅下修至年減 10.3%，為自 109 年以來首度陷入萎縮，全球半導體銷售金額將降至 5,150 億美元，而 113 年則預估將呈現強勁反彈，全球半導體銷售額將達 5,760 億美元，成長 11.8%，有望創下歷史新高紀錄。WSTS 也指出，112 年並非所有半導體需求皆低迷，像是電動車、再生能源等相關用途的需求持續強勁，而需求急劇攀升的生成式 AI 也推升部分邏輯晶片需求。

### 臺灣半導體產業產值概況

億新臺幣	2019	2019 成長率	2020	2020 成長率	2021	2021 成長率	2022	2022 成長率	2023 (e)	2023 (e) 成長率
IC 產業產值	26,656	1.7%	32,222	20.9%	40,820	26.7%	48,370	18.5%	42,496	-12.1%
IC 設計業	6,928	8.0%	8,529	23.1%	12,147	42.4%	12,320	1.4%	10,760	-12.7%
IC 製造業	14,721	-0.9%	18,203	23.7%	22,289	22.4%	29,203	31.0%	26,060	-10.8%
晶圓代工	13,125	2.1%	16,297	2.1%	19,410	19.1%	26,847	38.3%	24,380	-9.2%
記憶體與其他製造	1,596	-20.4%	1,906	19.4%	2,879	51.0%	2,356	-18.2%	1,680	-28.7%
IC 封裝業	3,463	0.5%	3,775	9.0%	4,354	15.3%	4,660	7.0%	3,771	-19.1%
IC 測試業	1,544	4.0%	1,715	11.1%	2,030	18.4%	2,187	7.7%	1,905	-12.9%
IC 產品產值	8,524	1.3%	10,435	22.4%	15,026	44.0%	14,676	-2.3%	12,440	-15.2%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	4,123	-12.0%	4,404	6.8%	5,559	26.2%	5,741	3.3%	5,508	-4.1%

資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2023/05)

依臺灣半導體產業協會預估，就臺灣半導體產業來看，112 年臺灣半導體產業產值為新台幣 4.25 兆元，較 111 年 4.84 兆元衰退約 12.1%，整體而言，半導體景氣最終還是取決於電子終端需求，112 年持續受通膨、升息等負面因素影響，消費市場買氣不佳、拉貨力道疲軟，IC 設計業者面臨客戶砍單、殺價及庫存水位過高的問題，因此調降對晶圓代工廠的投片量或採取延遲出貨措施，晶圓代工廠的產能利用率將逐季下修，而晶圓廠產量下滑、訂單能見度低，也連帶影響 IC 封測業稼動率持續鬆動。若以半導體細項產業表現來說，均陷入衰退走勢，其中記憶體與其他製造業的跌幅最高，產值年減率由 111 年的(18.2)%擴大為(28.7)%，主係 DRAM、Flash 等產品供過於求，造成價格大跳水；而次要跌幅的則是 IC 設計業，產值年增率由 1.4%轉為(12.7)%，主係手機、平板等消費性電子領域的需求表現不佳，影響相關晶片的需求與價格；半導體封測業、晶圓代工業也均呈現由正轉負，其中 111 年大幅成長 38.3%的晶圓代工業，也將轉為(9.2)%，主係二線晶圓代工廠面臨成熟製程的價格戰，代工報價預期有鬆動情況。



儘管市場需求以及全球經濟的週期性變化導致了半導體市場銷售額波動，致使短期內國內外半導體業似乎將陷入衰退局面，然而晶片係構築人類社會數位化轉型的底層基礎，在使世界更智慧、更高效等方面發揮越來越重要的作用，故中長期來說，國內外半導體市場的長期需求仍然是相當強勁，未來成長依舊可知；例如 Apple 革命性的 MR 設備將引領新一輪的全球消費電子創新週期，以及 ChatGPT 帶動 AI 熱潮，預計可順勢拉抬半導體供應鏈題材，或是新能源汽車和智慧化汽車滲透率上升，將進一步提升將對於車用半導體供應鏈的需求。

## 2. 嵌入式非揮發性記憶體 SIP 產業概況

所謂嵌入式非揮發性記憶體(以下簡稱 eNVM)，有別於常見的動態隨機存取記憶體(DRAM)和靜態隨機存取記憶體(SRAM)，eNVM 係指當電流關掉後，所儲存的資料不會消失的資料儲存裝置，其中依記憶體內的資料是否能在使用系統時隨時改寫為標準，又可分為光罩式唯讀記憶體(Mask ROM)、單次寫入唯讀記憶體(One-Time Programming，以下簡稱 OTP)、多次寫入記憶體(Multi-Times Programming，以下簡稱 MTP)及快閃記憶體(Flash)等四種不同性質之記憶體模組，該公司主要產品為以邏輯製程開發之 MTP 為主，OTP 為輔，並提供客戶具備不同記憶體容量、燒寫次數、操作溫度與操作電壓的產品規格，其所發展之 SIP 產品可應用範圍廣泛，諸如電源管理 IC、微控制器 IC、車用 IC 及智慧聯網 AIoT 等應用領域。

根據調研機構 Arsta Research Analysis 於 111 年 7 月出具之報告指出，eNVM SIP 市場產值將從 111 年的 3.1 億美元，成長至 117 年 8.1 億美元之水準，預估年均複合成長率將達到 14.7%，而該公司產品 OTP 及 MTP SIP，其市場產值更將從 111 年的 0.9 億美元，成長至 117 年 2.5 億美元，預估年均複合成長率達到 15.0%，顯示隨著系統單晶片(SoC)的發展，eNVM SIP 的儲存優勢也逐漸顯現，未來成長潛力可觀。

## eNVM SIP 市場規模預測

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
eFlash	162.32	195.23	228.25	269.60	313.06	365.23	419.82
eE2PROM	38.14	46.11	54.28	64.97	74.34	87.45	99.97
eOTP/eMTP	94.30	113.88	133.99	159.74	184.73	217.42	250.98
Others	16.56	20.00	23.36	27.55	31.77	37.43	43.31
Total	311.31	375.22	439.87	521.86	603.90	707.53	814.09

Source: Arsta Research Analysis

資料來源：Arsta Research Analysis(2022/07)

若以各領域應用類別來看，Arsta Research Analysis 預估，eNVM SIP 金額最大市場仍以消費性電子產品為主，由 111 年的 1.3 億美元成長至 117 年的 3.3 億美元。車用領域將成為一匹黑馬，由 111 年約 0.8 億美元的市場成長至 117 年 2 億美元，另外，通訊領域也有顯著成長，由 111 年約 0.4 億美元的市場成長至 117 年 1.1 億美元。

消費性電子產品近年來受到消費性晶片供給過剩而導致的衝擊，加上國際局勢緊張、高通膨等影響，導致經濟成長停滯，市場需求降溫，消費者也將節約支出，限制了消費性電子產品成長。然而儘管手機及個人電腦市場存在短期困境，消費性電子產品仍是各應用類別中最大之市場，在此同時，智慧家庭、智慧生活以及聚焦在健康性質的消費性電子產品將承載著最多的機會，另外在微軟、輝達等公司致力發展 AI 的情況下，可預見人工智慧科技未來將應用於各領域之消費性電子產品，並改變人們的生活模式，消費性電子產業的長期前景仍屬樂觀。

在車用領域中，舉凡螢幕顯示、雨刷及天窗等，都含有電子控制單元(ECU)，根據統計，現在一台汽車上已有上百個 ECU 在其中進行運作，不單是 ECU，其內部組成零件也包含了 MCU、電源元件以及車內通訊電路等，每個晶片都必須各司其職，才能讓汽車內部對指令的溝通與傳輸更加順暢，此外，無論是燃油車或是電動車，現行車款導入先進駕駛輔助系統(ADAS)已成為標準配備，此部分應用都必須仰賴如大腦般的 AI 運算晶片，藉此有效並快速分析資訊，而隨著全球加快推動「綠色低碳發展」及 2050 年淨零碳排目標的確立，無

形中加速了電動車的普及速度，而車用晶片在電動車中的需求大過於傳統汽車，因此電動車銷售成長，晶片需求也跟著增加。

而在通訊領域中，近幾年來歐美國家維持去中化原則，巨額投資新世代高速基礎網路，刺激更多新技術與產品的問市，新一代 5G 網路、Wi-Fi 7 路由器等設備陸續推出，美國更於 112 年 6 月宣布將向全美各州投入 420 億美元經費，用於寬頻網路基礎建設，以便達成高速寬頻網路普及，故未來通訊市場發展可期。

### eNVM SIP 市場應用類別預測

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Consumer Electronics	126.80	152.38	178.41	212.35	246.81	288.81	332.07
Communication	42.74	51.33	60.00	71.60	82.37	97.50	111.61
Automotive	76.83	92.98	109.57	129.63	149.34	174.34	201.49
Home Appliance	29.73	36.06	42.58	50.31	57.85	67.57	77.42
Industrial	21.01	25.21	29.16	34.34	40.04	47.05	54.30
Others	14.20	17.26	20.15	23.64	27.48	32.26	37.20
<b>Total</b>	<b>311.31</b>	<b>375.22</b>	<b>439.87</b>	<b>521.86</b>	<b>603.90</b>	<b>707.53</b>	<b>814.09</b>

Source: Arsta Research Analysis

資料來源：Arsta Research Analysis(2022/07)

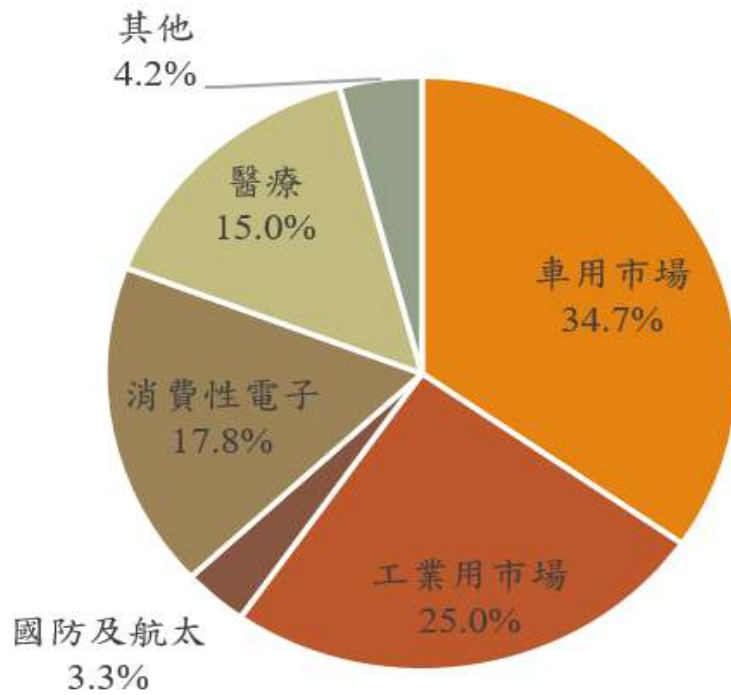
### 3.微控制器產業概況

微控制器為該公司 eNVM SIP 主要應用產品，微控制器 (Microcontroller Unit，以下簡稱 MCU)，係將中央處理器、記憶體、輸入/輸出介面等各式零組件整合在一塊 IC 上，因此 MCU 有「微型電腦」一稱，可以負責做少量、簡單的資料運算與處理，其小體積、低耗能和低成本特性，讓它被廣泛應用在許多不需大量運算應用的設備中，依等級可分 4 位元、8 位元、16 位元與 32 位元，從發展趨勢觀察，4 位元與 16 位元 MCU 晶片使用案例愈來愈少，目前市場上較活躍的是 8 位元及 32 位元 MCU 晶片。使用者在選擇 MCU 單晶片時一般會將系統規模、產品大小、成本、可獲取性、延遲性、RAM 效率、控制及處理能力等因素納入考量。8 位元 MCU 單晶片可執行簡單的邏輯運算，如加、減、乘、除，相較於 32 位元 MCU 單晶片，8 位元儲存空間較小，計算能力較弱，多應用於簡單、小型的系統，優點是可支援老式程式語言；32 位元單晶片具有可獲取性，可應用於

複雜系統，同時具有較佳的控制和處理能力，而且能控制較多模組及設備，以 Cortex-M 架構為例，由於支援 C++ 資料庫，開發人員可以輕鬆地在其中編寫韌體。若以效率而言，8 位元 MCU 單晶片在處理簡單的運算工作時效率較高，32 位元 MCU 單晶片則是在處理複雜度高的運算工作時效率較高。近年來，洗衣機、洗碗機、爐具、電冰箱、空調、微波爐等白色家電逐漸朝物聯網靠攏，智能化需求促使不少產品的內部晶片全面升級，如按鍵式操作鈕轉換為內建觸控螢幕操作模式，這類升級需求加上車用、網通及工控需求，推升 32 位元 MCU 單晶片需求，逐漸成為主流產品。

根據 Global Market Insights 之調查報告指出，MCU 終端應用大致可分為消費性市場及非消費性市場，其中消費性市場應用為消費性電子、醫療及其他，非消費性市場應用則包括車用市場、工業用市場、國防及航太，而全球 MCU 市場又以非消費性應用為大宗，約占總市場 63% 份額。消費性 MCU 由於技術門檻不高，加上中國近年致力推動晶片國產化，祭出了半導體產業相關減稅補助，目前已屬紅海市場，估計未來數年消費性市場將維持低價競爭的情形。而非消費性 MCU 則屬於技術門檻較高的市場，以工業、車用兩大應用為主，由於工控、車用等非消費性 MCU 注重產品的穩定性及客製化，通常客戶採用後會有一定黏著度，不會輕易更換供應商，加上智慧化工廠的建置及 ADAS 持續升級和電動車的電動動力系統發展等因素影響下，使非消費性 MCU 的整體未來展望較消費性 MCU 亮眼許多。

#### MCU 市場應用類別



資料來源：Global Market Insights (2022/07)，兆豐證券整理

## 二、發行人之競爭地位

### (一)未來發展之有利與不利因素

該公司產品主係以嵌入式非揮發性記憶體矽智財(Embedded-Non-Volatile Memory SIP,以下簡稱：eNVM SIP)為主，致力於 eNVM SIP 產品之技術開發、功能設計、市場應用與業務行銷。茲就其未來發展之有利與不利因素說明如下：

#### 1.有利因素

##### (1)矽智財產業已成為半導體供應鏈重要關鍵板塊

近年來由於電子產品外型短小輕薄、功能多樣化等需求，促使晶片設計複雜度日益提高，矽智財產業作為半導體產業鏈的重要關鍵技術，可大幅縮短產品開發時程及加速產品上市週期，有效提升客戶產品競爭力。此項關鍵技術亦將促使未來更多終端客戶快速投入市場，有利矽智財供應商開拓不同應用領域之商機。

##### (2)技術進入門檻高

eNVM SIP 產業為一高技術密集型產業，SIP 設計服務供應商須先具備自主開發基本單元(cell)之能力並取得專利權保護智慧財產，才得以掌握關鍵技術提升與同業之競爭力。eNVM SIP 產品整體開發流程亦相當冗長，從基本單元研發，至 SIP 功能區塊建置完成，SIP 產品還須經過晶圓代工廠、整合元件製造廠驗證成功，

並建置於其製程平台，才得以被客戶採用進行量產，此外，與中游廠商建立緊密之策略夥伴關係，將更有利於產品之開發且順利導入量產流程。由於如此漫長開發過程且高技術之進入門檻，故競爭投入者相對稀少。

### (3)擁有多項 MTP 技術專利及開發經驗

由於 IC 產品功能設計複雜度日趨增加，許多 IC 設計公司開始捨棄只能一次性使用之 OTP SIP 與成本較高的 Flash SIP，改採成本適中且可多次燒寫之 MTP SIP 解決方案。該公司自從進入矽智財產業，即致力於邏輯製程嵌入式 MTP 非揮發性記憶體 SIP 之開發，已累積豐富之 MTP SIP 技術開發經驗，至今已取得數十項國內外相關專利技術，並成功導入合作夥伴之 0.4 $\mu$ m、0.3 $\mu$ m 等直到 90nm 製程技術，因應客戶不同產品之多元化需求，該公司在各大晶圓代工廠建置技術平台，且有許多案件已開發完成並量產出貨，並與 IC 設計公司、晶圓代工廠、整合元件製造廠建立起緊密合作關係。

## 2.不利因素及因應對策

### (1)非揮發性記憶體(NVM) SIP 領域人才尋找不易

矽智財設計產業為典型之知識經濟，隨著 IC 設計產業蓬勃發展，種類繁多之非揮發性記憶體於市場中相繼出現，惟目前在此領域資深且專業之人才難覓，如何培養優秀之研發技術人員及減低人才流失之風險將會是 SIP 設計公司成就與否之關鍵因素，亦為永續經營之必要條件。

#### 因應對策：

- A.計劃性長期培訓公司員工，提供公司內部專業訓練並於半導體專業機構或學校接受教育訓練，透過產學合作學習知識培養專業人才。
- B.申請半導體相關科系畢業之研發替代役學生進行長期培訓。
- C.辦理現金增資供員工認購，使員工成為股東，分享公司成果，藉此吸引員工及留住人才並增強向心力。

### (2)產業前景看好，競爭者推出競品

由於晶片設計複雜度伴隨終端產品新型應用與日俱增，嵌入式 MTP SIP 技術具備可多次編寫之特性及成本競爭優勢，將吸引許多記憶體 SIP 設計服務供應商加快於 MTP SIP 市場開發腳步，進而推出競爭品項，未來矽智財產業之競爭亦將更顯激烈。

### 因應對策：

- A. 考量邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體 SIP 之優劣特性，與基本單元(cell)架構有直接關係，且嵌入式 OTP SIP 開發經驗值並非可直接套用於嵌入式 MTP SIP 上，該公司目前已站穩 MTP SIP 研發經驗及技術領先優勢，未來將持續開發適用各項製程之 MTP SIP 產品，並持續縮小非揮發性元件面積，擴大產品規格領先優勢及應用市場，以滿足客戶需求並區隔競爭市場。
- B. 持續於不同晶圓代工廠、整合元件製造廠建置多樣化技術平台，進而提高嵌入式非揮發性記憶體技術 SIP 在晶圓廠、IC 設計公司及 IC 產品間之滲透率，以挹注業績之成長暨擴大市場占有率。
- C. 架構專業技術服務系統，力求迅速反應客戶多元化需求，提供客戶完整的嵌入式記憶體 SIP 佈局並降低客戶開發成本，提升客戶服務滿意度暨穩固客供關係。
- D. 提高公司知名度，開發國際級客戶使用該公司 SIP 技術。

### 3. 市場占有率

該公司產品主係以嵌入式非揮發性記憶體矽智財(Embedded-Non-Volatile Memory SIP, 以下簡稱：eNVM SIP)為主，致力於 eNVM SIP 產品之技術開發、功能設計、市場應用與業務行銷。

就產業方面而言，若以我國 IC 設計產業作為產值計算基礎，根據工研院 IEK 研究資料統計，2023 年度我國整體 IC 設計產業產值為 1 兆 735 億元，而 2023 年度該公司之營業收入為 187,384 千元，占整體 IC 設計業總產值 0.02%。就產品方面而言，根據 Arsta Research Analysis 研究報告顯示，2022 年全球 eNVM SIP 市場規模為美金 3 億 1,131 萬元，換算該公司在全球 eNVM SIP 市場市占率為 2.35%。

eNVM 產品依其可編程次數多寡，由少至多可概分為光罩式唯讀記憶體(Mask Read-Only Memory；以下簡稱：Mask ROM)、一次可程式(One-Time Programmable，以下簡稱：OTP)、多次可程式(Multi-Times Programmable，以下簡稱：MTP)及快閃記憶體(Flash)等不同性質之記憶體模組。該公司之產品則主要聚焦於 MTP，其雖結合 Flash 高寫入次數及 OTP 低成本之產品優勢，然因終端應用需求及成本考量，致現今記憶體 SIP 市場仍以採用 OTP 產品為大宗，故使得該公司市占率相較同業為低。然該公司現有 MTP 之產品效能及矽智財面積皆已位居業界技

術領先地位，未來將持續增強其 MTP 產品市場競爭力，瞄準家電及車用市場商機，另該公司擬藉由 MTP 領域領先技術切入 OTP 市場，搶攻未來高成長之高壓先進製程之面板驅動 IC 及車用市場。綜上所述，該公司未來將持續優化現有成熟製程技術並積極佈局先進製程，研發高精度之非揮發性元件，另與全球各大晶圓代工廠及 IC 設計公司建立密切合作關係，以挹注業績之成長暨擴大市場占有率，經評估該公司未來仍有相當大之成長空間。

Table Global Embedded NVM(eNVM) SIP Market Share by Companies(2017-2022)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Microchip (微晶片科技)	46.27%	48.06%	47.78%	44.85%	43.47%	40.19%
eMemory(力旺電子)	26.65%	24.27%	21.49%	23.87%	26.15%	26.87%
Synopsys(新思科技)	19.19%	18.38%	20.10%	19.49%	18.52%	20.41%
Yield Microelectronics Corp.(億而得微電子)	2.25%	2.50%	2.62%	2.22%	2.40%	2.35%
NSCore,Inc.	0.49%	0.57%	0.68%	0.62%	0.61%	0.59%
Chengdu Analog Circuit Technology Inc.(成都模擬電路技術)	0.01%	0.05%	0.22%	0.82%	0.44%	0.97%
Others	5.13%	6.18%	7.11%	8.12%	8.41%	8.60%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Source:Astra Research Analysis (2022/2)

## (二)公司競爭利基

### 1.市場先行者優勢

eNVM SIP 市場包含種類多樣之記憶體元件，其中，該公司成立初期選擇以高門檻、技術含量高之 MTP SIP 作為進入矽智財設計產業之發展主軸，惟早期由於此技術仍處開發中階段，MTP 之面積仍較 OTP 為大，且因其製程所需光罩次數較多而不具備產品成本優勢，故此技術方向在業界尚未被廣泛接受。然該公司憑藉在 MTP SIP 領域累積逾 20 年之技術開發經驗，已搶先取得多項 MTP SIP 專利技術。隨著 IC 產品生命週期縮短、晶片設計複雜度日益提升，需搭載 MTP SIP 使用之晶片需求逐漸成長，該公司藉由營運策略提前佈局，現已成為業界少數擁有 MTP SIP 之技術領導公司，成為市場競爭之一大利基。

### 2.獨特專利技術

近幾年 IC 產業在 AI 高效能運算潮流帶動下，全球 IC 業者對於先進製程之需求逐漸成長，以致晶片整合度之提升及對終端產品輕、薄、短、小之需求，逐漸成為 IC 技術發展主流趨勢。該公司藉由採用其自行研發 1 電晶體 1 電容 (1 Transistor, 1 Capacitor, 以下簡稱：1T1C) 之



存儲單元專利技術，成功開發出極具小面積優勢之記憶體細胞，將此獨特專利技術套用於該公司之 MTP SIP，在非特殊製程及無內建升壓電路之情況下，可將 64kb(千位元)容量之 MTP SIP 面積縮小至 0.12mm<sup>2</sup>(平方毫米)，其面積已小於競爭者在相同容量及類似製程所推出之 OTP SIP(面積約為 0.169mm<sup>2</sup>)，並已進入製程量產階段。藉由低成本、小面積又可多次燒寫之產品優勢，除了進一步提升市場競爭力，亦可擴大產品適用範圍，提升市占率。

### 三、營運風險

#### (一)行業營運風險

##### 1.景氣循環

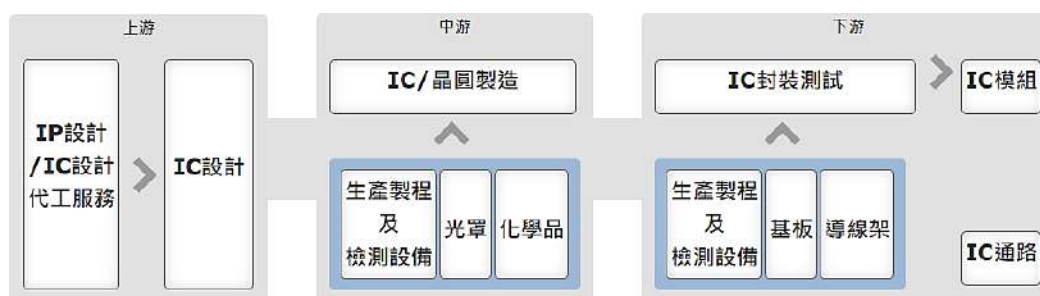
該公司主要產品係以 eNVM SIP 之授權及設計服務，其主要客戶為全球各大半導體廠商及 IC 設計公司，客戶群遍及臺灣、美國、中國、日本及韓國等地區，如同一般 IC 設計產業所面臨之共同風險，其營運仍會受整體半導體市場景氣之波動及下游終端產品之產業景氣而產生影響，然因該公司客戶端之應用涵蓋範圍相當廣泛，下游應用以微控制器、電源管理 IC、物聯網、中小尺寸面板驅動 IC 為主，終端應用產品則包含資訊設備、車用電子、智慧家電、通訊及消費性電子，皆屬於該公司產品可應用範圍，因此該公司營運上無明顯因特定產業波動之現象，較不易受特定需求循環或季節性需求影響。

##### 2.行業上中下游變化

該公司係屬於半導體業上游之 SIP 設計服務公司，屬於高知識密集產業，主要業務為自行研發設計 SIP 模組架構並授權下游客戶，或接受客戶委託開發產品等設計服務，而 SIP 為 IC 設計的智慧財產權，SIP 開發流程包含 SIP 設計與 SIP 驗證，在 IC 設計中，SIP 核心再利用可以有效縮短產品開發週期並降低成本，現今 IC 設計大幅增加了許多功能，因此必須運用既有的驗證有效 SIP 元件，以滿足上市前置時間的要求。

當 IC 設計產品完成設計開發後，再委託中游之 IC 製造公司，即專業晶圓代工廠，以自身擁有之複雜製程技術與精密機器設備，同時搭配 SIP 設計公司提供特定性能之 SIP，方能協助 IC 設計公司將其所設計之電路生產製造成 IC 晶片，最後送至下游之 IC 封裝及測試廠，將製造完成之晶圓半成品先經專業封裝廠完成切割及封裝，後由專業測試廠進行晶圓電路測試，而完成測試之 IC 成品最終售予各系統廠商，各系統廠商再裝配生產成各式應用之系統產品，因此半導體產業

每一生產環節皆有專門技術之個別廠商投入，形成設計、製造、封裝、測試垂直整合一條龍之產業鏈，使半導體業上中下游均具有高度專業水平分工體系，茲將 IC 產業上、中、下游產業關聯圖列示如下：



資料來源：台灣證券交易所-產業價值鏈資訊平台

### 3. 行業未來發展

#### (1) 嵌入式系統晶片應用多元化

隨著科技不斷進步，新電子產品不斷推陳出新，消費性產品不僅要求輕薄短小，更要提高其效能，使得晶片的設計也朝高效能、小面積發展，採用嵌入式系統晶片設計成為縮小面積並提高效能的最佳方案，舉凡日常生活用的智能家電、穿戴裝置到工業應用的物聯網、車聯網等各種電子裝置，均屬於嵌入式系統應用的範疇，也因此嵌入式晶片已成為晶片設計業者的兵家必爭之地。然而隨著嵌入式晶片設計的複雜度提高，相關的驗證工序也變得繁瑣與複雜，該公司憑藉其於 eNVM SIP 深耕多年之經驗及技術，可針對客戶產品所需之記憶體提供多元化解決方案，並縮短產品驗證時間，滿足客戶降低成本及提高產品價值與競爭力之需求。

#### (2) 與晶圓代工廠策略結盟發展先進製程

SIP 公司發展與晶圓代工廠息息相關，SIP 開發對於先進製程的需求越來越高，不僅需晶圓代工廠提供驗證方面之協助，若成功開發新產品後，也需要委由擁有先進製程及高良率之晶圓代工廠投片量產，故與晶圓代工廠保持密切合作關係不僅能加強研發能力並提高設計效率，還能建構更完整之製程技術平台，提供客戶多元化的產品線，並藉由晶圓代工廠的推廣，帶來更多新客戶，使權利金收入進一步的成長，創造雙贏的局面。該公司除了與原合作夥伴加強其製程技術，發展高速多次寫入、減少光罩層數及低電壓低電流寫入讀取之 eNVM，也拓展不同地區晶圓廠與之合作，不僅加強自身產品的深度及廣度，更能提供客戶多元化製程技術平台選擇。

### (3)具備 AI 應用潛力

隨著 AI 技術的發展，智慧化的需求開始湧現在各個產品應用，對運算效能的需求也倍速增加，其所使用的記憶體將比以往更加吃重，除了儲存所擷取的資訊外，也需要大量儲存空間用以學習演算法、演算結果及大數據分析等，因此除了具備足夠的記憶體儲存容量外，長期讀寫的可靠度、高速讀寫的能力、在不同環境下仍具備穩定的性能，未來將尋求效能更好的記憶體解決方案，以達成 AI 的需求。而目前新一代的嵌入式記憶體技術與次世代非揮發性記憶體的結合，已成為主要半導體業者研發重點，如 RRAM、MRAM 及 FRAM 等，除具有上述特性，並可以滿足龐大運算需求，帶動前瞻記憶體研發能量。

### 4. 產品可替代性

該公司主要經營授權 eNVM SIP 及提供相關技術服務，相較於外掛式的記憶體，eNVM 具有低成本、低功耗及易於整合等優勢，目前已大量用於電子產品，尤其可攜帶性產品之中。而該公司主力產品 MTP 在 eNVM 中結合了 OTP 的低製造成本及 Flash 的高效能等特點，並能根據客戶要求之容量、寫入次數和導入成本等，量身打造最適之 MTP 產品，對於需要多次程式編寫之晶片提供完美解決方案。採用 MTP 產品不僅不需特殊元件便能進行開發，建置週期較短，且與採用多個 OTP 組成之產品價格相當，其面積更能大幅縮小。近年來隨著物聯網的應用持續普及和電動車需求的持續增加，MCU 使用 eNVM 的需求也持續增加，MTP 技術已被市場廣泛認可和應用。綜上所述，MTP 結合 Flash 寫入次數較高及 OTP 成本較低之兩大優點，短期間難有新產品可替代，故整體而言，不論就該公司產品本身或終端應用發展上觀察，該公司所屬產業短期內尚無明顯之替代風險。

## (二)業務之營運風險

### 1.市場未來供需變化情形

#### (1)供給面

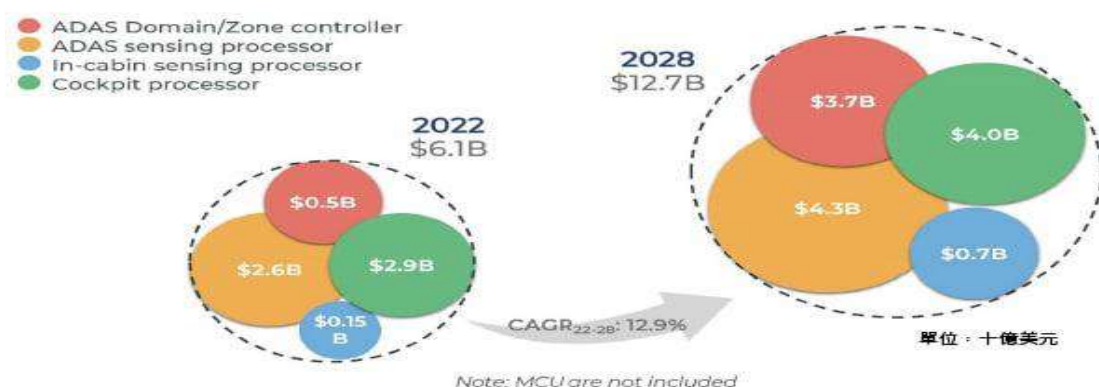
半導體產業為一高技術密集型產業，專業化之產業供應鏈使得產業上、中、下游廠商彼此分工且關係緊密，該公司位於供應鏈最上游之矽智財設計服務產業，除了專業領域人才之培育外，下游晶圓廠產能對於市場供給面亦有重要之影響力，近年來全球半導體市場隨著疫後宅經濟效應消退及高通膨經濟環境影響，使得消費性

電子市場需求疲軟，且在疫情期間因晶片短缺促使半導體供應商擴充產能之情況下，進而造成 2023 年上半年各類晶片處於供過於求之情事，連帶使得晶圓代工廠產能利用率逐步衰退，惟考量半導體仍是市場剛性需求，未來隨著終端市場庫存去化調整，加上在 AI、物聯網及車用電子等利基型應用不斷推陳出新，預計仍將帶動晶圓產能利用率逐步回升。

## (2) 需求面

近年來 5G、AI、車用電子等新興應用逐步浮現，全球 IC 業者對於矽智財元件在各式製程上之需求逐漸受到重視。以該公司矽智財產品應用面觀察未來市場需求，隨著 5G、AI、物聯網時代來臨，持續催生各類網通、穿戴式裝置及智能家電等應用商機，且在中國政府頒布「十四五」政策之推波助瀾下，加快既有住宅設施數位化及新建社區增設智慧系統，預期中國消費性電子內需市場將持續擴大；在車用電子市場方面，伴隨電動車及自駕車市場滲透率逐漸提升，先進駕駛輔助系統(ADAS)與智慧座艙(Cockpit)兩類應用所使用之車用處理器市場需求，預期將出現可觀之成長，根據研究機構 Yole Group 最新發表之報告指出，2022~2028 年間 ADAS 處理器之年複合成長率將達到 18%，Cockpit 處理器之年複合成長率則有 5%。綜上所述，預期未來在智慧應用、車用電子及穿戴式裝置等利基應用持續擴張，將帶動相關應用晶片及矽智財需求持續成長。

### 2022~2028年汽車ADAS與座艙處理器市場規模預估



資料來源：Yole Group(3/2023)

## (三) 技術能力、研發及專利權之營運風險

### 1. 取得技術專家之評估意見佐證

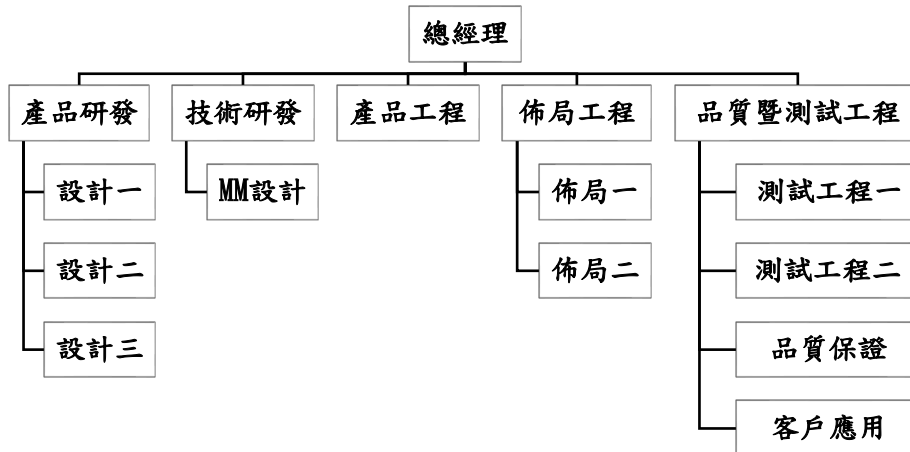
本證券承銷商與該公司並未委請技術專家就該公司之技術研發

能力出具意見或報告，故不適用。

2. 研究發展部門之沿革、組織、人員、學經歷、研究成果及未來計畫等資料，以了解主要技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額，暨研發工作未來發展方向，並分析研發部門人員之人數、平均年資、流動情形及離職率等資料，評估研發人員離職對申請公司之營運風險。

(1)研發部門之沿革及組織

該公司係專業矽智財開發商，自民國 90 年成立以來積極建構堅實的研發技術與服務團隊，網羅來自國內、外產業界具有豐富實務經驗之人才，專注於邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體 SIP 開發與銷售領域。該公司為因應客戶需求多元化發展，研發出多樣化之創新矽智財，以協助客戶縮短產品設計週期、降低製造成本、提升產品競爭力並搶占市場先機為目標，因此相當重視公司研發設計能力之建置及培植。112 年度，該公司研發人員共計 46 人，其研發組織圖及各研發單位之職掌概述如下：



研發單位		工作內容
產品研發	設計一	1.產品之技術開發與設計。 2.整合公司資源，持續改進產品的性能及品質。 3.協助客戶解決應用上問題。 4.產品規格書製作。 5.產品設計套件製作。
	設計二	
	設計三	
技術研發	單晶微波電路(MM)設計	1.無線射頻之發射接收類比產品研究開發。 2.數位產品的研究開發。
產品工程處		1.產品規格擬定。 2.產品製作流程安排。 3.產品特性驗證分析。 4.產品特性改善建議。 5.協助客戶使用產品。 6.製程平台溝通窗口。

佈局工程	佈局一	1.產品之電路佈局設計。 2.協助客戶佈局嵌入合併驗證。
	佈局二	
品質暨設計工程處	測試工程一	1.開發/維護產品相關之測試程式，使其能提供產品除錯/驗證工程之作業。 2.提昇測試程式之偵錯能力，確保產品驗證之完整性，解決產品驗證相關之技術問題。 3.提供產品測試驗證結果相關資料。 4.提供產品相關量產測試流程。
	測試工程二	
	品質保證	1.提昇驗證效率，節省測試時間。 2.驗證完整產品特性，確認其結果是否符合規格。 3.協助產品晶圓晶粒挑揀及封裝收送貨事宜。 4.提供產品完整特性驗證結果報告。 5.不良原因的分析制度建立與執行。 6.產品可靠度測試與失效分析。 7.實驗室儀器校正管理。 8.協助提供客戶產品相關可靠度問題。 9.提供產品可靠度驗證結果報告。 10.撰寫維護高溫工作壽命相關測試程式。
	客戶應用	1.處理並回應客戶之應用問題。 2.客戶故障產品之分析。 3.產品應用狀況之掌握與回覆。 4.提供故障分析報告。

資料來源：該公司提供。

(2)最近期及最近二個會計年度研發部門人員之人數、平均年資、學經歷、流動情形及離職率

單位：人；年；%

項目		年度	111 年度	112 年度	113 年 2 月 29 日
員工人數	期初人數		45	47	46
	新進人數		7	2	1
	離職人員		5	3	—
	資遣及退休人數		—	—	—
	期末人數		47	46	47
平均服務年資(年)			6.4	7	7
離職率(%)			9.62	6.12%	0%
學歷分佈	博士		—	—	—
	碩士		22	21	22
	大學(專)		25	25	25
	高中/高職		—	—	—

資料來源：該公司提供。

註：離職率=本期離職人數/(本期期末人數+本期離職人數、資遣及退休人員)

該公司最近二年度及 113 年截至 2 月 29 日止，研發部門人數分別為 47 人、46 人及 47 人，所聘任人員以大學(專)及碩士以上學歷為主，顯示該公司相當重視研發人員素質。該公司 111~112 年度

及 113 年截至 2 月底研發部門離職率分別為 9.62%、6.12%及 0%，離職員工主係因其個人生涯規劃或家庭因素等而離職，未有研發人員集體離職之情形。該公司已訂定相關研發循環及資通安全管控辦法，嚴格控管及歸檔於研發過程之書面及電子檔紀錄並列為機密文件，此外，該公司與研發人員皆有簽署保密合約，以確保公司之智慧財產權，離職員工皆依公司規定完成工作交接，以避免人員流動所造成研發中斷之風險。整體而言，研發人員之流動對於該公司之研發部門運作及公司營運尚不致產生重大之影響。

(3)111~112 年度研發費用占營業收入之情形

單位：新台幣千元；%

項目 \ 年度	111 年度	112 年度
研發費用	107,830	108,127
營業收入淨額	229,420	187,384
研發費用/營業收入淨額(%)	47.00	57.70

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告。

該公司 111~112 年度研發費用分別為 107,830 千元及 108,127 千元，占營收比重為 47.00%及 57.70%。該公司研發費用主要投入於產品之開發上，性質主係研發人員薪資費用及研發設備所需攤提之各項費用。111~112 年度之研發費用占營業收入淨額比重上升，主係因 112 年度持續受到全球高通膨經濟環境之影響，導致終端消費性電子市場需求疲弱，使得 112 年度之權利金收入相較 111 年度下滑，惟該公司為持續維持一定之研發量能，故 112 年度之研發費用相較 111 年度差異微小，進而使得 112 年度研發費用占營業收入淨額比重相較去年同期上升。

該公司自成立以來，即積極從事新技術之開發與創新，持續擴編研發團隊並延攬產業優秀人才，且為精進整體研發實力亦持續投入相關研發經費，使研發費用呈逐年成長之趨勢。綜上所述，該公司研發費用及其占營收淨額比重之變動情形尚屬合理，尚無重大異常情事。

(4)重要研發成果

年度	開發技術或產品名稱	研發成果說明
109	Gen3 MTP 電源管理應用技術在 180 奈米 BCD 製程完成開發並導入量產，提供電源管理應用。	億而得所開發之 Gen3 cell 較 Gen2 cell 縮減約 30%

年度	開發技術或產品名稱	研發成果說明
	Gen3 FTP 技術在 110 奈米高壓製程完成開發並導入量產，提供電子紙應用。(原 OTP 應用市場)	面積，加上 FTP SIP 及 MTP SIP 相較 eFlash SIP 所需之製程層數更少，故在中高容量 (128kb~512kb) 記憶體 SIP 市場中更具成本優勢。
	Gen3 MTP 技術在 110 奈米邏輯製程完成開發並導入量產，提供微處理器應用。	
	Gen3 MTP 技術在 65 奈米 BCD 製程完成開發並導入量產，提供微處理器應用。	
110	Gen3 FTP 指紋 IC 應用技術在 180 奈米邏輯製程完成開發並導入量產。(原 OTP 應用市場)	Gen3 cell 已能逐漸取代部分 OTP 應用市場，搭配有著可多次編寫之優點特性，在少量多樣之應用市場，具產品推廣及驗證之方便性。
	Gen3 MTP 技術在 110 奈米高壓製程完成開發並導入量產，提供車用市場應用。	
	Gen2 FTP 技術在 90 奈米高壓製程完成開發並導入量產，提供平板、手機應用。(原 OTP 應用市場)	
	反熔絲 Gen1 OTP cell 取得美國專利。	
111	Gen5 FTP 技術在 180 奈米邏輯製程完成開發並導入量產，提供微處理器應用。	億而得開發之 Gen5 cell 成功將記憶體 SIP 面積相較 Gen3 cell 縮小約 30%，面積已幾乎相近於 OTP，成本相近且具備產品推廣及驗證方便性，使產品受到更多應用市場採用。此外，當年度推出 Gen1 Trim SIP 可多次寫入亦吸引客戶使用，客戶可以在封裝後修改設定，增加產品賣點。
	Gen1 Trim SIP 在 180 奈米 BCD 製程完成開發並導入量產，提供電源管理應用。	
	Gen5 FTP 技術在 110 奈米及 150 奈米邏輯製程完成開發並導入量產，提供微處理器應用。	
112	Gen2 OTP SIP 在 180 奈米邏輯製程完成開發。	Gen5 cell 除了在微處理器應用已



年度	開發技術或產品名稱	研發成果說明
	Gen5 FTP 技術在 90 奈米 BCD 製程完成開發並導入量產，提供電源管理應用。	開始量產，亦開始導入在電源管理之應用，鑒於面積有絕對之優勢因此市場反應良好
	Gen3 FTP 在 90 奈米高壓製程完成開發，提供電子紙應用(原 OTP 應用市場)	

資料來源：該公司提供。

#### (5)技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額

該公司自投入嵌入式記憶體矽智財之設計以來，即不斷從事研發工作，並積極培育研發人才，其主要技術來源係來自該公司研發部門自行開發，惟為持續強化研發能力及拓展產品應用範圍，該公司部分技術係以支付授權金方式取得，其技術授權合約主要內容如下表所示：

合作對象	契約名稱	契約期間	內容摘要	技術報酬金或權利金
晶隼科技股份有限公司	專利專屬授權契約書	108.01.21 ~各該專利期間屆滿為止	特定專利授權	依契約分期支付金
國立中央大學	產學合作開發暨授權契約書	112.02.01~113.01.31	基於先進半導體製程技術之 1T4R 陣列式記憶體設計	依契約分期支付金

資料來源：該公司提供。

#### (6)未來研發計畫暨研發工作未來發展方向

嵌入式非揮發性記憶體 SIP 市場在未來幾年仍將持續蓬勃發展，該公司研發團隊以研發創新為主軸，持續提昇研發技術能力並設計出可滿足客戶需求之嵌入式非揮發性記憶體 SIP 技術，並擴大應用市場。茲就該公司短、長期未來之研發方向列示如下：

##### A.短期研發計畫

- ① 因應產品多元化需求，研發各式應用領域矽智財，如微控制 IC、功率 IC、觸控 IC 應用，建置更完整的 MTP SIP 資料庫解決方案，提供即時且更完善的客戶服務。

- ② 與韓國、日本、大陸晶圓代工廠、整合元件製造廠簽署合作契約，並提供給客戶更多製程平台技術作選擇，建立該公司、IC 設計公司及晶圓廠三方穩固策略夥伴關係，進而提升市場競爭力。
- ③ 開發先進製程所需非揮發性記憶體元件，透過產學、客戶合作以及招募高階技術相關人才，以加速研發速度及增加研發機會，與策略夥伴合作開發 55、40 奈米先進製程技術，並以持續縮小非揮發性記憶體元件面積為目標，擴大利基應用範圍。
- ④ 持續研發改進高階 SIP 之設計方法與流程，以降低成本和縮短產品上市時程為目標。

#### B.長期研發計畫

- ① 因應產品多樣化需求，持續研發新型記憶體技術，如 55、40 奈米以下先進製程技術元件開發，應用如通訊類相關產品。
- ② 專攻於智慧電力市場商機，持續精進研發旗下擁有面積小、低功耗、高效能同時具備成本競爭力之 MTP SIP，可廣泛支援物聯網、手機屏控、手機屏驅動、微控制器及感應器應用市場。
- ③ 藉由關鍵 SIP 的開發與佈局，包含單次(OTP)、多次(MTP)可程式非揮發性記憶體矽智財，建立完整的 SIP 平台，依產品應用需求，提供更具彈性的 OTP 與 MTP 整合方案，並架設公司產品專利保護網，確保該公司 SIP 在市場上的競爭優勢。

#### 3.重要技術合作契約對該公司營運之風險

經評估上述簽訂之技術授權合約對該公司有強化技術能力及發展產生應用範疇效益，故對該公司營運應有正面幫助，經檢視其契約內容並未有重大不利限制條款，故對該公司營運應尚無不利之影響。

#### 4. 目前已登記或取得專利權、商標權及著作權之情形，有無涉及違反專利權、商標權及著作權之情事，暨因應措施是否合理有效

截至評估報告出具日為止，該公司並無涉及違反專利權、商標權及著作權之情事，茲將該公司之專利權、商標權及著作權列示如下：

## (1)專利權

### ① 已取得

專利名稱	專利證號碼	註冊國家	申請日期	類型	有效期間 (起~迄)	
非揮發性記憶體及其操作方法	I231039	中華民國	2005/4/11	發明	2005/4/11	2024/4/29
單閘極之非揮發性記憶體的抹除方法	I281163	中華民國	2005/9/9	發明	2007/5/11	2025/9/8
單閘極之非揮發性記憶體及其操作方法	I319189	中華民國	2006/3/17	發明	2010/1/1	2026/3/16
低干擾性之單閘極非揮發性記憶體及其操作方法	I307161	中華民國	2006/7/11	發明	2009/3/1	2026/7/10
參考電壓產生裝置	I359343	中華民國	2008/02/13	發明	2012/3/1	2028/2/12
非揮發性記憶體的低壓快速抹除方法	I419166	中華民國	2010/01/08	發明	2013/12/11	2030/1/7
低電壓操作之電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列	I440034	中華民國	2010/07/16	發明	2014/6/1	2030/7/15
低成本電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列	I449045	中華民國	2010/07/16	發明	2014/8/11	2030/7/15
小面積電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列	I415251	中華民國	2010/07/30	發明	2013/11/11	2030/7/29
單閘源極共線之非揮發性記憶體及其操作方法	I559506	中華民國	2014/06/10	發明	2016/11/21	2034/6/9
低成本電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	I533310	中華民國	2014/11/21	發明	2016/5/11	2034/11/20
小面積電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	I530955	中華民國	2014/11/25	發明	2016/4/21	2034/11/24
降低電壓差之電子寫入抹除式可複寫唯讀記憶體及其操作方法	I563508	中華民國	2015/04/14	發明	2016/12/21	2035/4/13
單閘極多次寫入非揮發性記憶體的操作方法	I624034	中華民國	2016/11/21	發明	2018/5/11	2036/11/20
低電壓差之電子寫入抹除式可複寫唯讀記憶體及其操作方法	I640084	中華民國	2017/08/16	發明	2018/11/1	2037/8/15
單閘極之非揮發性記憶體的抹除方法	I635496	中華民國	2017/10/12	發明	2018/9/11	2037/10/11
低電流電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	I653631	中華民國	2018/08/17	發明	2019/3/11	2038/8/16
電子寫入抹除式可複寫唯讀記憶體的低壓快速抹除方法	I695489	中華民國	2019/03/07	發明	2020/6/1	2039/3/6
低電流電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的快速抹除方法	I678700	中華民國	2019/03/07	發明	2019/12/1	2039/3/6
單閘極多次寫入非揮發	I690061	中華民國	2019/04/02	發明	2020/4/1	2039/4/1

專利名稱	專利證號碼	註冊國家	申請日期	類型	有效期間 (起~迄)	
性記憶體及其操作方法						
單閘極多次寫入非揮發性記憶體陣列及其操作方法	I707344	中華民國	2019/10/08	發明	2020/10/11	2039/10/7
低電流電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	I693602	中華民國	2019/11/13	發明	2020/5/11	2039/11/12
電子寫入抹除式可複寫唯讀記憶體的操作方法	I710113	中華民國	2019/11/29	發明	2020/11/11	2039/11/28
低電壓反熔絲元件	I718861	中華民國	2020/02/04	發明	2021/2/11	2040/2/3
小面積低電壓反熔絲元件與陣列	I747528	中華民國	2020/09/28	發明	2021/11/21	2040/9/27
低成本低電壓反熔絲陣列	I744130	中華民國	2020/12/09	發明	2021/10/21	2040/12/8
高寫入效率的反熔絲陣列	I769095	中華民國	2021/10/08	發明	2022/6/21	2041/01/07
小面積側邊電容唯讀記憶體元件及其陣列與操作方法	I805189	中華民國	2022/01/14	發明	2023/6/11	2042/1/13
非揮發性記憶體及其操作方法	US7,099,192B2	美國	2004/06/07	發明	2004/6/7	2024/6/7
單閘極之非揮發性記憶體及其操作方法	US7,423,903B2	美國	2006/04/14	發明	2006/4/14	2026/12/23
非揮發性記憶體的低壓快速抹除方法	US8,218,369B2	美國	2010/01/25	發明	2010/1/25	2031/1/8
低成本電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列	US8,300,469B2	美國	2010/08/11	發明	2010/8/11	2031/12/9
低電壓操作之電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列	US8,305,808B2	美國	2010/08/12	發明	2010/8/12	2031/1/28
小面積電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列	US8,300,461B2	美國	2010/08/24	發明	2010/8/24	2024/4/30
單閘源極共線之非揮發性記憶體及其操作方法	US9,281,312B2	美國	2014/07/08	發明	2014/7/8	2034/8/7
低成本電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	US9,240,242B1	美國	2014/12/10	發明	2014/12/10	2034/12/10
小面積電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	US9,318,208B1	美國	2014/12/17	發明	2014/12/17	2034/12/17
降低電壓差之電子寫入抹除式可複寫唯讀記憶體及其操作方法	US9,601,202B2	美國	2016/09/08	發明	2016/9/8	2036/9/8
低電壓差之電子寫入抹除式可複寫唯讀記憶體及其操作方法	US10,242,741B1	美國	2017/09/19	發明	2017/9/19	2037/11/17
單閘極之非揮發性記憶體的抹除方法	US10,141,057B1	美國	2017/11/21	發明	2017/11/21	2037/11/21
低電流電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	US10,643,708B1	美國	2018/10/12	發明	2018/10/12	2038/10/12

專利名稱	專利證號碼	註冊國家	申請日期	類型	有效期間 (起~迄)	
低電流電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的快速抹除方法	US10,685,716B 1	美國	2019/04/11	發明	2019/4/11	2039/4/11
電子寫入抹除式可複寫唯讀記憶體的操作方法	US11,004,857B 1	美國	2020/01/21	發明	2020/1/21	2040/2/2
低電流電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	US10,854,297B 1	美國	2020/01/10	發明	2020/1/10	2040/1/10
低電壓反熔絲元件	US11,380,694B 2	美國	2020/03/04	發明	2020/3/4	2040/7/25
小面積低電壓反熔絲元件與陣列	US11,424,252B 2	美國	2020/10/29	發明	2020/11/23	2041/1/30
低成本低電壓反熔絲陣列	US11,502,090B 2	美國	2021/02/05	發明	2021/2/5	2041/7/24
小面積側邊電容唯讀記憶體元件及其陣列與操作方法	US11,742,039B 2	美國	2022/03/18	發明	2022/3/18	2042/4/2
單閘極的非揮發性內存及其操作方法	514050	中國大陸	2006/04/03	發明	2006/4/3	2026/4/2
低成本電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列	1270240	中國大陸	2010/08/05	發明	2013/9/11	2030/8/4
小面積電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列	1249787	中國大陸	2010/08/11	發明	2013/8/7	2033/8/10
低成本電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	3511238	中國大陸	2014/11/25	發明	2019/8/30	2034/11/24
小面積電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	3510467	中國大陸	2014/12/09	發明	2019/8/30	2034/12/8
降低電壓差的EEPROM及其操作方法(原：降低電壓差之電子寫入抹除式可複寫唯讀記憶體及其操作方法)	3510507	中國大陸	2015/04/15	發明	2019/8/30	2035/4/14
單閘極多次寫入非揮發性記憶體的操作方法	3690474	中國大陸	2016/11/29	發明	2020/2/14	2036/11/28
低電壓差的電子寫入抹除式可複寫唯讀記憶體及操作方法	3948652	中國大陸	2017/08/25	發明	2020/8/21	2037/8/24
低電流電子抹除式可複寫唯讀記憶體陣列的操作方法	4615038	中國大陸	2018/09/06	發明	2021/8/13	2038/9/5

資料來源：該公司提供。

## ② 申請中

專利名稱	專利申請號碼	註冊國家	申請日期	類型
單閘極多次寫入非揮發性記憶體陣列及其操作方法	201911024481.9	中國大陸	2019/10/25	發明
低電流電子抹除式可複寫唯	201911214012.3	中國大陸	2019/12/2	發明

讀記憶體陣列的操作方法				
帶電可擦除可程式設計唯讀記憶體的操作方法	201911415784.3	中國大陸	2019/12/31	發明
低電壓反熔絲元件	202010086112.9	中國大陸	2020/2/11	發明
小面積低電壓反熔絲元件與陣列	202011178949.2	中國大陸	2020/10/29	發明
低成本低電壓反熔絲陣列	202011528284.3	中國大陸	2020/12/22	發明
高寫入效率的反熔絲陣列	202111229153.X	中國大陸	2021/10/21	發明
高寫入效率的反熔絲陣列	17/455,546	美國	2021/11/18	發明
小面積側邊電容只讀存儲器元件及其陣列與操作方法	202210187660.X	中國大陸	2022/2/28	發明
小面積高效率唯讀記憶體陣列及其操作方法	112103524	中華民國	2023/2/1	發明
小面積高效率只讀存儲器陣列及其操作方法	202310101501.8	中國大陸	2023/2/10	發明
小面積高效率唯讀記憶體陣列及其操作方法	18/186,278	美國	2023/3/20	發明
小面積共電壓反熔絲陣列	112125175.0	中華民國	2023/7/6	發明
小面積共電壓反熔絲陣列	202310916231.6	中國	2023/7/25	發明
小面積共電壓反熔絲陣列	18/480,743	美國	2023/10/4	發明
小面積共電壓多次寫入非揮發性記憶體陣列	112125174.0	中華民國	2023/7/6	發明
小面積共電壓多次寫入非揮發性記憶體陣列	202310916560.0	中國	2023/7/25	發明
小面積共電壓多次寫入非揮發性記憶體陣列	18/480,722	美國	2023/10/4	發明
高速高寫入次數唯讀記憶體陣列	112133603	中華民國	2023/9/5	發明
高速高寫入次數唯讀記憶體陣列	202311294061.9	中國	2023/10/9	發明
多次寫入唯讀記憶體陣列	112137822	中華民國	2023/10/3	發明
多次寫入唯讀記憶體陣列	202311484705.0	中國	2023/11/9	發明
高速高寫入次數唯讀記憶體陣列	18/519,320	美國	2023/11/27	發明
多次寫入唯讀記憶體陣列	18/529,115	美國	2023/12/5	發明
多次寫入唯讀記憶體陣列及其唯讀記憶體	112149187	中華民國	2023/12/18	發明
多次寫入唯讀記憶體陣列及其唯讀記憶體	202410004035.6	中國	2024/1/3	發明

資料來源：該公司提供。

## (2)商標權

商標名稱	商標註冊號數	註冊國家	有效期間	
			(起~迄)	
億而得微電子股份有限公司標章圖	01026524	中華民國	2012/12/16	2032/12/15
yntp	01704649	中華民國	2015/5/1	2025/4/30
yntp	01711125	中華民國	2015/6/1	2025/5/31
ymc 及標章圖	02163559	中華民國	2021/8/16	2031/8/15

資料來源：該公司提供。

## (3)著作權：無。

5. 以科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市者，應說明其產品生產開發技術之層次、來源、確保與提升，暨現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究開發計畫、預計生產時程及成本、市場定位、需求及未來營收效益預測達成可能性及研究發展之內部控制暨保全措施

該公司非以科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市，故不適用此評估事項。

6. 以科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市者，其參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東，以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷、持股比例、最近三個會計年度及申請年度內股權轉移變化暨該技術股東與經理人實際投入經營之時間與情形等，並評估該等人員未來若未能繼續參與經營對發行公司財務業務之影響，及其因應措施

該公司非以科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市，故不適用。

7. 以科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市者，取得參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東，以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷、持股比例、最近三個會計年度及申請年度內股權轉移變化暨該技術股東與經理人實際投入經營之時間與情形等，並評估該等人員未來若未能繼續參與經營對發行公司財務業務之影響，及其因應措施

該公司非以科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市，

故不適用。

8. 以創新版上市者，就其創新特點及營運模式，因重大技術、產品、政策、經營模式變化等可能導致之風險暨所採行之因應措施

(1) 關鍵核心技術：

A. 獨特專利之 1T1C 核心技術

相較於其他記憶體 SIP 設計公司專注於僅能單次寫入且製程簡易之 OTP (One-Time Programming, 以下簡稱 OTP) 產品，申請公司主要著墨於可多次讀寫且製程更為複雜之 MTP (Multi-Times Programming, 以下簡稱 MTP) 產品。藉由自行研發 1 電晶體 1 電容 (1 Transistor, 1 Capacitor, 以下簡稱 1T1C) 之存儲單元專利技術，成功開發出極具小面積優勢且可多次寫入之 MTP 產品。申請公司 1T1C 存儲單元專利技術已發展至第七代，代表持續精進於面積的縮小與成本的降低，不但有利於增進客戶的競爭力，同時拓寬產品未來應用市場之廣度。

B. MTP SIP 技術領導公司

申請公司之主要產品為 MTP SIP，相較於傳統製程便宜卻僅能一次性編程之 OTP SIP 或製程昂貴但可多次編程之 Flash SIP，MTP SIP 結合可多次編程且低成本兩者優勢，以其關鍵核心技術 1T1C 所研發之 MTP，具備毋需更改製程、不增加額外光罩層數及最小面積之優勢，且其第七代記憶體細胞，可將 MTP 面積降至小於競爭對手之 OTP 面積，藉此節省 IC 業者開發成本及提升設計彈性，為目前市場中最具競爭力之 MTP SIP。

(2) 創新能力：

A. 多樣化寫入次數，提供客戶彈性選擇

鑑於市場應用亦有少量寫入次數需求，申請公司憑藉早期成功開發寫入次數 100~10,000 次之 EEPROM (電子抹除式可複寫唯讀記憶體) 產品之經驗，研發不同寫入規格之 SIP 產品，包含 100~10,000 次之 EEPROM、100~1,000 次之 MTP 及 1~100 次之 FTP，目前皆已量產，其中尤以 FTP 為當前市場獨有具備可量產之中低容量產品。申請公司結合其獨特 1T1C 核心技術之小面積及低成本優勢，具有各式寫入次數、容量及面積之創新產品研發



能力，滿足客戶多樣彈性應用 MTP SIP 之需求。

#### B.獨特設計架構，發展少量寫入次數之 OTP

申請公司透過其創新設計架構—電子式抹除方式，搭配其核心技術 1T1C 之面積領先優勢，發展出在相同面積下，可電子式寫入 10 次之浮動閘極 (Floating-gate) 架構 OTP 產品；在單次寫入方面，更將面積縮小至同業之 80%，大幅提升產品競爭力，產品已獲客戶驗證，並於 0.18 $\mu\text{m}$ 、0.35 $\mu\text{m}$  等製程量產使用。

#### C.持續開發高階應用及研發特殊材料，突破既有框架

持續開發高階 SIP 設計方法與流程，發展可提供 100,000 寫入次數之 HEEPROM 產品，以符合工業控制、車用及電腦週邊等終端市場應用，目前已進入產品驗證階段；另由於現行 MTP 受寫入方式限制，無法成功應用於先進製程，申請公司積極研發高精密度之非揮發性元件—高介電常數金屬閘極陣列 (HKMG array)，尋找適用於先進製程之 MTP 解決方案，目前進行產學合作初步量測且提出專利申請中。

### (3)因重大技術、產品、政策、經營模式變化等可能導致之風險暨所採行之因應措施：

#### A.美中科技戰對半導體產業未來佈局之風險

近年來美中貿易戰已逐漸演變成半導體、人工智慧及 5G 通訊等領域之科技戰，各國政府陸續頒布半導體出口管制措施，限制先進製程設備及技術元件輸往中國大陸地區，以壓制其半導體技術之發展。惟中國大陸擁有全球最大之晶片市場，受到各國政府抵制政策之影響，將造成產業供應鏈移轉之風險，衝擊全球半導體產業發展，SIP 設計業者亦連帶受到波及，進而影響該公司之營收及獲利表現。

#### 因應對策：

依據美國頒布之出口管制條例，半導體禁令旨在限制中國大陸 10~20 奈米以下之先進製程發展技術，而針對 28 奈米以上之成熟製程則並非其主要管制目標。由於該公司 SIP 產品於中國大陸地區之佈局仍以 55 奈米及更成熟之製程節點為主，並未落於該管制條例之制裁名單中，故短期內對該公司營運狀況無產生直接之影響，未來該公司於中國市場亦持續朝往成熟製程

方向發展，預期中國市場晶圓代工業者在先進製程技術受限下將積極擴充成熟製程產能，且在物聯網、電動車及工業等趨勢領域需求持續提升，將帶動電源管理、微控制器及 Wi-Fi 等晶片供不應求，有助於推升公司整體業績表現。

#### B. 主要產品市場占有率低對公司營運規模之風險

早期記憶體 SIP 產業由於技術發展受限，使得該公司主要產品 MTP SIP 雖可提供客戶多次讀寫之功能，惟因面積仍較 OTP SIP 為大而不具備相應之成本優勢，且下游 IC 設計業者多考量採以數顆面積較小之 OTP SIP 組合方案來取代其僅能一次性編寫之效能限制，進而與該公司產品產生排擠效應，故 MTP SIP 並非成為初期市場上主流採用之記憶體 SIP 技術，進而導致該公司營運規模不及同業競爭者之風險。

#### 因應對策：

該公司專注於 MTP 技術領域已累積多年開發經驗，透過自有記憶體細胞單元專利，已可將其 MTP SIP 面積縮小於同業之 OTP SIP，並完成晶圓廠功能及製程相關驗證且成功導入量產，論其產品效能及效益皆已優於同業競品。此外，考量 OTP SIP 仍占有較高之市占率，加上現有客戶對該公司 SIP 設計架構較為熟悉且亦提出 OTP SIP 產品相關需求，故該公司擬藉由新開發之創新技術，提供可電子式寫入十次或面積可縮小至現有供應商 SIP 之 80% 等產品競爭優勢，並透過合作客戶取得新製程平台投產機會，搶攻 OTP SIP 市場商機，目前該公司 OTP SIP 產品已獲客戶驗證採用，並用作 0.18 $\mu$ m、0.35 $\mu$ m 等製程量產使用。綜上所述，受惠於 IC 產品週期縮短及設計複雜度增加之產業趨勢，MTP SIP 市場需求及新應用領域將逐步浮現，另隨著半導體產業持續追求製程微縮技術發展，將帶動以 OTP SIP 應用為主之先進製程需求成長，該公司將逐步切入 OTP SIP 市場，並占有產業領先技術優勢，建置完整之記憶體 SIP 資料庫客製化解決方案，有效提升該公司產品競爭優勢及市占率。

9. 以創新版上市者，就其產品生產開發技術之層次、來源、確保與提升，暨現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究開發計畫，預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性及研究發展之內部控制暨保全措施加以評估

(1) 產品生產開發技術之層次、來源、確保專利權及所受法律保護狀況

## 與提升

### A. 產品生產開發技術之層次、來源、確保與提升

該公司所屬半導體市場最上游之矽智財設計產業，主要提供「邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體」矽智財授權及技術開發服務，相較於一般傳統的唯讀記憶體(Read-Only Memory，以下簡稱：ROM)元件，其技術層次有著顯著之差異，在傳統的 ROM 製程技術中，起初即會將特定程式碼以光罩方式寫入記憶體元件中，且寫入後即無法再做任何修改，限制了產品設計之彈性及生產研發效率，而採用該公司自行研發之記憶單元技術，另搭載不同邏輯控制線路所設計之 OTP SIP(單次寫入)、MTP SIP(多次寫入)及 EEPROM SIP(電子抹除式寫入)等矽智財產品，可根據客戶不同產品及製程特性需求，提供可編程、面積小、高效能及高穩定度之嵌入式記憶體矽智財客製化解決方案，大幅提升客戶產銷彈性及產品競爭力。

該公司之主要技術來源為研發部門自行開發為主，其可提供具競爭力之記憶體規格與面積，與邏輯製程相容之技術更使其可靈活應用於各技術平台如邏輯(logic)、高壓(high-voltage)、混合信號(mixed-mode)、BCD (bipolar-CMOS-DMOS)等製程，提供客戶高性價比及特殊需求之最佳嵌入式記憶體矽智財解決方案。

該公司經驗豐富之技術研發團隊，除藉由公司內部專業訓練之外，亦透過特定外部課程深耕技術層次，必要時亦會與大專院校或研究機構進行產學合作計畫，另為保護公司研發成果及智慧財產權，該公司已於內部控制制度中之研發循環訂定技術文件管理相關作業程序，嚴格把關各階段之研發資料皆受有系統性安全控管，並將新技術之研發成果申請專利權保護，直接或間接提升及確保公司整體技術能力。

### B. 現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性

#### ① 主要產品之競爭優勢

該公司之主要產品係屬嵌入式 MTP 非揮發性記憶體 SIP，相較於傳統製程便宜卻僅能一次性編程之嵌入式 OTP SIP 以及製程昂貴但可多次編程之嵌入式 Flash SIP，嵌入式 MTP SIP 結合兩者優勢，提供客戶以一般製程之晶圓價格，得到多達 10~100K 次擦寫次數之使用效能，此技術特色適合為參數與組態設定、系統程式編碼儲存與紀錄及安全辨識管

理等應用，提供最適用且經濟實惠 eNVM SIP 之解決方案。此外，該公司 MTP SIP 之設計採用自行研發之 1T1C 記憶細胞及記憶陣列核心技術專利，大幅縮小嵌入式 MTP SIP 產品面積，不僅有效降低產品讀寫電壓提升客戶產品效能，並提升極具競爭力之成本效益。

### ② 主要產品之生命週期

相較於一般記憶體 SIP 設計公司係以專用製程設計服務為主，SIP 產品僅需依規格要求範圍內完成相關功能及特性驗證即可使用，製程驗證項目較少，產品可量產性也較低，而該公司 MTP SIP 所需之技術層級高，多應用於穩定性高及可量產性之非專用製程，需遵照晶圓廠提供之超規格製程規範，額外通過高低溫寫入次數、讀取能力及製程可靠度測試等各項功能驗證，故 MTP SIP 從開發至完成驗證一般需要 2 年的時間才可進入量產階段。然該公司主要產品由於並非終端產品，其生命週期應依各式 MTP SIP 終端應用而定，而目前客戶終端產品多應用於對產品耐用性及穩定性要求甚高之家用電器及車用電子市場，其產品生命週期可長達 5~10 年之久，隨著客戶 SIP 累積使用量逐年增加，將帶動該公司權利金收入持續成長。

### ③ 主要產品之持續發展性

隨著半導體製程技術日益精進，消費性電子市場面臨少量多樣之需求挑戰，促使系統單晶片(System on Chip；以下簡稱：SoC) 設計已成為 IC 產業發展顯學，進而使得晶片整合趨勢快速提升。該公司嵌入式非揮發性記憶體技術涵蓋多次反覆讀寫之功能及各式記憶體容量之產品特性，提供客戶在相同硬體產品設計中，可靈活變更不同版本之韌體，快速反應不同終端產品應用需求，將大幅縮減產品開發時程，提升產品市場競爭力。顯見隨著 5G、AI、物聯網及車用市場等利基型應用領域快速崛起，IC 設計產業規模逐年擴大，SIP 產品之運用將扮演 IC 產業重要關鍵之角色。該公司未來將持續投入新產品及新技術之研究發展計畫，結合掌握產業關鍵技術競爭優勢，開發如微控制器、電源管理、OLED 面板驅動及無線充電等各式 IC 應用領域，聚焦於車用電子、智慧電力及物聯網等利基市場，建置更完整 MTP SIP 資料庫之解決方案，希冀成為嵌入式 MTP 非揮發性記憶體 SIP 之領

導廠商。

C. 新產品之研究開發計劃，預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性

① 新產品之研究開發計畫、預計生產時程及成本

產品項目	計畫研發之新產品	預計時程
100K cycle EEPROM	研發第 1 代 HEEPROM 記憶體架構，提供高讀寫次數至 100K 次之嵌入式 EEPROM，可應用於 DDR5 電源管理、車用及工控監測產品	預計 2024 年中完成驗證
Anti-fuse OTP (反熔絲 OTP)	研發第 2 代 OTP 記憶體架構，提供相較競爭者產品縮小約 30% 之面積優勢，可應用於 OLED 面板驅動 IC 及車用電子市場	預計 2024 年底完成驗證
MTP/Flash SIP	研發第 7 代多次寫入記憶體，可應用於 MTP 及 Flash SIP，將面積持續縮小於 $0.5\mu\text{m}^2$ ，讀取速度達 25ns(奈秒)，強化產品效能及擴大應用範圍	預計 2024 年底完成產品開發
HKMG MTP	研發第 1 代 HKMG(高介電常數金屬閘極)記憶體架構，將 HKMG 材料與 MTP 技術之結合，擴大 MTP 技術於先進製程之應用範疇	預計 2024 年底完成工程驗證

資料來源：該公司提供。

② 新產品之市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性

該公司未來產品開發計畫係以目前現有之技術持續延伸，除了強化現有產品之效能外，為因應終端產品應用功能日益擴增且符合市場發展趨勢，透過採用創新材料及作法研發新型記憶體架構，陸續開發出多樣化之 SIP 新品，以提升產品競爭力並擴大應用領域。該公司目前已針對其開發之核心技術申請專利保護，其新產品之市場定位將鎖定下一代主流趨勢產品，如：OLED 面板驅動 IC、車載 IC、電源管理 IC、物聯網 IC 及微控制器 IC 之產品需求，以主要應用市場及先進製程技術平台作為該公司新產品發展之主要目標。根據研究機構 Gartner 之估計，2021 年全球物聯網終端電子市場規模為 4,100 億美金，預估 2021 年至 2031 年整體市場規模之年複合成長率將達 8.8%，隨著聯網技術蓬勃發展，將為汽車電子、穿戴式裝置、智慧家庭及無線充電等終端應用領域帶來絕佳之發展前景，該公司未來將憑藉其研發團隊開發之技術，持續以技術領先思維，提升產品寫入次數、容量規

格與讀寫速度，提供客戶更為優異之產品效能及性價比。綜上所述，由於該公司所處相關應用市場持續成長，加上新產品推出使公司產品線更加完整，適用於更多終端產品，因此，隨著新產品授權客戶增加及權利金之貢獻成長，未來營收之成長係可預期，故未來營收效益應可順利達成。

## (2)現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究發展計劃

### A.現在主要產品之競爭優勢

該公司之主要產品係屬嵌入式 MTP 非揮發性記憶體 SIP，相較於傳統製程便宜卻僅能一次性編程之嵌入式 OTP SIP 以及製程昂貴但可多次編程之嵌入式 Flash SIP，嵌入式 MTP SIP 結合兩者優勢，提供客戶以一般製程之晶圓價格，得到多達 10~100K 次擦寫次數之使用效能，此技術特色適合為參數與組態設定、系統程式編碼儲存與紀錄及安全辨識管理等應用，提供最適用且經濟實惠 eNVM SIP 之解決方案。此外，該公司 MTP SIP 之設計採用自行研發之 1T1C 記憶細胞及記憶陣列核心技術專利，大幅縮小嵌入式 MTP SIP 產品面積，不僅有效降低產品讀寫電壓提升客戶產品效能，並提升極具競爭力之成本效益。

### B.現在主要產品之生命週期及持續發展性

相較於一般記憶體 SIP 設計公司係以專用製程設計服務為主，SIP 產品僅需依規格要求範圍內完成相關功能及特性驗證即可使用，製程驗證項目較少，產品可量產性也較低，而該公司 MTP SIP 所需之技術層級高，多應用於穩定性高及可量產性之非專用製程，需遵照晶圓廠提供之超規格製程規範，額外通過高低溫寫入次數、讀取能力及製程可靠度測試等各項功能驗證，故 MTP SIP 從開發至完成驗證一般需要 2 年的時間才可進入量產階段。然該公司主要產品由於並非終端產品，其生命週期應依各式 MTP SIP 終端應用而定，而目前客戶終端產品多應用於對產品耐用性及穩定性要求甚高之家用電器及車用電子市場，其產品生命週期可長達 5~10 年之久，隨著客戶 SIP 累積使用量逐年增加，將帶動該公司權利金收入持續成長。

### C.主要產品之持續發展性

隨著半導體製程技術日益精進，消費性電子市場面臨少量多樣之需求挑戰，促使系統單晶片(System on Chip; 以下簡稱: SoC)

設計已成為 IC 產業發展顯學，進而使得晶片整合趨勢快速提升。該公司嵌入式非揮發性記憶體技術涵蓋多次反覆讀寫之功能及各式記憶體容量之產品特性，提供客戶在相同硬體產品設計中，可靈活變更不同版本之韌體，快速反應不同終端產品應用需求，將大幅縮減產品開發時程，提升產品市場競爭力。顯見隨著 5G、AI、物聯網及車用市場等利基型應用領域快速崛起，IC 設計產業規模逐年擴大，SIP 產品之運用將扮演 IC 產業重要關鍵之角色。該公司未來將持續投入新產品及新技術之研究發展計畫，結合掌握產業關鍵技術競爭優勢，開發如微控制器、電源管理、OLED 面板驅動及無線充電等各式 IC 應用領域，聚焦於車用電子、智慧電力及物聯網等利基市場，建置更完整 MTP SIP 資料庫之解決方案，希冀成為嵌入式 MTP 非揮發性記憶體 SIP 之領導廠商。

(3)新產品之研究開發計畫，預計生產時程及成本、市場定位、需求與未來營收效益預測達成可能性及研究發展之內部控制暨保全措施

#### A.新產品之研究開發計畫，預計生產時程及成本

產品項目	計畫研發之新產品	預計時程
100K cycle EEPROM	研發第 1 代 HEEPROM 記憶體架構，提供高讀寫次數至 100K 次之嵌入式 EEPROM，可應用於 DDR5 電源管理、車用及工控監測產品	預計 2024 年中完成驗證
Anti-fuse OTP (反熔絲 OTP)	研發第 2 代 OTP 記憶體架構，提供相較競爭者產品縮小約 30% 之面積優勢，可應用於 OLED 面板驅動 IC 及車用電子市場	預計 2024 年底完成驗證
MTP/Flash SIP	研發第 7 代多次寫入記憶體，可應用於 MTP 及 Flash SIP，將面積持續縮小於 $0.5\mu\text{m}^2$ ，讀取速度達 25ns(奈秒)，強化產品效能及擴大應用範圍	預計 2024 年底完成產品開發
HKMG MTP	研發第 1 代 HKMG(高介電常數金屬閘極)記憶體架構，將 HKMG 材料與 MTP 技術之結合，擴大 MTP 技術於先進製程之應用範疇	預計 2024 年底完成工程驗證

資料來源：該公司提供。

#### B.研究發展之內部控制暨保全措施

該公司為強化資訊安全管理，確保所屬之研發資產之機密性及完整性，於公司內部建置資通安全風險管理架構，成立智財管理部門及跨部門資訊安全委員會並由總經理擔任總召集人，予以

制定資訊安全及個人資料管理目標及政策，另亦設置資訊安全主管，負責推動並具體落實資訊安全措施。

該公司所屬高技術密集之矽智財產業，相當重視資安風險控制與保護，其佈建多層次資安管控防護網，實施嚴格之管控措施，如研發部門採用經防火牆控管之專用封閉式網路作業，無法連線至外部網路並禁止使用未經授權之軟體、重要研發資料定期執行異地備份，且異地備份每周更換一次備份媒體，以此確保資料存儲之安全性、資訊設備進出必須遵照流程提出申請核准，禁止攜入私人儲存裝置及設備進行拍照或錄影、電腦機房實施門禁管制，人員進出須詳實紀錄於機房工作日誌，且權限需定期進行重新審閱等，此外，該公司亦定期透過實體或線上課程給予全體同仁進行資安教育訓練，建構完善之資安管控及防護意識。

10.以創新板上市者，其參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東、以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷(工作經驗、教育背景及職位年資)、持股比例、最近二個會計年度及申請年度內股權移轉變化情形暨該技術股東與經理人實際投入經營之時間與情形，並評估該等人員未來若未能繼續參與經營對發行公司財務業務之影響及其因應之措施

(1)參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東，以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷、持股比例、實際投入經營之時間與情形

113年2月29日；單位：年；%

職稱	姓名	主要學(經)歷	產業年資	公司服務年資	持股比例
董事長兼總經理	黃文謙	國立清華大學物理系學士 華邦電子(股)公司行銷業務經理 凌巨科技(股)公司行銷業務處長	37.5	23	3.81
董事	陳鴻文	國立清華大學電機所碩士 台灣積體電路製造(股)公司工程師 太欣半導體(股)公司工程師	37	14	3.39
董事	陳永華	國立清華大學物理系學士 大同工學院事業經營研究所碩士 精強科技(股)公司總經理	37	13	4.41
董事	魏雅庵	南亞技術學院土木工程系 中華民國工業區北部理事長聯誼會會長	36	5	2.09
董事	鄭玥姝	空中商專 台揚科技資深會計 億而得微電子股份有限公司經理	32	23	2.50



獨立董事	潘燕民	文化大學經濟研究所碩士 銖德科技股份有限公司投資部副總經理	31	6	—
獨立董事	吳清沂	國立清華大學電機所博士 嘉聯益科技股份有限公司獨立董事	37	6	—
獨立董事	林月霞	東海大學會計系學士 正大聯合會計師事務所執業會計師	33	6	—
獨立董事	李展南	國立中興大學企研所碩士 臺灣證券交易所專員 臺灣期貨交易所副組長	34	6	0.02
副總經理	吳政穎	國立交通大學電信工程所碩士 華邦電子(股)公司資深工程師	29.3	20	0.17
副總經理	吳其沛	國立清華大學電子工程所碩士	16	16	—

資料來源：該公司提供。

(2) 參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東，以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術開發經理人等，最近二個會計年度及申請年度內股權移轉變化情形

單位：股

職稱	姓名	111 年度	112 年度		113 年 2 月 29 日	
		期末股數	增(減)股數	期末股數	增(減)股數	期末股數
董事長 兼總經理	黃文謙	1,020,425	—	1,020,425	—	1,020,425
董事	陳鴻文	909,575	—	909,575	—	909,575
董事	陳永華	1,174,685	8,000	1,182,685	—	1,182,685
董事	魏雅庵	687,040	(126,000)	561,040	—	561,040
董事	鄭玥妹	679,000	(3,000)	670,000	—	670,000
獨立董事	潘燕民	—	—	—	—	—
獨立董事	吳清沂	—	—	—	—	—
獨立董事	林月霞	—	—	—	—	—
獨立董事	李展南	5,000	—	5,000	—	5,000
副總經理	吳政穎	45,234	—	45,234	—	45,234
副總經理	吳其沛	—	—	—	—	—

資料來源：該公司提供。

111~112 年度及 113 年截至 2 月 29 日止，該公司參與經營決策之董事及掌握生產技術與技術開發經理人之股權變動，主係策略投資規劃及自身理財因素致持股異動，並未發現有重大異常情形之股權移轉或轉讓之情事。

(3) 參與經營決策之董事、監察人、持股百分之五以上股東、以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等，未來若

未能繼續參與經營對發行公司財務業務之影響及其因應之措施

該公司參與經營決策之董事及掌握技術開發之經理人均具備營運及業務發展所需之產業相關經驗，其營運策略方向主係透過董事在董事會提供營運及經營策略之適當建議，並無單一董事或集團控制該公司經營或日常運作之情事；而該公司因無以專門技術出資之股東，關鍵核心技術均掌握於其研發團隊中，智慧財產擁有權亦歸屬於億而得，並非由單一個人能完全掌握且無技術集中於特定人士或組織之情事。綜上所述，即便上述董事或經理人未來不繼續參與公司之經營，然因公司重大決策與營運方針係由董事會決議，致使公司之治理仍可有效實施，此外，該公司建立完善之研發循環內部控制制度及相關作業辦法，使得研發成果得以保留於公司內部，作為後續研發團隊改善及追蹤之依據，並能在智慧資產及經驗傳承中保持完整性，致該等人員之異動尚不致對該公司產生重大影響。

11. 以創新板上市者，屬生技醫療業者，應就其核心產品之臨床試驗進度加以評估

該公司非屬生技醫療業者創新板上市者，故不適用此項評估。

(四) 人力資源之營運風險

1. 最近二年度及申請年度截至最近期止員工總人數、離職人員、資遣或退休人數、直接或間接人工數、平均年齡及平均服務年資

單位：人；%

年度		111 年度	112 年度	113 年 2 月 29 日
		人數		
期初人數		64	63	62
新進人數		10	5	3
減少 人數	離職人數	10	6	1
	資遣人數	—	—	—
	退休人數	1	—	—
期末人數		63	62	64
平均年齡(歲)		36	36	37
平均服務年資(年)		6.4	6.9	7.3
學歷分布 比率(%)	博士	—	—	—
	碩士	41.27	45.16	42.19
	大學(專)	58.73	54.84	57.81
	高中(職)	—	—	—

資料來源：該公司提供。

該公司最近二年度及 113 年截至 2 月 29 日止，期末人數分別為 63 人、62 人及 64 人，其員工人數變化微小，主係隨公司營運規模變化而調整人力所致。在員工平均年齡及服務年資方面，該公司員工平均年齡為 36 歲至 37 歲，平均服務年資為 6.4 年至 7.3 年，顯示該公司員工主要為青壯年人口且呈現增加之趨勢，對公司營運之穩定及成長將有所助益。該公司目前員工學歷組成以大學及專科(含)以上為主，顯見該公司對人力素質之重視，未來將持續招募高度學術涵養及專業素養之人才，以強化公司技術實力及市場競爭力，經評估尚無重大異常情事。

## 2. 最近期及最近二年度員工離職率之變化情形

單位：人；%

年度 人數	111 年度			112 年度			113 年 2 月 29 日		
	離職 人數	期末 人數	離職率	離職 人數	期末 人數	離職率	離職 人數	期末 人數	離職率
經理人	1	7	12.50%	—	8	—	8	—	—
一般 職員	10	56	15.15%	4	54	6.90%	56	1	1.75%
合計	11	63	14.86%	4	62	6.06%	64	1	1.54%

資料來源：該公司提供。

註 1：離職率 = 本期離職人數 / (本期期末人數 + 本期離職人數)。

註 2：本期離職人數包含資遣及退休人數。

在離職率方面，111~112 年度及 113 年截至 2 月 29 日之離職(含一般離職、資遣及退休)人數分別為 11 人、4 人及 1 人，離職率分別為 14.86%、6.06% 及 1.54%，離職員工除一名經理人外，其餘皆為一般職員，離職原因主係為個人生涯規劃及家庭因素等。

該公司針對員工相關作業辦法已建有完整書面管理制度，並備有職務代理制度，故人力增補後可順利銜接。整體而言，該公司各年度之人員異動情形尚屬合理，尚無因人員異動而對公司營運造成重大不利之影響。

## (五)各主要產品之成本分析

1.最近期及最近二個會計年度主要產品之原料、人工及製造費用資料，並分析各成本要素比率變化對發行公司營運之風險

該公司係提供嵌入式非揮發性記憶體技術之 SIP 技術授權與設計服務，因此無實體貨品產出，亦無投入直接原料、直接人工及製造費用，故不適用此項評估。

2. 符合「有價證券上市審查準則」第十六條規定之公司申請股票上市者，取得當(鄰)地行情報導、同業資料及政府機關提供之房地價格比例(如評定現值及公告現值比例或房屋造價及地價比例等)，以評估合建分售、合建分屋或合建分成者，發行公司與地主之分配比率是否合理

該公司非屬「有價證券上市審查準則」第十六條規定之建設公司申請上市者，故不適用本項評估。

## (六)匯率變動情形

1.最近期及最近二個會計年度內外銷、內外購之金額與比例

該公司係提供嵌入式非揮發性記憶體技術之 SIP 技術授權與設計服務，因此無實體貨品產出，未有採購原料之情事，故僅以最近期及最近二年度內外銷之金額與比率評估。

(1) 最近期及最近二年度內外銷之金額與比例

單位：千元

項目	年度	111 年度		112 年度	
		金額	%	金額	%
內銷	新台幣	34,074	14.85	25,004	13.34
	美金	41,956	18.29	22,711	12.12
	小計	76,030	33.14	47,715	25.46
外銷	美金	151,756	66.15	138,398	73.86
	人民幣	1,634	0.71	1,271	0.68
	小計	153,390	66.86	139,669	74.54
銷貨合計		229,420	100.00	187,384	100.00

資料來源：該公司提供。

該公司 111~112 年度美金銷售占整體營收之比率分別為 84.44%及 85.98%，銷售地區主要為臺灣、中國大陸、新加坡及韓國，惟應客戶要求多以美金為計價幣別，因此美金匯率變動將對該公司之營收及獲利造

成影響。

## 2.最近二年度兌換損益占營收淨額及營業利益之情形

單位：新台幣千元；%

項目	年度	111 年度	112 年度
兌換利益		1,082	70
營業收入淨額		229,420	187,384
營業利益		78,846	35,057
兌換利益/營業收入		0.47	0.04
兌換利益/營業利益		1.37	0.20

資料來源：該公司 111~112 年度經會計師查核簽證之財務報告。

該公司 111~112 年度兌換利益占營收淨額比率分別為 0.47%及 0.04%；兌換利益占營業利益比率則分別為 1.37%及 0.20%。111 年度由於俄羅斯與烏克蘭軍事衝突擴大，造成全球通膨壓力升高，致使美國聯準會決議啟動升息循環，截至 111 年底美國聯準會共升息 4.25%，使得美元對新台幣強勢升值，致該公司 111 年度產生兌換利益 1,082 千元；112 年度因美國通貨膨脹情形尚未緩解，美國聯準會持續升息予以因應，致美元兌新台幣匯率升值，使得該公司 112 年度產生兌換利益 70 千元。

該公司及 111~112 年度之兌換利益占營業收入比例分別為 0.47%及 0.04%，占營業利益比例分別為 1.37%及 0.20%，顯見該公司兌換利益占各年度營業收入及營業利益比重甚微，且其兌換損益之變化情形與匯率變動趨勢尚屬合理，尚不致因匯率變動而對其營運產生重大風險，惟該公司亦將適時採取必要之避險措施，以防止兌換損失侵蝕獲利水準之風險。

## 3.發行公司之避險措施

該公司對於匯率變動風險之因應係以規避風險為原則，不以投機交易為目的，所採取之具體因應措施如下：

- (1)與主要往來銀行開立外匯存款帳戶，客戶匯入之貨款則視實際資金需求及匯率可能變動趨勢，適時決定外幣兌換或存入外匯存款帳戶。
- (2)公司財務單位與各銀行之外匯部門保持密切聯繫，並隨時蒐集市場匯率變化之相關資訊，充分掌握國內外匯率走勢及變化資訊，以降低匯率變動所產生之負面影響。
- (3)公司業務單位進行報價前，會先行對未來之匯率走勢及影響匯率之因素做綜合考量及評估，以決定適當且合理之報價，降低因交易而產生之匯兌風險，以保障公司之合理利潤。

經評估該公司最近二年度及申請年度兌換損益情形及因應匯率變動之具體措施應屬允當。

#### 四、最近期及最近二個會計年度募集與發行有價證券籌資效益

請參閱本評估報告「肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形」之說明。

### 參、業務財務狀況

#### 一、業務狀況

(一)最近期及最近二個會計年度財務報告主要銷售對象及供應商(年度前十名或占年度營業收入淨額或進貨淨額百分之五以上者)之變化分析—應列明最近期及最近二個會計年度主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例，主要銷售對象變化情形之原因並分析是否合理，是否有銷售集中之風險，並簡述發行公司之銷售政策；最近期及最近二個會計年度各主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額，並分析最近期及最近二個會計年度主要供應商之變化情形

1. 最近期及最近二個會計年度主要銷售對象(年度前十名或占年度營業收入淨額百分之五以上者)之名稱、金額及占年度營業收入比例，主要銷售對象變化情形之原因並分析是否合理，是否有銷售集中之風險，並簡述發行公司之銷售政策

(1)最近期及最近二個會計年度主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例

單位：新台幣千元

排名	111 年度				112 年度			
	客戶名稱	金額	%	與發行人之關係	客戶名稱	金額	%	與發行人之關係
1	A 公司	43,317	18.88%	無	A 公司	33,194	17.72%	無
2	B 公司	33,951	14.80%	無	B 公司	25,285	13.49%	無
3	C 公司	23,808	10.38%	無	D 公司	19,788	10.56%	無
4	D 公司	21,936	9.56%	無	C 公司	18,929	10.10%	無
5	E 公司	10,067	4.39%	無	K 公司	11,914	6.36%	無
6	F 公司	9,717	4.23%	無	L 公司	10,999	5.87%	無
7	G 公司	9,563	4.17%	無	E 公司	7,117	3.80%	無
8	H 公司	7,847	3.42%	無	F 公司	5,534	2.95%	無
9	I 公司	7,339	3.20%	無	M 公司	4,335	2.31%	無
10	J 公司	6,725	2.93%	無	H 公司	3,993	2.13%	無
	小計	174,270	75.96%	—	小計	141,088	75.29%	—
	其他	55,150	24.04%	—	其他	46,296	24.71%	—
	合計	229,420	100.00%	—	合計	187,384	100.00%	—

資料來源：該公司提供

## (2)主要銷售對象變化情形之原因並分析是否合理

該公司主要從事嵌入式非揮發性記憶體矽智慧財產權(以下簡稱 eNVM SIP)技術之研究開發、功能設計及授權服務等業務，依交易模式不同，該公司收入來源可分為技術服務收入及技術權利金收入，其主要銷售客戶為臺灣、新加坡、中國及韓國等晶圓代工廠及 IC 設計公司。該公司 111~112 年度之銷售對象及金額受到市場需求、客戶營運政策改變等因素影響，致各年度間主要銷售客戶有所變動，茲就主要銷售對象變化情形說明如下：

### ① A 公司

A 公司成立於民國 98 年，總部位於美國加利福尼亞州聖克拉拉，為美國 NASDAQ 上市公司，資本額為 80.3 億美元，為全球第四大晶圓代工製造廠商，該公司於 104 年與 A 公司簽訂授權合約至今，主要係授權使用於 0.18、0.15 微米製程之 MTP SIP，並應用於 MCU 及電源管理 IC 等終端產品。

該公司 111~112 年度對 A 公司之銷售金額分別為 43,317 千元及 33,194 千元，占營收淨額比重分別為 18.88%及 17.72%。112 年度銷售金額較 111 年度減少，係因 112 年全球經濟持續面臨高通膨壓力、地緣政治風險及各國央行接連升息等因素，導致經濟成長動能明顯減緩，終端消費市場購買力道衰弱，供應鏈備貨心態趨於謹慎，IC 設計公司庫存居高不下，面臨調整庫存去化階段，整體半導體產業進入淡季，而晶圓出貨量下滑致該公司收取之技術權利金減少；惟在合作開發設計 SIP 產品方面，受到終端需求冷卻晶圓代工廠釋出產能，進而加速產品開發之各項驗證時程，A 公司委託該公司設計於 1.8V、6V 等不同電壓製程應用之 MTP 產品，多於 112 年度達成特性及品質驗證之里程碑，使技術服務收入成長，故最近二年度 A 公司皆為該公司第一大銷售客戶。

### ② B 公司

B 公司成立於民國 83 年，為我國上櫃公司，實收資本額為新台幣 16,389,823 千元，為全球第八大晶圓代工製造廠商，該公司於 98 年與 B 公司簽訂授權合約至今，期間雙方配合良好，該公司已有多項 SIP 上架至其製程設計平台，供終端客戶選擇使用，主要係 0.18~0.5 微米製程，並應用於 MCU、電源管理 IC



及顯示器驅動 IC 等產品。

該公司 111~112 年度對 B 公司之銷售金額分別為 33,951 千元及 25,285 千元，占營收淨額比重分別為 14.80%及 13.49%。112 年度銷售金額較 111 年度減少，主係 112 年半導體產業進入庫存調整階段且終端消費性電子市場購買力道減緩，晶圓出貨量下滑致該公司收取之技術權利金減少，而 B 公司委託設計之 BCD 專案仍持續達成品質驗證里程碑，使 B 公司於最近二年度皆為該公司第二大銷售客戶。

### ③ D 公司

D 公司為位於韓國專注生產電源管理 IC、驅動面板 IC 及 MCU 之 8 吋晶圓代工廠，隸屬於全球前三大記憶體供應商旗下之晶圓代工事業體。該公司於 101 年與 D 公司簽訂授權合約，主要係授權 0.16 及 0.18 微米製程之 MTP SIP，並應用於 MCU 及電源管理 IC 等產品。

該公司 111~112 年度對 D 公司之銷售金額分別為 21,936 千元及 19,788 千元，占營收淨額比重分別為 9.56%及 10.56%。112 年度銷售金額較 111 年度減少，係因 112 年半導體產業面臨庫存調整使整體產業進入淡季，在智慧聯網(AIoT)及電動車應用之相關軟硬體技術日趨成熟之下，應用於伺服器之電源管理 IC，市場需求持續成長，終端客戶仍維持投片量，衰退幅度較小，致 D 公司於 112 年度成為該公司第三大銷售客戶。

### ④ I 公司

I 公司成立於民國 83 年，為我國上市公司，實收資本額為新台幣 40,692,493 千元，為全球第七大晶圓代工製造廠商，該公司於 98 年與 I 公司簽訂授權合約，主要係授權 0.09、0.13、0.18 微米製程之 MTP SIP，應用於顯示器之驅動 IC 等產品。該公司 111~112 年度對 I 公司之銷售金額分別為 7,339 千元及 1,598 千元，占營收淨額比重分別為 3.20%及 0.85%。112 年度銷售金額較 111 年度減少，112 年半導體生產鏈庫存水位過高，又全球景氣衰退致終端市場需求疲弱，消費者購買力持續低迷，I 公司晶圓代工訂單受到明顯衝擊，客戶出貨量大幅減少牽動該公司技術權利金收入下滑，致 112 年度 I 公司退出該公司前十大銷售客戶排行之列。

#### ⑤ F 公司

F 公司成立於民國 69 年，為我國上市公司，實收資本額為新台幣 125,031,392 千元，為全球第三大晶圓代工製造廠商，該公司於 100 年與 F 公司簽訂授權合約，係授權 0.25、0.35 微米製程之 MTP SIP，主要應用於顯示器之驅動 IC 等產品。該公司 111~112 年度對 F 公司之銷售金額分別為 9,717 千元及 5,534 千元，占營收淨額比重分別為 4.24%及 2.95%。112 年度銷售金額相較 111 年度減少，主係 112 年半導體產業進入庫存調整階段，同時受到全球經濟成長趨緩影響，手機及電腦等消費性電子市場疲弱、購買力持續低迷，晶圓出貨量下滑致該公司收取之技術權利金減少，使 F 公司於 112 年度由該公司第六大銷售客戶退為第八大銷售客戶。

#### ⑥ G 公司

G 公司成立於民國 97 年，為我國第一上市公司，實收資本額為新台幣 959,320 千元，主要從事電源管理 IC 之研發、設計與銷售業務，產品廣泛應用消費性電子、工業、資訊通信及汽車電子等領域，為全球少數生產小封裝、高壓大電流之 IC 設計公司，該公司於 104 年與 G 公司簽訂授權合約，主要係授權 0.35 微米製程之 MTP SIP，主要應用於固態硬碟及通訊電子等終端產品。該公司 111~112 年度對 G 公司之銷售金額分別為 9,563 千元及 1,824 千元，占營收淨額比重分別為 4.17%及 0.97%。112 年度銷售金額較 111 年度減少，係因 112 年半導體產業進入庫存調整階段且終端消費性電子市場購買力道減緩，晶圓出貨量下滑致該公司收取之技術權利金減少，且 G 公司委託該公司設計開發適用於 0.35 及 0.162 微米製程平台之 MTP 項目，已於 111 年度達成最終階段里程碑，又新委託設計產品尚在洽談階段未達成開案里程碑，故無產生技術服務收入，使 G 公司於 112 年度退出該公司銷售前十大客戶之列。

#### ⑦ E 公司

E 公司為全球前三大記憶體供應商於民國 107 年切割成立之專業晶圓代工事業體，111 年該集團調整整體營運模式，將位於南韓清州之 8 吋晶圓廠遷移至中國無錫，該公司主要係授權 0.11 微米製程之 MTP SIP，並應用於電源管理 IC 等產品，尚有多項 SIP 產品技術合作計劃，隨著達成階段性驗證里程碑，而

收取不同階段之技術服務收入。

該公司 111~112 年度對 E 公司之銷售金額分別為 10,067 千元及 7,117 千元，占營收淨額比重分別為 4.39%及 3.80%，銷售金額呈逐年成長趨勢。112 年度銷售金額相較 111 年度成長，主係 112 年 E 公司委託該公司設計專案達功能性里程碑，致收取之技術服務收入增加，惟 112 年半導體整體產業成長趨緩，晶圓出貨量減少致技術權利金收入大幅下滑，使 E 公司於 112 年度由該公司第五大銷售客戶退為第七大銷售客戶。

#### ⑧K 公司

K 公司成立於 105 年，資本額為人民幣 120,000 千元，總部位於中國大陸成都市，為一專業 IC 設計公司，在中國上海、深圳、西安、香港，以及韓國和美國均設有分部，主要從事無線充電 IC、電源管理 IC 等晶片設計與銷售業務，該公司於 109 年與 K 公司簽訂授權合約，主要係授權 0.18 微米 BCD 製程之 MTP SIP，並應用於電源管理 IC 等產品。該公司 111~112 年度對 K 公司之銷售金額分別為 5,766 千元及 11,914 千元，占營收淨額比重分別為 2.51%及 6.36%，銷售金額呈逐年成長趨勢。112 年度銷售金額相較 111 年度增加，主係近年來 K 公司委託該公司設計產品已進入量產階段，且電源管理晶片應用日漸廣泛，致其終端產品市場需求增加，帶動該公司 112 年度技術權利金收入大幅成長，使 K 公司於 112 年度成為該公司第五大銷售客戶。

#### ⑨C 公司

C 公司成立於民國 104 年，為上海證券交易所科創板掛牌公司，實收資本額為人民幣 1,504,601 千元，主要提供顯示器驅動 IC、CMOS 影像感測器、MCU、電源管理等應用領域之晶圓代工服務，111 年為全球第十大晶圓代工製造廠商。該公司於 106 年與 C 公司簽訂授權合約至今，係授權 0.11、0.09 微米製程之 MTP SIP，主要應用於微控制器之 IC 及顯示器之驅動 IC 等產品。該公司 111~112 年度對 C 公司之銷售金額分別為 23,808 千元及 18,929 千元，占營收淨額比重分別為 10.38%及 10.10%。112 年度銷售金額相較 111 年度減少，主係 112 年半導體產業進入庫存調整階段且終端消費性電子市場購買力道減緩，晶圓出貨量下滑致該公司收取之技術權利金減少，使 112 年度 C 公司退為該公司第四大銷售客戶。

#### ⑩ H 公司

H 公司成立於民國 76 年，實收資本額為新台幣 259,320,710 千元，為我國上市公司，係全球第一大晶圓代工製造廠商，該公司於 101 年授權專利元件予 H 公司，供其自行開發設計符合 0.25 及 0.18 高壓製程之 SIP，隨著製程平台驗證完成，該公司依晶圓生產數量收取技術權利金。該公司 111~112 年度對 H 公司之銷售金額分別為 7,847 千元及 3,993 千元，占營收淨額比重為 3.42%及 2.13%。112 年度銷售金額相較 111 年度減少，主係 112 年半導體產業進入庫存調整階段且終端消費性電子市場購買力道減緩，晶圓出貨量下滑致該公司收取之技術權利金減少，使 112 年度 H 公司退為該公司第十大銷售客戶。

#### ⑪ J 公司

J 公司為我國上市公司於民國 92 年成立之子公司，資本額為美金 879 千元，主要於中國大陸地區提供代理銷售半導體、光電及電子材料等產品及技術服務。IC 設計公司自身營運規模將影響晶圓代工廠產能安排，故營運規模較小之 IC 設計公司常委託 J 公司投片下單至晶圓代工廠生產，並由 J 公司進行代收付之交易模式，而該公司主要係授權 0.18 微米製程之 MTP SIP，並按照授權合約依晶圓出貨數量收取技術權利金。

該公司 111~112 年度對 J 公司之銷售金額分別為 6,725 千元及 693 千元，占營收淨額比重為 2.93%及 0.37%。111 年終端 IC 設計客戶與晶圓代工廠間交易模式改變，轉由委託 J 公司代向晶圓代工廠採購晶圓，並受到 110 年晶片缺貨影響延續，IC 設計公司提高庫存準備以免供應鏈中斷，晶圓出貨量增加使 111 年度技術權利金收入大幅成長，致 111 年度 J 公司成為該公司第九大銷售客戶，惟 112 年崇越集團調整代理銷售營運模式，改由崇越科技直接向臺灣晶圓代工廠採購晶圓，且又受到半導體整體產業面臨庫存調整階段，致 112 年度技術權利金收入減少，J 公司退出該公司銷售前十大客戶之列。

#### ⑫ L 公司

L 公司成立於 103 年，資本額為人民幣 36,000 千元，總部位於中國大陸合肥市，於中國上海、北京、杭州、深圳，以及美國、馬來西亞、韓國均設有分部，主要從事無線充電、有線快充等電源管理 IC 設計及研發，終端應用橫跨消費性電子、汽車電子、

工業及醫療等領域，目前為多家手機品牌及手機配件廠商之供應商。該公司於 110 年與 L 公司簽訂授權合約至今，主要授權應用於電源管理 IC 之 0.18 微米高壓製程，並按照授權合約依晶圓出貨數量收取技術權利金。

該公司 111~112 年度對 L 公司之銷售金額分別為 1,429 千元及 10,999 千元，占營收淨額比重分別為 0.62% 及 5.87%，112 年度銷售金額相較 111 年度增加。主係中國大陸地區手機品牌市場競爭激烈，無線充電系統成熟應用加速終端消費市場成長，整體呈現供不應求之情形，L 公司積極取得客戶訂單跨足車用電子市場，112 年終端品牌產品進入量產，帶動該公司技術權利金收入大幅成長，而 L 公司委託該公司設計之 SIP 晶片已進入流片階段達成里程碑，致技術服務收入同時增長，使 L 公司於 112 年度成為該公司第六大銷售客戶。

### ⑬ M 公司

M 公司成立於民國 99 年，資本額為人民幣 405,556 千元，為上海證券交易所科創板掛牌上市公司，係我國上市公司之子公司，主要提供面板驅動及電源管理之 IC 設計服務。M 公司主要委託該公司設計應用於 0.11 微米製程之 MTP SIP，並依照合約內容達成階段性里程碑後收取技術服務收入。

該公司 111~112 年度對 M 公司之銷售金額分別為 1,116 千元及 4,335 千元，占營收淨額比重分別為 0.49% 及 2.31%，112 年度銷售金額相較 111 年度增加，主係 112 年 M 公司委託該公司設計之 SIP 產品晶片已進入流片階段達成里程碑，同時 M 公司使用該公司多項 SIP 產品開發電子標籤、電子紙等驅動 IC，故技術服務收入成長，致 M 公司於 112 年度成為該公司第九大銷售客戶。

### (3) 是否有銷售集中之風險

該公司主要營業項目係從事嵌入式非揮發記憶體 SIP 授權及技術服務。該公司 111~112 年度前十大銷售客戶占各該年度營業收入比重分別為 75.96% 及 75.29%，並無單一銷售客戶占整體營收比率逾 20% 以上，經評估尚無銷貨集中之風險。

### (4) 該公司之銷售政策

臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，該公司憑

藉著小面積大容量之 MTP 關鍵核心技術，成為臺灣 IC 設計公司、整合元件公司及晶圓代工廠重要合作之 eNVM 矽智財廠商。未來公司發展策略聚焦於研發小面積單次或少量寫入次數之 SIP 產品，提前佈局先進製程應用，在 MTP 產品方面，該公司針對各種容量、面積大小及寫入次數等提供多樣化規格，擴展產品寬度增強客戶使用彈性以提高黏著度，並且持續研發第六代 MTP，專注於縮小面積提高產品深度，以關鍵技術打造護城河維持自身核心競爭力。

該公司 MTP 產品擁有業界中相同寫入次數中最小面積之技術優勢，既有客戶忠誠度高，且單一 IC 中通常會使用各種類型之 eNVM SIP，在同一設計架構下，客戶轉換使用 OTP 成本降低，將可逐步帶動新產品成長同時鞏固現有客戶，也透過既有客戶推廣 SIP 產品，以增加公司 SIP 流片量，後續將帶動技術服務收入及技術權利金收入成長，產品進入量產後將可形成一細水長流之營運模式。該公司深耕於產業 20 餘年，與各大晶圓代工廠保持良好互動關係，增加取得晶圓代工廠建置製程設計平台之開案機會，並且透過晶圓代工廠推廣 SIP 產品，觸及不同應用領域之終端客戶，再藉由參展及官網等行銷推廣通路，進而提升公司知名度及產品市占率

2. 最近期及最近二個會計年度各主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額，並分析最近期及最近二個會計年度主要之變化情形

該公司為一專業邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體 SIP 設計公司，係以收取技術服務費及權利金為主要營運模式，並無供應原物料等之供應商，故不適用本項評估。

(二) 最近期及最近二個會計年度，發行公司之財務報告及個體財務報告應收款項變動之合理性、備抵呆帳提列之適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估

該公司無須編制合併財務報告，故僅評估最近期及最近二年度個體財務報告應收款項變動合理性、備抵損失提列適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估。

1. 最近期及最近二年度個體應收款項變動合理性評估

單位：新台幣千元

項目	年度	個體財務報表	
		111 年度	112 年度
營業收入淨額		229,420	187,384

項目	年度	個體財務報表	
		111 年度	112 年度
應收款項總額(A)		24,304	16,486
減：備抵呆帳總額(B)		-	-
應收款項淨額(A)-(B)		24,304	16,486
備抵呆帳(B)占應收款項總額(A)比例(%)		-	-
應收款項週轉率(次)		10.41	9.18
應收款項收款天數(天)		35	39
授信條件	該公司主要係依據銷售客戶之財務狀況、營運規模、信用狀況及過往交易紀錄等因素，分別訂定不同之授信條件，授信天數主要介於 30 至 90 天。		

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告。

該公司 112 年度之應收款項總額為 16,486 千元，較 111 年度應收款項總額 24,304 千元減少 7,818 千元，變動比率為 32.17%，主係因 112 年受到全球景氣衰退影響，消費者購買力持續低迷，使 112 年該公司營業收入呈現衰退情形，致 112 年底應收款項金額較 111 年底下降。

應收款項週轉率及應收款項收現天數，該公司 111 年度及 112 年度之應收款項週轉率分別為 10.41 次及 9.18 次，應收款項收款天數分別為 35 天及 39 天；112 年度應收款項週轉率下降及應收款項收現天數上升，主係因半導體產業整體面臨產能過剩並進入庫存調整期，致晶圓出貨量下滑，使 112 年該公司技術權利金收入減少，致使應收帳款週轉率下滑。整體而言，該公司之應收款項及週轉率之變動情形，尚屬合理。

綜上所述，該公司最近二個會計年度之應收款項係隨營業收入而產生變化，且應收款項收款天數尚介於授信天數之間，經評估該公司應收款項變化情形尚屬合理，尚無重大異常之情事。

## 2. 應收款項備抵損失提列之適足性及收回可能性之評估

### (1) 備抵損失提列政策

該公司應收款項備抵損失提列政策係按存續期間預期信用損失認列應收款項之備抵損失，存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況、產業經濟情勢，並同時考量產業展望，依信用損失歷史經驗顯示，不同客戶群之損失型態並無顯著差異，因此準備矩陣未進一步區分客戶群，僅以應收款項逾期天數訂定預期信用損失率。

### (2) 應收款項備抵損失提列之適足性

該公司 111~112 年度皆無提列備抵呆帳。該公司備抵呆帳提列

政策係參酌過去之經營經驗並考量客戶信用品質，訂定備抵呆帳提列政策據以提列備抵呆帳，其提列金額已依政策執行，應足以涵蓋該公司應收款項可能發生壞帳之風險，且依照歷史經驗，尚無實際發生重大呆帳無法收回之情事，經評估其提列情形尚無重大異常。

(3) 應收款項收回之可能性

單位：新台幣千元

項目	112.12.31 金額	截至 113.02.29 收回情形		截至 113.02.29 未收回情形	
		金額	%	金額	%
應收票據	-	-	-	-	-
應收帳款	16,486	13,109	79.52	3,377	20.48
合計	16,486	13,109	79.52	3,377	20.48

資料來源：該公司提供

該公司 112 年度應收帳款總額為 16,486 千元，截至 113 年 2 月 29 日止已收回 13,109 千元，回收比率為 79.52%，未收回部分 3,377 千元，未收回比率為 20.48%，其中已逾期之款項金額 3,377 千元主係因銷售客戶內部作業不及延遲付款，其中逾期款項 1,842 千元已於 3 月初收回。經評估該公司 112 年度之應收款項餘額，截至 113 年 2 月底之收回情形，尚無發現重大異常之情形。

3. 與同業比較

單位：新台幣千元；%

項目 \ 年度		110 年度	111 年度	112 年度
營業收入淨額	億而得	168,192	229,420	187,384
	力旺	2,363,824	3,216,711	3,050,325
	晶心科	819,778	931,821	1,057,818
	M31	1,011,879	1,360,165	1,612,337
應收款項總額 (A)	億而得	19,758	24,304	16,486
	力旺	104,104	239,478	194,960
	晶心科	161,077	116,518	205,696
	M31	327,537	333,346	383,474
備抵呆帳(B)	億而得	-	-	-
	力旺	1,435	97	43
	晶心科	6,556	5,200	5,898
	M31	8,465	8,129	9,670
備抵呆帳占應 收款項總額比 例(B)/(A)	億而得	-	-	-
	力旺	1.38%	0.04%	0.02%
	晶心科	4.07%	4.46%	2.87%
	M31	2.58%	2.44%	2.52%
應收款項週轉	億而得	12.06	10.41	9.19
	力旺	20.25	18.56	14.05



項目		年度	110 年度	111 年度	112 年度
率(次)	晶心科		5.19	6.17	6.57
	M31		3.45	4.12	4.61
應收款項收款 天數(天)	億而得		30	35	39
	力旺		18	20	25
	晶心科		70	54	55
	M31		106	89	79

資料來源：各公司 111~112 年度經會計師查核簽證之財務報告。

該公司 111~112 年度之應收款項週轉率分別為 10.41 次及 9.19 次，應收款項週轉天數分別為 35 天及 39 天，其差異變化主係隨營收變動而略為增減，且應收帳款週轉天數均落於該公司對銷售客戶授信條件 30 至 90 天區間內，經評估，尚無重大異常之情事。

該公司由於收款情形良好，111~112 年度均無產生備抵呆帳，故備抵損失占應收款項總額比率均優於採樣同業，該公司係參酌過去之經營經驗並考量客戶信用品質，基於保守穩健之原則，訂定備抵損失提列政策據以提列備抵損失。經檢視該公司過去客戶往來經驗及收款情形，尚無發生呆帳無法收回之情事。

綜上所述，經評估該公司 111~112 年度，應收款項變動之合理性及應收款項期後收回情形尚無重大異常之情事。依據該公司過去客戶往來經驗及收款情形，尚無發生呆帳無法收回之情事，此外，該公司已根據財務準則公報、過去之經營情形、考量個別客戶應收帳款收回可能性，並參考以往年度收款情形，擬訂備抵呆帳提列政策並據以提列，經評估其提列金額之合理性及適足性，尚屬合理。

(三)最近期及最近二個會計年度發行人之財務報告及個體財務報告存貨淨額變動之合理性、母子公司備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估，並與同業比較評估。

該公司為一專業邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體 SIP 設計公司，係以收取技術服務費及權利金為主要營運模式，並無供應原物料等之供應商，故不適用本項評估。

(四)發行人最近期及最近二個會計年度財務報告之業績概況

1.列表並說明最近期及最近二個會計年度財務報告營業收入、營業毛利及營業利益與同業比較情形

單位：新台幣千元

分析項目	年度 公司	111 年度	112 年度	
		金額	金額	成長率
營業收入	億而得	229,420	187,384	(18.32)%
	力旺	3,216,711	3,050,325	(5.17)%
	晶心科	931,821	1,057,818	13.32%
	M31	1,360,165	1,612,337	18.54%
營業毛利	億而得	227,700	185,816	(18.39)%
	力旺	3,216,711	3,050,325	(5.17)%
	晶心科	931,090	1,056,995	13.52%
	M31	1,360,165	1,612,337	18.54%
營業利益	億而得	78,846	35,057	(55.54)%
	力旺	1,853,418	1,692,600	(8.68)%
	晶心科	(69,168)	(268,494)	288.18%
	M31	367,950	446,496	21.35%

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告。

該公司主係從事嵌入式非揮發性記憶體矽智財(簡稱 eNVM SIP) 技術之研究開發、功能設計及授權服務等業務，產品涵蓋 MTP(Multi-Time Programming，簡稱 MTP)、FTP(Few-Time Programming，簡稱 FTP)、EEPROM(Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory，簡稱 EEPROM)、Flash Memory 及 OTP(One-Time Programming，簡稱 OTP)等不同性質之記憶體模組，主要係提供自有專利 SIP 授權及 SIP 設計服務，綜觀目前國內上市櫃公司中，經考量比較公司之業務內容、營收獲利比重、應用產業、實收資本額及營收規模等，選擇營運模式以矽智財相關業務、產品性質應用領域較為相近之上櫃公司力旺(股票代號:3529)、上市公司晶心科(股票代號:6533)及上櫃公司 M31(股票代號:6643)。力旺專注於邏輯嵌入式非揮發性記憶體矽智財開發，其產品以 OTP 為主；晶心科主要提供嵌入式微處理器核心 SIP 及相關軟體發展平台等，為提供 RISC-V 處理器核心產品軟硬體解決方案的供應商；M31 主要從事基礎元件及高速傳輸 SIP 設計與記憶體設計。上述三家公司除力旺與該公司相同皆致力於開發 eNVM SIP 產品外，M31 與晶心科主要產品應用之領域與產業或有不同，惟主要皆為開發矽智財之公司，故選擇作為採樣公司。以下就該公司與採樣公司 111~112 年度之營業收入、營業毛利及營業利益變化情形進行說明：

#### (1)營業收入

該公司 111~112 年度營業收入分別為 229,420 千元及 187,384

千元。該公司 MTP 產品結合寫入次數較 OTP 高及成本較 Flash 低兩大優點，且其專利技術使 MTP 擁有同業中最小面積之優勢，陸續取得銷貨客戶認證，產品量產後客戶認同度逐漸提高，目前應用於消費性電子、車用電子及無線通訊領域等終端市場。

112 年度較 111 年度減少 42,036 千元，減少幅度達(18.32)%，111 年下半年開始，全球面臨高通膨、各國升息政策及地緣政治等負面影響，使得小型家電、個人電腦及顯示器等終端市場需求迅速滑落，半導體產業整體面臨產能過剩並進入庫存調整期，致晶圓出貨量下滑，使得 112 年該公司技術權利金收入減少，而該公司技術服務收入受到客戶使用已開發完成之 SIP 次數或客戶訂定合約之開發里程碑影響，致 112 年度該公司營業收入較 111 年度減少。

與同業相較，該公司營運規模相較採樣同業小，故以營收成長率進行比較。該公司 112 年度營業收入成長率低於採樣同業，主係因該公司股本及營收規模與採樣同業有所差異，受到整體產業影響致營收波動較為劇烈，其中採樣同業力旺營收收入組成與該公司較為相似，技術權利金占比亦超過 7 成，故同樣受到半導體產業影響，營業收入呈現負成長；而採樣同業 M31 及晶心科營收來源以階段性之技術服務收入為主，主要係依合約簽訂之里程碑開發進度認列營業收入。整體而言，該公司受限於目前營運規模較小，在經營策略有效佈局之下，持續維持研發量能以拓展產品應用範圍，已開發完成之技術服務產品逐漸發酵，後續收取之技術權利金將逐年成長，致客戶依存度提高，持續推升產品量產數量以擴大營運規模，其 111~112 年度之營業收入變化趨勢與同業相較，應無重大異常情事。

## (2)營業毛利

公司 \ 年度	111 年度	112 年度	
	比率	比率	成長率
億而得	99.25%	99.16%	(0.09)%
力旺	100.00%	100.00%	0.00%
晶心科	99.92%	99.92%	0.00%
M31	100.00%	100.00%	0.00%

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告。

註：截至評估報告出具日止，採樣同業尚未於公開資訊觀測站公告 112 年度財務資訊。

該公司 111~112 年度營業毛利分別為 227,700 千元及 185,816 千元，毛利率分別為 99.25%及 99.16%，該公司營業收入組成可分為技術權利金及技術服務收入，由於授權 SIP 毋須進貨，且 SIP 產

品的投入研發存有量產成功的不確定性，故研發人員薪資及開發支出等相關費用多數列入當年度之研究發展費用，惟委託設計專案係屬客製化服務，尚可歸屬部分研發費用，致技術服務收入產生少量營業成本，毛利率接近 100%，該公司 111~112 年度，毛利率皆低於採樣同業，主係因採樣同業力旺、M31 皆將 SIP 開發費用認列為當年度之研究發展費用，惟採樣同業晶心科尚有印刷電路板進貨等需求，致毛利率有所變動，該公司 111~112 年度之毛利率均維持於 99% 以上，與採樣同業晶心科相同，其營業毛利率之變化趨勢與同業相較，應無重大異常情事。

### (3)營業利益

公司 \ 年度	111 年度	112 年度	
	比率	比率	成長率
億而得	34.37%	18.71%	(45.56)%
力旺	57.62%	55.49%	(3.70)%
晶心科	(7.42)%	(25.38)%	241.94%
M31	27.05%	27.69%	2.37%

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告。

該公司 111~112 年度營業利益分別為 78,846 千元及 35,057 千元，營業利益率分別為 34.37% 及 18.71%，112 年度營業利益較 111 年度減少，係晶圓出貨量受到半導體產業景氣影響而下滑，使得技術權利金收入減少，且 111 年獲利大幅成長，故估列員工酬勞及董事酬勞增加，同時為維持穩定研發量能，使得研究發展費用增加，致營業利益及營業利益率較 111 年度減少(55.54)%及(45.56)%。

與同業相較，該公司 112 年度營業利益成長率為負成長，主係該公司持續研發並積極拓展業務，尚處於營運規模擴張階段，而與營收收入組成與該公司較為相似之採樣同業力旺相比，112 年度營業利益同樣受到半導體整體產業影響，皆呈現衰退情形，故其 111~112 年之營業利益之變化趨勢，應無重大異常情事。

綜上所述，該公司 111~112 年度之營業收入、營業毛利及營業利益變動情形及與同業比較，尚無重大異常情事。

2.列表並說明最近期及最近二個會計年度財務報告以「部門別」或「主要產品別」之營業收入、營業成本及營業毛利之變化情形是否合理

#### (1)產品別營業收入變動表

單位：新台幣千元

年度 產品別	111 年度		112 年度	
	金額	%	金額	%
技術服務	58,821	25.64	48,082	25.66
技術權利金	170,599	74.36	139,302	74.34
總計	229,420	100.00	187,384	100.00

資料來源：該公司提供。

#### (2) 產品別營業成本變動表

單位：新台幣千元

年度 產品別	111 年度		112 年度	
	金額	%	金額	%
技術服務	1,720	100.00	1,568	100.00
技術權利金	-	-	-	-
總計	1,720	100.00	1,568	100.00

資料來源：該公司提供。

#### (3) 產品別營業毛利變動表

單位：新台幣千元

年度 產品別	111 年度		112 年度	
	金額	%	金額	%
技術服務	57,101	25.08	46,514	25.03
技術權利金	170,599	74.92	139,302	74.97
總計	227,700	100.00	185,816	100.00

資料來源：該公司提供。

#### (4) 主要產品別之營業收入、營業成本及營業毛利變化情形

該公司 eNVM SIP 主要應用於 MCU、電源管理、無線電充、顯示器及電子紙等晶片，終端產品涵蓋消費性電子、車用電子、及無線通訊領域等應用市場。根據授權服務內容及交易模式不同，該公司營業收入組成可分為技術服務收入及技術權利金收入，茲將各類別之營業收入、營業成本及營業毛利等變化情形說明如下：

##### ① 技術服務收入

該公司技術服務收入可依服務性質區分為委託設計開發收入(NRE)及使用收入(Usage)，NRE 係指該公司根據客戶所要求之規格製作 SIP 區塊，並於開發過程中達到特定階段里程碑時收取開發設計費用；Usage 係針對客戶使用已開發且驗證完成 SIP 或已於晶圓代工廠上架之既有 SIP，依其使用於自身產品次數收取固定費用。111~112 年度之技術服務收入金額分別為 58,821 千元及 48,082 千元，占營收淨額比重分別為 25.64% 及 25.66%。該公司 112 年度銷售金額較 111 年度減少 10,739 千元，衰退率為 18.26%，主係自 111 年下半年開始，全

球面臨高通膨、各國升息政策及地緣政治等負面影響，使得小型家電、個人電腦及顯示器等終端市場需求迅速滑落，IC 設計公司隨即面臨庫存過高、存貨去化速度緩慢等問題，在調整庫存之際，IC 設計公司持續減緩開發新案之速度，導致該公司使用收入減少；惟受到美國發佈對中國之晶片禁令，中國大陸全力扶植國內半導體產業，興建晶圓代工廠並加強發展 IC 設計公司，多數已達成開案或投片里程碑，使委託設計開發收入小幅成長，整體而言，該公司 112 年度技術服務收入僅呈現微幅減少之態勢。

該公司 111~112 年度之技術服務收入之營業成本分別為 1,720 千元及 1,568 千元，營業毛利分別為 57,101 千元及 46,514 千元，各期營業毛利率分別為 99.25% 及 99.16%。在營業成本及營業毛利方面，根據產業特性，矽智財的研究需經由長時間開發，且存有量產成功的不確定性，故以投入研發時將相關成本予以費用化，惟委託開發設計偏向客製化服務，尚可歸屬部分開發費用，故產生少量之技術服務成本，且最近期及最近二年度該公司毛利率均維持於 99% 以上，其變動差異不大，應無重大異常之情形。

#### ②技術權利金收入

技術權利金係該公司經晶圓代工廠驗證之 SIP 產品，於客戶採用並量產時，依據晶圓代工廠之晶圓價格或 IC 設計公司依其自行量產晶圓價格，由該公司收取一定比例權利金，並於每季出具生產產量報表，以計算權利金金額。111~112 年度技術權利金收入金額分別為 170,599 千元及 139,302 千元，占營收淨額比重分別為 74.36% 及 74.34%，112 年度技術權利金收入金額較 111 年度減少 31,297 千元，衰退率為 18.35%，主係自 111 年下半年開始，國際通貨膨脹使各國央行逐步調升利率，全球總經濟成長疲軟，消費性電子市場需求急速跌落，晶片供貨量趨於穩定，IC 設計公司隨即面臨高庫存壓力致晶圓出貨量大幅下滑，進而影響該公司技術權利金收入減少。在營業成本及營業毛利方面，技術權利金收入並無銷貨成本，係源自於已開發完成之既有技術或技術服務授權衍生之後續相關收入，且在研發時程中開發人員相關費用均列為當年度研發費用，使技術權利金之毛利率均為 100%。

綜上評估，該公司最近期及最近二個會計年度主要產品項目之營業收入、營業成本及營業毛利隨著授權 SIP 數量、市場需求及客戶量產投片情況而產生變動，分析其營業收入、營業成本及營業毛利之變化原因尚無重大異常。

3. 最近期及最近二個會計年度財務報告營業收入或毛利率變動達 20% 以上者，應做價量分析變動原因，並敘明是否合理

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	110 年度	111 年度		112 年度	
	金額	金額	變動率	金額	變動率
營業收入	168,192	229,420	36.40%	187,384	(18.32)%
毛利率	99.21%	99.25%	0.04%	99.16%	(0.09)%

資料來源：各期經會計師查核簽證之財務報告。

由上表可得知，該公司 111~112 年度之營業收入變動率分別為 36.40% 及 (18.32)%，毛利率變動率分別為 0.04% 及 (0.09)%。111 年度之營業收入變動有達 20% 以上之情事。因該公司營業收入來源，主要係客戶委託開發設計 SIP 或客戶使用該公司既有 SIP 收取之技術服務收入，以及與客戶開發完成之 SIP，依據客戶出貨量收取之技術權利金，各項授權簽約金受到授權範圍、SIP 數量、晶圓價格、客戶量產投片數量等情形有所不同，故不具價量關係，僅針對該公司於 111 年度之營業收入變動原因說明如下：

該公司於 111 年度之營業收入變動率為 36.40%，變動達 20% 以上，惟其變動原因請詳前述「參、一、(四)、1、(1)營業收入」之分析。

(五)最近二個會計年度及截至承銷商評估報告出具日止，發行人及其各子公司（包括母子公司間交易事項）與關係人交易之評估

1. 與關係人間業務交易往來情形，以評估其有無涉及非常規交易情事，如屬銷貨予關係人者，則再評估授信政策、交易條件、款項收回、所售產品關係人後續投入生產或再銷售之情形及其合理性，如未符一般交易常規，其差異之原因及合理性。

該公司最近二個會計年度及截至承銷商評估報告出具日止並無產生關係人交易，故不適用本項評估。2. 發行人與同屬關係企業公司之主要業務或產品(指最近二個會計年度均佔該年度總營業收入百分之三十以上者)，有無互相競爭情形：

該公司並無同屬關係企業公司，故不適用本項評估。

## 二、財務狀況

(一)列表並說明最近期及最近二個會計年度財務比率之分析，與同類別上市公司及未上市同業財務比率之比較分析，應包括財務結構、償債能力、經營能力及獲利能力

### 1. 選擇採樣公司之理由

該公司主要從事 eNVM SIP 之技術開發、設計及授權。經檢視其相關產業及同業資料，以目前國內上市及上櫃公司中從事 SIP 相關業務之廠商為選樣標準，故選取上櫃公司力旺(股票代碼：3529)，主要從事 eNVM 技術開發與 SIP 授權業務，產品涵蓋 OTP、MTP 與快閃記憶體等，為全球首創邏輯製程 eNVM SIP 廠，其邏輯製程 SIP 技術市佔為全球第一；上市公司晶心科(股票代碼：6533)，其主要專注於嵌入式處理器矽智財及相關技術的研發與服務，致力於提供低功耗高效能處理器及周邊平台 SIP，與必要之開發工具及軟體，產品應用範圍包含消費、網通、車用、工業及醫療等電子產品；上櫃公司 M31(股票代碼：6643)，主係為專業之積體電路矽智財技術研發及授權服務廠商，其主要技術與產品可應用於基礎元件及高速介面等領域；同業平均資料則選用財團法人金融聯合徵信中心出版之「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」中之「專業、科學及技術服務業」資料，作為同業平均之比較數據。

### 2. 最近期及最近二個會計年度經會計師核閱或查核簽證財務報告之損益狀況

單位：新台幣千元；%

分析項目	年度 公司	111 年度	112 年度		
		金額	金額	變動 金額(註 1)	變動 比率(註 2)
營業收入	億而得	229,420	187,384	(42,036)	(18.32)
	力旺	3,216,711	3,050,325	(166,386)	(5.17)
	晶心科	931,821	1,057,818	125,997	13.52
	M31	1,360,165	1,612,337	252,172	18.54
營業成本	億而得	1,720	1,568	(152)	(8.84)
	力旺	-	-	-	-
	晶心科	731	823	92	12.59%
	M31	-	-	-	-
營業毛利	億而得	227,700	185,816	(41,884)	(18.39)
	力旺	3,216,711	3,050,325	(166,386)	(5.17)



分析項目	年度 公司	111 年度	112 年度		
		金額	金額	變動 金額(註 1)	變動 比率(註 2)
	晶心科	931,090	1,056,995	125,905.00	13.52%
	M31	1,360,165	1,612,337	252,172	18.54
營業費用	億而得	148,854	150,759	1,905	1.28
	力旺	1,363,293	1,357,725	(5,568)	(0.41)
	晶心科	1,000,258	1,325,489	325,231	32.51%
	M31	992,215	1,165,841	173,626	17.50
營業(損)益	億而得	78,846	35,057	(43,789)	(55.54)
	力旺	1,853,418	1,692,600	(160,818)	(8.68)
	晶心科	(69,168)	(268,494)	(199,326)	288.18%
	M31	367,950	446,496	78,546	21.35
營業外收入 及支出	億而得	2,525	3,210	685	27.13
	力旺	55,506	58,392	2,886	5.20
	晶心科	452,918	169,402	(283,516)	(62.60)
	M31	75,179	66,820	(8,359)	(11.12)
本期淨利 (損)	億而得	72,964	32,017	(40,947)	(56.12)
	力旺	1,604,141	1,462,657	(141,484)	(8.82)
	晶心科	355,937	(101,718)	(457,655)	(128.58)
	M31	379,252	435,170	55,918	14.74
本期其他綜 合損益	億而得	1,597	(3)	(1,600)	(100.19)
	力旺	(2,973)	1,884	4,857	(163.37)
	晶心科	6,224	(552)	(6,776)	(108.87)
	M31	(773)	19	792	(102.46)
本期綜合損 益總額	億而得	74,561	32,014	(42,547)	(57.06)
	力旺	1,601,168	1,464,541	(136,627)	(8.53)
	晶心科	362,161	(102,270)	(464,431)	(128.24)
	M31	378,479	435,189	56,710	14.98

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告。

註 1：較前一年度相同期間之增減金額。

註 2：較前一年度相同期間之增減比率。

(1)營業收入、營業成本及營業毛利

請參閱本評估報告參、一、(四)業績概況之說明。

(2)營業費用及營業利益

單位：新台幣千元；%

項目	111 年度		112 年度	
	金額	占營收比率	金額	占營收比率
推銷費用	11,538	5.03	12,056	6.43
管理費用	29,486	12.85	30,576	16.32
研究發展費用	107,830	47.00	108,127	57.70
營業費用合計	148,854	64.88	150,759	80.45
營業利益	78,846	34.37	35,057	18.71

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告。

①營業費用

該公司 111~112 年度營業費用分別為 148,854 千元及 150,759 千元，營業費用率分別為 64.88%及 80.45%，茲就各費用類別之變化原因說明如下：

A.推銷費用

在推銷費用方面，該公司於 111~112 年度分別為 11,538 千元及 12,056 千元，占各期營業收入比重分別為 5.03%及 6.43%，主要係業務單位人員之薪資支出、佣金支出、折舊費用及運雜費用等項目。112 年度推銷費用較 111 年度增加 518 千元，增幅為 4.49%，主要係透過中介之技術服務收入開案致佣金支出增加、參展及拜訪客戶致旅費及廣告費增加。

B.管理費用

該公司 111~112 年度分別為 29,486 千元及 30,576 千元，占各期營業收入比重分別為 12.85%及 16.32%，主要係管理單位人員之薪資支出、獎金、折舊費用、各項攤提、勞務費、董事酬勞及員工酬勞等項目。112 年度管理費用較 111 年度增加 1,090 千元，增幅為 9.45%，主要係委託會計師出具內控專審報告致勞務費增加所致。

C.研究發展費用

該公司 111~112 年度研發費用分別為 107,830 千元及

108,127 千元，占營收比重為 47.00% 及 57.70%。該公司研發費用主要投入於產品之開發上，主要係研發單位人員之薪資支出、獎金、折舊及攤提等項目。112 年度研究發展費用較 111 年度增加 297 千元，增幅為 0.28%，主要係參展及拜訪客戶使旅費增加所致。

## ②營業利益

該公司 111~112 年度營業利益分別為 78,846 千元及 35,057 千元，營業利益率分別為 34.37% 及 18.71%。該公司 112 年度營業利益較 111 年度減少，係晶圓出貨量受到半導體產業景氣影響而下滑，使得技術權利金收入減少，且 111 年度獲利大幅成長，故估列員工酬勞及董事酬勞增加，致營業利益較 111 年度減少 (55.54)%

綜上所述，該公司 111~112 年度之營業費用及營業利益之變化情形，尚屬合理。

## (3)營業外收入及支出

單位：新台幣千元

項目	年度	111 年度	112 年度
利息收入		1,539	3,190
其他收入		10	1
其他利益及損失(淨外幣兌換利益)		1,082	70
財務成本		(106)	(51)
營業外收入及支出合計		2,525	3,210
營業外收入及支出占營業收入淨額比率(%)		1.10	1.71

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告

### ①利息收入

該公司 111~112 年度利息收入金額分別為 1,539 千元及 3,190 千元，主要係 111 年央行升息使金融機構之定存利息收入增加所致。

### ②其他收入

該公司 111~112 年度其他收入金額分別為 10 千元及 1 千元，主要係退稅、補助及下腳收入。

### ③其他利益及損失

該公司 111~112 年度之其他利益及損失分別為 1,082 千元及 70 千元，主要係外幣兌換之匯差，該公司營業收入多以美金為計價幣別，112 年度因美國通貨膨脹情形尚未緩解，美國聯準會持續升息予以因應，致美元兌新臺幣匯率升值，使得該公司 112 年度產生兌換利益 70 千元，經評估尚無重大異常之情事。

#### ④財務成本

該公司 111~112 年度財務成本分別為 106 千元及 51 千元，主係為租賃負債所認列之財務成本，並受到租賃負債期間產生變動。

#### (4)本期淨利、本期其他綜合損益及本期綜合損益總額

單位：新台幣千元；%

項目	年度	111 年度	112 年度
	本期淨利		72,964
本期淨利占營收淨額比率		31.80	17.09
本期其他綜合損益		1,597	(3)
本期綜合損益總額		74,561	32,014

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告

該公司 111~112 年度本期淨利分別為 72,964 千元及 32,017 千元，占營收淨額比率分別為 31.80%及 17.09%，而本期其他綜合損益分別為 1,597 千元及(3)千元；本期綜合損益總額分別為 74,561 千元及 32,014 千元。112 年度主要係受消費性電子產品終端需求疲弱且 IC 設計公司存貨尚在去化，致營業收入下滑，營業毛利較 111 年度下降所致。

綜上所述，該公司 111~112 年度之損益變動情形尚屬合理，與採樣同業相較尚無重大異常之情事。

#### 3.最近期及最近二個會計年度財務比率分析及與同業比較分析

分析項目	年度	111 年度	112 年度	
	財務結構	公司名稱		
億而得		15.92	13.60	
力旺		20.65	18.73	
晶心科		8.12	9.84	
M31		21.54	13.93	
負債占資產比率 (%)	同業	29.20	註 2	
	長期資金占不動產、廠房及設備比	億而得	2,523.48	3,935.21
		力旺	675.20	648.01

分析項目		年度		
		公司名稱	111 年度	112 年度
	率(%)	晶心科	6,814.61	5,117.80
		M31	326.14	368.60
		同業	561.80	註 2
償債能力	流動比率(%)	億而得	622.35	714.20
		力旺	423.72	428.46
		晶心科	1,377.56	903.69
		M31	328.50	507.33
		同業	330.20	註 2
	速動比率(%)	億而得	620.26	708.87
		力旺	420.51	424.38
		晶心科	1,356.14	863.76
		M31	317.23	493.79
		同業	237.30	註 2
	利息保障倍數(倍)	億而得	767.34	750.33
		力旺	13,257.42	3,962.52
		晶心科	222.82	(4,355.58)
		M31	1,745.60	1510.75
		同業	5,211.30	註 2
經營能力	應收款項週轉率(次)	億而得	10.41	9.19
		力旺	18.56	13.94
		晶心科	6.71	6.57
		M31	4.12	4.50
		同業	6.90	註 2
	應收款項收款天數(天)	億而得	35.06	39.71
		力旺	20	26.18
		晶心科	54	55.55
		M31	88.59	81.11
		同業	53	註 2
	存貨週轉率(次)	億而得	-	-
		力旺	-	-
		晶心科	0.34	0.3
		M31	-	-
		同業	-	註 2
平均售貨天數(天)	億而得	-	-	
	力旺	-	-	
	晶心科	1,073.52	1,216.66	

分析項目		年度			
		公司名稱	111 年度	112 年度	
		M31	-	-	
		同業	-	註 2	
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	億而得	14.43	17.03	
		力旺	6.98	6.53	
		晶心科	18.75	12.35	
		M31	2.18	2.85	
		同業	3.80	註 2	
		總資產週轉率(次)	億而得	0.60	0.48
	力旺		0.91	0.80	
	晶心科		0.18	0.20	
	M31		0.63	0.68	
	同業		0.60	註 2	
	獲利能力	資產報酬率(%)	億而得	19.14	8.25
			力旺	45.28	38.22
			晶心科	6.84	(1.86)
M31			17.63	18.28	
同業			6.80	註 2	
權益報酬率(%)		億而得	22.49	9.68	
		力旺	58.24	48.47	
		晶心科	7.29	(2.08)	
		M31	22.04	22.20	
		同業	9.60	註 2	
營業利益占實收資本額比率(%)		億而得	29.41	13.08	
		力旺	243.28	226.76	
		晶心科	(13.66)	(53.01)	
		M31	116.08	128.06	
		同業	註 1	註 2	
稅前純益占實收資本額比率(%)		億而得	30.35	14.27	
		力旺	250.57	234.58	
		晶心科	75.76	(19.56)	
		M31	139.80	147.30	
		同業	註 1	註 2	
純益率(%)	億而得	31.80	17.09		
	力旺	49.87	47.95		
	晶心科	38.20	(9.62)		
	M31	27.88	26.99		

分析項目		年度		
		公司名稱	111 年度	112 年度
	每股盈餘 (元)	同業	9.80	註 2
		億而得	2.72	1.19
		力旺	21.61	19.76
		晶心科	7.03	(2.01)
		M31	12.16	12.60
		同業	註 1	註 2
現金 流量	現金流量比率(%)	億而得	187.83	129.61
		力旺	213.76	221.25
		晶心科	223.71	(17.35)
		M31	128.99	74.01
		同業	(9.70)	註 2
	淨現金流量允當比 率(%)	億而得	429.00	242.00
		力旺	142.40	123.06
		晶心科	87.94	53.21
		M31	106.45	100.64
		同業	註 1	註 2
	現金再投資比率(%)	億而得	22.20	註 4
		力旺	19.45	註 3
		晶心科	13.02	註 3
		M31	19.77	註 3
		同業	(2.40)	註 2

資料來源：1.各公司 111~112 年度經會計師查核簽證之財務報告；各公司公開資訊觀測站揭露之財務分析資料；及兆豐證券計算之財務分析資料。

2.同業資料係摘自財團法人金融聯合徵信中心出版之「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」。

註 1：「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」並未揭露該資訊。

註 2：截至評估報告出具日止，該期間之「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」尚未出具。

註 3：現金再投資比率因營業活動淨現金流量扣除現金股利後為負數，故未予列示。

註 5：財務分析之計算公式說明：

#### 1.財務結構

(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額。

#### 2.償債能力

(1)流動比率=流動資產/流動負債。

(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

### 3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)淨額。

(2)應收款項收款天數=365/應收款項(含應收票據)週轉率。

(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨總額。

(4)平均售貨天數=365/存貨週轉率

(5)不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

(6)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。

### 4.獲利能力

(1)資產報酬率=[稅後損益+利息費用×(1-稅率)]/平均資產總額。

(2)權益報酬率=稅後損益/平均權益淨額。

(3)營業利益占實收資本額比率=營業利益/實收資本額。

(4)稅前利益占實收資本額比率=稅前利益/實收資本額。

(5)純益率=稅後損益/銷貨淨額。

(6)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數。

### 5.現金流量

(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。

(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。

(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)。

## 4.財務比率變動分析及與同業之比較分析說明

### 1. 財務結構

#### (1)負債占資產比率

該公司 111~112 年度之負債占資產比率分別為 15.92%及 13.60%，112 年度負債占資產比率較 111 年度下降，主係該公司 112 年度營收下滑，估列之員工紅利及董事酬勞等流動負債減少所致。

與採樣公司及同業比較，該公司 111~112 年度之負債占資產比率均介於採樣同業之間，經評估尚無重大異常。

#### (2)長期資金占不動產、廠房及設備比率



該公司 111~112 年度之長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為 2,523.48%及 3,935.21%，112 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率較 111 年度上升，主係該公司 112 年度未有新增重大之不動產、廠房及設備，原有資產折舊後使不動產、廠房及設備淨額進一步減少所致。

與採樣公司及同業比較，該公司 111~112 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率均優於力旺、M31 及同業，低於晶心科。整體而言，該公司 111~112 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率皆達 100%以上，顯示該公司長期資金尚足以支應不動產、廠房及設備之支出，經評估尚無重大異常。

整體而言，該公司之財務結構良好，且長期資金支應不動產、廠房及設備能力尚屬健全，其變化情形尚無重大異常情事。

## 2. 償債能力

### (1) 流動比率及速動比率

該公司 111~112 年度之流動比率為 622.35%及 714.20%，速動比率為 620.26%及 708.87%。112 年度受到營收下滑影響，致營業活動淨現金流量相較於 111 年度減少，惟年底估列之員工及董事酬勞下滑，使得流動負債減幅較大，致 112 年度之流動比率及速動比率上升。

該公司 111~112 年度流動比率及速動比率介於採樣公司及同業平均間，且均高於 100%，顯示該公司流動性尚屬良好，經評估尚未發現重大異常情事。

### (2) 利息保障倍數

該公司 111~112 年度之利息保障倍數分別為 767.34 倍及 750.33 倍。該公司之利息費用組成項目為租賃負債之利息，112 年度雖因營收下滑，致稅前息前淨利較 111 年度減少，然該公司 112 年度租賃負債之利息也較 111 年度減少約 50%，故使 112 年度利息保障倍數仍與 111 年度相當。

與採樣公司及同業相較，該公司 111~112 年度皆高於晶心科、低於力旺、M31 及同業平均，經評估尚無重大異常情事。

整體而言，該公司 111~112 年度之流動比率、速動比率及利息

保障倍數等指標變化尚屬健全，顯示該公司償債能力尚屬允當。

### 3. 經營能力

#### (1) 應收款項週轉率及應收款項收現天數

該公司 111~112 年度應收款項週轉率分別為 10.41 次及 9.19 次，應收款項收款天數分別為 35 天及 39 天。該公司 112 年度營業收入較 111 年度減少，使 112 年度平均應收帳款較 111 年度增加，故應收款項週轉率下降、應收款項收款天數至 39 天。

與採樣公司及同業比較，該公司 111~112 年度應收款項週轉率高於晶心科、M31 及同業平均、低於力旺。整體而言，該公司 111~112 年度均落於其對銷售客戶主要授信期間 30 至 90 天區間內，經評估尚無重大異常之情事。

#### (2) 存貨週轉率及平均售貨天數

該公司 111~112 年度均無存貨，故存貨週轉率及存貨週轉天數不適用。

#### (3) 不動產、廠房及設備週轉率

該公司 111~112 年度之不動產、廠房及設備週轉率分別為 14.43 次及 17.03 次，112 年度營業收入雖較 111 年度下滑，惟不動產、廠房及設備淨額減少比率仍較營業收入減少比率高，致不動產、廠房及設備週轉率較 111 年度上升。

與採樣公司及同業比較，111 年度高於力旺、M31 及同業平均、低於晶心科；112 年度則高於所有採樣同業，經評估尚無重大異常之情事。

#### (4) 總資產週轉率

該公司 111~112 年度之總資產週轉率分別為 0.60 次及 0.48 次。112 年度營業收入較 111 度減少，致總資產週轉率下滑。

與採樣公司及同業比較，111~112 年度皆高於晶心科，低於力旺、M31 及同業平均，經評估尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司 111~112 年度各項經營能力指標變化情形尚屬健全，與採樣公司及同業比較，尚無重大異常之情事。

#### 4. 獲利能力

##### (1) 資產報酬率及權益報酬率

該公司 111~112 年度資產報酬率為 19.14%及 8.25%，權益報酬率則分別 22.49%及 9.68%。112 年度資產報酬率及權益報酬率均較 111 年度下降，主係該公司受到下游廠商調整庫存等影響，致權利金收入較 111 年度下降，使稅前損益減少所致。

與採樣公司及同業比較，111 年度資產報酬率高於晶心科、M31 及同業平均、低於力旺；112 年度資產報酬率低於力旺及 M31。111 年度權益報酬率高於晶心科、M31 及同業平均、低於力旺；112 年度權益報酬率則高於晶心科、低於力旺及 M31，經評估並無重大異常情事。

##### (2) 營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率

該公司 111~112 年度營業利益占實收資本額為 29.41%及 13.08%，稅前純益占實收資本額比率則分別為 30.35%及 14.27%，112 年度受下游廠商調整庫存之影響，該公司營收較 111 年度減少，致營業利益及稅前純益占實收資本額比率皆較 111 年度下滑。

與採樣公司及同業比較，該公司營業利益占實收資本額 111 年度高於晶心科、低於力旺、M31，112 年度則低於力旺、M31。而 111 年度之稅前純益占實收資本額比率均低於採樣同業；112 年度則高於晶心科、低於力旺、M31，經評估並無重大異常情事。

##### (3) 純益率及每股盈餘

該公司 111~112 年度純益率為 31.80%及 17.09%，每股盈餘分別為 2.72 元及 1.19 元。而 112 年度純益率較 111 年度下降，主係受下游廠商庫存去化之影響，使該公司收取之權利金減少，致純益率下降。

與採樣公司及同業比較，111 年度高於 M31 及同業平均、低於力旺及晶心科，112 年度高於晶心科、低於力旺及 M31；另在每股盈餘方面，111 年度低於所有採樣公司，112 年度則高於晶心科、低於力旺及 M31，主係該公司整體規模尚較採樣同業小，經評估尚無重大異常。

整體而言，該公司 111~112 年度獲利能力等各項指標變化尚屬

合理，未發現重大異常之情事。

## 5. 現金流量

### (1) 現金流量比率

該公司 111~112 年度之現金流量比率為 187.83%及 129.61%，112 年度現金流量比率較 111 年度下降，主係 112 年度稅前淨利較 111 年度減少約 52.97%，致 112 年度現金流量比率較 111 年度減少。

與採樣公司及同業比較，該公司 111 年度之現金流量比率高於 M31 及同業平均、低於力旺及晶心科；112 年度則高於晶心科及 M31、低於力旺，經評估後，尚無發現重大異常。

### (2) 淨現金流量允當比率

該公司 111~112 年度之淨現金流量允當比率為 429.00%及 242.00%，112 年度淨現金流量允當比率較 111 年度下降，主係 111 年度營運良好，並於 112 年度發放 111 年度之現金股利，加上 112 年度營收較 111 年度減少，致 112 年度淨現金流量允當比率下降。

與採樣公司及同業比較，111~112 年度皆高於所有採樣公司，經評估尚無發現重大異常。

### (3) 現金再投資比率

該公司 111 年度之現金再投資比率為 22.20%，112 年度之現金再投資比率因該公司營業活動淨現金流量扣除現金股利後為負數，故不予列式。

與採樣公司及同業比較，該公司 111 年度均高於所有採樣公司；112 年度該公司與採樣同業皆呈現負數，經評估尚無發現重大異常。

整體而言，該公司 111~112 年度現金流量相關比率之變化尚屬合理，經評估應無重大異常之情形。

(二)發行人及其各子公司（包括母子公司間交易事項）最近期及最近二個會計年度背書保證、重大承諾、資金貸與他人、衍生性金融商品交易之情形及重大資產交易之情形，並評估其對公司財務狀況之影響

#### 1. 背書保證情形

該公司已訂定「背書保證作業程序」，並經董事會及股東會決議通過後實施，以作為辦理背書保證作業之依據。經查閱該公司 111~112 年度經會計師查核簽證之財務報告、董事會議事錄及背書保證備查簿等，該公司最近二年度及申請年度截至最近期止未有為他人背書保證之情形。

## 2. 重大承諾事項

該公司已訂定「負債承諾及或有事項管理辦法」，並經董事會決議通過後實施，作為該公司從事相關交易之依據。經查閱該公司 111~112 年度及 113 年截至最近期止經會計師查核簽證之財務報告、董事會及股東會議事錄，尚無發現該公司有任何重大承諾事項。

## 3. 資金貸與他人之情形

該公司已訂定「資金貸與他人作業程序」並經董事會及股東會決議通過後實施，以作為資金貸與他人之依據。經查閱該公司 111~112 年度及 113 年截至最近期止經會計師查核簽證之財務報告、董事會議事錄及資金貸與他人備查簿等，該公司最近二年度及申請年度截至最近期止未有資金貸與他人之情形。

## 4. 衍生性商品交易

該公司已訂定「取得或處分資產處理準則」，並經董事會及股東會決議通過後實施，作為該公司從事衍生性商品交易之依據。經查閱該公司 111~112 年度及 113 年截至最近期止經會計師查核簽證之財務報告及董事會議事錄，該公司最近二年度及申請年度截至最近期止並無從事衍生性商品交易之情形。

## 5. 重大資產交易

該公司已訂定「取得或處分資產處理準則」，並經董事會及股東會決議通過後實施，作為該公司從事重大資產交易之依據。經查閱該公司 111~112 年度及 113 年截至最近期止經會計師查核簽證之財務報告及董事會議事錄，該公司最近二年度及申請年度截至最近期止並無從事重大資產交易之情形。

綜上所述，該公司最近二年度及 113 年截至評估報告出具日並無從事背書保證、重大承諾、資金貸與他人、衍生性商品交易及重大資產交易之情形，尚不致對該公司財務狀況造成重大不利影響。

### (三)發行人最近期及最近二個會計年度資金募集及每股盈餘變化情形

#### 1. 最近期及最近二年度資金募集及每股盈餘變化情形

單位：新台幣千元

項目		年度	111 年度	112 年度
期	初	股 本	268,100	268,100
現	金	增 資	—	—
期	末	股 本	268,100	268,100
營	業	收 入	229,420	187,384
營	業	淨 利	78,846	35,057
稅	後	淨 利	72,964	32,017
每股稅後盈餘	追溯前(註 1)		2.72	1.19
(元)	追溯後(註 2)		2.72	1.19

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告

註 1：係以當年度加權平均流通在外股數計算之基本每股稅後盈餘。

註 2：係以 112 年 12 月 31 日為基準往前追溯調整之基本每股稅後盈餘。

## 2. 評估所募集資金是否允當運用並產生合理效益

請參閱本評估報告「肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論」之說明。

## 3. 對每股盈餘稀釋之影響

請參閱本評估報告「肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論」之說明。

(四) 本次募資計畫如用於償債或用於充實營運資金者，現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源、用途及預計效益。前各次現金增資、併購或受讓公司股份發行新股或發行公司債計劃實際完成日距本次申報時尚未逾三年，且增資計畫係用於償債或用於充實營運資金者，前所提現金收支預測表中之重大資本支出及長期股權投資項目預計效益之達成情形

1. 本次募資計畫如用於償債或用於充實營運資金者，現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源用途及預計效益。

該公司本次募集資金計畫係用於充實營運資金，經檢視該公司所編製 113 及 114 年度之現金收支預測表，該公司未來有資本支出合計之金額達本次募資金額百分之六十之情事，請參閱本評估報告「陸、

三、本次募集與發行有價證券資金計畫如用於轉投資、償債、充實營運資金、購買營建用地、支付營建工程款、購買未完工程並承受賣方未履行契約者，其必要性及合理性」之說明。

2.前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債計畫實際完成日距本次申報時尚未逾三年，且增資計畫係用於償債或用於充實營運資金者，前所提現金收支預測表中之重大資本支出及長期股權投資項目預計效益之達成情形。

該公司前各次現金增資計畫實際完成日距本次申報時已逾三年，且其增資計畫係用於償債或用於充實營運資金者為 111 年 6 月辦理現金增資發行新股案，該計畫已執行完畢，其相關計畫內容及執行情形請參閱本評估報告「肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形」之說明。

#### (五)發行人其他特殊財務狀況

經查閱該公司最近期及最近二個會計年度經會計師查核簽證之財務報告，該公司並無其他特殊財務狀況。

**肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論**

本承銷商已依「中華民國證券商同業公會證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商報告之評估查核程序」規定查核完成，所獲致結論如下：

- 一、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫尚未完成者之執行狀況，如執行進度未達預計目標者，應再具體評估其落後原因之合理性、對股東權益之影響及是否有具體改善計畫

該公司截至評估報告出具日止，前各次募集與發行有價證券計畫均已執行完畢，尚無執行進度未達預計目標之情形，且該公司並無併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫尚未完成之情事，故不適用本項評估。

- 二、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫如經重大變更且尚未完成者，應說明其變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因及變更前後效益

該公司截至評估報告出具日止，該公司並無併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券之情事，且前次現金增資計畫已執行完畢，並無經重大變更且尚未完成者，故不適用本項評估。

- 三、計畫實際完成日距申報時未逾三年之前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫已完成者之原預計效益是否顯現，如執行效益未達預計目標者，應具體評估其原因之合理性及對股東權益之影響

該公司截至本評估報告出具日止，尚無併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價債券之情事，而前各次募集與發行有價證券計畫實際完成日距本次現金增資案申報日已逾三年，故不適用本項評估。

- 四、曾發行公司債或舉借長期債務者，是否均如期還本付息，其契約對公司目前財務、業務或其他事項之重大限制條款，並說明最近期及最近二個會計年度有無財務週轉困難情事

經參閱該公司最近期及最近二個會計年度經會計師查核簽證之財務報告、董事會議事錄、股東會議事錄及公開資訊觀測站資訊，截至評估報告出具日止，該公司未曾發行公司債且無長期債務。

- 五、是否確實依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理資訊公開



經參閱該公司最近二年度及 113 年截至評估報告出具日止之董事會議事錄、股東會議事錄及公開資訊觀測站資訊，截至評估報告出具日止無辦理私募有價證券之情事，故不適用本項評估。

伍、就本次募集與發行有價證券之適法性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

一、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款所列之情事，如有，則應就其事項性質依附表九之一中所列事項詳與評估對發行人財務狀況之影響及是否影響本次有價證券募集及發行

該公司本次係依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第三款之規定，辦理現金增資發行新股以供辦理初次上市前公開承銷之用，非屬同準則第六條第二項第一款或第四款所列發行新股之情事，故不適用同準則第十三條第一項第二款所列情事之評估。

二、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條及第八條所列之情事

(一)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條所列情事之承銷商審查意見

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
1. 簽證會計師出具無法表示意見或否定意見之查核報告者。		√		經參閱該公司 111~112 年度經會計師查核簽證之財務報告，並無出具無法表示意見或否定意見之查核報告，故無左列情事。
2. 簽證會計師出具保留意見之查核報告，其保留意見影響財務報告之允當表達者。		√		經參閱該公司 111~112 年度經會計師查核簽證之財務報告，並無出具無法表示意見或否定意見之查核報告，故無左列情事。
3. 發行人填報、簽證會計師複核或主辦證券承銷商出具之案件檢查表，顯示有違反法令或公司章程，致影響有價證券之募集與發行者。			√	該公司本次係辦理現金增資發行新股作為創新板初次上市前公開承銷之用，依法令規定無須檢附發行人填報、簽證會計師複核或主辦證券承銷商出具之案件檢查表，故不適用。
4. 律師出具之法律意見書，表示有違反法令，致影響有價證券之募集與發行者。		√		經參閱律師對本次現金增資發行新股出具之法律意見書及法律事項檢查表，並未發現該公司有違反法令，致影響有價證券募集與發行之情事。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
5. 證券承銷商出具之評估報告，未明確表示本次募集與發行有價證券計畫之可行性、必要性及合理性者。		√		本承銷商已對本次募集與發行有價證券計畫明確表示計畫之可行性及合理性，另本次係辦理現金增資發行新股以供創新板初次上市前公開承銷之用，屬「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第三款所列之案件，依同準則第八條第三項規定，得不適用關於募集資金計畫必要性之評估。綜上，本次募集與發行有價證券計畫並無左列情事，詳細內容請參閱評估報告「陸、本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性」說明。
6. 經金融監督管理委員會退回、撤銷、廢止或自行撤回其依「發行人募集與發行有價證券處理準則」申報(請)案件，發行人自接獲金管會通知即日起三個月內辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項規定之案件者。但本次辦理合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股者，不在此限。		√		經檢視該公司董事會議事錄及與金管會往來函文，該公司最近三個月內並無經金融監督管理委員會退回、撤銷、廢止或自行撤回其依「發行人募集與發行有價證券處理準則」申報(請)案件之情事。
7. 申報現金增資或發行公司債案件，直接或間接赴大陸地區投資金額違反經濟部投資審議委員會規定者。但其資金用途係用於國內購置不動產、廠房及設備並承諾不再增加對大陸地區投資，不在此限。		√		經檢視該公司 111~112 年度及 113 年截至送件日止董事會議事錄及經會計師查核簽證之財務報告，截至評估報告出具日止該公司並無直接或間接赴大陸地區投資，故無左列情事。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
8. 上市、上櫃公司或興櫃股票公司未依本法第十四條之六第一項規定設置薪資報酬委員會或未依相關法令規定辦理，情節重大者。		√		經檢視該公司董事會議事錄，並至公開資訊觀測站查詢該公司重大訊息公告，該公司已依法設置薪資報酬委員會，並依相關法令規定訂定組織規程及委任薪資報酬委員，並召開薪資報酬委員會，故無左列情事。
9. 未依公司法第一百七十七條之一第一項但書規定將電子方式列為表決權行使管道之一者。		√		經檢視該公司公司章程，該公司已依左列規定將電子方式列為表決權行使管道之一。
10. 違反或不履行申請股票上市或在證券商營業處所買賣時之承諾事項，情節重大者。		√		經檢視該公司申請股票創新板上市時之聲明書，並未發現該公司有違反或不履行申請股票上市或在證券商營業處所買賣時之承諾事項，情節重大之情事。
11. 經金管會發現有違反法令，情節重大者。		√		經查閱該公司 111~112 年度及 113 年截至評估日止之董事會及股東會議事錄、與主管機關往來函文、金管會證期局公告裁罰案件資訊及律師法律意見書，並無左列情事。

(二)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第八條所列情事之承銷商審查意見

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
1. 申報年度及前二年度公司董事變動達二分之一，且其股東取得股份有違反本法第四十三條之一者。但於申報日前已完成補正者，不在此限。		√		經檢視該公司 111~112 年度及 113 年截至評估報告日止之變更事項登記卡、董事會及股東會議事錄，該公司並無左列之情事。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
2. 上市或上櫃公司有本法第一百五十六條各款情事之一者。但依本法第一百三十九條第二項規定限制其上市買賣者，不在此限。				
(1) 發行該有價證券之公司遇有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產。		√		經查閱該公司 111~112 年度及 113 年截至評估日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證之財務報告、與主管機關往來函文，並參閱律師出具之法律意見書及該公司之聲明書，未發現該公司有訴訟或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產之情事。
(2) 發行該有價證券之公司，遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計畫之重要內容或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大之變更。		√		經查閱該公司 111~112 年度及 113 年截至評估日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證之財務報告、現行有效之重大契約，並參閱律師出具之法律意見書及該公司之聲明書，該公司並未遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計畫之重要內容或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大變更之情事。
(3) 發行該有價證券公司之行為，有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格。		√		經檢視該公司 111~112 年度經會計師查核簽證之財務報告、主管機關往來函文、並參閱律師出具之法律意見書及該公司之聲明書，並未發現該公司有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格之情事。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
(4) 該有價證券之市場價格，發生連續暴漲或暴跌情事，並使他種有價證券隨同為非正常之漲跌。		√		經查詢櫃檯買賣中心網站所公告之興櫃股票股價異常達通知公告，該公司申報日前一個月間並無發生連續暴漲或暴跌之情事。
(5) 發行該有價證券之公司發生重大公害或食品藥物安全事件。		√		經查閱該公司 111~112 年度及 113 年截至評估日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證之財務報告、主管機關往來函文，並參閱律師出具之法律意見書及該公司之聲明書，該公司並未有發生重大公害或食品藥物安全事件之情事。
(6) 其他重大情事。		√		經查閱該公司 111~112 年度及 113 年截至評估日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證之財務報告、主管機關往來函文，並參閱律師出具之法律意見書及該公司之聲明書，尚未發現該公司有其他重大情事，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。
3. 本次募集與發行有價證券計畫不具可行性、必要性及合理性者。		√		該公司本次係辦理現金增資發行新股以供創新板初次上市前公開承銷之案件，屬「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第三款所列之案件，依同準則第八條第三項規定，得不適用關於募集資金計畫必要性之評估。 另本次募集與發行有價證券之計畫確具可行性及合理性，請參閱本評估報告「陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性」之說明。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
4. 前各次募集與發行及私募有價證券計畫之執行有下列情事之一，迄未改善者：				
(1) 無正當理由執行進度嚴重落後，且尚未完成。		√		經查詢該公司前各次募資與發行有價證券計畫已執行完畢；另該公司並無私募有價證券，請參閱本評估報告「肆、就發行人前各次募集與發行有價證券計畫之執行情形」之說明。
(2) 無正當理由計畫經重大變更者。但計畫實際完成日距申報時已逾三年，不在此限。		√		經查詢公開資訊觀測站，及查閱該公司董事會及股東會議事錄，該公司前各次募集與發行有價證券計畫，並無重大變更情形。
(3) 募集與發行有價證券計畫經重大變更，尚未提報股東會通過。		√		經檢視該公司董事會及股東會議事錄，前各次募集與發行有價證券並無募集與發行有價證券計畫經重大變更之情事，故不適用左列事項之評估。
(4) 最近一年內未確實依第九條第一項第四款至第九款及發行人募集與發行海外有價證券處理準則第十一條規定辦理。		√		經查閱該公司與主管機關往來函文、公開說明書、董事會及股東會議事錄，並查詢公開資訊觀測站之募資計畫執行專區，並未發現該公司最近一年內有未確實依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第四款至第九款之情事；且該公司最近一年內並無辦理募集與發行海外有價證券，故未有左列情事。
(5) 未確實依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理，情節重大。			√	經查閱該公司董事會及股東會議事錄、該公司出具之聲明書，參閱律師出具之法律意見書，並查詢公開資訊觀測站私募專區，該公司並無辦理私募有價證券之情事。
(6) 未能產生合理效益		√		該公司並無前次募集與發行有價證

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
且無正當理由。但計畫實際完成日距申報時已逾三年，不在此限。				券計畫之執行未能產生合理效益且無正當理由之情事，詳請參閱本評估報告「肆、就發行人前各次募集與發行有價證券計畫之執行情形」之說明。
5. 本次募集與發行有價證券計畫之重要內容(如發行辦法、資金來源、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益等)未經列成議案，依公司法及章程提董事會或股東會討論並決議通過者。		√		該公司本次辦理創新板上市前現金增資計畫之重要內容已列成議案，業經 113 年 2 月 27 日之董事會討論並決議通過。
6. 非因公司間或與行號間業務交易行為有融通資金之必要，將大量資金貸與他人，迄未改善，而辦理現金增資或發行公司債者。		√		經查閱該公司 111~112 年度及 113 年截至評估報告出具日止經會計師查核簽證之財務報告、董事會議事錄及股東會議事錄，並未發現該公司有非因公司間或行號間業務交易行為有融通資金之必要，將大量資金貸與他人，迄未改善，而辦理現金增資或發行公司債者。
7. 有重大非常規交易，迄未改善者。		√		經查閱該公司 111~112 年度及 113 年截至評估日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證之財務報告及該公司之聲明書，截至評估日止，並未發現該公司有重大非常規交易之情事。
8. 持有具流動性質之金融資產投資、閒置性資產或投資性不動產而未有處分或積極開發計畫，達最近期經會計師查核簽證之財務報告歸屬於母公司業主之權益之百分之			√	該公司本次係依照「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第三款之規定，辦理現金增資發行新股供辦理創新板上市前公開承銷之用，依同準則第八條第四項規定，得不適用左列評估。



審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
四十或本次申報現金增資或發行公司債募集總金額之百分之六十，而辦理現金增資或發行公司				
債者。但所募得資金用途係用於購買不動產、廠房及設備或用於合併非以買賣有價證券為主要業務之公司，且有具體募資計畫佐證其募集資金之必要性，不在此限。				
9. 本次現金增資或發行公司債計畫之用途為轉投資以買賣有價證券為主要業務之公司或籌設證券商或證券服務事業者。			√	經檢視該公司 113 年 2 月 27 日董事會議事錄，該公司本次現金增資計畫之資金用途係為充實營運資金，非為轉投資以買賣有價證券為主要業務之公司或籌設證券商或證券服務事業者，故不適用左列事項之評估。
10. 不依有關法令及一般公認會計原則編製財務報告，情節重大者。		√		經檢視該公司 111~112 年度經會計師查核簽證之財務報告，該公司係依相關法令及一般公認會計原則編製財務報告，並無發現左列情事。
11. 違反第五條第二項規定情事者。		√		經取具該公司之聲明書，該公司承諾將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五條第二項規定辦理。
12. 內部控制制度之設計或執行有重大缺失者。		√		該公司業依規定委請會計師就內部控制制度之設計與實際運作情形進行專案審查，經取具會計師無保留意見之內部控制制度審查報告，其內部控制制度及內部稽核制度應已健全建立並有效執行，該公司內部控制制度之設計及執行尚無發現重大異常之情事。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
13. 申報日前一個月，其股價變化異常者。		√		經查詢櫃檯買賣中心網站所公告之興櫃股票股價異常達通知公告，該公司申報日前一個月間並無股價變化異常情事。
14. 公司全體董事或監察人持股有下列情形之一者：				
(1) 違反本法第二十六條規定，經通知補足持股尚未補足。		√		該公司業已設置審計委員會取代監察人，故不適用左列監察人持股規定，另經查閱最近一個月公開資訊觀測站「董監事持股餘額明細資料」、「董事、監察人持股不足法定成數彙總表」與主管機關之往來函文，該公司全體董事尚無持股不足或經金管會通知補足持股而尚未補足之情事。另經查閱該公司截至 113 年 2 月底止，全體董事之持股總數為 4,343,725 股，占該公司實收資本額 26,810,000 股之 16.20%，符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，故無左列情事。
(2) 加計本次申報發行之股份後，未符本法第二十六條規定。但經全體董事或監察人承諾於募集完成時，補足持股，不在此限。		√		該公司已發行股數為 26,810,000 股，加計本次現金增資發行股數 2,616,000 股，預計增資後股數為 29,426,000 股；截至評估報告出具日止，全體董事持股總數為 4,343,725 股，增資後全體董事持股比率 14.76%，仍符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，尚無左列情事。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
(3) 申報年度及前一年度公司全體董事或監察人未依承諾補足持股。			√	經檢視該公司 112 年度及 113 年截至評估報告日止，該公司與主管機關往來函文，並至公開資訊觀測站公司查詢董事、監察人持股不足法定成數彙總表資訊，未發現該公司有受主管機關通知應補足持股之情事，故不適用左列事項之評估。
15. 發行人或其現任董事長、總經理或實質負責人於最近三年內，因違反本法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法等工商管理法律，或因犯貪污、瀆職、詐欺、背信、侵占等違反誠信之罪，經法院判決有期徒刑以上之罪者。		√		經參閱律師出具之法律意見書、該公司 111~112 年度及 113 年截至評估日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證之財務報告，並取具該公司及董事長暨總經理出具之聲明書，並無左列情事。
16. 因違反本法，經法院判決確定須負擔損害賠償義務，迄未依法履行者。		√		經參閱律師出具之法律意見書、該公司 111~112 年度及 113 年截至評估日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證之財務報告，並取具該公司之聲明書，該公司並無左列情事。
17. 為他人借款提供擔保，違反公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第五條規定，情節重大，迄未改善者。		√		經參閱該公司 111~112 年度及 113 年截至評估日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證之財務報告及該公司之聲明書，該公司並無左列情事。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
<p>18.合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股者，而有下列情形之一：</p> <p>(1) 違反本會公開發行公司取得或處分資產處理準則第二章第五節之規定，情節重大。</p> <p>(2) 受讓或併購之股份非為他公司新發行之股份、所持有非流動之股權投資或他公司股東持有之已發行股份。</p> <p>(3) 受讓之股份或收購之營業或財產有限制買賣等權利受損或受限制之情事。</p> <p>(4) 違反公司法第一百六十七條第三項及第四項之規定。</p> <p>(5) 被合併公司最近一年度之財務報告非經會計師出具非無保留意見之查核報告。但經出具保留意見之查核報告，其資產負債表經出具無保留意見，不在此限。</p>			√	該公司本次辦理現金增資發行新股，係供創新板初次上市前公開承銷之用，非屬合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股者，故不適用左列評估事項。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
<p>19. 有第十三條第一項第二款第六目規定之情事，且有下列情形之一：</p> <p>(1) 申報現金發行新股，公司董事、監察人及持有股份超過股份總額百分之十之股東未承諾將一定成數股份送交證券集中保管事業保管。</p> <p>(2) 申報發行轉換公司債或附認股權公司債，未於發行辦法明定應募人應自前揭公司債發行日起將公司債及嗣後所轉換或認購之股份送交證券集中保管事業保管一年。</p>			√	該公司本次係辦理現金增資發行新股，作為創新板初次上市前辦理公開承銷之股份來源，屬「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第三款募集與發行有價證券，非屬「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第一款或第四款，故不適用左列之評估。
<p>20. 證券承銷商於發行人申報時最近一年內經金管會、證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及中華民國證券商業同業公會處記缺點累計達十點以上，且自被處記缺點累計達十點之日起未逾三個月。但發行人辦理現金發行新股為初次上市、上櫃公開銷售者，不在此限。</p>			√	本證券承銷商於該公司申報時最近一年內並未經金融監督管理委員會、證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及中華民國證券商業同業公會處記缺點累計達十點以上之情事。且本案係屬興櫃股票公司辦理現金發行新股為創新板初次上市公開銷售者，故不適用左列之評估。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
21. 其他本會為保護公益認為有必要者。		√		經檢視該公司與主管機關之往來函文，並未發現有左列情事。

綜上所述，該公司本次申報辦理現金增資發行新股案件並無違反「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條及第八條各款所列之情事。

二之一、總括申報發行新股案件者，是否符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十九條之一及十九之二所列情事

截至本評估報告出具日止，該公司尚屬興櫃公司，非為上市或上櫃公司，且該公司本次辦理現金增資發行普通股係供申請初次創新板上市公開承銷之用，故不適用本項評估。

三、是否符合中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定

茲就「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第壹章總則及第貳章現金增資普通股之相關條文評估說明如下：

條次	自律規則條款	說明
第一條	為推動有價證券之發行，並保障投資，除其他法令另有規定外，本公會承銷商會員輔導發行公司或外國發行人辦理募集與發行有價證券事宜時應遵守本自律規則。	本承銷商辦理該公司募集與發行有價證券相關事宜，謹遵守本自律規則辦理。
第二條	承銷商輔導發行公司或外國發行人募集與發行有價證券時，主辦承銷商與發行公司或外國發行人間不得有下列情事： 一、任何一方與其母公司、母公司之全部子公司，合計持有對方股份總額百分之十以上者。 二、任何一方與其子公司派任於對方之董事，超過對方董事總席次半數者。 三、任何一方董事長或總經理與對方之董事長或總經理為同一人，或具有配偶、二親等以內親屬關係者。 四、任何一方股份總額百分之二十以上之股份為相同之股東持有者。 五、任何一方董事或監察人與對方之董事或監察人半數以上相同者。其計算方式係包括該等人員之配偶、子女及具二親等以內之親屬關係者在內。 六、任何一方與其關係人總計持有他方已發行股份總額百分之五十以上者。但證券承銷商為金融機構或金融控股公司之證券子公司時，如其母公司、母公司之全部子公司總計持有發行公司股份未逾發行公司已發行股份總額百分之十，且擔任發行公司董事或監察人	經查本承銷商與該公司間並無左列各款之情事，且雙方亦已出具聲明書，聲明並無左列情事，故符合左列條文之規定。

條次	自律規則條款	說明
	<p>席次分別未逾三分之一者，不在此限。</p>	
	<p>七、雙方依相關法令規定，應申請結合者或申報後未經公平交易委員會禁止結合者。</p> <p>八、其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者，致有失其獨立性之情事者。</p> <p>發行公司或外國發行人發行普通公司債及未涉及股權之金融債券，如銷售對象僅限於證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人，其主辦承銷商得不受前項規定之限制，發行公司或外國發行人如具證券承銷商之資格者，亦得擔任主辦承銷商。</p> <p>本條所稱母公司及子公司，應依證券商財務報告編製準則規定認定之。</p>	



條次	自律規則條款	說明
第二條之一	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人募集與發行有價證券應取得填報檢查表並出具法律意見書之律師，於最近一年內未受法務部律師懲戒委員會懲戒，且不得與發行公司或外國發行人、會計師及證券商具有下列關係之聲明書：</p> <p>一、財務會計準則公報第六號規定之關係人關係。</p> <p>二、其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者。</p> <p>依發行人募集與發行海外有價證券處理準則或外國發行人募集與發行有價證券處理準則規定出具海外存託憑證、海外股票或海外公司債發行辦法與行政院金融監督管理委員會同意生效內容無重大差異意見書中文本之律師，亦應符合前項之規定。</p>	<p>經取得律師填報之檢查表及出具之法律意見書，並無左列各項之情事。</p>
第三條	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人募集與發行有價證券，應於向本公會申報承銷契約副本時，檢送有關承銷商與發行公司或外國發行人於向金管會或其委託之機構申報案件至繳款截止日止，其相關宣傳或資訊揭露應以公開說明書所載內容為限之聲明書；總括申報追補發行新股案件，前開聲明書之聲明期間為自承銷商出具評估總結意見之日起至繳款截止日止，承銷商並應複核發行公司或外國發行人有無違反前開規定。</p> <p>前項聲明書之聲明事項，應增列有關不得對特定人或不特定人說明或發布除依金管會「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」辦理公告之財務預測資訊內容以外之其他財務業務預測性資訊。</p>	<p>本承銷商將依規定於向公會申報承銷契約副本時，檢送左列規定之聲明書。</p>
	<p>經主管機關依證券交易法第二十二條第一項核定免向金管會申報生效者，第一項聲明書之聲明期間以向金管會申請案件至繳款截止日止。</p>	

條次	自律規則條款	說明
第四條	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券(員工認股權憑證除外),加計其前各次(含其所私募者)上述有價證券流通在外餘額依各別轉換(認購)價格設算轉換(認購)後所增加之股數,不得逾已發行股數之百分之五十。</p> <p>發行公司或外國發行人以已發行之股份做為轉換(認購)之用者,其做為轉換(認購)用之已發行股份不列入前項增加股數之計算。</p>	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股,故不適用左列規定。
第四條之一	<p>承銷商輔導發行公司申報發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券,以新發行之股份履行轉換義務或履約者,承銷商應加強輔導發行公司採取股票無實體發行之制度,惟自九十五年七月一日起,上市、上櫃及興櫃股票公司發行股票或公司債應採帳簿劃撥交付,不印製實體方式為之。</p> <p>承銷商輔導外國發行人募集與發行有價證券之交付,除外國發行人註冊地國另有規定外,應以帳簿劃撥方式為之。</p>	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股,故不適用左列規定。
第四條之二	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券,應注意發行公司之發行與轉換(認購)辦法中應訂明「自發行公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起,至權利分派基準日止,辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止,辦理股票變更面額之停止轉換(認購)起始日至新股換發股票開始交易日前一日止,不得請求轉換(認購)」規定;另應注意避免現金增資認股停止過戶日前十五個營業日、股票變更面額之停止轉換(認購)起始日起暫停轉換(認購)期間與前各次具轉換(認股、交換)有價證券到期日前之停止轉換(認股、交換)期間接續,及已發行流通在外之轉換公司債其轉換股份時先交付股票再辦理變更登記者,如遇普通股除息、除</p>	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股,故不適用左列規定。

條次	自律規則條款	說明
	<p>權或現金增資認股時，應符合證交所「營業細則」及櫃檯中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第十條有關二階段公告規定。</p>	
	<p>前項變更面額之停止轉換(認購)起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。發行公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換(認購)期間。</p>	
<p>第四條之三</p>	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購、交換)權之各種有價證券，自發行日後屆滿一定期間起，除依法暫停過戶期間外，持有人得依發行人所定之發行及轉換(認股、交換)辦法請求轉換(認股、交換)；但發行公司或外國發行人為未上市(櫃)、未登錄興櫃之公開發行公司者，轉換(認股、交換)期間自發行日後屆滿一定期間至到期日前十日止為限。</p> <p>前項所稱一定期間不得少於三個月，並應由發行人或外國發行人於轉換(認購、交換)辦法中訂定之。</p>	<p>該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列規定。</p>
<p>第四條之四</p>	<p>刪除</p>	<p>-</p>

條次	自律規則條款	說明
第四條之五	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具股權轉換(交換、認購)性質之各種有價證券，應就發行年期、發行價格、贖回時點、轉換溢價率、收益率、賣回時點、擔保狀況、分券狀況等因素綜合評估其發行條件訂定之合理性。</p> <p>對於發行條件顯不相當者，承銷商應輔導發行公司或外國發行人於重新合理訂定發行條件後，再行送件。</p>	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
第四條之六	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行海外有價證券，其按發行價格計算之發行金額，應高於二千萬美元。但發行公司確有外幣需求或外國發行人確有特殊需求，且發行條件合理者，不受此限。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
第四條之七	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換(認購)辦法中應訂明發行公司或外國發行人依發行與轉換(認購)辦法所定反稀釋調整公式計算其調整後轉換價格時，其公式中之已發行股數應加計已私募股數。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列規定。

條次	自律規則條款	說明
	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人申報（請）發行具有普通股轉換（認購）權之各種有價證券，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換（認購）辦法中應訂明發行公司或外國發行人發行具有普通股轉換（認購）權之各種有價證券後，除發行公司或外國發行人所私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份者外，發行公司或外國發行人遇有私募普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價之轉換或認股價格再私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時，發行公司或外國發行人應比照該發行與轉換（認購）辦法所定於遇有已發行普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價之轉換或認股價格再發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時之轉換價格調整公式，計算其調整後轉換價格（向下調整，向上則不予調整）並函請證交所或櫃檯買賣中心公告，於私募有價證券交付日調整之。</p> <p>依第二項計算調整後轉換價格時，如須訂定每股時價，應以私募有價證券交付日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。</p>	
第四條之八	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具股權轉換（交換、認購）性質之各種有價證券，公開說明書中應充分揭露當次發行有價證券之發行條件及該發行條件對股權稀釋、股東權益之影響。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列規定。

條次	自律規則條款	說明
第四條之九	<p>除上市(櫃)公司、興櫃公司辦理現金增資發行普通股採公開申購配售辦理案件外，發行公司或外國發行人得先行印製價格以區間方式揭露之公開說明書寄交投資人，並於該公開說明書封面顯著處註明提醒投資人上網查詢、參閱承銷商配售通知之實際承銷價格並依承銷商之通知繳交價款。承銷商應注意交寄當日發行公司或外國發行人須將該公開說明書電子檔傳送至金管會指定之網站，另價格確定後二日內須將完整公開說明書電子檔傳送至金管會指定之網站。</p> <p>第一項公開說明書上揭露之價格區間應與承銷商辦理詢價公告之預計承銷價格之可能範圍一致。</p>	<p>該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，本承銷商於辦理公開承銷時將依左列規定辦理。</p>
第四條之十	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有股權轉換(認購、交換)性質之各種有價證券，應注意發行與轉換(認購、交換)辦法中應訂明下列事項：</p> <p>一、債券到期還本付息之款項支付日。</p> <p>二、發行條件中包含債券持有人之賣回權者，應訂明行使賣回權之款項支付日。</p> <p>三、發行條件中包含發行公司之收回權者，應訂明行使收回權利之款項或有價證券交付日。</p> <p>四、發行條件中包含交換權者，應訂明投資人行使交換權之有價證券交付日。</p>	<p>該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列規定。</p>
第四條之十一	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具股權性質之各種公司債，應注意發行公司或外國發行人應依財務會計準則公報第 34 及 36 號規定設算應負擔年息總額是否符合公司法第 249 條第 2 款及第 250 條第 2 款之規定。</p>	<p>該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列規定。</p>

條次	自律規則條款	說明
第四條之十二	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應輔導發行公司或外國發行人於申報案件時出具承諾書，承諾自申報日起至該有價證券掛牌後三個月內不得買回該公司股份。</p> <p>現金增資發行新股案件，前項承諾書應承諾自申報日起至股票掛牌後一個月內不得買回本公司股份。</p> <p>總括申報發行新股案件，第一項承諾書應承諾首次發行自申報日起及各次追補發行自承銷商出具評估總結意見之日起，至股票掛牌後一個月內不得買回本公司股份。</p>	<p>該公司本次係創新板初次上市前現金增資發行普通股，已出具承諾書承諾自申報案件日起至該有價證券掛牌後一個月內不得買回該公司股份。</p>
第四條之十三	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募集人民幣計價海外公司債時，應輔導發行公司或外國發行人於申報案件時出具承諾書及到期償債資金來源之計畫，承諾海外募得人民幣資金係供海外營運實體使用，不得以任何方式匯回臺灣。</p>	<p>該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，非屬申報募集以人民幣計價之海外公司債，故不適用左列規定。</p>
第四條之十四	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應輔導發行公司或外國發行人於公開說明書記載發行公司、發行公司之董事、監察人、總經理、財務長以及與發行公司辦理募資案件有關之經理人、受僱人，絕無要求或收取承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予發行公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等之聲明書，並依「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」編製公開說明書及簡式公開說明書，且於申報募資案件及向本公會申報承銷契約前，檢核上傳之公開說明書電子檔已確實用印且內容具完整性。</p>	<p>該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，謹遵左列規定事項辦理。</p>

條次	自律規則條款	說明
第四條之十五	<p>承銷商輔導外國發行人辦理申報「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第一項第一款至第三款募資案件時，應於募集完成年度及其後二個會計年度，協助其遵循中華民國證券相關法令。</p> <p>承銷商輔導有重要子公司位於中國大陸之外國發行人辦理申報募資案，應輔導外國發行人於申報案件時出具承諾書，承諾應將在臺所募資金存放於台資銀行或其海外子（分）行並依計劃支用。承銷商並應將前揭資金控管情形納入每季之募資計畫執行情形併予評估。</p> <p>承銷商依前項輔導外國發行人申報在臺募集與發行公司債案件，擔保銀行及受託銀行限於在我國設有營業據點之銀行。</p>	該公司非屬外國發行人，故不適用左列規定。
第四條之十六	承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應就發行公司或外國發行人之財務業務狀況製作檢查表，並於發行公司或外國發行人向金管會申報案件前五個營業日，向證交所或櫃買中心申報。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列之規定。
第四條之十七	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換（認購、交換）權之各種有價證券，若發行條件中訂有收回條款者，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換（認股、交換）辦法中應訂明債券持有人請求轉換（認股、交換）之最後期限為終止櫃檯買賣日後第二個營業日。	該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列之規定。
第四條之十八	承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應將發行公司或外國發行人辦理永續發展相關事項納入輔導評估流程，並協助其依規定於公開說明書揭露推動永續發展相關事項。	該公司本次辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，本承銷商已將該公司辦理永續發展相關事項納入輔導評估流程，該公司業已依規定於公開說明書揭露推動永續發展相關事項。



條次	自律規則條款	說明
第四條之十九	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報募資案件時，應出具發行公司或外國發行人是否應依中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」，向中國證券監督管理委員會辦理備案之意見。承銷商應取得發行公司之說明意見，且發行公司應出具說明內容無虛偽、隱匿之聲明。	該公司並未於中國境內設有子公司，故不適用左列之規定。
第貳章 現金增資普通股		
第五條	承銷商輔導上市(櫃)公司、創新板上市公司辦理現金增資發行普通股，應於申報案件時出具發行公司或外國發行人之子公司不得參與新股認購之承諾書，如屬總括申報發行新股案件，並應承諾不得參與首次發行及各次追補發行之新股認購。	該公司非為上市(櫃)公司，本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
第五條之一	承銷商輔導上市(櫃)公司、創新板上市公司、興櫃公司、戰略板興櫃公司辦理現金增資發行普通股，如申請延長募集期間且其財務預測無重大變動者，應檢送由發行公司或外國發行人出具經會計師複核之財務預測仍屬有效性聲明書。	本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股案，並未公告財務預測，故不適用左列規定。

條次	自律規則條款	說明
第五條之二	<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人以現金增資發行普通股申請初次上市(櫃)案件、股票申請創新板初次上市案件，除另有規定外，向金管會或其委託之機構申報案件時應以合理之方式訂定暫定價格，如有興櫃交易者，暫定價格不得低於向金管會或其委託之機構申報案件前興櫃(或戰略新板興櫃公司)有成交之十個營業日其成交均價(或戰略新板興櫃公司收盤價)簡單算術平均數之七成；如經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，得採股數區間方式辦理申報，並敘明實際發行價格或股數如有變動，導致募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。</p> <p>承銷商應輔導發行公司或外國發行人於實際發行價格確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。</p> <p>以現金增資發行新股辦理股票初次上市、上櫃、股票申請創新板上市前之承銷案件，主辦承銷商應與發行公司或外國發行人約定，由發行公司或外國發行人協調股東按該次現金增資對外公開銷售之一定比例之已發行普通股股票，供主辦承銷商於承銷期間進行過額配售，並應依本公會「承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」辦理。</p>	<p>該公司本次辦理現金增資發行普通股係供申請創新板初次上市公開承銷之用，謹遵守左列之規定。另本承銷商已與該公司簽訂過額配售協議書，並依「承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」辦理相關作業。</p>

條次	自律規則條款	說明
第六條	<p>承銷商輔導上市（櫃）承銷商輔導上市（櫃）公司、創新板上市公司辦理現金增資發行普通股如採公開申購配售辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之七成。</p> <p>承銷商輔導興櫃公司辦理現金增資發行普通股採公開申購配售辦理承銷，其發行價格除不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值外，應參考向本公會報備承銷契約前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之均價，並應提出合理說明。</p> <p>戰略新板興櫃公司現金增資發行普通股採公開申購配售辦理承銷，其發行價格準用前項規定，惟用以計算之價格採戰略新板興櫃公司股票之收盤價。</p> <p>承銷商輔導發行公司或外國發行人向金管會申報案件時，應載明暫定發行價格及因市場變動實際發行價格須依第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。</p> <p>承銷商應輔導發行公司或外國發行人於實際發行價格確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。</p>	<p>該公司非為上市(櫃)公司，且本次辦理創新板上市前現金增資發行普通股，故不適用左列之規定。</p>
第六條之一	<p>承銷商輔導上市（櫃）公司、創新板上市公司、興櫃公司及戰略新板興櫃公司辦理現金增資發行普通股，如發行公司依證券交易法第二十八條之一第三項規定，決議提撥發行新股總額超過百分之十對外採公開申購配售辦理承銷，其發行價格訂定方式應提報公司股東會。</p>	<p>該公司非為上市(櫃)公司，且本次辦理創新板上市前現金增資發行普通股，故不適用左列之規定。</p>

條次	自律規則條款	說明
第七條	<p>承銷商輔導上市(櫃)公司辦理現金增資發行普通股經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，如採詢價圈購方式辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報詢價圈購約定書及向本公會申報承銷契約時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之九成；如採競價拍賣方式辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報辦理競價拍賣公告時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之九成。</p> <p>承銷商輔導創新板上市公司辦理現金增資發行普通股經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報詢價圈購約定書及向本公會申報承銷契約時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之九成。</p> <p>承銷商輔導戰略新板興櫃公司辦理現金增資發行普通股經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，其發行價格準用第六條第三項規定，惟用以計算之價格採戰略新板興櫃公司股票之收盤價。</p> <p>承銷商輔導發行公司或外國發行人向金管會申報案件時，應載明暫定發行價格、股數區間及因市場變動實際發行價格須依第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。承銷商應輔導發行公司或外國發行人於實際發行價格及股數確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。</p>	<p>該公司非為上市(櫃)公司，且本次辦理創新板上市前現金增資發行普通股，故不適用左列之規定。</p>

條次	自律規則條款	說明
第七條之一	<p>承銷商輔導上櫃(市)公司申請轉上市(櫃)為達股權分散標準辦理現金增資發行新股之承銷案件經股東會決議原股東全數放棄優先認股，採公開申購方式辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報辦理公開申購公告時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成。</p> <p>承銷商輔導發行公司向金管會申報案件時，應載明暫定發行價格、股數區間及因市場變動實際發行價格須依第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。</p> <p>承銷商應輔導發行公司於實際發行價格及股數確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。</p>	<p>該公司非為上市(櫃)公司，且本次辦理創新板上市前現金增資發行普通股，故不適用左列之規定。</p>
第八條	<p>採詢價圈購配售辦理之承銷案件，於承銷契約報本公會前，如發行價格偏離市場價格過大者，應重新辦理詢價，並於詢價後，隨即進行承銷作業。</p> <p>承銷商於向本公會申報承銷契約時，應一併檢送下列資料：</p> <p>一、詢價圈購之相關資料(含詢價期間、詢價範圍、各圈購價格及其圈購股數、詢價公告暫訂發行價格占詢價公告日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之成數等資料)。</p> <p>二、配售原則及預計配售予自然人、法人及本公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第三十六條第一項第一款至第七款有關董事、監察人、大股東、關係人等之股數及配售比率。</p> <p>承銷商於向本公會申報承銷契約後，應隨即辦理承銷公告及相關承銷事宜。</p>	<p>該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股案件，本承銷商係採競價拍賣方式辦理公開，故不適用左列規定辦理。</p>

條次	自律規則條款	說明
第八條之一	承銷商輔導上市(櫃)公司辦理總括申報發行新股案件，準用第六條、第六條之一、第七條及第八條規定。	該公司非為上市(櫃)公司，且本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股案，故不適用左列規定。
第九條	<p>承銷商輔導上市(櫃)公司辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證，其發行價格之訂定方式及依公司法第二百六十七條第一項保留員、工承購股份於員、工未認購時之處理方式，均應列成議案經股東會討論並決議通過。</p> <p>承銷商輔導上市(櫃)公司向金管會申報案件，暫訂發行價格不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之八成。</p> <p>實際發行價格不得低於訂價日收盤價、訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之八成。</p> <p>前項實際發行價格低於九成者，海外存託憑證持有人不得於發行後三個月內請求兌回，承銷商並應輔導上市(櫃)公司於發行計畫及存託契約中載明。</p> <p>創新板上市公司辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案件，前各項規定準用之。</p>	該公司非為上市(櫃)公司及創新板上市公司，且本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行普通股案，故不適用左列規定。

綜上所述，該公司本次申報辦理現金增資發行新股案件符合「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之相關規定，本承銷商本次輔導該公司辦理現金增資發行新股亦將依自律規則之規定辦理。

#### 四、法令之遵循及對公司營運影響

(一)發行人是否符合公司法第一百二十九條、第一百三十條、第一百五十六條第五項、第一百六十七條第三項及第四項、第二百四十六條、第二百四十七條及證券交易法第二十八條之四規定，且無公司法第二百四十九條及第二百五十條、第二百六十九條及第二百七十條規定之情事

有關之法令條款內容	是否符合規定	查核程序及結論
<p>1.公司法第 129 條 發起人應以全體之同意訂立章程，載明下列各款事項，並簽名或蓋章：</p> <p>(1)公司名稱。 (2)所營事業。 (3)採行票面金額股者，股份總數及每股金額；採行無票面金額股者，股份總數。 (4)本公司所在地。 (5)董事及監察人之人數及任期。 (6)訂立章程之年、月、日。</p>	是	經檢視該公司之公司章程，業已於章程明訂左列各款事項。
<p>2.公司法第 130 條 下列各款事項，非經載明於章程者，不生效力：</p> <p>(1)分公司之設立。 (2)解散之事由。 (3)特別股之種類及其權利義務。 (4)發起人所得受之特別利益及受益者之姓名。 前項第四款發起人所得受之特別利益，股東會得修改或撤銷之。但不得侵及發起人既得之利益。</p>	是	經檢視該公司之公司章程，業已載明公司法 130 條第一項第一款事項，且自該公司設立後，尚無解散、發行特別股與發起人所得受之特別利益，故無違反左列規定。
<p>3.公司法第 156 條第 5 項 股東之出資，除現金外，得以對公司所有之貨幣債權、公司事業所需之財產或技術抵充之；其抵充之數額需經董事會決議。</p>	不適用	該公司本次募集與發行有價證券，係現金增資發行普通股，未以現金以外之出資抵充情形，故不適用左列規定。
<p>4.公司法第 167 條第 3 項及第 4 項 被持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司，不得將控制公司之股份收買或</p>	是	經查閱該公司最近期股東名冊及 110~112 年度經會計師查核簽證之財務報告，截至評估報告出具日止，該公司無持有已發行有

有關之法令條款內容	是否符合規定	查核程序及結論
<p>收為質物。</p> <p>前項控制公司及其從屬公司直接或間接持有他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額合計超過半數者，他公司亦不得將控制公司及其從屬公司之股份收買或收為質物。</p>		<p>表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司；且未有直接或間接持有已發行有表決權之股份總數超過半數之公司，故無違反左列規定。</p>
<p>5.公司法第 246 條</p> <p>公司經董事會決議後，得募集公司債。但須將募集公司債之原因及有關事項報告股東會。</p> <p>前項決議，應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意行之。</p>	不適用	<p>該公司本次募集與發行有價證券，係現金增資發行普通股，故不適用左列規定。</p>
<p>6.公司法第 247 條</p> <p>公開發行股票公司之公司債總額，不得逾公司現有全部資產減去全部負債後之餘額。</p> <p>無擔保公司債之總額，不得逾前項餘額二分之一。</p>	不適用	<p>該公司本次募集與發行有價證券，係現金增資發行普通股，故不適用左列規定。</p>
<p>7.證券交易法第 28 條之 4</p> <p>已依本法發行股票之公司，募集與發行公司債，其發行總額，除經主管機關徵詢目的事業中央主管機關同意者外，依下列規定辦理，不受公司法第二百四十七條規定之限制：</p> <p>(1)有擔保公司債、轉換公司債或附認股權公司債，其發行總額，不得逾全部資產減去全部負債餘額之百分之二百。</p> <p>(2)前款以外之無擔保公司債，其發行總額，不得逾全部資產減去全部負債餘額之二分之一。</p>	不適用	<p>該公司本次募集與發行有價證券，係現金增資發行普通股，故不適用左列規定。</p>



有關之法令條款內容	是否符合規定	查核程序及結論
<p>8.公司法第 249 條</p> <p>公司有下列情形之一者，不得發行無擔保公司債：</p> <p>(1)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實已了結者，自了結之日起三年內。</p> <p>(2)最近三年或開業不及三年之開業年度課稅後之平均淨利，未達原定發行之公司債，應負擔年息總額之百分之一百五十。</p>	不適用	該公司本次募集與發行有價證券，係現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
<p>9.公司法第 250 條</p> <p>公司有下列情形之一者，不得發行公司債：</p> <p>(1)對於前已發行之公司債或其他債務有違約或遲延支付本息之事實，尚在繼續中者。</p> <p>(2)最近三年或開業不及三年之開業年度課稅後之平均淨利，未達原定發行之公司債應負擔年息總額之百分之一百者。但經銀行保證發行之公司債不受限制。</p>	不適用	該公司本次募集與發行有價證券，係現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
<p>10.公司法第 269 條</p> <p>公司有下列情形之一者，不得公開發行具有優先權利之特別股：</p> <p>(1)最近三年或開業不及三年之開業年度課稅後之平均淨利，不足支付已發行及擬發行之特別股股息者。</p> <p>(2)對於已發行之特別股約定股息，未能按期支付者。</p>	不適用	該公司本次募集與發行有價證券，係現金增資發行普通股，故不適用左列規定。
<p>11.公司法第 270 條</p> <p>公司有下列情形之一者，不得公開發行新股：</p> <p>(1)最近連續二年有虧損者。但依其事業性質，須有較長準備期</p>	是	經參閱該公司 111 及 112 年度經會計師查核簽證之財務報告，未有連續二年虧損，及未有資產不足抵償債務之情事，故無違反左列之規定。

有關之法令條款內容	是否符合規定	查核程序及結論
間或具有健全之營業計畫，確能改善營利能力者，不在此限。 (2)資產不足抵償債務者。		

綜上，該公司對上述各項應遵循之法令並未有違反情事，故對該公司之營運及本次有價證券之募集與發行應無不利影響。

(二)發行人是否有證券交易法第一百五十六條第一項各款情事

請參閱本評估報告伍、二、(二)、2.之評估說明。

(三)發行人及其現任董事、監察人、持股比例達百分之十以上之大股東、負責人、總經理或實質負責人與從屬公司最近二個會計年度至刊印日止繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件

經查閱該公司 111~112 年度及 113 年截至評估日止之董事會及股東會議事錄、與主管機關往來函文、公開說明書及經會計師查核簽證之財務報告，並參酌蔚中傑法律事務所蔚中傑律師出具之法律意見書，該公司及其上述人等尚無繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟之事件。

(四)發行人或其現任董事、監察人、負責人、總經理或實質負責人最近二個會計年度至刊印日止是否經法院判決有期徒刑以上之罪者

經查閱該公司 111~112 年度及 113 年截至評估日止與主管機關往來函文、經會計師查核簽證之財務報告，並參閱蔚中傑法律事務所蔚中傑律師出具之法律意見書及法律事項檢查表，該公司發行人或其現任董事、監察人、負責人、總經理或實質負責人最近二年度至本評估報告刊印日止，並無經法院判決有期徒刑以上之罪情事。

(五)發行人及其各子公司目前仍有效存續、最近一個會計年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約及其他足以影響投資人權益之重要契約

經取具該公司出具之聲明書，及參閱蔚中傑法律事務所蔚中傑律師出具之法律意見書及法律事項檢查表、檢視該公司存續有效或最近一個會計年度到期之契約列示如下，並詢問該公司相關人員，該公司目前有效存續之重要契約均屬於正常營運所需而簽訂，尚無對該公司營運有重大限制條款而影響投資人權益之情事。

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
授權使用、合作開發	力晶積成電子製(股)公司	101.10.1~	技術授權合約	保密及遵守智慧財產權
授權使用、合作開發	Globalfoundries	105.03~	技術授權合約	保密及遵守智慧財產權
授權使用	無錫華潤矽科微電子	105.07.15~115.07.15	技術授權合約	保密及遵守智慧財產權
授權使用	世界先進(股)公司	105.10.06~	技術授權合約	保密及遵守智慧財產權
授權使用	南方集成電路(香港)有限公司	106.11.07~	技術授權合約	保密及遵守智慧財產權
授權使用	無錫中微愛芯電子	107.06.25~	技術授權合約	保密及遵守智慧財產權

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
授權使用	九齊科技(股)公司	107.08.30~	技術授權合約	保密及遵守智慧財產權
產品開發	廣州粵芯半導體技術有限公司	108.01.03~113.01.03	技術授權合約	保密及遵守智慧財產權
專利專屬授權	晶隼科技(股)公司	108.01.21~	技術授權合約	保密及遵守智慧財產權

資料來源：該公司提供。

(六)發行人及其各子公司是否有重大勞資糾紛或污染環境事件

經取具該公司出具之聲明書，並查閱該公司 111~112 年度及 113 年截至評估日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證之財務報告、與主管機關之往來函文，並參酌蔚中傑法律事務所蔚中傑律師出具之法律意見書，最近二年度及申報年度截至評估報告出具日止，該公司尚無重大勞資糾紛或污染環境事件而對該公司財務業務產生重大不利影響之情事。

(七)發行人之資金用途須經目的事業主管機關同意者，其核准之附帶事項是否有影響本次募集與發行有價證券之情事

該公司本次辦理現金增資發行新股案件，其資金用途係充實營運資金，並無須事先取得目的事業主管機關同意函，故亦無其核准之附帶事項對本次募集與發行有重大影響之情事。

(八)承銷商因前項之評估需要，若有洽請律師出具意見者，應說明事項。

本次並無洽請律師對前項評估出具意見，故不適用。

五、說明發行人委請填報其案件檢查表並出具法律意見書之律師，於最近一年內是否曾受法務部律師懲戒委員會懲戒，且是否與發行公司、最近期財務報告簽證會計師及主辦證券承銷商間具有財務會計準則公報第六號規定之關係人關係或其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者

(一)於最近一年內曾受法務部律師懲戒委員會懲戒。

(二)與發行人、最近期財務報告簽證會計師及主辦證券承銷商間具有下列關係之一：

1. 依主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則所規範之關係人關係。
2. 其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者。

經取具蔚中傑法律事務所蔚中傑律師出具之聲明書，其於最近一年內未曾受法務部律師懲戒委員會懲戒，且未與該公司、最近期財務

報告簽證會計師及本承銷商間具有財務會計準則公報第六號規定之關係人關係，或其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者之關係。

陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

本承銷商依「中華民國證券商業同業公會證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定查核，所獲致結論如下：

一、本次募集與發行有價證券資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益是否具有合理性

(一)本次計畫內容

1.本次計畫所需資金總額：新台幣 196,200 千元。

2.本次計畫資金來源及募集資金不足時處理方式：

(1)現金增資發行新股 2,616 千股，每股面額新台幣 10 元，發行價格暫定為每股新台幣 75 元，預計募集金額為新台幣 196,200 千元。

(2)本次資金運用計畫擬以現金增資發行新股支應，如每股實際發行價格因市場變動而調整，致募集資金不足時，將減少本次計畫金額，若致募集資金增加，則增加之資金亦將用於充實營運資金。

3.計畫項目及預計資金運用進度

單位：新台幣千元

計畫項目	預計完成日期	所需資金總額	預計資金運用進度
			113 年第二季
充實營運資金	113 年第二季	196,200	196,200

資料來源：該公司提供

4.預計可能產生效益

該公司本次辦理現金增資所募得資金 196,200 千元，擬全數用於充實營運資金，將可提高自有資本比率及健全財務結構，對該公司業務成長及整體營運發展應有正面助益。

(二)本次計畫之可行性評估

1.法定程序之可行性

該公司本次辦理上市前現金增資發行新股，業經 107 年 3 月 14 日董事會及 107 年 5 月 30 日股東臨時會決議通過辦理初次上市前現金增資提撥公開承銷案，且於 113 年 2 月 27 日董事會決議通過本次現金增

資股票發行計畫。經核閱本次計畫之內容及決議程序，均符合「公司法」、「證券交易法」、「發行人募集與發行有價證券處理準則」、「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及其他相關法令之規定，另參閱蔚中傑法律事務所蔚中傑律師出具之法律意見書，本次計畫已符合相關法令之規定，故本次計畫於法定程序上應屬適法可行。

## 2. 募集資金完成之可行性

該公司本次辦理現金增資發行新股 2,616 千股，除依公司法第 267 條規定，保留發行股數之 10%，計 262 千股由該公司員工認購外，其餘 2,354 千股則依證券交易法第 28 條之 1 規定，於 107 年 5 月 30 日股東常會決議通過原股東放棄優先認購權利，排除公司法第 267 條第 3 項原股東優先認購之適用。本次辦理創新板初次上市前現金增資發行新股採全數競價拍賣方式辦理，另員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理，應足以確保本次資金募集完成，故本次計畫募集完成應具可行性。

## 3. 資金運用計畫之可行性

該公司本次現金增資募集金額 196,200 千元擬全數用於充實營運資金，可望提高自有資本比率及強化財務結構以因應日後營運成長所需，亦可提升資金調度之彈性，提升整體競爭力，故本次現金增資之募集計畫應具可行性。

綜上所述，該公司本次現金增資發行新股計畫，就其法定程序、資金取得及資金運用計畫等各方面評估均具可行性，故整體而言，其籌資計畫應屬可行。

### (三) 本次計畫之必要性評估

本次辦理現金增資發行新股係依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第 36 條規定，以現金增資發行新股方式委託證券承銷商辦理上市前公開承銷，故依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 8 條第 3 項規定，得不適用有關募集資金計畫必要性之規定。

### (四) 本次計畫之合理性評估

#### 1. 資金運用計畫及預計進度之合理性

該公司本次辦理現金增資發行新股係作為初次上市前公開承銷，預計募得資金總額新台幣 196,200 千元將用於充實營運資金，經考量主管機關審查時間及募集資金所需之作業時程，預計於 113 年第二季完成資金募集作業後，即可依本次計畫挹注該公司營運所需之資金，故本次現金增資之資金運用計畫及預計進度應屬合理。

## 2. 預計可能產生效益之合理性

項目/年度		112 年度 (增資前)	增資後 (預估數)
財務 結構	負債占資產比率(%)	13.60	8.83
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	3,935.29	6,362.83
償債 能力	流動比率(%)	714.20	1,154.74
	速動比率(%)	708.99	1,149.53

資料來源：該公司提供。

註：係以 112 年度經會計師查核之財務數字設算籌資後之財務比率。

該公司本次辦理現金增資發行新股用以充實營運資金，將可強化財務結構並提升償債能力，預計負債比率將由 13.60% 降低至 8.83%，長期資金占不動產、廠房及設備比率自 3,935.29% 提升至 6,362.83%，流動比率自 714.20% 提升至 1,154.74%，速動比率自 708.99% 提升至 1,149.53%，顯見該公司本次籌資計畫不僅得以強化財務結構並提升償債能力，亦能提升資金調度之彈性，提升整體競爭力，對於該公司未來發展具有正面助益，故其本次籌資計畫預計可能產生之效益尚屬合理。

綜上所述，該公司本次辦理現金增資用以充實營運資金，其資金運用計畫、預計進度及預計可能產生之效益應具合理性。

### 一之一、總括申報發行新股案件者，應另就下列事項提供評估說明

該公司本次係辦理初次上市前現金增資發行新股，故不適用本項評估。

### 二、分析比較各種資金調度來源對發行人當年度每股盈餘稀釋、財務負擔、股權之可能稀釋情形及對現有股東權益之影響。發行人如辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款規定之案件，得僅就發行新股對當年度每股盈餘稀釋情形進行評估

該公司本次募資計畫係依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款之規定，以現金增資發行新股辦理初次上市前之公開銷售作業，故僅就發行新股對當年度每股盈餘稀釋情形進行評估。該公司本次辦理現金增資發行新股 2,616 千股，占該公司增資後預計流通在外普通股股數



29,426 千股之 8.89%，考量該公司整體營運及獲利維持穩定成長，且本次辦理現金增資係用於充實營運資金，除可支應該公司營運成長所需資金外，亦能強化財務結構及增加資金調度彈性，對於公司競爭力及整體營運發展具有正面助益，故本次發行新股對該公司當年度每股盈餘之稀釋之影響尚屬有限，應不致對現有股東權益產生重大不利之影響。

三、 本次募集與發行有價證券資金計畫如用於轉投資、償債、充實營運資金、購買營建用地、支付營建工程款、購買未完工程並承受賣方未履行契約者，其必要性及合理性

(一)本次募集與發行有價證券資金計畫如用於轉投資者之評估。

該公司本次募集與發行有價證券資金運用計畫並非用於轉投資，故不適用本項評估。

(二)本次募集與發行有價證券資金計畫如用於償債或用於充實營運資金者之評估。

1. 查閱該公司最近一個會計年度財務報告暨申報年度及預計未來一年度各月份之現金收支預測表，以了解該公司之營業特性、應收帳款收款政策、資本支出計畫與前揭現金收支預測表編製基礎之合理性及與財務預測之關聯性，並分析本次增資計畫對該公司資金需求狀況、資金不足時點與原因相關影響之必要性及合理性。前述現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源、用途及預計效益。

(1)營業特性

該公司主要以 eNVM SIP 之授權及設計服務，其主要客戶為全球各大半導體廠商及 IC 設計公司，客戶群遍及臺灣、美國、中國、日本及韓國等地區，因應該公司客戶端之應用涵蓋範圍相當廣泛，下游應用以微控制器、電源管理 IC、物聯網、中小尺寸面板驅動 IC 為主，終端應用產品則包含資訊設備、車用電子、智慧家電、通訊及消費性電子，皆屬於該公司產品可應用範圍。

SIP 設計服務公司屬於高知識密集產業，位於半導體供應鏈最上游，該公司主要業務為自行研發設計 SIP 模組架構並授權下游客戶，或接受客戶委託開發產品等設計服務，而 SIP 為 IC 設計的智慧財產權，SIP 開發流程包含 SIP 設計與 SIP 驗證，在 IC 設計中，SIP 核心再利用可以有效縮短產品開發週期並降低成本，現今 IC 設計大幅增加了許多功能，因此必須運用既有的驗證有效 SIP 元件，

以滿足上市前置時間的要求。依據工研院產科國際所研究報告，隨著全球人工智慧、物聯網、5G、高效能運算及車用等應用需求持續成長，預估 2023 年全球半導體封測產業市場規模為 362 億美元，半導體產業已逐步回升。整體而言，該公司將持續優化現有成熟製程技術並積極佈局先進製程，研發高精密度之非揮發性元件，另與全球各大晶圓代工廠及 IC 設計公司建立密切合作關係，以挹注業績之成長，經評估該公司未來仍有相當大之成長空間。

以現金流量觀點，該公司主要現金流入為銷貨所產生之應收帳款收現，主要現金流出則為維持日常營運所產生之營業費用等支出，依該公司所編製之 113 年及 114 年各月份預計現金收支預測表，113 年 1~2 月份之實際數，其餘係參考過往年度實際營運狀況、歷史銷售經驗、產業未來趨勢發展、預估接單狀況及公司收付款政策等因素，作為編製申報年度及預計未來一年度各月份之收入與支出之依據，故其編製基礎應尚屬合理。

### (2) 應收帳款收款及應付費用付款政策

應收帳款收款政策方面，係考量客戶之信用情形、財務狀況及過往交易之經驗等因素而予以不同之授信條件，對一般客戶之平均授信條件約為月結 30~90 天。其每月應收款項現數之編制基礎除 113 年 1~2 月份係實際金額外，餘係考量該公司未來預估之銷售情形，並依據上開授信政策，復斟酌過去之歷史往來紀錄，作為預估 113 年 3~12 月及 114 年度各月份現金收支預測表之預算基礎，其編製基礎假設尚屬合理。

應付費用付款政策方面，係依據市場行情及與供應商過往交易之經驗等因素，其付款條件為月結 30~60 天左右。該公司以上述付款條件為基礎，預估 113 年 3~12 月及 114 年度各月份現金收支預測表之預算基礎，其編製基礎假設尚屬合理。

### (3) 資本支出計畫

該公司之資本支出計畫係依未來經營策略及營運發展而定，將視公司業務發展需要並審慎評估後，依公司核決權限執行。該公司 113 及 114 年度各月份現金收支預測表中，資本支出主要係用於研發設計所需之各項軟體，以提升研發品質及研發效率，而前述增添之資本支出所需資金係以自有資金支應，與本次募集資金用途並無直接關聯，其估列應尚屬合理。

(4)現金收支預測表編製基礎之合理性及與財務預測之關聯性

經檢視該公司編製之 113 及 114 年度各月份現金收支預測表，113 年 1~2 月份為實際數，113 年 3~12 月份及 114 年度則為預估數，其預估數係考量產業未來發展趨勢、公司營運狀況、應收帳款政策，以及配合未來銷售情形等因素編製而成，經核對 113 年 1 月之期初現金餘額與 112 年度經會計師查核簽證之財務報表之現金餘額相符，且本次籌資款項之預計現金流入、資金運用進度與本次籌資計畫一致。整體而言，該公司申報年度及預計未來一年度各月份之現金收支預測表編制基礎尚屬合理。

另該公司並無對外公佈 113 年度及 114 年度之財務預測，故不適用現金收支預測表與財務預測之關聯性評估。

(5)本次增資計畫對發行人資金需求狀況、資金不足時點與原因相關影響之必要性及合理性

就該公司編製之 113 及 114 年度各月份現金收支預測表觀之，該公司自有資金尚屬充足，並無明顯資金缺口，惟為配合承銷制度之規定，爰依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第三十六條及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第十七條之一規定，以現金增資發行新股委託證券承銷商辦理公開銷售，故該公司本次現金增資計畫有其必要性及合理性。另該公司本次現金增資募集資金用於充實營運資金，將可增加該公司營運資金調度之靈活度、強化整體財務結構、藉以提升競爭力及降低企業經營風險。

(6)現金收支預測中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源、用途及預計效益

經檢視該公司 113 及 114 年度各月份現金收支預測表中，尚無重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十之情形，故不適用本項評估。

113 年度各月份之現金收支預測表

單位：新台幣千元

項目	1 月份	2 月份	3 月份	4 月份	5 月份	6 月份	7 月份	8 月份	9 月份	10 月份	11 月份	12 月份	合計
期初現金餘額(1)	294,821	299,674	286,750	279,660	242,888	450,083	451,099	455,786	479,783	471,693	476,486	483,830	294,821
加：非融資性收入(2)													0
應收帳款及票據收現	15,372	16,850	12,317	13,008	27,135	14,006	21,047	36,457	15,890	15,453	26,316	14,018	227,869
利息收入/退稅/其他	224	221	230	230	230	610	340	340	340	340	340	610	4,055
合計(2)	15,596	17,071	12,547	13,238	27,365	14,616	21,387	36,797	16,230	15,793	26,656	14,628	231,924
減：非融資性支出(3)													0
應付帳款付現	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
薪資(含獎金及員工酬勞)	5,330	11,416	10,628	5,800	5,800	8,600	5,800	6,000	9,000	6,000	6,000	6,000	86,374
各項費用	5,413	3,410	6,200	6,000	8,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	64,023
董事酬勞	0	0	1,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609
資本支出-軟體	0	2,569	0	0	0	0	5,900	1,800	4,600	0	8,312	0	23,181
資本支出-租賃改良	0	6,278	0	5,685	0	0	0	0	0	0	0	0	11,963
資本支出-辦公、消防設備	0	6,322	1,200	5,715	0	0	0	0	0	0	0	0	13,237
資本支出-儀器設備	0	0	0	0	2,570	0	0	0	2,570	0	0	0	5,140
所得稅	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150	0	0	0	3,150
非融資性支出合計(3)	10,743	29,995	19,637	23,200	16,370	13,600	16,700	12,800	24,320	11,000	19,312	11,000	208,677
要求最低現金餘額(4)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
所需資金總額(5)=(3)+(4)	25,743	44,995	34,637	38,200	31,370	28,600	31,700	27,800	39,320	26,000	34,312	26,000	223,677
融資前可供支用現金餘額(短絀)(6)=(1)+(2)-(5)	284,674	271,750	264,660	254,698	238,883	436,099	440,786	464,783	456,693	461,486	468,830	472,458	303,068
融資淨額(7)													0
現金增資	0	0	0	0	196,200	0	0	0	0	0	0	0	196,200
支付股利	0	0	0	(26,810)	0	0	0	0	0	0	0	0	(26,810)
融資淨額合計(7)	0	0	0	(26,810)	196,200	0	0	0	0	0	0	0	169,390
期末現金餘額(8)=(1)+(2)-(3)+(7)	299,674	286,750	279,660	242,888	450,083	451,099	455,786	479,783	471,693	476,486	483,830	487,458	487,458

114 年度各月份之現金收支預測表

單位：新台幣千元

項目	1 月份	2 月份	3 月份	4 月份	5 月份	6 月份	7 月份	8 月份	9 月份	10 月份	11 月份	12 月份	合計
期初現金餘額(1)	487,458	487,750	517,769	513,960	491,065	519,412	530,041	541,412	575,921	576,159	575,621	591,195	487,458
加：非融資性收入(2)													0
應收帳款及票據收現	17,252	43,579	20,195	31,904	42,007	21,519	30,231	48,569	20,848	15,022	37,046	21,416	349,588
利息收入/退稅/其他	340	340	340	340	340	610	340	340	340	340	340	610	4,620
合計(2)	17,592	43,919	20,535	32,244	42,347	22,129	30,571	48,909	21,188	15,362	37,386	22,026	354,208
減：非融資性支出(3)													0
應付帳款付現	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
薪資(含獎金及員工酬勞)	12,000	6,000	16,008	6,000	9,000	6,000	6,600	6,600	6,600	9,900	6,600	6,600	97,908
各項費用	5,300	5,000	5,000	5,000	5,000	5,500	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	66,800
董事酬勞	0	0	3,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,336
資本支出-軟體	0	2,900	0	0	0	0	6,600	1,800	4,600	0	9,212	0	25,112
資本支出-租賃改良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本支出-辦公、消防設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本支出-儀器設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所得稅	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750	0	0	0	3,750
非融資性支出合計(3)	17,300	13,900	24,344	11,000	14,000	11,500	19,200	14,400	20,950	15,900	21,812	12,600	196,906
要求最低現金餘額(4)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
所需資金總額(5)=(3)+(4)	32,300	28,900	39,344	26,000	29,000	26,500	34,200	29,400	35,950	30,900	36,812	27,600	211,906
融資前可供支用現金餘額(短絀)(6)=(1)+(2)-(5)	472,750	502,769	498,960	520,204	504,412	515,041	526,412	560,921	561,159	560,621	576,195	585,621	629,760
融資淨額(7)													0
現金增資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付股利	0	0	0	(44,139)	0	0	0	0	0	0	0	0	(44,139)
融資淨額合計(7)	0	0	0	(44,139)	0	0	0	0	0	0	0	0	(44,139)
期末現金餘額(8)=(1)+(2)-(3)+(7)	487,750	517,769	513,960	491,065	519,412	530,041	541,412	575,921	576,159	575,621	591,195	600,621	600,621

2.就該公司申報年度財務槓桿、負債比率(或自有資產與風險性資產比率)、營業收入、獲利能力及每股盈餘稀釋等相關影響，了解本次增資計畫之必要性及合理性

該公司本次係辦理現金增資發行新股作為初次上市前公開承銷案件，故不適用必要性之評估，僅針對合理性評估如下：

(1)財務槓桿及負債比率

項目 \ 年度	111 年度	112 年度
財務槓桿度(倍)	1.00	1.00
負債比率(%)	15.92	13.60

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告

財務槓桿度係衡量公司舉債經營之財務風險，評估利息費用之變動對於營業利益之影響程度，若公司未舉債經營，則其財務槓桿度為 1，數值愈高代表公司所承擔之財務風險愈大。該公司 111 年度及 112 年度之財務槓桿度皆為 1.00 倍，足以顯示其利息費用對於該公司之財務風險影響尚屬有限。預計本次辦理現金增資發行新股所募集之資金用於充實營運資金後，將可提升長期資金之穩定性，對該公司之財務槓桿度將可有正面之影響。

負債比率係用以衡量公司財務結構與財務風險，該公司 111 年度及 112 年度之負債比率分別為 15.92% 及 13.60%，預計本次辦理現金增資發行新股用以充實營運資金後，除了降低負債比率外，亦能增加資金靈活調度之彈性，有益於強化該公司財務結構及降低營運風險。

(2)營業收入、獲利能力及每股盈餘稀釋

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	111 年度	112 年度
營業收入	229,420	187,384
本期淨利(損)	72,964	32,017
每股盈餘(元)	2.71	1.19

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告

該公司本次資金用於充實營運資金，除可強化財務結構、提升自有資金比率及償債能力，降低公司經營風險，並維持公司正常營運所需資金靈活調度之彈性，是以本次現金增資計畫對營收成長應有正面之貢獻，此外，該公司本次辦理現金增資發行新股，

預計於 113 年第二季募集完成，目前流通在外股數為 26,810 千股，本次擬發行 2,616 千股，合計 29,426 千股，股本增加比率為 9.76%，雖造成股本膨脹，惟此次所募集之款項用於充實營運資金，將對該公司業績之持續成長有所助益，預計其未來獲利能力尚不致因股本膨脹而對股東權益產生重大不利之影響，故本次辦理現金增資發行新股對該公司每股盈餘稀釋之影響尚屬有限。

綜上所述，該公司本次辦理現金增資發行新股所募資金用以充實營運資金，對其財務槓桿、負債比率、營業收入、獲利能力及每股盈餘稀釋並無重大之不利影響，其募資計畫應具合理性。

(三)本次增資計畫如用於購買營建用地或支付營建工程款者，就預計自購置土地至營建個案銷售完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，並就認列損益之時點與金額，評估可能產生效益是否具有合理性

該公司本次辦理現金增資發行新股之資金計畫係用於充實營運資金，並非用於購買營建用地或支付營建工程款，故不適用本項評估。

(四)本次增資計畫如用於購買未完工程並承受賣方未履行契約者，應評估其賣方轉讓之理由、受讓價格之依據及其合理性，受讓過程是否適法及對契約相對人權利義務之影響

該公司本次辦理現金增資發行新股之資金計畫係用於充實營運資金，並非用於購買未完工程並承受賣方未履行契約之情事，故不適用本項評估。

三之一、本次增資計畫如非以現金出資時，其出資金額之合理性及取得資產之必要性

該公司本次辦理現金增資發行新股係採現金出資方式，故不適用本項評估。

四、本次增資計畫如併同減資計畫辦理者，應評估其可行性與合理性

該公司本次增資計畫並未併同減資計畫辦理，故不適用本項評估。

五、以低於票面金額辦理現金發行新股者，應評估未採用其他籌資方式之原因及其合理性、發行價格訂定方式及對股東權益之影響

該公司本次增資計畫非以低於票面金額辦理現金增資發行新股，故不適用本項評估。

六、發行人向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報募集與發行有價證券，發行辦法依規定採彈性訂定方式者，應評估事項

(一)已上市(櫃)公司辦理現金增資發行普通股原股東未放棄優先認股，採公開申購配售方式辦理承銷者，應載明暫定發行價格及因市場變動實際發行價格須依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，及其適法性及合理性。

該公司本次係辦理現金增資發行新股以供初次上市公開承銷，故不適用本項評估。

(二)已上市(櫃)公司辦理現金增資，經股東會已決議原股東全數放棄優先認購，採全數詢價圈購或競價拍賣方式辦理承銷者，應載明暫定發行價格、股數區間及因市場變動實際發行須依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第七條第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，及其適法性及合理性。及暫定發行股數區間是否符合公司法第一百二十九條第三款規定之情事。

該公司本次係辦理現金增資發行新股以供初次上市公開承銷，故不適用本項評估。

(三)以現金增資發行普通股申請初次上市(櫃)案件向金管會申報案件時應以合理之方式訂定暫定價格，並敘明實際發行價格如有變動，導致募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，其適法性及合理性

該公司於113年2月27日經董事會決議辦理現金增資發行普通股2,616千股，每股面額新台幣10元，暫定每股發行價格為新台幣75元，其係依一般市場承銷價格訂定方式，參考本益比法，以及該公司近一個月之興櫃市場平均成交價等方式，以推算合理之承銷價格。本次現金增資之重要內容，包括但不限於發行價格、發行條件及其他有關事項，如因法律規定或主管機關要求、基於營運評估或客觀環境需予修正變更時，已於113年2月27日董事會授權董事長全權處理，故本次現金增資於法定程序應屬可行。若每股實際發行價格因市場變動而調整，致募集資金不足時，其差額將減少充實營運資金，惟若募集金額高於預計募集資金，增加之部分亦將用於充實營運資金，故其募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，皆具適法性及合理性。

(四)公司債未足額發行者，需就募集資金不足時之處理方式之合理性予以說明。

該公司本次係辦理現金增資發行新股申請股票初次上市案，故不適用本項評估。



七、發行人申報發行人民幣債券者，應審慎評估到期償債資金來源計畫之可行性、必要性及合理性

該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股，故不適用本項評估。

**陸之一、是否確實依規定於公開說明書揭露推動永續發展相關事項**

該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，本承銷商已將該公司辦理永續發展相關事項納入輔導評估流程，該公司業已依規定於公開說明書揭露推動永續發展相關事項。

**柒、就本次附認股權特別股、分離型附認股權特別股分離後之特別股及認股權憑證發行及認股辦法之下列各款之合理性及對原股東及附認股權特別股持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論**

該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，故不適用。

**捌、就本次公司債發行(及轉換)辦法之合理性及對原股東及轉換公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論**

該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，故不適用。

**玖、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債分離後之公司債及認股權憑證發行及認股辦法之合理性及對原股東及附認股權公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論**

該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，故不適用。

**拾、就本次發行公司債債權確保情形(列明有無擔保、擔保品種類與價值等)蒐集資料，說明其查核程序及其實際情形，如為經信用評等機構評等者，取得其相關項目及評等結果**

該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，故不適用。

**拾壹、就本次轉換公司債設算理論價值之各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論**

該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，故不適用。

**拾貳、就本次附認股權公司債、分離型認股權公司債射算理論價值之各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論**

該公司本次係辦理創新板初次上市前現金增資發行新股案件，故不適用。

拾參、就發行人其他必要補充說明事項蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論  
無。

拾肆、於公開說明書刊印日期，如有重大期後事項，亦應查明本要點各相關事項並加以更新說明與評估。

無。

主辦承銷商：兆豐證券股份有限公司



負責人：陳佩君



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 五 日

(註：本用印僅限於億而得微電子股份有限公司一一三年度現金增資案件評估報告使用)

億而得微電子股份有限公司



董事長：黃文謙

